

達航科技股份有限公司 Ofuna Technology Co., Ltd. 公開說明書

(現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用稿本)

一、公司名稱：達航科技股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用稿本。

(一)新股來源：現金增資發行新股。

(二)新股種類：記名式普通股股票，每股面額為新台幣壹拾元整。

(三)股數：已發行股份股數普通股 43,186,998 股，加計本次現金增資股數 5,806,000 股，共 48,992,998 股，擬上櫃掛牌股數為 48,992,998 股。

(四)金額：已發行股份總額新台幣 431,869,980 元，加計本次辦理現金增資新臺幣 58,060,000 元，共計新臺幣 489,929,980 元。

(五)發行條件：

1. 本次現金增資發行新股 5,806,000 股，每股面額新臺幣 10 元，計新臺幣 58,060,000 元。

2. 本次現金增資依公司法第 267 條之規定，保留發行新股總數 15% 計 870,000 股由員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘 85% 計 4,936,000 股，依證券交易法第 28 條之 1 規定及本公司 110 年 7 月 5 日股東會決議通過以現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購權利，不受公司法第 267 條關於原股東按原有股份比例優先認購之規定限制，並全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。

3. 本次現金增資發行新股其權利、義務與原發行之普通股股份相同。

(六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股之 85%，計 4,936,000 股。

(七)承銷及配售方式：奉主管機關核准後，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第 77 頁。

四、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：包含上櫃輔導費及承銷手續等費用，約計新臺幣伍佰萬元整。

(二)上櫃審查費：新臺幣伍十萬元整。

(三)其他費用：包括會計師、律師及印刷等其他費用，約計新臺幣伍佰萬元整。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項(請參閱本公開說明書第 4 頁至第 8 頁)。

八、本公開說明書適用於初次申請股票櫃檯買賣，並計劃以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理上櫃前之公開銷售。

九、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資人應注意交易之風險。

十、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。

十一、查詢本公開說明書之網址：<http://mops.twse.com.tw>



達航科技股份有限公司 編製

中華民國 111 年 5 月 30 日刊印

本公司申請已公開發行普通股上櫃乙案，業經財團法人中華民國櫃檯買賣中心依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心營業處所買賣有價證券審查準則」審查後同意，並以 111 年 3 月 4 日證櫃審字第 1110100376 號函同意俟本次現金增資發行新股公開銷售完畢後，列為上櫃股票。

一、本次發行前實收資本額之來源：

單位：新台幣元；%

資本來源	金額	占實收資本額比率%
設立資本	5,000,000	1.16
現金增資	742,148,000	171.85
盈餘轉增資	246,859,200	57.16
減資分割	(550,000,000)	(127.35)
庫藏股註銷	(15,563,830)	(3.60)
員工認股權增資	3,426,610	0.78
合計	431,869,980	100.00

二、公開說明書之分送計劃：

(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另陳列於本公司以供查閱。

(二)分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之方式辦理規定之方式辦理。

(三)索取方式：請上網至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 查詢及下載。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：康和綜合證券股份有限公司網址：<https://www.concords.com.tw>

地址：台北市信義區基隆路一段 176 號 10 樓電話：(02)8787-1888

名稱：台新綜合證券股份有限公司網址：<https://www.tssco.com.tw/>

地址：台北市中山北路二段 44 號 2 樓電話：(02)2181-5888

名稱：兆豐證券股份有限公司網址：<https://www.megasec.com.tw/>

地址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 3 樓電話：(02)2327-8988

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部

網址：<http://www.concords.com.tw>

地址：台北市基隆路 1 段 176 號 B1

電話：(02)8787-1888

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：楊清鎮會計師、龔則立會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

網址：<https://www.deloitte.com.tw>

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電話：(02)2725-9988

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

律師姓名：鍾元珖律師

事務所名稱：普華商務法律事務所

網址：[ttp://www.pwclegal.com.tw](http://www.pwclegal.com.tw)

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 22 樓 2209 室

電話：(02)2729-5200

十二、發言人及代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱:

發言人姓名：孫逸敏

職稱：管理中心主管

電話：(04)2681-0607

電子郵件信箱：4577@ofunatech.com

代理發言人姓名：劉智鴻

職稱：會計部主管

電話：(04)2681-0607

電子郵件信箱：4577@ofunatech.com

十三、本公司網址：<http://www.ofunatech.com>

本公司之產業、營運及其他重要風險

一、 產業風險

1. 美中貿易關稅壁壘，後疫情時代下，全球經濟環境詭譎多變的風險增加：

自 2019 年美中貿易戰、2020 年新冠肺炎及 2021 年後疫情時期，新冠變種病毒仍持續在全球各地竄流著，導致新冠病毒成為全球經濟發展的不確定性因子，此一總體經濟環境，除了考驗企業的因應能力外、同時，亦攸關企業之決策、指揮及風險管理能力，未來全球的經濟環境將與疫情共存，本公司，則將正視產品的多元化及各區域資源整合的課題。

因應對策

本公司確保供應鏈之穩定性，並加速設備產品的數位化轉型，由於，PCB 製程相當繁瑣，大多仰賴人力操控設備，對比半導體產業已導向高度智慧化設備，PCB 產業所處現況實有難度，但對本公司而言，亦將可發展產品數位化及智慧化之契機，另，後疫情時代，組織資訊溝通屬當前企業環境之重要課題，透過資訊安全之監控管理，本公司將透過雲端及多元的網際網路資訊介面或遠距視訊連線等方式因應。

2. 5G 發展不受限帶動投資熱潮：

2021 年度電子產業，均籠罩在終端產品升級需求強勁的市場氛圍中，再加上，2020 年臺灣半導體產值年成長高達 20.7%，而 IC 載板為晶片模組關鍵元件，致下游各家印刷電路板廠，為了因應 HPC、5G 與 B5G、AI 應用發展，無不加緊擴產計畫，並提高資本支出總額，但對本公司而言，消費性電子產品的推陳出新，縱使，目前下游印刷電路板廠擴增資本投資，一旦遭逢市場景氣驟降時，對設備廠而言，恐將面臨採購訂單瞬間急凍之風險。

因應對策

本公司透過多元產品組合來因應市場景氣的變化，同時，面對市場的競爭，則採取系統性策略因應，藉由本身專精鑽孔工藝，承襲過往對 PCB 高階載板材料應用的經驗，活用鑽孔工藝，使其得以搭載各式材質，以達有效率支援各產業製程上之需求，同時，設立短、中、長期的研發能量，以維持競爭力及企業永續經營的能力。

二、營運風險

1. 原物料短缺及飆漲下，助漲通貨膨脹：

2021 年度原、物料受到美元貶值、通膨風險升高，以及各主要國家採取擴張性貨幣及政治政策等因素的干擾影響下，致原、物料取得面臨短缺或上漲之成本，恐將轉嫁到中、下游廠商的現象。

因應對策

本公司針對客戶及市場需求，應適時進行供應鏈廣度分析，透過在供應鏈中各種可能之接觸點來蒐集數據，必要時，進行數據分析以強化組織決策之能力，使供應鏈系統，得以達到優化管理之目的。

2. 人才確保

隨著高齡化時代來臨，鑽孔設備製造、維護及保養技術，均需仰賴技術及經驗之傳承，由於，近年來，國內技職教育政策及產業結構的變化下，具備設備維修及製造之專業人才短缺，進而造成留才及招聘不易，恐造成人力斷層之影響。

因應對策：

本公司於台灣及日本設置生產基地，以及華東設置售後服務據點，且鑽孔機設備之人工需求，雖非屬高度勞力密集產業，但著重於技術養成，本公司產線技術人員，具備數十年的產業經驗累積，且本公司於台灣及日本分別設立兩個技術團隊，不定時進行雙邊交流，必要時，派遣人員赴日研習，減少面臨人力斷層之風險。

三、其他重要風險

請參閱本公開說明書壹、二、(一)風險事項之說明。

四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項

(一) 貴公司原第一大客戶 C 公司自購進口雷射機台後，即減少雷射加工訂單，致貴公司 110 年前三季雷射加工服務收入較 109 年同期減少 21.17%，有關貴公司面臨客戶自購機台後減少託工訂單之風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

【公司說明】

本公司 110 年前三季較雷射應用服務收入較 109 年同期減少 21.17%，主係因銷售客戶 C 公司設備已到位，致對 C 公司雷射鑽孔加工收入減少，惟對 B 公司之雷射加工收入由 109 年 73,894 千元提高到 110 年度 146,959 千元，適度替補此缺口。

本公司下游印刷電路板廠，如主要代工客戶 C 公司，為因應其客戶多元化之需求進而積極布局雷射鑽孔設備之採購，因此在其產線設備到位後，便逐漸縮減對本公司之雷射應用鑽孔代工訂單之需求，致 110 年前三季對 C 公司之雷射應用(代工)收入較 109 年同期減少 154,158 千元，惟下游印刷電路板廠在擴廠或增購設備時，會依市場需求預估工廠最大產能，因預估的生產數量會受景氣或客戶下單等因素影響而有高低起伏的變化，為降低投資成本及投資風險，在決策時會預留一部分的市場需求由外包商提供產能。例如：C 公司擴廠，仍需由本公司提供部分產能。另下游印刷電路板廠因擴充產能受制於場地、鑽孔設備取得成本及取得之時效性。換言之，下游板廠發現其產能無法滿足客戶需求時，預計建廠從籌建到量產需要 2 至 3 年的時間，若難以尋覓適當土地、設備購買交期延後等因素至建廠時間延後數年，新廠完成前需要的產能將由代工廠補足。例如：C 公司擴廠預計 113 年擴廠完成前預計也有雷射加工需求。

本公司採自製雷射鑽孔機代板廠加工，加工板材材質因產品週期變化快，加工參數條件多樣化，因雷射機為自行設計，機台之性能、特性或設備升級均較同業或板廠快速且更具有彈性。因此，依目前經驗，大型板廠因為其客戶對板材之品質提升或板材變更之要求，板廠自購之機台功能僵化，性能提升速度慢、成本高等因素，而無法及時配合，故選擇本公司為第一優先委外加工廠，尤其是新推出的高階板材、先進製程之加工最為明顯；中小型板廠則因未購置雷射機或雷射機設備老舊，而本公司能機動性因應其板材加工之技術規格、產量的需求，委託代工後，雖無訂定長期合約，但滿足其技術性需求，即成為本公司之長期性客戶。

本公司於雷射鑽孔機開發初期並未將雷射鑽孔設備以銷售方式行銷，主係因雷射鑽孔設備產能有限(本公司子公司日本大船每月產能約 2 臺雷射鑽孔機)，故考慮以代工鑽孔服務為主，並以鑽孔之精準與良率為行銷策略，但近年來，本公司亦已積極投入其他非 PCB 產業族群，透過以租代售方式與半導體、光電及封測產業進行新產品先進製程的開發並已獲得具體實績之肯定，預計 111 年可將雷射鑽孔設備少量銷售。至於 PCB 產業的雷射鑽孔代工服務，有鑑於國內 PCB 板廠多數不具備新產品製程之

主導地位，且短期產能上仍處於瓶頸階段，故本公司未來仍將視市場供需狀況，採長期租賃方式替代設備產銷方式提供服務。

【推薦券商說明】

該公司目前推動與中小型板廠的合作，從客戶技術研發產品階段開始參與，研發成功後，雷射鑽孔的產能列為該企業生產流程的一部份，已陸續有貢獻。經取得該公司與客戶聯繫資料，顯示該公司已與二家客戶目前進行打樣測試中、一家客戶目前仍洽談淘汰舊設備，改為向該公司租賃或加工產品。

另該公司也擴展非 PCB 產業的鑽孔加工，目前該公司已與數家半導體廠、封裝廠在測試高階雷射機的運用，已近成熟中，預計 111 年將對營收有所貢獻。經取得該公司與客戶聯繫資料，顯示該公司 111 年 2 月將提供半導體廠雷射鑽孔機，並進入試產階段；預計 5 月將再可增加提供半導體廠 1 台 UV 雷射機。

臺灣 PCB 廠建廠時，會考量生產數量變動風險，及為降低不景氣來時帶來之衝擊，在相關擴產計劃決策時會保留一定程度之彈性，造成需要有委外加工代鑽孔之情形，另因各產品生產週期及工序需求不一，倘若出現同一時間需要大量鑽孔工序的情形，客戶端亦會出現有產能不足而需委外代工之情況。

綜上評估，該公司面臨客戶自購機台後減少託工訂單之風險及所採具體因應措施尚屬可行。

(二)相較同業已跨足半導體及光電等其他產業，貴公司主要客戶仍集中於 PCB 產業，有關貴公司面臨單一產業銷售風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

【公司說明】

本公司成立於 80 年，過去主要以 PCB 機械鑽孔加工及代理日立維亞鑽孔機的裝機、維修保養等售後服務開始，逐步拓展進入日立維亞鑽孔機的組裝代工，進而因機器設備維修保養及為客戶提升機台性能等需求，於 93 年投入關鍵零組件(主軸)之研發製造，94 年開始量產空氣軸承(AIR BEARING)16 萬轉主軸，95 年成功研發滾珠軸承式(BALL BEARING)6 萬轉主軸及空氣軸承(AIR BEARING)20 萬轉主軸，99 年成功研發空氣軸承(AIR BEARING)30 萬、35 萬轉主軸，另，本公司於 96 年成功開發自有品牌 VELA 成型機搭載自製滾珠軸承式(BALL BEARING)主軸且於 101 年量產 16 萬或 20 萬轉機械鑽孔機、108 年開發成功高階精密機械鑽孔機搭載 30 萬或 35 萬轉主軸，本公司之子公司日本大船亦分別於 106 年度及 107 年度成功開發出 CO2 及 UV 雷射鑽孔機，由於鑽孔設備為 PCB 製程之一環，致本公司主要客戶集中於 PCB 產業為主。本公司與 A 公司、B 公司、C 公司等 PCB 客戶已合作逾 20 年，自初期為前述客戶提供售後維修服務，到目前銷售機械鑽孔機、提供雷射加工或維修保養服務等，皆維持穩定之關係。

但近年來，本公司之雷射應用逐漸跨入非 PCB 產業，透過與半導體產業、光電產業及被動元件產業等客戶之產品開發單位共同合作開發或協助改良製程，提供客製化之 CO2 或 UV 鑽孔機設備，並以客製化的技術支援方式來擴大產品市場滲透率。實際案例說明如下：

(1)半導體業：主要可運用於 Wafer 切割及封裝測試鑽孔製程等。

(2)光電產業：主要可運用於 Mini LED Micro Via 技術。

(3)被動元件產業：主要可運用於陶瓷薄膜之雷射鑽孔加工製程。

綜上，本公司已持續與非 PCB 之客戶接洽，致力拓展 PCB 以外之產業，以降低單一產業銷售風險。另中長期本公司研發技術團隊仍將逐步開發皮秒 (Picosecond，簡稱 PICO， 10^{-12})雷射、飛秒 (Femtosecond Laser，簡稱 FEMTO， 10^{-15})雷射機台，因應不同領域、材質之高階先進製程之加工需求，並積極拓展與其他產業之研發團隊維持密切之合作關係，以增加產品打入供應鏈機會。

【推薦券商說明】

該公司專精鑽孔工藝技術的支援服務，本身擁有自製鑽孔、成型設備及改造設備的能力，可提供 PCB 客戶先進載板製程所需之工藝。近年來，該公司也逐漸拓展多元的雷射微孔技術，以因應光電或半導體等產業之製程需求。受到光電半導體產業近年吸晴產品 OLED、Micro-LED 影響，與其相關之製程技術用雷射源亦跟著發展，例如 Coherent Inc.之 CO₂ 雷射，因其波長特性，200W 之 CO₂ 雷射可用於玻璃切割、PCB 通孔鑽孔；切割 OLED 面板之紫外光皮秒脈衝雷射源，加入感測器與精準光束控制模組，可提供光電半導體產業高速發展之解決方案，該公司最近二年度及 110 年前三季對於非 PCB 產業之營業收入已逐年成長，該公司產品已逐步應用於半導體、光電及其他電子零組件等產業上。

(三)貴公司主要原物料成本近年來節節攀升，其中關鍵零組件主係向國外廠商進口，亦受運費上漲與船期不穩定影響，有關貴公司面臨主要原物料成本上升、關鍵零組件缺料之風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

【公司說明】

本公司雷射鑽孔機、鑽孔機、成型機及相關零組件之主要原物料包含雷射頭、電子掃描鏡、鑄鐵、控制器、螺桿滑軌、線性馬達等，主軸相關素材須具備品質優良、分子穩定性高、材料金相組織一致性高之不鏽鋼、鑄鐵等，均屬長期性物料。本公司主要進貨廠商包含雷射頭供應商甲公司（為全球最大的雷射儀器產品及相關光電子產品製造商，與本公司往來 10 年以上）、控制器供應商丁公司（與本公司往來 10 年以上）、電子掃描鏡供應商戊公司（與本公司往來 10 年以上）、螺桿與滑軌供應商日商清光社、光學部品供應商日商宝產業，皆合作多年，進貨供貨穩定。

本公司主要原物料廠商自下單到送達通常約 30-180 天的時間，故本公司之安全庫存政策，係依據市場情況、客戶訂單，並安排生產計劃，以不鏽鋼材為例，本公司主軸生產所需之不鏽鋼材之品質，需符合分子之穩定性及金相組織之一致性，故於 110 年 1 月預購三年份使用料源，後分批於 110 年 4 月、8 月及 10 月完成進貨，本公司評估每年不鏽鋼之原料使用量約 7.5 噸(7,500 公斤)，數量不多，本次採購金額總計日幣 17,247 千元(折合約新臺幣 4,900 千元)，該批存貨總計約 22,672 公斤，占用倉儲空間約 25 立方米，預估可於三年之內使用完畢。另本公司設備生產用之鑄鐵、控制器則於 110 年 11 月預購一年份用料，依照接單生產計畫安排出貨、雷射鑽孔設備生產所需之雷射頭、電子掃描鏡，則依照生產計劃，每年第一季與供應廠商檢討年度批量訂單，且本公司就未來一年主要原料之數量與成本仍將密切控管，避免產生短期間有缺料或成本大幅增加之風險。另由於本公司銷售之機台，係客製化設計生產，於客戶下訂時，即會評估現況原物料市場之價格後，再與客戶進行報價，而本公司亦會依照原物料漲價趨勢提早備料因應。

中長期方面，本公司採下列策略以達成穩定貨源及成本優勢，說明如下：

- 1、與現有供應商維持良好關係，了解其未來的動向；
- 2、尚未有替代廠商的部分，設法找尋第二家供應商；
- 3、評估與供應商合資或策略聯盟；
- 4、評估是否可自行開發(例如：氣浮鞍座(AIR GUIDE)、新影像處理器、二次元桌面補正等)。

綜上所述，面臨主要原物料成本上升、關鍵零組件缺料之風險，本公司目前尚無重大影響，且應可及時應對。

【推薦券商說明】

該公司之生產方式以各年度預測客戶之需求訂定安全庫存量而備貨，大約會備 1 至 3 個月之庫存量，且該公司鋼鐵、不鏽鋼、鑄鐵類等不會變質之原物料有預購之採購計畫，而預購之原料也較不受原物料短期價格波動影響。

另，建議該公司針對原物料之採購尋找第二、第三供應商以建立成本優勢並分散風險。該公司最近三年度及 110 年前三季向前十大供應商進貨金額占該公司整體進貨淨額比率分別為 39.50%、42.41%、42.51%及 37.39%。前十大供應商個別進貨比率最高者之進貨金額占整體進貨比率為 15.33%，足見該公司並無進貨集中於特定供應商之情事。

另該公司已成功開發出高階機械鑽孔機台，110 年前三季設備產銷毛利率達 25.89%，已有效高拉售價維持一定之毛利率，將可有效控管原物料價格攀升帶來不利之影響。

達航科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣431,870千元		公司地址：臺北市內湖區基湖路35巷49號6樓之1		電話：(04)2681-0607			
設立日期：80年2月25日			公司網址：http://www.ofunatech.com				
上市日期：不適用		上櫃日期：不適用		公開發行日期：107年9月12日			
管理股票日期：不適用							
負責人：董事長：翁榮隨 總經理：陳柏棋			發言人：孫逸敏 代理發言人：劉智鴻		職稱：管理中心主管 職稱：會計部主管		
股票過戶機構：康和綜合證券股份有限公司 股務代理部			電話：(02)8787-1888網址：http://www.concords.com.tw 地址：臺北市信義區基隆路1段176號B1				
股票承銷機構： 康和綜合證券股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 兆豐證券股份有限公司			電話：(02)8787-1888 網址：http://www.concords.com.tw 地址：台北市基隆路1段176號10樓 電話：(02)2181-5888 網址：https://www.tssco.com.tw/ 地址：台北市中山北路二段44號2樓 電話：(02)2327-8988 網址：https://www.megasec.com.tw/ 地址：台北市中正區忠孝東路二段95號3樓				
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 楊清鎮會計師、龔則立會計師			電話：(02)2725-9988 網址：https://www.deloitte.com.tw 地址：台北市信義區松仁路100號20樓				
複核律師：普華商務法律事務所 鍾元珧律師			電話：(02)2729-5200 網址：http://www.pwclegal.com.tw 地址：台北市信義區基隆路一段333號22樓2209室				
信用評等機構：不適用			電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用				
評等標的	發行公司：不適用		無■；有□，評等日期：- 評等等級：-				
	本次發行公司債：不適用		無■；有□，評等日期：- 評等等級：-				
董事選任日期：109年8月31日，任期：3年			監察人選任日期：成立審計委員會，故不適用。				
全體董事持股比例：20.80%（111年5月18日）			全體監察人持股比率：成立審計委員會，故不適用。				
董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例：（111年5月18日）							
職稱		姓名	持股比例	職稱	姓名	持股比例	
董事長		翁榮隨	4.87%	獨立董事		游張松	0%
董事暨持股10%股東		鴻圻國際(股)代表人	15.44%	獨立董事		梁江蔚	0%
股東		稻見和明		持股10%股東		黃立達	22.80%
董事		金谷保彥	0.49%	持股10%股東		鴻洋投資股份有限公司	13.61%
董事		蕭長榮	0%				
獨立董事		陳文炯	0%				
工廠地址： 精工廠：臺中市大甲區日南里工一路21號 青年廠：臺中市大甲區日南里青年路123之2號					電話： 精工廠：(04)2681-0607 青年廠：(04)2681-0907		
主要產品：雷射應用(鑽孔加工)、設備產銷、專業服務			市場結構： 內銷81%、外銷19%(110年度)		參閱本文之頁次 第56頁		
風險事項		詳本公開說明書公司概況之風險事項說明				參閱本文之頁次 第4~8頁	
去(110)年度		營業收入：1,245,511千元 稅前純益：121,076千元		每股稅後盈餘：2.12元		參閱本文之頁次 第88頁	
本次募集發行有價證券種類及金額			請參閱本公開說明書封面				
發行條件			請參閱本公開說明書封面				
募集資金用途及預計產生效益概述			請參閱本公開說明書第77頁				
推薦證券商執行過額配售及價格穩定之相關資訊			本公司已與主辦推薦證券商簽訂過額配售協議書約定相關事項				
本次公開說明書刊印日期：111年5月30日			刊印目的：現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用稿本				
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：參閱本公開說明書目錄							

達航科技股份有限公司

公開說明書目錄

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項.....	1
一、風險事項乙節	1
二、特別記載事項乙節	1
貳、公司概况.....	2
一、公司簡介	2
(一) 設立日期.....	2
(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話.....	2
(三) 公司沿革.....	2
二、風險事項	4
(一) 風險因素.....	4
(二) 訴訟或非訟事件.....	6
(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響.....	7
(四) 發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明	7
(五) 外國發行人申請股票登錄興櫃或第一上櫃者，應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施.....	8
(六) 其他重要事項.....	8
三、公司組織	9
(一) 組織系統.....	9
(二) 關係企業圖.....	10
(三) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料.....	12
(四) 董事及監察人資料.....	14
(五) 發起人資料.....	19
(六) 董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	20
(七) 發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經（學）歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司之職務、與發行人董事之關係及對發行人實質控制情形，另外國發行人並應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任.....	25
四、資本及股份	26
(一) 股份種類.....	26
(二) 股本形成經過.....	26
(三) 最近股權分散情形.....	27

(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	30
(五) 公司股利政策及執行狀況.....	30
(六) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	31
(七) 員工、董事及監察人酬勞.....	31
(八) 公司買回本公司股份情形.....	31
五、 公司債(含海外公司債)辦理情形.....	32
六、 特別股辦理情形.....	32
七、 參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	32
八、 員工認股權憑證辦理情形.....	33
(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證.....	33
(二) 累積至公開說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數 前十大員工之姓名、取得及認購情形.....	34
(三) 最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形.....	34
九、 限制員工權利新股辦理情形.....	34
十、 併購辦理情形.....	34
十一、 受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	34
參、 營運概況.....	35
一、 公司之經營.....	35
(一) 業務內容.....	35
(二) 市場及產銷概況.....	56
(三) 最近二年度從業員工人數.....	67
(四) 環保支出資訊.....	68
(五) 勞資關係.....	69
(六) 資通安全管理：.....	71
(七) 公司及其子公司於申請上櫃年度及其前二年度如有委託單一加工工廠於年度內加工金 額達五千萬元以上者，應增露該加工工廠之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分 之十大股東及最近期財務報表勞資關係.....	71
(八) 有無爭訟事件，及勞資間關係有無尚須協調之處.....	72
(九) 有無因應景氣變動之能力.....	72
(十) 關係人間交易事項是否合理（公營事業依審計法規辦理者不適用）.....	72
(十一) 如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令取得主 管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國內從事生物技術工業或醫療儀器工 業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷售或提供技術服務之實績 暨最近一年度產品及相關技術服務之營業額、研究發展費用所占該公司總營業額之比 例情形.....	72
(十二) 公司如於提出上櫃申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將其部分 之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記載說明其終止、 移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續營業項目前一年度之營業 額、研究發展費用占公司該年度總營業額之比例情形.....	72
二、 不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產.....	72
(一) 自有資產.....	72

(二) 使用權資產.....	73
(三) 各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率：.....	73
三、 轉投資事業.....	74
(一) 轉投資事業概況.....	74
(二) 綜合持股比例.....	74
(三) 上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響.....	74
(四) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數.....	74
(五) 已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，應增列該投資事業之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表.....	75
四、 重要契約.....	75
肆、 發行計劃及執行情形.....	77
一、 前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計劃分析.....	77
二、 本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項.....	77
三、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項.....	83
四、 本次併購發行新股應記載事項.....	83
伍、 財務概況.....	86
一、 最近五年度簡明財務資料.....	86
(一) 簡明資產負債表及綜合損益表.....	86
(二) 影響上述財務報表一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響.....	89
(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見.....	89
(四) 財務分析.....	90
(五) 會計項目重大變動說明.....	94
(六) 本國發行人自公開發行後最近連續七年或外國發行人最近連續七年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施.....	96
(七) 外國發行人申請股票登錄興櫃者，得僅列示最近二年度之財務資料；外國發行人申請股票第一上櫃者，得僅列示最近三年度之財務資料.....	96
二、 財務報告應記載事項.....	96
(一) 發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告.....	96
(二) 最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表.....	96
(三) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無此情事.....	96

三、財務概況其他重要事項.....	96
(一) 公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響	96
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露相關資訊	96
(三) 期後事項.....	96
(四) 其他.....	96
四、財務狀況及經營結果檢討分析.....	97
(一) 財務狀況.....	97
(二) 財務績效.....	98
(三) 現金流量.....	99
(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	99
(五) 其他重要事項.....	100
陸、特別記載事項.....	101
一、內部控制制度執行狀況.....	101
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告	101
三、證券承銷商評估總結意見.....	101
四、律師法律意見書	101
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見.....	101
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形	101
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項.....	101
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形.....	101
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容.....	101
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其主要缺失與改善情形.....	101
十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書	101
十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書.....	101
十三、本國發行人自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書	101
十四、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾，及其重要業務之政策（公營事業不適用）	102
十五、發行人是否有與其他公司共同使用申請貸款額度.....	102
十六、發行人有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人.....	102
十七、發行人申請公司債上櫃者，應說明公司債本金及利息償還之資金來源，暨發行標的或保證金融機構之信用評等等級、評等理由及評等展望等信用評等結果.....	102

十八、 發行人有本中心審查準則第十條第一項第四款或外國審查準則第九條第一項第三款情事者，應將該重大未改善之非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會.....	102
十九、 充分揭露發行人與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式.....	102
二十、 發行人分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響.....	102
二十一、 其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明.....	102
二十二、 發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次有價證券後未來展進比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估	102
二十三、 其他必要補充說明事項.....	102
二十四、 上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項.....	157
(一) 董事會運作情形資訊.....	157
(二) 審計委員會運作情形.....	162
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	166
(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 ..	170
(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	172
(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	174
(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式	177
(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管辭職解任情形之彙總.....	177
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊.....	177
柒、 重要決議、公司章程及相關法規.....	177
一、 與本次發行有關之董事會及股東會議事錄.....	177
(一) 與本次發行有關之決議文.....	177
(二) 盈餘分配表	177
二、 公司章程	177
三、 未來股利發放政策	177
四、 截至公開說明書刊印日止之背書保證相關資訊.....	177

附件一、內部控制制度聲明書&內部控制制度審查報告

附件二、證券承銷商評估總結意見

附件三、法律意見書

附件四、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書

附件五、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾

附件六、與本次發行有關之決議文

附件七、公司章程(含修正前後條文對照表)

附件八、盈餘分配表

附件九、109 年度合併財務報告暨會計師查核報告

附件十、110 年度合併財務報告暨會計師查核報告

附件十一、109 年度個體財務報告暨會計師查核報告

附件十二、110 年度個體財務報告暨會計師查核報告

附件十三、111 年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告

附件十四、不受理特定對象投標單聲明書

附件十五、誠信聲明書

附件十六、承銷價格計算書

附件十七、股票初次申請上櫃推薦證券商評估報告

附件十八、111 年度現金增資發行新股證券商評估報告

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項

一、風險事項乙節

- (一) 貴公司原第一大客戶 C 公司自購進口雷射機台後，即減少雷射加工訂單，致 貴公司 110 年前三季雷射加工服務收入較 109 年同期減少 21.17%，有關貴公司面臨客戶自購機台後減少託工訂單之風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。
- (二) 相較同業已跨足半導體及光電等其他產業，貴公司主要客戶仍集中於 PCB 產業，有關貴公司面臨單一產業銷售風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。
- (三) 貴公司主要原物料成本近年來節節攀升，其中關鍵零組件主係向國外廠商進口，亦受運費上漲與船期不穩定影響，有關貴公司面臨主要原物料成本上升、關鍵零組件缺料之風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱本公開說明書「本公司之產業、營運及其他重要風險」。

二、特別記載事項乙節

- (一) 貴公司 108 及 109 年度營業收入分別較前一年度衰退 23.78%及 14.81%，有關貴公司業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見
- (二) 貴公司雷射應用加工服務占 109 年度營業收入比重達 45.83%，110 年前三季雷射加工服務收入較 109 年同期減少 21.17%，惟其預計投入 7.5 億元擴建廠房及增購雷射加工設備，有關貴公司擴廠計畫、資金來源、預計效益與可行性，及如何因應 PCB 產業景氣變化之說明，暨推薦證券商及簽證會計師之評估意見。
- (三) 有關貴公司與大船企業(股)有限公司(以下簡稱大企公司)及其轉投資公司間財務業務之獨立性，及關係人交易之必要性與合理性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱本公開說明書「陸、二十三、其他必要補充說明事項」。

貳、公司概況

一、公司簡介

(一)設立日期：中華民國 80 年 2 月 25 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司：臺北市內湖區基湖路 35 巷 49 號 6 樓之 1

精工廠：臺中市大甲區日南里工一路 21 號

電話：04-2681-0607

青年廠：臺中市大甲區日南里青年路 123 之 2 號

電話：04-2681-0907

分公司：

達航科技股份有限公司韓國分公司

電話：+82-2-868-0618

地址：819 Ho,2 Gasan digital 1-ro,Geumcheon-Gu,Seoul,08591,South Korea

達航科技股份有限公司香港分公司

電話：+852-2487-8111

地址：香港灣仔皇后大道東 109-115 號智群商業中心 18 樓 A 室

(三)公司沿革：

年份	重要紀事
80 年 2 月	2 月成立於臺中市大甲區，以 PCB 鑽孔加工及相關機械設備之維修為主營業項目。設立資本額 5,000 千元。
80 年 4 月 80 年 8 月	4 月成立 CAM 部門，專事精密底片繪製。 辦理現金增資 5,000 千元，增資後實收資本額為 10,000 千元。
82 年 4 月 82 年 6 月	4 月 DNC 連線測試成功，提供工廠自動化、電腦整合監控系統，正式邁入自動化產品銷售領域。 辦理現金增資 15,000 千元，增資後實收資本額為 25,000 千元。
84 年 6 月	辦理現金增資 10,000 千元，增資後實收資本額為 35,000 千元。
85 年 2 月 85 年 9 月	2 月擴大廠區，並與日本 HITACHI VIA 技術合作，鑽孔機組裝生產上線。 辦理現金增資 10,000 千元，增資後實收資本額為 45,000 千元。
86 年 4 月	4 月臺中幼獅工業區精工廠成立。CNC 部門遷移至精工廠。
86 年 9 月	9 月 CNC 部門與華通電腦股份有限公司業務合作。鑽孔機組裝生產線遷至精工廠。上下環機開發成功並進入市場行銷。
87 年 3 月 87 年 10 月	辦理現金增資 105,000 千元，增資後實收資本額為 150,000 千元。 10 月投收板機開發成功並進入市場行銷。
88 年 10 月	10 月跨足電子商務暨網路資訊服務系統領域，使系統業務整合能力及技術水準邁向新的里程碑。
89 年 2 月	2 月榮獲 BSI ISO-9001 品質系統認證。
90 年 8 月	辦理現金增資 210,000 千元，增資後實收資本額為 360,000 千元。
91 年	導入 ORACLE ERP 系統。
92 年 11 月	辦理盈餘轉增資 20,000 千元，增資後實收資本額為 380,000 千元。
94 年 8 月	辦理盈餘轉增資 100,000 千元，增資後實收資本額為 480,000 千元。
96 年	自有品牌 vela 進入市場行銷。 導入 CRM 緊密結合客戶關係。
99 年 3 月	辦理現金增資發行新股 2,504 千股，每股面額 10 元，以每股 30 元溢價發行，增資後實收資本額為 505,045 千元。

年份	重要紀事
99 年 7 月	辦理增資發行新股 34,471 千股，每股面額 10 元，以每股 31.80 元溢價發行，合併 Ofuna Holding Co.,Ltd.，增資後實收資本額為 849,756 千元。
100 年	vela 三項產品榮獲第 19 屆台灣精品獎。 UNA 品牌發表。
101 年	vela ND 開發成功並進入市場行銷。
102 年 3 月 102 年 10 月	辦理營業分割及減資，減資 550,000 千元，減資後實收資本額為 299,756 千元。 SPINDLE 38 萬轉業界最高轉速發表。
103 年 3 月 103 年 11 月	發行新股 1,739 千股作為受讓大船企業日本株式會社 100%股權及台灣田中貴金屬股份有限公司 10%股權之對價，每股面額 10 元，並以每股約 37.26 元溢價發行，增資後實收資本額為 317,148 千元。 辦理盈餘轉增資 126,859 千元，增資後實收資本額為 444,007 千元。
104 年	ORACLE ERP 系統升級。
104 年 6 月	更名為達航科技股份有限公司。
106 年 6 月	Vela CO2 雷射鑽孔機開發成功並於 JPCA SHOW 發表，同年 10 月於 TPCA SHOW 發表，並進入量產。
107 年 6 月	Vela UV 雷射鑽孔機開發成功並於 JPCA SHOW 發表，同年 10 月於 TPCA SHOW 發表，次年進入量產。
107 年 9 月	首次辦理股票公開發行生效，並含補辦員工認股權憑證 10,000 千元。
107 年 10 月	辦理註銷庫藏股 57 千股，減少資本額計新台幣 572 千元，註銷庫藏股後實收資本額為 443,435 千元。
108 年	鑽孔機新機種(DM、DS 系列)、成型機新機種(RM 系列)研發成功。
109 年	增設台中精工廠投資增設雷射加工部門。
109 年 10 月	登錄興櫃
109 年 4 月	辦理註銷庫藏股 1,499 千股，減少資本額計新台幣 14,992 千元，註銷庫藏股後實收資本額為 428,443 千元。
110 年 6 月	員工認股增資 169 千股，增資後實收資本額為 430,133 千元。
110 年 6 月	新增台中幼獅工業區青年廠
111 年 5 月	辦理員工認股增資 173 千股，增資後實收資本額為 431,870 千元。

二、風險事項

(一)風險因素

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施利率變動影響

(1)利率變動影響

單位：新台幣千元

項目	109 年度	110 年	111 年第一季
營業收入(A)	1,000,900	1,245,511	410,964
利息支出(B)	15,724	14,514	3,453
利息支出(B)/營業收入(A)%	1.57	1.17	0.84

資料來源：各期經會計師查核及核閱簽證財務報告

上表顯示，本公司各年度之利息支出占營業收入比重甚微，故利率變動風險對本公司影響相當有限，由於，本公司自有資金尚稱充裕，財務結構良好且財務規劃以保守穩健為原則，資金調度首重安全之管理，未來將視公司規劃發展及當下金融市場利率變動，適時調整資金運用，以降低利率變化對本公司負債產生之影響。

(2)匯率變動影響

單位：新台幣千元

項目	109 年度	110 年度	111 年第一季
淨匯兌(損失)利益	3,346	6,282	(1,087)
營業收入	1,000,900	1,245,511	410,964
營業利益	109,352	128,439	68,500
淨匯兌(損失)利益/營業收入(%)	0.33	0.50	0.26
淨匯兌(損失)利益/營業利益(%)	3.06	4.89	1.59

資料來源：各期經會計師查核及核閱簽證財務報告

本公司最近二年度及111年第一季兌換(損)益金額分別為3,346千元、6,282千元及(1,087)千元，占各年度營業收入比率分別為0.33%、0.50%及0.26%；占各年度營業利益比率分別為3.06%、4.89%及1.59%。本公司之營運據點涵蓋臺灣、日本及中國，其銷貨與進貨係以臺幣、美元、人民幣、日圓及歐元做為交易計價之貨幣，於日常營運中即需面對多種不同外幣產生之匯率風險，整體而言，本公司兌換損益占營業收入與營業利益之比重非屬重大，故匯率變動對本公司尚無重大影響。

(3)通貨膨脹影響

近年來，全球原物料價格持續上漲，全球總體經濟環境，亦呈現微幅通貨膨脹之趨勢，然截至目前為止，本公司之損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，未來，本公司仍將持續密切注意全球市場原物料價格之波動狀況，必要時，適度調整產品的價格，降低通貨膨脹情形影響本公司損益。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注鑽孔工藝，搭配鑽孔機及成型機之設備導入電子產品之製程整合服務本業，並未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事。另，本公司以健全財務及營運為基礎下，已訂立「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產作業程序」與相關作業程序，業經股東會決議通過，截至公開說明書刊印日止，本公司從事資金貸與他人與背書保證交易之對象均為本公司轉投資之子公司，且本公司及子公司訂有「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，相關作業程序皆遵循規範辦理。

3.未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司因應客戶多變的技術與需求。預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況逐年調整。投入新區域品牌開發，尋找新的商機，拓展不同客群，以強化公司之市場競爭優勢，提高收益能力。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司日常營運均依循國內、外相關法令規範辦理，提升公司治理內部管理機制，並隨時注意國內、外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化，故最近一年度及截至公開說明書刊印日止，國內、外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

5.科技改變(含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司持續投入資源於研發新技術、新產品，以配合業務單位之市場開發，業務單位隨時自市場上收集新資訊並與研發人員配合開發符合客戶需求之設備，研發資料管理以 PLM 系統為主，依專案別、功能別區分不同使用者權限，且 CAD 圖檔等重要資料搭配 TRUSTVIEW 軟體防止資料任意流出或外洩。最近一年度及截至公開說明書刊印日止，科技變更及產業變化對公司財務業務並無重大影響。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任，故本公司最近一年度及截至公開說明書刊印日止，尚未有因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。惟企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近一年度及截至公開說明書刊印日止，尚無併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將遵循本公司之「取得或處分資產作業程序」，並秉持審慎評估之態度進行各種效益之評估及風險之控管，以確實保障公司利益及股東權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司於 109 年間，於台中精工廠增設雷射鑽孔應用加工部門，增加自製產能設備。本公司專精於鑽孔工藝技術上，未來將依各產業的製程發展(舉凡，半導體、5G、電動車、Mini LED 等利基產業)及市場需求下，縝密規劃擴充產能及廠

房資本支出之投入，以提升生產力與競爭力，但擴充產能及廠房將會產生營運成本墊高之情事，故本公司為降低產能無法有效利用之可能風險下，除了密切注意市場變遷，與下游客戶間建立緊密合作關係外，並適時調整擴充計畫以作為因應。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司最近一年度及截至公開說明書刊印日止，各年度並無對單一進貨商採購達 30%以上之情事，與供應商間長久往來並維持良好關係，且本公司進貨來源分散，故本公司無進貨集中之情形。

(2)銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司最近一年度及截至公開說明書刊印日止，各年度並無對單一銷售客戶銷貨達 30%以上之情事，且本公司之產品服務銷售終端應用範圍涵蓋 PCB、半導體、面板光電等各產業，故本公司無銷貨集中之風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近一年度及截至公開說明書刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉之情事，另，本公司為加強公司治理，故於 109 年 08 月 31 日召開臨時股東會全面改選董事，並選任三席獨立董事，由三席獨立董事組成審計及薪酬委員會，以強化公司治理之職能、保障股東權益，對於公司之營運管理有正面之效益。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近一年度及截至公開說明書刊印日止，並未有經營權改變之情事。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訟事件

- 1.公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
- 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- 3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四)發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明

本公司最近一年度截至公開說明書刊印日止，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項規定之重要子公司分別為 China Expo Limited(以下簡稱 China Expo)、MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED(以下簡稱 MEGA)及上海達航實業有限公司(以下簡稱上海達航)，其中，China Expo 為 MEGA 之控股公司，另 MEGA 則為上海達航之控股公司，其本身無實際之生產活動，故以下茲就實際發生營運之重要子公司-上海達航之風險事項說明如下：

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率影響

最近一年度及申請年度最近期之利息費用分別為15,724千元及14,514千元，占各年度之合併營業收入分別為1.57%及1.17%，對集團損益影響尚不重大，主係營運週轉所需，未來將視公司規劃發展及當下金融市場利率變動，適時調整資金運用，以降太低利率變化對本公司負債產生之影響。

(2)匯率變動

上海達航之銷貨分別以美金及人民幣計價，另採購及相關營業活動所產生之費用則以美金或人民幣計價為主，上海達航匯兌風險除部分透過進銷貨自然避險方式降低外，另本公司亦隨時密切注意匯率變化資訊及國際經濟局勢變化，審慎研判匯率變動趨勢，以有效降低匯率風險，故匯率波動對營運之影響不大。

(3)通貨膨脹影響

上海達航主要從事設備維修、保養及雷射鑽孔加工業務，最近一年度及截至公開說明書刊印日止，通貨膨脹對上海達航損益面之影響尚不明顯，隨時注意物價波動、相關經濟環境變化及市場情勢變動以因應之。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

上海達航並無從事高風險高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品之交易，若經評估有必要從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，須根據本公司相關作業辦法及程序使得進行。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

上海達航並未從事研發活動，故不適用。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

上海達航均遵循當地國相關法令，並隨時注意外重要政策及法律變動，以確保公司運作順暢。最近年度及截至本公開說明書刊印日止，尚無因國內外重要政

策及法律變動而對公司財務業務造成重大影響之情事。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

上海達航亦隨時密切注意中國當地印刷電路板之產業趨勢，且與上下游客戶維持緊密良好關係，以利即時掌握產業動態，做好相關之規劃及因應措施之準備，故最近一年度及截至公開說明書刊印日止，尚無發生科技改變或產業變化而對其財務業務有重大影響之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

上海達航極重視企業應有之社會責任且遵守相關之法令規定，最近一年度及截至公開說明書刊印日止，並無因企業形象改變而造成企業危機或需危機管理之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

上海達航最近一年度及截至公開說明書刊印日止，並無進行併購之計畫。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

上海達航最近一年度及截至公開說明書刊印日止，並無擴充廠房之計畫。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨集中所面臨之風險評估及因應措施

上海達航主要負責中國區市場之設備產銷產品及關鍵性零件商品之銷售，以及鑽孔機成型機設備之保養及維修服務為主，故主要進貨對象以本公司之轉投資公司東莞達程有限公司，並無對申請主體外之供應商有進貨集中之情形。

(2)銷貨集中所面臨之風險評估及因應措施

上海達航 109 年度及 110 年之第一大銷貨客戶之銷貨金額占各該年度銷貨淨額比重分別為 16%及 17%，故尚未集中單一客戶之情事。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

12.其他重要風險及因應措施：無。

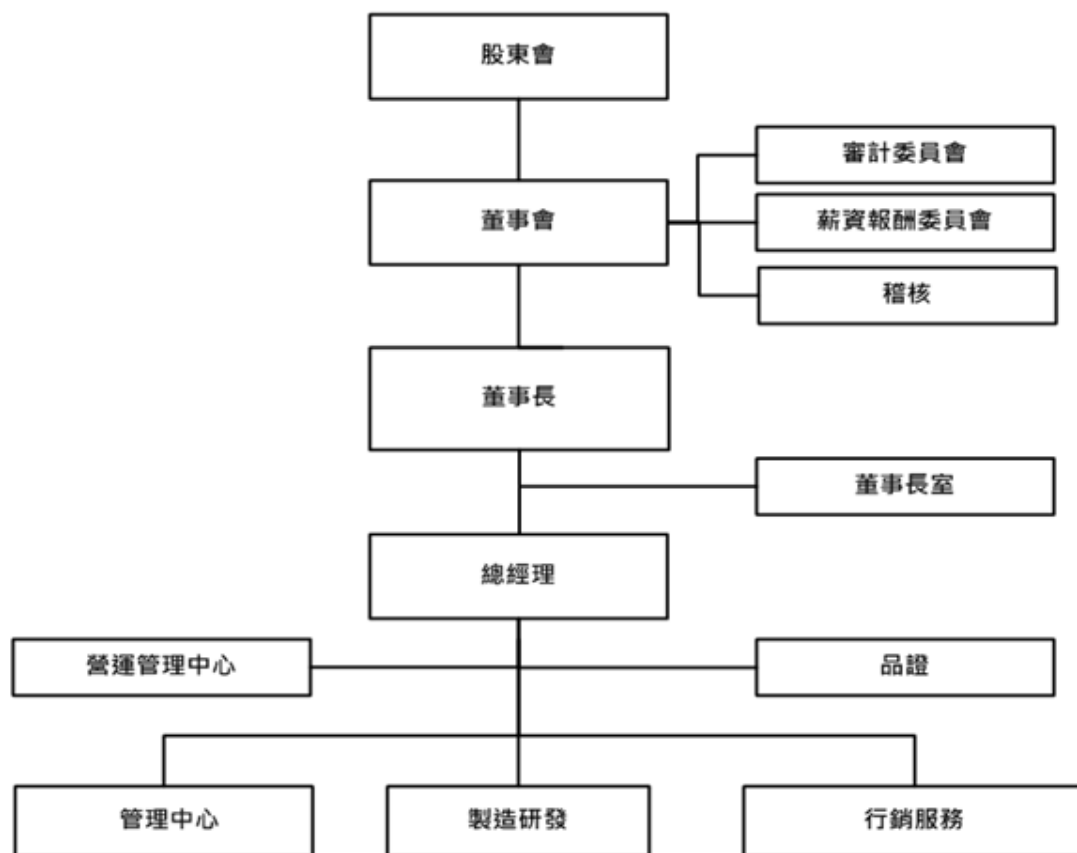
(五)外國發行人申請股票登錄興櫃或第一上櫃者，應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：不適用。

(六)其他重要事項：無。

三、公司組織

(一)組織系統

1.公司之組織結構



註: 111年1月10日董事會通過。

2.各主要部門所營業務

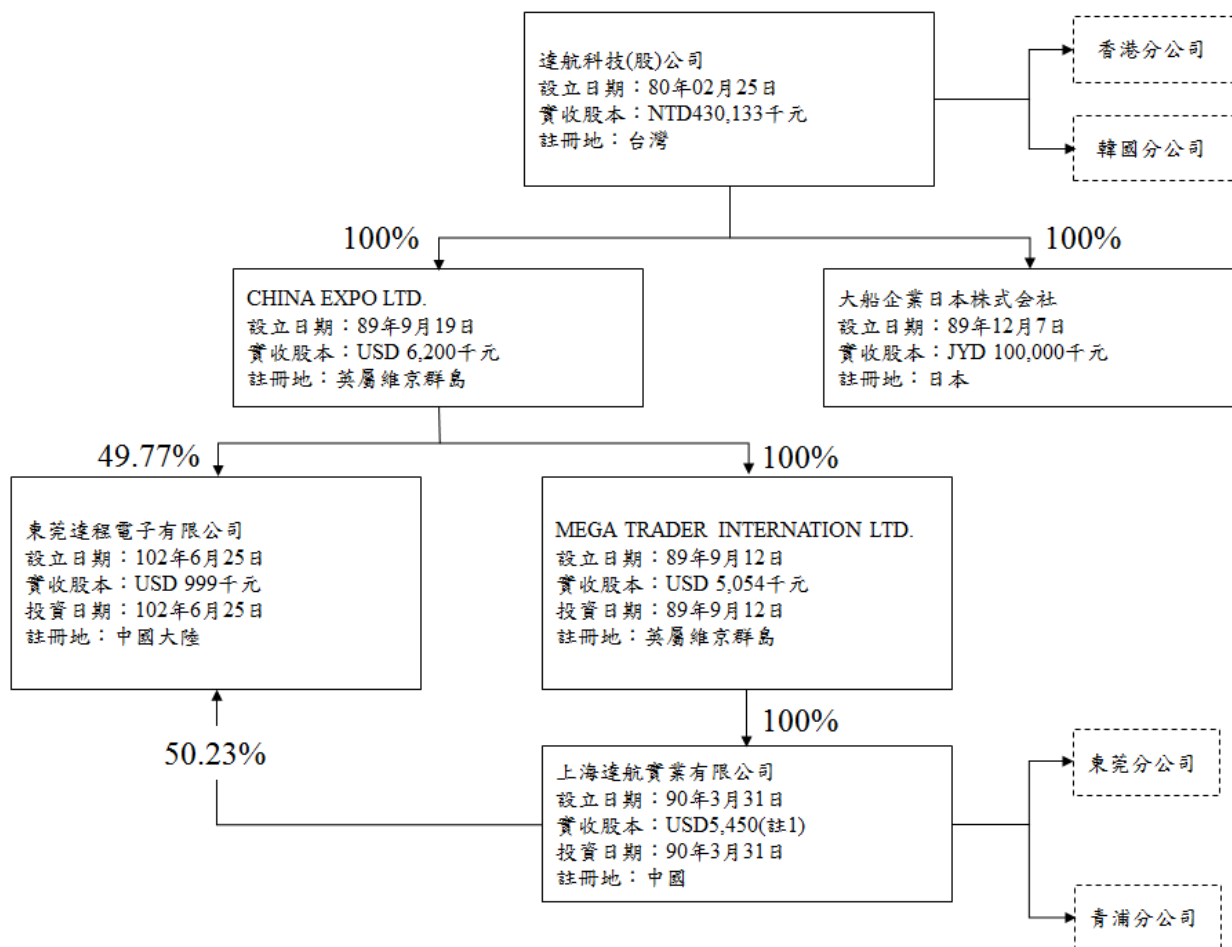
部門	主要職掌
董事會	依據公司治理的理念，董事會責任為善盡監督責任、指導經營團隊、評量經營團隊之績效及任免經理人。
審計委員會	以下列事項之監督為主要目的：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。
薪資報酬委員會	係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
稽核	定期追蹤呈現內部審查業務的計劃及改善的調查。
董事長	對董事會負責，並接受督導，執行董事會之決策。
董事長室	公司長期經營發展策略之擬定。
總經理(集團)	秉承董事會之決議，綜理公司業務。
營運管理中心	負責市場分析，訂定產品市場策略及營運預算計劃編審與控制。
品證	規畫建立品質保證系統，執行品質相關工作以確保產品與服務品質，並推行品質教育訓練及稽查品質改善。
管理中心	統轄會計、財務、人資、總務、資訊，負責集團資源整合協調事宜。

部門	主要職掌
製造研發	- 負責雷射鑽孔加工服務/機械鑽孔/成型與主軸等產品之研發設計，並針對製程需求研發差異化產能提升方案。 - 統合雷射鑽孔加工服務/機械鑽孔/成型與主軸等產品技術資源，以滿足客戶對技術服務、產品品質及交期之要求。 - 執行雷射設備、機械鑽孔、成型設備、主軸產品之製造、組測、包裝作業。
行銷服務	- 台灣、韓國、日本、大中華區之各類產品線行銷計劃與產品管理。 - 台灣、韓國、日本、大中華區之營業策略、推廣、研擬及執行銷售計劃。 - 統合台灣、韓國、日本、大中華區之技術資源，負責雷射鑽孔加工服務/機械鑽孔/成型/售後服務與主軸產品之運作，以滿足客戶對技術服務、產品品質及交期之要求。

(二)關係企業圖

1.關係企業組織圖

日期：111 年 2 月 28 日



2.公司與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額

110年12月31日；新臺幣千元；千股

關係企業名稱	與公司之關係	持有本公司股份			本公司持有關係企業		
		比例	股份	金額	比例	股份	投資金額
CHINA EXPO LIMITED	子公司	-	-	-	100%	6,200	229,487
MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED	孫公司	-	-	-	100%	5,054	139,900
上海達航實業有限公司	孫公司	-	-	-	100%	-	150,856
東莞達程電子有限公司	孫公司	-	-	-	100%	-	27,652
大船企業日本株式會社	子公司	-	-	-	100%	2	31,567

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

111年3月31日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註 (註)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
總經理	陳柏棋	男	中華民國	107.4.1	136,300	0.32	-	-	-	-	輔仁大學日文系學士 大船科技(股)公司營業處總經理 達航科技(股)公司營業處副總經理	大船企業日本株式會社監察人 達航科技(股)公司_韓國分公司總經理	-	-	-	50,000	-
董事長室主任	稻見和明	男	日本	110.11.08	359,906	0.83	3,108	0.01	-	-	台北日本人學校畢業(現今，台北市日僑學校) 大船企業(股)公司副總經理 達航科技(股)公司總經理	大船企業日本株式會社董事				60,000	
製造研發處主管	金谷保彥	男	日本	110.11.08	210,000	0.49	-	-	-	-	金澤大學精密工學科學士 Hitachi Via Mechanics Ltd.董事	大船企業日本株式會社董事長				-	
上海達航實業青浦分公司 法人代表	王維倫	男	中華民國	110.7.5	-	-	-	-	-	-	中華技術學院電子工程科畢業 大船電子(上海)有限公司營業副理 廣東達航電子有限公司上海分公司營業經理	上海達航實業有限公司青浦分公司法人代表 東莞達程電子有限公司營業資深協理	-	-	-	-	-
營業一部主管	陳俊程	男	中華民國	110.11.08	35,648	0.08	81,674	0.19	-	-	虎尾技術學院動力機械科畢業 達程科技(股)公司總經理	東莞達程電子有限公司法人代表 上海達航實業有限公司監事	-	-	-	30,000	-

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股	股數	持股	股數	持股			職稱	姓名	關係		
管理中心主管	孫逸敏	男	中華民國	110.11.08	48,480	0.11	-	-	-	-	臺灣大學EMBA在學中 南開工專電子工程科畢業 達船科技(股)公司總經理	佐登妮絲集團(股)公司獨立董事	-	-	-	40,000	-
會計部主管	劉智鴻	男	中華民國	108.10.1	28,378	0.07	-	-	-	-	淡江大學會計系畢業 東浦精密光電(股)公司上櫃規劃課長 東官實業(股)公司財務副理 福裕事業(股)公司上櫃規劃專員 大船營運管理(股)公司董事長	上海達航實業有限公司法人代表 上海達航實業有限公司東莞分公司法人代表	-	-	-	20,000	-
財務部主管	陳巧梅	女	中華民國	108.10.1	3,500	0.01	656	0.002	-	-	中正大學社會福利學學士 中正大學財務金融系學士 達鵬科技(股)公司管理課課長	-	-	-	-	5,000	-
稽核室主管	鄭照慶	男	中華民國	108.8.1	2,258	0.01	-	-	-	-	元培醫專醫學工程科畢業 巨匠電腦維修工程師 達船科技(股)公司應用課課長 達航科技(股)公司資深電腦程式工程師	-	-	-	-	5,000	-

註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。

(四)董事及監察人資料

1. 董事及監察人：

111年3月31日；單位：股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選(就)任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註 (註2)
							股數	持股 比率%	股數	持股 比率%	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係人	
董事長	翁榮隨	男 61~70 歲	中華民國	103.06.03	109.08.31	三年	2,135,000	4.81	2,103,000	4.87	1,000,000	2.32	-	-	臺灣大學管理學院商學系在職專班碩士 臺灣大學經濟學系學士 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人	韶瑞開發(股)公司董事長 合機電線電纜(股)公司獨立董事 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 台灣銘板(股)公司獨立董事	-	-	-	-
董事	鴻圻國際(股)公司代表人	法人	中華民國	110.08.30	110.08.30	三年 (註3)	6,670,000	15.51	6,670,000	15.44	-	-	-	-	台北日本人學校(現今，台北市日僑學校)畢業 大船企業(股)公司副總經理 達航科技(股)公司總經理	達航科技(股)公司董事 大船企業日本株式會社董事	-	-	-	-
	稻見和明	男 61~70 歲	日本				347,906	0.81	359,906	0.83	3,108	0.01	-	-						
董事	金谷保彥	男 71~80 歲	日本	105.05.30	109.08.31	三年	210,000	0.47	210,000	0.49	-	-	-	-	金澤大學精密工學科畢業 Hitachi Via Mechanics Ltd. 董事	大船企業日本株式會社總經理 達航科技(股)公司董事	-	-	-	-
董事	蕭長榮 (註1)	男 61~70 歲	中華民國	109.08.31	109.08.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學商學院經營管理碩士學程之財務管理組畢業 臺灣大學經濟學系畢業 國家高等考試金融人員及格 國家特種考試金融人員及格 國家關特考試稅務人員及格 GARP 認證財金風險管理分析師(FRM)合格 證券投資分析人員及格 中華票券金融公司副總經理 中華票券金融公司總稽核	萬通票券金融有限公司獨立董事	-	-	-	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選(就)任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註 (註2)
							股數	持股 比率%	股數	持股 比率%	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係人	
獨立董事	陳文炯 (註1)	男 61~70 歲	中華民國	109.08.31	109.08.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	陽明大學醫學院醫務管理研究所碩士 臺灣大學商學系學士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 台北市會計師公會理事 銘傳大學會計研究所兼任助理教授	杏和聯合會計師事務所所長 祥德陶瓷股份有限公司董事長	-	-	-	-
獨立董事	游張松 (註1)	男 61~70 歲	中華民國	109.08.31	109.08.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國卡內基美隆大學管理博士 臺灣大學管理學院工商管理學系專任教授 網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事	國立台灣大學管理學院工商管理學系教授(兼任) 雄獅旅行社(股)公司獨立董事 寶陞國際股份有限公司	-	-	-	-
獨立董事	梁江蔚 (註1)	男 61~70 歲	中華民國	109.08.31	109.08.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	淡江大學航空工程學系畢業 臺灣大學推廣教育中心企業管理研究碩士(和信企業內碩士班) 中租迪和(股)公司經理 菱光科技(股)公司創辦人菱光科技(股)公司總經理 亞泰影像(股)公司創辦人亞泰影像(股)公司總經理	怡豐創業投資股份有限公司董事 虹光精密工業股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

註1：本公司於109/08/31全面改選董事(七席、含三席獨立董事)，取消監察人。

註2：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。

註3：原董事黃OO於110年6月21日辭任，故本公司於110年8月30日股東臨時會選任之，任期自110年8月30日起至112年8月30日止。

2. 法人股東之主要股東：

法人股東	法人股東之主要股東
鴻圻國際(股)公司	黃立達(77.34%)、黃家揚(11.33%)、黃家琦(11.33%)

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
翁榮隨		<u>主要經(學)歷</u> ： 財政部關務署高雄關關務員、 中央信託局專員、 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人	註 2	3
鴻圻國際(股)公司 代表人 稻見和明		<u>主要經(學)歷</u> ： 大船企業(股)公司副總經理、 達航科技(股)公司總經理、	註 2	-
金谷保彥		<u>主要經(學)歷</u> ： Hitachi Via Mechanics Ltd.董事、	註 2	-
蕭長榮		<u>主要經(學)歷</u> ： 中華票券金融公司副總經理及總稽核、 萬通票券金融(股)公司獨立董事	註 2	1
陳文炯		<u>主要經(學)歷</u> ： 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人、 杏和聯合會計師事務所所長(現任)、 台北市會計師公會理事、 銘傳大學會計研究所兼任助理教授、 臺北商業大學兼任教師	註 3	-

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
游張松		<u>主要經(學)歷：</u> 臺灣大學管理學院工商管理學系專任教授、兼任教授(現任)、 雄獅旅行社(股)公司獨立董事(現任)、 網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事、 寶陞國際(股)公司獨立董事(現任)	註 3	2
梁江蔚		<u>主要經(學)歷：</u> 中租迪和(股)公司經理、 菱光科技(股)公司創辦人及總經理、 亞泰影像(股)公司創辦人及總經理 虹光精密工業(股)公司獨立董事(現任)	註 3	1

註1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註2：本公司董事間，並無違反「證券交易法」中有關獨立性規範之情事。

註3：本公司三位獨立董事並無違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中有關獨立性規範之情事。

5. 董事會多元化及獨立性：

- (1) 董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形：

A、董事會成員多元化政策：

本公司尊重並提倡董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司依據所制定之「公司治理實務守則」第二十條所示，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)；具備專業知識、專業技能、產業經歷及專業背景如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等；並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，明定董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

B、董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

- (A) 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有三分之二以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- (B) 獨立董事不得連任超過三屆，以維持其獨立性。
- (C) 董事成員中具外國籍(日本)身分之人數共有二位，提供本公司具前瞻性研發相關之國際市場資訊。

C、董事會成員多元化達成情形：

本公司之董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元之進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，強化董事會職能。董事會成員有二位日本籍董事，落實經營管理國際化，國籍多元化之政策；董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；八大核心項目中，至少均有三分之一以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理能力等三大核心項目，亦有三分之二以上之董事成員具備該能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								產業經驗(註)				專業能力		
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡(歲)			獨立董事任期年資(年)		資訊及科技	銀行及保險	商務與供應	光學及機械	會計	法律	風險管理
				51-60	61-70	71-80	0-3	4-6							
翁榮隨	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	○	✓	✓	○	✓	○	✓

鴻圻國際(股)公司	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	○	-	✓	✓	-	-	✓
代表人稻見和明	日本														
金谷保彥	日本	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	○	✓	✓	-	-	✓
蕭長榮	中華民國	男	×	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	○	✓	✓
陳文炯	中華民國	男	×	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	○	✓
游張松	中華民國	男	×	-	✓	-	✓	-	✓	-	○	○	-	-	✓
梁江蔚	中華民國	男	×	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓

註、✓具備能力，○具備部分能力。

(2) 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明 董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形：

本公司董事成員共有七位，其中包含獨立董事三席，比重為 42.86%，以確保董事會之獨立性。本公司之董事並無違反「證券交易法」中有關獨立性規範之情事；本公司之獨立董事，並無違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中有關獨立性規範之情事，符合獨立性情形。

(五)發起人資料

- 1.公司設立未滿一年者，比照前款規定，揭露持股比例占前十名之發起人之有關資料：不適用。
- 2.公司設立未滿三年者，應揭露自設立後公司與發起人間除業務交易行為以外之重要交易，包括財產交易與資金融通；其屬財產交

易者，尚應揭露該標的之性質、所在及該交易價格之決定方式。向發起人購入之資產，如係發起人於出售前二年內所購置者，並應說明該發起人之購入成本：不適用。

(六)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度(110 年)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1)最近年度支付董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例(%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等 七項總額及占稅後純益之比 例(%)		領取 來自 子公司 以外轉 投資 事業 或母 公司 酬金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司		財務報告 內所有公 司		本公司	財務報告內 所有公司			
董事長	翁榮隨	750	750	-	-	3,600	3,600	100	100	4.89	4.89	15,944	17,767	236	236	760	0	760	0	23.49	25.49	無
董事	黃○○(註 1)																					
董事	金谷保彥																					
董事	鴻圻國際股份有限公司 代表人：稻見和明(註 1)																					
董事	蕭長榮																					
獨立董事	陳文炯	1800	1800	-	-	-	-	300	300	2.31	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	2.31	無
獨立董事	游張松																					
獨立董事	梁江蔚																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：董事酬勞依本公司章程第三十條規定，依年度獲利狀況，提撥 3%~10%為員工酬勞及不高於獲利之 5%為董事酬勞，實際金額則由薪資報酬委員會提出建議後，提董事會核定通過，並向股東會報告。前開所稱年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。另董事酬勞個別分配，依所參與公司經營日常管理、出席率、股權安定貢獻，併同考量個人所擔負職務及責任，依此基本原則調整分配，由薪資報酬委員會討論訂定後提董事會通過。獨立董事依本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」規定：不參與董事酬勞之分派。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：原董事黃○○於 110 年 6 月 21 日辭任，故本公司於 110 年 8 月 30 日股東臨時會補選董事一席，由鴻圻國際股份有限公司代表人稻見和明先生當選，任期自 110 年 8 月 30 日起至 112 年 8 月 30 日止。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於 1,000,000 元	翁榮隨、金谷保彥、蕭長榮、陳文炯、游張松、梁江蔚、鴻圻國際股份有限公司代表人：稻見和明	翁榮隨、金谷保彥、蕭長榮、陳文炯、游張松、梁江蔚、鴻圻國際股份有限公司代表人：稻見和明	蕭長榮、陳文炯、游張松、梁江蔚	蕭長榮、陳文炯、游張松、梁江蔚
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	黃○○	黃○○		
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）			金谷保彥	
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）			黃○○、鴻圻國際股份有限公司代表人：稻見和明	黃○○、金谷保彥、鴻圻國際股份有限公司代表人：稻見和明
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）			翁榮隨	翁榮隨
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）				
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）				
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）				
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）				
100,000,000 元以上				
總計	8 人	8 人	8 人	8 人

(2)最近年度支付監察人之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：本公司已於民國 109 年 8 月 31 日全面改選董事後卸任，由改選後之全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能，故不適用。

(3)最近年度(110)支付總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：

單位：新台幣千元，千股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳柏棋	6,042	7,809	4,650	10,113	1,652	3,112	1,652	-	1,652	-	15.37%	24.91	無
上海達航實業青浦分公司法人代表	王維倫													
廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表(註 2)	蕭○○(註 1)													
營業一部主管	陳俊程													
管理中心主管	孫逸敏													

註 1：蕭○○於 110 年 7 月 31 日退休。

註 2：廣東達航電子有限公司上海分公司於 110 年 8 月 4 日正式更名為上海達航實業有限公司青浦分公司。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司(E)
低於 1,000,000 元		王維倫
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳俊程	陳俊程
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	孫逸敏	孫逸敏
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	陳柏棋、蕭○○	陳柏棋
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		蕭○○
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	4人	5人

(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

110年12月31日單位：新台幣千元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
總經理	陳柏棋	-	3,160	3,160	3.47
董事長室主任	稻見和明				
製造研發主管	金谷保彥				
上海達航實業青浦分公司 法人代表(註1)	王維倫				
營業一部主管	陳俊程				
管理中心主管	孫逸敏				
會計部主管	劉智鴻				
財務部主管	陳巧梅				
稽核室主管	鄭照慶				

註1：上海達航實業青浦分公司，原為廣東達航電子上海分公司。

註2：110年7月5日 董事會任命 王維倫 擔任 法人代表，正式取得發證日110年8月4日。

註3：110年度配發員工酬勞金額，估列數計新臺幣3,160千元；實際配發員工酬勞之員工，以本公司董事會通過之名單為基準。

2. 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準及組合，訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性。

- (1)本公司及合併報告內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例如下：

名稱	109年度 酬金總額占稅後純益比例		110年度 酬金總額占稅後純益比例	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	18.95%	21.2%	25.79%	27.8%
監察人	1.08%	1.08%	-	-
總經理及副總經理	8.88%	11.74%	15.37%	24.91%

(2)給付董事、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事人之酬金政策明訂於本公司章程內，並經股東會同意通過。總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。本公司對於上述人員之酬金支付，係依據本公司經營成果，衡量管理績效，並參酌市場一般水準而訂定，其支付亦符合本公司薪資相關管理規定，應足以表彰其所承擔的責任及風險。

(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經（學）歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司之職務、與發行人董事之關係及對發行人實質控制情形，另外國發行人並應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任：不適用。

四、資本及股份

(一)股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註1)	未發行股份	合計	
記名式普通股	43,186,998	51,813,002	95,000,000	註2

註1：流通在外股份中，包含員工認股權行使 173,713 股截至刊印日止經濟部尚未完成變更登記。

註2：本公司股票未在證券交易所上市，亦未在證券商營業處所買賣。

(二)股本形成經過

1. 本公司最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

單位：股/金額：新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
80.02	1,000	5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	公司設立股本 5,000 股	無	註 1
80.08	1,000	10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	現金增資 5,000 股	無	註 2
82.06	1,000	25,000	25,000,000	25,000	25,000,000	現金增資 6,600 股	債權抵繳股款 8,400 股	註 3
84.06	1,000	35,000	35,000,000	35,000	35,000,000	現金增資 2,500 股	債權抵繳股款 7,500 股	註 4
85.09	1,000	45,000	45,000,000	45,000	45,000,000	現金增資 7,000 股	債權抵繳股款 3,000 股	註 5
87.03	1,000	150,000	150,000,000	150,000	150,000,000	現金增資 9,500.42 股	債權抵繳股款 140,499.58 股	註 6
90.08	10	95,000,000	950,000,000	36,000,000	360,000,000	現金增資 21,000,000 股	無	註 7
92.11	10	95,000,000	950,000,000	38,000,000	380,000,000	盈餘轉增資 2,000,000 股	無	註 8
94.08	10	95,000,000	950,000,000	48,000,000	480,000,000	盈餘轉增資 10,000,000 股	無	註 9
99.03	30	95,000,000	950,000,000	50,504,500	505,045,000	現金增資 2,504,500 股	無	註 10
99.07	31.8	95,000,000	950,000,000	84,975,600	849,756,000	無	現金以外財產 34,471,100 股	註 11
102.03	10	95,000,000	950,000,000	29,975,600	299,756,000	分割減資(55,000,000)股	無	註 12
103.03	10	95,000,000	950,000,000	31,714,800	317,148,000	無	現金以外財產 1,739,200 股	註 13
103.11	10	95,000,000	950,000,000	44,400,720	444,007,200	盈餘轉增資 12,685,920 股	無	註 14
107.10	10	95,000,000	950,000,000	44,343,500	443,435,000	註銷庫藏股 57,220 股	無	註 15
110.04	10	95,000,000	950,000,000	42,844,337	428,443,370	註銷庫藏股 1,499,163 股	無	註 16
110.06	10	95,000,000	950,000,000	43,013,285	430,132,850	員工認股權增資 168,948 股	無	註 17

註1：80.02.25八○建三庚字第一七○九○五號。

註2：80.08.15八○建三丙字第二六四八九三號。

註3：82.06.15八二建三丙字第三二二六一二號。

註4：84.06.24八四建三癸字第三九○一七○號。

註5：85.09.16八五建三戊字第二二九八○八號。

註6：87.03.06經(87)商字第一○二二四四號。

註7：90.08.06經(0九○商09001304110號。

註8：92.11.10經授中字第09232932880號。

註9：94.08.03經授中字第09432579610號。

註10：99.03.18經授商字第09901051330號。

註11：99.07.08經授商字第09901145770號，發行新股合併Ofuna Holding Co., LTD。

註12：102.03.20經授商字第10201043550號。

註13：103.03.05府產業商字第10380601020號，發行的新股取得，分別取得大船企業日本株式會社100%股權與台灣田中

貴金屬股份有限公司10%之股權。
 註14：103.11.24府產業商字第10390289300號。
 註15：107.10.01府產業商字第10754096000號。
 註16：110.04.01府產業商字第11048057000號。
 註17：110.06.01府產業商字第11049688710號。

2. 最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無。

(三)最近股權分散情形

1.股東結構

單位:人/股；111年3月31日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	-	-	12	568	7	587
持有股數	-	-	19,538,990	23,047,687	600,321	43,186,998
持股比例(%)	-	-	45.24	53.37	1.39	100

2.股權分散情形

單位：人；股；111年3月31日

持股分級	股東人數	持有股數(股)	持股比例(%)
1 至 999	144	54,423	0.13
1,000 至 5,000	238	507,560	1.17
5,001 至 10,000	44	343,898	0.80
10,001 至 15,000	45	542,106	1.25
15,001 至 20,000	19	328,389	0.76
20,001 至 30,000	19	481,763	1.12
30,001 至 40,000	18	623,810	1.44
40,001 至 50,000	7	338,365	0.78
50,001 至 100,000	22	1,622,385	3.76
100,001 至 200,000	9	1,296,862	3.00
200,001 至 400,000	10	2,980,972	6.90
400,001 至 600,000	1	500,000	1.16
600,001 至 800,000	2	1,274,070	2.95
800,001 至 1,000,000	1	1,000,000	2.32
1,000,001 以上	8	31,292,395	72.46
合計	587	43,186,998	100.00

3.主要股東名單

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

單位：股；111年3月31日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
黃立達	9,847,615	22.80%
鴻圻國際股份有限公司	6,670,000	15.44%
鴻洋投資股份有限公司	5,878,159	13.61%
韶瑞開發股份有限公司	3,285,714	7.61%
翁榮隨	2,103,000	4.87%
鴻盛投資股份有限公司	1,316,705	3.05%
大船企業股份有限公司	1,129,554	2.62%
康和綜合證券股份有限公司	1,061,648	2.46%
李瓊如	1,000,000	2.32%
黃家揚	642,051	1.49%

4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形：無。

5.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(1)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十大股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	109年度		110年度		當年度截至 刊印日止	
		持有股數 增（減）	質押股數 增（減）	持有股數 增（減）	質押股數 增（減）	持有股數 增（減）	質押股數 增（減）
董事	鴻圻國際股份有限公司 代表人：稻見和明	-	-	39,000	-	12,000	-
董事長	翁榮隨	(32,000)	-	-	-	-	-
董事暨 10%持 股以上股東	黃立達	-	-	-	-	-	-
董事	韶瑞開發(股)公司	-	-	-	-	-	-
董事	金谷保彥	-	-	-	-	-	-
董事	蕭長榮	-	-	-	-	-	-
總經理	陳柏棋	-	-	34,000	-	10,000	-
監察人	普實創業投資(股)公司	-	-	-	-	-	-
監察人	洪啟宗	-	-	-	-	-	-
獨立董事	陳文炯	-	-	-	-	-	-
獨立董事	梁江蔚	-	-	-	-	-	-
獨立董事	游張松	-	-	-	-	-	-
10%以上股東	鴻洋投資(股)公司	-	-	-	-	-	-
10%以上股東	鴻圻國際(股)公司	-	-	-	-	-	-

註1：109/08/31 全面改選新任董事(含獨立董事)，由三席獨立董事設置審計委員會取代監察人。

註 2:110 年 6 月 21 日董事黃立達辭任董事，並於 110 年 8 月 30 日第一次股東臨時會辦理董事補選，由法人股東鴻圻國際(股)公司指派稻見和明先生為法人代表人董事並選任之。

(2)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(3)股權質押之相關人為關係人者：無。

6.持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

111 年 3 月 31 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有之股份		利用他人名義持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(或姓名)	關係	
黃立達	9,847,615	22.80	-	-	-	-	黃家揚	父女	-
鴻圻國際(股)公司 董事長：黃立達	6,670,000	15.44	-	-	-	-	註	註	-
鴻洋投資(股)公司 董事長：黃立達	5,878,159	13.61	-	-	-	-	註	註	-
韶瑞開發(股)公司 董事長：翁榮隨	3,285,714	7.61	-	-	-	-	翁榮隨	為該公司之董事長	-
翁榮隨	2,103,000	4.87	1,000,000	2.32	-	-	李瓊如	配偶	-
鴻盛投資(股)公司 董事長：黃立信	1,316,705	3.05	-	-	-	-	註	註	-
康和綜合證券(股)公司 董事長：鄭大宇	1,150,163	2.62	-	-	-	-			-
大船企業(股)公司 董事長：黃立達	1,129,554	2.46	-	-	-	-	註	註	-
李瓊如	1,000,000	2.32	2,103,000	4.87	-	-	翁榮隨	配偶	-
黃家揚	642,051	1.49	-	-	-	-	黃立達	父女	-

註：鴻圻國際(股)公司、鴻洋國際(股)公司、大船企業(股)公司之代表人為黃立達；鴻盛投資(股)公司之代表人為黃立信。黃立信與黃立達為兄弟。

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：元/千股

年度		109年	110年
項目			
每股市價	最 高	未上市（櫃）	未上市（櫃）
	最 低	未上市（櫃）	未上市（櫃）
	平 均	未上市（櫃）	未上市（櫃）
每股淨值	分 配 前	24.17	25.37
	分 配 後	22.81	23.62(註7)
每股盈餘 (註1)	加權平均股數		42,740
	每股盈餘 (註2)	追溯調整前	2.09
		追溯調整後	2.12
每股股利	現金股利		1.40
	無償配股	盈餘配股	-
		資本公積配股	-
	累積未付股利 (註3)		-
投資報酬 分析	本益比(註4)		未上市（櫃）
	本利比(註5)		未上市（櫃）
	現金股利殖利率(註6)		未上市（櫃）

註1：請依據董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。

註2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股。

註6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註7：110年度盈餘分配案經董事會同意，尚未經股東常會決議。

(五)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就當年獲利提撥不低於 20% 分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 20%。

2.本年度股東會決議之盈餘分配情形

本公司 110 年度盈餘分配案，業經 111 年 3 月 15 日董事會通過，分配如下：股東紅利(現金股利)新台幣 75,000,000 元，現金股利每股配發新台幣 1.743647 元；截至公開說明書刊印日止尚未經股東會承認。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(七)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司章程第二十六條：本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給之。第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥 3%~10% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於獲利之 5% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。

本公司員工及董事酬勞係依公司章程以可能分配之金額為估列基礎，本期估列費用若與股東會決議有所差異，則視為會計估計變動，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

業於 111 年 3 月 15 日董事會決議分派 110 年度員工酬勞 6,000 千元，董監酬勞 3,600 千元，全數以現金為之，與估列數並無差異。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果

經 110 年 3 月 15 日董事會決議分派 109 年度員工酬勞 5,000 千元，董監酬勞 3,000 千元，業於 110 年 7 月 5 日向股東常會報告。全數以現金為之，與估列數並無差異。

5. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

(八)公司買回本公司股份情形：

1. 已執行完畢：

(1) 本公司 103 年 12 月 31 日止原本持有卓越國際投資(股)公司股票 115,101 股，104 年度卓越國際投資(股)公司辦理減資退還財產(退還達航科技股票)，因而本公司取得庫藏股 57,220 股，每股單價 23.80 元，合計 1,362 千元；已於 107 年 10 月辦理註銷。

(2) 107 年 03 月買回庫藏股計 1,603,163 股，每股單價 21.80 元，合計 34,949 千

元。已於 110 年 4 月辦理註銷。

111 年 3 月 31 日

買 回 期 次	第1次	第2次
買 回 目 的	減資退還財產	轉讓員工
買 回 期 間	104年09月	107年03月
買 回 區 間 價 格	23.80元/股	21.80元/股
已買回股份種類及數量	普通股 57,220股	普通股1,603,163股
已買回股份金額	1,362千元	34,949千元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	57,220股	1,603,163股
累積持有本公司股份數量	0股	0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數率 (%)	0.00%	0.00%

2. 尚在執行中：無。

五、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證：

111 年 4 月 22 日

員工認股權憑證種類	107 年度員工認股權證
申報生效日期	公開發行前所發行，故不適用
發行日期	107 年 7 月 31 日
存續期間	自發行日起算六年
發行單位數	分兩階段發行，第一階段 107 年 7 月 31 日發行 1,000 張，第二階段 500 張另訂發行日期
發行得認購股數占已發行股份總數比率	2.25%
得認股期間	認股權人於每年下列時間(若遇依法暫停過戶期間，則停止行使認股權)，得依本辦法第五條第二項所訂時程行使權利，並填具員工認股權請求書向本公司之股務代理機構或本公司提出申請。 (1)3月20日至3月30日。(2)9月20日至9月30日。
履約方式	以本公司發行新股交付
限制認股期間及比率(%)	自被授予本員工認股權憑證屆滿兩年後，可依下列時程行使其認股權利： (1)自被授予本員工認股權憑證屆滿兩年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之五十為限，行使認股權利。 (2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之七十為限，行使認股權利。 (3)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之百，行使認股權利。 (認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。)
已執行取得股數	342,661 股
已執行認股金額	8,566,525 元
未執行認股數量	657,339 股
未執行認股者其每股認購價格	由董事會決議認購價格
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	1.53%
對股東權益影響	本公司員工認股權憑證發行目的係為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。因員工認股權憑證酬勞成本係於既得期間內平均分攤費用，故本公司發行之員工認股權對股東權益尚無重大影響。

(二)累積至公開說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

單位：千股/新台幣千元

職稱		姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率%	已執行				未執行			
					認股			認股數量占已發行股份總數比率%	認股			認股數量占已發行股份總數比率%
					數量	價格	金額		數量	價格	金額	
經理人	董事長室主任	稻見和明	210	0.49	133.5	25	3,338	0.31	76.5	25	1,913	0.18
	總經理	陳柏棋										
	管理中心主管	孫逸敏										
	營業一部主管	陳俊程										
	會計部主管	劉智鴻										
	財務部主管	陳巧梅										
	稽核室主管	鄭照慶										
員工	CNC 技術服務主管	周永庭	290	0.67	87	25	2,175	0.20	203	25	5,075	0.47
	營運管理中心主管	李慧玲										
	製造研發主管	蔡耀華										
	營業三部主管	陳星文										
	主軸產品主管	張宸銘										
	雷射應用主管	曾黃彬										
	營業一部副主管	陳志明										
	NDNR 售服產品主管	洪進展										
	品證部主管	戚大鈺										
	研發工程師	林雍盛										

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無。

十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

參、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)公司所營業務主要內容：

CB01010	機械設備製造業
CC01080	電子零組件製造業
CC01030	電器及視聽電子產品製造業
F113020	電器批發業
F119010	電子材料批發業
F113070	電信器材批發業
F213060	電信器材零售業
F113010	機械批發業
F213080	機械器具零售業
F401010	國際貿易業
F107170	工業助劑批發業
F207170	工業助劑零售業
JE01010	租賃業
F115010	首飾及貴金屬批發業
F215010	首飾及貴金屬零售業
J101080	資源回收業
J101090	廢棄物清理業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)營業比重

單位：新臺幣千元

主要產品 類別	109 年度		110 年度		111 年度第一季	
	營業收入 淨額	佔營收比重 (%)	營業收入 淨額	佔營收比重 (%)	營業收入 淨額	佔營收比重 (%)
專業服務	824,878	82.41	688,763	55.30	172,606	42.00
設備產銷	154,963	15.48	524,659	42.12	201,485	49.02
其他(註)	21,059	2.11	32,089	2.58	36,873	8.98
合計	1,000,900	100.00	1,245,511	100.00	410,964	100.00

註：其他係代理類收入。

(3)公司目前之商品(服務)項目：

A、專業服務-雷射應用

本公司憑藉自主研發生產的雷射鑽孔機設備，以及自主雷射光源整合之技術，所提供之專業雷射鑽孔技術服務，已因應各式高密度、多層型與微型等規格的載板之製程需求，其行銷方式，分別透過設備及專業技服人員駐廠，或高規格場域空間及設備服務客戶之製程需求，目前本公司之雷

射應用，可廣泛服務 IC 載板、半導體 wafer、5G、車用板、Mini LED、智慧型手機、iPAD、筆記型電腦、穿戴等產品之製程。

B、專業服務-設備維修、保養及改造

本公司除因具備自製機械鑽孔機及成型機設備的能力，然因設備於經歷長期生產下，存在耗損或效能不佳之情事，故本公司提供客製化設備保養及維護服務技術，協助客戶讓既存設備得以穩定運轉，確保投產之稼動率及產能效率，其行銷方式係透過定期合約、接單式或駐廠等服務方案支援，另，設備維修保養所需汰換之關鍵性耗材零件需求，本公司透過自主開發生產方式支應。

C、設備產銷-自有品牌之鑽孔及成型設備

本公司擁有自有品牌高精密鑽孔及成型設備，其軟硬體係透過自主開發的高速主軸、自動檢測、相關刀具等機構組件，完成高精密鑽孔機設備及成型機之生產，其產品可應用於 PCB(RAM module、穿戴裝置、車載板等)、IC 載板等產業之鑽孔製程中，而成型機設備，則服務於 PCB(RAM module、穿戴裝置、車載板等)、IC 載板、面板(MiniLED)、IC 封裝等產業之成型製程。

(4)計劃開發之新商品(服務)：

A、雷射鑽孔機

產業目前市場現況，臺灣市場上的設備供給者，目前仍以日商三菱電機為主流，其次則為原隸屬日立維亞旗下品牌 HitachiVia mechanics 為主要供應商(於 102 年日立製造所已出售其股權)，本公司目前自製開發之雷射鑽孔設備，已達進口雷射鑽孔設備產品水準，惟考量本公司雷射鑽孔機規格及性能與主流品牌相當，單純設備銷售較無差異化優勢，但因設備投資金額高昂，半導體技術持續微縮，PCB 產業高階領域設備生命週期很難超過 5 年，本公司自行研發階段既已考慮該特性，因此可以透過升級即可因應不同規格、材料的變化，讓代工所需的設備資產可在不同時期符合客戶需求，因此採用以自製研發設備用於代工服務客戶的創新商業模式進入市場。

此外，考量客戶即使有充裕資金可以投資雷射製程設備，因製造業人力募集及高階載板工程師技職人才培育趕不上需求，預測客戶可能擔憂即使有廠房有設備，缺乏操作設人力及技術製程工程人才而衍生代工需求，本公司有別於其他代工同業僅採用與客戶相同設備而未自行培養技術團隊，而是有自行培養多名工程技術及開發工程師，且使用自有品牌雷射設備開發技術及製程參數，技術與同業有差異化，線上人員於機器操作上相較同業更有彈性，且人員較不易被同業挖腳。故本公司政策維持以代工方式提供客戶服務。未來倘有銷售之機會，則會限定銷售 UV 雷射鑽孔機，

以與現在的 PCB 產業的主流加工機種 CO2 雷射鑽孔機有所區隔，銷售對象則會限定為非 PCB 的潛力市場，並依據市場情勢因應調整。

未來本公司仍將掌握市場脈動及洞察先進製程演進，並透過產品線調整及提昇自製能力，以優化客戶產線製程，期望本公司雷射鑽孔機產品於與客戶進行磨合並可量產後，能逐漸打入半導體、光電業、生技醫療產業之供應鏈，至於目前已提供之雷射加工服務，本公司除原有客戶外，將逐漸拓展 PCB 之第二線客戶以及其他產業，已有光電相關客戶之合作實績，此外半導體也有幾客戶正在測試驗證中。

本公司因產能受限及未具顯著市場實績，故以鑽孔代工服務方式持續精進機台功能及厚植設備研發能量，相較國內其他鑽孔代工同業凱崙及尖點公司，本公司具備設備開發自主化能力，故可順應市場各式製程技術需求進行產能彈性調整。

綜上顯見，本公司 CO2 雷射鑽孔機台品質已獲市場肯定，未來仍持續採取鑽孔代工業務及機台銷售並行策略，擴大營運規模。

B、主軸

主軸(鑽頭)之用途，係於設備上帶動刀具或工件旋轉，產生切削運動的運動軸。按照主軸(鑽頭)的驅動方式，主軸可分為機械主軸(鑽頭)和電主軸(鑽頭)兩大類。機械主軸(鑽頭)通過主軸電機與中間的傳動裝置(變速齒輪、皮帶或聯軸器)帶動軸旋轉進行工作，其輸出扭矩和功率大，但轉速、精度和平穩性相對較差。電主軸(鑽頭)係將設備主軸功能與電機功能從結構上融為一體的新型主軸元件，也就是高速電機直接安裝於主軸部件內部，去除了皮帶、齒輪或聯軸器等影響轉速、精度、使用壽命的不利因子，大幅提升了主軸高速運轉的整體性能及加工品質，具有機械主軸不可替代的優越性。

高端設備，如航空及汽車高精度零件加工所使用的五軸加工設備、半導體所使用研磨及切割主軸、PCB 所使用小孔和微孔加工設備等，由於製程和加工元件的特殊性，其對主軸的轉速、精度以及設備結構都有極高且特殊要求。電主軸憑藉一體化的結構設計和高轉速、高精度的優異性能，有效地實現了高端加工的特殊要求。

主軸從低轉速(3 千轉)到極高轉速(35 萬轉)需要長時間的製造技術經驗累積且開發不同金屬材料結合製程、微米等級高精密軸承、高穩定性電機等高技術含量的不斷突破、創新，本公司憑藉著多年的經驗及研發，逐漸研發出高端主軸。面對中國紅色供應鏈複製品牌廠商經驗、低價替代性材料、低廉的衛星工廠成本，在中低轉速主軸市場屢屢創造破壞性價格(僅約品牌主軸的一半價格)之情形下，於機械鑽孔市場上，本公司係採取與競爭對手間會適度地保持服務差異化，以符合客戶追求先進製程規格之需求，

高端主軸(20 萬、30 萬、35 萬轉)市場目前是供不應求，隨著航空、汽車、半導體、電子產業的持續增長，預估未來三年內對於主軸仍是供不應求的狀況，本公司目前空氣軸承式主軸產品已可達 38 萬轉。

本公司已於臺中廠區改建專屬雷射應用加工之廠房，以符合未來高精度加工需求，並導入智慧化全廠監控系統，其環境尚符合恆溫、恆濕、無塵之環境，並透過全廠無線網路佈署，讓各終端裝置具備 IoT 機能即時回報數據，提升加工品質，進行 IC 載板、ABF 等高精度加工，為客戶提供更快、更彈性的解決方案，另，本公司仍持續提升鑽孔設備工藝技術，由於，消費性電子產品愈趨強調輕薄短小，相關行動裝置、智慧手機可保留給予相關 PCB 或載板的空間愈來愈細小，致孔徑製程的精細程度將更具挑戰，因此，雷射應用之微整型將朝多元化發展，最後，高轉速 35 萬轉高精度鑽孔機及 CCD6 軸各別驅動鑽孔機產品之升級與加值應用，有助智能化及節能生產之市場需求。

2. 產業概況：

(1) 產業之現況與發展

本公司專精鑽孔工藝技術的支援服務，本身擁有自製鑽孔、成型設備及改造設備的能力，其提供先進載板製程所需，係用以輔助次世代產品之製程，另，本公司亦提供設備完整的解決方案，以優化產線運作。本公司產品係應用於 5G 智慧型手機、網通伺服設備、自動車、WI-FI(如 SpaceX 的衛星網路計畫)、輕薄筆電等產品的 PCB 板或載板之製程中，近年來，也逐漸拓展多元的雷射微孔技術，以因應光電或半導體等產業之製程需求，其相關產業現況與發展分析如下：

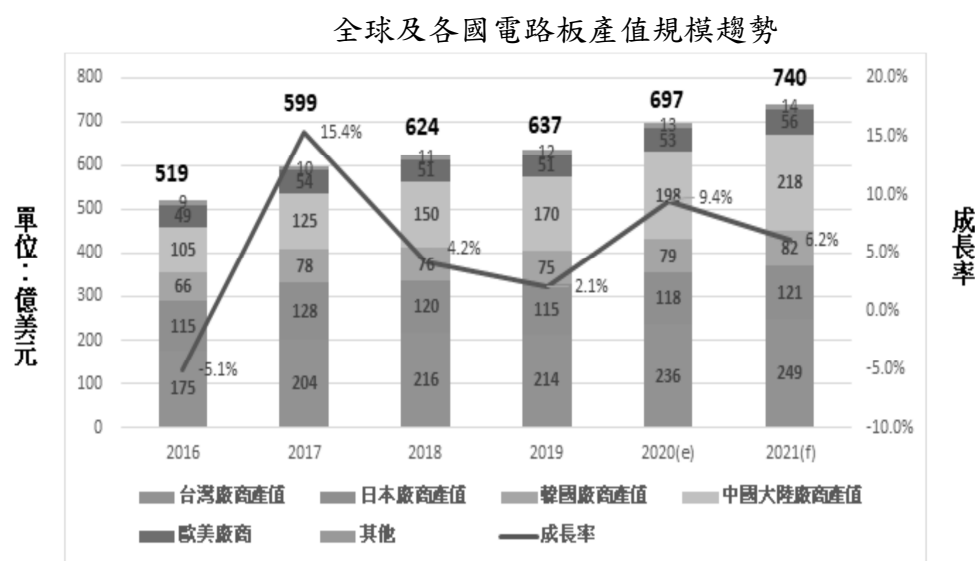
A、PCB 產業概況

印刷電路板(Printed Circuit Board; PCB)係將各種電子零組件藉由印刷電路板所形成之電路設計，做為組成零件間訊息溝通之重要媒介與承載，使各項零組件之功能得以發揮，可謂為電子產品的根基，廣泛應用於所有電子、通訊、資訊家電，汽車與航太產品。其類別有傳統的單/雙面板、多層板、HDI 高密度連結板、IC 載板與軟板。隨著電子資訊及通訊產品需求擴增，並趨向輕薄短小與多功能化，對 PCB 產品(如 HDI 與 IC 載板)之需求走向高階細密化，因此，對於精密工藝設備之需求將愈為殷切，另，近幾年，隨著晶片製程由 7nm 向 5nm 發展以及 5G 時代的來臨，半導體封裝產業，亦逐漸往微細化發展，故在先進製程上，鑽孔工藝亦可透過雷射應用方式，以達高準確度及微小孔之目標。

(A)全球 PCB 產業

依據 IEK 及 TPCA 資料顯示，109 年全球遭逢 COVID-19 疫情影響，原本預計全球電路板會面臨營收衰退的困境，但在公佈的 109 年

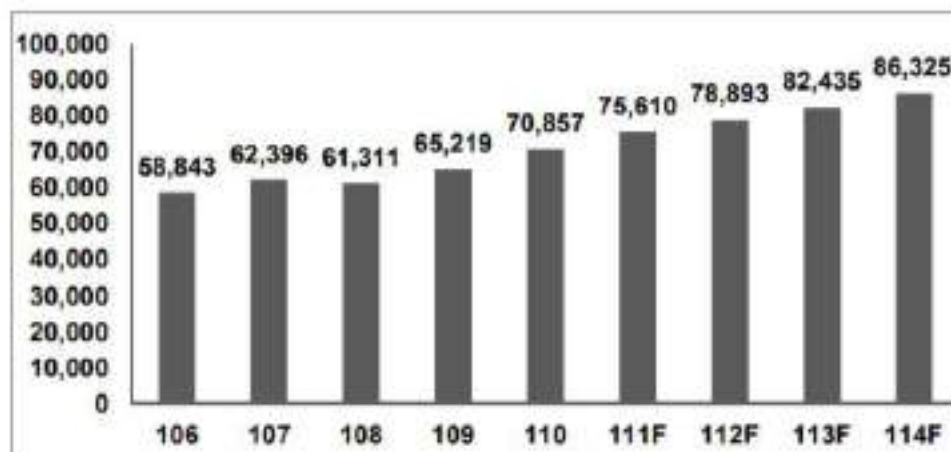
第一季至第三季營收判斷如下圖，109 年全球全球電路板產值(包含電路板廠商從事後段打件產值)預估將創下約 697 億美金規模，相較 108 年成長率達到 9.4%，此一產值及成長率相較年初預估有相當大的落差存在，109 年全球電路板產值(包含電路板廠商從事後段打件產值)預估約 697 億美金規模，相較 108 年成長率達 9.4%。疫情雖然影響了如汽車、智慧型手機...等電子產品的需求，但也因疫情改變了生活型態而衍生了意料外的產品需求，例如遠端線上會議新增的通訊及視訊設備、宅經濟帶動的平板電腦及遊戲機、Work From Home 新增的筆記型電腦，尤其筆記型電腦 109 年出貨量預估超過 2 億台，年成長率超過 20%，因此筆記型電腦電路板相關供應商均有不錯的成長動能，也成為帶動整體產值成長的力量之一。5G 效應商機亦不受疫情影響，5G 基地台的 ABF 載板、通訊設備的高速超高層板、5G 手機的 AiP 皆為高階電路板產品且具更高的平均單價，因此 5G 高階的高價產品也帶動 109 年整體產值。



資料來源:TPCA; 工研院 IEK (2021/03)

根據 Prismark 預測，全球印刷電路板產值由 98 的 412 億美元增長到 108 年的 613 億美元，成長幅度 49.0%，預估 109 年成長率為 2.0%，各式印刷電路板產業將在 107 至 112 年之間以 3.7%的年均複合增長率成長。

106-114 年全球印刷電路板市場規模



資料來源：Prismark(110/02)

[註]111-114 年之數值為預估值。單位：百萬美元。

(B) 臺灣 PCB 產業

109 年台灣電路板產值約為 6963 億新台幣，若以原始訂單美元計算產值約為 236 億美元，相較 108 年大幅成長 10.2%(換算台幣則因台幣大幅升值，因此成長率降為 5.1%)。根據 IMF 於 110 年 1 月 26 日所發布更新的「世界經濟展望」報告，110 年全球經濟成長率預估為 5.5%，其中預期在 COVID-19 疫苗加速推動施打以及更多財政刺激措施實施下，將抵銷疫情於全球造成的持續性影響，此亦是對於 110 年發展持樂觀態度的主要原因。不過雖然各國開始施打疫苗有機會讓終結疫情的期待露出曙光，110 年下半年經濟增長可望恢復正常，但由於疫苗的供應有限，復甦將呈現不均衡的情況，而同時由於新一波感染和病毒變異帶來風險，全球經濟將繼續面臨高度的不確定性。

臺灣電路板產值規模趨勢

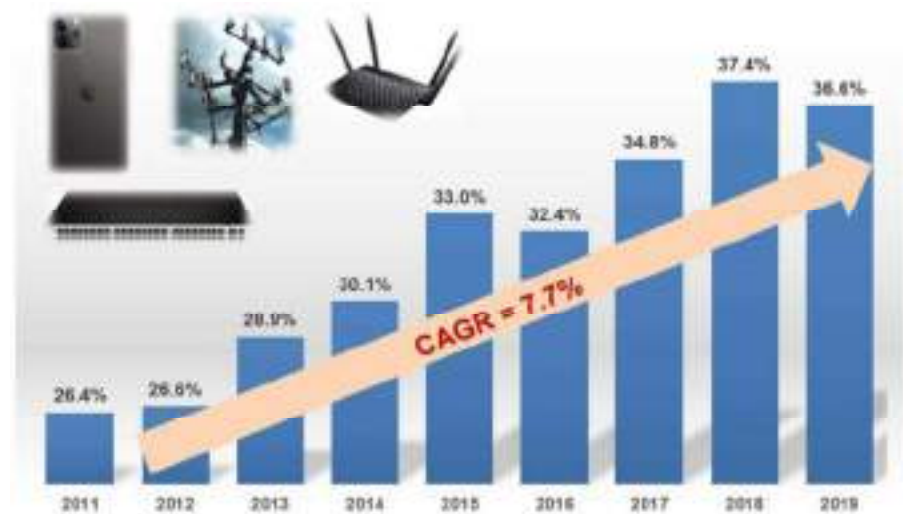


(C)、5G 持續推動 PCB/載板

台灣產業隨著歷年通訊技術演進，每每抓住世代更迭下的商機，長期而言通訊應用持續提高，就統計數據來看，100 年台灣電路板通

訊應用產值比重 26.4%至 108 年提升至 36.6%，期間產值亦以 7.7% 年複合成長率明顯優於整體平均的 3.4%。總結來說，通訊已成為台灣電路板產業發展的領頭羊，不論在高階技術或者相關應用等內在因素上皆已累積許多經驗與優勢，因此隨著 5G 的部署以及 Beyond5G 技術發展方向的浮現，若於技術研發上持續精進將有助於保持競爭力，以下列舉出與 PCB 高度相關之產品、應用或技術項目並進一步探討。

臺灣 PCB 通訊應用產值比重趨勢



資料來源：工研院產科國際所；IEK。

B、雷射應用(加工)

雷射加工技術在工業上的應用，從金屬切削、鋼板切割、焊接及熱處理等機械加工，到電子產業中的印刷電路板鑽孔、TFT LCD 切割、晶圓切割及 MEMS 加工技術等，都已有十分廣泛的應用。

根據調研機構 Maximize Market Research 資料顯示，全球雷射材料加工市場規模將從 105 年的 64 億美金成長至 113 年的 97 億美金，複合成長率約達 6%，呈現穩健成長的態勢。雷射材料加工市場可大致分為雷射標籤、雷射精密加工(金屬切割/焊接等)和雷射清潔等領域。未來材料加工之需求將隨經濟發展和終端應用如消費性電子(手機、平板/筆電、穿戴式裝置、面板)、車用、工業等領域發展而持續增加，雷射技術將成為相關應用之關鍵技術，有助推動各項產業向上成長。



近年來，在 5G 通訊、IA 等此產業可攜性輕薄短小，多功能及價格低廉的要求，印刷電路板遂走向高密度佈線、細線及小孔化、複合多層化、薄板化發展，另雷射精微加工領域部分，受到光電半導體產業近年吸睛產品 OLED、Micro-LED 影響，與其相關之製程技術用雷射源亦跟著發展，例如 Coherent Inc.之 CO₂ 雷射，因其波長特性，200W 之 CO₂ 雷射可用於玻璃切割、PCB 通孔鑽孔；切割 OLED 面板之紫外光皮秒脈衝雷射源，加入感測器與精準光束控制模組，可提供光電半導體產業高速發展之解決方案。

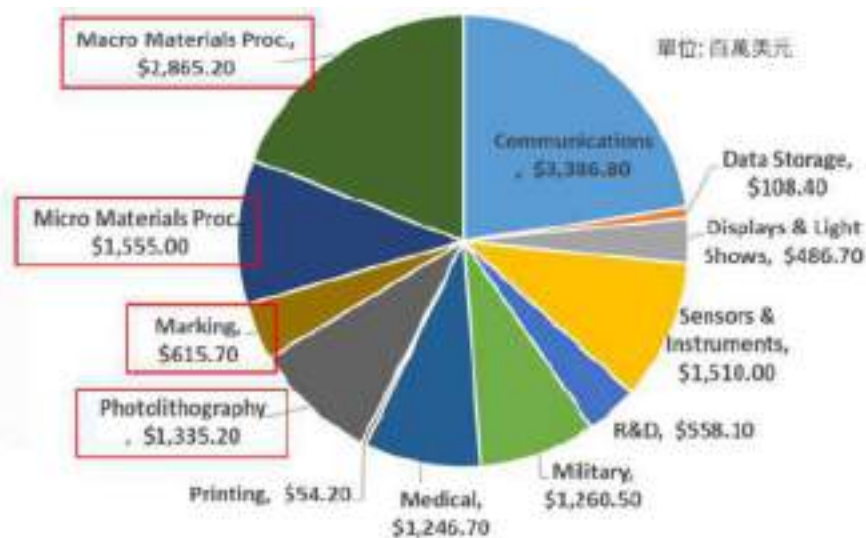
根據專業雷射雜誌 Photonics Spectra 在 106 年 10 月刊指出，超短脈衝與高峰值功率為固態雷射未來發展趨勢，並且適合電路板焊接與切割金屬薄板。雷射功率愈高，加工速度越快。以二極體當激發光源，可以大幅降低超短脈衝雷射成本。在粗加工(Macro processing)的部份，雷射源功率愈高，加工效率愈高。在細加工(Micro processing)的部份，脈衝愈短，對於工件的熱影響區(heat zone)愈小，加工的精度越高。

Macro machining >KW	Micro Machining <KW	Marking
Cutting	Texturing	Marking
Welding	Drilling	
Additive Manufacturing	Surface Hardening	
Melting	Cleaning	

資料來源:工研院產科國際所 ITIS 研究團隊(2020/12)

108 年雷射加工(包含微影)仍然是比重最大的應用市場，占整體的 42.5%，產值達 63.7 億美元，相較於 107 年下滑 8.4%。第二大的應用是通訊與儲存，占整體產值 22.6%，產值達 33.9 億美元，相較於 107 年下滑 4.3%。除了這兩項應用下滑之外，其餘的應用，醫美、科研軍事、感測儀器、娛樂/顯示/印刷皆呈現成長。

108 年雷射應用市場之產值分析



資料來源:Strategies Unlimited (2020/04)

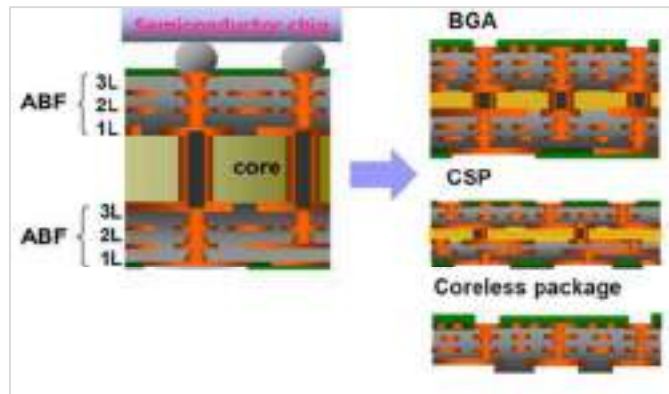
(A)載板鑽孔製程與載板材料應用，為次世代產品之關鍵製程

科技日新月異，當今的變化速度相當快，各項應用也開始發展多功能化及高頻高速傳輸的產品項目，產業對 IC 載板的需求與日俱增，同時，規格要求也越來越高，必須具有高耐熱、低熱膨脹、低介電和低損失的特性來達成通訊高頻高速化的發展，而 ABF 材料正好具有此一優勢，所以，目前 ABF 載板有相當高的市場需求。

Ajinomoto Build up Film (以下簡稱:ABF) 是目前需求量大且適合高頻高速 IC 載板使用之絕緣材料，推估 109 年至 113 年 ABF 載板需求的年複合成長率接近 17%，整體市場規模將於 113 年達到 70 億美元。

ABF 樹脂配方主要由環氧樹脂和二氧化矽無機填料組成樹脂配方經塗佈後成膜。ABF 主要用於導入覆晶構裝製程等高階載板的生產，可製成較精細的線路，可減少載板整體的厚度，同時也解決在 BT 樹脂載板在雷射鑽孔所遇到的困難。不論是從 BGA 封裝或 CSP 封裝甚至到現在直接使用 ABF 樹脂為核心的 Core Less 封裝，ABF 樹脂都扮演著重要的角色。

ABF 載板結構



資料來源：味之素；IEK。

目前伺服器和通訊設備的 IC 封裝層數和使用面積都在增加，由於，訊號傳輸中最關鍵的為傳輸損耗，傳輸損耗是由導體的損耗和介質的損耗所相加而成，當 ABF 樹脂有 low Dk 和 low Df 的特性，能滿足低介質損耗，雖然當今仍有新的增層材料在研發中，但因 ABF 樹脂的優勢，至今仍為 IC 高速載板採用的標竿產品這也是目前 ABF 載板總銷量增加的主要原因。

由於，近年各國自動駕駛車技術蓬勃發展，各國車廠皆投入大量資源，自駕車上會使用先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems ADAS) 和自動駕駛技術，其中會使用多樣的感測器來達到輔助和自動駕駛的功能，由於，SoC (System on a Chip) 能減少體積、減少成本、提升系統效能、降低耗電量同時提高運算速度，車用電子對 ABF 高速載板的需求預計會持續增長。

(B)雷射應用加工與半導體產業

109 年臺灣半導體產業產值達新臺幣 3 兆以上之規模，居全球先進製程領先之地位。現今，5nm 晶片已經完成且成功的整合在行動裝置。很大程度要歸因於一家荷蘭半導體設備公司阿斯摩爾 (ASML) 的獨創性，它開創了一種透過極紫外光 (EUV; Extreme Ultra Violet) 微影的工藝，將電路圖案雕刻到矽晶圓的方法。而這項關鍵設備的關鍵模組，就是雷射。也就是說雷射源是關鍵中的關鍵，有雷射才有極紫外光微影設備，有極紫外光微影設備才能做出 5nm 以下的晶片，新的手機才有更先進的功能與更低的功耗。

雷射除了可以用在微影，也非常適合加工半導體晶片，不論是切割、打標、鑽孔、量測、退火、取下製程都需要雷射來完成，而這幾項半導體製程，運用雷射加工都具有相對的優勢。

半導體與PCB製程中的雷射應用

LASER PROCESSING	PROCESS STEP	APPLICATIONS						
Removal process	Dicing/scribing	Thin Si wafer	MEMS devices	Low-loss IC, backside metal	LED supplier dicing	Compound Semiconductor	Packaging dicing (ICs, LEDs with PCB)	
	Drilling	PCB flex, PCB HDI	IC substrate (interposer)	IC package: TQFP	LTCC			
	Marking	Mold compound	Si wafer					
	Trimming	Memory repair cuts	Embedded chip in PCB					
Exposure	Patterning/photography	PCBs flex/rigid	HDI PCBs	Advanced packaging platforms (BDL, seed layer)			FC BGA/FC CSP	
Bonding process	Bonding/welding	Metal welding	Plastic welding (MEMS, µP)	Solder bonding/flip chip bonding				
	Temporary bonding & debonding	Semiconductor debonding (carrier)	LED die-off	FO WLP debonding	Power ICs debonding	Sensor debonding	3D memory	
Returning process	Laser deposition	PVD pulsed laser Thin-film deposition	Additive manufacturing					
	Laser annealing	SiGe to separate activation	CMOS image sensors	Memory & logic				
Inspection & Metrology	Measurement	Particles, defects	Bump measurement					

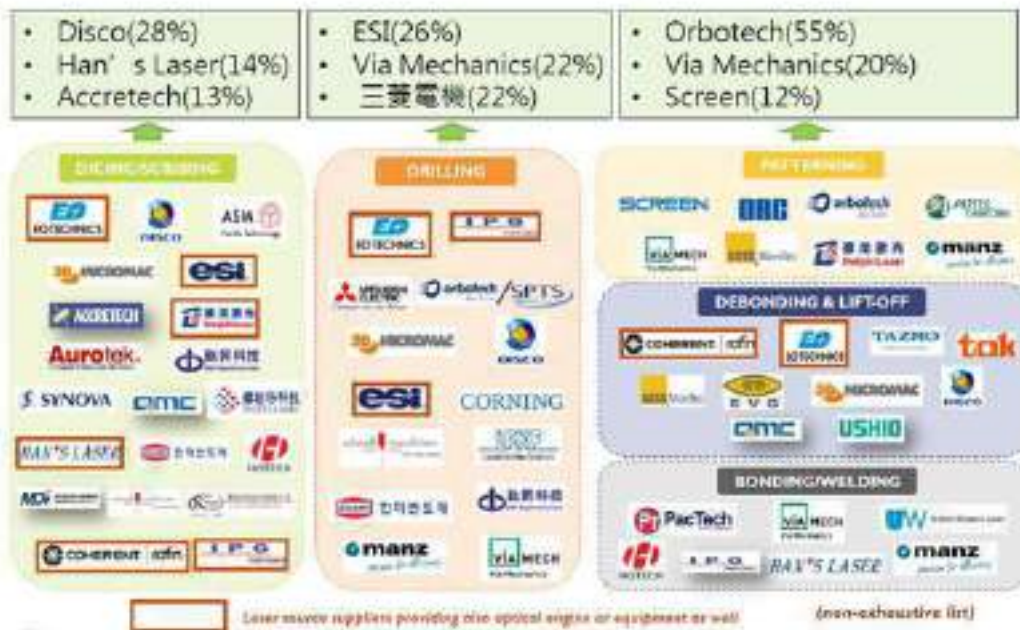
資料來源:工研院產業科技國際策略發展所 108.09

半導體/PCB製程主要雷射設備(依市場規模)

設備總類		(1) 分割/切割 Dicing/Cutting	(2) 鑽孔 Drilling	(3) 圖形轉移 Patterning
市場規模 (百萬元)	2016	668.5	451.8	244.7
	2019(f)	835.0	584.8	311.2
	2022(f)	1,047.0	760.8	396.4
2016~2022 CAGR		8%	9%	8%
應用範疇		- 畫線(Scribing) - 開槽(Grooving) - 完全切割(Full cut) - 隱形切割(Stealth dicing)	- PCB鑽孔 - 低溫共燒陶瓷(LTCC)基板鑽孔 - 半導體IC基板鑽孔 - 半導體IC封裝	- PCB - 低溫共燒陶瓷(LTCC)基板 - 半導體IC基板
市場驅動因素		- 避免晶圓破片 - 縮小品粒尺寸 - 增加良率 - 減少微粒、毛邊 - 因應新基板材料	- 增加少數層多孔產品製成成本效益 - 因應新基板材料 - 因應封裝尺寸縮減 - 增加小直徑鑽孔效能	- 降低成本 - 增加良率 - 因應晶粒尺寸縮減 - 無微影光罩污染 - 可適應多種材料

資料來源:Yole(2017/10)工研院產業科技國際策略發展所 108.06

全球半導體/PCB製程雷射設備供應商



資料來源:Yole(2017/10)工研院產業科技國際策略發展所 108.09

半導體與PCB製程雷射鑽孔設備市場規模



TMV(Through-Molding-Via)直通樹脂導孔
LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) 低溫共燒陶瓷
PCB(Printed Circuit Board)印刷電路板
HDI(High Density Interconnect)高密度互連
Flex PCB軟性印刷電路板

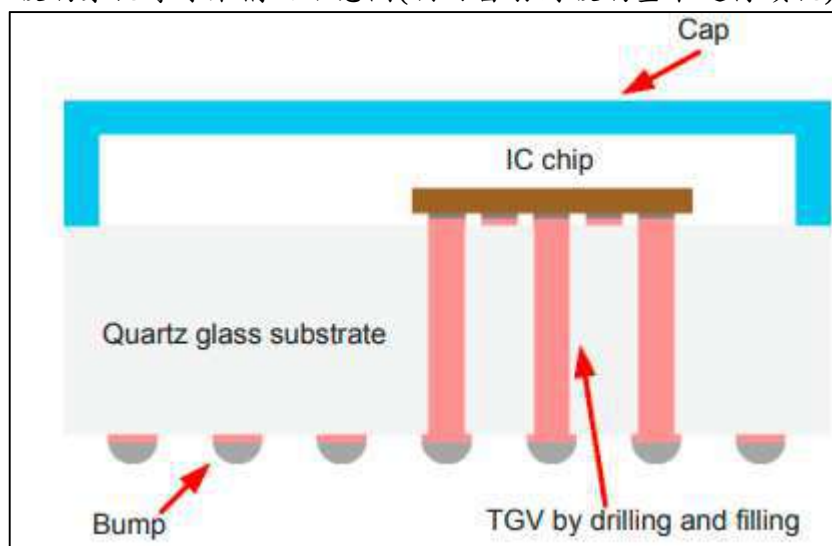
資料來源:Yole(106/10)工研院產業科技國際策略發展所 108.09

(C)Mini LED 產品應用(玻璃通孔 TGV 技術)

Omdia 預估，明年 Mini LED 電視、IT 應用（平板、筆記型電腦、顯示器）全球出貨量將分別達一千萬台、五五〇萬台；TrendForce 樂觀認為，114 年 Mini LED 在 IT 產品應用的滲透率將達 18%；Research Dive 預估，全球 Mini LED 的市場規模，到了 115 年將達到 33 億美元，換算的年複合成長率達 85.6%。而 MINI LED 具有壽命長、高對比的優點，可應用於筆電、顯示器、平板、車用領域、智慧手機、與近期市場討論度極高的元宇宙相關穿戴式裝置。

隨著 Mini LED 晶片越來越小，Mini LED 會有更緊密的晶片焊接，熱量密集度會較以往產品更高，而 PCB 基板由於散熱性的限制，會有翹曲變形的問題。相較下，其玻璃材料為低介電係數、超高電阻率、高尺寸安定性、與銅的熱膨脹差異小以及良好的機械性質，可滿足複雜的布線需要。此外，玻璃基板平坦度高，剛性較好，可以高精度拼接需求，減少拼接的黑縫，實現大尺寸 Mini LED 產品的製作。而這其中關鍵的技術之一，就是玻璃通孔 TGV 技術，利用雷射在玻璃穿孔，再電鍍銅填孔，並將驅動電路做在基板之下。工研院也在此領域不斷鑽研，其雷射中心最新研發之高均質 TGV 鑽孔模組，可在 50 組，至 700 組，可玻璃厚度下達成高真圓度 TGV 製程，可應用於輕薄短小的 3C 裝置與高頻通訊、4K 攝影等高容量訊號傳輸需求，及 5G 高頻與次世代 Micro LED 顯示，而在此領域技術中，雷射鑽孔機及其鑽孔技術是不可缺少的重要關鍵因子，故其未來發展和利基市場，潛力無窮。

玻璃穿孔導線架構之示意圖(利用雷射對玻璃基本進行鑽孔)

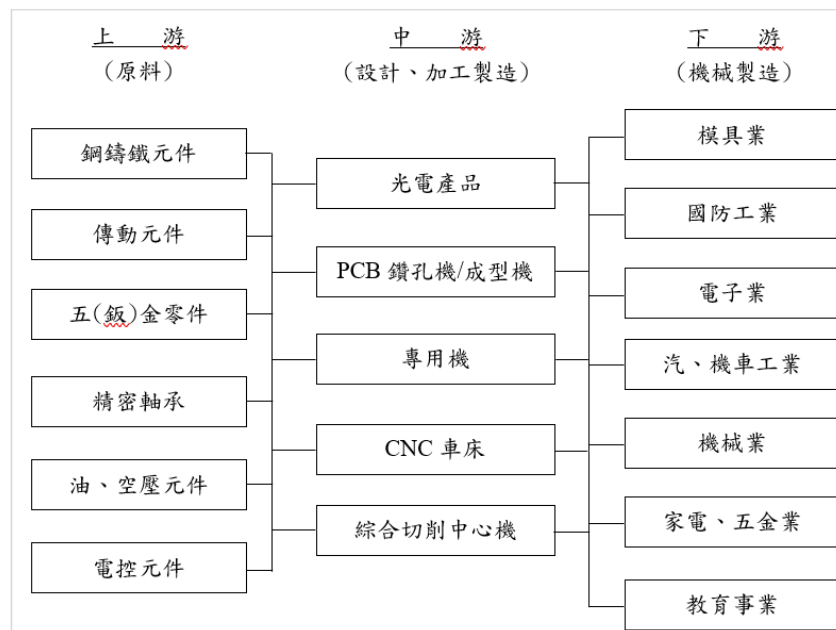


資料來源：科儀新知 209 期 105.12

(2)產業上、中、下游之關聯性

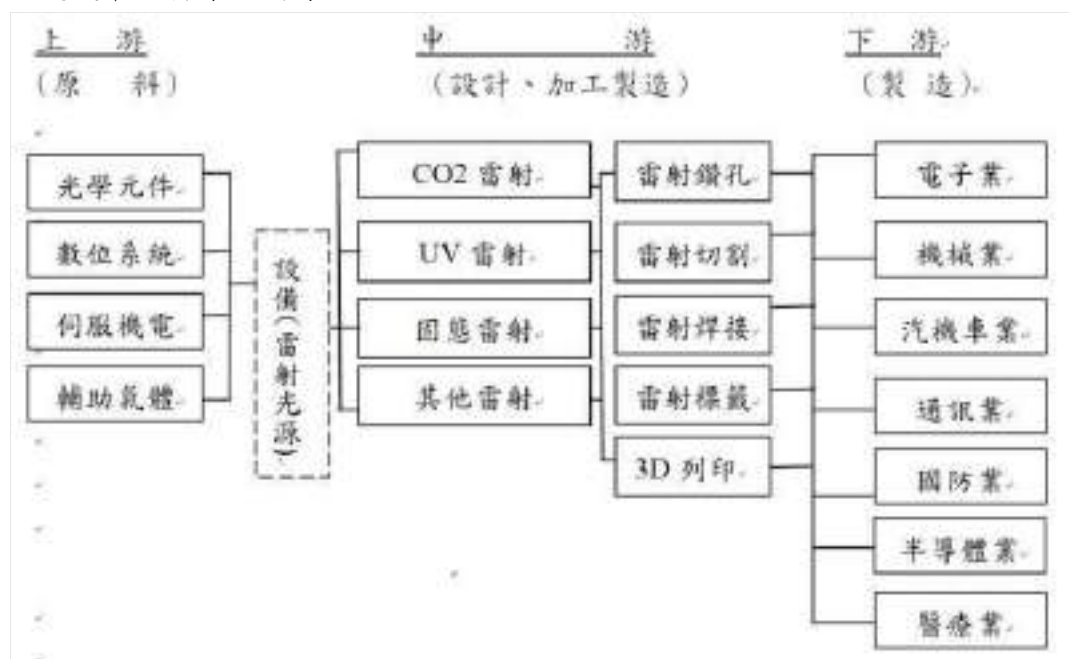
A.PCB 產業設備產業

印刷電路板製造過程中，所需設備相當繁多，包括鑽孔機、壓合機、壓膜機及成型機等，其中，鑽孔機需求量相對較大，再者，成型機需求量次之，因此，以專業分工方式整合設備之製造，由於所需零組件種類眾多，原料包括鑄件、五金零件、電控元件等，設備使用上可依各產品之製程，終端可應用於國防工業、汽機車工業、電子業等為其下游產業。



B.雷射加工產業

雷射加工產業上游主要包括雷射材料及配套元件，中游為雷射器及其配套元件，下游包括雷射應用產業如國防、機械、電子、通訊、半導體、汽機車、醫療設備等。



(3)產品之各種發展趨勢及競爭情形

A、產品之各種發展趨勢

(A)PCB 設備產業

甲、PCB 產業智能化應用

在現今生產資訊數位化的現在，MES 製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)能完整收集各製程端從來料、庫存、生產、品保、設備管理甚至機台即時監控等生產資訊，發生異常狀況時 MES 能以手機簡訊或 APP 軟體即時通知，即時找出錯誤並立即修正。隨著生產技術的提升，管理資訊的方式也應一同提升，PCB 素有『電子產品之母』之稱，然而能與其相配達到智慧工廠，能相輔相成的 MES 也扮演不可或缺的重要角色。

目前市面上產品，智能化應用多係客製化配合客戶廠內工廠管理系統及設備特性，每一家客戶都有獨自的規格。本公司產品在管理面上除具有製造執行系統(Manufacturing Execution System, 簡稱 MES)之串接及軟體配套功能外，在單機設備智能化方面，本公司現有機種 DS、DM 系列產品可應客戶要求、安裝本公司獨特開發異於同業的機器視覺辨識系統(Charge Coupled Device Camera System, 簡稱 CCD)及多功能刀具管理系統(Direct Spot Facing insulation System, 簡稱 DSFi); CCD 功能可以自動對位、補正漲縮值、讀取 QRCode 之功能; DSFi 功能係指可以提升刀具的使用壽命、及量測加工結果，提高鑽孔精準度，以確保產品品質。

為配合第五代行動通訊技術(5th Generation Mobile Networks; 簡稱 5G)、工業物聯網(Industrial Internet of Things, 簡稱 IIoT)、人工智能(Artificial Intelligence, 簡稱 AI)及大數據等趨勢，本公司鑽孔機已因應客戶客製化需求，於機台上已具有傳感器(Sensor)技術、物聯網技術(Internet of Things, 簡稱 IoT)、遠端遙控技術、MES 系統;另雷射加工用的自製雷射機，具備電腦數值控制技術(Computer Numerical Control, 簡稱 CNC)、高速位置制御、高精度圖像處理。本公司製造之設備具有工業物聯網裝置(IIoT Platform Box)，可支援 OPC 統一架構協定(Open Platform Communications Unified Architecture, OPC 會應用在自動化技術的機器對機器網絡傳輸協議)、訊息佇列遙測傳輸協定(Message Queuing Telemetry Transport, 簡稱 MQTT)、半導體設備和上層(host)溝通用的通訊協定/介面(SEMI Equipment Communication Standard/Generic Equipment Model, 與外部連接、支援工業 4.0 協議，達到相關加工數據查詢、分析，簡稱 SECS/GEM)，應用程式的介面(Application Program ing Interfaces, 簡稱 APIs)連接到如 MES、

ERP(Enterprise Resource Planning)企業資源規劃、CAM(電腦輔助製造，Computer Aided Manufacturing，簡稱 CAM)等系統，以優化生產流程。

本公司將原有設備組裝配線，導入 MES，在各組立人員作業平台佈署平板電腦，透過無線網路即時回報各組立進度、數據、時間等，達到進度與品質管理，透過資訊交換達到各站別智慧化安排，達成生產作業管理及生產履歷回查。

乙、節能措施

108 年台灣 PCB 產業能源大用戶的電力消費流向，以製程設備用電占比最高(51.5%)，其次為空調(19.5%)、空壓(10.8%)、集塵設備(4.3%)、污水處理(2.8%)、電熱(2.6%)及照明(2.2%)等，因此，目前 PCB 產業在節能措施上，主力仍著重在硬體面改善，未來應強化節能智慧化的軟實力。

台灣 PCB 業者致力於高效節能設備的汰舊換新，也具一定成效。但面對未來 IoT、AI、大數據等資通信技術的高度進展潮流，如何深化用戶在 FEMS 的加值應用，使其在能源管理效益上發揮極大化，是為當務課題。鑑此，對國內 PCB 業推動 FEMS 之建議：從『智慧化節能』切入，先奠基能源用戶在 FEMS 系統整合能量；從補助面切入，宜再強化國內 FEMS 普及力道；從輔導面切入，深化能源用戶在 FEMS 的加值應用。

本公司目前具備業界最高轉速 35 萬轉高精度鑽孔機，以及 CCD6 軸各別驅動鑽孔機，未來仍持續精進設備效能，同時搭載本公司自製升級之主軸產品，除了滿足設備投產之性能外，並逐漸朝向節能環保之效益上邁進。

(B)雷射應用

a、先進載板雷射超微鑽孔

近年 5G 技術快速發展，為達成高速傳輸之目標，高頻毫米波(mmWave)於高密度、低損耗異質載板應用需求遽增，產品朝高密度、多層與微型化發展，盲孔與埋孔需求大增，傳統機械鑽孔機無法有效解決盲孔、埋孔製程及孔徑微小化問題；而雷射鑽孔機在小孔徑及盲孔具優勢，適用高階 PCB 板製程。本公司目前已成功開發出 CO2/UV 雷射應用加工，未來，仍持續提升雷射鑽孔之精微技術。

b、雷射代工

本公司客製化代工服務，係透過自製設備整合資源及專業技術團隊，並規劃專屬的生產環境，以符合未來高精密加工需求，並導入智慧化全廠監控系統，將加工環境進行監控管理，以達到高精度加工要

求的恆溫、恆濕、無塵環境，透過全廠無線網路佈署，讓各終端裝置具備 IoT 機能即時回報數據，提升加工品質，進行 IC 載板、ABF 等高精度加工，為客戶提供更快、更彈性的解決方案。

c、有關具備 IoT 機能即時回報數據及雷射之微整型朝多元化發展

本公司已於台中廠區改建專屬雷射應用加工之廠房，其恆溫、恆濕、無塵之環境，符合未來高精密加工需求，導入智慧化全廠監控系統，包括冰水、空調、空壓、真空排氣、電力等系統。為達到遠距管理之目標，導入全廠無線網路佈署，讓各終端裝置具備 IoT 機能即時回報數據。

由於消費性電子產品愈趨強調輕薄短小，相關行動裝置、智慧手機可保留給予相關 PCB 或載板的空間愈來愈細小，致孔徑製程的精細程度將更具挑戰，因此，雷射應用之微整型將朝多元化發展，例如將來的孔徑趨於微小(30um→10um)、孔形要真圓完整、孔壁需平滑。

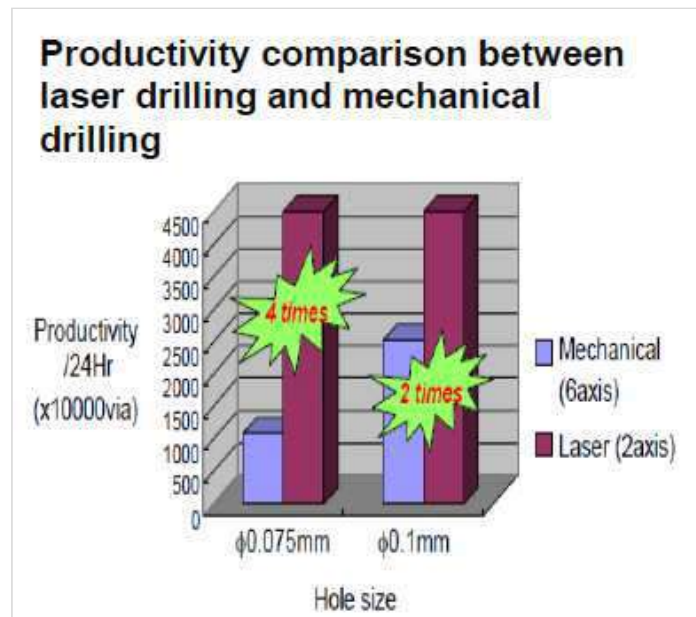
本公司對於機械鑽孔機之研發方向，短期為朝二代高效率、高精度、省電型機種進行開發。對於單機智能化功能之布局，除原有之 Sensor 技術、IoT 技術、遠端遙控技術、MES 系統外，將再發展可對應極小孔徑之加工及隨顯螢幕（Always on Display，簡稱 AOD）等功能，並朝自動化、智能化搭配智慧系統(AI 或 AR)之方面開發。未來本公司亦會與客戶保持密切的聯繫，即時了解客戶需求，並改良或增加本公司產品之功能，以針對單機智能化持續提升。另有關自製雷射鑽孔機之研發方向，短期將朝開發雷射鑽孔以外的雷射切割及現有的 CO₂、UV 雷射功性能提升，未來將積極規劃開發波長更短的皮秒 (Picosecond，簡稱 PICO，10⁻¹²)雷射、飛秒 (Femtosecond Laser，簡稱 FEMTO，10⁻¹⁵)雷射機台。

B、產品之競爭情形

過去，從 PC 到行動通訊裝置的應用，對電路板的要求是標準化、大量生產的製造特性，並以成本為優先考量，讓臺灣 PCB 廠商獲得大幅的市場優勢。然而在 AIoT+5G 的時代，對電路板的要求逐漸轉向利基型、客製化，使得「技術至上」的重要性不言而喻。

面對後 5G 及 6G 的應用趨勢，由於從通訊設備到行動裝置都需要處理更高頻的訊號，也使得電路板材料必須要更能減少訊號的損耗；而在電動車等新能源汽車的應用情境下，帶來的則是化合物半導體及高功率環境的使用需求，相對也讓電路基板的散熱性能成為一大課題；另，半導體所需要的高階載板，就是 PCB 技術研發的重點項目之一。

經參考工研院產業國際科技策略發展資料，對 PCB 雷射鑽孔產業發展現況說明如下，首先，分析機械與雷射鑽孔之差異分析：



資料來源:工研院產業科技國際策略發展所 108.09

雷射鑽孔 VS 機械鑽孔與 PCB 板應用之孔徑比較

	HDI	軟板	載板
雷射	孔徑 <100μm	孔徑 <75μm	孔徑 <50μm
機械	150μm	100μm	50μm

資料來源:工研院產業科技國際策略發展所 2019.09

另，針對 PCB 廠商對雷射鑽孔機需求分析，在孔徑深淺：能量穩定度 $\pm 5\%$ 、孔徑精度： ± 20 孔機、加工速度快及耐用性高為主，且推估目前臺灣一年需求量約為 500 台，估計全球一年約需求 1,500 台，若依目前 PCB 雷射鑽孔設備市場分析，目前臺灣大多數 PCB 板廠所使用的雷射鑽孔機仍以進口為主，係以日本 Mitsubishi(即三菱電機，TYO-6503，東證一部)之市占第一、其次，Via Mechanics(早期，隸屬日立製作所旗下，於 102 年日立製造所已出售其股權)，以及高價位的德國西門子品牌，而臺灣國內設備廠商雖仍積極布局開發，分別為東台(TW-4526)獨立開發，大量科技(TW-3167)與日廠住友重工(SHI)共同合作生產，但仍尚無法與進口設備廠並駕齊驅或共同投產，且中國大陸設備商大族激光(於深圳交易所掛牌公司，股票代碼：002008，英文：Han'S Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.)仍亦虎視眈眈積極切入中。

綜上述，本公司之產品服務內容，長年專精於鑽孔工藝，係透過設備銷售與維修服務，逐步朝向更多元化的方向經營，換言之，有別於前

述設備廠商侷限於設備販售，本公司未來將其鑽孔工藝所搭載設備業務範疇，朝向囊括各行各業的產品應用，服務更多元化的產業類型，以因應產品週期快速變化之競爭。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次與研究發展概況

本公司之研發核心，係源自過往協助日本原廠設備於臺灣、中國大陸地區之組裝、維修及提出解決方案所累積之經驗，迄今，已具備得以自行開發製造鑽孔設備之關鍵性零件、鑽孔設備(機械及雷射)及成型機台，轉型成為具備研發為核心之競爭優勢且網羅機械設計、光電組裝及自動化控制等菁英專業人才，涵蓋台灣及日本的所組成的研發團隊，因此，本公司之研發可區分為三大領域-機械、電學軟硬體的開發、關鍵零件之研發及雷射機構件、光學軟硬體開發，以確保設備產品之高精密性、高精準、高穩定及高效能的標準，另，本公司更著重於傾聽客戶需求，以確保所提供之技術與服務內容，得以兼具滿足客戶需求，同時，亦可達到優化客戶產線運作之效能，近年來，本公司更把研發重心，致力於順應各類載板材料特性與應用市場的新需求，投入開發新規格之設備及產品，因此，本公司在創新研發上，維持著精益求精的職人精神，持續性投入研發費用並開發新產品，故本公司為確保研發成果，截至 111 年 3 月，所獲證之專利權已核准且持續存續有效持有中的案件共 39 件，另尚在審查中之發明和新型為 27 件，合計 66 件，如下表所示：

存續中專利權	發明					新型				總計
	台灣	日本	中國	韓國	小計	台灣	日本	中國	小計	
雷射技術	1	1	-	-	2	1	1	1	3	5
ND/NR 機械設計	2	2	2	-	6	5	2	-	7	13
其他機械設計	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
精密主軸	7	2	5	3	17	1	-	1	2	19
總計	10	5	7	3	25	8	3	3	14	39

申請中	發明					新型		總計
	台灣	日本	中國	韓國	小計	日本	小計	
雷射技術	5	2	6	4	17	-	-	17
ND/NR 機械設計	4	2	2	1	9	1	1	10
總計	9	4	8	5	26	1	1	27

(2)研究發展人員與其學歷：

本公司目前研發團隊主要集中在台灣及日本，計約 28 人。

單位：人

年度別 項目		107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
學歷 分佈	博士	1	1	1	1
	碩士	2	2	2	2
	學士	20	19	16	14
	專科	5	5	5	5
	專科以下	6	6	6	6
	合計	34	33	30	28

(3)最近五年每年投入之研發費用：

單位：新台幣千元

年度 項目	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
研發費用	70,290	71,774	89,147	66,331	65,918
營業收入淨額	1,610,676	1,542,739	1,175,825	1,000,900	1,245,511
研發費用占營業收入淨額比率(%)	4.36	4.65	7.58	6.63	5.29

(4)最近五年度開發成功之技術或產品：

年度	研發成果	主要用途/應用領域
104	大板 PCB 鑽孔機研發成功	車載板、伺服器、基地台基板
	D10 主軸研發	高光加工主軸
	高轉速 30 萬轉主軸	主軸
105	大板 PCB 成型機研發成功	車載板、伺服器、基地台基板
	高轉速 35 萬轉主軸	主軸
106	Vela CO2 雷射鑽孔機開發成功	CO2 雷射鑽孔機
107	新增 ABF 模式與改善 CCD 鏡頭	CO2 雷射鑽孔機
	Vela UV 雷射鑽孔機開發成功	UV 雷射鑽孔機
	F20Q 主軸研發(20 萬轉)	鑽孔機主軸
108	改善 X-VIA 對穿加工、縮減 Over Hang 量、開發二維碼生成加工模式，優化整個加工品質及加工速度。	CO2 雷射鑽孔機
	鑽孔機新機種(DM、DS 系列)研發成功	鑽孔機
	成型機新機種(RM 系列)研發成功	成型機

年度	研發成果	主要用途/應用領域
109	生產工單導入 QR Code，雷鑽機可讀取該 QR Code 進行程式呼叫。	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	雷鑽機的影像辨識系統加入圓邊緣模式，提高當靶孔變形時的影像辨識度。	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	高景深 CCD 對焦模組	鑽孔機、成型機
	Z 軸輕量化鑽孔模組	鑽孔機、成型機
	薄板小孔徑加工技術之開發	CO2 雷射鑽孔機
	降低熱影響之加工技術之開發	CO2 雷射鑽孔機
110	2H2P 設備(ABF 專用)	CO2 雷射鑽孔機
	2 次元桌面高精度補正技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	UV 高轉速切割技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機

4.長、短期業務發展計劃

(1)短期業務發展計畫：

- A、雷射應用(代工)服務市場之拓展：持續推動雷射應用代工服務技術及產品開發，以擴大產品銷售及拓展市場。
- B、優化解決方案之服務：協助客戶符合終端大廠產品多元化之需求，本公司將依各式載板的板材、孔徑等規格，與研發團隊商討提出貼近市場之解決方案，以滿足客戶與終端大廠一次性購足之客製化需求。
- C、提升售後服務能力的支援，因應客戶產線製程能力之提升需求，本公司亦提供各式方案，針對客戶產能設備維護、改善及效能提升等專業服務方案。
- D、投產排程與業務需求，與主要原、物料進貨之時間緊密配合，避免庫存風險，並精準控管訂單交期。
- E、穩健臺灣、中國大陸市場，並積極拓展東北亞(韓國、日本)、東南亞新興市場地區的銷售通路。

(2)長期業務發展計畫：

- A、增加產品及服務整合，擴展營運規模，目前本公司於臺灣台中廠區增添雷射應用設備，以服務各大載板製造商的製程供需。
- B、致力於將雷射應用服務產品得以多元產業應用上，除了 PCB 產業外，更期許能跨入半導體之先進載板製程的一環。
- C、尋求共同研發之可能性，以期可加速市占率並拉大競爭對手之差距。
- D、持續投入研發創新，培育研發人才，同時開發新產品，提升品牌競爭力。

E、開發設備自動化方案，並結合軟體蒐集數據，加強管理調度及提升生產效率等。

5.專利侵權之影響及公司因應措施

本公司於產品設計過程中，對零組件選擇、功能性設定、供應商評估等，就關注是否侵犯其他公司專利之問題，故為避免可能涉及其他公司之專利部分，首先，本公司採取洽詢法律專利事務所之意見，以因應侵犯他人專利之風險，並且於產品開發過程中，對於本公司自行發明之專利亦將申請專利且定期委請法律專利事務所，提供其他競爭對手所申請專利之資訊，倘若遭遇他公司有侵犯本公司專利之情事，本公司亦將提出異議。

目前本公司所開發之 CO2 雷射鑽孔機採用之關鍵零件，包含雷射頭、電子掃描鏡、控制器、光迴路等四大類，分別透過外購及自製開發方式取得，故在外購關鍵零件，本公司會請供應廠商出具無侵權之聲明，而自製程技術部分，則均取得專利字號，此外，本公司就多年研發成果，已陸續在日本、台灣、中國申請專利，其中，臺灣專利部分，包含印刷電路板之雷射加工方法及其雷射加工機(發明專利：I705749)，另其他專利已陸續準備送件申請，未來，本公司針對重要專利擬將進行申請，以確保本公司之智慧財產權可獲得妥善的保護。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)公司主要商品(服務)銷售(提供)地區

單位：新臺幣千元

年度 地區	109 年度		110 年度	
	銷售額	占營收比例	銷售額	占營收比例
內銷	725,093	72%	1,009,214	81%
外銷	275,807	28%	236,297	19%
合計	1,000,900	100%	1,245,511	100%

(2)市場占有率

根據公開資訊觀測站及台經院產經資料庫統計資料顯示，台灣屬專業機械設備製造產業之上市櫃公司，於109 年度之合併營收約為93,702 百萬元，以本公司109 年度合併營收1,002百萬元計算，本公司市場占有率為1.07%。

由於雷射加工產業在國內並無相關具體統計數字，依目前可取得之台經院產經資料庫統計資料顯示，台灣屬專業機械設備製造產業之上市櫃公司，於109 年度之合併營收約為93,702 百萬元，以本公司109 年度合併營收1,001百萬元計算，本公司市場占有率為1.07%。倘以雷射鑽孔機、鑽頭相關產業之上市櫃同業109年度營業收入計算(同業包含：3167大量、4526東台、5498凱歲、6234高僑、6609瀧澤科、8021尖點)，本公司之占比如下：

單位：新臺幣千元

公司	主要產品	資本額	109 年度 營業收入	占比
4577 達航	雷射鑽孔代工服務、自有品牌鑽孔機及成型機產銷、保養、維修及改造服務	443,435	1,000,900	5.33%
3167 大量	半導體產品檢測設備、PCB 設備及 CNC 彫銑機械	801,341	2,427,607	12.94%
4526 東台	各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售、電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售	2,548,265	7,778,541	41.46%
5498 凱崴	PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工	1,899,133	1,264,376	6.74%
6234 高僑	自動化輸送及倉儲設備、產業專業自動化機器及各類腔體組裝、精密微型鑽頭	1,003,864	1,193,888	6.36%
6609 瀧澤科	CNC 工具機之製造及銷售、PCB 鑽孔機之製造及銷售	724,562	2,123,597	11.32%
8021 尖點	精密鑽針、精密銑刀以及鑽孔加工服務	1,421,805	2,973,426	15.85%
合計		8,842,405	18,762,335	100.00%

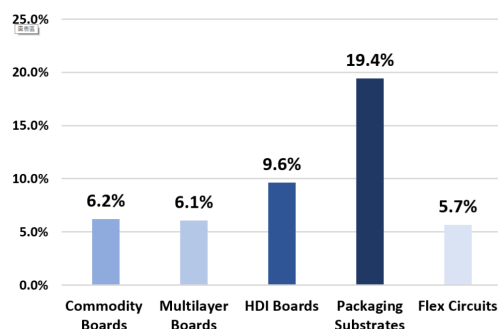
依上表所示，以本公司109 年度合併營收1,000,900千元，占國內雷射鑽孔機、鑽頭上市櫃同業之營收比重為5.33%，惟隨著本公司110年度銷售設備營收增加，預期未來占比可逐步提升。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

在109年全球電路板各式產品中，載板產值佔所有產品之比重達16%，全球年成長率高達25%，因5G手機晶片需求及SiP、AiP等新的應用規模快速的成長帶動先進製程需求，呈現高度成長主要原因為：1.全球IC出貨量持續成長；2.高單價ABF載板需求旺盛，由於5G基地台、高效能電腦的需求高度成長；3. 5G手機衍生出AiP之載板需求。

根據研究機構Prismark資料，晶圓製造產能與載板的供不應求下，110年全球載板成長率預估維持19%高成長，如圖所示，居各式電路板產品之冠。

圖 110 年全球電路板產品預估成長率



資料來源:Prismark (2021/02) 製表:TPCA

另，109年度7月我國行政院會議中宣導，推動臺灣成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，此一計畫係透過兩大政策及三大行動進行執行，首先，兩大政策所指的分別是1.加速5G、AI應用→亞洲高階製造中心，深化製造業軟硬整合帶動產業智慧化、數位轉型、創新應用，以及集結產業公協會齊力實現產業鏈智慧化、2. 完整半導體產業生態系→半導體先進製程中心，利用國內半導體產業發展需求扶植國內材料與設備，至於，三大具體行動，產業智慧化、數位轉型及創新應用，更期望半導體產業部分，利用國內需求，扶植國內材料與設備產業，朝向材料在地化、技術自主化之目標，且外商設備在地化、先進封裝設備國產化，讓臺灣製造成為全球產業的關鍵力量，此一計畫預計投資上看新臺幣1.2兆元，預估119年半導體產業的產值上看新臺幣5兆元。

本公司長年專精於鑽孔工藝技術，並搭載於自製的設備上，因此，在機械鑽孔市場，採取與競爭對手間會適度地保持服務的差異化，以符合客戶追求先進製程規格之需求，至於，雷射鑽孔部分，目前仍以日商三菱電機為主流，其次，則為原隸屬日立製作所旗下品牌HitachiVia mechanics為主要供應商(於102年日立製造所已出售其股權)，以主流品牌日商三菱電機為例，其雷射鑽孔設備之加工優點再於穩定輸出能量的雷射，有助於製程加工精密的微孔，可維持高加工良率，其次，三菱電機之雷射頭不需更換，但須搭配三菱電機原廠之維護保養，才能持續穩定的輸出能量，確保產品的品質達可供量產之目的，但本公司目前所自製開發雷射鑽孔設備產品，已具備與進口雷射鑽孔設備產品，達成共同投產之實績，未來本公司仍將掌握市場脈動及洞察先進製程演進，並透過產品線調整及提昇自製能力，以優化客戶產線製程為目標。

目前產業中雷射光的應用包含鑽孔、切割、雕刻、焊接、堆疊、表面處理等，另外主軸(鑽頭)的應用可以鑽孔、切割、雕刻、表面處理等，普遍應用於電子、汽車、醫療、半導體、LCD、玻璃等產業。本公司開發的雷射機及主軸(即鑽頭)可應用在電子產業中各項電子主動被動零件的導通與連結，包括PCB、光電、封裝、u-LED等用途非常廣泛。雷射的部分，未來本公司仍將掌

握市場脈動及洞察先進製程演進，並透過產品線調整及提昇自製能力，以優化客戶產線製程，期望本公司雷射鑽孔機產品於與客戶進行磨合並可量產後，能逐漸打入半導體、光電業、生技醫療產業之供應鏈，至於目前已提供之雷射加工服務，本公司除原有客戶外，將逐漸拓展PCB之第二線客戶以及其他產業，如與光電客戶合作已有實績，半導體客戶幾家公司正在測試驗證中。主軸的部分，從低轉速(3千轉)到極高轉速(35萬轉)需要長時間的製造技術經驗累積且開發不同金屬材料結合製程、微米等級高精密軸承、高穩定性電機等高技術含量的不斷突破、創新，本公司憑藉著多年的經驗及研發，逐漸研發出高端主軸。面對中國紅色供應鏈複製品牌廠商經驗、低價替代性材料、低廉的衛星工廠成本，在中低轉速主軸市場屢屢創造破壞性價格(僅約品牌主軸的一半價格)之情形下，於機械鑽孔市場上，本公司係採取與競爭對手間會適度地保持服務差異化，以符合客戶追求先進製程規格之需求，高端主軸(20萬、30萬、35萬轉)市場目前是供不應求，隨著航空、汽車、半導體、電子產業的持續增長，預估未來三年內對於主軸仍是供不應求的狀況

(4)競爭利基

A、多元的行銷模式可望贏得更多客戶訂單

(A)終端科技產品消費市場少量多樣的需求，接單已不在像過往集中大量單一產品，為在激烈競爭中求生存，無不積極分散接單風險、成為多品牌代工，但是生產效率卻面對嚴苛挑戰，本公司多年來與客戶發展緊密，儼然已成為客戶生產的一部份，故本公司為能就近服務，在主要客戶聚落均設有服務據點，例如：中國大陸華東地區，東北亞地區日本、韓國也都有銷售點，均提供客戶跨區服務。

(B)本公司 PCB 鑽孔設備零件及主軸為屬自主開發品牌，且於大中華地區所販售，銷售客戶的覆蓋率相當廣並屬長期合作關係。

(C)本公司服務客戶群，除臺灣前三大 PCB 大廠外，亦積極開發其他客戶，分散客戶群。

(D)為本公司主要客戶群，與國際知名大廠互動良好，因此，有助本公司貼近市場下一世代產品的發展，適時得調整設備供應技術，以符合先進製程之需求，例如：雷射應用技術支援，透過詳盡的生產數據收集與分析，配合客戶接單生產終端產品，並搭配本公司專業技術工程師調整最佳適宜投產模式。

B、產品優勢

(A)近年，本公司以「VELA」為其設備之自創品牌，亦為自行研發的零組件、耗材、高速精密主軸等的代名詞，為提供客戶最佳時效與成本競爭力服務，從鑽孔機、成型機的常耗性零件、大小徑壓力腳切換裝置(ATBC)等精密零組件，以及各轉速高精密主軸皆自主研發、設計與製造，此外

更獨步市場最高轉速 38 萬轉主軸，對比同級距產品其扭力更提升至 218 %，可供各大設備製造商對高轉速主軸之需，另，16 萬轉、20 萬轉主軸具高扭力特性，可為客戶現有量產設備提升效率與品質而大幅控制成本。

(B)維修服務，主係因確保設備的稼動率，專案設備保養，係提供執行定期保養，增加設備使用壽命並進行預防性故障排除，有助客戶得以較低成本可以達到最大效能化的目標。

C、研發優勢

(A)研發團隊，具備日本與臺灣人才屬跨國技術交流及共同開發，臺灣研發人員擅長機械鑽孔及關鍵零件，另，日本研發人員擅長雷射鑽孔技術，均具備平均資歷達數十年以上。

(B)本公司有電機工程能力上，主要係因熟悉系統、設備及參數設定，可即時因對客戶的要求，進行完善的客製化服務、升級或安裝。

(C)本公司在雷射應用鑽孔加工製程上，具備優化產品，並可對應搭載各類載板材質、加工方式或異材結合能力。

D、採購優勢

本公司，與主要供應商往來互動良好，且具備採購議價優勢，另，本公司針對客戶及市場之需求，可適時進行供應鏈廣度分析，必要時，進行數據分析以強化組織決策之能力，使供應鏈系統，得以達到優化管理之目的。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A、有利因素

(A)5G 浪潮下載板應用遍地開花

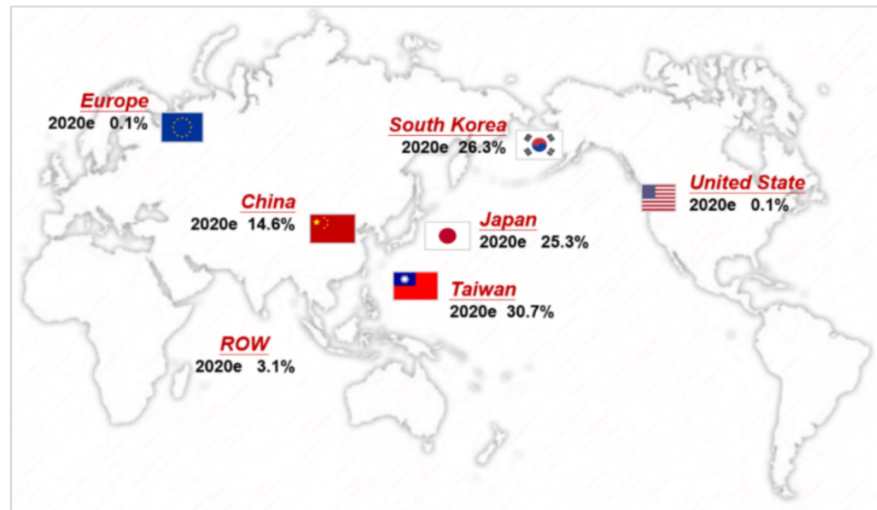
110 年預估 5G 終端產品就屬智慧型手機最受矚目，5G 智慧型手機採用 AiP (Antenna-in- Package)，以提高手機之訊號收訊能力，AiP 模組則是將短天線、射頻晶片...等封裝在一模組內，因此將衍生出 AiP 之載板需求；除此之外， 5G 終端應用於各式物聯網裝置也需要 AiP，載板需求量大增。如過去一年，疫情帶動消費電子，CPU、GPU 等 LSI 晶片需求量大增，大尺寸的 FC-BGA 基板在 109 年一整年都處於產能緊缺的狀態，IC 載板需求持續強勁，供不應求的局面預計將至少持續至 111 年，據了解 110 年除了 Intel 將推出新品之外，AMD、NVIDIA 也陸續都有新品準備推出，因此，110 年市場對 ABF 載板之需求節節高升。

(B)全球各國主要載板廠動態

目前全球載板市場廠商以台灣、日本及韓國廠商為主，主要領導

廠商分別為欣興、Ibiden、SEMCO、南電、景碩、Shinko、Simmtech，其中台灣 IC 載板產業總產值領先全球，全球市占近 31%，為目前全球載板製造最大之載板生產國家。下圖所列示全球載板市場廠商之市佔率分佈，值此全球正苦於解晶片荒之際，台灣擁有全球領先的半導體與封測產業，更要掌握同業動態，把握此天時地利優勢，順勢掘地而起，以謀立於不敗之地位。

109 年全球各區域載板預估市佔率分佈



資料來源:Prismark (110/02) 製表:TPCA

B、不利因素及因應對策

(A)產業主要集中在印刷電路板，而 PCB 業競爭強度加劇

PCB產業發展較久，概略的說，全球約有3,000家PCB廠商，主要分佈在台灣、中國、日本及韓國。集中度相對其他產業低，全球前十大PCB廠商的合計市場佔有率約為30%。產業集中度不若其他科技產業，因此PCB產業競爭較激烈，對於每分資金投入會較謹慎。

因應對策：

本公司近年來啟動多項組織變革，轉型成為專注產業技術與客戶需求「小而美」的企業。將組織扁平化成二階層管理，以加速前端對前端客戶的回應。過往，本公司的銷售營業額集中在PCB印刷電路板業，為了降低銷售過度集中於單一行業之風險，採取多角化經營，故近年來，本公司的客戶產品應用範圍已拓展至半導體、光電、其他電子零組件等產業上。

(B)設備類景氣循環明顯

設備業營運績效受景氣循環影響甚深，其績效表現會較景氣循環提前收縮、延後擴張，達航科技部份自有品牌鑽孔機、成型機受景氣影響

大，當下游產業縮減資本支出時，對於生產調節及營運非常激烈，形成對公司經營的重大考驗。

因應對策：

本公司採取穩健的財務政策、管理方式，並試圖拓展出新的營運模式：

- a、財務政策：不擴大信用，亦幾乎不投入不熟悉領域，對於應收帳款管理上，亦採取嚴格的備抵呆帳提列準則。
- b、管理方式：落實週損益預推控管，本公司透過流程改善及系統建置，由前端業務及專業服務團隊，即時的資訊反饋市場訊息，搭配定期掌握業界最新動態及市場信息，彈性的調整。
- c、營運模式：持續與客戶端研發單位合作開發加工技術，確保適用客戶需求之解決方案。朝向高階機種方向精進，並以客製化需求接單模式，一方面得以確保獲利外，另一方面減少價格競爭之營運模式。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

A、機械鑽孔機(Driller)- HDI & HLC 高產量、多樣化生產、IC 載板(BGA & FC & CSP) 高精度、高效率對應及特殊製程 Back Drill &高精度對位補償應用，並搭載各式主軸配件產品，對應各式產品製程之需求，以下茲就各機款產品及用途說明：

產品 (型號)	用途
ECO-D Series	可搭載 F16P(Max. 1600 Krpm)、F20Q(Max. 2000 Krpm)之主軸運轉，此系列產品應用於 HDI、HLC、車載板、厚銅板及 FPC 板之製程，為高產量、多樣化生產泛用機。
ECO-DS Series	Z 軸線性馬達，可搭載 F35P(Max. 3500Krpm，刀柄 2mm)、F30P(Max. 3000 Krpm，刀柄 3.175mm)之主軸運轉，此系列產品應用於 IC 載板(BGA & CSP) 高精度、高效率對應。
ECO-DM Series	X、Y、Z 軸線性馬達，獨立桌面，搭載 F20Q 或、F30P(Max. 3000 Krpm，刀柄 3.175mm)之主軸運轉，特殊製程 Back Drill &高精度對位補償應用。

B、成型機 (Routing Machine)- 高產能、多機能生產設備、高精度深度控制、真空桌面搭載及特殊製程、高精度對位補償應用，對應各式加工尺寸產品，以下茲就各機款產品及用途說明：

產品 (型號)	用途
ECO-R Series	高產能、多機能生產泛用機。
ECO-RZ Series	高精度深度控制、真空桌面搭載。
ECO-RM Series	特殊製程、高精度對位補償應用。

C、SPINDLE Spindle Accessories-高轉速、高扭力主軸及高扭力輸出特性產品，以下茲就各主軸產品及用途說明：

產品 (型號)	用途
F30P/F35P SPINDLE	300,000 RPM、350,000 RPM 超高速精密空氣軸成主軸，微小鑽孔加工對應，同時具有較市場上同級產品有更高的馬達扭力輸出設計，特殊專利軸承設計具備高度穩定性。
F20P SPINDLE	200,000 RPM 高精度、高轉速精密空氣軸承主軸，採用特殊軸承專利設計，具備高度穩定性，主軸內部結構設計強化(專利)，大幅提升各式設備搭載的適應性。
F16P SPINDLE	160,000 RPM 高精度、高轉速空氣軸承主軸，強化馬達輸出扭力設計及軸承負載能力，進而提升大孔徑、難削材料的加工能力，同時具有高轉速的加工能力，適用性大幅提升。
F80P/F12 SPINDLE	80,000 RPM、120,000 RPM 精密空氣軸承主軸，高負荷、高扭力、高轉速設計，同時提供市場鑽孔、銑削能力，可拆式夾頭設計，確保主軸性能時效性得以延展的高性賴性主軸。
FR06 SPINDLE	60,000 RPM 精密滾珠軸承主軸，可拆式夾頭設計，擁有特殊設計的冷卻系統維持主軸內部零件溫度均勻化，是提供市場高精度、高穩定性、高壽命的 PCB 成型機主軸。

D、全廠效能提升-機台設備效能、製程/設備升級

本公司提供專業的機台設備效能、製程升級解決方案，讓客戶的既有機台發揮更有效率的生產力，且透過本公司提供之高精度盲撈加工、微小孔徑/多孔數高精度鑽孔加工、自動植 PIN 裝置改造、ATBC 改造...

等等，提升對應各式訂單型態需求、作為增加產能的選項之一，有助使設備升級投資效益相對於購買新機更佳超值。

E、雷射應用(代工)服務-專業代工服務，雷射應用技術

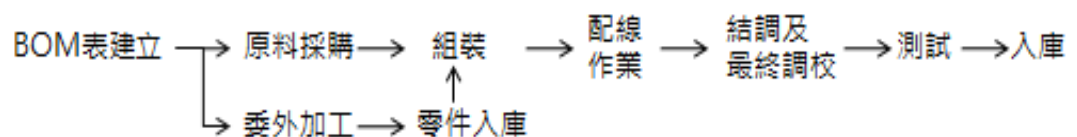
本公司通過『ISO9001:2015』品質管理認證，且具備專業維修、保養及專業雷射光調整之工程師，提供客製化解決方案，透過自製開發 CO2、UV 雷射鑽孔專用機，並以 JOB SHOP(零工式生產)方式，支援客戶產能且依客戶需求進行設備軟、硬體之調整，透過雷射應用鑽孔使 PCB 或載板之訊號傳輸藉由導通孔及盲孔，達到高速高頻傳輸雜訊及散熱對策等盲孔之加工製程。

F、其他製造品質管理的系統

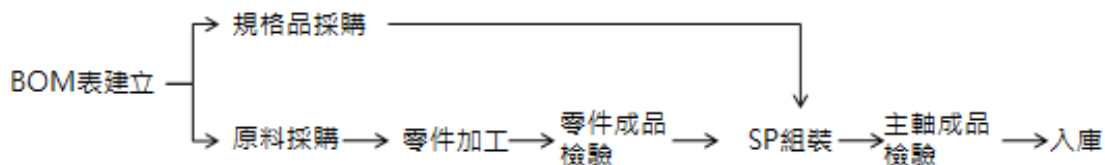
- a. 統計製程管制系統(Statistical Process Control，簡稱 SPC)：SPC 主要是指應用統計分析技術對生產過程進行實時監控，科學的區分出生產過程中產品質量的隨機波動與異常波動，從而對生產過程的異常趨勢提出預警，以便生產管理人員及時採取措施，消除異常，恢復過程的穩定，從而達到提高和控制質量的目的，本公司於 102 年導入統計製程管制系統，以即時掌握線上製程的現況，及時處理異常狀況。
- b. Minitab 統計軟體(Minitab Statistical Software，簡稱：Minitab)：Minitab 是一套專業的統計分析軟體，由賓州州立大學的研究員 Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr.，和 Brian L. Joiner 於 1972 年研發而成，提供統計製程管制、DOE、量測系統分析、可靠度、預測分析等工具，直覺化的操作介面及原廠完善的技術支援，為品質改善的最佳工具。本公司於 105 年導入 Minitab 用於品保方面的測量分析、可靠度分析、預測分析，尤其利用 6 個 sigma 的品質分析的技術提升本公司產品品質及追蹤改善。
- c. 遠端管理系統：本公司於 109 年導入遠端管理系統，提供設備保養維修、人員派工排程、及產品品保抽樣等即時資訊。

(2)主要產品之產製過程

A、Vela 設備產銷產品之製作



B、SP(主軸)產品製作



C、雷射應用(加工)

進貨檢驗→工程作業(壓入基準銷、控制參數設定及雷射光源裝置、執行鑽孔作業)→製程檢驗(大範圍抽檢、自主檢查、完批檢查及品質檢查)→成品檢驗(外觀檢查)→包裝/出貨檢。

3.主要原料之供應狀況：

主要原料	供應來源	供應狀況
不鏽鋼、銅合金	國內及國外廠商	貨源穩定
電氣配件	國內及國外廠商	貨源穩定
鈹金	國內廠商	貨源穩定
螺桿及滑軌	國內及國外廠商	貨源穩定
鑄件	國內廠商	貨源穩定
雷射頭	國外廠商	貨源穩定
光學部品	國外廠商	貨源穩定

4.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明：

(1)最近二年度毛利率之變動情形：

單位：新台幣千元；%

主要產品類別	109 年度			110 年度			差異		
	營業收入	營業毛利	毛利率 %	營業收入	營業毛利	毛利率 %	毛利金額	毛利率 %	變動比率 %
專業服務	824,878	295,650	35.84	688,763	185,309	26.90%	(110,341)	(8.94)	(24.9)
設備產銷	154,963	19,300	12.45	524,659	168,753	32.16%	149,453	19.71	158.31
其他	21,059	21,059	100.00	32,089	32,089	100.00%	11,030	-	-
合計	1,000,900	336,009	33.57	1,245,511	386,151	31.00%	50,142	(2.57)	(7.66)

註1：其他係代理收入，以毛利表示

(2)營業毛利變動率達百分之二十以上之說明：

本公司 110 年營業毛利金額相較前一年增加 50,142 千元，毛利率之變動未達 20%，另專業服務毛利率，變動達 24.9%，係因受新冠肺炎影響，以及客戶需求減少，致本公司營收及毛利同步減少。設備產銷 110 年度營業收入及毛利較 109 年度增加，主因高階鑽孔機台出貨量增加所致。

5.主要進、銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨淨額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣千元；%

年度	109年度				110年度			
項目	名稱	金額	占全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	76,300	15.33	無	甲公司	59,093	7.31	無
	其他	421,436	84.67		其他	749,262	92.69	
	進貨淨額	497,736	100.00			808,355	100.00	

說明：110年度無占進貨淨額百分之十以上之供應商。金額增減係因市場需求變動所致。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣千元；%

年度	109年度				110年度			
項目	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A公司	52,140	5.21	無	A公司	314,010	25.21	無
2	B公司	92,269	9.22	無	B公司	171,470	13.77	無
3	C公司	252,825	25.26	無	C公司	83,321	6.69	無
	其他	603,666	60.31		其他	676,710	54.33	
	銷貨淨額	1,000,900	100.00			1,245,511	100.00	

說明：本公司109年度及110年度銷售客戶中，A公司、B公司及C公司為國內印刷電路板業者，受整體產業景氣影響及客戶自身擴廠、設備更替狀況之影響，致本公司接單代工及設備產銷數量因而產生增減變動。整體而言，銷售客戶變化情形尚無重大異常。

6.最近二年度生產量值及變動分析：

單位：PCS/台/ 新台幣千元

生產量值 主要商品	109年度			110年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
專業服務	註 1	註 1	495,223	註 1	註 1	432,021
自有品牌	120	52	157,996	120	100	385,916
合計	註 2	註 2	653,219	註 2	註 2	817,937

註 1：本公司產線主係雷射鑽孔加工服務，依訂單排程機動調整產能，故產能隨訂單狀況波動。

註 2：單位不一致，故不予以加總。

7.最近二年度銷售量值表及變動分析：

單位：PCS/台/ 新台幣千元

銷售量值 主要商品	年度	109年度				110年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
專業服務		註 1	591,866	註 1	233,012	註 1	552,004	註 1	136,759
自有品牌		32	112,168	12	42,795	68	425,121	27	99,538
其他		註 2	21,059	註 2	-	註 2	32,089	註 2	-
合計		註 3	725,093	註 3	275,807	註 3	1,009,214	註 3	236,297

註 1：係雷射加工收入、機台售後服務保養收入、統包統修、及勞務收入等。

註 2：其他係代理類收入。

註 3：單位不一致，故不予以加總。

本公司為配合市場變化，縮小中國大陸營運規模，自 108 年度起逐步縮減華南、華東地區營運規模，並調整營運策略，將重心移回台灣，並致力往高階精密鑽孔機發展，致本公司外銷金額自 109 年度 275,807 千元下降至 110 年度 236,297 千元。

另隨著 108 年度美中貿易戰摩擦加遽，台商陸續回台，本公司於 108 年研發成功之 30 萬轉以上高階 DM、DS 機種陸續上市，於 109 年陸續經過客戶認證，並於 109 年底陸續出貨，致本公司內銷金額自 109 年度 725,093 千元增加至 110 年度 1,009,214 千元。

(三)最近二年度從業員工人數

單位：人；歲；年；%

年度		109 年度	110 年度
員工 人數	直接人員	163	150
	間接人員	114	110
	合計	277	260
平均年歲		42	42
平均服務年資		11	11
學歷分 佈比率	博士	0.36%	0.38%
	碩士	3.97%	5.00%
	大專	73.29%	72.31%
	高中及其他	20.94%	21.92%
	高中以下	1.44%	0.39%
	合計	100%	100%

因本公司之雷射應用、機鑽服務屬服務業性質，且設備產銷需要員工於線上進行設備生產之組裝，故本公司之員工主要係以直接人員為主，占本公司員工人數近六成。其餘間接人員主係研發(逾員工人數一成)、業務、總務及會計等後勤單

位。另本公司之總部設於臺灣，包含管理單位、設備維修、機台生產及雷射應用服務之工廠，故配置較多之人力；中國大陸地區包含子公司上海達航及東莞達程，當地員工主係提供設備維修及雷射應用服務等業務及工程師；日本主要係負責雷射鑽孔機之研發及生產，故當地員工主係研發及線上人員；韓國主係服務據點，提供當地產品銷售之諮詢，人力配置較少。

110 年底員工人數較 109 年底減少 17 位，主係因中國大陸業務萎縮，以及台灣地區主要係雷射應用營收減少及部分員工無法配合總部自林口遷至大甲。考量雷射應用服務人力減少以及設備產銷業績成長，本公司仍將持續徵聘產線及倉管人員。

(四)環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司位處於台中大甲幼獅工業區內，相關環保均架構在工業區環境安全管理規範內，無水污染防治費等問題。精工廠及青年廠 廢棄物清理計畫書已依規定取得核准。

- 2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

111 年 2 月 28 日單位：新台幣元

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減 餘額	用處及 預計可 能產生 效益
無塵室安裝 AIR SHOWER	1	2020/12/15	195,000	121,875	防止空 氣污染
精工廠雷加無塵 室工程_CV 中央 集塵系統	1	2020/10/30	8,968,753	7,410,723	防止空 氣污染
切削水箱及電磁 濾紙過濾裝置	1	2019/12/26	15,727	5,112	防止空 氣污染
TOYO 內圓磨床 T-11J(YGI02)含附 屬油霧回收機 LG-250B_B	1	2017/09/28	617,027	6,576	防止空 氣污染
高壓式脈衝集塵 機(7.5 HP)入口 3"	2	2015/06/30	180,000	10,418	防止空 氣污染
超冷處理爐 CP-300vi	1	2011/01/11	1,880,000	799,001	防止空 氣污染

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減 餘額	用處及 預計可 能產生 效益
雷射焊接機(CO2) 2500W	1	2010/09/30	9,987,791	5,000	防止空 氣污染
CS-1022 多段式脈 衝集塵機(7.5HP)	1	2010/04/26	115,000	5,000	防止空 氣污染
真 空 熱 處 理 爐 VKNQ60/60/90-6b ar 含石墨底盤 2 件 及支柱 6 支	1	2009/11/18	12,900,000	6,271,104	防止空 氣污染
高真空熱處理爐	1	2007/10/17	9,280,000	5,000	防止空 氣污染
超冷處理設備	1	2005/12/16	1,600,000	5,000	防止空 氣污染
集塵機	1	1998/04/3	210,100	2,101	防止空 氣污染

3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛情事者，並應說明其處理經過：無。

4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(五)勞資關係

1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1)員工福利措施

公司致力於營造一個和諧的勞資關係，及健全員工之福利，秉持尊重人性、關懷員工之理念，為充分照顧員工，提升公司競爭力，針對員工職涯規劃及專業職能提供完整培訓計劃，使員工更具向心力與充實員工福利。現行之福利措施包括：

A.依據福利辦法規定，提供婚喪喜慶福利措施，如：結婚禮金、直系旁系血親喪奠儀、生育祝賀金、新居落成禮金、住院慰問金。同時，為鼓勵各部門踴

躍舉辦團隊活動，促進團隊交流，讓每一位同仁都可以在工作和生活中求得平衡，舒緩工作壓力，特別設有獎勵部門團隊營造費用，每季每人費用額度為新台幣500元，作為部門聚餐、慶生、踏青、親子活動...等活動費用，共創精彩生活。

B.依規定提撥勞工退休準備金，以便管理員工退休準備金各項事宜，俾使退休無後顧之憂。

C.本公司亦按政府相關法令投保勞工及全民健康保險，更為了員工安全著想，為員工加保團體保險以保障員工，提供員工更多的福利。

D.本公司依據職工福利金條例設立職工福利委員會，提撥福利金辦理福利事項，現行施行要項包括：

1. 生日禮金，每人新台幣2,000元。
2. 尾牙禮品代金，每人新台幣1,200元。
3. 勞動節禮品代金，每人新台幣2,000元。
4. 端午節禮品代金，每人新台幣2,000元。
5. 中秋節禮品代金，每人新台幣2,000元。
6. 定期舉辦健康檢查或員工旅遊補助，每人補助金額上限為新台幣12,000元。
7. 定期舉辦假日員工旅遊，上、下年度各辦理假日旅遊乙次，每人預算額度為新台幣3,000元，並視疫情狀況調整。

E.具競爭力與留才之薪資結構，除保障員工生活外，亦可達到留才之目的。

(2)進修及訓練

為提升人力資源發展體質與競爭優勢，針對關鍵人才養成，本公司鼓勵員工至各大 EMBA 院校進修管理職能，培養管理學問素養。同時，本公司針對同仁之職能需求並配合相關規定，舉辦員工教育訓練、專業技術職能養成訓練、品質管制訓練、員工成長相關訓練及勞工安全衛生講習等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成與自我成長。

(3)退休制度與其實施情形：

本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，每月按薪資總額提撥退休準備金，存入台灣銀行之退休金專戶，勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制後，本公司員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係和諧，為保障勞資權益，協調勞資關係，本公司致力加強勞資和諧並做雙向溝通協調以解決問題，定期召開勞資會議，因此，截至目前為止並未發生重大勞資糾紛情事。

2.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

(1)勞資糾紛所遭受之損失：無。

(2)勞工檢查結果違反勞動基準法事項：

處分日期	處分字號	違反法條規定	違反內容	處分內容	因應措施
109.05.28	府受勞動字第1090125930號	勞工退休金條例第12條第一項及第45條之一規定	我司於108年10月給付給陳○文的資遣費，臺中市政府勞工局勞工局勞動基準科認定，陳○文駐韓期間在韓國分公司領取的薪資要納入資遣費計算。	罰鍰新臺幣三十萬元	已依勞退條例之規定辦理

(六)資通安全管理：

1.敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

公司以 ISO 27001 與 BS7799 為參考標準，並依據公司內部實際管理需求制定資訊安全政策。主要之資訊安全管理需求為建置基準，以資訊管理中心提供的相關資訊服務，以及公司相關部門為主要範圍。建立相關資訊資產清單，並明定擁有者，人員錄用簽署相關安全保密文件，異動或離職時應歸還其資訊資產；大樓及資訊安全管制區域應落實相關門禁管控及物品攜出入規定，資訊安全教育訓練、定期宣導以提昇資訊安全防護之認知觀念，電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，禁止使用未經授權軟體。同仁個人持有之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任、管理人員應定期清查覆核，系統運作資料應定期備份並執行回復測試。資訊安全事件，應立即通報，並依照資訊安全事件處理程序處理。

2.列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(七)公司及其子公司於申請上櫃年度及其前二年度如有委託單一加工工廠於年度內加

工金額達五千萬元以上者，應增露該加工工廠之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表勞資關係：無。

(八)有無爭訟事件，及勞資間關係有無尚須協調之處：無。

(九)有無因應景氣變動之能力：

本公司隨時洞悉產業變遷，並且本公司研發團隊不斷精進技術工藝的開發與創新，並且本公司定期不定期召開經營會議，以利即時掌握總體經濟市場變化、產業趨勢等，且本公司主要產品區分專業服務、設備產銷並且積極將應用領域多元化，降低集中單一市場的風險，故本公司尚能隨著市場變化進行對應，因此，本公司具備對景氣變動之應變能力。

(十)關係人間交易事項是否合理（公營事業依審計法規辦理者不適用）：

本公司與關係人間交易，其價格與交易條件與一般交易無重大差異，相關交易事項及說明請參閱本公司經會計師查核簽證之財務報告附註。

(十一)如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令取得主管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國內從事生物技術工業或醫療儀器工業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷售或提供技術服務之實績暨最近一年度產品及相關技術服務之營業額、研究發展費用所占該公司總營業額之比例情形：不適用。

(十二)公司如於提出上櫃申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將其部分之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記載說明其終止、移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續營業項目前一年度之營業額、研究發展費用占公司該年度總營業額之比例情形：不適用。

二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產：

(一)自有資產

1. 取得成本達實收資本額百分之二十或三億元以上之不動產、廠房及設備名稱、數量、取得日期、取得成本、重估增值及未折減餘額，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事

單位：新台幣千元。

不動產、廠房及設備名稱	單位	數量	取得年月	原始成本	重估增值	未折減餘額	使用情形	保險情形	設定擔保及權利受限制之其他情事
主軸生產設備	台	26	98/2~100/6	176,724		7,180	主軸生產部門使用中	已投保	無
雷射應用設備(註)	台	48	106/10~110/09	609,584		448,736	雷射應用部門生產或租賃客	已投保	無
雷射應用設備(註)	台	14	109/06~110/03	173,410		160,128	戶使用中	已投保	已抵押

註：雷射應用設備係本公司子公司大船企業(日本)株式會社生產，賣回母公司使用。

2. 閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產：無。

(二)使用權資產

1. 金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之使用權資產租賃標的名稱、數量、租賃期間、出租人名稱、原始帳面金額、未折減餘額，並揭露其保險情形及租約之重要約定事項：無

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率：

1.各生產工廠之使用狀況：

項目 工廠	建物面積 (註 1)	員工人數 (註 2)	生產商品種類	目前使用狀況
精工廠	9093 m2	118	雷射加工、NDNR 製造、專業服務	正常使用
青年廠	2202 m2		專業服務_機鑽	正常使用

註 1：建物權狀面積

註 2：不含營業單位、研發單位及管理後勤單位人員

2.最近二年度設備產能利用率：

生產 量值 主要商品	年度	109年度				110年度			
		產能	產量	產能利用率	產值	產能	產量	產能利用率	產值
專業服務	註 1	6,039	-	495,223	註 1	6,172	-	432,021	
設備產銷	120	52	43%	157,996	120	100	83%	385,916	
合計	註 2	6,091	-	653,219	註 2	6,272	-	817,937	

註 1：本公司產線主係雷射鑽孔加工服務，依訂單排程機動調整產能，故產能隨訂單狀況波動。

註 2：單位不一致，故不予以加總。

三、轉投資事業：

(一)轉投資事業概況

110年12月31日；單位：新臺幣千元；千股

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例%				投資損益	分配股利	
CHINA EXPO LTD.	境外投資公司	229,487	265,066	6,200	100	264,661	—	權益法	(4,188)	—	—
大船企業日本株式會社	設備、零件買賣及維修之業務	31,567	(41,051)	2	100	65,828	—	權益法	(21,336)	—	—
MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED	境外投資公司	139,900	236,018	5,054	100	236,018	—	權益法	(3,074)	—	—
上海達航實業有限公司(原廣東達航電子有限公司)	印刷電路板整廠機械設備製造加工買賣	150,856	236,032	—	100	236,032	—	權益法	(3,074)	—	—
東莞達程電子有限公司	印刷電路板整廠機械設備製造加工買賣	27,652	44,612	—	100	44,612	—	權益法	(623)	—	—

(二)綜合持股比例

110年12月31日；單位：千股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
China Expo Limited	6,200	100	-	-	6,200	100
MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED	5,054	100	-	-	5,054	100
上海達航實業有限公司(更名前:廣東達航電子有限公司)	-	100	-	-	-	100
東莞達程電子有限公司	-	100	-	-	-	100
大船企業日本株式會社	2	100	-	-	2	100

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：不適用。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

(五)已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，應增列該投資事業之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表：

公司名稱	地址	電話	董事成員	持股 10%大股東	110 年損益
上海達航實業有限公司	上海市青浦區滬青平公路 2266 號 3 幢 201 室	021-59898111	劉智鴻、 陳俊程、 王維倫	MEGA(註 1)	(3,074)
東莞達程電子有限公司	廣東省東莞市松山湖區科技二路 10 號 1 棟 1 單元 604 室	0769-22897068	劉智鴻、 陳俊程、 孫逸敏、 翁榮隨	CHINA EXPO(註 2) 上海達航	(623)

註 1：MEGA 為 CHINA EXPO 採權益法投資之 100%子公司。

註 2：CHINA EXPO 為本公司採權益法投資之 100%子公司。

四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110 年 12 月 16 日至 111 年 12 月 15 日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110 年 12 月 16 日至 111 年 12 月 15 日	應收帳款讓售	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110 年 8 月 13 日至 115 年 8 月 13 日	中長期借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110 年 9 月 27 日至 111 年 9 月 26 日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110 年 11 月 15 日至 111 年 11 月 14 日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	中國信託商業銀行	110 年 10 月 19 日至 111 年 9 月 30 日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	台北富邦商業銀行	110 年 12 月 7 日至 111 年 12 月 6 日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	富邦華一銀行	108 年 9 月 19 日至 111 年 9 月 30 日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	玉山銀行	110 年 8 月 26 日至 111 年 12 月 16 日(短期) 114 年 6 月 16 日(中期)	短、中期借款	無
銀行授信	元大銀行	110 年 3 月 4 日至 111 年 3 月 4 日	短期綜合授信借款	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行授信	王道銀行	108 年 2 月 26 日至 113 年 2 月 25 日	中長期借款	無
銀行授信	台新商業銀行	108 年 4 月 8 日至 112 年 3 月 2 日(自動展期)	短期綜合授信借款	無
銀行授信	瑞穗銀行	108 年 2 月 19 日至 115 年 2 月 27 日	日本大船發行無擔保 公司債	無
銀行授信	三井住友銀行	110 年 11 月 29 日至 115 年 11 月 29 日	中長期借款	無
廠房租賃	英隆針織股份有限公司	110 年 6 月 1 日至 111 年 12 月 16 日	本公司之廠房租約	無
廠房租賃	鈞宏精密工業(股)公司	110 年 6 月 1 日至 120 年 5 月 31 日	本公司之青年廠房租 約	無
廠房租賃	大船電子(上海)有限公司	109 年 6 月 1 日至 112 年 5 月 29 日	子公司(上海達航實 業)之租約	無
廠房租賃	大船科技(股)公司	109 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	子公司-大船企業(日 本)株式會社之租約	無

肆、發行計劃及執行情形

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計劃分析：不適用。

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項：

(一) 本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益

1. 本次計畫所需資金總金額：新台幣 185,792 千元。

2. 本次計畫資金來源：現金增資發行新股 5,806 千股，每股發行價格暫訂 32 元，募集總金額 185,792 千元。

3. 計畫項目、運用進度及可能產生之效益

單位：新台幣千元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度
			111 年第三季
充實營運資金	111 年第三季	185,792	185,792
合計		185,792	185,792

資料來源：本公司提供

本次現金增資所募得之資金，預計全數用於充實營運資金，係考量公司長期發展與未來成長性，以因應本公司營運規模擴大及配合未來發展策略之執行，故藉由現金增資充實營運資金，將可使本公司之自有資金更形充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

4. 本次募集資金不足時處理方式

本公司本次現金增資發行普通股，如每股實際發行價格因市場變動而與暫訂發行價格不同，致募集資金不足時，將減少充實營運資金之金額；惟若募集資金增加時，則將全數用以充實營運資金。

(二) 本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法：不適用。

(三) 本次發行特別股者，應揭露事項：不適用。

(四) 上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露事項：不適用。

(五) 股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市(櫃)計畫：不適用。

(六) 本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。

(七) 本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。

(八) 說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：

1. 本次計畫之可行性評估

(1) 於法定程序上之可行性

本公司本次辦理上櫃前現金增資發行普通股計畫，業經 110 年 3 月 15 日董事會及 110 年 7 月 5 日股東常會決議通過辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷案，並於 111 年 3 月 15 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，並授權董事長全權處理相關增資事宜。經查本次增資內容及程序與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定並無不符，並經律師對本次募集現金增資計畫之內容出具法律意見書，顯示本次現金增資發行普通股計畫確已符合相關法令之規定，故本公司本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

(2) 資金募集完成之可行性

本公司本次現金增資計畫發行普通股 5,806 千股，每股面額新臺幣 10 元，暫訂以每股 32 元溢價發行，預計募集總金額為 185,792 千元，其中依公司法第 267 條規定保留 15%，計 870 千股由員工認購，其餘 4,936 千股則依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」按證券交易法第 28 條之 1 規定，於 110 年 7 月 5 日股東常會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購。

本次辦理現金增資發行新股係採部份競價拍賣，部份公開申購方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，經本公司 111 年 3 月 15 日董事會決議授權董事長洽特定人認購之；而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故本公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

(3) 資金運用計劃之可行性

本次辦理現金增資發行新股所募得之資金，考量主管機關審查與承銷作業時程，預計於 111 年 6 月募集完成，並於 111 年第三季支用，資金運用計畫為充實營運資金，以因應本公司營運週轉及業務成長所產生之資金需求，除可強化本公司財務結構之外，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業之經營及健全財務結構具有正面助益，故本次籌資用於充實營運資金應屬合理可行。

綜上所述，本公司本次現金增資發行新股計畫內容，就其適法性、資本市場募得資金及資金運用項目及進度等各方面評估應具有可行性，故整體而言其籌資計畫應屬可行。

2. 本次計畫之必要性評估

本次現金增資發行新股係依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」規定，以現金增資發行新股方式，委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，故依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 6 條第 2 項第 2 款之規定，不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

3. 本次計畫之合理性評估

(1) 資金運用計畫及預定進度合理性評估

本公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理初次上櫃前公開銷售之用，預計募集資金共計新臺幣 185,792 千元，資金運用計畫為充實營運資金，以提高自有資本比率及強化財務結構，並可提升資金靈活調度之彈性，更可有效提升本公司之競爭力，降低營運及財務風險，故資金運用計畫應具合理性。另資金運用之進度，將視主管機關之審查時間、公開承銷期間及繳款作業時程而定，預計於 111 年 6 月完成資金募集作業後，並於 111 年第三季用於充實營運資金，故本公司之資金運用計畫及預定進度應屬合理。

(2) 預計可能產生效益之合理性

項目 \ 年度		籌資前	籌資後(註)
		110 年度	111 年第一季(預估)
財務結構	負債佔資產比率(%)	49.83	45.91
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	164.56	187.53
償債能力	流動比率(%)	92.86	114.89
	速動比率(%)	27.25	49.27

資料來源：本公司提供。

註：係以 110 年度經會計師查核之個體財務數字為基礎設算。

本公司本次辦理現金增資發行新股 185,792 千元，預計於 111 年 6 月募集完成，並於 111 年第三季投入充實營運資金。若以該計畫募集完成後之財務結構及償債能力觀之，其負債比率可降至 45.91%，長期資金占不動產、廠房及設備比率、流動比率及速動比率將分別上升至 187.53%、114.89% 及 49.27%，將可達成強化財務結構之效益，且考量公司長期發展與未來成長性，將可使本公司之自有資金更形充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益，故本次現金增資計畫之效益應屬合理。

綜上所述，本公司本次辦理現金增資，其資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益應具合理性。

4. 各種資金調度來源對公司申報年度及未來年度每股盈餘稀釋之影響

本公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上櫃前之公開銷售

作業，該公司本次辦理現金增資發行普通股 5,806 千股，另於辦理公開承銷前有員工認股權憑證 173,713 股已執行完畢，故已發行股數為 43,187 千股，每股盈餘將因現金增資後股權稀釋比率為 11.85% (5,806 千股/(43,013 千股+173,713 股+5,806 千股)，考量本公司整體營運及獲利均能維持一定水準，且本次辦理現金增資用於充實營運資金，將可強化財務結構及償債能力、支應營運規模成長所需資金且維持公司之競爭力，整體而言對該公司營運發展係有正面之助益，故本次辦理現金增資發行新股對本公司每股盈餘稀釋影響應屬有限，對現有股東權益亦尚無重大影響。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性，未採用其他籌資方式之原因及其合理性暨所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九) 說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式：請參閱本公開說明書附件十六、承銷價格計算書。

(十) 資金運用概算及可能產生之效益：

1.收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應列明相關事項：不適用。

2.轉投資其他公司者，應列明相關事項：本公司本次募集資金並非用於轉投資，故不適用本項評估。

3.充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表。

A、公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形：不適用。

B、目前營運資金狀況：詳本公開說明書第 84~85 頁之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表。

C、所需之資金額度及預計運用情形

本公司本次申報現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷金額為新臺幣 185,792 千元，預計於 111 年第三季完成資金募集後，即用於充實營運資金，其資金用途及預計進度應合理。

(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率（或自有資產與風險性資產比率），說明償債或充實營運資金之原因。

A、應收帳款收款政策

本公司應收帳款政策係評估考量客戶屬性、擔保品及歷史收款情形等因素給予不同的授信條件，其主要授信條件為直接銷售客戶月結平均 110 天。本公司預計 111 及 112 年度對銷售客戶之收款政策變化不大，故本公司以此推估未來年度各月份應收款項之收款情形，用以編製未來年度之現金收支預測表，其應收款項收現之編製之假設基礎尚屬合理。

B、應付帳款付款政策

在應付帳款付款政策方面，本公司對供應商之選定及付款條件則視採購產品之數量、單價、品質、雙方合作期間及廠商供貨穩定性與及時性等因素而有不同，對主要供應商付款條件及付款天期係為月結 30~115 天，預估 111 及 112 年度之付款政策無顯著變動，故以此作為現金收支預測表之編製基礎，其應付款項付現之編製假設基礎尚屬合理。

C、資本支出計畫

經檢視本公司編製之現金收支預測表，本公司 111 及 112 年度之資本支出金額分別為 406,404 千元及 179,037 千元，主要分別考量 ABF 載板需求暢旺將帶動雷射鑽孔需求大增及擴大雷射加工機台自主性，且適度改善中國大陸區子公司產線精進需求而執行汰舊換新，此外，為因應鑽孔加工產能調度彈性、5G 電子產品製程工序之複雜與半導體、光電領域製程所需雷射加工製程，進而適度擴增自製雷射鑽孔設備之供給，經評估期編製假設基礎尚屬合理。

D、財務槓桿及負債比率

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	109年度	110年度
營業利益	135,323	156,629
利息費用	13,238	11,425
財務槓桿度(倍)	1.11	1.08
負債比率(%)	45.11	49.83

資料來源：本公司 109 年度 110 年經會計師查核簽證之個別財務報告

註：財務槓桿度=營業利益/(營業利益－利息費用)。

甲、財務槓桿

財務槓桿指數係為衡量公司舉債經營之財務風險，用以評估利息費用之變動對於營業利益之影響程度。若公司未舉債經營，則財務槓桿度為 1，而該數值若為正數，顯示舉債經營仍屬有利，惟若財務結構不良，則易發生資金週轉困難而陷入財務危機，該項指標數值愈高表示公司所承擔之財務風險越大。本公司 109 年度及 110 年即便向金融機構舉借長短期借款，但其財務槓桿度均維持在 1 倍，尚稱穩定，未有信用過度擴張之情形。預計此次辦理現金增資以充實營運資金將降低公司財務負擔及資金調度壓力，避免未來因業績成長導致對營運資金需求增加而向銀行借款所產生之利息費用，並提升償債能力及公司競爭力，故本公司以現金增資發行新股應有其必要性及合理性。

乙、負債比率

本公司 109 年度及 110 年度之負債比率分別為 45.11%及 49.83%，預計此次辦理現金增資以充實營運資金，將可降低負債比率，並強化財務結構以增加資金靈活調度彈性，故本次以現金增資發行新股用以充實營運資金，提高資金靈活運用空間並提升償債能力，確有其必要性及合理性。

(3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程，應就預計自購置該營建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，說明原借款原因，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形：不適用。

(4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：

本公司於 111 年度及 112 年度現金收支預測表中，預計重大資本支出金額分別為新台幣 406,404 千元及 179,037 千元，主係因臺中精工廠區承接原位於林口廠區之雷射應用代工，故修繕改建既有廠區之無塵作業環境、增購雷射鑽孔設備因應非 PCB 產業之客戶訂單及預留部分產能外包服務之需求，合計為新台幣 585,441 千元，已逾本次募集金額之百分之六十(新台幣 111,475 千元)，茲就其必要性、預計資金來源及效益說明如下：

A、必要性：

本公司原雷射應用廠區為林口廠承租面積為 559 坪，可供容納設備台數 31，且建置達 16 年以上，故作業環境設施老舊且空間上狹小不具規模效益，本公司於 108 年度著手規劃於台中精工廠區增設可供容納 100 台設備之雷射服務區域，分別於 109 年度及 110 年度陸續完工下，本公司為精實費用及管理便利，故於 110 年度 9 月，已將林口廠區設備南遷至台中精工廠區，以滿足客戶加工環境需求，降低生產成本，此外，本公司雷射應用之設備，初期由本公司之技術人員調整改良他牌之雷射鑽孔機台約 60 臺，從事雷射鑽孔代工業務，惟本公司子公司大船企業日本株式會社(以下簡稱日本大船)，於 105 年度已成功開發自製之 CO2 雷射鑽孔設備(原型機)，於 106 年度陸續經過臺灣 PCB 板廠認證後，開始投入雷射代鑽孔服務，並將他牌設備汰換，故截至目前為止本公司設備自給率臺灣地區已達 100%，中國大陸地區尚有 9 台牌設備，預計於未來二年內汰換之。

綜上所述，本公司購置資本支出除考量原既有廠房空間不足、無塵室設備老舊外暨考量 ABF 載板需求暢旺將帶動雷射鑽孔需求大增及擴大雷射加工機台自主性，以及半導體、光電產業雷射鑽孔之製程所需，所

應預留加工產能彈性，本次因本公司雷射應用代工部門之精實計畫，所產生無塵室作業環境建置、因應非 PCB 產業客戶之租賃訂單及預留廠區部分產能可供外包服務之需求，故資本支出實有其必要性。

B、預計資金來源：

本公司營運產生之現金流入及金融機構借款支應，以本公司 111 年 2 月底銀行借款額度尚有 641,933 千元，另以 109 年及 110 年營運活動之現金流量分別為 346,398 千元及 371,219 千元觀之，其資金來源應屬可行。

C、效益說明：

本公司如依計畫完成擴增雷射鑽孔機設備，除有利於本公司有效提升營業額創造更高利潤外，就長期無形效益而言，滿足客戶加工產能需求、同時持續性的提供雷射事業加工服務可以穩固競爭優勢外，亦可藉由代工生產因應各種加工板材而調整機台參數之經驗回饋至子公司日本大船，可再精進雷射加工機台之性能，期待未來雷射鑽孔機及其加工服務成為客戶的首選品牌。

4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案 銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工 程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據 及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

四、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

111年度

單位：新臺幣千元

項目	月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合計
期初現金餘額 1		71,909	102,382	152,440	80,902	73,984	78,017	83,471	85,934	86,575	89,248	88,354	87,148	71,909
加：非融資性收入 2														
應收款項收現		42,547	114,734	68,705	120,371	82,449	101,305	72,241	154,283	153,820	118,423	122,445	168,591	1,319,914
其他收現		3	2,251	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,301
合計		42,550	116,985	68,752	120,371	82,449	101,305	72,241	154,283	153,820	118,423	122,445	168,591	1,322,215
減：非融資性支出 3														
應付帳款付現		85,948	83,912	88,536	45,761	47,134	46,673	48,028	48,028	48,028	48,028	48,028	48,028	686,132
薪資		45,297	2,662	13,865	14,258	14,220	14,420	14,220	14,220	14,420	14,220	14,220	14,220	190,242
費用及其他付現		16,311	17,736	7,751	5,530	9,325	8,543	9,367	9,790	10,812	10,497	11,881	11,366	128,909
購置固定資產		14,184	48,622	25,231	38,195	82,037	50,624	35,731	13,936	27,234	22,875	35,210	12,525	406,404
利息費用及其他付現		698	829	3,418	805	14,070	1,091	6,347	805	14,233	805	4,908	954	48,963
員工紅利、董事酬勞		691	-	346	346	346	346	346	346	346	346	9,946	346	13,751
合計		163,129	153,761	139,147	104,895	167,132	121,697	114,039	87,125	115,073	96,771	124,193	87,439	1,474,401
要求最低現金餘額 4		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
所需資金總額 5=3+4		193,129	183,761	169,147	134,895	197,132	151,697	144,039	117,125	145,073	126,771	154,193	117,439	1,504,401
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5		(78,670)	35,606	52,045	66,378	(40,699)	27,625	61	111,480	83,710	69,288	44,994	126,688	(110,277)
融資淨額 7														
發行新股		-	-	-	-	-	185,792	-	-	-	-	-	-	185,792
借款		151,052	86,834	(1,143)	(22,394)	88,716	(84,946)	44,261	(66,517)	(36,074)	(22,546)	542	(86,115)	51,670
現金股利							(75,000)							(75,000)
合計		151,052	86,834	(1,143)	(22,394)	88,716	25,846	44,261	(66,517)	(36,074)	(22,546)	542	(86,115)	150,850
期末現金餘額 8=1+2-3+7		102,382	152,440	80,902	73,984	78,017	83,471	85,934	86,575	89,248	88,354	87,148	82,185	82,185

資料來源：本公司提供。

112年度

單位：新臺幣千元

項目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合計
期初現金餘額 1	82,185	83,364	84,765	84,052	87,549	85,949	88,077	88,588	90,463	87,426	82,031	85,089	82,185
加：非融資性收入 2													
應收款項收現	138,378	98,542	139,276	121,226	118,351	122,712	131,036	104,055	116,660	132,963	137,837	140,062	1,501,098
其他收現	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	138,378	98,542	139,276	121,226	118,351	122,712	131,036	104,055	116,660	132,963	137,837	140,062	1,501,098
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	91,840	67,252	52,618	53,859	57,540	60,359	61,635	57,985	51,936	53,442	64,011	72,873	745,350
薪資付現	35,453	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	191,873
費用及其他付現	15,591	12,705	12,612	12,219	9,909	10,522	9,319	9,756	10,791	10,477	11,861	11,345	137,107
購置固定資產	5,132	14,813	10,264	15,396	20,528	25,660	20,528	15,396	10,264	15,396	10,264	15,396	179,037
利息費用及其他	1,000	1,000	1,000	1,000	24,103	1,000	1,000	1,000	17,552	1,000	1,000	1,000	51,655
員工紅利、董事酬勞	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	9,946	346	13,752
合計	149,362	110,336	91,060	97,040	126,646	112,107	107,048	98,703	105,109	94,881	111,302	115,180	1,318,774
要求最低現金餘額 4	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
所需資金總額 5=3+4	189,362	150,336	131,060	137,040	166,646	152,107	147,048	138,703	145,109	134,881	151,302	155,180	1,358,774
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	19,589	19,958	81,369	56,626	27,642	44,942	60,453	42,328	50,402	73,896	56,954	58,359	212,897
融資淨額 7													
發行新股													
借款	12,163	13,195	(48,929)	(20,689)	6,695	66,523	(23,477)	(3,477)	(14,588)	(43,477)	(23,477)	(23,477)	(103,015)
現金股利	-	-	-	-	-	(75,000)	-	-	-	-	-	-	(75,000)
合計	12,163	13,195	(48,929)	(20,689)	6,695	(8,477)	(23,477)	(3,477)	(14,588)	(43,477)	(23,477)	(23,477)	(178,015)
期末現金餘額 8=1+2-3+7	83,364	84,765	84,052	87,549	85,949	88,077	88,588	90,463	87,426	82,031	85,089	86,494	86,494

資料來源：本公司提供。

伍、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1.簡明資產負債表

(1)國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料（註 1、註 2）					截至刊印日 最近期
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年 3 月 31 日止
流動資產		1,206,647	1,173,449	1,040,839	929,950	1,005,425	1,133,090
不動產、廠房 及設備		499,841	622,873	717,692	938,172	1,016,581	1,043,692
無形資產		1,951	8,791	6,216	4,080	5,912	10,970
其他資產		180,193	185,024	151,021	157,653	256,638	274,558
資產總額		1,888,632	1,990,137	1,915,768	2,029,855	2,284,556	2,462,310
流動 負債	分配前	752,792	925,522	753,983	814,156	937,428	1,076,575
	分配後	802,792	955,522	798,983	874,156	1,012,428	-
非流動負債		37,871	25,304	124,956	144,004	256,015	228,192
負債 總額	分配前	790,663	950,826	878,939	958,160	1,193,443	1,304,767
	分配後	840,663	980,826	923,939	1,018,160	1,268,443	-
歸屬於母公司 業主之權益		1,097,969	1,039,311	1,036,829	1,071,695	1,091,113	1,157,543
股本		444,007	443,435	443,435	443,435	430,133	430,133
資本公積		47,683	47,622	47,622	50,065	50,959	53,627
保留 盈餘	分配前	651,842	628,261	648,933	689,264	702,133	755,530
	分配後	601,842	598,261	603,933	629,264	627,133	-
其他權益		(44,201)	(45,058)	(68,212)	(76,120)	(92,112)	(83,484)
庫藏股票		(1,362)	(34,949)	(34,949)	(34,949)	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-	-
權益 總額	分配前	1,097,969	1,039,311	1,036,829	1,071,695	1,091,113	1,157,543
	分配後	1,047,969	1,009,311	991,829	1,011,695	1,016,133	-

註1：上述財務資料均經會計師查核簽證。

註2：截至公開說明書刊印日止，110年盈餘分配案經董事會通過，尚未經股東常會決議。

(2)國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度		最近五年度財務資料（註1、註2）				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
流動資產		758,502	775,278	683,528	677,481	783,286
不動產、廠房及設備		258,383	376,181	561,920	792,206	808,998
無形資產		-	6,625	5,588	4,080	5,912
其他資產		732,351	719,662	711,006	478,679	576,590
資產總額		1,749,236	1,877,746	1,962,042	1,952,446	2,174,786
流動負債	分配前	615,857	813,173	827,354	777,391	843,472
	分配後	665,857	843,173	872,354	837,391	918,472
非流動負債		35,410	25,262	97,859	103,360	240,201
負債總額	分配前	651,267	838,435	925,213	880,751	1,083,673
	分配後	701,267	868,435	970,213	940,751	1,158,673
歸屬於母公司業主之權益		1,097,969	1,039,311	1,036,829	1,071,695	1,091,113
股本		444,007	443,435	443,435	443,435	430,133
資本公積		47,683	47,622	47,622	50,065	50,959
保留盈餘	分配前	651,842	628,261	648,933	689,264	702,133
	分配後	601,842	598,261	603,933	629,264	627,133
其他權益		(44,201)	(45,058)	(68,212)	(76,120)	(92,112)
庫藏股票		(1,362)	(34,949)	(34,949)	(34,949)	0
非控制權益		-	-	-	-	0
權益總額	分配前	1,097,969	1,039,311	1,036,829	1,071,695	1,091,113
	分配後	1,047,969	1,009,311	991,829	1,011,695	1,016,113

註1：上述財務資料均經會計師查核簽證。

註2：截至公開說明書刊印日止，110年盈餘分配案經董事會通過，尚未經股東常會決議。

2.簡明綜合損益表

(1)國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	最近五年度財務資料（註1）					截至刊印日 最近期
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年 3 月 31 日
營業收入	1,610,676	1,542,739	1,175,825	1,000,900	1,245,511	410,964
營業毛利	452,120	431,584	418,019	336,009	386,151	140,059
營業損益	74,711	52,715	46,956	109,352	128,439	68,500
營業外收入及支出	5,014	5,254	7,393	686	(7,363)	4,817
稅前淨利	79,725	57,969	54,349	110,038	121,076	73,317
繼續營業單位本期淨利	55,978	32,045	50,403	89,295	91,064	53,397
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利	55,978	32,045	50,403	89,295	91,064	53,397
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(25,029)	(5,754)	(22,885)	(11,872)	(18,431)	8,628
本期綜合損益總額	30,949	26,291	27,518	77,423	72,633	62,025
淨利歸屬於母公司業主	55,978	32,045	50,403	89,295	91,064	53,397
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	30,949	26,291	27,518	77,423	72,633	62,025
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-	-
每股盈餘(元)	1.26	0.74	1.18	2.09	2.12	1.24

註1：上述財務資料均經會計師查核及核閱簽證。

(2)國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	最近五年度財務資料（註1）				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
營業收入	1,163,656	1,195,667	883,024	844,725	1,110,429
營業毛利	314,235	320,853	306,025	285,983	351,957
營業損益	57,934	68,075	56,440	135,323	156,629
營業外收入及支出	10,458	(24,739)	3,480	(26,347)	(32,988)
稅前淨利	68,392	43,336	59,920	108,976	123,641
繼續營業單位本期淨利	55,978	32,045	50,403	89,295	91,064
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利	55,978	32,045	50,403	89,295	91,064
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(25,029)	(5,754)	(22,885)	(11,872)	(18,431)
本期綜合損益總額	30,949	26,291	27,518	77,423	72,633
淨利歸屬於母公司業主	55,978	32,045	50,403	89,295	91,064
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	30,949	26,291	27,518	77,423	72,633
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	0
每股盈餘(元)	1.26	0.74	1.18	2.09	2.12

註1：上述財務資料均經會計師查核及核閱簽證。

(二)影響上述財務報表一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響：無。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

查核年度	查核會計師事務所	查核會計師	查核意見
110	勤業眾信聯合會計師事務所	楊清鎮 龔則立	無保留意見
109	勤業眾信聯合會計師事務所	楊清鎮 龔則立	無保留意見
108	勤業眾信聯合會計師事務所	楊清鎮 龔則立	無保留意見
107	勤業眾信聯合會計師事務所	楊清鎮 龔則立	無保留意見
106	勤業眾信聯合會計師事務所	楊清鎮 龔則立	無保留意見

2.最近五年度如有更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計失對更換原因之說明：無此情事。

(四)財務分析

1.國際財務報導準則(合併)

分析項目		最近五年度財務分析（註1、註2）					截至刊印日 最近期
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年 3 月 31 日
財務結構	負債占資產比率(%)	41.86	47.78	45.88	47.20	52.24	52.99
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	227.24	170.92	161.88	129.58	132.52	132.77
償債能力	流動比率(%)	160.29	126.79	138.05	114.22	107.25	105.25
	速動比率(%)	86.22	61.71	69.01	54.68	39.55	44.21
	利息保障倍數(倍)	6.70	5.49	3.98	8.00	9.34	22.23
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.34	3.94	3.41	3.23	5.29	7.09
	平均收現日數	110	93	107	113	69	51.48
	存貨週轉率(次)	2.17	2.05	1.39	1.39	1.62	1.74
	應付款項週轉率(次)	3.10	4.58	5.03	6.36	4.93	4.83
	平均銷貨日數	168	177	263	263	225	210
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	3.32	2.75	1.75	1.21	1.27	1.6
	總資產週轉率(次)	0.81	0.80	0.60	0.51	0.58	0.69
獲利能力	資產報酬率(%)	3.39	2.18	3.33	5.16	4.76	9.46
	權益報酬率(%)	4.96	3.00	4.86	8.47	8.42	19.00
	稅前純益占實收資本額比率(%)	17.96	13.07	12.26	24.81	28.15	68.18
	純益率(%)	3.48	2.08	4.29	8.92	7.31	12.99
	每股盈餘(元)	1.26	0.74	1.18	2.09	2.12	1.24
現金流量	現金流量比率(%)	16.86	6.00	註3	55.19	46.31	註3
	現金流量允當比率(%)	32.40	22.21	36.87	70.66	51.99	41.27
	現金再投資比率(%)	1.71	0.27	註3	19.77	17.51	註3
槓桿度	營運槓桿度	2.50	3.43	3.81	2.35	2.26	1.61
	財務槓桿度	1.23	1.32	1.64	1.17	1.13	1.05
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)							
1.速動比率：主係流動負債增加所致。							
2.應收款項週轉率(次)：主係出售設備增加所致。							
3.平均收現日數：主係出售設備增加所致。							
4.應付款項週轉率(次)：主係平均應付款項增加所致。							
5.現金流量允當比率(%)：主係營業活動存貨增加所致。							

註1：本公司自104年度起首次適用國際財務報導準則。

註2：本公司106年至110年財務資料業經會計師查核簽證。

註3：營業活動淨現金流量為淨流出，故不適用。

註4：分析項目之計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

2.國際財務報導準則(個體)

分析項目		年度	最近五年度財務分析（註 1、註 2）				
			106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
財務結構	負債占資產比率(%)		37.23	44.65	47.16	45.11	49.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)		438.64	282.99	201.93	148.33	164.56
償債能力	流動比率(%)		123.16	95.34	82.62	87.15	92.86
	速動比率(%)		66.48	42.99	36.62	36.37	27.25
	利息保障倍數(倍)		10.22	6.90	5.93	9.23	11.82
經營能力	應收款項週轉率(次)		4.88	5.36	4.31	4.27	7.00
	平均收現日數		74.80	68.10	84.69	85.48	52.14
	存貨週轉率(次)		2.27	2.34	1.46	1.48	1.65
	應付款項週轉率(次)		2.92	4.65	4.80	5.77	4.74
	平均銷貨日數		160.79	155.98	250.00	246.62	221.21
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		4.68	3.77	1.88	1.25	1.39
	總資產週轉率(次)		0.64	0.66	0.46	0.43	0.54
獲利能力	資產報酬率(%)		3.42	2.09	3.13	5.10	4.86
	權益報酬率(%)		4.96	3.00	4.86	8.47	8.42
	稅前純益占實收資本額比率(%)		15.40	9.77	13.51	24.58	28.74
	純益率(%)		4.81	2.68	5.71	10.57	8.20
	每股盈餘(元)		1.26	0.74	1.18	2.09	2.12
現金流量	現金流量比率(%)		1.52	6.12	註 3	44.56	44.01
	現金流量允當比率(%)		32.03	23.19	13.52	50.52	41.41
	現金再投資比率(%)		註 4	註 4	註 3	19.51	17.75
槓桿度	營運槓桿度		1.84	2.02	2.37	1.72	1.79
	財務槓桿度		1.15	1.12	1.27	1.11	1.08

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)

- 1.速動比率(%)：主係流動負債增加所致。
- 2.利息保障倍數(倍)：主係所得稅增加所致。
- 3.應收款項週轉率(次)：主係出售設備增加所致。
- 4.平均收現日數：主係出售設備增加所致。
- 5.總資產週轉率(次)：主係銷貨淨額增加所致。
- 6.純益率(%)：主係銷貨淨額增加所致。

註1：本公司自104年度起首次適用國際財務報導準則。

註2：本公司106年至110年財務資料業經會計師查核簽證。

註3：營業活動淨現金流量為淨流出，故不適用。

註4：營業活動淨現金流量減現金股利為負數，故不適用。

註5：分析項目之計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(五)會計項目重大變動說明：

比較最近二年度資產負債表及綜合損益表之會計項目，若金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者，應詳予分析其變動原因。

1.國際財務報導準則（合併）

單位：新臺幣千元

會計科目 \ 年度	109 年度		110 年度		增減變動		說明
	金額	% (註 1)	金額	% (註 1)	金額	% (註 2)	
應收帳款淨額	246,485	12	173,161	8	(73,324)	-30%	主要係設備產銷的應收款按合約收取及年底賣斷所致。
存貨	450,788	22	612,851	27	162,063	36%	主要係設備產銷的備料增加所致。
使用權資產	50,984	3	76,003	3	25,019	49%	主要係租賃青年廠及桃辦所致。
預付設備款	34,638	2	99,542	4	64,904	187%	主要係購買雷射鑽孔機及廠房整修所致。
短期借款	477,365	23	327,730	14	(149,635)	-31%	主要係年底償還短期借款所致。
合約負債-流動	25,290	1	138,436	6	113,146	447%	主要係設備產銷訂單之預收貨款所致。
應付帳款	113,850	6	234,927	10	121,077	106%	主要係設備產銷的備料增加所致。
其他應付款	109,142	5	133,466	6	24,324	22%	主要係獎金、紅利及上市櫃費增加所致。
長期借款	86,006	4	178,978	8	92,972	108%	主要係增加兆豐中長期專案借款所致。
租賃負債-非流動	33,054	2	54,887	2	21,833	66%	主要係租賃青年廠及桃辦所致。
營業收入	1,000,900	100	1,245,511	100	244,611	24%	主要係設備產銷收入增加所致。
營業成本	664,891	66	859,360	69	194,469	29%	主要係設備產銷收入增加所致。
營業毛利	336,009	34	386,151	31	50,142	15%	主要係設備產銷收入增加所致。
營業費用	226,657	23	257,712	21	31,055	14%	主要係獎金、紅利及上市櫃費增加所致。
營業淨利	109,352	11	128,439	10	19,087	17%	主要係設備產銷收入增加所致。
稅前淨利	110,038	11	121,076	10	11,038	10%	主要係設備產銷收入增加所致。
所得稅費用	20,743	2	30,012	3	9,269	45%	主要係前期投抵稅額調整所致。

註1：%指該科目於各相關報表之同型比率。

註2：%指以前一年為基期所計算出之變動比率。

2.國際財務報導準則（個體）

單位：新臺幣千元

會計科目 \ 年度	109 年度		110 年度		增減變動		說明
	金額	% (註 1)	金額	% (註 1)	金額	% (註 2)	
應收帳款淨額	174,223	9	126,456	6	(47,767)	-27%	主要係設備產銷的應收款按合約收取及年底賣斷所致。
存貨	378,284	19	542,740	25	164,456	43%	主要係設備產銷的備料增加所致。
使用權資產	5,502	-	45,897	2	40,395	734%	主要係租賃青年廠及桃辦所致。
預付設備款	89,078	5	238,873	11	149,795	168%	主要係購買雷射鑽孔機及廠房整修所致。
合約負債-流動	25,266	1	138,326	6	113,060	447%	主要係設備產銷訂單之預收貨款所致。
其他應付款	193,166	4	119,865	5	(73,301)	-38%	主要係獎金、紅利及上市櫃費增加所致。
長期借款	86,006	4	148,189	7	62,183	72%	主要係增加兆豐中長期專案借款所致。
租賃負債-非流動	2,234	-	37,977	2	35,743	1600%	主要係租賃青年廠及桃辦所致。
採用權益法之投資貸餘	3,541	-	41,051	2	37,510	1059%	主要海外子公司長期投資貸餘增加所致。
其他權益	(76,120)	(4)	(92,112)	(4)	(15,992)	21%	主要係國外營運機構財務報表換算之差額所致。
庫藏股票	(34,949)	(2)	-	-	34,949	-100%	主要係辦理庫藏股註銷所致。
營業收入	844,725	100	1,110,429	100	265,704	31%	主要係設備產銷收入增加所致。
營業成本	558,742	66	758,472	68	199,730	36%	主要係設備產銷收入增加所致。
營業毛利	285,983	34	351,957	32	65,974	23%	主要係設備產銷收入增加所致。
營業費用	152,928	18	189,302	17	36,374	24%	主要係獎金、紅利及上市櫃費增加所致。

註1：%指該科目於各相關報表之同型比率。

註2：%指以前一年為基期所計算出之變動比率。

(六)本國發行人自公開發行後最近連續七年或外國發行人最近連續七年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：不適用。

(七)外國發行人申請股票登錄興櫃者，得僅列示最近二年度之財務資料；外國發行人申請股票第一上櫃者，得僅列示最近三年度之財務資料：不適用。

二、財務報告應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告：

1.109 年度合併財務報告及會計師查核報告：詳參閱附件九。

2.110 年度合併財務報告及會計師查核報告：詳參閱附件十。

3.111 年度第一季合併財務報告及會計師核閱報告：詳參閱附件十三。

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表

1. 109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告：詳參閱附件十一。

2. 110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告：詳參閱附件十二。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無此情事。

三、財務概況其他重要事項

(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露相關資訊：無。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

1.財務狀況比較分析表

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	差異	
			增(減)金額	%
流動資產	929,950	1,005,425	75,475	8.12
不動產、廠房及設備	938,172	1,016,581	78,409	8.36
使用權資產(註 1)	50,984	76,003	25,019	49.07
無形資產	4,080	5,912	1,832	44.90
其他資產	106,669	180,635	73,966	69.34
資產總額	2,029,855	2,284,556	254,701	12.55
流動負債(註 2)	814,156	937,428	123,272	15.14
非流動負債(註 3)	144,004	256,015	112,011	77.78
負債總額	958,160	1,193,443	235,283	24.56
股本	443,435	430,133	(13,302)	(3.00)
資本公積	50,065	50,959	894	1.79
保留盈餘	689,264	702,133	12,869	1.87
其他權益(註 4)	(76,120)	(92,112)	(15,992)	21.01
庫藏股票(註 5)	(34,949)	-	34,949	(100.00)
權益總額	1,071,695	1,091,113	19,418	1.81
說明：				
1.使用權資產：主要係租賃青年廠及桃辦所致。				
2.流動負債：主要係因應付帳款及預收貨款增加所致。				
3.非流動負債：主要係因中長期借款、租賃負債增加所致。				
4.其他權益：主要係因國外營運機構財務報表換算差額增加所致。				
5.庫藏股票：主要係因辦理庫藏股票註銷所致。				

2.最近二年度財務狀況重大變動之影響及未來因應計畫：上述變動對本公司營運狀況尚無重大影響。

(二)財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

1.財務績效分析

單位：新臺幣千元；%

項 目 \ 年 度	109 年度	110 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入(註 1)	1,000,900	1,245,511	244,611	24.44
營業成本(註 1)	664,891	859,360	194,469	29.25
營業毛利	336,009	386,151	50,142	14.92
營業費用	226,657	257,712	31,055	13.70
營業淨利(註 1)	109,352	128,439	19,087	17.45
營業外收入及支出(註 2)	686	(7,363)	(8,049)	(1173.32)
稅前淨利	110,038	121,076	11,038	10.03
所得稅費用(註 3)	20,743	30,012	9,269	44.68
本期淨利(註 3)	89,295	91,064	1,769	1.98
本期其他綜合損益(註 4)	(11,872)	(18,431)	(6,559)	55.25
本期綜合損益總額	77,423	72,633	(4,790)	(6.19)
說明： 1.主因係因設備產銷收入成長，故導致營收增加。 2.主要係因 109 年度出售海外子公司利益及處分固定資產收益所致。 3.主要係因前期投抵稅額調整所致。 4.主要係因國外營運機構財務報表換算差額增加所致。				

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

(1)本公司定期追蹤過去經營績效及考量整體市場環境，且對未來發展方向訂立各年度之銷售目標，預期未來業績將可望於穩定中求成長。

(2)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司將致力於滿足終端客戶使用需求，且使財務資金之運用更為有效，以因應業務成長之需。

(三)現金流量

最近二年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

1.最近二年度現金流量變動情形分析

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	差異	
			金額	%
營業活動淨現金流量	449,315	434,106	(15,209)	(3.38)
投資活動淨現金流量	(336,705)	(296,844)	39,861	(11.84)
籌資活動淨現金流量	(55,511)	(119,333)	(63,822)	114.97
變動情形分析：				
(1)營業活動淨現金流量：主要係 110 年度因應訂單量成長故增加購料所致。				
(2)投資活動淨現金流量：主要係 110 年度廠房擴建及購置設備減少所致。				
(3)籌資活動淨現金流量：主要係 110 年度償還短期借款增加所致。				

2.流動性不足之改善計畫：本公司尚無流動性不足之情形，故不適用。

3.未來一年現金流動性分析：

期初現金餘額 a	預計全年來自營運活動淨現金流量 b	預計全年來自投資活動淨現金流量 c	預計全年來自融資活動淨現金流量 d	預計現金剩餘(不足)數額 a+b+c+d	預計現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
134,979	282,087	(507,464)	200,850	110,452	-	-
1. 營業活動：預計 111 年度營業淨利增加、故產生之淨現金流入。						
2. 投資及籌資活動：主係預計購置設備及利用資金償還借款。						
3. 預計現金不足之補救措施及流動性分析：本公司尚無現金不足之情形，故不適用。						

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

110 年度資本支出預算 602,041 千元，其中 365,867 千元為投入購置 VELA 雷射鑽孔機，以提昇雷射應用業務；其中 178,173 千元為投入廠房裝修及搬遷需求，係以自有資金或銀行融資之款項支應，其對財務業務並無重大影響。

最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

1.轉投資政策

本公司轉投資政策現階段以保守穩健為原則。

2.獲利或虧損之主要原因、改善計畫

近三年轉投資均為虧損，主要係中國供應鏈崛起，競爭激烈，產品價格下降，本集團不願降價或降低產品水準，致競爭力不足，營運虧損。

108 年間，本公司位於中國區營運策略布局之調整，將中國大陸華北、中之營運據點進行整合為華東地區，精簡華南地區功能，減少人力、降低費用，控管人力成本。109~110 年間，雖受惠新世代 5G 通訊、雲端等設備興起，市場對於 IC 載板需求上揚，但同年間中國大陸 PCB 產業聚落，中國大陸新冠肺炎影響，直接影響該區域 PCB 廠的正常運作，再加上，美中科技禁令影響，致本公司於中國大陸區的營收表現下滑，可望明年起呈現盈餘。

3.未來一年投資計劃：

展望未來，本公司的轉投資政策將配合公司產品事業之發展，轉投資重心將以有效取得公司成長所需之各項客戶服務為主。本公司長期之轉投資政策，係以保守穩健為原則，並配合公司長期發展策略進行本業相關之投資佈局。本公司將持續監督管理既有之轉投資公司，以達成預期之轉投資目標，強化整體投資績效。

(五)其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一) 最近三年度會計師提出之內部控制改進建議及內部稽核發現重大缺失之改善情形：

1. 最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：

年度	建議事項/因應措施
108	無。
109	建議：依資金貸與及背書保證處理準則第9條第1項第3條規定修改資金貸與他人管理辦法。 因應措施：本公司已於109/07/24提董事會並通過修改資金貸與他人管理辦法。
110	無。

2. 最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形：尚無重大缺失情事。

(二) 內部控制聲明書：請參閱附件一。

(三) 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：請參閱附件一。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：請參閱附件二。

四、律師法律意見書：請參閱附件三。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形：不適用。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項：不適用。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：不適用。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其主要缺失與改善情形：無此情事。

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：請參閱附件四。

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：不適用。

十三、本國發行人自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審

查取具之報告書：請參閱附件一。

十四、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾，及其重要業務之政策（公營事業不適用）：請參閱附件五。

十五、發行人是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：無

十六、發行人有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無

十七、發行人申請公司債上櫃者，應說明公司債本金及利息償還之資金來源，暨發行標的或保證金融機構之信用評等等級、評等理由及評等展望等信用評等結果：不適用

十八、發行人有本中心審查準則第十條第一項第四款或外國審查準則第九條第一項第三款情事者，應將該重大未改善之非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：無

十九、充分揭露發行人與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式：請參閱附件十六。

二十、發行人分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響：無

二十一、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明：無

二十二、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次有價證券後未來展進比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估：無。

二十三、其他必要補充說明事項：

（一）貴公司 108 及 109 年度營業收入分別較前一年度衰退 23.78%及 14.81%，有關貴公司業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

【公司說明】

（一）本公司所屬行業之產業概況及所營業務之主要內容

1. 本公司發展沿革

本公司成立於 80 年，初期主要提供日商日立製造所(下稱日立維亞)之鑽孔事業於臺灣、中國大陸地區之設備安裝、維修及保養業務，故本公司當時曾參與了國內上市櫃印刷電路板大廠如 C 公司、A 公司等，於臺灣、中國大陸廠區擴廠之過程。本公司後於 93 年度開始投入關鍵零組件(主軸)之研發製造，94 年至 99 年間成功量產空氣軸承(AIR BEARING)16 萬~38 萬轉主軸，順利達成為客戶提升機台性能之目標。另本公司亦投入研發機械鑽孔設備，於 96 年成功研發 VELA 品牌成型機搭載自製滾珠軸承式(BALL BEARING)主軸，101 年開發成功並量產 16 萬或 20 萬轉鑽孔機，108 年研發成功高階精密鑽孔機搭載 30 萬或 35 萬轉主軸，係國內少數可生產高轉速機械鑽孔機之廠商。

由於日立集團於 102 年間將日立維亞股權出售予香港商隆力集團，成為其旗下子公司維亞(股)有限公司(下稱維亞)，同時本公司亦進行組織重組，承接關係企業-大船企業(股)公司之日系設備代理業務(包含代理維亞、台灣日電產理德及日商日立化成之設備)，故 102 年至 107 年間，本公司之主要業務範疇涵蓋設備維修及保養業務、自有品牌產品銷售及日系他品牌之代理業務。另本公司於過去提供設

備維修服務客戶期間，曾接手客戶淘汰之雷射鑽孔機，經本公司維修升級後，亦可使用該中古機為客戶提供雷射加工服務，後隨著本公司研發團隊於 106 年度及 107 年度分別開發出 CO2 及 UV 雷射鑽孔設備，開始逐步減少代理業務，進而專注於自有品牌業務之發展，並以自製雷射鑽孔設備取代中古機進行雷射加工服務，截至目前為止，本公司已可全方位提供 PCB 雷射應用鑽孔加工服務、機械鑽孔機/成型機生產銷售及設備維修、保養改良業務。

本公司之雷射應用鑽孔加工服務之行銷模式，主係以自製之雷射鑽孔設備代客戶進行鑽孔加工或以出租方式取代機台買賣。不同於國外同業產銷之營運模式，主係因目前印刷電路板設備之主流仍係以日商三菱電機及日商維亞(前身為日立維亞)等國際大廠居多，考量前述領導大廠已獨占市場多年，直接打入產業不易，本公司基於過去之經驗，體認到客戶對於雷射加工有長期之需求，遂採取先由自製設備產出達到客戶要求之品質、取得客戶甚至終端客戶之認證後，再以代工方式切入其製程中，透過與客戶密切合作，可提升本公司雷射鑽孔設備之能見度與競爭力，亦可讓市場對本公司之雷射鑽孔設備逐步獲得認同感及信賴度，目前本公司除 PCB 產業外，亦逐步朝向跨領域產業應用，期望未來可將雷射鑽孔應用之觸角得以廣泛延伸。

2. 本公司所屬行業之產業概況

本公司之鑽孔工藝技術可應用於印刷電路板(Printed Circuit Board, 簡稱 PCB)或載板製程中，作為貫穿電路板層與層間的接點，製造出點對點間的通孔，使得 PCB 電路板或載板的線路分布密度更高，本公司機械鑽孔及雷射鑽孔設備，位處 PCB 或載板生產中間之製程服務。機械鑽孔及雷射鑽孔兩者各有其優缺點，取決於 PCB 或載板類型、材質及孔徑大小，自 84 年起，日本首將半導體基板加工結合應用雷射技術，慢慢受到業界重視而跟進採用，鑽孔工藝之孔徑由細微逐漸拓展至精微，以因應各式產業之製程所需。本公司在機械鑽孔設備上，擁有高轉速軸心(Spindle)的核心技術，由於目前鑽針需求愈細，為避免高轉速減少斷針發生之情況，目前本公司已成功開發軸心轉速最高可達每分鐘 35 萬轉，為業界少數擁有者，孔徑電鍍銅膜後，形成連接 PCB 板前後兩層間的電子線路，因此，鑽孔機軸心的轉速和穩定度將攸關 PCB 板的品質。此外，本公司自主開發之雷射鑽孔設備，可作為雷射應用加工服務生產設備，並可搭載不同的雷射源(CO2、UV)應用於各式載板、Mini LED PCB、半導體檢測製程等專業加工鑽孔上的需求。本公司另有成型機設備生產，以應用於印刷電路板之成型製程，即將整片印刷電路板之各個排版進行裁切後，再轉交由封裝廠進行晶片與印刷電路板或載板封裝生產。

依據臺灣電路板協會出版之 PCB 高階技術所調查的製程、材料、設備缺口與發展藍圖中，臺灣於載板項目之自主化程度為最低，約 7 成的關鍵材料與設備需要依賴外商，在高階材料自主化程度不足的有 Ajinomoto Build-up Film(以下簡稱：ABF)、樹酯(以下簡稱：BT)、乾膜、電鍍藥水；在機台方面，有 DI 的曝光機、雷射鑽孔機、機械鑽孔機、電測機等，其中，絕大部分來自於日本，顯見臺灣 PCB 在關鍵材料與設備的自主能力上還未達到相對應的表現，茲就本公司所屬行業之產業應用概況說明如下：

(1)PCB 產業概況

PCB 係將各種電子零組件藉由印刷電路板所形成之電路設計，做為組成零件間訊息溝通之重要媒介與承載，使各項零組件之功能得以發揮，可以說是電子產品的根基，廣泛應用於所有電子、通訊、資訊家電，汽車與航太產品。其類別有傳統的單/雙面板、多層板、高密度連結 (High Density Interconnect，簡稱 HDI) 板、IC 載板與軟板。隨著電子資訊及通訊產品需求擴增，並趨向輕薄短小與多功能化，對 PCB 產品(如 HDI 板與 IC 載板)之需求走向高階細密化。

105 年至 108 年間，我國行政院經濟部工業局，基於鞏固我國印刷電路板產業永續發展之利基，並帶領產業升級轉型發展，推動高階印刷電路板產業發展推動計畫，致力於推動印刷電路板產業提升系統整合及應用，帶動設備與材料產業投入關鍵設備與材料國產化開發，加強串聯先進設備或材料驗證，其中關鍵技術包含設備國產化或新材料國產化驗證、智能化產線。

109 年全球遭逢 COVID-19 疫情影響，疫情雖然影響了如汽車、智慧型手機等電子產品的需求，但也因疫情改變了生活型態而衍生了意料外的產品需求，例如遠端線上會議新增的通訊及視訊設備、宅經濟帶動的平板電腦及遊戲機、Work From Home 新增的筆記型電腦，尤其筆記型電腦 109 年出貨量預估超過 2 億台，年成長率超過 20%，因此筆記型電腦電路板相關供應商均有不錯的成長動能，也成為帶動整體電路板產值成長的力量之一；5G 效應商機亦不受疫情影響，5G 基地台的 ABF 載板、通訊設備的高速超高層板、5G 手機的 AiP 皆為高階電路板產品且具更高的平均單價，因此 5G 高階的高價產品也帶動 109 年電路板整體產值。依據 IEK 及 TPCA 資料顯示，109 年全球電路板產值(包含電路板廠商從事後段打件產值)預估約 697 億美金規模，相較 108 年成長率達 9.4%。另根據 Prismark 預測，全球印刷電路板產值由 98 年的 412 億美元增長到 108 年的 613 億美元，成長幅度 49.0%，預估 109 年成長率為 2.0%，各式印刷電路板產業將在 107 至 112 年之間以 3.7% 的年均複合增長率成長。

(2)雷射應用(加工)產業概況

雷射加工技術在工業上的應用，從金屬切削、鋼板切割、焊接及熱處理等機械加工，到電子產業中的印刷電路板鑽孔、薄膜電晶體液晶顯示器 (Thin film transistor liquid crystal display，簡稱 TFT-LCD) 切割、晶圓切割及微機電系統 (Micro Electro Mechanical Systems，簡稱 MEMS) 加工技術等，都已有十分廣泛的應用。

根據調查研究機構 Maximize Market Research 資料顯示，全球雷射材料加工市場規模將從 2016 年的 64 億美金成長至 2024 年的 97 億美金，複合成長率約達 6%，呈現穩健成長的態勢。雷射材料加工市場可大致分為雷射標籤、雷射精密加工(金屬切割/焊接等)和雷射清潔等領域。未來材料加工之需求將隨經濟發展和終端應用如消費性電子(手機、平板/筆電、穿戴式裝置、面板)、車用、工業等領域發展而持續增加，雷射技術將成為相關應用之關鍵技術，有助推動各項產業向上成長。



綜上所述，本公司所屬行業產業全球印刷電路板產值，依研究機構 Prismark 之預測，各式印刷電路板產業將在 107 至 112 年之間以 3.7% 的年均複合增長率成長，另根據調查研究機構 Maximize Market Research 資料顯示，全球雷射材料加工市場規模將從 105 年度至 113 年度複合成長率約達 6%，且我國政府亦致力扶植高階印刷電路板產業發展推動計畫，本公司所處之產業景氣維持成長的樂觀趨勢。

3. 本公司所營業務之主要內容

本公司主要從事提供印刷電路板/載板製程，所需搭載之鑽孔機及成型機設備之供應，或配合客戶製程所需提供雷射鑽孔加工，以利於下游印刷電路板廠之產能提升及產品良率優化，產品主要應用於電腦、通訊、車用及消費性電子商品，以下茲就主要產品項目、用途之營業收入金額列示表達：

單位：新臺幣千元

產品項目	重 要 用 途 及 功 能	108 年度		109 年度		110 年前三季	
		營收淨額	%	營收淨額	%	營收淨額	%
專業服務	雷射應用、主軸製造及維修，機台效能提升、維護保養服務。	912,184	77.58	825,709	82.43	513,976	58.11
設備產銷	機械鑽孔機、成型機--主要應用於 PCB(RAM module、穿戴裝置、車用載板等)、IC 載板等產業之鑽孔及成型製程。	253,091	21.52	154,963	15.47	344,160	38.91
其他	代理其他品牌之零件銷售。	10,550	0.90	21,059	2.10	26,341	2.98
合 計		1,175,825	100.00	1,001,731	100.00	884,477	100.00

資料來源：本公司提供。

(二)最近二年度及申請年度業績變化原因及其合理性分析

108 年度、109 年度及 110 年前三季各主要產品別業績及毛利率變動表

單位：新臺幣千元

年度	108年度				109年度			
產品	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)
專業服務	912,184	549,360	362,824	39.78	825,709	529,228	296,481	35.91
設備產銷	253,091	208,446	44,645	17.64	154,963	135,663	19,300	12.45
其他	10,550	—	10,550	100.00	21,059	—	21,059	100.00
合計	1,175,825	757,806	418,019	35.55	1,001,731	664,891	336,840	33.63

年度	109年度前三季				110年度前三季			
產品	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)
專業服務	606,980	386,222	220,758	36.37	513,976	391,218	122,758	23.88
設備產銷	96,363	87,694	8,669	9.00	344,160	255,073	89,087	25.89
其他	13,224	—	13,224	100.00	26,341	—	26,341	100.00
合計	716,567	473,916	242,651	33.86	884,477	646,291	238,186	26.93

資料來源：本公司提供。

1. 依主要產品別說明營業收入、營業成本、營業毛利及毛利率變化分析

(1)營業收入

本公司主要從事 PCB 雷射應用鑽孔加工服務、機械鑽孔機/成型機生產銷售及設備維修、保養改良業務。本公司的產銷方式，僅販售機械鑽孔設備及成型機設備，至於雷射鑽孔設備，主係考量本公司具備雷射鑽孔自製的技術，可配合客戶之需求搭載不同的雷射源，降低客戶購置設備成本及優化產線生產效率，故雷射鑽孔機係以鑽孔加工模式提供服務，本公司另尚有由自製鑽孔機台能力延伸至機台設備之維修、保養及改良之專業服務，有助提升客戶產線之稼動率及產品良率。本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季之營業收入分別為 1,175,825 千元、1,001,731 千元及 884,477 千元，茲就主要產品別營業收入之變化情形及其合理性說明如下：

A.專業服務

本公司之專業服務之維修、保養及改造服務，源自於本公司長期以來協助日商日立維亞於臺灣、中國大陸地區進行設備組裝、保養及維修業務之經驗，以及本公司所具備自製生產機械鑽孔設備之能力。由於機械設備之使用壽命在經歷長期生產下，易產生耗損或效能不佳之情況，若生產者欲延續設備耐用年限及穩定產線之品質，須確保既存設備得以穩定運轉、產線投產之稼動率及產能效率處於最佳狀態，故鑽孔設備中之關鍵性零組件必須定期進行維修、保養及改良。

有關專業服務之維修、保養及改造之收入認列，本公司係與客戶簽訂維修、保養及改良合約，若合約價款於 200 千元以上且其履約義務能合理

衡量（數量或時數）完成程度者，後續依客戶提出之服務需求提供維修、保養及改良服務，於服務提供完畢後，技術服務人員將該次服務之作業報告書與客戶確認服務提供完畢後，提交至會計單位並據以認列收入；若合約價款於 200 千元以下或其履約義務無法合理衡量完成程度者，依照 IFRS 15.35 辨認此契約類型係隨本公司履行合約時，客戶已同時取得並耗用該類型服務所產生之效益，且該資產強化時已由客戶控制，本公司對該項資產所提供之勞務亦無其他用途，符合 IFRS 15.35 隨時間逐步移轉對勞務之控制，因而隨時間逐步滿足履約義務並認列收入。履約價款係按提供之服務內容進行拆分，並依合約內容判定交易價格之分攤基礎，同時依照 IFRS 15.41 之規範於每月底分別按照已完成服務或隨合約時間經過之分攤基礎認列收入。

另，本公司之專業服務之雷射應用鑽孔代工服務，主係透過自主開發之二氧化碳雷射器(CO₂)及紫外線(UV)雷射鑽孔機設備，以及自主雷射光源整合技術，協助下游印刷電路板廠客戶，進行 IC 載板(含 ABF 載板)、類載板及 PC/NB 板等加工鑽孔製程之需求，主要應用於消費性電子產品中所需搭載之晶片等電子元件，舉凡：智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置及網通伺服等相關產品的製程上。綜觀國內其他印刷電路板廠在雷射鑽孔設備製程上，大多依賴國外進口設備，以日商三菱電機及日商維亞機械為大宗，而本公司則為目前國內少數具備獨立開發產能設備的雷射鑽孔加工廠商，長期以來，扮演著衛星協力工廠的角色支援著國內外印刷電路板廠的雷射鑽孔製程。

有關雷射應用收入認列，本公司與客戶訂立加工服務契約，於契約服務期限內就客戶提供之 PCB 板或載板進行客製化加工，並依照勞務提供進度認列加工收入。依照 IFRS 15.9 辨認此加工服務契約確認係屬 IFRS 15 之客戶合約，並依照 IFRS 15.22 辨識其履約義務，評估契約中承諾移轉之加工勞務為一履約義務。另依照合約內容評估本公司於 PCB 板或載板進行加工時，該項資產係由客戶所控制，且該加工服務所創造出之資產對於達航公司並無其他用途並且對已完成履約之款項具有可執行之權利，符合 IFRS 15.35 隨時間逐步移轉對勞務之控制，因而隨時間逐步滿足履約義務並認列收入，同時依照 IFRS 15.41 之規範以產出法衡量收入認列，於每月底針對已加工完成出貨至客戶端之部分認列收入。

本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季之專業服務的營業收入分別為 912,184 千元、825,709 千元及 513,976 千元，占各年度之營業收入比重分別為 77.58%、82.43%及 58.11%，本公司 108、109 年度業績逐年成長，主要受惠次世代電子產品須具備高傳輸、高速度的能力，以及 5G 世代網路伺服相關設備之升級需求，對 IC 載板（如：ABF 載板）需求大增，而載板製程中，雷射鑽孔為關鍵製程，正當下游印刷電路板廠自身產能不足，或陸續著手規劃擴建載板的產能，提升自身製程技術與能力的同時，則可由本公司先行透過自製雷射鑽孔機設備，提供下游印刷電路板廠加工鑽孔服務及解決問題之技術支援。110 年前三季本公司專業服務收入較前一年度同期減少 93,064 千元，變動幅度(15.32)%，係因下游印刷電路板廠擴充雷射

鑽孔產能設備下，委託由本公司進行雷射鑽孔加工服務之需求降低所致，另 109 年初中國大陸華中武漢地區爆發新冠肺炎疫情，使原先於中國大陸華中湖北一帶之 PCB 產業聚落經濟活動產生嚴重性之遲緩性成長，致本公司專業維修及保養之服務收入減少。

B.設備產銷

本公司設備產銷產品以鑽孔機(ND)與成型機(NR)兩大類產品組合為主。本公司機械鑽孔工藝設備的技術支援功能，若以多層印刷電路板為例，其開孔之目的，係為做出連接所需要的導通路徑，除了橫向的（平面方向）的連接外，同時，亦進行垂直立體的連接，故在 PCB 或載板製程上，除了在基板上鑽孔或孔壁上電鍍的方法外，亦有將孔填埋的技術，至於，成型機之用途功能，係應用印刷電路板之成型(Profile)作業製程上，即將整片印刷電路板之各個排版(Pattern)進行裁切後，再轉交由封裝廠進行晶片與印刷電路板或載板封裝生產。

有關設備買賣之收入認列，本公司與客戶簽訂設備產銷契約，依照 IFRS 15.9 辨認此契約確認其屬 IFRS 15 之客戶合約，依照 IFRS 15.22 辨識履約義務，評估契約中承諾移轉 ND/NR 機台為一履約義務。依照 IFRS15.31 之判斷，本公司與客戶簽訂之產銷契約，本公司需於客戶驗收時始將資產之控制權移轉移轉予客戶，符合 IFRS 15.38 非隨時間逐步滿足履約義務，係以驗收時點始滿足該履約義務。經考量本公司於客戶驗收前，對所銷售商品具有主導該資產之權利，並且擁有法定所有權，因而辨認此契約為某一時點滿足之單一商品銷售，同時依照 IFRS 15.41 於完成履約義務時認列銷貨收入。

本公司設備銷售之收款方式，多係於客戶訂購時須預先支付該筆交易總額 30%訂金、於預計設備交付前支付該筆交易總額 60%、驗收完成後支付該筆交易總額 10%尾款（實際狀況依合約約定）。另本公司於設備產品銷售後提供一年保固，並依據過去歷史經驗，於銷售時提列銷售金額 3%之負債準備，每年亦會針對提列政策進行適足性之評估。本公司 108 年底、109 年底及 110 年第三季底之負債準備-保固費用餘額分別為 14,381 千元、14,778 千元及 18,593 千元，提列之金額應屬充足。

本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季之設備產銷營業收入分別為 253,091 千元、135,663 千元及 344,160 千元，占營業收入比重分別為 21.52%、15.47%及 38.91%，109 年度設備產銷營業收入較 108 年度減少 117,428 千元，減少幅度 46.40%，主係因中國大陸 PCB 廠商用低階鑽孔機製造商大幅擴產，並以低價搶奪市場，致台灣 PCB 鑽孔機製造商營收逐年下滑，本公司低階產品因於中國大陸地區競爭力不足，相關設備產銷營業收入減少，且 109 年初起受新冠肺炎疫情影響，中國大陸各地因受封城、復工緩慢等複雜因素之影響，印刷電路板廠原訂擴廠計畫延緩，暫緩對本公司之設備採購，致本公司 109 年度機械鑽孔機設備較 108 年度銷售減少；惟本公司於 108 年研發成功高階精密鑽孔機可搭載 20 萬、30 萬或 35 萬轉主軸，109 年間經客戶認證，並自 109 年下半年起陸續出貨予 A 集團等客戶，110 年前三季

因受惠雲端、5G、AI 產品對 ABF 載板需求增加，致 A 公司、G 公司及競國等對高精密機械鑽孔設備數量之訂單增加，使設備產銷收入較 109 年同期增加 247,797 千元，增加幅度 257.15%。

C.其他

本公司其他類收入主係代理癸公司之電測治具所收取之收入，因本公司僅提供代理零件銷售等服務，故營業收入與成本係以淨額表達。本公司提供此類服務之主要客戶包含 C 公司、B 公司等。108 年度、109 年度及 110 前三季其他產品營業收入分別為 10,550 千元、21,059 千元及 26,341 千元，營業收入變動主係受下游印刷電路板廠客製化之檢測模具訂購量多寡影響所致，由於其他類營業收入於 108 年度、109 年度及 110 前三季僅分別占營業收入 0.90%、2.10%及 2.98%，比重甚低，故不擬予以深入分析。

(2)營業成本、營業毛利及毛利率

A.專業服務

本公司專業服務之營業成本、營業毛利及毛利率之變化方面，108 年度、109 年度及 110 年前三季之營業成本分別為 549,360 千元、529,228 千元及 319,218 千元，108 年度、109 年度之營業毛利分別為 362,824 千元、296,481 千元及 122,758 千元，毛利率分別為 39.78%、35.91%及 23.88%；109 年度專業服務之營業成本，相較前一年度減少 20,132 千元，變動幅度(3.66)%，係因設備關鍵零組件維修、保養與改造訂單減少，109 年度專業服務營業毛利較前一年度減少 66,343 千元，變動幅度(18.29)%，係因鑽孔設備及關鍵零組件之維修、保養與改造訂單減少，毛利率由 39.78%下降至 35.91%，變動幅度(9.73)%；110 年前三季專業服務之營業成本較前一年度增加 4,996 千元，變動幅度 1.29%，主要銷售客戶 C 公司、B 公司之雷射鑽孔設備仍以國外進口設備為採購主流，故隨著 C 公司採購之日商三菱電機設備於 110 年第一、二季已陸續交貨，致縮減對本公司之雷射應用代工訂單，營收下滑，固定成本卻增加所致，致 110 年前三季營業毛利較前一年度同期減少 97,999 千元，變動幅度(44.39)%，毛利率部分，110 年前三季為 23.88%較前一年度同期間 36.37%，下降 34.34%。

B.設備產銷

本公司108年度、109年度及110年前三季之設備產銷營業成本分別為 208,446 千元、135,663 千元及 255,073 千元，營業毛利分別為 44,645 千元、19,300 千元及 89,087 千元，毛利率分別為 17.64%、12.45%及 25.89%。109 年度設備產銷營業成本較 108 年度減少 72,783 千元，減少幅度 34.92%，係因中國大陸 PCB 設備紅海市場及受 109 年初起新冠肺炎疫情影響下，本公司 109 年度設備產銷之營業毛利較 108 年度減少 25,345 千元，減少幅度 56.77%；110 年前三季設備產銷營業成本較 109 年同期增加 167,379 千元，增加幅度 190.87%，係因後疫情時代下，因應 5G 產品在 PCB 或高階載板製程上，對高精密機鑽孔設備需求上揚，致本公司設備產銷之營業毛利亦增加 80,418 千元，增加幅 927.65%。另設備產銷之毛利率 108 年度、109 年度及 110 年前三季分

別為17.64%、12.45%及25.89%，109年度較108年度減少幅度29.42%，係因所銷售之機械鑽孔機及成型機為標準款及庫存機種，因銷售數量減少，惟尚有廠房折舊等固定成本，致未達規模經濟、毛利率下降，110年前三季較109年同期增加187.67%，係因110年前三季隨著5G世代電子產品符合高運算、高傳輸功能之訴求，在PCB或高階載板之製程上，需仰賴高精密機鑽孔設備應對，本公司於109年度銷售量約70%為較舊型之標準機，且係以貼近成本之價格出售，而110年前三季銷售數量約57.2%係屬標準機種，其餘約42.8%(占營收比重65%)係屬客製款高階鑽孔機，且高階鑽孔機毛利率約較標準機毛利率高約15%~20%，致110年前三季較109年同期毛利金額及毛利率均增加。

D.其他

本公司108年度、109年度及110年前三季其他產品營業毛利分別為10,550千元、21,059千元及26,341千元，因本公司其他類營業收入與成本係以淨額表達，故營業毛利變化不擬予以深入分析。

2. 主要銷售對象變化分析

108 年度、109 年度及 110 年前三季前十大客戶變動表

單位：新臺幣千元

	108 年度			109 年度			110 年前三季		
	名稱	金額	%	名稱	金額	%	名稱	金額	%
1	C 公司	213,205	18.13	C 公司	252,825	25.24	A 公司	190,625	21.55
2	A-2 公司	142,659	12.13	B 公司	92,269	9.21	B 公司	122,812	13.89
3	A 公司	75,009	6.38	A 公司	52,140	5.20	D 公司	73,143	8.27
4	L 公司	72,577	6.17	D-1 公司	37,205	3.71	C 公司	69,170	7.82
5	A-1 公司	49,379	4.20	A-1 公司	29,409	2.94	G 公司	52,997	5.99
6	F 公司	26,300	2.24	G 公司	28,252	2.82	競國	28,484	3.22
7	M-3 公司	24,406	2.08	I 公司	22,960	2.29	A-1 公司	21,876	2.47
8	瀚宇博德(江陰)	23,926	2.03	瀚宇博德(江陰)	21,504	2.15	YS	18,531	2.10
9	J 公司	23,709	2.02	C-1 公司	19,017	1.90	C-1 公司	18,227	2.06
10	B 公司	17,655	1.50	J 公司	18,848	1.88	H 公司	16,564	1.87
	小計	668,825	56.88	小計	574,429	57.34	小計	612,429	69.24
	其他	507,000	43.12	其他	427,302	42.66	其他	272,048	30.76
	合計	1,175,825	100.00	合計	1,001,731	100.00	合計	884,477	100.00

資料來源：本公司提供。

(1)主要銷售對象變化分析

茲就 108 度、109 年度及 110 年前三季前十大銷售對象變化情形及原因依照其集團分析如下：

A. C 集團

108 年度、109 年度及 110 年前三季對 C 集團之銷貨情形

單位：新臺幣千元

公司名稱	108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%
C 公司	213,205	18.13	252,825	25.24	69,170	7.82
C-1 公司	8,709	0.74	19,017	1.90	18,227	2.06
合計	221,914	18.87	271,842	27.14	87,397	9.88

資料來源：本公司提供。

C 公司主要從事生產及銷售傳統印刷電路板、HDI 板、軟硬複合板(Rigid-Flex)、ABF 載板及 PP 載板(Prepreg Substrate)，產品終端應用領域分別於電腦、智慧手機、5G 網通設備、AI 人工智慧及高效能運算，而 C-1 公司，為 C 公司持股 100% 之子公司，於中國大陸生產傳統電路板與載板為主，廣泛應用於汽車、消費性電子及記憶體用板上，透過兩地生產的互補效應，發揮技術相互支援。本公司對 C 集團之銷貨主係提供設備維修、保養及雷射應用服務。

本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季對 C 集團之銷售金額分別為 221,914 千元、271,842 千元及 87,397 千元，占銷貨淨額比重分別為 18.87%、27.14% 及 9.88%，本公司 108 年度及 109 年度對 C 集團之銷售金額較高，係因受惠於 5G 基礎建設啟動，推升高層數大尺寸之網通載板需求，使得 ABF 載板重新獲得青睞，廣泛被應用於 5G 基礎建設與高階智慧型手機，網通市場仍持續開發高階網通設備、人工智慧、雲端伺服器、天線模組及基地台收發器等高值化產品，使推升 C 公司對本公司之雷射鑽孔應用加工服務訂單成長，致 108 年度、109 年度均位居本公司之第一大銷售客戶，惟 110 年前三季因 C 公司進行設備汰換計畫，向國外進口之設備陸續交貨，減少對本公司雷射應用加工訂單，致退居至本公司之第四大銷售客戶。另 C-1 公司因持續提供雷射應用加工服務，於 109 年及 110 年前三季均位居本公司第九大銷售客戶。

B. A 集團

108 年度、109 年度及 110 年前三季對 A 集團之銷貨情形

單位：新臺幣千元

公司名稱	108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%
A 公司	75,009	6.38	52,140	5.21	190,625	21.55
A-2 公司	142,659	12.13	16,258	1.62	—	—
A-1 公司	49,379	4.20	29,409	2.94	21,876	2.47
合計	267,047	22.71	97,807	9.77	212,501	24.02

資料來源：本公司提供。

A 公司主要從事印刷電路板生產銷售及 IC 預燒測試代工，其產品項目包含硬板 PCB、軟板 PCB、HDI 板、IC 載板等，另 A-2 公司及 A-1 公司，均隸屬於 A 公司旗下之轉投資公司，主要從事設計、製造、加工計算器、通訊、超大型積體電路封裝所需精密高密互聯積層板、剛撓電路板、柔性印刷線路板等，產品終端應用於通訊、電腦、消費性、車用及航太，該集團終端主要銷售客戶為 Intel。本公司對 A 集團之銷貨主係提供高階印刷電路板製程所需之鑽孔及成型機設備販售、鑽孔設備之維修與保養服務以及雷射應用服務。

本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季對 A 集團銷售金額分別為 267,047 千元、97,807 千元及 212,501 千元，占銷貨淨額比重分別為 22.71%、9.77%及 24.02%，近年來，A 集團為配合下游客戶中、長期新產品之開發，漸進式地進行產能擴充與製程優化，惟 108 年度 12 月底，因中國大陸湖北省武漢市爆發新冠肺炎，中國大陸各省(市)政府為降低新冠肺炎疫情之蔓延，便展開封城管制禁令，迫使部分工廠停工，且 A-1 公司於 109 年間，逐漸將設備維修、保養及改造業務委託予單一特定廠商受理，致本公司 109 年度對 A-2 及 A-1 的設備出售及維修訂單減少；110 年前三季，受惠於高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、雲端與新世代 GPU 需求帶動 ABF 產業需求大增，A 集團對本公司高轉速鑽孔機設備需求增加，致 110 年前三季度 A 躍居至第一大銷售客戶之列。

整體而言，A 公司及 A-1 公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季皆位居本公司前十大銷售客戶排行之列，惟 A-1 公司因 108 年度擴廠完成，且將維修業務委託他廠，109 年度及 110 年前三季對本公司需求減少，致退出前十大銷售客戶之列。

C.M-3 公司

M-3 公司主要從事各種印刷電路板之製造、銷售，以及 TFT LCD 等產品之 PCB 基板加工組裝業務。本公司對 M-3 之銷貨主係提供鑽孔及成型設備販售，以及設備維修保養與雷射應用服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季，本公司對 M-3 銷售金額分別為 24,406 千元、10,261 千元及 7,126 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.08%、1.02%及 0.82%，本公司 108、109 年間對 M-3 銷售業績逐年遞減，係因雷射應用服務訂單減少，110 年前三季則較 109 年同期增加 228 千元，變動幅度 1.76%，因變動微小，不擬予深入說明。

D.L 公司

L 公司電子有限公司為國內上市公司於中國大陸之轉投資公司，主要產品包含單面板、雙面板、四層板、多層板、HDI 板等，產品終端應用領域分別為汽車、消費性、工業用及網通，並以汽車板為大宗並為全球第一大汽車板製造商。本公司對 L 公司之銷貨主係提供印刷電路板機械鑽孔及成型設備販售，以及鑽孔設備的維修保養服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季對 L 公司銷售金額分別為 72,577 千元、2,281 千元及 1,821 千元，占銷貨淨額比重分別為 6.17%、0.23%及 0.21%，108 年受惠全球投入電動車

的節能及智能化，推升汽車電子多層板的供給量，L 公司分階段擴建產能，致本公司對 L 公司鑽孔機設備的出貨量增加，隨著 L 公司之產能擴建案結束，亦降低設備採購之需求，109 年度起，雙方僅維持設備維修保養服務，L 公司並退出本公司前十大銷售客戶之列。

E.F 公司

F 公司主要經營印刷電路板製造、電子元件及組件製造等業務，包括類載板、高密度互聯板、積體電路封裝基板及相關電子裝聯、微電子及光電產品，其終端應用於通訊、消費性電子產品，如智慧型手機、NB 及數位照相機。本公司對 F 公司之銷貨主係提供專業服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季本公司對 F 公司銷售金額分別為 26,300 千元、11,500 千元及 10,996 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.24%、1.15%及 1.24%，108 年本公司對 F 公司銷售以雷射應用服務為主，109 年度及 110 年前三季之銷售變化係因雷射應用服務訂單減少，致 F 公司自 109 年度退出本公司前十大主要銷售客戶之列。

F. 瀚宇博德科技(江陰)有限公司

瀚宇博德(江陰)，為國內上市公司瀚宇博德股份有限公司(股票代碼：5469)持股 100%之子公司，主要生產雙面至十六層的多層印刷電路板，產品應用於筆記型電腦、行動電話、平面電視、遊戲機、通訊設備、機上盒及伺服器專用印刷電路板，其中，以筆記型電腦用板為大宗。本公司對瀚宇博德(江陰)之銷貨主係提供機械鑽孔與成型設備之維修保養服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季本公司對瀚宇博德(江陰)銷售金額分別為 23,926 千元、21,504 千元及 14,488 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.03%、2.15%及 1.64%，瀚宇博德科技(江陰)工廠位於中國華中及華南廠區生產基地，為優化產能需求而汰換部分老舊設備的零件，故持續對本公司下單，110 年前三季隨著產線擴增計畫已完工，對本公司減少採購訂單，並退出前十大銷售客戶之列。

G.J 公司

J 公司為國內上市透過第三地於中國山東煙台之轉投資事業，主要提供硬質單(雙)面印刷電路板、硬質多層印刷電路板、軟質多層印刷電路板及其他印刷電路板之產銷業務，終端應用於 PC/NB、可攜式電子裝置等產品。本公司對 J 公司之銷貨主係提供鑽孔與成型設備產品及維修保養服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季銷貨金額分別為 23,709 千元、18,848 千元及 11,250 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.02%、1.88%及 1.27%，於 108 年間，受因美中貿易戰的影響下，使得下游消費性電子大廠的出貨意願降低，且 109 年度因新冠肺炎(COVID-19)於全球肆虐的影響下，致本公司對 J 公司銷售金額逐年遞減，並於 110 年前三季退出前十大銷售客戶之列。

H.B 公司

本公司對 B 公司之銷貨主係提供鑽孔及成型設備之維修保養及雷射應用服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季本公司對 B 公司銷售金額分別

為 17,655 千元、92,269 千元及 122,812 千元，占銷貨淨額比重分別為 1.50%、9.21%及 13.89%，109 年度起對 B 公司之銷售金額持續增加，係因 5G、高效能運算和人工智慧等應用帶動 ABF 載板及 BT 載板的供給需求，以致 B 公司對本公司增加雷射應用服務的訂單需求，整體而言，B 公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季均位居本公司前十大銷售客戶之列。

I.D 集團

108 年度、109 年度及 110 年前三季對 D 集團之銷售情形

單位：新臺幣千元

公司名稱	108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%
D-1 公司	6,890	0.59	8,630	0.86	73,143	8.27
D 公司	100	0.01	37,205	3.72	10,870	1.23
合計	6,990	0.60	45,835	4.58	84,013	9.50

資料來源：本公司提供。

D 公司生產基地遍佈臺灣及中國，從早期 PC 使用的多層板（Multilayer PCB），升級至智慧裝置使用的 HDI 板與軟硬板（Rigid-Flex PCB），並延伸到智慧汽車使用的汽車板，終端應用於智慧手持裝置（手機及無線耳機等）、車用、IT（平板/NB），另，D-1 公司係因原 D-1 公司廠區獲中國大陸政府通知進行遷廠乙案，故於中國大陸江蘇南通設立之新廠，作為因應 D-1 公司廠產能之銜接。本公司對 D 集團之銷貨主係提供機鑽機及成型設備販售，以及鑽孔設備之維修保養服務。

108 年度、109 年度及 110 年前三季對 D 集團之銷售金額分別 6,990 千元、45,835 千元及 84,013 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.60%、4.57%及 9.50%，109 年度因 D-1 公司於新設廠房銜接原 D-1 公司的產能，而增加鑽孔機設備採購，D-1 公司於 109 年成為本公司第四大銷售客戶；另 110 年前三季 D 公司為因應高階 NB 及消費性電子商品及車用電子產品等軟、硬結合板之應用製程需求，增加鑽孔設備採購訂單，故於 110 年前三季成為本公司第三大銷售客戶。

J.G 公司

G 公司主要業務內容為提供機械鑽孔加工服務，本公司對 G 公司之銷貨主係供應機鑽機及成型設備販售，以及鑽孔設備之維修與保養服務。本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季對 G 公司之銷售金額分別為 461 千元、28,252 千元及 52,997 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.04%、2.82%及 5.99%。109 年度及 110 年前三季 G 公司為配合下游客戶的高階載板投產製程需求，陸續向本公司增添機台設備，致 G 公司於 109 年度及 110 年前三季均位居本公司前十大銷售客戶之列。

K.I 公司

I 公司為國內上市公司旗下轉投資之子公司，主要從事發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷。本公司對 I 公司之銷貨主係提供機鑽機及

成型設備販售，以及鑽孔設備之維修與保養服務。本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季銷售金額分別為 8,057 千元、22,960 千元及 4,510 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.68%、2.29%及 0.46%，108 年度本公司以維修保養服務訂單服務為主，109 年度係因出售鑽孔機設備銷售業績成長，另，110 年前三季較 109 年同期，係因專業服務設備維修、保養訂單減少，則退出前十大銷售客戶之列。

L. 競國實業股份有限公司

競國生產基地遍佈臺灣及中國，主要從事專業製造雙層、多層印刷電路板且採少量多樣方式生產，終端應用於網路、LED、DRAM 模組、電視、消費性電子、汽車等領域，本公司對競國主係提供機械鑽孔設備販售。本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季銷售金額分別為 10,897 千元、12,733 千元及 28,484 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.93%、1.27%及 3.22%，本公司於 108 年度、109 年度及 110 年前三季銷貨逐年增加，主係因競國汰換部分老舊設備，本公司對其出售鑽孔機所致。

M.H 公司

H 公司主要從事 PCB 鑽孔成型設備及主軸之維修業務，本公司對 H 公司之銷貨主係銷售雷射鑽孔設備相關關鍵性零件。108 年度、109 年度及 110 年前三季對 H 公司之銷售金額分別為 2,423 千元、12,842 千元及 16,564 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.21%、1.28%及 1.87%。109 年度因雷射鑽孔設備之關鍵性零件出售增加，另 110 年前三季則因雷射光學零件屬高單價之出售增加，致 110 年前三季竄升為第十大銷售客戶之列。

N. ヤハタ精工株式会社(英譯，YAHATA-SEIKO CO. LTD，以下簡稱 YS)

YS 係日商八幡商事株式会社(英譯:YAHATA CO.)之關係企業，主要從事印刷電路板製造鑽孔及雷射鑽孔專業加工，本公司主要提供 YS 雷射應用服務及設備租賃業務。108 年度、109 年度及 110 年前三季銷售金額分別為 7,347 千元、4,400 千元及 18,531 千元，占各年度之銷貨淨額比重分別為 0.37%、0.44%及 2.10%，108、109 年間，本公司主要提供少量的雷射應用代工服務為主，然自 110 年下半年起，因市場對載板需求日益增加，YS 公司為擴增產能因應，故向本公司承租雷射鑽孔設備，作為穩定產能之供給與交期，致本公司於 110 年前三季 YS 竄升至本公司前十大銷售客戶之列。

本公司 108 年、109 年度及 110 年前三季之銷貨對象增減變化，主要受終端市場中、長期產品發展需求，間接牽動下游印刷電路板廠之製程改善、產能擴充及建置之需求影響所致，108 年度、109 年度及 110 年前三季並未對單一銷售對象達三成以上之情事，尚無銷售集中之情事。

(2)本公司授信政策說明

本公司目前之客戶信用管理方式，因本公司能取得客戶的信評資訊有限，無法深入評估客戶相關債信狀況，故現行之授信政策主係參酌銀行反饋本公司客戶應收帳款之信評資料後，採行下列方式給予授信額度：

- A. 信用額度設定：透過本公司向銀行申請應收帳款賣斷額度時，銀行對賣斷客戶之徵信情況所核定之賣斷額度作為對該客戶之信用額度，並於 ERP 系統中設定。倘銀行評估客戶信用不佳或不願列入承作對象，本公司就該客戶之首次交易會採預收或現金交易三個月後，經內部審核才會給予適當之授信額度；另，若部分銷售客戶資訊銀行無法提供者，本公司則依客戶基本資料(含營業事業登記資料、財務報告等)，連同外部信評單位可提供之信評資料進行徵信，並採逐筆交易審核方式授信，此外，本公司將視雙方交易歷史紀錄良好，基於業務需求，經各區域業務單位最高主管核准後，將給予適當額度之授信金額。
- B. 額度控管：客戶應收帳款、應收票據、已建立銷貨單金額總計超過設定之授信額度時，系統會自動將銷貨單鎖住，營業單位應評估交易風險，若判斷該交易繼續執行，則至系統填寫「客戶銷貨單解鎖之申請-公司作業」或「客戶銷貨單解鎖之申請-委任作業」進行解鎖申請，經核決權限權責主管審核通過後，由財務至 ERP 系統進行解鎖作業。
- C. 信用額度調整：
- 當銀行核定之賣斷額度(一年續約一次)有變動，本公司將同步進行調整。
 - 若營業單位判斷應調整信用額度時，需至系統填寫「客戶授信核准/變更-公司作業」或「客戶授信核准/變更-委任作業」進行授信額度變更申請，經核決權限權責主管審核通過後，由財務至 ERP 系統內進行信用額度之修改。

另，本公司對信用額度的追蹤管理上，係參照銀行每年度對賣斷客戶之徵信情況，所給予之信用評等，作為本公司對該客戶之信用評鑑之參考依據，至於，部分無法取得銀行之徵信資訊者，本公司則每年度檢視客戶之交易與付款情形後，雖未給予信用評鑑，但仍將會適度調整逐筆審核之條件，於額度或收款天期等條件上，給予適當之調節。

本公司因過去曾有代理日系廠商客戶產品之相關業務，當時多有進貨廠商要求本公司支付款貨款期限短於本公司對銷貨客戶收款期限之情形，致有融資需求，復加前述本公司不易取得銷貨客戶之債信狀況資料，故採將本公司應收帳款交予往來銀行進行信用評估，後於有資金需求時再依照信評結果將應收帳款賣斷予銀行之情形。目前本公司主係依個別客戶交易條件、收款天期及歷史付款經驗等因素，針對收款天期較長，或評估可能延遲付款機率較高者，在符合銀行之可承作範圍，將應收帳款出售予銀行，以移轉倒帳之風險。惟隨著本公司代理業務逐漸減少，應收帳款賣斷情形亦較過去大幅下降。

3. 營業費用及營業利益變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元；%

項目	108 年度		109 年度		109 年前三季		110 年前三季	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率	金額	占營收比率	金額	占營收比率
推銷費用	115,065	9.79	77,495	7.74	59,295	8.27	60,336	6.82
管理費用	150,267	12.78	98,025	9.79	68,294	9.53	81,159	9.18
研究發展費用	89,147	7.58	66,331	6.62	54,151	7.56	36,865	4.17
預期信用風險損失(利益)	16,584	1.41	(15,194)	(1.52)	(12,063)	(1.68)	527	0.06
營業費用合計	371,063	31.56	226,657	22.63	169,677	23.68	178,887	20.23
營業利益	46,956	3.99	110,183	11.00	72,974	10.18	59,299	6.70

資料來源：本公司各期間經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(1)營業費用

本公司 108~109 年度及 110 年前三季之營業費用分別為 371,063 千元、226,657 千元及 178,887 千元，109 年度營業費用較 108 年度減少 144,406 千元，主係因 108 年間對於中國大陸華東、華南地區的營運據點進行整合，致營業費用減少 36,207 千元，以及處分子公司大船煙台股權，致營業費用減少 23,940 千元，復因 109 年度新冠肺炎疫情影響交際費用及旅費支出減少 14,665 千元，且 109 年度雷射應用加工服務以少樣多量，致雷射應用設備精進改良開發投入減少 21,087 千元，此外，本公司另於 109 年度收回 108 年度已提列備抵呆帳之應收帳款，於 109 年度迴轉減損損失，致 109 年度預期信用風險損失較 108 年度減少 31,778 千元；另 110 年前三季營業費用較 109 年同期增加 9,210 千元，主要係因 110 年前三季申請股票初次上櫃費支付中介機構包含會計師、律師及推薦券商等勞務費用增加 9,318 千元所致。本公司 108~109 年度及 110 年前三季之營業費用率分別為 31.56%、22.63%及 20.23%，經前述組織調整後，本公司之營業費用率於 109 年度及 110 年前三季下降至 22.63%及 20.23%，預計之後將維持 20%左右之水準。茲就營業費用組成之變動原因說明如下：

A.推銷費用

本公司推銷費用主要包含業務人員薪資及獎金支出、保險費用、交際費用、旅費、廣告費用等項目，108~109 年度及 110 年前三季之推銷費用分別為 115,065 千元、77,495 千元及 60,336 千元，占各期營業收入比重分別為 9.79%、7.74%及 6.82%。109 年度較 108 年度減少 37,570 千元，減少幅度 32.65%，係因 108 年度本公司調整中國區營運策略布局對於中國大陸華東、華南地區的營運據點進行整合，並處分子公司大船煙台股權，致華北地區員工人數由 51 人減至 0 人，使 109 年度薪資費用較 108 年度減少 11,750 千元，另 109 年度因新冠肺炎影響下，全球各地政府限縮人流的經濟活動範圍，致本公司的交際費用及旅費支出較 108 年度分別減少 10,043 千元及 4,622 千元，110 年前三季較 109 年同期增加 1,041 千元，因增加幅度僅 1.76%，故不擬深入分析。

另本公司 108 年、109 年度及 110 年前三季佣金金額分別為 2,486 千元、

985 千元及 594 千元，占合併營收比率分別為 0.21%、0.10%及 0.07%，主係透過經銷代理商 HANSHIN 提供南韓當地 PCB 廠維護保養服務，及透過經銷代理商佳椿於越南當地拓展本公司設備產銷產品。108 年度、109 年度及 110 年前三季與 HANSHIN 相關銷貨扣除佣金後之毛利率約為 39.78%，尚無明顯低於 108 年度、109 年度及 110 年前三季專業服務毛利率 39.78%、35.91%及 23.88%之情形；另 108 年度與佳椿相關銷貨扣除佣金後之毛利率約為 15%，僅微幅低於 108 年度產銷設備毛利率 17.64%。綜上所述，本公司支付佣金作為拓展本公司設備產銷產品及維護保養服務之目的，以尋求銷售通路發展，對本公司較有經濟效益，故應有其必要性及合理性。

B.管理費用

本公司管理費用主要包含薪資支付、保險費用、租金支出、折舊、保險費用等項目，108~109 年度及 110 年前三季之管理費用分別為 150,267 千元、98,025 千元及 81,159 千元，占各期營業收入比重分別為 12.78%、9.79%及 9.18%，109 年度較 108 年度減少 52,242 千元，減少幅度 34.77%，係因本公司集團政策之營運策略調整，於 108 年 8 月為樽節管理費用支出，將原先向關係人大船開發公司承租林口廠之辦公管理中心，遷移至台中大甲幼獅工業區之自有廠區，落實廠辦合一，致本公司員工人數大幅縮減 18 人，且同年 10 月除了處分子公司大船煙台公司股權外，亦縮減大陸地區華東、華南營運地區之員工人力，由 47 人減至 12 人，致薪資費用減少 23,943 千元、租金費用減少 4,042 千元、保險費用減少 5,121 千元、折舊費用減少 4,222 千元及其他費用減少 5,581 千元。110 年前三季管理費用較 109 年同期增加 17,286 千元，增加幅度 18.84%，主要係因 110 年前三季申請股票初次上櫃費支付中介機構包含會計師、律師及推薦券商等勞務費用增加 9,318 千元、翻修裝潢臺中精工廠的修繕費用增加 635 千元、新購辦公桌椅之雜項購置增加 371 千元所致。

C.研究發展費用

本公司研究發展費用主要包含研發部門薪資支付、保險費、資訊軟體使用費、勞務費用、檢測費用等項目，108~109 年度及 110 年前三季之研發費用分別為 89,147 千元、66,331 千元及 36,865 千元，占各期營業收入比重分別為 7.58%、6.62%及 4.17%。109 年度較 108 年度減少 22,816 千元，減少幅度為 25.59%，係因 109 年度雷射應用加工服務以少樣多量，致雷射應用設備精進改良開發投入減少 21,087 千元，隨著本公司雷射應用設備已逐漸成熟且已貼近市場需求下，致 110 年前三季較 109 年同期減少 17,286 千元，減少幅度 31.92%。

D.預期信用風險損失(利益)

本公司 108~109 年度及 110 年前三季之預期信用風險損失(利益)分別為 16,584 千元、(15,194)千元及 527 千元，占各期營收比重分別為 1.41%、(1.52)%及 0.06%，109 年度較 108 年度減少 31,778 千元，變動幅度(191.62)%，係因 108 年度 L 公司電子及雄福之逾期應收帳款，於 109 年度已陸續回收所致，110 年度前三季因金額微小，故不擬予深入分析。

(2)營業利益

本公司 108~109 年度及 110 年前三季之營業利益分別為 46,956 千元、110,183 千元及 59,299 千元，另營業利益率分別為 3.99%、11.00%及 6.70%，109 年度營業利益較 108 年度增加 63,227 千元，增加幅度 134.65%，係因本公司於 108 年度調整中國區營運策略布局，同時將林口辦公處與臺中廠區進行廠辦合一撙節開支，致 109 年度營業費用較 108 年度減少 141,113 千元，營業利益率由 3.99%上升至 11.00%，110 年前三季營業利益較 109 年同期減少 13,675 千元，減少幅度 18.74%，分別係因 110 年前三季因雷射應用需求訂單減少，受產品銷售組合調整影響，營業毛利減少 4,465 千元，又 109 年前三季營業費用因迴轉原提列 L 公司電子的呆帳費用 10,355 千元所致。

4. 營業外收支變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元

年度		108 年度	109 年度	109 年 前三季	110 年 前三季
利息收入	利息收入	919	634	536	496
其他收入	其他	3,290	2,543	2,335	3,584
其他利益及損失	處分子公司利益	28,850	6,885	—	—
	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	(1,829)	4,885	3,508	7,154
	淨外幣兌換利益(損失)	(1,970)	3,346	700	5,017
	租賃修改利益	59	194	193	—
	不動產、廠房及設備減損回升利益	356	—	—	—
	手續費支出	(1,875)	(1,720)	(1,299)	(1,603)
	其他	(2,164)	(1,188)	(1,033)	(2,238)
財務成本		(18,243)	(15,724)	(12,147)	(10,761)
合計		7,393	(145)	(7,207)	1,649

資料來源：本公司各期間經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(1)利息收入

本公司 108~109 年度及 110 年前三季利息收入分別為 919 千元、634 千元及 496 千元，主係本公司帳上資金存放銀行存款及押金設算之利息收入，109 年度較 108 年度減少 285 千元，係因本公司美金存款部位，受因新臺幣匯率升值影響所致，110 年前三季較 109 年同期減少 40 千元，係存款利息減少所致。

(2)其他收入

本公司 108~109 年度及 110 年前三季其他收入分別為 3,290 千元、2,543 千元及 3,584 千元，109 年度較 108 年度減少 747 千元，減少幅度 22.71%，係因 108 年度駐廠雷射設備之營業租賃所產生之租金收入 400 千元，於 109 年度起轉列營業收入項下所致，110 年前三季較 109 年同期增加 1,249 千元，主係因勞資和解金 200 千元及廢料零件回收 336 千元。

(3)其他利益及損失

- A.處分子公司利益：本公司 108~109 年度及 110 年前三季處分子公司利益分別為 28,850 千元、6,885 千元及 0 千元，係因 108 年 10 月出售子公司大船煙台股權所產生之利益，出售合約內容述明價款之 5%係於大船煙台之應收帳款實際收回後，始有向買方收取之權利，故於 108 年度計算處分投資利益時，未將其 5%納入計算，而於 109 年度確認已達成履約義務時，始認列此變動價款之處分利益。
- B.處分不動產、廠房及設備利益(損失)：本公司 108~109 年度及 110 年前三季處分不動產、廠房及設備利益(損失)分別為 (1,829)千元、4,885 千元及 7,154 千元，本公司於 108 年度第二季逐步調整集團營運策略，108 年度因出售子公司大船煙台之股權後，將部分老舊設備處分致產生損失 1,829 千元，109 年度及 110 年前三季則係本公司將中國大陸區及臺灣區部分日系他牌老舊鑽孔機設備出售所產生之利益。
- C.淨外幣兌換利益(損失)：本公司 108~109 年度及 110 年前三季之淨外幣兌換利益(損失)分別為(1,970)千元、3,346 千元及 5,017 千元，109 年度由 108 年度之兌換損失轉為外幣兌換利益，係因本公司於中國大陸區銷貨收款，採美元交易，然 108 年度美中貿易關係漸緩，美國 Fed 降息及英國脫歐等國際政經變動，造成美元走弱，而致有匯兌損失，109 年度及 110 年前三季因本公司向子公司日大船購置設備付款，採日幣交易，因受日圓走弱、新臺幣走強影響，產生外幣兌換利益。為避免匯率波動之風險，本公司與往來銀行隨時保持密切聯繫，並請銀行提供專業諮詢，以因應國際間匯率的走勢，且本公司財務部門在外匯資金保留外幣部位，並視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動之影響。
- D.租賃修改利益：本公司 108~109 年度及 110 年度前三季之租賃修改利益分別為 59 千元、194 千元及 0 千元，109 年度較 108 年增加 135 千元，係因東莞達程與大船科技(東莞)有限公司提前終止租賃契約所致。
- E.不動產、廠房及設備減損回升利益：本公司 108 年度之不動產、廠房及設備減損回升利益 356 千元，係 108 年第三季大船煙台出售設備所產生之資產評價利益回升。
- F.手續費支出：本公司 108~109 年度及 110 年度前三季之手續費支出分別為 1,875 千元、1,720 千元及 1,603 千元，主係銀行匯款手續費支出，109 年度較 108 年度減少 155 千元，其變動主要受因外幣匯款業務頻率之增減影響。
- G.其他：本公司 108~109 年度及 110 年前三季之其他分別為(2,164)千元、(1,188)千元及(2,238)千元，108 年度及 109 年度主係分期支付 M-2 公司電子賠償款(共賠償美金 100 千元)，分別支付 1,928 千元及 688 千元，110 年前三季較 109 年同期增加，主係因上海達航遷址，經當地稅局核定補繳 105 年度中國大陸內銷稅 2,193 千元所致。

(4)財務成本

本公司 108~109 年度及 110 年前三季之財務成本分別為 18,243 千元、15,724 千元及 10,761 千元，主要包含銀行借款利息、租賃負債之利息、應收帳款讓售利息、應付公司債利息及其他財務成本，109 年度較 108 年度財務成本減少 2,519 千元，減少幅度 13.81%，係因 109 年間陸續償還銀行借款，致銀行借款利息減少 3,440 千元，

110 年前三季較 109 年同期減少 1,386 千元，減少幅度 11.41%，係因銀行借款減少所致。

(三)本公司轉投資公司之定位及投資效益

1.轉投資公司之概況

直接轉投資事業

單位：新臺幣千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	投資目的	評價方法	投資狀況				110 年 9 月 30 日			
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值或市價
CHINA EXPO LTD.	境外投資公司	英屬維京群島	89	境外投資	權益法	229,487	6,200	100%	259,754	6,200	100%	41.9	259,757
大船企業日本株式會社	設備、零件買賣及維修之業務	日本	89	設備製造及銷售、零件買賣及維修	權益法	31,567	2	100%	(25,912) (註)	2	100%	35.463	70,926 (註)

資料來源：本公司經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

註：日本大船為該集團雷射鑽孔設備研發中心並產銷雷射鑽孔設備予集團內公司，其 110 年 9 月底長期股權投資餘額為負數係因集團內逆流交易所產生之未實現利益計 96,109 千元所致，該未實現利益將隨折舊費用攤提逐期轉為已實現，另日本大船 110 年第 3 季個體財報帳列淨值為日幣 284,845 千元。

間接轉投資事業

單位：新臺幣千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	投資目的	評價方法	投資金額				110 年 9 月 30 日			
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值或市價
MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED	投資業務	英屬維京群島	89	境外投資	權益法	140,759	5,054	100%	232,566	5,054	100%	46.01	232,566
ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(註 1)	投資業務	薩摩亞	93	境外投資	權益法	—	—	100%	—	—	100%	—	—

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	投資目的	評價方法	投資金額				110年9月30日			
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值或市價
上海達航實業有限公司(註2)	PCB 成型機、鑽孔機、設備進口、零件買賣、維修保養及雷射加工	中國上海	90	設備製造及銷售	權益法	151,783	—	100%	232,580	—	100%	—	232,580
東莞達程電子有限公司	PCB 機械製造加工買賣	中國廣東省	102	設備、零件買賣及維修	權益法	27,822	—	100%	41,492	—	100%	—	41,492

資料來源：本公司經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

註1：已於110年4月19日完成清算。

註2：原名廣東達航電子有限公司，已於110年2月更名為上海達航實業有限公司。

本公司之集團分工可區分為控股型態及實際營運兩種，茲就轉投資事業之功能及業務簡單說明如下：

(1)控股型態者，分別為 CHINA EXPO LTD、MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED、ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(已於110年04月完成註銷)，主要從事投資海外之第三地海外，其轉投資事業之功能，僅扮演投資控股功能，未從事相關貿易交易者。

(2)實際營運者，研發功能為大船企業日本株式會社，主要從事研發及雷射機台製造業務，另，銷售功能者上海達航實業有限公司、東莞達程電子有限公司，主要從事本公司 PCB 鑽孔機於中國大陸華東、華南地區之銷售暨營運據點。

2.轉投資事業之投資效益

單位：新臺幣千元

公司名稱	持股比例(%)	損益認列方式	營業收入淨額			營業毛利			營業利益(損失)			本期稅後淨利(損)		
			108年度	109年度	110年前三季	108年度	109年度	110年前三季	108年度	109年度	110年前三季	108年度	109年度	110年前三季
CHINA EXPO	100	權益法	-	-	-	-	-	-	(198)	(804)	(1,728)	19,956	(8,435)	(6,930)
日本大船	100	權益法	322,824	381,752	271,194	44,560	54,689	31,515	8,128	23,446	8,268	2,169	17,261	5,227
MEGA	100	權益法	-	-	-	-	-	-	-	(13)	-	(15,176)	(15,612)	(4,501)
ALPHA	100	權益法	-	-	-	-	-	-	(13)	(273)	-	268	7,870	-
上海達航	100	權益法	340,407	246,755	143,284	77,663	44,924	27,520	(9,919)	(7,246)	(8,450)	(15,175)	(15,598)	(4,501)
東莞達程	100	權益法	129,289	141,307	59,606	15,719	(1,600)	3,928	8,553	(7,804)	(1,284)	7,791	(8,122)	(378)
大船(煙台)(註)	100	權益法	87,996	-	-	6,828	-	-	(15,987)	-	-	(15,256)	-	-

資料來源：本公司提供。

註：已於108年11月出售100%股份。

茲就本公司海外轉投資之主要營運據點 108 年度、109 年度及 110 年度前三季之營業收入、毛利及利益之增減變動說明如下：

(1)日本大船

108 年度、109 年度及 110 年前三季營業收入金額分別為 322,824 千元、381,752 千元及 271,194 千元，營業毛利金額分別為 44,560 千元、54,689 千元及 31,515 千元，營業利益金額分別為 8,128 千元、23,446 千元及 8,268 千元，日本大船因出售雷射鑽孔設備並提供技術諮詢服務予本公司及上海達航，故營收表現穩定。109 年度營業利益較 108 年度增加 15,318 千元，主係因受惠銷售機台並提供技術諮詢服務增加，致營業收入成長，及受新冠肺炎疫情影響參展費用及出差費減少所致。110 年前三季營業收入 271,194 千元較 109 年同期 269,314 千元增加 1,880 千元，營業利益 8,268 千元較 109 年同期 8,501 千元減少 233 千元，主係因 110 年前三季高毛利技術諮詢服務減少，致營業利益些微下滑。

(2)上海達航實業

106 年度因遭逢中國大陸境內 PCB 設備維修、保養業者採削價競爭之行銷模式，致上海達航於 106 年度開始產生營業虧損，且 108 年度適逢美中貿易戰開始，故本公司著手進行營運規模縮減。

上海達航 108 年度、109 年度及 110 年前三季之營業收入金額分別為 340,407 千元、246,755 千元及 143,284 千元，營業毛利金額分別為 77,663 千元、44,924 千元及 27,520 千元，逐期減少，除前述中國大陸同業削價競爭之原因外，尚受 109 年初起新冠肺炎疫情影響所致，而 108 年度、109 年度及 110 年前三季之營業損失分別為 9,919 千元、7,246 千元及 8,450 千元，109 年度營業損失減少主係因新冠肺炎影響下，致推銷及管理費用之支出減少。110 年起上海達航因人力重新調配，基於成本效益考量以高毛利訂單為主，致營業收入下降，但相關之營業費用亦因組織調整減少，期望 110 年將可由虧轉盈。上海達航因需就近服務當地客戶，未來營運組織尚無變動之規畫、人員應不致有重大增減，惟仍將配合臺灣達航之產品事業之發展，以有效爭取各項業務。

(3)東莞達程

108 年度、109 年度及 110 年度前三季之營業收入金額分別為 129,289 千元、141,307 千元及 59,606 千元，營業毛利(損)金額分別為 15,719 千元、(1,600) 千元及 3,928 千元，營業利益(損失)之金額分別為 8,553 千元、(7,804)千元及 (1,284) 千元，109 年度營業毛利為負數且營業損失較多，主係因東莞達程於 109 年度配合集團中國大陸華南區業務整合，承接上海達航東莞分公司之售服維修業務，於 109 年度依客戶實際需求提供維修義務而認列較高成本所致，東莞達程因售後服務相關之維護成本高，且於 109 年度出現虧損之情形，目前之接單政策為視客戶及產品發展性，選擇利基型案件，務求轉虧為盈。

3.本公司與轉投資公司間之交易模式

(1)專業服務-雷射應用(代工)

本集團採各子公司獨立接單生產之政策，臺灣達航及日本大船主要分別負

責臺灣與日本地區的雷射鑽孔專業服務；而子公司上海達航及東莞達程則各自負責中國華東及華南地區之接單，惟目前雷射鑽孔設備皆移往上海，因此東莞達程會於接單後，再交由上海達航進行雷射鑽孔專業服務。

(2)專業服務-機械鑽孔維修、保養及改造

本集團採各子公司獨立接單生產之政策，因此由各子公司各自負責各地區機器設備維修保養之接單及服務。

(3)鑽孔機/成型機設備產銷

臺灣達航為本集團鑽孔機與成型機之主要生產基地，因此除日本地區以外之設備產銷主要透過臺灣達航接單、生產及出貨；日本廠區空間有限且材料、人事成本較高不具市場競爭力，故透過臺灣達航銷售鑽孔機與成型機給日本大船後，日本大船再出貨給日本客戶。

(4)集團間原料、零件及產品交易

A.上海達航、東莞達程

集團所需大部分零組件主係由母公司臺灣達航統一採購，由於上海達航及東莞達程主係提供各地區客戶機械鑽孔機維修服務，故臺灣達航負責銷售各子公司執行維修所需要之重要設備零件如 SPINDLE（主軸）、滾珠螺桿及滑軌等維修零組件。部份零組件因成本考量則由子公司上海達航及東莞達程在中國採購，主要以氣缸、夾頭、及 SPINDLE（主軸）之零件等。

B.日本大船

子公司日本大船主要係本集團雷射鑽孔設備研發中心及生產製造所在地，而雷射鑽孔設備所需要之雷射頭（LASER HEAD）、電子掃描鏡等零組件係由母公司臺灣達航代採購後再銷售予日本大船，隨著集團逐年擴充專業服務雷射加工產能，本公司銷貨至子公司日本大船之金額居高不下。日本大船銷售雷射鑽孔設備給集團內各公司之方式，依營運上之需求各公司獨立向日本大船下單，日本大船再出貨給各公司。另因維修或生產加工設備（如機械鑽孔機）之需求，部份零件係透過子公司日本大船採購日本當地生產之零組件，如 Z 軸線性馬達、滾珠螺桿、光學尺及 DSFI 基板等，再由母公司臺灣達航向子公司日本大船進貨。

綜上，本公司對各轉投資公司均係 100%持有，故雙方交易於合併沖銷後對合併報表損益並不會產生影響。

(四)美中貿易戰及新冠肺炎疫情對本公司財務業務之影響暨在手訂單情形

1.美中貿易戰對本公司財務業務之影響

汽車產業自 99 年起進入自動化的世代，係因汽車電控功能增加，對車用 PCB 用量亦同步提升，包含欣興、健鼎、耀華及敬鵬等多家印刷電路板廠亦積極佈局車用載板產能，以 A 公司為例，原預定於 105 年 7 月於中國大陸山東濟寧籌設汽車板廠，但自 108 年起美中貿易戰開打後，使得下游印刷電路板廠資本支出意願降低，致本公司於 107、108 年啟動大台面鑽孔成型設備之計畫性生產因美中貿易戰影響，出貨亦減緩，直到 109 年下半年間，美中關係由貿易戰轉為科技戰，在美

國政府的淨網政策、中國華為禁令，以及中國大陸十四五政策，雙邊貿易攻防戰之影響下，致下游印刷電路板廠之資本支出仍為保守態度；至 110 年初，全球車用晶片短缺，接踵而來是半導體晶片亦短缺，迫使下游印刷電路板廠為因應次世代電子產品之生產及避免自身產能斷鏈之風險，逐步提高產能擴建之意願。綜上所述，美中貿易戰對本公司 108 及 109 年度之業務拓展上存有相當程度阻礙之影響，惟美中貿易關係於 110 年美國拜登總統上任後逐漸趨於緩和，目前對本公司尚無重大影響。

2. 新冠肺炎疫情對本公司財務業務之影響

109 年新冠肺炎乃至 110 年新冠變種病毒仍肆虐全球各地，讓終結疫情的時間點變成了未知數，故此一總體經濟環境，除考驗企業之因應能力外，同時亦考驗企業之決策、指揮及風險管理能力。面對未來全球化與疫情共存下的經濟環境，本公司朝向產品多元化發展及致力各區域資源整合，確保供應鏈之穩定性，並加速設備產品之數位化轉型，故新冠肺炎疫情爆發時，本公司因已於 108 年度執行組織重組，包含 108 年 8 月處分大船煙台，退出華北地區之營運，並縮減華東、華南之業務，且於 109 年度回台於臺中精工廠投資雷射應用事業，然 109 年初中國大陸武漢爆發新冠肺炎，嚴重衝擊中國位於華中之印刷電路板聚落，因防堵政策使人車物流皆遭受控管，經濟活動呈現停頓狀態，致本公司中國大陸地區設備維修及保養業績減少，此時，本公司將營運及研發重心分別移至臺灣及日本兩地。目前子公司日本大船所生產之雷射鑽孔機，可應用於 5G 世代電子產品 IC 載板之鑽孔製程，故新冠肺炎疫情下，本公司因臺灣政府對新冠肺炎之監控得宜，致經濟活動未產生嚴重斷鏈之情事，以及半導體及封測產業對高階載板需求增加，推升客戶對本公司雷射應用加工產能需求，綜上所述，新冠肺炎疫情對本公司之業務尚無重大影響。

(五) 本公司未來發展性之說明

本公司目前主要產品係供應印刷電路板產業之製程上，其終端可應用領域涵蓋 5G 智慧型手機、網通伺服設備、自動車、WI-FI(如 SpaceX 的衛星網路計畫)、輕、薄、短小及攜帶式之消費性電子產品，本公司憑藉所專精之鑽孔工藝，並透過自製開發的機械鑽孔設備，提供新式電子產品製程的解決方案並陪同客戶共同摸索新製程，或維修升級服務使下游製造商的可優化產線、提高生產效能與品質之目標，甚至可以本公司自製雷射鑽孔機提供加工服務，以解決客戶產能不足之情形，茲就本公司主要產品未來發展規劃說明如下：

1. 專業服務-雷射應用(代工)：

依機械工業雜誌 110 年 1 月刊登，先進載板雷射超微鑽孔技術應用發展文中，指出近年先進載板朝向高密度、多層與微型化發展，隨著電子零件腳位的增加，孔徑亦被要求微小化，微孔深淺穩定度須達 $\pm 5\%$ 、微孔位置精度 $\pm 5\mu\text{m}$ 以及產速等要求。因此，對比機械鑽孔，雷射鑽孔是目前唯一能滿足規格需求的技術，多半集中於國際設備商如 MITSUBISHI、Via MechanicsI 及 ESI 等大廠，其中，雷射鑽孔設備上雖能線上調整孔徑大小，但往往難以縮小至小於 $30\mu\text{m}$ ，而 Via Mechanics 雖能將孔徑縮小至 $7.5\mu\text{m}$ ，但在產能以及其他設備上卻未能達到一定基

礎，因此，在未來逐漸往先進封裝走向的高科技產業的設備上仍將面臨這些問題。

本公司子公司日本大船因具備雷射鑽孔設備自製的技術，可配合客戶製程之需求搭載不同的雷射源，故應用產業已逐步滲透至半導體產業、光電產業及被動元件產業等客戶之產品開發或改良製程上，擴大雷射應用產品之市場滲透率，另因雷射鑽孔設備之投資成本高、配置場域空間需夠大且設備操作介面仍需仰賴專業人才，本公司為因應此一鑽孔代工之需求，已於大甲廠區建置無塵裝置的廠房空間，提供完善專業之代工鑽孔環境供應少量多樣性之訂單需求，本公司未來將朝波長更短的 PICO 雷射(10^{-12})、FEMTO(10^{-15})、開發雷射鑽孔以外的雷射切割，並將現有的 CO₂、UV 雷射的智能化及功能性提升等。

本公司與 PCB 第一線客戶(如：A 公司、B 公司等)已合作多年，於客戶產能不足時，或規劃擴建載板的產能過程中，由本公司先行透過自製雷射鑽孔機設備，以提供下游印刷電路板廠加工鑽孔服務及解決問題之技術支援，即使客戶已完成產能擴建，依舊持續會提供少量板材委由本公司進行雷射加工，故第一線客戶之委外加工訂單尚不致有中斷之情形，僅係委外加工數量之多寡。考量國內主要 PCB 廠每家均有上百億元之資本支出，故本公司亦持續增加現有客戶認證機台數，以增加未來代工機會。

綜上，本公司未來將因應產品功能之多樣化、先進製程零件微小化等製程之需求，爭取客戶的技術認證，切入 PCB 板廠第二線客戶之製程一環；積極拓展半導體、光電、被動元件、生醫產業等之雷射應用業務，降低目前集中單一產業之風險。

2.專業服務-機械鑽孔機維修、保養及改造

本公司自設立初期，便以專精設備維修、保養業務為主，依 NTI(N.T.Information) Dr.Hayao Nakahara(中原捷雄博士)之研究調查報告顯示，100 年度全球前百大 PCB 業者產值比較，臺灣廠商占 25 家，綜觀目前市售機械鑽孔之設備，仍以進口的日德系品牌設備為主流，惟本公司本身除具備擁有機械鑽孔設備關鍵耗材的開發能力外，亦擁有日本長年專精機械鑽孔設備開發的技師，可提供諮詢加速排除客戶產線上的障礙，且可透過子公司日本大船取得適合原廠設備之維修零組件，故可依照客戶製造需要調整、維修或保養所需之主要零組件或機台。

本公司自 93 年迄今，亦不斷投入機械鑽孔設備之關鍵性耗材零件-主軸產品精進，其產品轉速由 16 萬轉推升至今可達 30 萬或 35 萬轉，有別於用電鍍處理方式，本公司之主軸製法係以異材熱融合方式製造，可延長使用年限及提高再生可利用率，以利產線效能得以穩定運作，之前亦曾有利用本公司之自主開發主軸成功替換 C 公司、A 公司、B 公司及 D 公司等客戶設備零組件之實績。本公司未來除將現有主軸朝節能減碳方向進行改良，並將朝 40 萬轉主軸之研發方向進行開發，以持續維持自身競爭力以及與同業間之差距。

3.設備產銷-自有品牌之鑽孔及成型設備

依據 TPCA100 年的調查結果，臺灣廠商在高階製程供應鏈自主程度尚有不足，其中製程端中的鑽孔設備，臺灣雖擁有發達工具機設備產業，如大量、東台、達航、恩德與臺灣瀧澤等多家知名的鑽孔設備商，不過在面對高階製程的需求上，仍需克服提升精準度及效能，若當載板、軟板的產品以邁向最小孔徑規格 100um

之規格標準，則需搭載效能鑽孔轉速達到 35 萬轉等級之高轉速需求，這是目前台廠設備製程技術上尚未成熟之地方。本公司於 108 年成功研發高階精密鑽孔機可搭載 20 萬、30 萬或 35 萬轉主軸，成功跨入高階精密機種，109 年間經客戶認證，並於同年下半年逐漸銷售予客戶。

由於本公司設備產銷之鑽孔機已跨入載板專用之技術，隨著 5G、6G 次世代通訊滲透率逐漸提高，汽車自動駕駛、可攜式裝置的功能多樣化、物聯網速度及廣度、AI 影像高解析度等需求，載板於有限面積內之孔數，將日益增加，孔位精準度及加工不中斷之需求將會推升，因此，本公司配合自製主軸之能力，不斷精進主軸之性能，未來將朝向開發 50 小時生產不中斷，精準度誤差 20um 以內之更高階鑽孔機，符合全廠得以自動化投產，因應人口老化勞動人力斷層的風險，以維持精進技術領先的競爭優勢。

綜上述，本公司之產品服務內容，已非僅單純的機台銷售與維修服務，而是逐步將專精的鑽孔工藝，延伸至更多元化的方向經營，未來本公司除持續精進自身產品及服務外，並將逐步跨入半導體、光電類(例如：Micro LED)、被動元件、生醫產業等，以因應當今產品週期快速變化之競爭，並提升成長動能及市場拓展。

(六)綜合具體結論

本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季之營業收入分別為 1,175,825 千元、1,001,731 千元及 884,477 千元，108、109 年間，全球總體經濟環境分別受美中貿易戰及新冠肺炎影響，全球電子業製造商的資本支出趨於保守，因此，在製程的設備採購意願不高，使得本公司 108 及 109 年度之營業收入呈現略減趨勢，但全球 5G 商品、電動車、網通伺服產品、AI、IoT 及消費性電子產品仍持續朝向高速、高載量及高運算之目標推進，間接推升半導體晶圓、PCB 或載板、LED 顯示器及 DRAM 等產品之製程效率及良率升級，而本公司自製之雷射應用設備，適逢符合次世代電子產品升級，可協助客戶完成高精準度之製程需求，致 108、109 年度之營業毛利金額分別為 418,019 千元、336,840 千元，雖呈現下滑之趨勢，但毛利率可達三成以上；另 110 年前三季之營業收入、毛利金額分別為 884,477 千元及 238,186 千元，相較 109 年同期增減變動之金額為 167,910 千元、(4,465)千元，110 年前三季之毛利率為 26.93%，相較 109 年前三季 33.86% 下滑，係因新冠肺炎之後疫情時代，5G 電子產品仍持續性推陳出新，下游電子零組件製造商為優化產線及滿足製程之需求，以漸進式之方式，擴大次世代電子產品投產所需之資本設備，故本公司 110 年前三季較 109 年前三季營業收入、毛利金額及毛利率之變動，係因提供下游客戶雷射應用之服務減少，而訂單以設備產銷產品為主所致。

本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季之營業費用分別為 371,063 千元、226,657 千元及 178,887 千元，營業費用率分別為 31.56%、22.63%及 20.23%，108 及 109 年度營業費用之增減變動，係因本公司於 108 年間適度調整中國區營運策略布局，分別出售大船煙台股權，並將中國大陸華東、華南地區的營運據點進行整合，以及臺灣地區進行廠辦合一政策，將原營運管理中心南遷至台中精工廠區，致人事及日常營運所需之維護成本大幅減少，另 109 年度因全球新冠疫情之影響下，全球各地政府限縮人流的經濟活動範圍，致本公司因業務需求之交際費用及差旅等費用支出減少；本公司 110 年前三季之營業費用因配合申請股票初次上櫃

所需之中介機構費用，致本公司 110 前三季之管理費用較 109 年前三季增加 12,865 千元。

本公司之營業利益 108 年度、109 年度及 110 年前三季分別為 46,956 千元、110,183 千元及 59,299 千元，主係因各期間之營業收入、毛利及費用之增減變動原因所致，另本公司營業外收支 108 年度、109 年度及 110 年前三季分別為 7,393 千元、(145)千元及 1,649 千元，108 年度營業外收入較高主係因本公司 108 年度處分子公司股權產生出售產生處分利益 28,850 千元所致。

綜上述，本公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季營收、毛利及毛利率之增減變動，係因全球總體經濟活動影響，致產品組合所產生之變動差異，另 108 年度、109 年度及 110 年前三季營業費用及營業外收支，則係因本公司順應經營環境變遷，所執行之營運策略調整產生之變動差異，然本公司未來仍將持續關注自身產品技術，期望將自身技術拓展至其他產業領域上，進而提高本身產品及技術之滲透率，另，後疫情時代下，全球原物料短缺及飆漲下，助漲通貨膨脹，將適時進行供應鏈廣度分析，透過在供應鏈中各種可能之接觸點來蒐集數據，最後，本公司更期望將雷射應用鑽孔工藝挺進半導體等產業的開發與量產速度，降低遭受傳統電子業景氣循環之干擾。

【推薦證券商評估】

本推薦證券商就達航科技股份有限公司(以下稱該公司)108~109年度及110年前三季之業績變化原因、合理性及未來發展性說明，經本推薦證券商取得該公司內部帳冊及相關營運資料、產業相關資料及同業之財務報告或公開說明書資料，並與該公司經營團隊訪談後，執行查核程序說明如下：

(一)該公司所屬行業之產業概況及所營業務之主要內容

NTI(N.T.Information) Dr.Hayao Nakahara(中原捷雄博士)針對 100 年全球 PCB 產業的研究調查報告指出，當今對應到終端市場應用與 PCB 產品之發展趨勢，近十年從過去標準化、大量生產的終端應用如家電、PC、行動裝置，隨著物聯網（IoT）時代來臨，電子產品高效能與多樣化，促使 PCB 走向利基型、少量多樣的終端應用如電動車、穿戴式裝置等，PCB 技術製程能力不斷向上提升，隨著產品高階技術不斷演化，驅動一波波新投資計畫與技術升級龐大需求，經取得該公司內部進、銷貨交易明細資料及蒐集產業報導相關資料，其產業狀況及未來趨勢大致與該公司所述相符，該產業確實有其穩定成長之市場需求。另經檢視該公司最近二年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及明細帳，該公司前述說明之營業收入、營業成本、營業毛利、營業費用、營業利益、營業外收支、稅前淨利、稅後淨利及每股純益等財務資訊，其金額核對相符，且經參閱該公司之董事會及股東會議事錄、與主管機關之往來函文、產業報導及研究報告等資料，並訪談該公司之經營團隊，其變化原因及合理性，經評估尚無發現重大異常之情事。

(二)該公司最近二年度及申請年度業績變化原因及其合理性分析

1.依主要產品別說明營業收入、營業成本、營業毛利及毛利率變化分析

經檢視該公司之公開說明書、108及109年及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，以及該公司提供110年截至最近期之財務報表及明細帳內容，並逐一核對及計算該公司之各年度產品別的營業收入、成本及毛利，前述金額尚無誤，另，

執行分析性複核程序，比較本期與前期之營業收入、成本及毛利財務資訊之增減趨勢，並與該公司之經營管理階層陳柏棋總經理進行訪談，以了解其變動原因是否吻合該公司所屬行業之產業概況或所營業務內容，並與所蒐集之全球總體經濟、產業研究資訊及下游銷售客戶所處的產業及營運現況比較後，尚無發現重大異常之情事。另分析該公司108及109年度及110年前三季之財務報表之營業收入、營業毛利及毛利率之增減變動，主係因108年美中貿易戰、109年新冠肺炎之全球總體經濟環境之影響，致設備產銷業務因經濟規模不及之影響下，108及109年度之營業收入減少，反觀，該公司營業毛利率維持30%以上，係因專業服務業績成長，110年前三季，因應5G等次世代電子產品對載板需求日益高漲，推升載板製程設備需求，因此，110年前三季較109年同期之營業收入表現上揚，惟因雷射應用服務減少等因素致毛利率下降。整體而言，該公司之營業收入、營業成本、營業毛利及毛利率其變化原因，業經執行上述評估程序後，尚屬合理。

2.銷貨變化及真實性查核程序說明

經檢視該公司108及109年及110年前三季之前十大銷貨客戶之基本資料、授信條件及交易金額後，執行下列查核程序以確認該公司之銷貨變化及真實性，以下茲就銷貨變化執行之查核程序逐一說明：

- (1)經檢視該公司108及109年及110年前三季之前十大銷貨對象，並與該公司之公開說明書或股東會年報資訊，以及108及109年及110年前三季個體或合併財務報告之關係人附註，並未發現前述銷售對象具關係人者。
- (2)經檢視該公司108及109年及110年前三季之前十大銷貨對象之公司網站，其中，多數為國內外上市(櫃)公司或其轉投資中國大陸地區事業，因此，國內上市櫃公司部分，業經參閱我國金管會證期局所指定之國內證券期貨網站-公開資訊觀測站，所揭露之相關重大訊息、發行公司之基本資料、歷年股東會年報訊息或重大資訊，至於，國外上市掛牌公司，則查詢銷售客戶自身公司網站的IR專區資訊，然該公司108及109年及110年前三季之前十大銷貨對象中，屬非公開發行公司者，則透過我國經濟部商業司之工商登記查詢系統、中國大陸地區則透過企查查系統查詢及日本地區則透過日本企業信用調查網(TDB, Teikoku Databank, Ltd)獲得前述非公開發行公司客戶之基本資料，另，執行函證或實地訪談方式，了解該等客戶之營運情形、與該公司之關係、交易目的及交易必要性等，經檢視及執行上述查核程序後，該公司與該等客戶間之交易目的，尚實屬必要。
- (3)經取得該公司108及109年及110年前三季之銷貨排行前十大客戶之統計資料及銷貨明細後，依據中華民國證券商業同業公會證券承銷商辦理承銷案件對發行人進銷貨業務狀況評估報告查核規範之抽樣標準，執行銷售及收款循環測試，以下茲就該公司108及109年及110年前三季之銷貨排行前十大客戶之樣本選取方式、以及檢覈相關交易契約、憑證及帳冊明細等查核逐一說明：

A、108及109年及110年前三季之銷貨排行前十大客戶之樣本量選取方式：

(A)選樣程序：

當年度之前十名銷貨對象之年度交易情形之抽核筆數應至少各抽1筆(即，每一年度至少10筆銷貨)，另，屬當年度營業收入淨額5%以上之銷售客戶者，其年度交易情形之抽核筆數應至少加抽1筆，換言之，達當年度

營業收入淨額5%以上之銷售客戶抽核筆數為2筆;若該公司之銷貨對象符合，下列甲、乙交易條件對象者，應分別達其年度交易總金額之30%或年度抽核總筆數至少5筆：

甲、屬年度新增且占年度營業收入淨額5%以上之銷售客戶。

乙、與關係人間之銷貨交易。

(B)決定樣本的方式：

依該公司提供108及109年及110年前三季之前十大銷售客戶之銷貨交易明細，其重大性標準，係各該銷貨客戶於該年度金額第一大筆銷貨，若樣本量達一筆以上者，則依序選取第二大筆交貨，以滿足中華民國證券商業同業公會證券承銷商辦理承銷案件對發行人進銷貨業務狀況評估報告查核規範之抽樣標準的樣本量之要求。

B、108及109年及110年前三季之銷貨排行前十大客戶之所執行之銷售及收款循環測試，以下茲就其各測試控制點所執执行程序逐一說明：

(A)經執行上述選樣方式後，依108及109年及110年前三季個別銷售客戶與該公司進行交易業態，並檢視個別交易之訂單或合約的交易條件，尚未發現重大異常或重大不合乎常規之交易情事，另，檢閱該公司授予之個別客戶之授信條件，且與其他個別交易客戶相較，尚未發現重大異常或顯不合理之情事。

(B)承(A)，所選取交易樣本之銷貨單、出貨單或驗收單、銷貨發票等交易憑證，逐一比對交易品名、數量及金額與出貨單，尚屬合理，故未發現重大異常之情事。

(C)承(B)，所測試交易樣本之憑證，逐一核至帳冊傳票並核算後尚均相符，另，檢視其銀行收支對帳單之匯款交易日與該公司之授信政策，尚未發現重大異常之情事。

(D)另，檢覈該公司所開立之發票對象與銀行收支對帳單匯款之交易對象，均屬同一法人，此一測試樣本交易之收款銀行帳戶的戶名及帳號，比對該公司之銀行帳戶明細，屬該公司所擁有之戶名與帳號，尚未發現重大異常之情事。

3.營業費用及營業外收支變化原因及其合理性分析

經取得該公司108、109年度及110年前三季之營業費用及營業外收支出明細帳、該公司之各期業經會計師查核或核閱之財務報告，並訪談該公司之經營管理階層-會計主管，有關該公司之各期間會計科目間-推銷、管理及研發費用，以及營業外收支費用之變化，其前後期比較分析後，尚未發現重大異常之情事。

整體而言，該公司營業費用之108及109年度之增減變動原因，係因109年新冠肺炎之影響下及該公司集團營運政策之調整，致109年度推銷及管理費用較108年度分別減少37,570千元、52,242千元，110年前三季之推銷費用較109年度同期增加1,041千元，係因變動幅度微小，故不擬予深入評估，另，管理費用較109年同期間增加17,286千元，係因籌備初次申請股票上櫃之費用所致，研發費用部分，109年度及110年前三季之研發費用則較108年度及109年同期分別減少22,816千元及17,286千元，係

因該公司之雷射應用設備已符合市場需求，降低研發費用的支出，另，營業外收支108、109年度及110年前三季之增減變動原因，包含利息收入、處分子公司利益、外幣兌換(損)益淨額、租賃修改利益、不動產、廠房及設備減損回升利益、手續費支出、其他及財務成本，整體而言，該公司108年及109年度之營業外收支之增減變動，主係因處分子公司大船科技煙台股權之利益，110年前三季較109年同期間營業外收支增加8,856千元，係因財務成本減少1,386千元及其他利益增加6,261千元所致。

綜上述，該公司108、109年及110年前三季之營業費用及營業外收支之增減變動情形，尚屬合理。

(三)該公司轉投資公司之定位及投資效益

1.各轉投資事業之定位與分工

經訪談該公司財會部劉智鴻協理，了解各轉投資公司主要營業項目、業務政策及作為集團整體佈局中之主要功能，取得各轉投資公司之營業登記、股東名冊、公司章程等資訊，核對其所載之營業範圍、設立地區等資訊，並檢視該公司股東會年報所載之主要營業及生產項目，評估該公司所設定各轉投資公司之定位與分工尚屬合理。

2.主要轉投資事業之經營效益及對公司財務業務之影響

取具該公司108~109年度及110年前三季合併沖銷大表，依各年度匯率試算各轉投資公司之財務數據，核至會計師出具之財報及該公司出具之股東會年報相符，並針對營收達合併營收20%之子公司—上海達航實業有限公司，執行進一步查核分析。另經執行上海達航108~109年度及110年前三季之主要進貨供應商與銷貨客戶之抽核並執行增減變動之分析，其營業收入變化情形尚屬合理。另經與臺灣達航經營團隊訪談，各公司108~109年度及110年前三季之營業毛利、營業利益及稅後純益變化情形，經評估尚無發現重大異常之情事。

(四)美中貿易戰及新冠肺炎疫情對該公司財務業務之影響暨情形

108年度初，美中貿易戰展開後，中國大陸亦逐步進行產業結構調整，因此，多數跨國企業基於長期營運布局之需，便陸續展開全球供應鏈之移轉，正當企業逐步尋求適宜之生產基地的時刻，109年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，全球各地陸續傳出大規模停工情事，致該公司109年之銷售業績相較108年度呈現減少趨勢，然該公司雖已於108年間對中國大陸之營運進行適度調整，分別將華北地區之孫公司大船企業(煙台)公司股權處分，並縮減整合華東、華南的業務，但該公司位於中國大陸之業務推廣上，仍無法完全倖免109年初於中國大陸武漢地區，所爆發新冠肺炎疫情之影響，但業已適度降低單一市場區域之風險，另該公司於109年間擴增臺中精工廠區雷射應用加工服務，相較全球供應鏈因疫情，產生斷料及斷鍊的風險危機，該公司則是因受惠國內印刷電路板廠仍持續積極擴增資本支出之預算，以因應次世代電子產品的高階製程設備需求而未減，但受限疫情之影響，再加上各國政府實施較嚴格通關管制，以及部分國外設備製造商，陸續發生斷料、斷鍊的問題，致國內印刷電路板廠，向國外採購設備之交期產生延遲交貨現象，為此國內印刷電路板業者，為避免自身產線製程，因斷鍊而影響出貨交期，故紛紛增加對該公司之雷射應用代工訂單，110年前三季全球進入後疫情時代，因全球疫苗接種覆蓋率上升，全球經濟活動逐漸走向復甦，致該公司110年前三季之設備產銷業績成長，受惠於次世代電子產品要搭載先進的製程，間接推升該公司之高階鑽孔設備之出貨；在財務方面，該公司108年度、109年度及110

年前三季之負債比率未達60%且營業活動之現金流量為正數，綜上述，在美中貿易戰及新冠肺炎疫情的影響下，該公司之財務業務活動，尚屬穩健。

(五)該公司未來發展性之評估

業經參閱該公司之未來發展性之說明，並訪談該公司之經營管理階層，蒐集專業機構之產業技術研究報告、產業資訊與總體經濟發展後，該公司可望順應次世代電子產品對先進載板鑽孔製程需求日益增溫，透過自身專精之鑽孔工藝技術予以支援提供解決方案，以達成市場之需求，故在疫情衝擊過後，全球人類的生活與消費型態產生轉變，巨量的資料傳輸、AI 等數位科技應對疫情潛力急速爆發，不僅可同時減緩疫情傳播、縮減防疫及封鎖政策所造成的經濟損失，更將重塑未來新經濟、新世代的可能樣貌，綜上所述，該公司產品之未來發展，尚屬合理。

(六)綜合具體結論

綜上所述，業經本推薦券商執行上述之查核程序後，該公司108年度、109年度及110年前三季之業績增減變動，除因受總體經濟環境影響外，其業務發展主係因次世代電子產品之製程與應用材料之影響所致。ABF載板因材料特殊性，致其鑽孔製程須仰賴精微的雷射鑽孔工藝，另部分PCB製程亦須搭配高階機械鑽孔工藝共同投產，有鑑於次世代電子產品製程中，必需搭載之PCB或載板其製程上應具備高度之精密性，對該公司而言尚無重大不利之影響，整體而言，該公司業績變化及產品未來發展性經評估後尚無發現重大異常之情事。

- (二) 貴公司雷射應用加工服務占 109 年度營業收入比重達 45.83%，110 年前三季雷射加工服務收入較 109 年同期減少 21.17%，惟其預計投入 7.5 億元擴建廠房及增購雷射加工設備，有關貴公司擴廠計畫、資金來源、預計效益與可行性，及如何因應 PCB 產業景氣變化之說明，暨推薦證券商及簽證會計師之評估意見。

【公司說明】

- (一)本公司近期雷射應用服務收入呈減少趨勢，惟本公司董事會仍決議擴建廠房及向子公司日本大船購置 38 台雷射鑽孔機設備之原因

1. 110 年前三季雷射應用服務收入較 109 年同期衰退之原因

本公司 110 年前三季較雷射應用服務收入較 109 年同期減少 21.17%，主係因銷售客戶 C 公司設備已到位，致對 C 公司雷射鑽孔加工收入減少，惟對 B 公司之雷射加工收入由 109 年度 73,894 千元提高到 110 年度 146,959 千元，適度替補此缺口。

2.以自製雷射鑽孔設備提供客戶鑽孔加工服務為本公司策略

本公司雷射應用服務方式，早期係透過中古日系雷射鑽孔機台，經過本公司技術人員調整改良後，作為雷射應用代鑽孔業務，但本公司 100%子公司日本大船於 105 年度已成功開發自製之 CO2 雷射鑽孔設備(原型機)，於 106 年度陸續經過臺灣 PCB 板廠認證後開始量產，並投入雷射代鑽孔服務。由於目前我國雷射鑽孔設備無法自主化，大多仰賴日本的三菱電機公司及維亞公司(早期隸屬於日立集團，於 102 年日立出售該事業體給港商隆力集團)，為避免市場競爭造成紅海市場，故本公司採取與二家日商公司不同策略(代工 VS 銷售)，並做出市場區隔，又國內較具規模之鑽孔代工廠商如凱崙及尖點等公司，其設備都為外購或與委託廠商策略聯盟，加工技術來源因設備外購而受限，加工對象因策略聯盟亦受限，反觀本公司雷射鑽孔機台為自行研發製造，可以因市場技術需求而研發提升。本公司因擁有設備生產技術及專業操作介面之人才，故採加工接單方式應對，一來是為了避免過度集中單一產業、客戶之風險以及削價競爭之風險，二來是為了維持產能得以自主調度的彈性需求，歷經 4 年的營運，績效顯著、策略有效，預估未來雷射加工市場仍然蓬勃發展。

3.董事會通過擴廠及購置設備之原因說明

本次擴建廠房除考量原既有廠房空間不足、無塵室設備老舊外，客戶對雷射加工環境要求亦日趨嚴格，故進行較大規模之修繕；另經以下原因考量，本公司董事會分別於 109 年 12 月 21 日及 110 年 12 月 20 日通過 110 年度及 111 年度增購 24 台及 14 台之雷射鑽孔機及擴建無塵室廠房之議案。

(1)ABF載板需求暢旺將帶動雷射鑽孔需求大增

依高盛研究報告顯示，在 5G、人工智慧和雲端計算等結構驅動因素支撐下，ABF 產業在未來幾年內將有大規模增長，ABF 產業於 109 年至 113 年將產生 17% 之需求複合年增長率，市場規模將由 109 年約 43 億美元成長至 113 年 70 億美元。

參照工研院產科國際所 110 年 10 月研究報告，由於終端產品對性能之要求日益增長，因此 IC 晶片朝向多層數、大尺寸以及更細的線寬設計，使得 ABF 載板面臨製程與良率的挑戰，且未來隨著各種先進封裝技術演進(如 CoWos、InFO、EMIB、Chiplet)也將進一步提升 ABF 面積需求。依據調研機構的調查，110 年市場對 ABF 的需求成長率為 27%，而供給成長率僅 16%，供需缺口達 11%，預計供給吃緊之時間可能持續至 112 年，到 113 年才可望達供需平衡，而供需問題也讓 ABF 的平均售價將呈上升趨勢。準此，本公司預測未來三年內雷射加工市場仍然需求大於供給，本公司多數雷射機台已獲國內 PCB 大廠 C 公司、A 公司及 B 公司等認證，且目前 C 公司、A 公司皆有擴廠計畫，擴大覆晶載板產能，在 C 公司及 A 公司擴廠完成前後預計將有雷射加工需求，爰本公司本次擴建機臺之營業額目標應可順利達成甚或超前。

(2)擴建無塵室廠房之必要性

原林口廠承租面積為 559 坪，擺放設備數最多容納 31 台，空間不足、且因無塵室為 16 年前建置、設備老舊，加工環境無法達到部分客戶之要求、空間上狹小不具規模效益且管理費用偏高。精工廠亦有雷射服務廠區，二廠分開不具規模，另精工廠空間足夠，為精簡費用，落實廠辦合一、集中管理，108 年間規劃在精工廠擴建可擺放 100 台雷射鑽孔機無塵室廠房，分二期建置，第一期 34 台已開工生產，第二期為本次之擴廠計畫，將分三階段陸續完工。基於滿足客戶加工環境需求，降低生產成本，於精工廠擴建無塵室廠房有其必要性。

(3)汰舊換新雷射加工機台及子公司產能考量

本公司提供專業服務-雷射應用加工已有 16 年以上歷史，過去多以三菱或日立維亞之雷射鑽孔機提供服務，後子公司日本大船於 106 年成功開發雷射鑽孔機，當時本公司持有他牌 60 台，由於設備為老舊之中古機，性能及效率不佳，精度技術也無法滿足部分產品之標準，且部分機台已屆耐用年限，故採出售或報廢方式處理，因此本公司擬定計畫，分 5~6 年逐步淘汰其他品牌之鑽孔機改用自製雷射鑽孔機。本公司自有品牌雷射鑽孔設備於 106 年起陸續取得臺灣 PCB 板廠認證後，視加工市場之增長、客戶技術需求及本公司資金狀況，陸續於 107~109 年度及 110 年度前三季於臺灣區分別淨增加 8 台(增加 10 台、汰舊 2 台)、3 台(增加 13 台、汰舊 10 台)、12 台(增加 24 台、汰舊 12 台)及 3 台(增加 5 台、汰舊 2 台)；另，中國廠區陸續於 107~109 年度及 110 年前三季逐年汰舊換新之需求下，分別淨減少 2 台(增加 5 台、汰舊 7 台)、1 台(增加 1 台、汰舊 2 台)、3 台(增加 0 台、汰舊 3 台)及 0 台(增加 3 台、汰舊 3 台)。臺灣廠區之他牌雷射鑽孔機已全數汰換為本公司自製鑽孔機，中國廠區尚餘 9 台他牌雷射鑽孔機，最慢於 2 年內汰換完畢，本次擴廠增添之部分機台將充作中國大陸機台汰舊使用。

(4)本公司持續推動與中小型板廠及非PCB產業合作，預留加工產能彈性

本公司目前推動與中小型板廠之合作，從客戶技術研發產品階段開始參與，研發成功後，雷射鑽孔之產能列為該企業生產流程的一部份，已陸續有貢獻，

已有多家公司委託本公司加工或租賃，另尚有多家客戶尚在研發階段，例如：二家客戶打樣測試中，一家客戶目前洽談淘汰舊設備，改為向本公司租賃或委託本公司加工。

本公司持續擴展非 PCB 產業之鑽孔加工，目前有數家半導體廠、封裝廠正在測試本公司高階雷射機於其製程運用，或客製化符合客戶規格需求之高階雷射機，已近成熟中。

(5) 考量臺灣PCB大廠會預留部分產能外包，及工序不一而有加工機會

臺灣 PCB 廠建廠時會考量生產數量變動風險，及為降低不景氣來臨時帶來之衝擊，在相關擴產計畫決策時通常會保留一定程度之彈性，造成有委外加工代鑽孔需求之情形，另因 PCB 產業是 IT 產業之一環，各產品生命週期短、技術需求不斷增加，換言之，在同樣尺寸的板材內所需要之鑽孔孔數不斷增加，如同時生產數種板材，將出現同一時間需要大量鑽孔工序之情形，超出原工廠鑽孔產能，板廠將會出現有產能不足而需委外代工之情況。詳細說明請參考(三)營運可行性之說明。

(6) 董事會決議之考量

鑒於 107 年起適逢 C 公司 ABF 載板生產之需求大幅提升，本公司也因為備置 IC 載板加工能力之雷射鑽孔機，因此 107 年來自 C 公司的雷射加工營收成長 100% 以上，108 年及 109 年間仍維持 20% 以上之高度成長，109 年來自雷射加工之營業收入及來自 C 公司之營業收入均創新高。其他 PCB 同業，也洽詢本公司有關 ABF 加工相關技術及產能。因此本公司預估未來 IC 載板、包括 ABF 等之加工需求非常強勁，故參照 109 年的購置台數 24 台，於 109 年 12 月 21 日董事會決定 110 年度資本支出計畫，前述 24 台於 110 年 12 月 31 日前已出貨 18 台，其餘 6 台預計 111 年出貨，惟本公司將視市場狀況、中國大陸地區之客戶加工需求調整固定資產預算。另 110 年 5 月 C 公司自購設備已到位，致雷射鑽孔代工產能訂單減少，致本公司 110 年度雷射代工應用營業收入減少，惟半導體產業持續投入大額資本支出，使國內主要 PCB 廠每家均有上百億元之資本支出，考量本公司資金狀況、加工市場需求及未來新市場開拓之情形，本公司於 110 年 12 月 20 日董事會通過 111 年度購置機器設備 14 台之雷射鑽孔機，包括 CO2 雷射鑽孔機 9 台及 UV 雷射鑽孔機 5 台，其中，CO2 雷射鑽孔機未來將視中國大陸雷射加工市場之市況進行汰換，倘未來市況不佳，亦可能調整預算延緩對子公司日本大船採購；另有關 UV 雷射鑽孔機，本公司原已有 3 台 UV 雷射鑽孔機，包含 1 台原型機放置於子公司日本大船測試用、1 台已出租、1 台放置於臺灣供半導體業客戶加工用，預算通過購置 5 台 UV 雷射鑽孔機，主係考量因半導體客戶共有 2 台之需求，其餘 3 台預計將提供 PCB 以外的客戶雷射鑽孔加工使用。

4. 小結

C 公司為因應其客戶多元化之需求，進而積極布局雷射鑽孔設備之採購，因此在其產線設備到位後，便逐漸縮減對本公司之雷射應用鑽孔代工訂單之需求，B

公司原於 110 年底之前已完成認證 28 台，考量工序日趨複雜，故另再追加認證 16 台，並於 111 年 1 月底加入量產，因而董事會於 110 年 12 月 20 日通過 111 年度增購 14 台雷射鑽孔機之議案。惟本公司亦會視市場狀況、資金水位及中國大陸地區之客戶加工需求調整固定資產預算，倘未來市況不佳，亦可能調整預算延緩對子公司日本大船採購。

(二)擴廠計畫內容及預計進度

本公司於 110 年度之前，於臺灣地區原有林口廠及大甲工業區總廠(以下簡稱精工廠)兩處工廠，林口廠房主要用於雷射加工服務且為本公司管理據點，精工廠房主要用於機械鑽孔設備及主軸生產暨維修保養服務，以及少部分雷射加工服務(約 10 台雷射鑽孔機台)。因本公司轉型為經營 VELA 自有品牌後逐步調整組織結構，精實非必要之費用，為使生產線(工廠)可以獲得就近管理，遂於 108 年 9 月將原林口廠之管理據點移至精工廠，落實廠辦合一管理，貼近生產現場，降低成本，改善產品品質並強化研發製造。

另原林口廠承租面積為 559 坪，擺放設備數最多容納 31 台，且因無塵室設備老舊，加工環境無法達到部分客戶之要求、空間上狹小不具規模效益且管理費用偏高，為精簡費用，故於 110 年中將原位於林口廠之雷射加工機台遷移併入精工廠，並規劃遷廠後雷射加工廠房可擺放 100 台雷射鑽孔機，估計所需面積約 1,500 坪。由於精工廠面積 1,500 坪，廠房將供雷射部門使用，致其他部門的使用面積不足，本公司遂承租幼獅工業區內距精工廠約一公里的廠房供主軸生產部門及維修保養服務使用(以下簡稱青年廠)。

綜上，目前本公司於臺灣地區包含精工廠及青年廠兩處工廠，精工廠為管理據點，且主要為雷射加工服務以及機械鑽孔設備生產廠所，青年廠則主要用於主軸生產及維修保養服務。有關本公司擴廠計畫預計時程表如下：

廠別	功能	項目	110 年	111 年	112 年
精工廠	雷射加工	二期廠房完工		Q2	
		二期投產(陸續投產)		Q2~Q4	Q1~Q2
青年廠	主 軸 生 產、維 修 保養服務	起租	Q2		
		裝修、搬遷完成	Q4		
		開始投產	Q4		

1.擴建廠房

本公司自 109 年第一季開始安排台中雷射加工廠房環境改善規劃，將精工廠分為二期進行修繕，並於 110 年逐步自林口廠將雷射加工單位遷移至精工廠，以降低對客戶影響。

未來規劃各區放置雷射鑽孔設備數量如下(單位：台)：

雷射加工擴廠工程					
精工廠廠區	第一期	第二期			合計
		第一區	第二區	第三區	
機台數	34	12	20	20(註)	86(註)

註：第三區預計可容納 34 台，本次擴廠計畫放置 20 台，合計全廠最多可達 100 台。

目前精工廠一期廠房已經完工，所放置之 34 台雷射鑽孔機設備已開始進行加工服務，精工廠二期廠房目前尚在建置中，其中二期第一區已裝修隔間完成，所放置之 12 台雷射鑽孔機設備已開始進行測試加工，二期整體建置預計於 111 年第二季底前完成廠房裝修隔間驗收。

另有關青年廠，本公司已於 110 年 6 月完成簽訂租賃合約並建置工廠，後於 110 年 11 月底完成主軸生產部門及維修部門遷廠，並於 12 月開始投產。

2. 購買雷射鑽孔設備

截至 110 年 12 月 31 日，110 年度預算 24 台已有 6 台(台灣 3 台及中國大陸 3 台)陸續安裝完成於 110 年底前投產，另已交機之 12 台(台灣 11 台及中國 1 台)將於 111 年第二~三季陸續安裝，剩餘 6 台預計 111 年底前驗收及投產，；111 年度預算 14 台(台灣 5 台及中國大陸 9 台)預計以每個月 1~2 台之速度陸續購入，預計 112 年 2 月全部交機完成，分別於 111 年第三季驗收 4 台、111 年第四季驗收 4 台、112 年第一季驗收 3 台及 112 年第二季驗收 3 台。

單位：台

預算 年度	地區	驗收時間			合計	
		110 年	111 年	112 年		
110 年	臺灣	3	17(註 1)		20	24
	中國大陸	3	1(註 1)		4	
111 年 (註 2)	臺灣		5		5	14
	中國大陸		3	6	9	

(註 1)包含 110 年交機臺灣 11 台及中國大陸 1 台。

(註 2) 本公司未來將視市場供需狀況做增減變動調整。

本公司於 105 年底雷射加工機台共計 63 台，包含自有品牌 VELA 3 台及他牌中古鑽孔機(主要係三菱或日立維亞之中古機台)60 台，歷年來逐漸淘汰他牌鑽孔機，直到 110 年底自有品牌 VELA 高達 74 台(包含本次擴廠計畫購入已驗收之 7 台，未包含尚未安裝之 11 台)，他牌僅剩 9 台，預計 112 年全數淘汰他牌完畢。

(三) 資金運用情形及規劃

1. 本次擴廠資金來源

單位：千元

項目	原幣借款金額	折合新臺幣金額	已支付金額	未支付金額
兆豐長期借款	NTD 176,000	176,000	94,606	81,394
玉山長期借款	RMB 20,000	83,908	-	83,908
三井住友借款	JPY 160,000	40,000	40,000	-
以營運取得的資金	NTD 446,940	446,940	148,648	298,292
合計	—	746,848	283,254	463,594

2. 資金運用

本次擴建精工廠及建置青年廠所需總資金預計約 746,848 千元，資金運用明細如下：

單位：新臺幣千元

項目		預計金額	已支付金額	未支付金額		
				預計 111 年支付金額	預計 112 年支付金額	合計
精工廠	廠房二期工程	150,213	53,970	96,243	—	96,243
	110 年向日本大船購置 24 台雷射鑽孔機設備	343,535	200,875	142,660	—	142,660
	111 年向日本大船購置 14 台雷射鑽孔機設備(註)	213,000	—	141,800	71,200	213,000
青年廠	廠房建置及搬遷費用	40,100	28,409	11,691	—	11,691
合計		746,848	283,254	392,394	71,200	463,594

註：本公司未來將視市場供需狀況做增減變動調整。

3. 資金運用進度

本公司就本次擴廠計畫所需之資金截至 110 年 12 月底已實際支付 283,254 千元，其資金來源為兆豐銀行中長期銀行借款 94,606 千元及日本三井住友銀行借款日幣 160,000 千元(換算新臺幣約 40,000 千元)，餘 148,648 千元係以營運所取得之資金支應；其餘 463,594 千元，本公司將以銀行借款及營運資金等方式支應，本公司銀行未使用額度包含兆豐銀行 81,394 千元(除以設備作為擔保借款外，尚無其他限制條款)及玉山銀行 83,908 千元(係由子公司上海達航向銀行融資，由母公司擔任保證人)，待上櫃順利通過預計暫定可募集資金 174,177 千元(預計募集 5,805,912 股，承銷價格暫定為 30 元，實際承銷價格俟奉主管機關核准後，與承銷商共同議定之)，可使本公司之資金更為充裕，其餘不足金額 124,115 千元將以營運所取得之資金支應，另考量 109 年度息稅折舊攤銷前盈餘(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization，簡稱 EBITDA)約為 274,457 千元，自有資金應屬充足。此外，本公司已持續與銀行洽談長期借款條件，未來將視自有資金水位狀況與銀行額度洽談情形做適當調配，應無以短支長之虞。

另有關 111 年預計向日本大船購置 14 台雷射鑽孔機設備，尚可依市場供需狀況做增減變動調整，故本次擴廠計畫之資金來源應無虞。

4. 對本公司財務結構之影響

依本公司自結 110 年度資產負債表，110 年底負債佔資產總額比率及長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 52.13%及 134.47%，本次擴廠透過長期銀行借款、現金增資及公司營運所取得之資金支付後，推估負債佔資產總額比率及長期資金占不動產、廠房及設備比率將分別為 50.62%及 140.90%，故本次擴廠資金運用對本公司之財務結構影響不大，若本案經主管機關審核通過辦理增資發行新股募集資金用於償還銀行長期借款，

將有助於提升本公司之財務結構。

(四)擴廠後之雷射鑽孔加工服務產能、營運可行性及預期未來效益

1.雷射加工的商業模式

目前雷射代工廠與板廠的加工交易模式為：首先，板廠先對雷射代工廠進行認證並提供板材進行試產，認證內容包括加工廠區之環境衛生、人員車輛進出之安全、無塵室之潔淨度、加工孔徑大小、孔的精準度、孔的深淺度、孔形的完整度等均列入考量，並且要試產一片至三片提供板廠檢測；其次，板廠認可各項條件均符合其規範，且視試產品符合品管要求後，進入小批量加工驗證；再次，認證可代加工之機台數，進而洽談代工合約(通常大客戶才會有之程序)，最後，當板廠的產線無法消化、造成該鑽孔製程瓶頸時才會將無法自行消化之板材數量委外給已認證的代工廠加工。因雷射鑽孔製程是板廠整段生產流程之一環，需與板廠之生產規劃相互搭配，通常在代工廠的停留時間不得超過 24 小時，因此代工廠須具有足夠設備才得以滿足板廠之需求。

又因，板廠無法明確保證提供委外加工之數量和時間點，代工廠也不一定有符合規範之設備可以代其加工，所以同一規格的板材會有多家已認證代工廠可以代其加工；代工廠為增加加工機會，其雷射機加工認證也會有一機多家板廠認證之情形。國內代工廠因為認證程序涉及各項加工參數之設定，須有高階技術人員才有能力處理，為克服技術困擾及高階技術人員成本，因此國內代工廠大都採購與板廠相同廠牌、型號之雷射鑽孔機。本公司與板廠之間的代工模式與同業不完全相同，不同之處在於認證程序，因為本公司係採用自製的雷射鑽孔機，於認證程序中，加工參數調整或設定，不能採用其他廠牌之參數，而須本公司研發或技術人員與板廠研發或技術人員交換各項加工條件及規格要求，才能完成第一階段的認證程序。其餘作業流程大致與同業相同。

2.合約無法約定委託加工數量

因板廠的 PCB 板係 IT 產業的重要零組件之一，IT 產業的市場需求變化快，產品週期短，板廠的 PCB 板材規格變化快，板材數量起伏不定，因此板廠基於自身對未來加工規格之變化及加工板數量之不確定性等考量，通常不願意簽定長期委託代工合約，即使簽約也是一年一簽，甚或半年一簽，其內容只約定加工板材之料號、加工品之鑽孔規格、及價格等，不願意約定加工數量(例如:每天、每月加工板材數量或合約期間之加工板材數量)。

3.本公司營運模式特點

本公司採自製雷射鑽孔機代板廠加工，加工板材材質因產品週期變化快，加工參數條件多樣化，因雷射機為自行設計，機台之性能、特性或設備升級均較同業或板廠快速且更具有彈性。因此，依目前經驗，大型客戶因為其客戶對板材之品質提升或板材變更之要求，板廠自購之機台功能僵化，性能提升速度慢、成本高等因素，而無法及時配合，故選擇本公司為第一優先委外加工廠，尤其是新推出的高階板材、先進製程之加工最為明顯；中小型板廠則因未購置雷射機或雷射機設備老舊，而本公司能機動性因應其板材加工之技術規格、產量的需求，委託代工後，雖無訂定長期合約，但滿足其技術性需求，

即成為本公司之長期性客戶。

就本公司之主要板廠 B 公司、C 公司及 A 公司而言，委託本公司加工可因應板材材質變化，而減少增購機器設備或提升性能之支出，降低資本支出，同時可獲得穩定的成品與供貨，並降低其景氣循環之風險。

4. 進行之新經營模式

依 NTI(N.T.Information) Dr.Hayao Nakahara(中原捷雄博士)之研究調查報告顯示，109 年全球百大名單數據顯示，前 25 大企業佔據了百大名單總產值的 59.3%，大者恆大的現象持續在 PCB 產業發生，高階技術能力與巨額投資規模所築起的高牆，促使全球百大 PCB 排行中，大型企業與中型廠間差距恐將會持續擴大。

本公司擴增雷射鑽孔設備提高產能供應，除了增進與前述大型板廠間，在高階板先進製程上之產能支援、增加營收外，另大力推展非 PCB 與 PCB 二線板廠之技術合作開發，將其板材製程中之雷射鑽孔程序直接與本公司之設備結合，不但解決其技術層次的問題，亦可減少其設備投資或產能不及供應之情事。例如：半導體客戶、被動元件客戶、光電客戶、PCB 之第二線客戶等。

5. 營運可行性

全球印刷電路板的生產基地，以亞洲為主，包含臺灣、日本、韓國及中國大陸，其中雷射鑽孔機亦為主要生產設備之一，近年來先進載板朝向高密度、多層與微型化發展，隨著電子零件功能的發展，電路板的孔徑需要微小化，微孔深淺穩定、微孔位置精度、鑽孔數量以及生產速度等，大大的加深了對雷射鑽孔產能之需求。因下列考量，本公司認為雷射鑽孔加工業務的營運應屬可期：

- (1) 下游板廠在擴廠或增購設備時，會依市場需求預估工廠最大產能，因預估的生產數量會受景氣或客戶下單等因素影響而有高低起伏的變化，為降低投資成本及投資風險，在決策時會預留一部分的市場需求由外包商提供產能。
- (2) 因各產品生產週期及鑽孔工序的孔數需求不一，而有受託加工的機會，例如板廠鑽孔設備的能量是 100M 孔，當月生產甲產品所需的鑽孔數是 100M 孔，則不須委外加工，惟次月生產乙產品，板材的尺寸相同但孔數為 200M 孔，板廠會出現鑽孔產能不足 100M 孔而需委外代工之情況。
- (3) 下游板廠因擴充產能受制於場地、鑽孔設備取得成本及取得之時效性。換言之，下游板廠發現其產能無法滿足客戶需求時，預計建廠從籌建到量產需要 2 至 3 年的時間，若難以尋覓適當土地、設備購買交期延後等因素至建廠時間延後數年，新廠完成前需要的產能將由代工廠補足。
- (4) 本公司目前推動與中小型板廠的合作，從客戶技術研發產品階段開始參與，研發成功後，雷射鑽孔的產能列為該企業生產流程的一部份，已陸續有貢獻。
- (5) 擴展非 PCB 產業的鑽孔加工，目前有數家半導體廠、封裝廠在研議高階雷射機的運用，已近成熟中。

6.相較同業之競爭優勢

目前國內業界從事代鑽孔業者分別尖點及凱崑，因其本身具備鑽針之開發能力，故為配合下游印刷電路板客戶之鑽孔耗材，多半以機械鑽孔代工為主，雷射鑽孔代工為輔，而本公司則是具備雷射鑽孔設備開發、操作調整雷射光源之技術能力，故專注於雷射鑽孔代工，惟鑽孔代工服務中，設備的取得及場域空間為高額資金投資，然本公司具備自製設備之優勢，因此，可適度降低設備取得之資金壓力，此外，本公司亦兼具自主調整改良設備之應變能力，得以彈性應對各式材質製程之需求，故目前本公司之設備一經下游客戶認證後，便可依客戶之製程需求自主性的接單投產，相較其他競爭對手之自主彈性較大，並避免過度依賴單一客戶之風險，近年來，本公司已於高階載板先進製程上已獲得具體之實績與肯定，但本公司仍持續致力參與其他領域客戶新產品製程之開發與設計上，涵蓋半導體、光電及封測等產業上。

7.預期未來效益

依據「TPCA；工研院產科國際所研究報告」(如下圖)，全球 IC 載板的生產基地，以亞洲為主，包含臺灣(43%)、日本(34%)、韓國(12%)等地區，其中雷射鑽孔機亦為加工載板的主要生產設備之一，近年來先進載板朝向高密度、多層與微型化發展，隨著電子零件功能發展，電路板之孔徑需要微小化，微孔深淺穩定、微孔位置精度、鑽孔數量以及生產速度等，大大的加深了對雷射鑽孔產能之需求。



另本公司參閱 109 年度 7 月我國行政院會議中宣導，推動臺灣成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，首先，臺灣製造升級絕佳機會分別為供應鏈重組、高階在臺及半導體優勢，且透過兩大政策及三大行動執行，分別為 A、兩大轉骨政策其內容為(A)加速 5G、AI 應用→亞洲高階製造中心、深化製造業軟硬整合 帶動產業智慧化、數位轉型、創新應用、集結產業公協會齊力實現產業鏈智慧化;(B)完整半導體產業生態系→半導體先進製程中心，利用國內半導體產業發展需求扶植國內材料與設備、B、三大具體行動-產業智慧化、數位轉型及創新應用，並在半導體產業部分，將利用國內需求，扶植國內材料與設備產業，朝向材料在地化、技術自主化之目標，且外商設備在地化、先進封裝設備國產化，讓臺灣製造成為全球產業的關鍵力量，從 CP(cost performance)服務推動計畫體優勢，因為：兩岸三地業界；同時提，價格從 China price→Taiwan price)服務推動，預計投資上看新臺幣 1.2 兆元，預估 2030 年半導體的產值上看新臺幣 5 兆元。

本公司的 CO2 及 UV 雷射鑽孔機本身具有 Apeature 自動補正效能、Alignment Mark 影像最佳化處理效能及 REMOTE 效能：遠端控制/Ver.Up/DIAGNOSE 自己診斷效能/故障排除等智慧化功能；已有高階製造中心所強調的 5G、AI 應用，具深化軟硬體整合的特色，已是亞洲高階製造中心的一份子，未來將往更高階的 PICO、FEMTO 層級雷射鑽孔機發展。

綜上所述，本公司如依計畫完成擴增雷射鑽孔機設備，除有利於本公司有效提升營業額創造更高利潤外，就長期無形效益而言，滿足客戶加工產能需求、同時持續性的提供雷射事業加工服務可以穩固競爭優勢外，亦可藉由代工生產因應各種加工板材而調整機台參數之經驗回饋至子公司日本大船，可再精進雷射加工機台之性能，期待未來雷射鑽孔機及其加工服務成為客戶的首選品牌。綜上分析，本公司擴增雷射鑽孔機計畫應屬可行，且未來效益預估尚屬合理。

8. 面對景氣變化、客戶訂單減少之因應措施及未來營運模式規劃

本公司於雷射鑽孔機開發初期並未將雷射鑽孔設備以銷售方式行銷，主係因雷射鑽孔設備產能有限(子公司日本大船每月產能約 2 臺雷射鑽孔機)，故考慮以代工鑽孔服務為主，並以鑽孔之精準與良率為行銷策略，但近年來，本公司亦已積極投入與其他非 PCB 產業族群，透過以租代售方式與半導體、光電及封測產業進行新產品先進製程的開發並已獲得實績肯定，例如於光電客戶有實績、半導體客戶也有幾家測試驗證中。預計 111 年可將雷射鑽孔設備少量銷售，至於 PCB 產業的雷射鑽孔代工服務，有鑑於國內 PCB 板廠多數不具備新產品製程之主導地位，且短期產能上仍處於瓶頸階段，故本公司未來仍將視市場供需狀況，採長期租賃方式替代設備產銷方式提供服務。

本公司過去在代理設備時，曾亦採取將機台出售給客戶，並將機台放置於本公司，由本公司為客戶提供加工服務，惟當時成效不彰，故目前本公司規劃先從自身熟悉的 PCB 產業作為自有雷射品牌事業之出發點，第一階段先在 PCB 產業奠基，接下來再往其他產業發展，例如泛半導體產業，包含晶圓後段切割前處理、封裝之鑽孔及切割、次世代面板 micro LED 所需之微細鑽孔、高功率半導體載板表面處理等等，這些都是本公司正在開發極具未來性的產業應用。PCB(含載板產業)之雷射鑽孔具有非常重要之製程地位，且已是非常成熟的技術，但僅集中於一線大廠這類以往承接 IC 載板與手機主板的公司，而隨著電子產品功能不斷增加及進步，一線大廠以外仍有數百家中型及小型 PCB 廠正處於技術轉型(朝向 HDI 需要雷射鑽孔製程技術)的時期，下一階段將有雷射產能需求之爆發潛力，本公司擴充產能除了與一線大廠持續合作優化生產管理及技術開發以外，同時也不斷與二線 PCB 廠保持生意往來及技術開發合作關係，並搭配 PCB 以外產業的應用開發，未來倘本公司的產品可達到一定品質，且在新領域可獲得先進者優勢之市場認同，則不排除調整策略並銷售雷射鑽孔機設備。

【推薦券商說明】

(一)擴廠計畫、資金來源、預計效益與可行性

1.擴廠計畫

依工研院產科國際所表示，臺灣為高階 IC 載板主要生產地和需求市場，臺灣占

全球 IC 載板材料需求比重達 39%，世界第一，各家載板廠都積極擴產，並布局 5G 天線封裝 (AiP) 載板。該公司主要銷售客戶 C 公司、B 公司及 A 公司於 110 年 1~11 月營收皆呈現 17%~36% 不等之營收成長率。另依高盛研究報告顯示，在 5G、人工智慧和雲端計算等結構驅動因素支撐下，ABF 產業在未來幾年內將有建設性增長，ABF 產業 109 年至 113 年將產生 17% 之需求複合年增長率，市場規模將由 109 年約 43 億美元成長至 113 年 70 億美元。該公司雷射加工鑽孔服務主要協助下游印刷電路板廠客戶，進行 IC 載板(含 ABF 載板)、類載板及 PC/NB 板等加工鑽孔製程之需求，主要應用於消費性電子產品中所需搭載之晶片等電子元件。

該公司雷射機台多數已獲 C 公司、A 公司及 B 公司等大廠認證完成，近年來先進載板朝向高密度、多層與微型化發展，隨著電子零件功能的發展，電路板的孔徑需要微小化，微孔深淺穩定、微孔位置精度、鑽孔數量以及生產速度等，大大的加深了對雷射鑽孔產能之需求，該公司 109 年 12 月 21 日及 110 年 12 月 20 日董事會分別通過 110 年度及 111 年度資本支出各購置 24 台及 14 台雷射機臺，除進行既有機台之汰舊換新外，亦考量 PCB 大廠擴廠特性及 ABF 產業需求持續暢旺將帶動雷射鑽孔需求而進行擴廠原因尚屬合理。

2. 資金來源

該公司本次擴廠所需總資金預計約 746,848 千元，截至 110 年 12 月底已實際支付 283,254 千元，餘 463,594 千元將以銀行借款及營運取得的資金支應。銀行借款額度部分，經取得該公司長期借款合同尚有專案借款額度新臺幣 1.65 億元；以營運取得的資金部分，該公司自結 110 年 12 月 31 日帳上尚有現金約為 1.35 億元，並檢視該公司 109 年度及 110 年第三季經會計師簽證或核閱財務報告之合併現金流量表之營業活動淨現金流入分別為 449,315 千元及 271,118 千元，持續皆為淨現金流入，故該公司本次擴廠資金來源尚屬足夠，亦無以短支長之虞。

3. 預計效益與可行性

(1) 營運可行性評估

A、ABF 載板需求暢旺將帶動雷射鑽孔需求大增

依高盛研究報告顯示，在 5G、人工智慧和雲端計算等結構驅動因素支撐下，ABF 產業在未來幾年內將有建設性增長，ABF 產業 109 年至 113 年將產生 17% 之需求複合年增長率，市場規模將由 109 年約 43 億美元成長至 113 年 70 億美元。另參照工研院產科國際所 110 年 10 月研究報告，由於終端產品對性能的要求日益增長，因此 IC 晶片朝向多層數、大尺寸以及更細的線寬設計，使得 ABF 載板面臨製程與良率的挑戰，且未來隨著各種先進封裝技術的演進將進一步提升 ABF 面積需求。依據調研機構的調查，110 年市場對 ABF 的需求成長率為 27%，而供給成長率僅 16%，供需缺口達 11%，預計供給吃緊之時間可能持續至 112 年，到 113 年才可望達供需平衡，而供需問題也讓 ABF 的平均售價將呈上升趨勢。

近年來，次世代電子產品具備多樣化之功能，對應的電子零件腳位的增加，先進載板亦朝向高密度、多層與微型化發展，在製程上孔徑朝向微小化、孔深淺度的穩定性、孔位精準與產速等標準規格，目前市場均採雷射鑽孔設備對應之，故該公司擴增設備增加產能尚屬可行。

B、該公司持續推動與中小型板廠及非 PCB 產業合作

該公司目前推動與中小型板廠的合作，從客戶技術研發產品階段開始參與，研發成功後，雷射鑽孔的產能列為該企業生產流程的一部份，已陸續有貢獻。經取得該公司與客戶聯繫資料，顯示該公司已與二家客戶目前進行打樣測試中，另一家客戶目前規劃將淘汰舊設備，預計將向該公司租賃或加工產品。

另該公司也擴展非 PCB 產業的鑽孔加工，目前該公司已與數家半導體廠、封裝廠在測試高階雷射機的運用，已近成熟中，預計 111 年將對營收有所貢獻。經檢視交易資料顯示該公司於 111 年 2 月將提供半導體業客戶 1 台雷射鑽孔機，並進入試產階段；預計 5 月將可再增加提供半導體廠 1 台 UV 雷射鑽孔機。

C、考量臺灣 PCB 大廠建廠時會預留部分產能供外包

臺灣 PCB 廠建廠時，會考量生產數量變動風險及為降低不景氣來時帶來之衝擊，在相關擴產計劃決策時會保留一定程度之彈性，造成需要有委外加工代鑽孔之情形，另因各產品生產週期及工序需求不一，倘若出現同一時間需要大量鑽孔工序的情形，客戶端亦會出現有產能不足而需委外代工之情況。

(2)預計效益

經參閱 108 年度及 109 年度雷射應用加工之毛利率分別為 44.80% 及 44.85%，111 年該公司雷射機台持續取得 PCB 大廠之更多台數認證，未來將可提供更多加工服務，在 5G、人工智慧和雲端計算需求增加下，未來二年度 ABF 產業仍呈現成長態樣，未來雷射加工需求將會增加，業務量亦將隨之增加，預計可能產生效益應具合理性。

綜上評估，該公司本次擴廠營運尚屬可行。

(二)如何因應 PCB 產業景氣變化

該公司專精鑽孔工藝技術的支援服務，本身擁有自製鑽孔、成型設備及改造設備的能力，可提供 PCB 客戶先進載板製程所需之工藝。近年來，該公司也逐漸拓展多元的雷射微孔技術，以因應光電或半導體等產業之製程需求。受到光電半導體產業近年吸晴產品 OLED、Micro-LED 影響，與其相關之製程技術用雷射源亦跟著發展，例如 Coherent Inc. 之 CO₂ 雷射，因其波長特性，200W 之 CO₂ 雷射可用於玻璃切割、PCB 通孔鑽孔；切割 OLED 面板之紫外光皮秒脈衝雷射源，加入感測器與精準光束控制模組，可提供光電半導體產業高速發展之解決方案，該公司最近二年度及 110 年前三季對於非 PCB 產業之營業收入已逐年成長，該公司產品已逐步應用於半導體、光電及其他電子零組件等產業上。

【會計師說明】

經檢視該公司 110 年第三季資產減損評估結果，達航公司於 110 年度至 111 年度雷射加工廠房搬遷及擴廠，相關設備因搬遷及待廠房擴建之情況下，部分時間處於未

稼動狀態，造成雷射加工收入較 109 年減少，預期 111 年中擴建廠房完成後，所有機台於可稼動狀態下，112 年起恢復應有之產能，而營收及毛利率亦受產能利用率提升而顯著成長。達航公司估計之未來 5 年現金流入之折現值，與 110 年第三季設備及未來預計增加雷射機台帳面金額相比為高，故未有減損之情事。

該公司預估未來產品需求，5G 世代電子產品須具備高傳輸、高速度的能力，以及 5G 世代的網路伺服器相關設備的升級需求，對載板(IC 載板或 ABF 載板)需求大增。經比較達航公司之各主要客戶 C 公司、A 公司及 B 公司之銷售趨勢，與高盛報告指出中央處理器、圖型處理器和客製化晶片等關鍵晶片升級趨勢加速，將推升 ABF 載板之需求相當，故該公司預期主要客戶為避免過度擴張自有產能，仍會依循原先委託加工模式並持續開發潛在客戶，並持續生產雷射加工設備。

本會計師經檢視達航公司既有使用設備中，有關於部分非自有品牌之雷射機台之使用年限可達 10 年，因此達航公司依照過去機台使用經驗評估該些機器之預期耐用年限為 10 年，且經評估同業針對雷射機台之估計耐用年限亦約當 10 年左右，故評估雷射加工相關設備之折舊以 10 年進行攤提並未有重大異常之情事。

(三)有關貴公司與大船企業(股)有限公司(以下簡稱大企公司)及其轉投資公司間財務業務之獨立性，及關係人交易之必要性與合理性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

【公司說明】

(一)大企公司投資本公司之緣由及持股變化情形

大企公司係 71 年 5 月 2 日由黃立達與黃立信兄弟共同創辦，主要從事 PCB 設備及相關電子零件代理業務，黃氏兄弟另於 80 年 2 月 25 日出資成立本公司(原名為達航工業(股)公司，現更名為達航科技(股)公司)，主係從事 PCB 鑽孔加工及相關設備維修業務。大企公司於 92 年間投資本公司，使本公司成為大企公司旗下持股 100%之子公司。

99 年 3 月本公司之大股東基於股權規劃引進財務性投資人，致對本公司持股降為 56.48%。後因考量外在經營環境之變化進行企業再造、提高競爭力及積極落實專業分工，故本公司於 101 年 12 月 5 日經股東臨時會決議通過減資分割議案，於 102 年 3 月完成減資 55,000 千股，並辦理兄弟分割新設大船開發(股)公司(下稱大開公司，後成為大企公司 100%持股之子公司)。大企公司後於 104 年度辦理減資，並以本公司之股票退還股東(多為創辦人黃立達與黃立信家族成員)，致大企公司對本公司之持股降為 2.55%，另因本公司於 110 年辦理註銷庫藏股，截至 110 年 12 月 10 日大企公司對本公司之持股為 2.63%，另黃立達家族持有本公司之股權共計 61.90%。

(二)本公司組織調整歷程

1. 本公司辦理分割前後之股權架構

本公司 102 年辦理減資兄弟分割之原則係本公司於減資分割後，保有代理、行銷、安裝、維修等業務及 VELA 品牌系列產品之產銷經營權(含專利權等)，並持有 China Expo Ltd.及其轉投資公司，大開公司則持有不動產及其餘子公司股權。

本公司後分別於 102 年度及 103 年度取得大船科技(煙台)有限公司(下稱大船煙台)及大船企業日本株式會社(以下簡稱：日本大船)之股權，相關說明如下：

(1) 本公司向大企公司取得日本大船股權

本公司早期代理日商日立 VIA 機台業務，並肩負日商日立 VIA 原廠鑽孔機設備於臺灣、中國大陸各區之安裝、售後維修及保養業務，由於日商日立 VIA 鑽孔機自 90 年代起市場占有率日趨萎縮，再加上 102 年間日商日立集團出售旗下日立維亞機械公司的股權予香港商隆力集團，致本公司與日商維亞機械公司的合作關係日漸疏遠，本公司逐步轉型為自製開發販售自有品牌的成型機台及鑽孔機台，考量日本大船在日本經營超過 10 年，擁有優秀的人才及高端的技術，因當時計劃在臺灣從事高階鑽孔機業務並在日本從事專用雷射機之開發，本公司遂於 102 年 12 月 23 日董事會決議通過，於 103 年 3 月以增資發行新股的方式，以 1,739 千股達航公司普通股，與大企公司交換

其子公司日本大船 100%股權及臺灣田中貴金屬(股)公司 10%之股權，使日本大船成為本公司 100%持股之子公司，日本大船遂於 104 年展開雷射鑽孔機之自製與開發計畫，並於 106 年度及 107 年度分別成功開發自製 CO2 雷射鑽孔機及 UV 雷射鑽孔機。

(2) 本公司向香港達航取得大船煙台股權

原大企集團於煙台設立子公司之目的，主係為生產主軸並提供鑽孔機、成型機設備之售後服務，並就近服務鴻海公司旗下子公司。本公司於 102 年分割後，因考量中國大陸員工薪資、工廠管理費用均較臺灣低廉，為降低中國大陸地區生產零組件的成本，故於 102 年透過海外子公司 ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED 向隸屬大開公司旗下之轉投資公司香港達航，現金收購大船煙台 100%之股權。本公司因考量關鍵零組件主軸及其核心零件軸心涉及本公司關鍵技術(分子燒結及雷射焊接)，為避免技術外洩，故僅由大船煙台從事主軸維修及技術層次較低的零件生產。

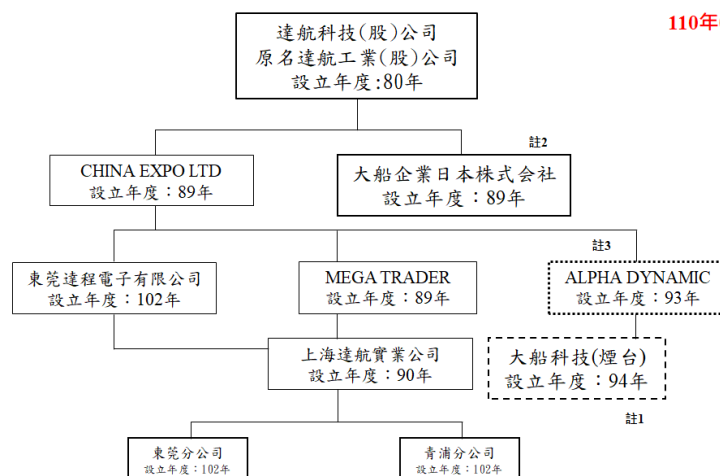
後因 106 年間紅色供應鏈崛起，中國廠商亦有能力製造 16 萬轉、20 萬轉主軸，本公司於中國大陸地區之主軸維修及零件製造，逐漸失去主軸主導地位，並於 107 年開始發生虧損，本公司遂決定縮小中國大陸營運規模，專注於開發 VELA 設備銷售(臺灣製造)及專業服務之中國市場，適逢非關係人-煙台宏源建設工程有限公司(下稱宏源建設)欲取得大船煙台之土地使用權及房屋，遂經本公司 108 年 9 月 27 日董事會決議通過以人民幣 48,500 千元(折合新臺幣 210,349 千元)處分大船煙台股權案，並於 108 年 11 月 30 日以人民幣 52,716 千元(折合新臺幣 228,635 千元)將大船煙台之股權出售予宏源建設，相關價格係參酌山東中勤資產評估事務所出具大船煙台資產評估報告(評估大船煙台土地使用權及房屋之公允價值為人民幣 3,348 萬元，折合新臺幣 145,195 千元)，及富博聯合會計師事務所鄭文榮會計師出具股權交易價格合理性評估意見書(評估合理價格區間為人民幣 46,075 千元至 50,925 千元，折合新臺幣 199,832 千元至 220,867 千元)。

2. 組織架構重組後本公司及子公司與大企公司、其子公司(下稱大企集團)之業務內容

創辦人於成立大企公司及本公司時，主係考量由大企公司從事代理業務，設備出售後由本公司提供售後服務，故有本公司與大企公司於臺灣、上海、東莞等地同時設有據點之情形。於減資分割後，本公司保有代理及售後維修業務，不動產則由大企集團持有，本公司因考量交通便利性及搬遷成本，遂分割後持續向大企集團承租廠房及辦公室，致本公司與大企集團間尚有關聯人交易。另因本公司原屬大企公司之子公司，原集團內各轉投資公司名稱即有雷同之情形，致分割後尚有大企集團部分公司名稱與本公司名稱雷同，或本公司之子公司名稱與大企公司名稱雷同之情形。

本公司及子公司之組織圖及業務內容如下：

110年09月30日



註1：大船科技(煙台)有限公司，係於102年由ALPHADYNAMIC以現金收購股權自香港達航取得。

註2：大船企業日本株式會社，係於103年由達航公司發行新股,與大船企業股份有限公司換股取得。

註3：ALPHA DYNAMIC LIMITED已於108年11月30日出售大船科技（煙台）有限公司100%股份；ALPHA DYNAMIC LIMITED 於109年12月辦理清算案，並於110年4月19日清算完成。

公司名稱	業務內容
本公司	雷射加工、設備產銷及專業服務。
CHINA EXPO LTD.	海外轉投資事業之控股公司。
大船企業日本株式會社(簡稱日本大船)	研發中心及雷射機台製造。
MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED (簡稱 MEGA)	海外轉投資事業之控股公司。
ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED (簡稱ALPHA)	海外轉投資事業之控股公司。
上海達航實業有限公司(簡稱上海達航)	業務據點-鑽 F 孔機、成型機之設備買賣及維修保養服務、雷射加工。
東莞達程電子有限公司(簡稱東莞達程)	業務據點-維修保養業務。

關係人大企集團之業務內容如下：

公司名稱	業務內容
大船企業股份有限公司(簡稱大企)	投資業務。
大船開發股份有限公司(簡稱大開)	投資業務。
大船科技股份有限公司(簡稱大科)	投資業務，不動產租賃等。
大船國際實業有限公司(簡稱大船國際)	境外投資公司。
OFUNA HOLDING COMPANY LIMITED (簡稱 OFUNA HOLDING)	已於 110 年 3 月 29 日註銷。
ARRIS CORP.(簡稱 ARRIS)	境外投資公司。
ARIA WORLDWIDE LTD.(簡稱 ARIA)	已於 110 年 5 月 3 日註銷。
大船電子(上海)有限公司(簡稱大船電子上海)	不動產出租等。

公司名稱	業務內容
達航工業(香港)有限公司(簡稱達航工業香港)	境外投資公司。
達航電子設備(上海)有限公司(簡稱達航電子上海)	不動產租賃等。
大船科技(東莞)有限公司(簡稱大船科技東莞)	業已於 109 年間出售股權予他人。

本公司在研發能力上長期以來係以獨立自主方式開發，目前營運所需之專利權分布於臺灣、中國、日本及韓國等地，皆係屬本公司及本公司所屬之子公司所有，尚無登記於大企集團之情事。另於業務推廣上，因考量本公司所販售之鑽孔設備，非典型民生消費性產品，仍需具備對產品及產業有相當程度之了解及知識，故本公司於分割後，基於對員工工作權之保障，有徵詢原大企集團員工留在本公司之意願，以持續從事自有品牌事業之業務推廣。

目前本公司旗下僅有日本大船之名稱有與大企集團公司名稱雷同之情形，惟從營業項目、與供應商及客戶交易情形來判斷，尚無混淆及競業之情事，因考量公司股權及投資等無任何異動，復因日本商業模式及文化、語言等較為保守，暫無立即變更公司名稱之規畫。另大企集團中有二家公司名稱與本公司雷同，業務內容不同，本公司已建議大船公司進行更名，惟對方表示須審慎評估，目前尚無明確變更時程。因考量大企集團各公司之業務內容與本公司及子公司皆無競業之情事，故雖名稱雷同，尚不致有使往來廠商或客戶混淆之情形。

(三)本公司與大企集團間財務業務之獨立性

因考量黃立達家族持有本公司股權高達 61.90%，且大企公司之負責人為黃立達，故實質認定大企公司及其轉投資公司大開公司、大科公司、大船國際、OFUNA HOLDING、ARIA、ARRIS、達航工業(香港)、大船電子(上海)、達航電子設備(上海)等 10 家公司為本公司之集團企業。

茲就本公司與大企公司間財務業務間之獨立運作說明如下：

1.財務方面：

本公司之財務、會計部門與大企集團分別獨立作業並無兼任大企集團任何職務之情事，且本公司及大企集團間與金融機構之融資額度均獨立運作，本公司尚無融資額度與大企集團共用或為大企集團提供融資保證或背書保證之行為。本公司現任財務主管陳巧梅、會計主管劉智鴻均係本公司分割前即為達航公司之職員。

2.業務方面：

分割後大企集團以投資或以物業經營為主要業務，本公司則保有日本 PCB 機台代理、行銷、安裝、維修等業務及 VELA 品牌系列產品之產銷經營業務(含專利權等)，並積極開發高階鑽孔機、雷射鑽孔機及其應用，並已獲得市場認同。雙方之業務型態、業務類別及產品別皆不相同，故無相互競爭之情事。

3.人事方面：

本公司與大企公司於分割後，部分經營團隊人員曾存在相互兼任之情事，惟已於 110 年第三季起陸續解除兼任大企公司或其關係企業之職務，以符合上市上櫃公司治理實務守則之期許，故本公司目前之經營團隊均未兼任大企集團之經營

管理職務，另黃立達家族人員目前並無於本公司及轉投資公司任職。

綜上所述，本公司與大企公司及其關係企業間之財務業務均獨立運作。

(四)本公司與大企集團間各項關係人交易之必要性與合理性

本公司目前與大企集團之交易主係廠房租賃，相關交易說明如下：

交易主體	交易對象-關係人	交易類型	交易必要性	交易條件及價格之合理性
達航科技	大科公司	廠房租賃及租賃所產生之費用	交通位置、供應商、客戶所在地等因素	雙方參酌市場行情及議價
日本大船	大科-東京支店	1、廠房租賃及租賃所產生之費用 2、物業管理	交通位置、供應商、客戶所在地等因素	雙方參酌市場行情及議價(註2)
上海達航	大船電子上海	廠房租賃及租賃所產生之費用	交通位置、供應商、客戶所在地等因素	雙方參酌市場行情及議價(註3)
東莞達程	大船科技東莞(註1)	廠房租賃及租賃所產生之費用	交通位置、供應商、客戶所在地等因素	雙方參酌市場行情及議價

註1：大企集團已於109年9月將大船科技(東莞)出售，故雙方終止租賃關係。

註2：取具TMAX Valuation 石山真也不動產鑑定士出具之不動產鑑價調查報告書。

註3：取具上海東洲房地產土地估價有限公司葉可、龍昆房地產估價師出具之工業房地產市場租金評估報告。

1.達航科技與大科公司

單位：新臺幣千元

	108 年度	109 年度	110 年前三季
租賃費用	13,700	7,743	4,539
其他費用	1,839	913	531
其他應付帳款	984	—	—

本公司108~109年度向大科公司承租林口廠所支付的租賃費用，隨著整體營運規畫縮減規模，租賃費用隨著租賃面積縮小而減少，於109年下半年本公司考量營運效益決定結束林口廠，將相關設備及人員全數搬回大甲廠，租賃費用隨著租賃合約終止而減少。其他費用為支付大樓管理費用，隨著本公司持續對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的管理費用亦隨之減少。其他應付帳款為承租林口廠區之水電費用，自109年起因會計師認定代墊水電之款項非屬關係人交易故未揭露。本公司與大科公司之租賃合約已於110年9月30日終止，已不存在有租賃關係。

2.日本大船與大科-東京支店

單位：新臺幣千元

	108 年度	109 年度	110 年前三季
勞務收入(註)	851	831	583
應收帳款(註)	152	76	—
預付租賃款	643	—	—
租賃費用	7,209	—	—
取得使用權資產	—	35,413	—
租賃負債	—	27,861	20,408
利息費用	—	454	257
存出保證金	868	1,220	1,099

註：110 年起重分類至業外-其他收入及其他應收款項下。

考量交通便利性及避免遷廠造成生產中斷，子公司日本大船向大科-東京支店承租廠房。另因大科-東京支店於日本當地並無員工，遂與日本大船簽約，委託日本大船執行其日本房地產物業管理，並支付日本大船相關費用，帳列勞務收入，目前大科-東京支店正另洽當地其他物業管理業者協助其物業管理，未來擬將終止委託本公司之子公司執行相關業務；預付租賃款係依合約預付大科-東京支店一個月之租金支出；因原定五年合約到期，日本大船於 108 年 12 月間與大科-東京支店簽訂新合約，面積 1750 平方公尺(約 530 坪)，租期自 109 年 1 月至 113 年 12 月，租期五年，每月租金日幣 221 萬元(折合新臺幣約 55 萬元)，押金日幣 442 萬元(折合新臺幣約 110 萬元)，並經本公司 110 年 6 月 21 日審計委員會及董事會追認通過；該租賃交易已依國際財務報導準則第 16 號「租賃」分別認列使用權資產、租賃負債及利息費用，存出保證金亦受合約調整，而增加存出保證金金額，交易價格係參酌 TMAX Valuation 出具之不動產鑑價調查報告書(取得資產之估價結果為每月租金日幣 2,263 千元)，交易價格應屬合理。

3.上海達航與大船電子上海

單位：新臺幣千元

	108 年度	109 年度	110 年前三季
租賃費用	4,008	3,250	84
存出保證金	374	380	374
取得使用權資產	—	11,119	—
租賃負債	—	9,150	6,106
利息費用	—	281	276

考量雷射機台搬遷將增加重置成本及客戶認證時間成本，子公司上海達航向大船電子上海承租廠房，所租用之廠房面積 1524 平方公尺(約 460 坪)，租期自 109 年 4 月至 112 年 4 月，租期三年，每月租金人民幣 8 萬元(折合新臺幣約 34 萬元)，押金人民幣 24 萬元(折合新臺幣約 100 萬元)，並經本公司 110 年 6 月 21 日審計委員會及董事會追認通過。上海達航與大船電子上海之交易主係為廠房租賃，租賃費用減少係因 109 年 4 月本公司與大船電子上海簽訂為期三年租賃合約，

其租賃交易已依照國際財務報導準則第 16 號「租賃」分別認列使用權資產、租賃負債及認列利息費用。

4.東莞達程與大船科技東莞

單位：新臺幣千元

	108 年度	109 年度	110 年前三季
取得使用權資產	9,030	—	—
租賃負債	6,686	—	—
利息費用	426	273	—
租賃費用	735	—	—
存出保證金	1,173	—	—
其他收入	—	967	—

考量搬遷成本及服務中斷風險，子公司東莞達程故向大船科技東莞承租廠房，並經本公司 110 年 6 月 21 日審計委員會及董事會追認通過。東莞達程所承租地位於松山湖高新技術產業開發區，後因大企集團於 109 年 9 月將大船科技東莞股權出售予他人而提前與子公司東莞達程解約，致 109 年度相關費用較 108 年度減少；另因大船科技東莞租賃合約提前解約，故東莞達程於 109 年取得違約金認列於其他收入。

綜上，因為分割時本公司保有代理、行銷、安裝、維修等業務及 VELA 品牌系列產品之產銷經營業務，原有生產的工廠、銷售展示場及辦公場所，分割後一部分歸屬在大開公司所屬的子公司，由於遷移工廠、遷移展示場所、遷移辦公室，所耗費金額龐大，基於節約成本、供應商及客戶的地點方便性、員工的交通方便性等考量之下，仍留在原場地(分割前原屬達航場所，分割後為大開公司所有)，故承租原場地之生產工廠、辦公室或展示場所，係屬合理且有其必要性。另本公司與關係企業間交易，係依「關係人交易管理辦法」、「內部管理循環-關係人交易管理」及「與關係企業及關係人間財務業務往來相關作業程序」作為與關係人間交易之遵循依據，且本公司針對上述交易業依取得或處分資產規定，向關係人間取得使用權資產，經本公司審計委員會及董事會全數通過在案且完成資訊公告事宜，相關交易價格業參酌市場行情辦理。

(五)黃立達先生與本公司之關係暨是否為實質負責人

黃立達先生於 71 年設立大企公司，時值 76 年後 PC 起飛的年代，一些國外零組件移到臺灣，又因緣際會與日立商社外貿部門社長結識，開始有了代理日立設備的機會，直到 79 年大企公司才算真正穩定，專注於代理日本設備與零件耗材等進口業務，因代理設備進口需要日本原廠來臺灣進行裝機、保養維修，日本原廠與客戶間多有業務耽擱及時間耗費的問題，故於 80 年間與兄長黃立信先生設立本公司，提供代理設備裝機、保養維修等服務業務，幾十年的勤奮經營，公司業務已趨成熟穩定，直到 105 年，身體亮起紅燈，反思自己創業以來，與結縭的妻子聚少離多之外，身體也應好好調理，在醫生再三叮囑之餘，故於 105 年卸任本公司董事長職務，僅以董事及大股東身分出席董事會，參與本公司之營運相關決策，直到於 110 年 6 月 21 日因個人家庭因素辭任董事職務，並於 110 年 6 月底辦理退休，退居為主要大股東之身份。

黃立達先生辭任董事長後，由翁榮隨先生接替董事長乙職，翁榮隨先生本身具備會計師背景，過去長年以來簽證許多國內上市(櫃)公司，同時參與稅務會審法規審議過程，亦具備管理與日文溝通之才能，因此，在本公司之財務、成本及資金管理及內部之溝通管理可勝任之，任職本公司董事長乙職長達5年之久，亦已熟悉本公司之事務。

黃先生家族的子女或晚輩因另有他就，均未在本公司任職，故黃先生退休後，並未參與本公司任何人事、財務或業務經營等方面事務，本公司已由家族企業正式全面性轉型為專業經理人治理。本公司沒有非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務之情事，黃立達先生並非本公司之實質負責人。

綜上所述，黃立達先生於110年6月底退休後，本公司之經營上仍由專業經理人負責、審計委員會及薪酬委員會制衡，財務會計部分業經會計師查核簽證，故黃立達先生辭任對本公司之經營尚無重大之影響。

【推薦證券商】

(一)該公司與大企集團間財務業務之獨立性評估意見

該公司於102年度辦理減資分割事宜，業經提請股東臨時會決議通過、分割換股比例合理性業經洪逸民會計師出具之專家意見書並報請經濟部投審會通過在案，同年間，透過該公司境外轉投資公司-ALPHA DYNAMIC 向大開公司之轉投資公司-達航工業(香港)有限公司現金購入大船科技(煙台)公司之股權，經查該公司業報請經濟部投審會通過在案，此一交易之目的係因中國大陸地區主軸生產、維修、保養業務之營運所需，另該公司因營運需求考量取得日本大船之股權，經檢閱董事會議事錄、勤業眾信會計師事務所林淑怡會計師103年02月18日出具查核驗資報告書及變更登記府產業商字第號10380601020號之內容相符。

再者，該公司所營事業為PCB鑽孔設備組裝、維修保養及自有品牌設備之販售業務，另查詢經濟部商業司工商登記大企公司及分割後新設公司大開公司，以物業管理為主，故該公司與大企公司間並未存有競業之情事。

經檢視該公司及其重要子公司借款合同內容、並洽詢該公司及其重要子公司之管理階層，尚無發現存有與他公司共同使用申請貸款額度(非母子公司)，並檢視該公司最近一年度及110年度前三季之關係人交易明細，確認銷貨及進貨交易對象，尚未發現該公司與大企公司及其轉投資公司間有進、銷貨交易之情事。另經檢視該公司員工清冊及訪談該公司人員，截至110年12月10日止該公司之經理人及員工，尚無兼任大企公司或其他同屬集團企業公司職務之情形，亦無大企公司或其他同屬集團企業公司兼任該公司職務之情形，並經抽核該公司薪資支付情形，該公司之員工勞健保及退休金皆由該公司提撥、代扣及繳納，該公司之人事尚已明確獨立於大企公司及其他同屬集團企業公司。綜上所述，該公司未有財務業務未能與他人獨立劃分之情事。

考量交通便利性及避免遷廠造成生產中斷，該公司持續向關係人承租廠房，經評

估應有其必要性，另經參閱該公司 107~109 年度及 110 年度前三季業經勤業眾信聯合會計師事務所查核或核閱之合併財務報告，所揭露之關係人交易主係為取得使用權資產之租賃交易，相關租約業經該公司之核決權限通過授權完成簽訂，尚未發現有損及該公司之限制條款，於合約中亦未有對未來承租價格之約定，依目前網上查得向實質關係人之承租地區租金行情，其交易價格，並未有發現明顯異常之情形。另該公司之子公司與大船電子上海及大科-東京支店間之交易已有委託外部單位出具估價報告，尚未有重大異常之情事，且該公司已於 110 年 6 月 21 日董事會追認與實質關係人租賃營業場所之交易資料並完成公告事宜，以完善交易條件及預計效益之評估，故整體而言，該公司與實質關係人之交易價格及條件尚屬合理。

(二)該公司實質負責人之評估

1.達航公司之股權結構及黃立達先生對該公司之實質控制情形

黃立達先生暨創業家族成員持有該公司之股權達 61.90%，於 110 年 6 月 21 日辭任董事乙職後，黃立達先生暨創業家族成員對該公司之董事會運作即不具影響力，創業家族成員逐漸淡出企業，甚至不過問經營決策，單純為公司持股最大之大股東，尚符合目前公司治理之主流。

至於，經營管理上，該公司目前由專業經理人全權負責並係遵循現行公開發行公司建立內部控制制度、資金貸與辦法及取得或處分作業程序所建立之制度，由專業經理人分層負責，而專業經理人之任免、考核及升遷制度，則委由薪酬委員會監督，確保專業經理人間良性競爭下，不致損及該公司長遠利益。

2.達航公司之董事會結構及黃立達先生對該公司董事會之實質控制情形

(1)是否實質上執行董事職務

黃立達先生於 103 至 105 年間，曾擔任該公司董事長之職務，但自 105 年 7 月便辭退董事長乙職，經檢視 107 年至 110 年間該公司董事會議事錄，其僅於董事會中擔任董事乙職，由於黃立達先生暨其家族關係企業之持股達 61.90%，取得董事會一席之董事席次，適時了解公司之現況及未來之營運及財務決策，必要時於董事會上提供建議，尚無不合理之處。然自 110 年 6 月 21 日，黃立達先生以個人家庭因素為由，辭任董事乙職後，該公司之經營已交由專業經理人負責經營。

(2)是否實質指揮董事執行業務

本推薦券商於該公司登錄興櫃輔導期間，均列席參與該公司董事會運作之情形，黃立達先生於 109 年 8 月 31 日任職至 110 年 6 月 20 日前間之董事會，均親自列席參與董事會議案之討論，惟自 110 年 6 月 21 日辭任後，本推薦券商並未見黃立達先生參與或列席董事會之情事，故尚無發現黃立達先生實質指揮董事執行業務之情事。

(3)對董事會運作之影響力

該公司之董事會運作依循公開發行公司董事會議事辦法、董事會議事規範，

並設置獨立董事成員，董事會亦設有審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會，分別負責該公司之預算、財務等相關事宜，及該公司之薪酬與人事，包含高階主管的績效評估、選任、薪酬福利等，故該公司董事會應屬獨立運作。

另現任翁榮隨董事長已任職長達 5 年之久，其董事長家族及其可控公司持有該公司 17.61% 股份，係為該公司之第二大持股家族，故對該公司仍具一定程度之影響，而翁董事長於任職期間一週至少親赴公司三天，統籌管理各單位事務之決策，以及按週針對各單位之行事計畫、執行進度、檢討成果的日常經營管理，翁董事長任職會計師期間，長年以來服務日商赴臺業務，故與日商間語言溝通及商業文化互動都相當熟稔，因此與日本研發團隊在研發事務之溝通無礙，便於可加速取得建立與當地員工及客戶之認同與信任。綜述，翁董事長以繼任者的角色、創業者的心胸，充分了解企業經營的特性與要點，故對該公司之經營決策上，有高度的影響力。

3. 黃立達先生對達航公司人事、財務或業務經營實質控制情形

(1) 人事

經檢閱該公司組織圖、內部控制制度、核決權限表、董事會議事錄、薪酬委員會議事錄及抽核薪工循環之相關表單，該公司設有人事單位，員工聘任之任免係依內部相關辦法執行，各單位依人力需求提出後經權責主管核准任免，有關經理人之薪資及獎金，亦需由薪資報酬委員會審核後提報董事會通過，故該公司人事任免及薪資報酬標準係依政策執行，已依其相關管理辦法運作，且該公司總經理、人事、研發及採購經理人於該公司服務年資長達 5~10 年左右，故該公司人事任免及決策尚屬獨立運作，並無黃立達先生實質控制之虞。

(2) 財務

經檢閱該公司經會計師查核簽證及核閱之財務報告、內部控制制度、核決權限表、董事會議事錄及現行存續中有效之重要契約及抽核相關會計憑證，並參閱翰辰律師事務所邱雅文律師意見書，該公司未有與他人簽訂對該公司營運有重大限制或顯不合理之契約，亦未有資金來源過度集中非金融機構或與他人共同使用貸款額度之情事，另，該公司會計帳務之編製及核決，均依核決權限辦理。

目前該公司會計主管劉智鴻先生及稽核主管鄭照慶先生，均經該公司董事會決議任命通過在案，亦非由黃立達先生所指派，而該公司於 109 年 8 月 31 日已設置審計委員會，故該公司簽證會計師之委任、解任或報酬、會計或稽核主管之任免及財務報告等，均需經審計委員會全體二分之一以上同意，並提董事會決議。

綜合上述，該公司已依證券交易法暨金管會證期局之公司治理問答集-審計委員會，由三席獨立董事設置成立審計委員會，監督該公司之財務運作，故該公司之財務運作，已非一般董事成員可以掌控，尚無法指揮審計委員之運作，亦無法影響全體董事之決議，進而控制該公司之財務運作。

(3)業務

主辦推薦證券商於輔導期間，經查訪該公司總經理、採購及各單位業務主管，該公司經營團隊於鑽孔設備年資長達數十年以上，而總經理陳柏棋先生自大學畢業後，便跟隨創辦人黃立達先生，穿梭臺灣、日本及中國大陸市場 PCB 鑽孔設備之販售業務，於 PCB 鑽孔設備業界經驗長達數十年以上，且與國內主要印刷電路板廠，已建立良好的互動關係，故有助於該公司業務的拓展。

另該公司與供應商間往來情形穩定，並由各單位主管與相關人員負責接洽，其訂單接洽與客戶信用額度審核上，均依循內部管理辦法執行，且內部相關核決權限，均透過系統控管，非授權人員不得操作，經洽詢稽核主管，目前黃立達先生並無帳號或權限可登入系統執行任何核決，故黃立達先生尚無控制該公司業務運作。

目前該公司研發團隊分別編製於臺灣及日本兩地，臺灣部分主要專研機械鑽孔設備及成型機開發、維修及主軸產品，主要由稻見和明先生主導，稻見先生已任職於該公司長達 20 年之久，專攻提供客戶鑽孔機設備的解決方案，而日本部分，由金谷保彥主要負責雷射鑽孔機台之開發，藉由貼近主流競爭大廠日商三菱之所在地，進行市場資訊交流與情報蒐集，並針對日本當地新材料開發與先進製程搭載，同時，稻見先生亦扮演與日本專業技師間溝通的橋樑，以利鑽孔設備之技藝得以延續傳承。雖該公司於 80 年設立迄今，董事會成員更迭，但該公司之業務及研發團隊，仍持續維繫與上下游廠商間的關係，致力於將產品銷往各地。

整體而言，該公司於人事、財務及業務面均依相關內控辦法程序執行，前董事長黃立達先生自 110 年 6 月 21 日辭任該公司董事乙職後，均無實質上執行董事業務或實質控制該公司之人事、財務或業務經營而實質董事執行業務之情事，故黃立達先生非為該公司之實質負責人。退萬步言，縱使黃立達先生因為該公司創辦人暨前董事，且其家族持有該公司 61.90%，而被認定為該公司實質負責人，經查閱財團法人金融聯合徵信中心之徵信報告並無被列為拒絕往來戶、發生存款不足退票列入記錄未經註銷及向金融機構貸款有逾期還款之情事、財政部所屬各地區國稅局、各縣市稅捐稽徵處所出具之無欠繳應納稅捐資料並查詢司法院網站中裁判書查詢系統、法源法律網裁判查詢系統後，黃立達先生於最近三年度及 110 年截至申請時並無違反相關法令規定，故尚無「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第七款有違反誠信原則之情形。

二十四、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項：

(一)董事會運作情形資訊

109 年度及 110 年截至公開說明書刊印日止，本公司董事會開會二十次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列) 席率%	備註
董事	翁榮隨	20	0	100	
董事	黃立達	12	0	100	110.06.21 辭任
董事	金谷保彥	20	0	100	
董事	蕭長榮	15	0	100	109.08.31 就任
董事	鴻圻國際(股)公司 代表人：稻見和明	5	0	100	110.08.30 就任
獨立 董事	陳文炯	15	0	100	109.08.31 就任
獨立 董事	游張松	15	0	100	109.08.31 就任
獨立 董事	梁江蔚	15	0	100	109.08.31 就任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

屆次	會議日期	議案內容	獨立董 事意見	公司對獨 立董事意 見之處理
第十二 屆第一 次	109.08.31	1.推選本屆第一次董事會主席案 2.推選董事長案 3.制訂「申請暫停及恢復其股票櫃檯買賣作業程序」案 4.本公司委任薪資報酬委員案 5.本公司組織調整異動案 6.本公司一〇九年度固定資產預算修正案 7.本公司境外資金匯回投資 產業投資計畫，指定受理銀行案 8.庫藏股轉讓予員工案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二 屆第二 次	109.11.16	1.一〇九年度第三季自編合併財務報表 2.本公司銀行額度申請及續約申請案 3.集團大陸子公司廣東達航電子有限公司銀行額度續約申請案 4.集團大陸子公司東莞達程電子有限公司資金貸予廣東達航電子有限公司案 5.本公司簽證會計師委任獨立性評估案 6.一〇九年度委任簽證會計師及簽證公費案 7.制訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過

		8.修訂本公司「關係人交易管理辦法」 9.修訂本公司「董事及經理人薪資報酬之管理辦法」		
第十二屆第三次	109.12.21	1.公司 110 年度營運計劃及預算案 2.本公司 110 年度固定資產預算案 3.本公司 110 年度稽核計畫案 4.本公司自行編製財務報告能力計畫書案 5.本公司「董事會績效評估辦法」附表修正及評估工作執行計畫案 6.本公司海外子公司廣東達航電子有限公司遷址及更名案 7.本公司海外子公司東莞達程電子有限公司及廣東達航電子有限公司東莞分公司遷址案 8.本公司海外子公司 ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(以下簡稱 ALPHA 公司)辦理清算案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第四次	110.01.25	1.本公司 109 年度員工年終獎金及酬勞案 2.本公司 109 年度經理人獎酬案 3.解除本公司董事競業禁止之限制案，依公司法第二〇九條之規定，擬提請 110 年度股東常會同意解除董事競業之限制 4.解除本公司經理人競業禁止之限制案 5.修訂本公司「資本支出(固定資產)管理辦法」案 6.制訂本公司「法令規章遵循管理辦法」案 7.制訂「防範內線交易管理作業辦法」案 8.本公司 110 年度薪資報酬政策案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第五次	110.03.15	1.109 年度營業報告書及財務報表案 2.109 年度員工酬勞及董監酬勞提撥案 3.109 年度盈餘分配案 4.109 年度內控聲明書案 5.110 年度董監事責任保險案 6.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告暨庫藏股註銷減資案 7.本公司擬與康和綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東自願集保協議書」案 8.本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案 9.110 年度簽證會計師委任獨立性評估案 10.110 年度委任簽證會計師及簽證公費案 11.訂定 110 年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜 12.受理百分之一以上股東提案相關事宜 13.自行編製財務報告能力計畫書案 14.銀行額度申請及續約申請案 15.集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案 16.林口廠搬遷及大甲幼獅工業區青年路廠房租	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過

		賃案 17.修訂本公司「股東會議事規則」案 18.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 19.108-109 年度向關係人取得雷射機台設備案 20.110 年度向關係人取得雷射機台設備案 21.本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸上海達航實業有限公司(更名前:廣東達航電子有限公司)增資案		
第十二屆第六次	110.05.10	1.110 年度第一季自編合併財務報表案 2.110 年固定資產預算修正案 3.銀行額度申請及續約申請案 4.集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證 5.本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第一次董事臨時會	110.05.21	1.本公司 110 年度股東常會開會日期及地點變更案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第七次	110.06.21	1.110 年度第二季、第三季及第四季財務預測案 2.本公司內部控制制度聲明書案 3.本公司子公司 CHINA EXPO LIMITED.(達通工業股份有限公司)減資案 4.本公司及子公司向關係人取得使用權資產之處理程序案。 5.本公司制訂「處理董事要求之標準作業程序」案 6.本公司經理人名單案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第八次	110.07.05	1.擬定 109 年度現金股利除息基準日案 2.補選董事一席案 3.訂定 110 年第 1 次股東臨時會日期、時間、地點、召集事由(議程)及停止過戶期間案 4.解除本公司董事競業禁止之限制案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6.本公司之子公司董監事及法人代表異動案 7.解除本公司經理人競業禁止之限制案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第九次	110.08.09	1.110 年度第二季合併財務報表案 2.本公司之子公司董事異動案 3.解除本公司董事競業禁止之限制案 4.本公司銀行額度申請修正案 5.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證,因背書保證金額變更及說明內容修正案 6.110 年固定資產預算修正案 7.稽核代理人異動案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十二屆第十次	110.11.08	1.110 年度第三季合併財務報表案 2.110 年第四季暨 111 年第一季之財務預測案	三位獨立董事	全體出席董事同意

次		3.本公司內部控制制度聲明書案 4.銀行額度續約申請案 5.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案 6.本公司之背書保證專用章保管人及保證函簽署人員授權案 7.本公司 109 年度經理人員工酬勞及董事酬勞提撥案 8.本公司董事薪資案 9.本公司總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管名單案	均同意 通過	通過
第十二屆第十一次	110.12.20	1.本公司 111 年度營運計劃預算案 2.本公司 111 年度固定資產預算案 3.本公司 111 年度稽核計畫案 4.本公司 110 年度董事會績效評估工作執行計畫案 5.本公司 111 年度薪資報酬政策案	三位獨立董事均同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十二屆第十二次	111.01.10	1.本公司 110 年度年終獎金發放案。 2.本公司 110 年度經理人獎酬案。 3.本公司組織調整案	三位獨立董事均同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十二屆第十三次	111.03.15	1.本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司 110 年度盈餘分配案。 4.本公司 110 年度內控聲明書案。 5.本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。 6.訂定本公司股票初次上櫃前現金增資普通股股票員工認購辦法、取得認購資格之經理人名單及可認購股數案。 7.本公司 111 年度董事責任保險續保案。 8.本公司 111 年度簽證會計師委任獨立性評估。 9.本公司 111 年度委任簽證會計師及簽證公費案。 10.本公司銀行額度續約申請案。 11.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。 12.本公司之子公司間資金貸與授權額度案案。 13.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 14.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 15.修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。 16.修訂本公司「誠信經營守則」案。 17.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 18.本公司訂定 111 年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。 19.本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。	三位獨立董事均同意 通過	全體出席 董事同意 通過

第十二屆第十四次	111.05.10	1. 111 年度第一季自編合併財務報表案 2. 員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日。 3. 本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。 4. 本公司經理人薪資調整案。	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	議案內容	董事姓名	應迴避原因	參與表決情形
110.01.25 第十二屆第四次董事會	本公司 109 年度經理人酬勞案	翁榮隨、黃立達、金谷保彥	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
110.11.08 第十二屆第十次董事會	本公司 109 年度經理人員工酬勞及董事酬勞提撥案	翁榮隨、金谷保彥、蕭長榮、稻見和明	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
110.11.08 第十二屆第十次董事會	本公司董事薪資案	稻見和明	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
111.01.10 第十二屆第十二次董事會	本公司 110 年度經理人獎酬案	翁榮隨、金谷保彥、稻見和明	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
111.03.15 第十二屆第十三次董事會	訂定本公司股票初次上櫃前現金增資普通股股票員工認購辦法、取得認購資格之經理人名單及可認購股數案	金谷保彥、稻見和明、	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形詳下：本公司於 109 年 12 月通過董事會績效評估辦法及程序，已於 110 年 1 月 15 完成 109 年度董事會及功能委員會績效評估，並於 3 月 15 日董事會報告。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

(一)本公司董事會運作依「董事會議事規範」等相關法規制訂並落實執行，於 109 年 08 月 31 日股東會臨時會進行全面董事改選，第十二屆董事會成員共七位含 3 席獨立董事，於改選後即同時成立審計委員會及薪酬委員會，提升強化董事會管理機能及健全審計監督功能。

(二)本公司不定期安排董事參與專業課程進修，使董事保持專業職能及法規知識。

(三)董事會之重大決議事項，已依規定揭露於公開資訊觀測站。

(四)本公司已投保董事責任險，以提供董事執行業務之保障。

(二)審計委員會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

本公司於民國 109 年 08 月 31 日始由全體獨立董事成立審計委員會取代監察人職能，109 年度及 110 年截至公開說明書刊印日止開會十二次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率 %(註 1、註 2)	備註
獨立董事	陳文炯	12	0	100	
獨立董事	游張松	12	0	100	
獨立董事	梁江蔚	12	0	100	

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

屆次	會議日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第一次	109.11.16	1.一〇九年度第三季自編合併財務報表 2.本公司銀行額度申請及續約申請案。 3.集團大陸子公司廣東達航電子有限公司銀行額度續約申請案。 4.集團大陸子公司東莞達程電子有限公司資金貸予廣東達航電子有限公司案。 5.本公司簽證會計師委任獨立性評估案。 6.一〇九年度委任簽證會計師及簽證公費案。 7.制訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 8.修訂本公司「關係人交易管理辦法」。	全體出席 委員同意通過	全體出席 董事同意通過
第一屆第二次	109.12.21	1.公司 110 年度營運計劃及預算案。 2.本公司 110 年度固定資產預算案。 3.本公司 110 年度稽核計畫案。 4.本公司自行編製財務報告能力計畫書案。 5.本公司海外子公司廣東達航電子有限公司遷址及更名案。 6.本公司海外子公司東莞達程電子有限公司及廣東達航電子有限公司東莞分公司遷址案。 7.本公司海外子公司 ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(以下簡稱 ALPHA 公司)辦理清算案。	全體出席 委員同意通過	全體出席 董事同意通過
第一屆第三次	110.01.25	1.解除本公司董事競業禁止之限制案，依公司法第二〇九條之規定，擬提請 110 年度股東常會同意	全體出席 委員	全體出席 董事

		解除董事競業之限制。 2.本解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3.修訂本公司「資本支出(固定資產)管理辦法」案。 4.制訂本公司「法令規章遵循管理辦法」案。 5.制訂「防範內線交易管理作業辦法」案。	同意通過	同意通過
第一屆第四次	110.03.15	1.109 年度營業報告書及財務報表案。 2.109 年度盈餘分配案。 3.109 年度內控聲明書案。 4.110 年度董監事責任保險案。 5.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告暨庫藏股註銷減資案。 6.本公司擬與康和綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東自願集保協議書」案。 7.本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。 8.110 年度簽證會計師委任獨立性評估案。 9.110 年度委任簽證會計師及簽證公費案。 10.訂定 110 年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。 11.受理百分之一以上股東提案相關事宜。 12.自行編製財務報告能力計畫書案。 13.銀行額度申請及續約申請案。 14.集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。 15.林口廠搬遷及大甲幼獅工業區青年路廠房租賃案。 16.修訂本公司「股東會議事規則」案。 17.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 18.108-109 年度向關係人取得雷射機台設備案。 19.110 年度向關係人取得雷射機台設備案。 20.本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸上海達航實業有限公司(更名前：廣東達航電子有限公司)增資案。	全體出席 委員同意通過	全體出席 董事同意通過
第一屆第五次	110.05.10	1.110 年度第一季自編合併財務報表案。 2.110 年固定資產預算修正案。 3.銀行額度申請及續約申請案。 4.集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證 5.本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日	全體出席 委員同意通過	全體出席 董事同意通過
第一屆第六次	110.06.21	1.110 年度第二季、第三季及第四季財務預測案。 2.本公司內部控制制度聲明書案。 3.本公司子公司 CHINA EXPO LIMITED.(達通工業股份有限公司) 減資案 4.本公司及子公司向關係人取得使用權資產之處理程序案。 5.本公司制訂「處理董事要求之標準作業程序」案。	全體出席 委員同意通過	全體出席 董事同意通過

第一屆 第七次	110.07.05	1.擬定 109 年度現金股利除息基準日案。 2.補選董事一席案。 3.訂定 110 年第 1 次股東臨時會日期、時間、地點、召集事由(議程)及停止過戶期間案 4.解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.本公司之子公司董監事及法人代表異動案。 7.解除本公司經理人競業禁止之限制案。	全體 出席 委員 同意 通過	全體 出席 董事 同意 通過
第一屆 第八次	110.08.09	1.110 年度第二季合併財務報表案。 2.本公司之子公司董事異動案。 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.本公司銀行額度申請修正案。 5.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證,因背書保證金額變更及說明內容修正案。 6.110 年固定資產預算修正案 7.稽核代理人異動案	全體 出席 委員 同意 通過	全體 出席 董事 同意 通過
第一屆 第九次	110.11.08	1.110 年度第三季合併財務報表案 2.110 年第四季暨 111 年第一季之財務預測案 3.本公司內部控制制度聲明書案 4.銀行額度續約申請案 5.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案 6.本公司之背書保證專用章保管人及保證函簽署人員授權案	全體 出席 委員 同意 通過	全體 出席 董事 同意 通過
第一屆 第十次	110.12.20	1.本公司 111 年度營運計劃預算案 2.本公司 111 年度固定資產預算案 3.本公司 111 年度稽核計畫案	全體 出席 委員 同意 通過	全體 出席 董事 同意 通過
第一屆 第十一次	111.03.15	1.本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司 110 年度盈餘分配案。 3.本公司 110 年度內控聲明書案。 4.本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。 5.本公司 111 年度董事責任保險續保案。 6.本公司 111 年度簽證會計師委任獨立性評估。 7.本公司 111 年度委任簽證會計師及簽證公費案。 8.本公司銀行額度續約申請案。 9.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。 10.本公司之子公司間資金貸與授權額度案案。 11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 12.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 13.修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。 14.修訂本公司「誠信經營守則」案。 15.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 16.本公司訂定 111 年股東常會日期、時間、地點	全體 出席 委員 同意 通過	全體 出席 董事 同意 通過

		及其他相關事宜。 17.本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。		
第一屆 第十二次	111.05.10	1. 111 年度第一季自編合併財務報表案 2. 員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日。 3. 本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應註明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，將稽核報告及追蹤報告交付各獨立董事，並及時回覆獨立董事所指示之事項。

(二)稽核主管列席公司定期性董事會並做稽核業務報告，且與本公司獨立董事溝通狀況良好。

(三)獨立董事若有需要，得與隨時與財務長進行電話或電子郵件的溝通。

2.監察人參與董事會運作情形：

本公司於民國 109 年 8 月 31 日始由全體獨立董事成立審計委員會取代監察人職能，109 年度董事會開會五次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數	委託出席 次數	實際出 (列)席率 %	備註
監察人	普實創業投資股份有限公司 鄭羽妙	5	0	100	109.08.31 卸任
監察人	洪啟宗	5	0	100	109.08.31 卸任

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：本公司之監察人列席本公司董事會，以監督運作情形並達雙向溝通之目的。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）

A.內部稽核主管每月與監察人溝通稽核報告結果。

B.內部稽核主管列席公司董事會並做稽核業務報告，本公司不定期以電話或 E-mail 方式聯繫，溝通情形良好。

C.監察人不定期與會計師針對公司財務報告及新頒布之法令對公司之影響，進行討論。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並經董事會通過，於本公司網站揭露。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)已依規定設置發言人制度並由專人處理相關問題。	(一)無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)由股務代理機構取得持股比例達5%以上或持股比例佔前十名之股東名單。	(二)無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)公司依內部控制制度辦理，確實執行關係企業風險控管機制及防火牆機制。	(三)無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)依公司「內部人資料申報管理作業」及相關法令規定辦理。	(四)無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司董事七席，具有經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律及環保等相關專業技能與經歷，成員多元互補有助於公司運作、營運型態及發展之需求。	(一)無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二)本公司目前僅設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚無設置其他功能性委員會之需求，未來將視公司營運需求增設其他功能各類功能性委員會。	(二)無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)本公司董事會於109年8月10日通過「董事會績效評估辦法」，依辦法每年進行績效評估，已於110年第一季完成董事會報告評估結果。	(三)無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司定期評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報審計委員會及董事會審議並通過，本公司近期於110年3月15日，經執行評估後，勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮、龔則立會計師、皆符合獨立性評估標準。	(四)無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	本公司董事會通過訂定「公司治理實務守則」，未來擬將於上櫃掛牌後，尋求選任適當之人選作為本公司公司治理主管，負責公司治理相關事務，目前暫由本公司董事長室執行董事會、股東會相關事宜及製作董事會、股東會議事錄。	擬將於上櫃掛牌後，依相關規定辦理。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司已於公司網站上，設立利害關係人專區並建立發言人制度，由專人處理相關問題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司業已委任康和證券股務代理部辦理相關事務代辦機構辦理股東會事務及股票過戶事宜。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司公司網站已設置『投資人專區』，揭露財務業務及公司治理資訊，並於公開資訊觀測站依相關規定申報或公告。	(一)無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		(二)本公司已建置中文網站並依規定落實發言人制度，網站內容由專人負責資訊之蒐集及揭露，定期揭露公司資訊。	(二)無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與		V	(三)本公司為興櫃公司，已依相關規定分別於每會計年度終了，後四個月內及每會計年度第二季終了後四十五日內分別公告及申報年度	(三)擬將於上櫃掛牌後，依相關規定辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
各月份營運情形？			財務報告及第二季財務報告，尚無須申報第一、三季之財報。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益與僱員關懷：本公司視員工為重要資產，除依法設立職工福利委員會，並訂有各項福利計畫，包含員工年節禮金、員工教育訓練等，另定期召開勞資會議，並訂定員工工作規則及各項管理辦法以維護員工合法權益，使員工與主管間溝通管道順暢。 (二)投資者關係：本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站，並設有發言人及代理發言人，提供 email 及電話等連絡方式，投資人可隨時反映意見。 (三)供應商關係：本公司與供應商均維持平等及良好之關係，並不定期討論商品供貨狀況，提升品質，以創雙贏之合作方式。 (四)利害關係人之權利：本公司依相關法令規定，公開經營資訊於「公開資訊觀測站」，同時委任康和綜合證券股份有限公司之股務代理處理股東及利害關係人之相關建議等問題，以維護利害關係人之權益。 (五)董事之情形：本公司董事會成員，均已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，參加指定機構舉辦涵蓋公司治理及證券法規等進修課程，並符合進修時數之規定。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各項內部規章並遵循之以控制風險。並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。 (七)客戶政策執行情形：本公司與客戶維持良好關係，並重視客戶意見，於本公司網站設有聯絡資訊，為避免影響客戶權益，本公司業務單位定期或不定期與客戶針對服務進度執行追蹤，以維護客戶之權益。	(一)無重大差異 (二)無重大差異 (三)無重大差異 (四)無重大差異 (五)無重大差異 (六)無重大差異 (七)無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(八)董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。	(八)無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)				

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳文炯	主要經(學)歷： 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人、 杏和聯合會計師事務所所長(現任)、 台北市會計師公會理事、 銘傳大學會計研究所兼任助理教授、 臺北商業大學兼任教師	註 3	-
游張松	主要經(學)歷： 臺灣大學管理學院工商管理學系專任教授、兼任教授(現任)、 雄獅旅行社(股)公司獨立董事(現任)、 網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事、 寶陞國際(股)公司獨立董事(現任)	註 2	2
梁江蔚	主要經(學)歷： 中租迪和(股)公司經理、 菱光科技(股)公司創辦人及總經理、 亞泰影像(股)公司創辦人及總經理 虹光精密工業(股)公司獨立董事(現任)	註 2	1

註1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註2：本公司三位獨立董事並無違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中有關獨立性規範之情事。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：109年08月31日至112年08月30日，109年度及110年截至公開說明書刊印日止薪資報酬委員會開會十次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	梁江蔚	10	0	100	109.08.31 就任
委員	游張松	10	0	100	109.08.31 就任
委員	陳文炯	10	0	100	109.08.31 就任
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否 建立推動永續發展之治理架構，且設置推動 永續發展 專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導 情形？		V	尚未設立企業永續發展委員會專(兼)職單位，將於上櫃後推動該組織建立、並規劃相關政策制定。	擬將於上櫃掛牌後，依相關規定辦理。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		V	本公司已訂定「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」且秉持「專業、服務、創新、團隊」經營理念及重大性原則，追求企業永續經營與獲利之同時，履行企業社會責任，重視利害關係人之權益；惟對環境、社會與公司治理議題之風險評估，未來將規劃制定風險管理政策，以因應企業經營環境之變化。	擬將於上櫃掛牌後，依相關規定辦理。
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司已依所處產業特性之環境保護相關法令遵循之，另本公司計畫推動 ISO-14001 之環境管理規定。	(一)無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司產品已致力於節能減碳之設計，力求減少廢品之產生並提昇廢品之回收再利用率。	(二)無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三)本公司會密切關注全球氣候變遷，對本公司潛在風險與機會，並且不定期向員工宣導省電措施、愛護資源及環保概念，提升各項資源之利用效率	(三)無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四)本公司雖無統計過去兩年度溫室氣體排放、用水量及廢棄物總重量，但在廢棄物管理上，本公司亦依循工廠所在地經當地縣市政府核發之合格廠商進行廢棄物管理，無隨意丟棄及違規之情事。本公司計畫推動 ISO-14001 及 ISO-45001，對所有製造過程中對環境所造成的衝擊均納入考量，以期能對環境生態衝擊降到最低，故本公司宣導節能減碳減，並且減少不必要的能源浪費。	(四)無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司遵守勞動相關法規並遵循國際人權公約，訂有工作規則及相關人事管理規章，依法保障員工之各項合法權益。	(一)無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二)本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。公司每年視經營成果並按員工對公司的貢獻度、績效表現等發給年終獎金，另，本公司設立職工福利委員會，由員工選舉產生福利委員辦理各項福利活動。	(二)無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三)本公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育及員工健康檢查。	(三)無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司定期舉辦員工教育訓練，涵蓋提升員工職涯能力發展項目。	(四)無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)本公司並不對消費者直接供應產品或勞務，對本公司之客戶則有專責業務人員負責產品後續追蹤服務及客訴處理，另，本公司對產品之行銷及標示係遵循相關法規及國際準則，對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，並設有利害關係人專區保護消費者權益，提供申訴管道。	(五)無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)本公司訂有供應商管理政策，並定期進行評鑑，惟，本公司目前尚未要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等規範，未來將視實際交易情況評估，評估是否應納入與主要供應商之契約，逐步推動辦理。	(六)無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司目前尚未達到必須編製企業社會責任報告書之規模、業務性質等標準，故尚未編製企業責任報告書，未來將視情況評估是否編製。	擬將於未來視情況評估編製。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：公司尚已訂定相關守則，相關實務尚在計畫推動中。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」且於內部管理及商業活動中確實執行。	(一)無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司訂有「誠信經營守則」與「道德行為準則」規範相關作業程序，並建立及落實執行有效之內部控制機制及內部簽核流程，以確保有效預防及發現貪腐之情事。	(二)無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三)本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」做為員工於執行業務之倫理標準，要求全體員工不得接受任何不當之饋贈，避免員工因個人利益而犧牲公司權益，以杜絕公司內外一切非法行為。另全體員工負有保密公司或他人之營業秘密	(三)無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			之義務。	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V V V		(一)本公司與往來對象有建置基本資料或建置徵信作業，以透明與公平方式進行商業活動，與重要往來之供應商皆訂有誠信經營條款，要求杜絕不當利益之連結，以確保各項商業活動符合誠信原則。 (二)本公司推動企業誠信經營相關宣導由董事長室負責。由各部門依其職務所及之範疇，辦理誠信經營守則之政策與防範方案之制定及監督執行等相關作業，並由董事長室彙總結果向董事會報告。 (三)本公司訂定「誠信經營守則」，作為公司全體員工、承包商、供應商和企業夥伴都應遵循的企業商業行為標準。 (四)本公司依相關法令訂定會計制度及內部控制制度。內部稽核人員定期查核其遵循情形，並向董事會報告。 (五)本公司定期舉辦員工教育訓練，包含推廣誠信經營理念。	(一)無重大差異 (二)無重大差異 (三)無重大差異 (四)無重大差異 (五)無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司為保障供應商和員工依法行使舉報及申訴權利，對於，違反誠信經營規定情事，本公司將依相關法令或工作規則予以簽報獎懲，員工亦可透過多重管道，向專責單位處理相關情事或向各管理階層及人事單位反應，且於本公司網站設有「檢舉信箱」，並指派專人受理。	(一)無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(二)本公司已於「誠信經營守則」清楚載明相關程序及保密機制。 (三)本公司網站設有「申訴信箱」、「檢舉信箱」，對檢舉人身分及檢舉內容保密，並保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	(二)無重大差異 (三)無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站揭露「誠信經營守則」，並於公開資訊觀測站公告相關資訊。	(一)無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

請參考公開資訊觀測站網站，網址：<http://mops.twse.com.tw>。

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管辭職解任情形之彙總：無此情形。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.本公司目前設置審計委員會及薪資報酬委員會，以強化公司治理。

2.本公司及時申報重大訊息及興櫃公司所規定應行申報之各項事宜。

3.每季至少召開一次董事會，經理人及財會主管列席備詢，稽核主管會列席並向董事會報告稽核情形。

柒、重要決議、公司章程及相關法規

一、與本次發行有關之董事會及股東會議事錄：

(一)與本次發行有關之決議文：請參閱附件六。

(二)盈餘分配表：110 年盈餘分配表：請參閱附件八。

二、公司章程(含章程新舊條文對照表)：請參閱附件七。

三、未來股利發放政策：

本公司每年決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。本公司產業發展階段屬於成長期，配合未來業務發展計劃，盈餘之分配應考量國內外競爭狀況及資本預算等因素，並兼顧股東利益，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10% 時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利當年度所分配股利之 10%，實際發放金額以股東會通過金額為之。

四、截至公開說明書刊印日止之背書保證相關資訊：

截至111年03月31止；單位：新台幣千元

背書保證者 名稱	被背書保證 對象	關係	對單一企業背 書保證限額	本期最高背 書保證餘額	期末背書 保證餘額	實際動 支金額	背書保證 最高限額
達航科技股 份有限公司	大船企業(日 本)株式會社	子公司	463,017	152,098	149,017	44,707	578,771
達航科技股 份有限公司	上海達航實業 有限公司	子公司	463,017	280,428	280,428	-	578,771

附件一、內部控制制度聲明書及內部控制制度審查報告

達航科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：111年 3 月 15 日

本公司民國110年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業，每個組成要素又包括若干項目，前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國110年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國111年 3 月 15 日董事會第 111 次第 1 次董事會決議，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容。

達航科技股份有限公司

董事長：翁榮隨

總經理：陳柏棋



(簽章)

(簽章)

達航科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

No: 20211108172614

日期: 110年 11 月 08 日

本公司內控專案期間之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於110年9月30日之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、為申請上櫃之需要，本公司依據「處理準則」第二十五條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查有價證券上櫃作業程序」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下進行取得、使用或處分之重大缺失。
- 七、本聲明書將成為本公司公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 八、本聲明書業經本公司民國110年11月08日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容。

達航科技股份有限公司



董事長：翁榮隨



(簽章)

總經理：陳柏棋



(簽章)

內部控制制度審查報告

後附達航科技股份有限公司民國110年11月8日謂經評估認為其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國110年9月30日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師審查竣事。維持有效之內部控制制度及評估其有效性係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據審查結果對公司內部控制制度之有效性及上開公司之內部控制制度聲明書表示意見。

本會計師係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及一般公認審計準則規劃並執行審查工作，以合理確信公司上述內部控制制度是否在所有重大方面維持有效性。此項審查工作包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之意見提供合理之依據。

任何內部控制制度均有其先天上之限制，故達航科技股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷，達航科技股份有限公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國110年9月30日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；達航科技股份有限公司於民國110年11月8日所出具謂經評估認為其上述與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊清鎮



會計師 龔則立



中 華 民 國 1 1 0 年 1 2 月 1 日

附件二、證券承銷商評估總結意見

承銷商總結意見

達航科技股份有限公司(以下簡稱達航或該公司)本次為辦理現金增資發行新股普通股 5,806,000 股，每股面額新台幣 10 元，合計總金額新台幣 58,060,000 元整，依法向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與該公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，該公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

康和綜合證券股份有限公司



負責人：邱榮澄



承銷部門主管：呂素玲



附件三、法律意見書

律師法律意見書

達航科技股份有限公司本次募集與發行普通股 5,806,000 股，每股面額新台幣 10 元，本次募集與發行總金額新台幣 58,060,000 元，經本律師採取必要審核程序，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，達航科技股份有限公司本次向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有重大違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

達航科技股份有限公司

普華商務律師事務所
律師鍾元珪



中華民國 111 年 3 月 16 日

附件四、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書

聲明書

本公司、本公司之董事及監察人、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行爲，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：達航科技股份有限公司



負責人：翁榮隨



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之董事長，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

董 事 長：翁榮隨



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

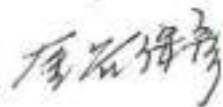
本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

董 事：金谷保彥

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

董 事：鴻圻國際股份有限公司

法人董事之代表人：稻見和明

稻見和明



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

董 事：鴻圻國際股份有限公司

負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

董 事：蕭長榮

蕭長榮

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之獨立董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

獨立董事：陳文炯

陳文炯

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

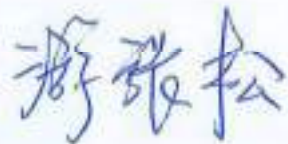
本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之獨立董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

獨立董事：游張松



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之獨立董事，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

獨立董事：梁江蔚



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之經理人，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

總經理：陳柏棋



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

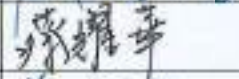
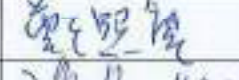
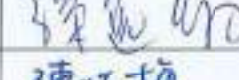
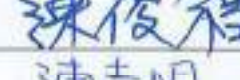
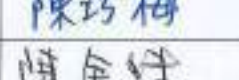
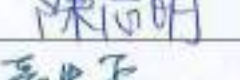
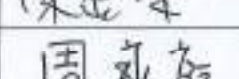
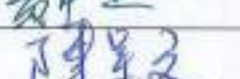
聲 明 書

本人係達航科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之經理人，茲聲明該公司申報募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案，本人絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司或其關係人或其指定之人，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人

會計主管:劉智鴻		主軸產品主管:張宸銘	
研發製造主管:蔡耀華		NDND 售服產品主管:洪進展	
稽核室主管:鄭照慶		雷射應用主管:曾黃彬	
管理中心主管:孫逸敏		營業一部主管:陳俊程	
財務主管:陳巧梅		營業一部副主管:陳志明	
人資主管:陳金珠		營業二部主管:黃中正	
CNC 技術服務主管:周永庭		營業三部主管:陳星文	
營運管理中心主管:李慧玲			

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本公司受達航科技股份有限公司（下稱達航公司）委託，擔任達航公司募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、達航公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

主辦證券承銷商：康和綜合證券股份有限公司



負責人：邱榮澄



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本公司受達航科技股份有限公司（下稱達航公司）委託，擔任達航公司募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、達航公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



協辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳 佩 君



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

本公司受達航科技股份有限公司（下稱達航公司）委託，擔任達航公司募集與發行一一一年現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、達航公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：台新綜合證券股份有限公司



負責人：郭 嘉



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

**附件五、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常
規交易情事之書面承諾**

集團企業聲明書

本公司謹依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券於證券商營業處所買賣之公開說明書應記載事項準則」之規定，承諾與下列同屬集團企業公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事

1. CHINA EXPO LTD.
2. 大船企業日本株式會社
3. 東莞達程電子有限公司
4. MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED
5. 上海達航實業有限公司

特此聲明

聲明公司：達航科技股份有限公司



負責人：翁榮隨



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明公司：CHINA EXPO LTD.

代表董事：翁榮隨

For and on behalf of
China Expo Limited,

.....
Authorized Signature(s)

中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明公司：大船企業日本株式會社

代表取締役：金谷保彦



金谷保彦

中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明公司：東莞達程電子有限公司

法人代表：陳俊程



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明公司： MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED

代表董事： 翁榮隨

For and on behalf of
Mega Trader International Limited

Authorized Signature(s)

中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明公司：上海達航實業有限公司

法人代表：劉智鴻



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明公司：ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED

代表董事：翁榮隨

For and on behalf of
ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED

Authorized Signature(s)

中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 九 日

集團企業聲明書

本公司謹依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券於證券商營業處所買賣之公開說明書應記載事項準則」之規定，承諾與下列同屬集團企業公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事

1. 大船企業股份有限公司
2. 大船開發股份有限公司
3. 大船科技股份有限公司
4. 大船國際實業有限公司
5. ARRIS CORP.
6. 達航工業(香港)有限公司
7. 大船電子(上海)有限公司
8. 達航電子設備(上海)有限公司
9. 鴻圻國際股份有限公司
10. 鴻洋投資股份有限公司

特此聲明

聲明公司：達航科技股份有限公司

負責人：翁榮隨



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：大船企業股份有限公司



負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：大船開發股份有限公司



負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，
且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：大船科技股份有限公司



負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：大船國際實業有限公司



負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：ARRIS CORP.

負責人：黃立達

ARRIS CORPORATION

黃立達

Authorized Signature

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

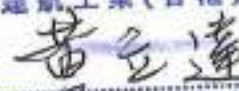
特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：達航工業(香港)有限公司

負責人：黃立達

For and on behalf of
DARHANG INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
達航工業(香港)有限公司

Authorized Signature(s)

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，
且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：大船電子(上海)有限公司

負責人：蕭傳翔



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：達航電子設備(上海)有限公司

負責人：蕭傳翔



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與達航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：



負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

集團企業聲明書

本公司與遠航科技股份有限公司間之財務、業務往來，均遵循常規辦理，且依本公司所訂各項管理制度之規定正常運作，無非常規交易之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明公司：鴻洋投資股份有限公司



負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

附件六、與本次發行有關之決議文

達航科技股份有限公司第十二屆第十三次董事會議事錄(節錄版_現金增資案)

- 一、日期：中華民國111年3月15日 上午11時30分
- 二、地點：台北市中山區南京東路一段9號 大倉久和大飯店三樓會議室
- 三、出席：董事 翁榮隨、鴻圻國際_稻見和明、蕭長榮、金谷保彥(200M視訊)；
獨立董事 陳文炯、游張松、梁江蔚。計七人全部出席，無人缺席。
- 四、列席：陳柏棋總經理、會計主管劉智鴻、稽核主管鄭照慶、財務主管陳巧梅、
管理中心主管孫逸敏、人資主管陳金珠、股務秘書李慧玲
康和證券：李育儒副總、紀秀鳳協理、郭雅君經理

五、主席：翁榮隨

翁榮隨

記錄：李慧玲



六、報告事項。

- (一) 上次會議紀錄及執行狀況：略
- (二) 重要財務業務報告：略
- (三) 內部稽核業務報告：略
- (四) 其他重要報告事項：略

七、承認及討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項：無。
- (二) 本次會議討論事項：

第一案~第四案：略

第五案

案由：本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案，提請 審議。

- 說明：1.本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股，發行股數5,806,000股，
每股面額：新台幣10元，發行總金額：新台幣58,060,000元。
- 2.發行價格：暫定發行價格為每股新台幣30元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。
- 3.員工認購股數或配發金額：870,000股
- 4.公開銷售股數：4,936,000股
- 5.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每股認購或配發股數)：本次現金增資依公司法第267條之規定，保留發行新股總數15%計870,000股由員工認購，其餘85%計4,936,000股，依證券交易法第28條之1規定及本公司110年7月5日股東會決議通過以現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購權利案，不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制，並全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
- 6.畸零股及逾期未認購股份之處理方式：員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特

定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

7. 本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股股份相同。

8. 本次增資資金用途：充實營運資金

9. 其他應敘明事項：

(1) 本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。

(2) 本次現金增資案待主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

10. 本次增資資金用途說明請參閱附件四。

11. 本案經111年3月15日審計委員會通過在案

12. 本案擬於董事會通過後，依規定於「公開資訊觀測站」發佈重訊。

決議：經主席徵詢全體出席董事，同意照案通過。

第六案~第十九案：略

八、臨時動議：無。

九、散會。

附件七、公司章程(含修正前後條文對照表)

達航科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為「達航科技股份有限公司」。(英文名稱為：OFUNA TECHNOLOGY Co., Ltd.)

第二條：本公司所營事業如下：

1. C106010 製粉業
2. CB01010 機械設備製造業
3. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
4. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
5. CC01060 有線通信機械器材製造業
6. CC01070 無線通信機械器材製造業
7. CC01080 電子零組件製造業
8. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
9. F102180 酒精批發業
10. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
11. F203030 酒精零售業
12. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
13. F207990 其他化學製品零售業
14. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
15. F218010 資訊軟體零售業
16. I103060 管理顧問業
17. I301010 資訊軟體服務業
18. I301020 資料處理服務業
19. I301030 電子資訊供應服務業
20. CB01020 事務機器製造業
21. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
22. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
23. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
24. F113010 機械批發業
25. F113020 電器批發業
26. F113070 電信器材批發業
27. F118010 資訊軟體批發業
28. F119010 電子材料批發業
29. F213010 電器零售業
30. F213060 電信器材零售業
31. F213080 機械器具零售業
32. F219010 電子材料零售業
33. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
34. JE01010 租賃業

35. C801100 合成樹脂及塑膠製造業
36. C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業
37. F401010 國際貿易業
38. F107170 工業助劑批發業
39. F207170 工業助劑零售業
40. F115010 首飾及貴金屬批發業
41. F215010 首飾及貴金屬零售業
42. J101080 資源回收業
43. J101090 廢棄物清理業
44. Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本之百分之四十。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第四條：刪除。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣玖億伍仟萬元正，分為玖仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本總額內，保留新台幣陸仟萬元，計陸佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，供員工認股權證發行之用，員工認股權憑證發給對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第五條之一：本公司股票公開發行後得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價（每股淨值）之認股價格發行員工認股權憑證。

第五條之二：本公司依相關法令規定發行員工認股權憑證，若以低於市價（每股淨值）之認股價格發行員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數股東出席股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

第五條之三：本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決議之。

第六條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行人之銀行簽蓋後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。

第七條：本公司股票若有送台灣證券集中保管公司集中保管之必要



時，係應該集中保管公司之請求，合併印製大而額股票。

- 第八條：本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載本公司變更名簿，始得對抗本公司。
- 第九條：本公司股票公開發行後，股票事務之處理辦法，概依「公開發行股票公司股票處理準則」及其他有關規定辦理。
- 第十條：股票因遺失或其他事由，補發換發時，得酌收手續費。
- 第十一條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第十二條：本公司股東會分常會及臨時會二種，股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開；股東臨時會於必要時依法召集之。本公司股東會之召集程序，應依公司法第一百七十二條規定辦理。
- 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法，除依公司法規定外，應依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條規定辦理之。
- 第十五條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股票掛牌上市(櫃)後，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。
- 第十六條之一：本公司股票公開發行後，非經股東會特別決議，不得申請停止公開發行。且於興櫃及上市櫃期間均不變動本條文。
- 第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發得依公司法第一八三條之規定辦理。

第四章 董事及審計委員會

- 第十八條：本公司設董事五至九名，任期均為三年，均由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，全體董事所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依法規定之成數。上述董事名額中，本公司於申請興櫃時，依主管機關之規定，前項董事名額中選任獨立董事

不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十八條之一：本公司股東會公開發行後得依證券交易法設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員會；其審計委員會由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。審計委員會成立之日同時替代監察人，本章程關於監察人之規定不再適用。

第十八條之二：本公司於上市上櫃期間，董事之選舉應依公司法第二〇九條之一規定採候選人提名制度。

第十九條：董事會之職權如下：

- 一、各項章程之審定。
- 二、業務方針之決定。
- 三、預算方針之審定。
- 四、盈餘分派之擬議。
- 五、資本增減之擬定。
- 六、重要不動產交易之處理。
- 七、投資事業之審議。
- 八、其他依法令或股東會所賦予之職權。

第二十條：董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補原任期之期限為限。董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任期為止。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第二十二條：董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇二條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第二十三條：董事會議除公司法另有規定外，須有過半數之董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。本公司董事會每季至少召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集通知得以書面、傳真或電子郵件(e-mail)等方式為之。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之

簽名簿及代理出席之委託書，一併保存本公司。

第廿五條：刪除

第廿六條：本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給之。本公司得經董事會決議於任期內為董事購買責任保險，以保障全體股東權益及降低公司經營風險。

第五章 經理及職員

第廿七條：本公司得設置經理人，其任免、報酬均由董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

第廿八條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

第廿九條：本公司於每會計年度終了時，董事會應編造左列表冊，依法定程序提交股東會，請求承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥3%-10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於獲利之5%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第三十條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，得不再提列；其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就當年獲利提撥不低於20%分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之20%。

第七章 附則

另冊一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅二條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅三條：本章程訂立於中華民國八十年一月十九日。

第一次修正於民國八十年五月三十一日。

第二次修正於民國八十年六月二十五日。

第三次修正於民國八十年五月十九日。

第四次修正於民國八十二年九月十五日。

第五次修正於民國八十四年五月十九日。

第六次修正於民國八十五年七月二十三日。

第七次修正於民國八十六年五月二十九日。

第八次修正於民國八十六年十二月八日。

第九次修正於民國八十八年十一月二十六日。

第十次修正於民國八十九年一月十二日。

第十一次修正於民國九十年三月十五日。

第十二次修正於民國九十年四月二十四日。

第十三次修正於民國九十一年十一月一日。

第十四次修正於民國九十四年七月十一日。

第十五次修正於民國九十四年十一月十八日。

第十六次修正於民國九十五年十二月十八日。

第十七次修正於民國九十六年十月四日。

第十八次修正於民國九十八年二月二十五日。

第十九次修正於民國一〇〇年四月十二日。

第廿次修正於民國一〇一年十二月五日。

第廿一次修正於民國一〇四年五月二十九日。

第廿二次修正於民國一〇五年五月三十日。

第廿三次修正於民國一〇六年四月二十八日。

第廿四次修正於民國一〇八年五月二十八日。

第廿五次修正於民國一〇九年八月三十日。

達航科技股份有限公司

董事長：翁 榮 隨





達航科技有限公司章程
修正條文對照表
版本：20CX1-0009-03

修正條文	現行條文	說明
第五條之一：本公司股票公開發行後得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證。 第五條之二：本公司依相關法令規定發行員工認股權憑證，若以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數股東出席股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。 第五條之三：本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決議之。	第五條之一：本公司股票公開發行後得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證。	依「發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一」規定增訂「第五條之二、第五條之三」。 員工獎勵工具對象擴及於控制、從屬公司。章程得訂明員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工新股認購權及限制員工權利新股之給付對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
第六條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司股票公開發行後，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	配合公司法第一百六十二條修正及本公司實際情形，酌為文字修訂。
第四章 董事及審計委員會	第四章 董事監察人	刪除「監察人」，改設審計委員會。

第十八條：本公司設董事五至九名，任期均為三年，均由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，全體董事所持本公司股份總數，各不得少於主管機關依法規定之成數。上述董事名額中，本公司於申請興櫃時，依主管機關之規定，<u>前項董事名額中選任獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一</u>，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	第十八條：本公司設董事五至九名，<u>監察人二至三名</u>，任期均為三年，均由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，全體董事及監察人所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依法規定之成數。上述董事名額中，本公司於申請興櫃時，依主管機關之規定，選任獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	廢除監察人，改設置審計委員會。並依據「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第三條」修訂本條文。
第十八條之一：本公司股票公開發行之後得依證券交易法設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員會；其中審計委員會由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。審計委員會成立之日同時替代監察人，本章程關於監察人之規定不再適用。	第十八條之一：本公司股票公開發行之後得依證券交易法設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員會，其中審計委員會由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。審計委員會成立之日同時替代監察人，本章程關於監察人之規定不再適用。	
第十八條之二：本公司於上市上櫃期間，董事之選任應依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。		
第二十條：董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補原任期之期限為限；董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任期為止。	第二十條：董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補原任期之期限為限，董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任期為止。	廢除監察人，改設置審計委員會。
第二十三條：董事會議除公司法另有規定外，須有過半數之董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。 董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。本公司董事會每季至	第二十三條：董事會議除公司法另有規定外，須有過半數之董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。 董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。本公司董事會每季至	廢除監察人，改設置審計委員會。

少召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集通知得以書面、傳真或電子郵件(e-mail)等方式為之。	少召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集通知得以書面、傳真或電子郵件(e-mail)等方式為之。	
第廿五條：(刪除)	第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會，但不得加入表決。	本條刪除，廢除監察人，改設置審計委員會。
第廿六條：本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給之。本公司得經董事會決議於任期內為董事購買責任保險，以保障全體股東權益及降低公司經營風險。	第廿六條：本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給之。本公司得經董事會決議於任期內為董事及監察人購買責任保險，以保障全體股東權益及降低公司經營風險。	廢除監察人，改設置審計委員會。
第廿九條：本公司於每會計年度終了時，董事會應編造左列表冊，依法定程序提交股東會，請求承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	第廿九條：本公司於每會計年度終了時，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，由監察人出具報告書，依法提交股東會，請求承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	配合本公司設置審計委員會修正。
第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥3%-10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於獲利之5%為董事酬勞，員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥3%-10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於獲利之5%為董事酬勞、員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	配合本公司設置審計委員會修正。
第卅三條：…第廿四次修正於民國一〇八年五月二十八日，第廿五次修正於民國一〇九年八月三十一日。	第卅三條：…第廿四次修正於民國一〇八年五月二十八日。	增訂本作業辦法制訂及修改沿革。

附件八、盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 329,545,321
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(2,438,424)	
減：註銷庫藏股影響之分配盈餘	(15,756,334)	(18,194,758)
加：本期稅後淨利	91,064,447	
提列法定盈餘公積（10%）	(7,286,969)	
依法提列特別盈餘公積	(15,992,521)	67,784,957
本期可供分配盈餘		379,135,520
分配項目		
股東紅利-現金額（每股 1.743647 元）	(75,000,000)	(75,000,000)
期末未分配盈餘		\$ 304,135,520

董事長：翁榮



總經理：陳柏棋



會計主管：劉智鴻



1. 擬自可供分配盈餘中提撥新台幣75,000,000元，每股分派現金股利1.743647元（計算至元為止，元以下捨去）。俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
2. 本公司流通在外股數為43,013,285股。
3. 本公司如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或其他法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

附件十四、不受理特定對象投標單聲明書

聲明書

茲聲明本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：達航科技股份有限公司



負責人：翁榮隨



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

茲聲明本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：康和綜合證券股份有限公司



負責人：邱榮澄



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

茲聲明本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

聲明書

茲聲明本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：台新綜合證券股份有限公司



負責人：郭嘉志



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

附件十五、誠信聲明書

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

申請人：達航科技股份有限公司



負責人：翁榮隨 董事長



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事長：翁榮隨



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事：金谷保彥

金谷保彥 

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事：鴻圻國際股份有限公司

法人董事之代表人：稻見和明

稻見和明



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事：鴻圻國際股份有限公司

負責人：黃立達



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事：蕭長榮



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

獨立董事：陳文炯

陳文炯

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

獨立董事：游張松



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

獨立董事：梁江蔚



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

總經理：陳柏棋



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

會計主管:劉智鴻	劉智鴻	主軸產品主管:張震銘	張震銘
研發製造主管:蔡耀華	蔡耀華	NDND 售服產品主管:洪進展	洪進展
稽核室主管:鄭照慶	鄭照慶	雷射應用主管:曾黃彬	曾黃彬
管理中心主管:孫逸敏	孫逸敏	營業一部主管:陳俊程	陳俊程
財務主管:陳巧梅	陳巧梅	營業一部副主管:陳志明	陳志明
人資主管:陳金珠	陳金珠	營業二部主管:黃中正	黃中正
CNC 技術服務主管:周永庭	周永庭	營業三部主管:陳星文	陳星文
營運管理中心主管:李慧玲	李慧玲		

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日

誠信聲明書

本會計師承辦達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 清 鎮



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 一 日

誠信聲明書

本會計師承辦達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 則 立



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 二 月 一 日



誠信聲明書

本律師承辦達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

律師事務所：普華商務法律事務所

律師：鍾元珖



中 華 民 國 1 1 0 年 1 2 月 9 日

聲 明 書

本律師承辦達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

律師事務所：翰辰法律事務所

律師：邱雅文律師



中 華 民 國 1 1 0 年 十 二 月 九 日

誠信聲明書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主辦推薦證券商：康和綜合證券股份有限公司



負責人：鄭大宇 董事長



中華民國 一 一 〇 年 十二月 九 日

誠信聲明書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦推薦證券商：台新綜合證券股份有限公司



負責人：郭嘉宏



中 華 民 國 一 一 〇 年 七 月 九 日

誠信聲明書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷達航科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦推薦證券商：兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



中 華 民 國 一 一 〇 年 七 月 九 日

附件十六、承銷價格計算書

達航科技股份有限公司

承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一) 達航科技股份有限公司(以下簡稱達航科技或該公司)申請上櫃時之實收資本額為新臺幣(以下同) 430,133 元，每股面額新臺幣 10 元整，已發行股數為 43,013 千股，另於辦理公開承銷前有員工認股權憑證 173,713 股已執行完畢，故已發行股數為 43,187 千股。該公司辦理現金增資發行新股 5,806 千股作為股票公開承銷作業之用，故預計股票上櫃掛牌時實收資本額為 489,930 千元，發行股數為 48,993 千股。

(二) 公開承銷股數來源

該公司本次申請股票上櫃，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條規定，採用現金增資發行新股之方式辦理上櫃公開承銷，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第 2 條及第 6 條規定，公開發行公司初次申請股票上櫃時，應至少提出擬上櫃股份總額 10% 以上股份，委託推薦證券商辦理承銷。另依第 6 條之規定，公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，提出承銷之股數，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷股數之 30%。該公司預計辦理股票公開承銷前已發行股數為 43,187 千股，配合本次上櫃前公開承銷，該公司擬辦理現金增資發行新股 5,806 千股，除依公司法第 267 條之規定，保留發行股份之 15%，計 870 千股供員工認購，其餘 4,936 千股則依證券交易法第 28 條之 1 規定排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，並業於 110 年 7 月 5 日股東會決議通過由原股東全數放棄認購，委由推薦證券商辦理上櫃前公開銷售作業，合計擬上櫃掛牌之實收資本額將為 489,930 千元，股數則為 48,993 千股。該公司本次提出公開承銷股數 4,936 千股已達擬上櫃股份總額 48,993 千股之 10%，符合前揭規定。

該公司爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第 2 點之規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數 15% 之額度上限，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售，惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。本推薦證券商已與該公司簽定「過額配售協議書」，並經該公司 110 年 3 月 15 日董事會決議通過，由其協調股東提出擬公開承銷股數之 15% 額度內，計 500 千股辦理過額配售。

(三) 股權分散標準

該公司截至 110 年 12 月 10 日止，股東人數共計 532 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾 50%之法人以外之記名股東人數 466 人，已逾 300 人，且其所持股份總額合計 16,329 千股，占發行股份總額 37.96%，超過 20%，已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 3 條有關人數不少於 300 人且所持有股份總額合計占發行股份總額 20% 以上或逾一千萬股之股權分散之標準。

二、申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式

(一) 承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較：

1. 承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

本推薦證券商依一般市場承銷價格訂定方式，參考市場法、成本法、收益法及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據。另參酌該公司所屬產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定股票公開承銷之承銷價。

2. 承銷價格計算方法比較

(1). 市場法

市場法主係與上市、櫃公司中產業性質相近的同業，透過已公開資訊與被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業的價值。市場上運用市價計算股價之方法，主要為本益比法及股價淨值比法。本益比法及股價淨值比法係依據公司之財務資料，計算每股盈餘及每股淨值，比較同業公司平均本益比及股價淨值比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與同業公司不同之處。

(2). 成本法

成本法近似重置成本的理論，所謂重置成本法，本指企業如要重置或重購相似資產所需花費之數額。以重置成本來估計資產之價值，即是以企業重置或重購相同獲利能力之資產所需花費之成本數額來估計其價值，且必須有相似且合理之資產價格可供參考，另外使用成本法的限制有下列四種：

A. 無法表達目前真正及外來的經濟貢獻值。

B. 忽略了技術經濟壽年。

C.技術廢舊及變革對於其所造成的風險無法預測。

D.成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，因此本推薦證券商不擬採用此種方式作為承銷價格訂定之參考依據。

(3).收益法

在股價評價方法選擇上，一般較常使用之方法為收益法下之現金流量折現法，惟考量現金流量折現法需推估公司未來數年之盈餘及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，推估營收資料之困難度提高，不確定風險相對較高，較不能合理評估公司應有之價值，故不予採用。

茲將前述各評價方式之優缺點及適用時機彙總說明如下：

項目	本益比法	股價淨值比法	成本法	收益法 (現金流量折現法)
優點	1.具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據。 2.市場價格資料容易取得。	1.淨值係長期且穩定之標。 2.當盈餘為負時之替代評估法。 3.市場價格資料容易取得。	1.資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同的關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響。 3.考量企業之成長性及風險。
缺點	1.盈餘品質易受會計方法之選擇所影響。 2.企業盈餘為負時不適用。 3.使用歷史資訊無法反映公司未來績效。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.同產業之不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。
適用時機	適合評估風險水準、成長率及股利政策穩定的公司。	適合評估有鉅額資產但股價偏低的公司。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

3. 承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

該公司主要從事印刷電路板/載板製程所需雷射鑽孔加工服務、機械鑽孔機、成型機等設備產品販售、機鑽設備關鍵零組件之維修、保養與改造的專業服務。綜觀目前國內上市、上櫃公司中，就所營業務及終端應用與該公司相似者，作為採樣公司之選樣標準，分別為上市公司大量科技股份有限公司(股票代碼：3167，以下簡稱：大量)、上櫃公司凱崙科技股份有限公司(股票代碼：5498，以下簡稱：凱崙)及尖點科技股份有限公司(股票代碼：8021，以下簡稱：尖點)，大量主要從事 CNC 精密設備生產，應用於印刷電路板製程之鑽孔定位及成型切割設備，凱崙主要從事 PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工（機械鑽孔、機械成型與雷射鑽孔）及尖點從事精密金屬製品（精密鑽針與精密銑刀）及加工服務（鑽孔服務）。

(1) 市場法

A. 本益比法

該公司所處行業歸屬為上市櫃類股之其他電子業，茲彙總該公司採樣同業公司及上市櫃類股之其他電子業最近三個月(111 年 2 月~111 年 4 月)之平均本益比列示如下表：

單位:倍

項目	採樣公司			上櫃其他 電子類股	上市其他 電子類股
	大 量 (3167)	凱 崙 (5498)	尖 點 (8021)		
111 年 2 月	8.67	34.36	12.29	20.55	11.85
111 年 3 月	12.52	66.94	11.66	18.73	12.26
111 年 4 月	10.47	56.39	10.62	17.25	11.63
平均本益比	10.55	52.56	11.52	18.84	11.91

資料來源: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所股份有限公司網站。

依上表所示，採樣公司、上市及上櫃其他電子類股最近三個月(111 年 2 月~111 年 4 月)之平均本益比約在 10.55~52.56 倍，以該公司 110 年第二季至 111 年第一季之最近四季財務報告之稅後淨利 112,212 千元及擬上櫃掛牌股數 48,993 千股推算之每股稅後盈餘 2.29 元為基礎計算，價格區間約為每股 24.16 元~120.36 元。

B. 股價淨值比法

茲就上述採樣公司及上市櫃其他電子類股最近三個月(111 年 2 月 ~111 年 4 月)之平均股價淨值比如下：

單位：倍

項目	採樣公司			上櫃其他 電子類股	上市其他 電子類股
	大 量 (3 1 6 7)	凱 崑 (5 4 9 8)	尖 點 (8 0 2 1)		
111 年 2 月	2.62	1.32	1.18	2.67	1.21
111 年 3 月	2.42	1.16	1.12	2.53	1.21
111 年 4 月	2.02	0.98	1.02	2.35	1.14
平均股價淨值比	2.35	1.15	1.11	2.52	1.19

資料來源：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

依上表得知，採樣公司、上市櫃其他電子業類股最近三個月(111 年 2 月~111 年 4 月)之平均股價淨值比約在 1.11 倍~2.52 倍，以該公司 111 年第一季經會計師核閱財務報告中歸屬於母公司業主權益之金額 1,157,543 千元，及擬上櫃掛牌股數 48,993 千股設算之每股淨值 23.63 元為計算基礎，其參考價格區間為 26.23 元~59.55 元。由於股價淨值比並未考量公司成長性，且股價淨值比法較常用於評估鉅額資產但股價偏低的公司或公營事業等，故擬不以此法來計算承銷價格。

(2) 成本法

成本法係依照一般公認會計原則將目標公司之資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值之方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。

成本法係依照一般公認會計原則將目標公司之資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值之方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。以該公司 111 年第一季經會計師核閱之財務報告中歸屬於母公司業主權益之金額 1,157,543 千元，及擬上櫃掛牌股數 48,993 千股設算之每股淨值 23.63 元，即為依成本法計算之參考價格，惟依此法未考慮公司未來獲利能力與現金流量，因此，依此法所計算之價格尚需經過調整，故較不具參考性。

(3) 收益法

收益法為現金流量折現法，係依據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考量實質現金及貨幣之時間價值來進行估算，惟考量現金流量折現法預測期間長，不僅困難度相對較高且資料未必十分準確，較不能合理評估公司應有之價值，另外投資者不易瞭解現金流量觀念，故不擬採用此法為議定承銷價格參考之依據。

綜上所述，考量達航科技所屬產業屬於營收獲利穩定之公司，並不適宜以成本法評價，而現金流量折現法需估計未來數年的營收獲利成長及現金流量、

投資率等，評價相關係數之參考價值相對較低下，因此該公司較不適合以現金流量折現法計算承銷價格。本推薦證券商為能訂定合理、客觀及具市場性之承銷價格，乃以市價法中本益比法作為該公司申請上櫃之承銷價格計算依據，尚屬合理。

(二) 申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1. 財務狀況及獲利情形

A. 財務狀況

分析項目		公司別	108年度	109年度	110年度	111年度 第一季
財務結構	負債占資產比率(%)	達航	45.88	47.20	52.24	52.99
		大量	55.06	62.10	60.91	65.93
		凱歲	42.86	42.44	51.68	52.10
		尖點	24.52	24.77	30.69	29.47
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	達航	161.88	129.58	132.52	132.77
		大量	529.57	177.67	264.99	249.15
		凱歲	239.11	252.70	155.99	172.33
		尖點	281.18	351.07	367.61	375.59

資料來源：各公司經會計師查核(閱)簽證之合併財務報告、各公司股東會年報、公開資訊觀測站及康和證券整理。

(a) 負債占資產比率

該公司負債佔資產比率最近三年度及 111 年度第一季分別為 45.88%、47.20%、52.24%及 52.99%。109 年初面對新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，終端市場需求明顯下滑，衝擊全球 PCB 產業，但也使遠距工作、線上學習等需求趁勢崛起，帶動資料中心、個人電腦、平板電腦等應用需求提升，且 5G、AI 等應用帶動高效能運算晶片需求持續放大，驅動 ABF 載板需求持續成長，受惠相關需求成長的帶動，該公司年底的預收貨款及備料準備均較去年底提升，使期末合約負債及應付帳款均較去年同期增加，致使 109 年度權益占資產比率下降，負債佔資產比率上升；110 年度因設備產銷訂單之增加，預收貨款及採購原料產生之應付帳款隨之增加，使權益占資產比率下降，負債占資產比率上升，111 年第一季負債比率較 110 年度增加幅度分別為 1.44%，係因變動幅度微小，故不擬深入分析。

該公司最近三年度及 111 年第一季負債占資產比率與採樣公司比較互有高低，該公司負債占資產比率維持在五成左右，其變動幅度不高，變動原因主係受營運面波動影響，尚無發現重大異常之情事。

(b)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司長期資金占不動產、廠房及設備比率最近三年度及111年第一季分別為161.88%、129.58%、132.52%及132.77%。109年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較108年度下滑，主係該公司106年起新增雷射鑽孔加工業務，有鑑於5G高頻高速的時代來臨，ABF載板、IC載板等高階材料之雷射鑽孔需求逐年攀升，該公司持續增加雷射機台設備，並於大甲精工廠增設雷射車間，因此不動產、廠房及設備淨額於109年度增加220,480千元所致。而110年度因109年度獲利轉入保留盈餘，權益總額增加，使長期資金佔不動產、廠房及設備比率小幅上升，111年第一季之長期資金占不動產、廠房及設備比率較110年度變動幅度0.19%，係因變動幅度微小，故不擬深入分析。

由於該公司雷射鑽孔加工業務所需，持續增加購置機器設備，致該公司最近三年度及111年度第一季長期資金占不動產、廠房及設備比率低於採樣公司，但比率仍均高於100%，顯示該公司長期資金仍足以支應不動產、廠房及設備之投資需求，尚無以短支長之現象，財務結構尚屬穩定。

綜上所述，該公司最近三年度及111年第一季財務結構變化趨勢及變動原因尚屬合理，且與採樣公司相較互有高低，顯示該公司財務結構尚屬穩健。

B.獲利能力

分析項目		公司別	108年度	109年度	110年度	111年度 第一季
獲	資產報酬率 (%)	達航	3.33	5.16	4.76	9.46
		大量	4.64	9.19	8.22	6.52
		凱崴	2.95	3.14	1.45	(1.32)
		尖點	3.49	5.06	7.22	6.22
	權益報酬率 (%)	達航	4.86	8.47	8.42	19.00
		大量	9.26	21.37	20.10	16.35
		凱崴	4.40	4.71	1.87	(3.78)
		尖點	4.44	6.54	9.82	8.69
	營業利益占實 收資本額比率 (%)	達航	10.59	24.85	29.86	63.45
		大量	26.16	25.31	68.74	37.67
		凱崴	2.93	2.17	2.94	(2.59)
		尖點	21.60	32.94	45.22	42.25
	稅前純益占實	達航	12.26	24.81	28.15	68.18
		大量	28.34	56.80	70.78	53.21

利 能 力	收資本額比率 (%)	凱崑	5.81	6.92	2.95	(3.65)
		尖點	23.28	32.81	46.80	43.60
	純益率(%)	達航	4.29	8.91	7.31	12.99
		大量	9.08	17.11	9.88	11.98
		凱崑	5.94	7.04	2.39	(4.97)
		尖點	6.75	10.23	13.02	12.72
	每股盈餘 (元)	達航	1.18	2.09	2.12	1.24
		大量	2.22	5.23	5.51	1.13
		凱崑	0.42	0.52	0.18	(0.10)
		尖點	1.34	1.98	3.14	0.72

資料來源：.各公司經會計師查核(閱)簽證之合併財務報告、各公司股東會年報、公開資訊觀測站及康和證券整理。

(a)資產報酬率及權益報酬率

該公司最近三年度資產報酬率分別為3.33%、5.16%及4.76%，權益報酬率則分別為4.86%、8.47%及8.42%。109年度營業收入因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響而小幅衰退，但在適度調整人力及辦公處所下，營業費用控管得宜較108年度減少141,114千元，使得稅後淨利仍較去年同期增加，使109年度資產報酬率及權益報酬率較去年同期上升。110年度營業收入雖隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，惟設備產銷之毛利較低，稅後損益僅較109年度上升約1.98%，而平均資產總額及平均權益總額分別增加約9.35%及2.57%，致使110年度資產報酬率及權益報酬率小幅下滑，另，111年第一季之資產報酬率及權益報酬率分別為9.46%及19.00%，係因該公司於110年第四季出貨設備產銷產品，於111年第一季已驗收認列收入，致111年度第一季較110年度之資產報酬率及權益報酬率分別成長98.73%及125.65%。

該公司最近三年度及111年第一季資產報酬率及權益報酬率與採樣公司互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好，尚無重大異常之情事。

(b)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近三年度營業利益占實收資本額比率分別為10.59%、24.66%及29.86%；稅前純益占實收資本額比率則分別為12.26%、24.81%及28.15%。109年營業收入因COVID-19疫情影響而下滑，但透過精實組織架構降低營業費用，致使營業利益及稅前純益上升，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較去年同期上升。110年度營業收入隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，使營業利益及稅前純益較109年度上升，使該兩項比率均較109年度上升，111年度第一季營業利益占實收資本額及稅前純益占實收資本額比率分別為

63.45%及68.18%，主係受惠111年第一季業績成長所致。

該公司最近三年度及111年第一季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率與採樣公司互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好。

(c)純益率及每股盈餘

最近三年度純益率分別為4.29%、8.92%及7.31%，每股盈餘分別為1.18元、2.09元及2.12元。109年度因受到美中貿易戰及新冠疫情之影響，營業收入表現下滑，雖營業收入表現下滑，但透過精實組織，營業費用較前一年度減少，稅後損益表現較前一年度上升，致使109年度純益率較前一年度上升。110年度營業收入因設備產銷收入增加而上升，較去年同期增加約24.44%，然設備產銷之毛利較不佳，使稅後損益僅較109年度上升約1.98%，其幅度小於營業收入之增加幅度，致使110年度純益率較去年同期小幅下滑。每股盈餘則是因加權平均已發行股數變動不大，其變動方向與稅後損益之變動方向相同，呈逐年增加趨勢，111年第一季純益率及每股盈餘分別為12.99%及1.24元，係因受惠111年第一季業績成長所致。

該公司最近三年度及111年第一季純益率及每股盈餘與採樣公司互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近三年度及111年第一季獲利能力各項指標雖受美中貿易戰及新冠疫情之影響，仍大致呈成長趨勢，顯示該公司獲利能力尚屬良好。

2. 本益比

請詳前述(五)2.(1)A 本益比法之評估說明。

(三) 所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本推薦證券商與該公司共同議定股票公開承銷價格，並未委請財務專家出具意見或委託鑑價機構出具鑑價報告，故本項評估尚不適用。

(四) 申請公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司係於 109 年 10 月 27 日於興櫃市場掛牌，彙整該公司最近一個月(111 年 4 月 8 日~5 月 27 日)於興櫃市場交易買賣總成交量及加權平均成交價格如下表所示：

月份	成交量(股)	平均成交價(元)
111年4月8日~5月27日	911,849	39.59

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站

另經查該公司自申請上興櫃迄今並無依櫃買中心「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，或依櫃買中心「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，故該公司自申請上興櫃日迄今並無興櫃股價波動過大、達冷卻機制或經公告為注意公布股票、暫停交易標準之情事。

(五) 推薦證券商就其與申請公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本推薦證券商與該公司議定承銷價格，係依一般市場承銷價格之訂定方式，參考上市及上櫃其他電子類股、採樣同業之本益比及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格，並衡酌公司之財務結構、市場規模、市場地位、經營績效、發行市場環境及未來產業前景等因素，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

綜上考量，本推薦證券商經參酌國際慣用之市場法下之本益比法評量，承銷價之參考價格區間為 24.16 元~120.36 元，另參酌該公司最近一個月興櫃股票市場之成交均價為 39.59 元，該公司預計初次上櫃前現金增資案之對外募資金額將循競價拍賣之方式承銷，故依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條及第 17 條規定，應以申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為最低承銷價格之上限，故以 111 年 3 月 23 日至 5 月 18 日興櫃有成交之 30 個營業日成交均價簡單算術平均數(39.77 元)之七折為上限，訂定新台幣 27.83 元為最低承銷價格(競價拍賣底標)，並以不高於最低承銷價格之 1.15 倍為上限。依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格 32.75 元，惟該均價高於最低承銷價格之 1.15 倍，故承銷價格訂為每股新臺幣 32 元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：達航科技股份有限公司



負責人簽章：翁 榮 隨



(僅限於達航科技股份有限公司一一一年現金增資股票承銷價格說明書使用)

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三 十 日

證券承銷商：康和綜合證券股份有限公司



負責人簽章：邱 榮 澄



(僅限於達航科技股份有限公司一一一年現金增資股票承銷價格說明書使用)

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三十 日

證券承銷商：兆豐證券股份有限公司



負責人簽章：陳 佩 君



(僅限於達航科技股份有限公司一一一年現金增資股票承銷價格說明書使用)

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三十 日

證券承銷商：台新綜合證券股份有限公司



負責人簽章：郭 嘉



(僅限於達航科技股份有限公司一一一年現金增資股票承銷價格說明書使用)

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三 十 日

附件十七、股票初次申請上櫃推薦證券商評估報告

達航科技股份有限公司

股票初次申請上櫃 推薦證券商評估報告

主辦推薦證券商：康和綜合證券股份有限公司



協辦推薦證券商：台新綜合證券股份有限公司



兆豐證券股份有限公司



中華民國一〇年十二月十日編制

中華民國一一年五月三十日修訂

該公司之產業、營運及其他重要風險因素

一、產業風險及營運風險

(一)銷貨集中單一產業風險

該公司主要從事機鑽設備產銷與雷射應用加工業務，其終端應用上以消費性電子或通訊產品為主，致現行產業分工中，大多集中於印刷電路板產業為主。

因應對策

該公司積極拓展自身產品技術，期望將自身技術拓展至其他產業領域上，進而提高本身產品及技術之滲透率，目前除延續強化與既有客戶間維持良好關係外，亦積極開發新客源，期望將技術運用於開發至其他產業領域上，以拓展新商機，有鑑，電子產品週期循環愈來愈短，故該公司透過雷射應用之加工服務對應，不同於其他外包託工的經營模式，該公司以自製技術製造生產營業用設備且提供客製化服務產品與完善的投產環境，進而，分擔客戶的資本投資與養護成本，以及供給少量多樣化的產品之製程需求，以達分散銷貨集中單一產業所帶來之風險。

(二)原物料短缺及飆漲下，助漲通貨膨脹：

110 年度原、物料受到美元貶值、通膨風險升高，以及各主要國家採取擴張性貨幣及政治政策等因素的干擾影響下，致原、物料取得面臨短缺或成本之上漲，恐將轉嫁到中、下游廠商的現象。

因應對策

該公司針對客戶及市場需求，應適時進行供應鏈廣度分析，透過在供應鏈中各種可能之接觸點來蒐集數據，必要時，進行數據分析以強化組織決策之能力，使供應鏈系統，得以達到優化管理之目的。

(三)景氣循環之影響

該公司主要產品應用於印刷電路板產品製程之設備與技術支援為主，應用範圍涵蓋通訊、電腦、智慧手機及車用產品等，因此，亦遭受電子產業景氣循環波動及終端品牌大廠中、長期產品開發時程與製程之影響，因此，就市場需求而言，該公司所處印刷電路板設備產業確實存有電子業傳統淡旺季節性之需求變化外，同時，承載終端品牌大廠中、長期產品開發之時程影響。

因應對策

- 1.拓展產品領域：該公司除了目前既有之設備產銷產品外，並積極發展雷射應用，另，尋求策略合作夥伴，期望將雷射應用鑽孔工藝挺進半導體等產業的開發與量產速度，降低遭受傳統電子業景氣循環之干擾。
- 2.分散銷售市場：該公司除了以台灣為中心外，亦隨著印刷電路板大廠赴中國大陸

之印刷電路板產業聚落，就近配合客戶之需求，並以技術核心之援為主軸，有別於中國大陸市場以削價競爭之策略，故該公司於中國大陸地區及韓國地區分別設置服務據點，以降低銷售單一國家市場之風險。

(四)人才確保

隨著高齡化時代來臨，鑽孔設備製造、維護及保養技術，均需仰賴技術及經驗之傳承，由於，近年來，國內技職教育政策及產業結構的變化下，具備設備維修及製造之專業人才短缺，進而造成留才及招聘不易，恐造成人力斷層之影響。

因應對策

該公司於台灣及日本設置生產基地，以及華東設置售後服務據點，且鑽孔機設備之人工需求，雖非屬高度勞力密集產業，但著重於技術養成，該公司產線技術人員，具備數十年的產業經驗累積，且該公司於臺灣及日本分別設立兩個技術團隊，不定時進行雙邊交流，必要時，派遣人員赴日研習，減少面臨人力斷層之風險。

(五)營運資金

由於，設備產業的生產週期及營業週期較長，易受市場景氣下行而產生不利影響情形。

因應對策

建置銷售客戶之基本資料，並強化授信之審核作業，必要時，限縮逾期付款客戶之交易條件，適時控管資金水位，避免產生資金週轉失衡之情事。

目 錄

壹、評估報告總評	4
一、承銷總股數說明	4
二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式	5
三、承銷風險因素說明	9
四、總結	11
貳、推薦證券商就外國申請公司應列示說明其註冊地國籍主要營運地國之總體經濟、政 經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力 之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性	12
參、產業狀況及營運風險	14
一、發行公司所屬行業營運風險	14
二、申請公司營運風險	25
肆、業務狀況	53
一、營業概況	53
二、存貨概況	76
三、最近期及最近三個會計年度之業績概況	85
四、併購他公司尚未屆滿一個完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理 性等因素	94
伍、財務狀況	95
一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上上 櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、 償債能力、經營能力、獲利能力及現金流量	95
二、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之最近期及最近三個會計年 度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情 形，並評估其對發行公司財務狀況之影響	106
三、申請公司申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益， 並評估其可行性	114
四、個體及合併財務報告之轉投資事業	117
五、申請公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依 據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至採內含價值法之員 工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響	125
六、公營事業申請股票上櫃時，其檢送之財務報告以經審計機關審定之審定報告書 替代者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及 其對財務報告之影響表示意見	125
七、推薦證券商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及 具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響	125
陸、關係人交易之評估	126
一、應針對申請公司交易金額重大或性質特殊之關係人交易執行相關評估程序（包	

括與同業及非關係人交易之比較)，以瞭解其交易之必要性，決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性.....	126
二、瞭解申請公司金額重大之關係企業應收款項是否逾期，針對逾期者，應查明其原因及有無重大異常情事.....	137
三、申請公司與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來者，應查明其原因，及利率、收付息情形有無重大異常之情事.....	137
柒、重要子公司營運情形.....	138
一、推薦證券商派員實地瞭解申請公司之重要子公司營運情形者，應具體列示其是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見.....	138
二、本國申請公司生產據點或獲利主要來自海外重要子公司者，應具體列示申請公司對其海外重要子公司在財務操作與資金調度、帳務處理、內控內稽執行及盈餘決策等事項之監管措施及實際執行情形之評估意見.....	139
捌、法令之遵循及對公司營運影響.....	140
玖、列明依櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見.....	145
拾、列明發行公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見.....	145
拾壹、評估發行公司公司治理自評報告是否允當表達其公司治理運作情形.....	145
一、維護股東權益及平等對待股東.....	145
二、強化董事會結構與運作.....	146
三、提升資訊透明度.....	146
四、落實企業社會責任.....	146
五、額外加、減分項目.....	146
拾貳、評估本國申請公司是否符合集團企業、建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定.....	147
一、評估是否符合集團企業申請股票上櫃之規定.....	147
二、評估本國申請公司是否符合建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定.....	153
三、評估外國申請公司是否符合「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第十六條至第十九條有關集團企業及第二十條至第二十三條有關投資控股公司之規定.....	153
四、評估外國申請公司是否符合本中心「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第四條第五項有關建設公司申請股票上櫃之規定.....	153
拾參、以投資控股公司申請股票上櫃者，推薦承銷商亦應就其被控股公司依應行記載事項要點第五條、第七條第四項、第十條及第十一條規定逐項評估.....	154
拾肆、本國上櫃(市)公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣者，推薦承銷商應評估本國上櫃(市)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施.....	154
拾伍、自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，推薦證券商對上列各項目應加以更新說明與評估.....	154

拾陸、其他揭露事項	154
附件一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見	155

壹、評估報告總評

一、承銷總股數說明

(一) 達航科技股份有限公司(以下簡稱達航科技或該公司)申請上櫃時之實收資本額為新台幣(以下同)430,133 千元，每股面額新台幣 10 元整，已發行股數為 43,013 千股，另於辦理公開承銷前有員工認股權憑證 173,713 股已執行完畢，故已發行股數為 43,187 千股。該公司擬於股票初次申請上櫃經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 5,806 千股作為股票公開承銷作業之用，故預計股票上櫃掛牌時實收資本額為 489,930 千元，發行股數為 48,993 千股。

(二) 公開承銷股數來源

該公司本次申請股票上櫃，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條規定，採用現金增資發行新股之方式辦理上櫃公開承銷，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第 2 條及第 6 條規定，公開發行公司初次申請股票上櫃時，應至少提出擬上櫃股份總額 10%以上股份，委託推薦證券商辦理承銷。另依第 6 條之規定，公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，提出承銷之股數，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷股數之 30%。該公司預計辦理股票公開承銷前已發行股數為 43,187 千股，配合本次上櫃前公開承銷，該公司擬辦理現金增資發行新股 5,806 千股，除依公司法第 267 條之規定，保留發行股份之 15%，計 870 千股供員工認購，其餘 4,936 千股則依證券交易法第 28 條之 1 規定排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，並業於 110 年 7 月 5 日股東會決議通過由原股東全數放棄認購，委由推薦證券商辦理上櫃前公開銷售作業，合計擬上櫃掛牌之實收資本額將為 489,930 千元，股數則為 48,993 千股。該公司本次提出公開承銷股數 4,936 千股已達擬上櫃股份總額 48,993 千股之 10%，符合前揭規定。

(三) 過額配售

該公司爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第 2 點之規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數 15%之額度上限，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售，惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。本推薦證券商已與該公司簽定「過額配售協議書」，並經該公司 110 年 3 月 15 日董事會決議通過，由其協調股東提出擬公開承銷股數之 15%額度內，計 740 千股為上限，辦理過額配售，惟主辦推薦證券商得依市場需求決定過額配售數量。依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第 2 條第 1 項第 1 款之規定，主

辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數百分之十五之額度上限，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售，惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。本推薦證券商已與該公司簽定「過額配售協議書」，並經該公司 110 年 3 月 15 日董事會決議通過，由其協調股東提出擬公開承銷股數之 15% 額度內辦理過額配售，惟主辦推薦證券商得依市場需求決定過額配售數量。

(四) 股權分散標準

該公司截至 110 年 08 月 30 日止，股東人數共計 526 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數 491 人，且其所持股份總額合計 15,575 千股，占發行股份總額 36.22%，已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 3 條有關股權分散之標準。

二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式

(一) 承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1. 承銷價格訂定所採用之方法、原則或計算方式

股票價值之評價方式多樣，各有其優缺點，評估結果亦有所差異。茲將目前市場上常用之股價評價方式分述如下：

(1) 市場法

市場法主係與上市、櫃公司中產業性質相近的同業，透過已公開資訊與被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業的價值。市場上運用市價計算股價之方法，主要為本益比法及股價淨值比法。本益比法及股價淨值比法係依據公司之財務資料，計算每股盈餘及每股淨值，比較同業公司平均本益比及股價淨值比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與同業公司不同之處。

(2) 成本法

成本法近似重置成本的理論，所謂重置成本法，本指企業如要重置或重購相似資產所需花費之數額。以重置成本來估計資產之價值，即是以企業重置或重購相同獲利能力之資產所需花費之成本數額來估計其價值，且必須有相似且合理之資產價格可供參考，另外使用成本法的限制有下列四種：

- A. 無法表達目前真正及外來的經濟貢獻值。
- B. 忽略了技術經濟壽年。
- C. 技術廢舊及變革對於其所造成的風險無法預測。
- D. 成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，因此本推薦證券商不擬採用此種方式作為承銷價格訂定之參考依據。

(3)收益法

在股價評價方法選擇上，一般較常使用之方法為收益法下之現金流量折現法，惟考量現金流量折現法需推估公司未來數年之盈餘及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，推估營收資料之困難度提高，不確定風險相對較高，較不能合理評估公司應有之價值，故不予採用。

茲將前述各評價方式之優缺點及適用時機彙總說明如下：

項目	本益比法	股價淨值比法	成本法	收益法 (現金流量折現法)
優點	1.具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據。 2.市場價格資料容易取得。	1.淨值係長期且穩定之標。 2.當盈餘為負時之替代評估法。 3.市場價格資料容易取得。	1.資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同的關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響。 3.考量企業之成長性及風險。
缺點	1.盈餘品質易受會計方法之選擇所影響。 2.企業盈餘為負時不適用。 3.使用歷史資訊無法反映公司未來績效。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.同產業之不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。
適用時機	適合評估風險水準、成長率及股利政策穩定的公司。	適合評估有鉅額資產但股價偏低的公司。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及現金流量折現法之比較

(1)市場法

該公司主要從事提供印刷電路板/載板製程所需雷射鑽孔加工服務、機械鑽孔機、成型機等設備產品販售、機鑽設備關鍵零組件之維修、保養與改造

的專業服務。綜觀目前國內上市、上櫃公司中，就所營業務及終端應用與該公司相似者，作為採樣公司之選樣標準，分別為上市公司大量科技股份有限公司(股票代碼：3167，以下簡稱：大量)、上櫃公司凱崑科技股份有限公司(股票代碼：5498，以下簡稱：凱崑)及尖點科技股份有限公司(股票代碼：8021，以下簡稱：尖點)，大量主要從事 CNC 精密設備生產，應用於印刷電路板製程之鑽孔定位及成型切割設備，凱崑主要從事 PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工（機械鑽孔、機械成型與雷射鑽孔）及尖點從事精密金屬製品（精密鑽針與精密銑刀）及加工服務（鑽孔服務）。

A. 本益比法

該公司所處行業歸屬為上市櫃類股之其他電子類，茲彙總該公司採樣同業公司及上市櫃類股之其他電子類股最近三個月(110 年 8 月 ~110 年 10 月)之平均本益比列示如下表：

單位:倍

項目	採樣公司			上櫃其他 電子類股	上市其他 電子類股
	大 量 (3167)	凱 崑 (5498)	尖 點 (8021)		
110 年 08 月	9.75	32.45	14.31	22.33	12.16
110 年 09 月	10.64	29.53	13.85	21.24	11.91
110 年 10 月	11.95	27.92	14.43	21.58	12.06
平均本益比	10.78	29.97	14.20	21.72	12.04

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所股份有限公司網站。

依上表所示，採樣公司、上市及上櫃其他電子類股最近三個月(110 年 8 月~110 年 10 月)之平均本益比約在 10.78~29.97 倍，以該公司 109 年第四季至 110 年第三季之最近四季經會計師查核簽證或核閱財務報告之稅後淨利 91,759 千元及擬上櫃掛牌股數 48,749 千股計算之追溯調整後每股稅後盈餘 1.88 元為基礎計算，價格區間約為每股 20.26 元~56.34 元。

B. 股價淨值比法

茲就上述採樣公司及上市櫃其他電子業類股最近三個月(110 年 8 月 ~110 年 10 月)之平均股價淨值比如下：

單位:倍

項目	採樣公司			上櫃其他 電子類股	上市其他 電子類股
	大 量 (3167)	凱 崑 (5498)	尖 點 (8021)		
110 年 08 月	2.62	1.53	1.27	2.63	1.28
110 年 09 月	2.85	1.39	1.23	2.50	1.25
110 年 10 月	3.21	1.32	1.28	2.54	1.27

項目	採樣公司			上櫃其他 電子類股	上市其他 電子類股
	大 量 (3 1 6 7)	凱 歲 (5 4 9 8)	尖 點 (8 0 2 1)		
平均股價淨值比	2.89	1.41	1.26	2.56	1.27

資料來源：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

依上表得知，採樣公司、上市櫃其他電子業類股最近三個月(110 年 8 月~110 年 10 月)之平均股價淨值比約在 1.26 倍~2.89 倍，以該公司 110 年截至第三季經會計師核閱之財務報告中歸屬於母公司業主權益之金額 1,048,619 千元，及擬上櫃掛牌股數 48,749 千股計算之每股淨值 21.51 元為計算基礎，其參考價格區間為 27.10 元~62.16 元。由於股價淨值比並未考量公司成長性，且股價淨值比法較常用於評估鉅額資產但股價偏低的公司或公營事業等，故擬不以此法來計算承銷價格。

(2)成本法

成本法係依照一般公認會計原則將目標公司之資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值之方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。

依該公司 110 年前三季經會計師核閱之財務報告之每股淨值 24.38 元，即為依成本法計算之參考價格，惟依此法未考慮公司未來獲利能力與現金流量，因此，依此法所計算之價格尚需經過調整，故較不具參考性。

(3)現金流量折現法

現金流量折現法係依據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考量實質現金及貨幣之時間價值來進行估算，惟考量現金流量折現法預測期間長，不僅困難度相對較高且資料未必十分準確，較不能合理評估公司應有之價值，另外投資者不易瞭解現金流量觀念，故不擬採用此法為議定承銷價格參考之依據。

綜上所述，考量達航科技所屬產業屬於營收獲利穩定之公司，並不適宜以成本法評價，而現金流量折現法需估計未來數年的營收獲利成長及現金流量、投資率等，評價相關係數之參考價值相對較低下，因此該公司較不適合以現金流量折現法計算承銷價格。本推薦證券商為能訂定合理、客觀及具市場性之承銷價格，乃以市價法中本益比法作為該公司申請上櫃之承銷價格計算依據，尚屬合理。

(二) 申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1.財務狀況及獲利情形

請詳本評估報告「伍、一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比

率之比較分析－應包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力與現金流量」之評估說明。

2. 本益比

請詳本評估報告「壹、評估報告總評、二、(一)2.(1)A. 本益比法」之評估說明。

(三) 所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本推薦證券商與該公司共同議定股票公開承銷價格，並未委請財務專家出具意見或委託鑑價機構出具鑑價報告，故本項評估尚不適用。

(四) 申請公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司係於 109 年 10 月 27 日於興櫃市場掛牌，彙整該公司最近一個月(110 年 10 月 1 日~110 年 10 月 31 日)於興櫃市場交易買賣總成交量及加權平均成交價格如下表所示：

月份	成交量(股)	平均股價(元)
(110年10月1日~10月31日)	81,699	27.45

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站

註：平均股價係以加權算術平均數計算。

另經查該公司自申請上興櫃迄今並無依櫃買中心「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，或依櫃買中心「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，故該公司自申請上興櫃日迄今並無興櫃股價波動過大、達冷卻機制或經公告為注意公布股票、暫停交易標準之情事。

(五) 推薦證券商就其與申請公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本推薦證券商與該公司議定承銷價格，係依一般市場承銷價格之訂定方式，參考上市及上櫃其他電子類股、採樣同業之本益比及該公司最近一個月(110 年 10 月 1 日~110 年 10 月 31 日)之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格。依照上述定價模式之參考價格區間為 20.26 元~56.34 元之間，另參酌該公司最近一個月興櫃股票市場之成交均價為 27.45 元，考量初次上櫃股票流通性風險貼水，並衡酌公司之財務結構、市場規模、市場地位、經營績效、發行市場環境及未來產業前景等因素，由本推薦證券商與該公司共同議定承銷價格暫定為每股新臺幣 30 元。

三、承銷風險因素說明

本次承銷相關風險依股價變化過鉅、穩定價格策略、本次承銷之相關費用及承銷手續費率、新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利等四項分別評估說明如下：

(一) 股價變化過鉅

該公司本次承銷價格，已考量該公司未來經營績效、同業狀況及發行市場現況等因素後而予以調整，因此，本次承銷價格應尚能合理反映該公司之市場價值，且本推薦證券商未來訂定承銷價格時，將再確實評估該公司企業真實價值、相關之產業變化及發行市場現況等，作為調整承銷價格之參考依據，以使該公司初次上櫃股票承銷價格合理化。另本推薦證券商已依「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，擬訂穩定價格策略，應可有效降低股價變化過鉅之風險。

(二) 穩定價格策略

1. 過額配售機制

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本推薦證券商已與達航科技簽訂「過額配售協議書」，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數 15% 額度，計 731 千股為上限，提供已發行普通股股票供本推薦證券商辦理過額配售。本推薦證券商負責規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。

2. 特定股東限制

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本推薦證券商已與該公司簽訂「過額配售協議書」，除依規定應提出強制集保股份外，並由該公司協調符合法令規定之特定股東，就其所持有之已發行普通股股票，於掛牌日前自願送存台灣集中保管結算所股份有限公司集保並承諾於掛牌日起三個月內不得賣出，以維持承銷價格穩定。

(三) 本次承銷之相關費用及承銷手續費率

本次承銷相關費用如律師、會計師簽證費、公開說明書印製、法人說明會等相關支出均已估列在該公司年度財務預算中，另承銷手續費將參考未來辦理公開承銷時市場行情議定，且依會計研究發展基金會 92 年 9 月 3 日(92)基秘字第 223 號解釋函「公司因發行新股而支出之必要外部成本，得作為發行溢價之資本公積之減項」，承銷手續費尚不影響該公司稅後純益，故對本次承銷風險而言，尚屬有限。

(四) 新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利

該公司為配合申請股票初次上櫃交易並考量未來整體營運計畫，預計將發行新股 5,806 千股，使增資後已發行股份總額將增加至 48,993 千股，本次現金增資發行新股占該公司增資後股數之 11.85%，而本推薦證券商與該公司議訂承銷價格時業已考量本次發行新股之稀釋效果，故對本次承銷風險之影響尚屬有限，應可有效降低股本膨脹對獲利稀釋之影響性。

四、總結

(一) 本推薦證券商經評估該公司之產業、業務、人力資源及財務狀況後，綜合該公司之營運風險、財務風險及潛在風險等說明如下：

1.銷貨集中單一產業風險

該公司主要從事機鑽設備產銷與雷射應用加工業務，其終端應用上以消費性電子或通訊產品為主，致現行產業分工中，大多集中於印刷電路板產業為主。

因應對策

該公司積極拓展自身產品技術，期望將自身技術拓展至其他產業領域上，進而提高本身產品及技術之滲透率，目前除延續強化與既有客戶間維持良好關係外，亦積極開發新客源，期望將技術運用於開發至其他產業領域上，以拓展新商機，有鑑，電子產品週期循環愈來愈短，故該公司透過雷射應用之加工服務對應，不同於其他外包託工的經營模式，該公司以自製技術製造生產營業用設備且提供客製化服務產品與完善的投產環境，進而，分擔客戶的資本投資與養護成本，以及供給少量多樣化的產品之製程需求，以達分散銷貨集中單一產業所帶來之風險。

2.原物料短缺及飆漲下，助漲通貨膨脹：

110 年度原、物料受到美元貶值、通膨風險升高，以及各主要國家採取擴張性貨幣及政治政策等因素的干擾影響下，致原、物料取得面臨短缺或成本之上漲，恐將轉嫁到中、下游廠商的現象。

因應對策

該公司針對客戶及市場需求，應適時進行供應鏈廣度分析，透過在供應鏈中各種可能之接觸點來蒐集數據，必要時，進行數據分析以強化組織決策之能力，使供應鏈系統，得以達到優化管理之目的。

3.景氣循環之影響

該公司主要產品應用於印刷電路板產品製程之設備與技術支援為主，應用範圍涵蓋通訊、電腦、智慧手機及車用產品等，因此，亦遭受電子產業景氣循環波動及終端品牌大廠中、長期產品開發時程與製程之影響，因此，就市場需求而言，該公司所處印刷電路板設備產業確實存有電子業傳統淡旺季節性之需求變化外，同時，承載終端品牌大廠中、長期產品開發之時程影響。

因應對策

(1)拓展產品領域：該公司除了目前既有之設備產銷產品外，並積極發展雷射應用，另，尋求策略合作夥伴，期望將雷射應用鑽孔工藝挺進半導體等產業的開發與量產速度，降低遭受傳統電子業景氣循環之干擾。

(2)分散銷售市場：該公司除了以台灣為中心外，亦隨著印刷電路板大廠赴中國大陸之印刷電路板產業聚落，就近配合客戶之需求，並以技術核心之援為主軸，有別於中國大陸市場以削價競爭之策略，故該公司於中國大陸地區及韓國地區分別設置服務據點，以降低銷售單一國家市場之風險。

4.人才確保

隨著高齡化時代來臨，鑽孔設備製造、維護及保養技術，均需仰賴技術及經驗之傳承，由於，近年來，國內技職教育政策及產業結構的變化下，具備設備維修及製造之專業人才短缺，進而造成留才及招聘不易，恐造成人力斷層之影響。

因應對策

該公司於台灣及日本設置生產基地，以及華東設置售後服務據點，且鑽孔機設備之人工需求，雖非屬高度勞力密集產業，但著重於技術養成，該公司產線技術人員，具備數十年的產業經驗累積，且該公司於台灣及日本分別設立兩個技術團隊，不定時進行雙邊交流，必要時，派遣人員赴日研習，減少面臨人力斷層之風險。

5.營運資金

由於，設備產業的生產週期及營業週期較長，易受市場景氣下行而產生不利影響情形。

因應對策

建置銷售客戶之基本資料，並強化授信之審核作業，必要時，限縮逾期付款客戶之交易條件，事實控管資金水位，避免產生資金週轉失衡之情事。

(二) 推薦證券商對申請公司評估之結果，作為推薦申請公司申請上櫃之依據

綜上所述，該公司雖存有相關風險，然該公司之因應對策尚屬允當，且本推薦證券商於輔導期間對該公司所進行之瞭解及評估，已考量該公司之未來經營績效、同業狀況及發行市場現況，各項條件均已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」所規定之上櫃標準，且該公司之營運績效尚屬穩定，相關營運及財務風險尚屬有限。因此，為使該公司業績持續成長、增加資金籌措管道、提高公司知名度以延攬優秀人才、達到永續經營之目的，並為國內資本市場提供良好之投資標的，是以本推薦證券商推薦達航科技申請股票上櫃。

貳、推薦證券商就外國申請公司應列示說明其註冊地國籍主要營運地國之總體經濟、政經環

境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性

該公司非屬外國申請公司，故不適用本項評估。

參、產業狀況及營運風險

一、發行公司所屬行業營運風險

達航科技成立於民國 80 年 2 月，主要從事印刷電路板製程中所需的鑽孔機台及成型機台的生產販售業務，以及其效能提升、關鍵零組件的維修與保養等服務，旗下自創品牌為「vela」，另該公司 106 年起自行開發成功 Vela CO2 雷射鑽孔機台，提供客製化雷射鑽孔加工的專業服務，主要銷售及服務對象為國內上市櫃印刷電路板大廠，主要銷售地區為台灣及中國大陸市場。茲就該公司所屬印刷電路板之產業概況說明如下：

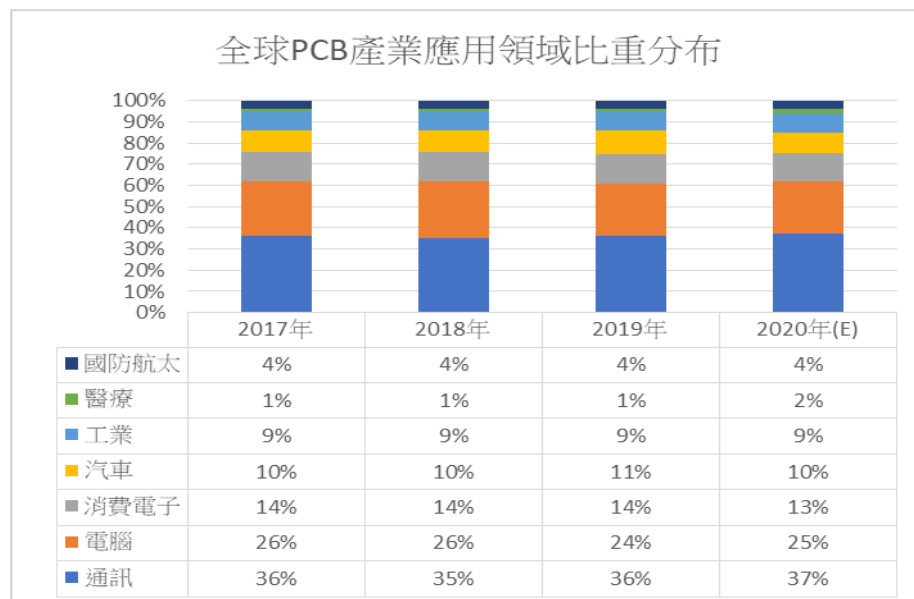
(一)產業概況

該公司所生產及銷售之 PCB 鑽孔機/PCB 成型機等設備，係屬 PCB 產業中游之鑽孔設備，另提供雷射加工應用服務，如：CO2 雷射鑽孔機台維護保養、協助提升雷射機台之效率以及雷射加工服務等，其應用係包含 PCB、光電及半導體產業之生產加工設備，因此就印刷電路板產業概況進行說明。

1.PCB 產業概況

印刷電路板（Printed circuit board；PCB）為電子產品之母，所有電子產品皆需使用 PCB，PCB 是將電子零件之間複雜的電路，蝕刻在一塊板子上，提供電子零組件在安裝與互聯的支撐，主要功用在固定電子零件、提供零件電流，因此也有 3C 產業之母的稱號。目前國內印刷電路板類型約可分類成單面板、雙面板、多層板、軟板、軟硬結合板、IC 載板等種類型，印刷電路板為各項電子產品之關鍵零組件，主要用於承載各電子元件及元件間訊息傳遞之媒介，產品廣泛應用於電子產品包括穿戴式裝置、個人電腦、平板電腦、網通、伺服器/儲存器、車用電子、5G、各類消費性電子產品等(詳圖一)。

圖一、全球 PCB 產業應用領域比重分布



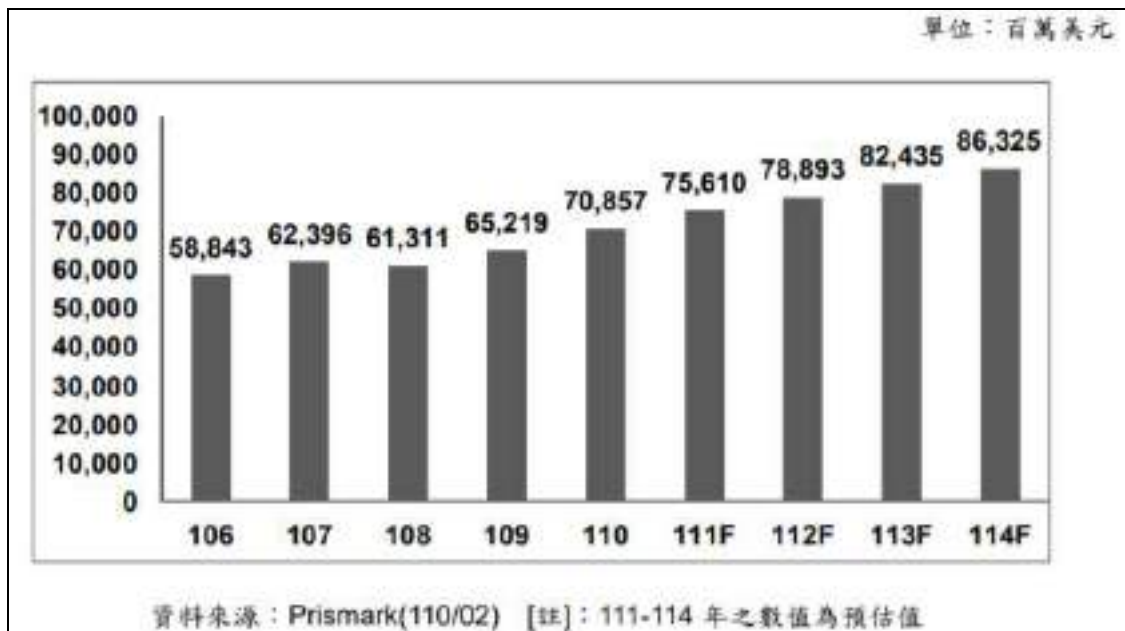
資料來源：台灣電路板協會(TPCA)、N.T.Information、台灣經濟研究院

(1) 全球 PCB 產業概況

109 年全球電子產業週期受到新冠肺炎(Covid-19)影響，多數工廠在第一季停工，使得週期延長，以及因隨著疫情持續升溫，終端消費需求減少，影響全球印刷電路板產業，所幸下半年全球 5G 通訊基礎建設陸續進入建設及 5G 智慧型手機印刷電路板商機逐步發酵，將提升各式印刷電路板在電子產業的高度應用與重要性，以及防疫下的遠距辦公、宅娛樂應用方面開發的電子設備及系統需求，也將帶動包括伺服器及穿戴裝置等各式印刷電路板需求持續增長。

根據 Prismark 預測，全球印刷電路板產值由 98 年的 412 億美元增長到 108 年的 613 億美元，成長幅度 49.0%，預估 110 年 PCB 行業預計成長率為 8.6%，109 年至 114 年之間以 5.8% 年複合增長率成長，至 114 年全球 PCB 行業產值將達到 863.3 億美元（詳圖二）。

圖二、106-114 年全球印刷電路板市場規模



從圖三可以看到全球 PCB 主要產品產值表現，在 109 年主要產品產值表現以 IC 載板、HDI 板表現相對較佳。IC 載板的主要成長動能主要來自 NB、伺服器、網通設備等應用需求明顯成長，加上雲端運算、AI 及 5G 基礎建設等應用持續增溫，帶動 ABF 載板市場需求持續增溫；而 HDI 板則主要來自手機主板規格升級及 NB、電動汽車等應用擴大導入；軟板、單雙層板受智慧手機、汽車市場需求下滑，表現相對疲弱。

圖三、全球主要 PCB 產品產值概況

(單位：百億美元)	2019年	2020年(e)		
	金額	金額	比重	年增率
IC載板	8,139	10,031	15.7%	23.2%
單雙面板	8,092	7,661	12.0%	-5.3%
多層板	23,877	24,476	38.3%	2.5%
HDI板	9,008	9,575	15.0%	6.3%
軟板	12,195	12,238	19.1%	0.4%

資料來源：台灣電路板協會(TPCA)、台經院產經資料庫

109 年初受新冠肺炎疫情(Covid-19)蔓延，導致廠商延後開工，衝擊供應鏈運作，全球經濟停滯也影響第一季產值表現，上班族在家辦公，學校使用遠距教學，反而帶動了伺服器及雲端儲存的需求，有望成為 PCB 產業的成長主軸。由於建置雲端網路系統所需資料中心、網路工作站，須配置大量網通設備、光通訊設備、電源設備、伺服器、散熱設備，其中，伺服器、網路交換器所搭載 IC，即需使用大量 IC 載板。

雲端網路應用之外，AI 應用已成為推動 IC 載板市場需求成長另一要角；機器視覺、語音辨識、大數據分析等科技，持續拓展不同生活應用層面，不只因此加速 AI 伺服器系統布建速度，更全面性擴大刺激雲端、終端 AI 高速運算晶片搭載需求。

以全球 AI 晶片市場規模而言，有機會自 108 年的 113 億美元，明顯大幅成長至 112 年 418 億美元，期間年複合成長率達 38.70%。如以公有雲市場而言，市場規模則有望自 108 年的 830 億美元，成長至 112 年時 1,791 億美元，期間年複合成長率亦達 21.20%；二大應用板塊的中長期成長向上趨勢，將為 IC 載板市場造就剛性需求。

(2) 臺灣 PCB 產業之概況與發展

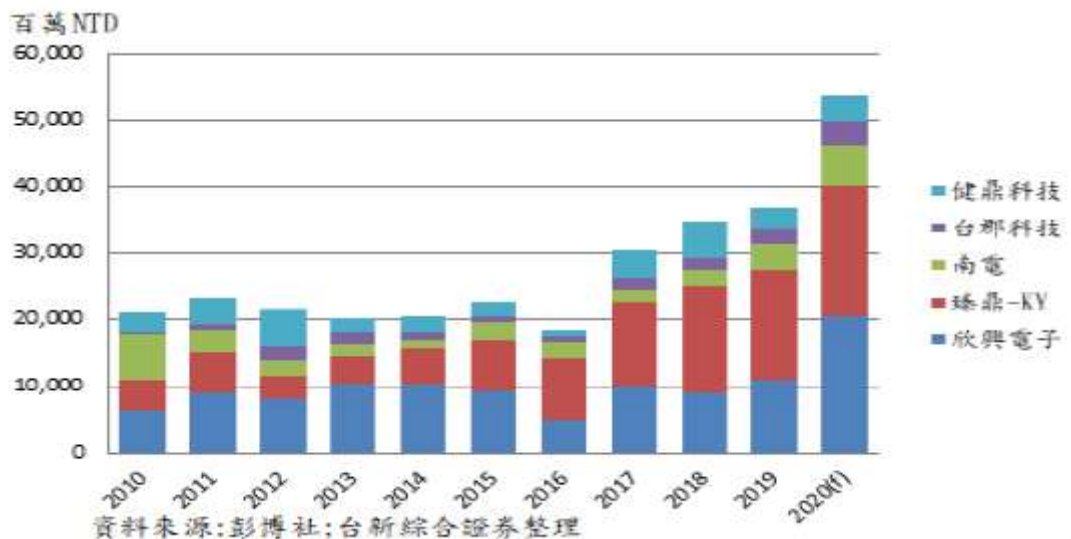
台灣在全球各式印刷電路板產業佔有舉足輕重的地位，據 Prismark 資料顯示，以生產地為基準，109 年大陸、日本、美國、歐洲之生產規模分別佔全球之 53.7%、8.8%、4.4%及 2.5%，全球超過 1/2 的各式印刷電路板在大陸生產，為全球最大之印刷電路板生產基地，亞洲其他以台系、韓系 PCB 廠商為主。而 109 年全球電路板產值年成長率 9.4%，台灣電路板成長率則優於全球，創下 10.2%(以原始訂單美金計算)，保守預估 110 年全球電路板產值可成長約 6%(詳圖四)。

圖四、台灣電路板產值規模趨勢



自 106 年以來，受惠於智慧手機規格持續提升，資料中心建置潮驅動伺服器升級需求，加上手機大廠的真無線藍芽耳機(TWS)的推出，使得 HDI 板、軟板、軟硬結合板等出貨持續增溫。除此之外，在物聯網(IOT)、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)等應用需求持續提升下，帶動微處理器(MCU)、繪圖晶片(GPU)、基地台晶片、伺服器晶片等封裝需求持續增溫，且由於晶片設計日趨複雜，在新增產能相對有限下，IC 載板市場供需轉趨吃緊，報價不斷走揚，帶動 IC 載板產值表現亦呈現穩定成長。著眼於各國持續投入 5G 基礎建設的建置、5G 手機市場規模將逐步擴大，國際主要品牌車廠加速投入電動車市場的布局，且 5G、AI 應用蓬勃發展將帶動高效能運算晶片市場需求持續增溫。為有效滿足市場需求，台廠 109 年加速投入高階軟板、HDI 板及 IC 載板產能的擴充，新產能將於 110 年起逐步開出。如圖五，台灣主要 IC 載板供應商也擴大在臺投資，如欣興在桃園楊梅設置新廠，擴增高階 IC 載板產能，臻鼎、南電、台郡也因應 5G 轉型，擴大 PCB 的資本支出。

圖五、臺灣主要印刷電路板大廠資本支出規模



在 PCB 的產品裡面，IC 載板因受惠於 5G、高效能運算等應用需求帶動 ABF 載板需求增溫，且產能大多位於台灣，帶動 ABF 載板出貨大幅提升，加

上 5G 手機、機上盒、記憶體等應用有效支撐 BT 載板出貨表現，驅使我國 IC 載板製造業 109 年上半年產值表現亮眼。根據經濟部工業生產統計磁帶資料顯示(詳見圖六)，109 年上半年我國 IC 載板製造業產值達 458 億元，年增率高達 25%，呈現強勁的成長力道。

圖六、我國 IC 載板產值及年增率走勢



資料來源：經濟部工業生產統計磁帶資料、台灣經濟研究院

雖然受到疫情影響，導致全球經濟停滯，但產業的發展只會延後不會消失，5G、高效能運算和人工智慧等應用依舊帶動 PCB 產品強勁需求。

(3) PCB 產業之發展趨勢

A. 新能源車發展趨勢

近年，汽車產業呈現逐年衰退，但在受到各國政府補貼政策的激勵，包含純電動車（BEV）與插電混合式電動車（PHEV）在內的新能源車，在整體車市衰退下仍保持銷售正成長。

燃油車跟電動車(新能源車)動力、傳動不同，傳統車較多的是機械相關，電動車則是透過電池，要應付內部各種直流電、交流電的變化，會採用更重的銅、和更高層數的設計，加上視聽娛樂、導航、雷達，到 ADAS、自動駕駛等其他不同功能的控制系統，每一個功能就要一塊 PCB，這也使得未來電動車的 PCB 需求量增大，單量電動車的 PCB 產值預估為 100 美元以上，優於燃油車的 60~70 美元，再加上現有的燃油車也有不少搭載自駕跟車系統，汽車內含的電路板越來越多，汽車電子化的趨勢下，仍是非常具有成長潛力的領域。

根據 TrendForce 旗下拓璞產業研究院統計數據指出，預估 109 年銷售量為 240 萬輛，到了 111 年，預期全球的新能源車規模將達到近 500 萬輛。



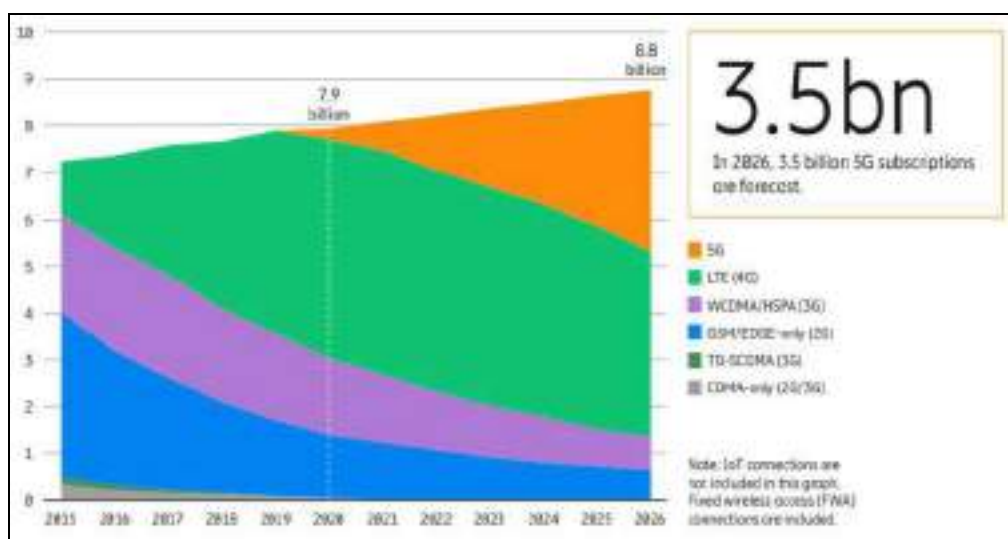
資料來源：拓璞產業研究院，NOV,109

而電動車未來勢必會朝向更輕量化、乘載更多電池、更高續航的方向邁進，而 HDI 具備輕薄短小的優勢，因此相關製程逐漸走入汽車板當中，未來電動車需求持續成長的話，預期將有更多 HDI 製程的 PCB 廠可望受益。

B. 5G 新浪潮帶動相關產業

第四代行動通訊(4G)自 102 年開始發展並普及以來已邁入了第 8 個年頭，隨著民眾對於傳輸網速要求以及物聯網對於高速聯網的需求不斷的提升，第五代行動通訊(5G)技術也開始孕育而生。自 108 年開始，各國 5G 服務陸續上路，5G 用戶數逐步放大，根據 EricssonMobilityReport 的統計，109 年時全球約有 2.2 億 5G 用戶數，到了 115 年時，全球 5G 用戶數預估將成長到 35 億戶。而目前則有 412 家電信商針對 131 國家/地區進行 5G 領域投資，135 家電信商即將在 50 個國家/地區啟動 5G 服務。

全球 5G 用戶數

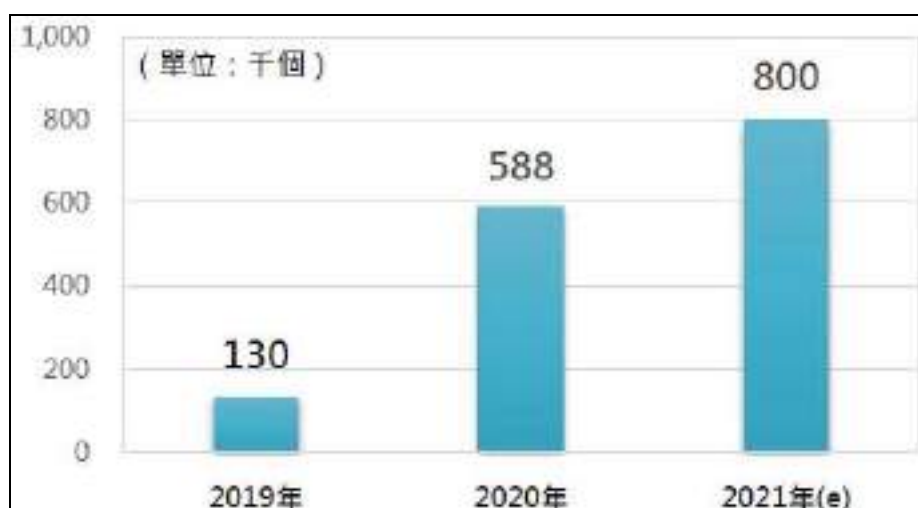


資料來源：EricssonMobilityReportNovember109

中國自 108 年開始也積極推動 5G 建設，預計投資 2.5 兆人民幣建設 5G

新基建。中國工信部統計，預計到 110 年將會建設逾 80 萬座 5G 基地台。而歐美 5G 基礎建設在 109 年受疫情及美中科技戰影響 5G 基地台的布建速度。為了加速 5G 服務普及，110 年歐美電信商將加快 5G 基地台等基礎建設的建置，以擴大 5G 服務的覆蓋率。因此當全球加速佈建 5G 基地台，開始 5G 時代的元年。而新世代通訊基地台需求急升，帶旺相關零組件產業鏈，PCB 產業鏈便是其中之一。

中國新增 5G 基地台數量



資料來源：中國工信部

根據研究機構 Prismark 指出，5G 行動通訊時代將帶動智慧手機規格、物聯網及汽車電子複雜度的提升等一系列終端應用產品升級，而軟板、HDI 板及多層板業者將是主要受惠者。由於通信設備對 PCB 需求主要以多層板為主(8-16 層板比重約 35.2%)，隨著 5G 開始商轉，通信設備的高頻高速將是必然趨勢，且基地台站所使用的 PCB 面積將會是 4G 基地台所使用的 1.55 倍，因此高頻高速 PCB 板需求將會顯著增加，相關 PCB 廠商也積極在高階 HDI 板上著墨。各項 5G 通訊設備 PCB 需求如下表一：

表一、各項 5G 通訊設備 PCB 需求一覽表

	基礎建設		行動 終端設備	用戶 終端設備	5G 應用
	戶外 大型基地台	小型基地台	智慧手機	路由器 交換器	各式 連網設備
	多層板 高頻高速板 ABF 載板	高頻多層板 高頻微波板	天線軟板 AiP 載板 SiP 載板	多層板 高頻高速板	多層板 高頻高速板 金屬基板
PCB 需求					

資料來源：工研院產科國際所、台灣經濟研究院產經資料庫

近年隨著全球智慧型手機需求飽和，相關供應鏈業者已開始將未來成長動能寄望於 5G 上路後所帶來的新興商機，各國電信業者也正積極展現布建 5G 網路的企圖心，冀望能取得優勢、搶攻市場占有率，也提供包括半導體、

印刷電路板、電子零組件等上游供應鏈業者新的藍海商機。市場原預期 109 年為 5G 基地台建置的高峰期，但受到新冠肺炎疫情在中國迅速蔓延，除導致台商中國廠區面臨延後開工，終端市場銷售亦出現急凍。邁入下半年，全球經濟市場逐步復甦，各國 5G 建設也重新啟動，而美系手機大廠推出新款 5G 手機，預估 5G 手機市場規模將逐步擴大，台廠在多元應用布局完整以及新產能陸續量產，在基期相對偏低之下，110 年 PCB 業景氣可望持續呈現成長態勢，後續營運表現仍值得期待。

2.雷射加工產業概況

雷射加工技術在工業上的應用，從金屬切削、鋼板切割、焊接及熱處理等機械加工，到電子產業中的印刷電路板鑽孔、TFT LCD 切割、晶圓切割及 MEMS 加工技術等，都已有十分廣泛的應用。

根據調研機構 Maximize Market Research 資料顯示，全球雷射材料加工市場規模將從 105 年的 64 億美金成長至 113 年的 97 億美金，複合成長率約達 6%，呈現穩健成長的態勢。雷射材料加工市場可大致分為雷射標籤、雷射精密加工(金屬切割/焊接等)和雷射清潔等領域。未來材料加工之需求將隨經濟發展和終端應用如消費性電子(手機、平板/筆電、穿戴式裝置、面板)、車用、工業等領域發展而持續增加，雷射技術將成為相關應用之關鍵技術，有助推動各項產業向上成長。



在 1981 年時，萊世曼(Leishman)將雷射加工微小盲孔的方法應用在 Finstrate 基板上，又到了 1990 年，IBM 公司發表了所謂表面配線板製程技術(Surface Laminar Circuit，簡稱 SLC Technology)的增層印刷電路板，其後，由於微細圖案和間距技術的持續發展與進步，使得增層印刷電路在 1998 開始實用化，而這時的增層法，係在傳統壓合之多層板外面，再以背膠銅箔(Resin Coated Copper，簡稱 RCC)或銅箔加膠片增層(Build up)，其與內在(core)板的連係採微孔(microvia)或雷射加工及光成孔(Photovia or laser via)之途徑，它是一種用非機械鑽孔方式，以及壓合後再增層的製造方式。

近年來，在 5G 通訊、IA 等此產業可攜性輕薄短小，多功能及價格低廉的

要求，印刷電路板遂走向高密度佈線、細線及小孔化、複合多層化、薄板化發展，另雷射精微加工領域部分，受到光電半導體產業近年吸睛產品 OLED、Micro-LED 影響，與其相關之製程技術用雷射源亦跟著發展，例如 Coherent Inc.之 CO2 雷射，因其波長特性，200W 之 CO2 雷射可用於玻璃切割、PCB 通孔鑽孔；切割 OLED 面板之紫外光皮秒脈衝雷射源，加入感測器與精準光束控制模組，可提供光電半導體產業高速發展之解決方案。

(二)所屬行業之營運風險

茲就該公司產品所屬之行業，分別說明景氣循環、行業上下游變化、行業未來發展趨勢及產品可替代性等對其之營運風險如下：

1.景氣循環之營運風險

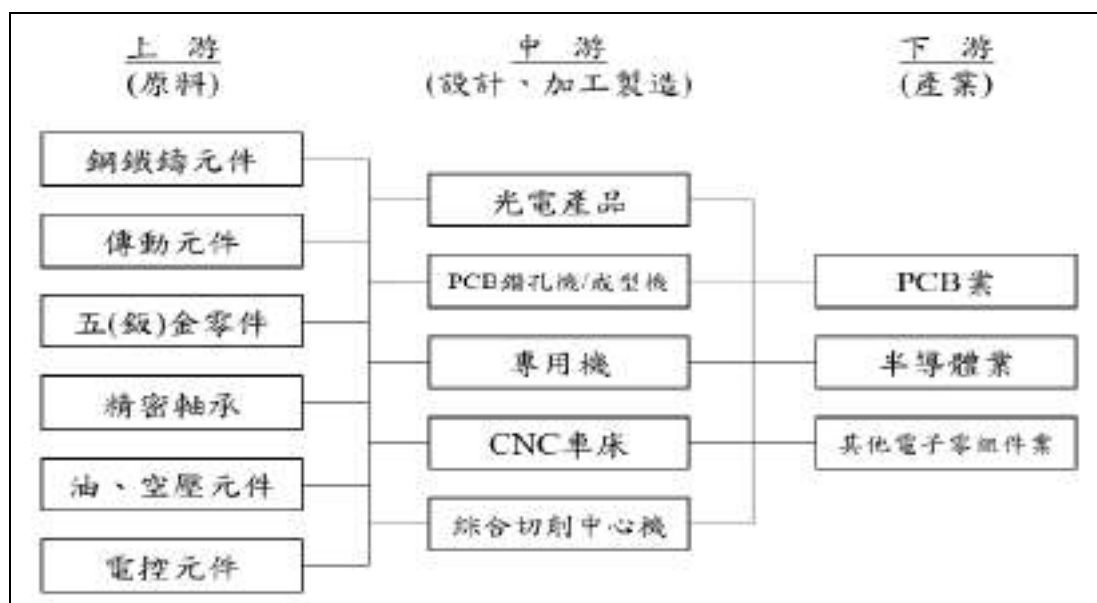
該公司主要生產及銷售 PCB 鑽孔機/PCB 成型機及雷射鑽孔加工服務等，係屬 PCB 產業中游。而 PCB 搭載於所有的電子產業，因此也有 3C 產業之母的稱號，應用範圍涵蓋各式通訊產品、工業用品及消費性電子產品等，因此電子業的景氣循環將影響 PCB 機械設備之需求多寡。未來隨著 5G 商轉、防疫之下 PC 及週邊設備消費性電子產品的強勁需求，汽車、軍事等領域之創新與升級，以及新興應用不斷開出之新需求，整體終端應用市場穩定成長，進而帶動印刷電路板之需求。臺灣在全球 PCB 產業的超前部署使需求湧向臺灣，預期臺灣 PCB 大廠資本支出將持續成長。

機械設備業本身即對整體經濟環境有著極高的敏感度，達航科技為降低產品集中的風險，一直積極拓展其他領域產品線，提前佈局投入自動車、半導體、光通訊及 6G 相關應用，以分散銷售市場、提升公司競爭力，並降低單一下游產業景氣循環對該公司的影響及風險。且面對印刷電路板高階製程之多樣化及複雜化，該公司持續研發更好之鑽孔技術，提供最佳客戶服務，並持續為該公司營收注入動能，亦提升同業競爭能力。

2.行業上中下游變化之營運風險

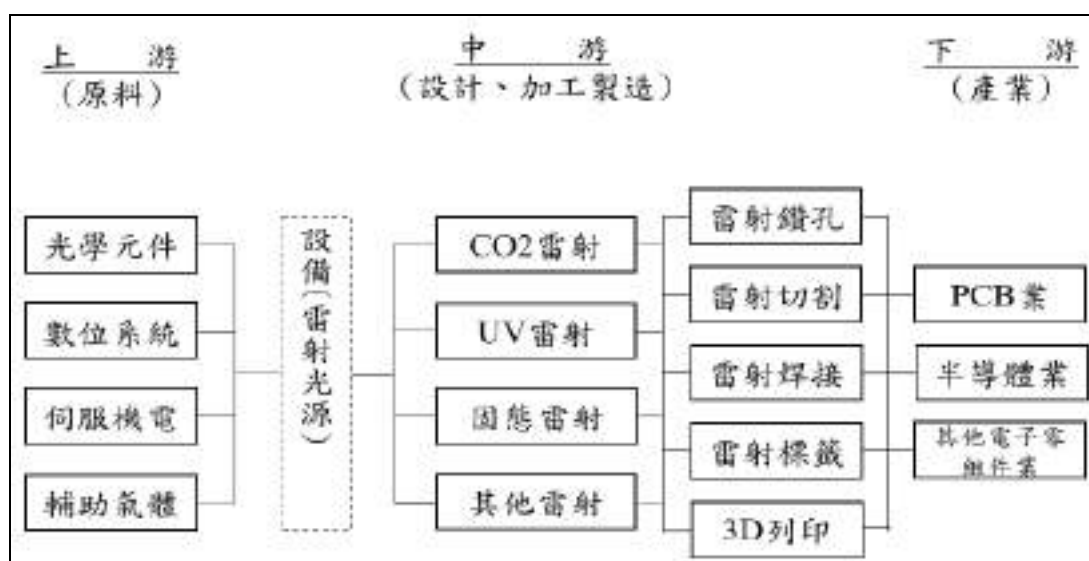
達航科技為印刷電路板之鑽孔機台製造商，係屬機械設備造業之中游，通常藉由協力廠商配合零件之加工製造等生產過程，以專業分工方式整合機械之製造，其整合上游之相關鑄件、五金零件、控制器、馬達及軸承等，研發製造 PCB 產業鑽孔機械設備，再銷售給下游 PCB 產業、半導體業及其他電子零組件業等廠商。茲將達航科技所屬產業之上、中、下關聯性圖示說明如下：

(1) PCB 設備產業



(2) 雷射加工產業

雷射加工產業上游主要包括雷射材料及配套元件，中游為雷射器及其配套元件，下游包括雷射應用產業如 PCB 產業、半導體業及其他電子零組件業等。

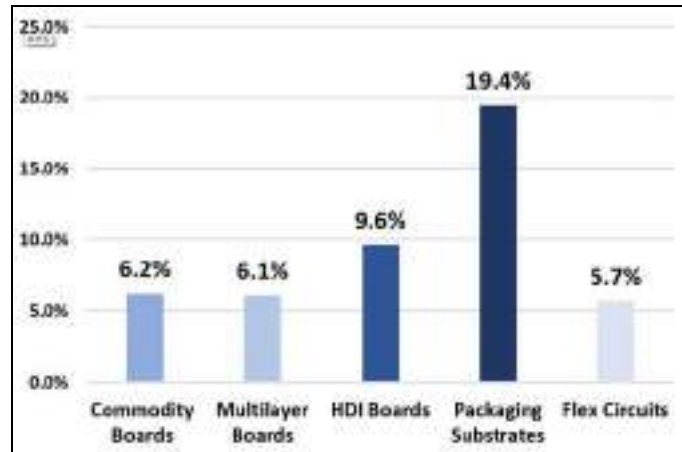


3. 行業未來發展趨勢

在 2020 年全球電路板各式產品中，載板產值佔所有產品之比重達 16%，全球年成長率高達 25%，因 5G 手機晶片需求及 SiP、AiP 等新的應用規模快速的成長帶動先進製程需求，呈現高度成長主要因為：(1)全球 IC 出貨量持續成長；(2)高單價 ABF 載板需求旺盛，由於 5G 基地台、高效能電腦的需求高度成長；(3)5G 手機衍生出 AiP 之載板需求。

根據研究機構 Prismark 資料，晶圓製造產能與載板的供不應求下，110 年全球載板成長率預估維持 19% 高成長，如圖所示，居各式電路板產品之冠。

圖 2021 年全球電路板產品預估成長率



資料來源:Prismark (2021/02) 製表:TPCA

近年 5G 技術快速發展，為達成高速傳輸之目標，載板朝高密度、多層與微型化發展，盲孔與埋孔需求大增，傳統機械鑽孔機無法有效解決盲孔、埋孔製程及孔徑微小化問題；而雷射鑽孔機在小孔徑及盲孔具優勢，適用高階 PCB 板製程，迎接下世代的 PCB 將跨入類載板(Substrate-Like Process, SLP)等製程。

展望 110 年，隨著 5G 網路正式普及，PCB 各終端需求包括車用、消費、通訊電子、工控醫療及航太等也將逐步成長；而 5G 基地台、物聯網、雲端智能及 AI 應用等軟硬體的規格提升，其需求增加也將受惠 PCB 產業鏈。依據 Prismark 預估，未來 IC 載板成長幅度將為 PCB 各產品類別中最大，113 年產值將達到美金 126 億元，較 109 年之複合成長率達 9.1%，Multilayer Board(多層板)與 HDI 複合成長率亦分別具 4.4%與 6.5%成長規模，各類印刷電路板總產值將在 108 年至 113 年以平均 5.1%年複合增長率成長，將於 113 年達到美金 787 億元規模，顯示未來五年 PCB 市場產業及其衍生出之雷射應用代工成長可期。

4. 產品可替代性

達航科技主要從事生產及銷售之 PCB 鑽孔機/PCB 成型機等設備，另提供雷射加工應用服務如雷射金屬切割機、全自動雷射鑽孔/劃線機及雷射晶圓標印機等，與客戶製程設備連結，提供客戶最佳自動化解決方案，提升各式印刷電路板在電子產業的高度應用與重要性，並與客戶共同開發成長。

隨著高科技產品在追求重量輕、體積小之前提下，PCB 越做越小，該公司鑽孔設備具有高穩定、高工藝、高技術等優勢，面對不同載板所需之孔數、深度等都能維持良好之品質與良率，目前國內鑽孔設備之廠商尚不能與該公司相比擬；且 5G、電動車等產業持續發展，使得 PCB 之需求爆發，就長遠製造產業需求而言，對於 PCB 機械設備之需求將隨之提高，該公司產品尚無被立即取代之風險。

二、申請公司營運風險

茲就該公司之業務、技術能力、研發、專利權、人力資源、財務（包括成本、匯率變動等）等之營運風險列示說明如下：

(一)業務之營運風險

1.產品或服務項目之市場佔有率、相關機器設備、人力資料、與同業中上市櫃公司或知名公司比較及其同業間之地位情形

(1)市場之占有率

該公司產品及服務項目主要劃分為專業服務及設備產銷兩大類分別說明如下：

A.專業服務

a.雷射鑽孔加工之相關服務：

使用自主研發生產之雷射鑽孔機，協助客戶進行加工 IC 載板(ABF 載板、BT 載板)、低耗損高頻基板材料(Low Loss)及次毫米發光二極體(Mini LED)等材料，滿足其各種高精密度、不同孔型的板材加工。該公司亦提供專業駐廠工程師協助進行加工條件之設定，以提升客戶生產效率。並可配合客戶研發階段、產品保密等因素，將設備搬入客戶廠區，並提供人員駐廠，進行雷射鑽孔加工服務。

b.鑽孔機與成型機之維護保養服務以及效能提升方案：

配合客戶既有機台，提供維護保養服務，或運用該公司生產製造之主軸產品，協助客戶設備改造升級等效率提升服務專案。該公司提供之主軸產品，係屬工具機之關鍵零組件，主軸系統與切削力之傳遞最直接相關，其旋轉精度與動態特性影響最終的加工品質。透過使用該公司提供之主軸產品，能夠將客戶既有機台之效能有效提升。

B.設備產銷

該公司以自主研發製造之鑽孔機及成型機進行銷售，並以「VELA」為其設備之自創品牌，搭載自主研發高速主軸、自動檢測、相關刀具等機構組件，主要應用於 PCB 基板、IC 載板等材料之鑽孔及成型製程。

該公司提供之產品及服務，參考行政院主計總處之行業統計分類能大致歸類為 C2630 印刷電路板製造業，該公司 107 年至 109 年度營業收入占我國印刷電路板製造業年產值之總金額約 0.32%至 0.53%，隨著 5G 通訊、汽車電子等應用需求持續成長，且各類電子產品愈趨強調輕薄短小，對雷射鑽孔服務之需求愈趨增加，該公司未來仍有成長空間可期。

單位：新臺幣千元

	營業收入(A)	印刷電路板 製造業年產值(B)	約略市場占有率 (A)/(B)
107 年度	1,542,739	289,995,627	0.53%
108 年度	1,175,825	291,631,029	0.40%
109 年度	1,001,731	313,517,311	0.32%

資料來源：經濟部統計處及該公司經會計師查核簽證之財務報告

a. 相關機器設備

該公司從事雷射鑽孔加工及鑽孔機與成型機之銷售、保養及維修等服務，主要機器設備為生產線中的各式機具與檢測設備，以及用於鑽孔代工之雷射鑽孔機等。該公司 110 年 9 月底止，合併機器設備淨額為 614,022 千元，占總資產比率為 26.59%。相關設備使用及維護情況良好，整體而言，尚無重大異常之情事。

b. 人力資源

人力資源為該公司之主要競爭力來源，無論是開發自製設備或是提供客戶專業服務，員工均為不可或缺的一環。該公司針對員工之職能需求，舉辦各式教育訓練，提升員工之核心競爭力，成為公司未來的競爭利基，帶動公司未來的成長潛力。該公司及其子公司民國 109 年底之員工人數共為 277 人，員工平均營收貢獻度為 3,616 千元，與採樣公司相比，略優於凱崑，並與大量僅有部分差距，顯示該公司及其子公司之人力資源效益尚屬良好。

日期：109年12月31日單位：新臺幣千元；人

公司名稱	109年度營業收入 (A)	109年底員工人 數(B)	員工平均營收貢 獻度(A/B)
達航	1,001,731	277	3,616
大量	2,427,607	566	4,289
凱崑	1,264,376	356	3,552
尖點	2,973,426	359	8,283

資料來源：該公司及採樣公司之股東會年報、公開說明書以及經會計師查核簽證之財務報告

c.申請公司在同業間之地位

單位：新臺幣千元；%

公司 名稱	主要產品	109 年度			
		實收 資本額	營業收入	毛利率 (%)	每股 盈餘
達航	雷射鑽孔代工服務、自有品牌鑽孔機及成型機產銷、保養、維修及改造服務	443,435	1,001,731	33.63	2.09
大量	半導體產品檢測設備、PCB 設備及 CNC 彫銑機械	801,341	2,427,607	29.50	5.23
凱崱	PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工	1,693,397	1,264,376	13.82	0.52
尖點	精密鑽針、精密銑刀以及鑽孔加工服務	1,421,805	2,973,426	32.6	1.98

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告

該公司與採樣公司相較，實收資本額及營收規模不及採樣公司，惟毛利率優於所有採樣公司，109 年度每股盈餘表現優於凱崱及尖點，顯示該公司以目前之規模，其營運表現及獲利能力尚具市場競爭力，在同業地位中尚屬穩健。

2.申請公司目的事業成就與不成就之關鍵因素

(1)研發團隊之經驗與技術

隨著科技之快速變遷，PCB 產業可能隨時會迎接材料的變化與製程的變化，如 5G、AI 及車用電子等領域，其所使用的材料基板與製程要求不盡相同。因此，研發團隊能否適時開發出符合市場需求之產品將是公司成就與否之關鍵因素之一。該公司研發團隊資歷豐富，具備持續研發專利之能力，並自行研發產品之核心技術，能隨時調整研發方向，推出符合市場需求之新設備及新技術，為該公司之競爭立基之一。

(2)市場發展趨勢之掌握度

市場上終端產品的發展趨勢，即為 PCB 產業的未來方向，縱使公司研發團隊能開發出符合當下市場需求的產品及技術，因產業中的競爭者眾多，推出新產品及服務的時點也成為關鍵。因此，對市場發展趨勢的掌握度將是公司成就與否的關鍵因素之一，市場中能越早掌握到未來發展趨勢的廠商，所獲得的優勢越大。該公司透過銷售設備及提供鑽孔代工服務，業務人員及研發人員與客戶進行交流，從需求端得到第一手的市場資訊，並憑藉著經營團隊對產業脈動的敏感度，可高度掌握未來產品技術的發展發項，有助於該公司及早啟動研發計畫，開發符合市場需求之技術及產品，提升競爭優勢。

(3)產品及服務之靈活程度

PCB 產業已發展超過數十年，生產方式從人工、半自動化、全自動化

乃至今的智動化，各式機械設備對生產流程至關重要，然鑽孔機、成型機等設備售價動輒百萬起跳，對於大額之資本支出，客戶並不會倉促做決定，若能提供替代之產品與服務，將能提升公司之競爭利基，因此產品及服務之靈活程度將是公司成就與否的關鍵因素之一。該公司透過提供完整的產品及服務鏈，從自行研發之設備銷售、客戶現有設備之改造，到提供鑽孔代工之服務等，並提供技術支援團隊做為後盾，提供客戶在生產流程中最佳的解決方案。

3.市場可能之供應變化情形及影響申請公司未來發展之有利與不利因素及其所採行相關因應措施之適當性

(1)市場可能之供應變化情形

109 年度的新冠肺炎疫情重創了全球經濟市場，然而隨著疫情的發展，帶動居家上班與宅經濟持續發燒，推升筆電、平板與遊戲機等相關產品需求，也為 PCB 產業帶來意外的收穫。若說新冠肺炎是 109 年度的一大災難，那 5G 絕對可說是災難中的一道曙光，IC 載板在 5G 相關應用需求暢旺的持續加持，基於產能受限供不應求下，成為帶動 PCB 產業成長主要的火車頭，著眼於 5G 商機已經發酵，根據台灣電路板協會（TPCA）統計，109 年起台資 PCB 製造與原物料廠商將陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣，如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎在台併購與新廠規劃、台郡、景碩、耀新電子等板廠外，也帶動材料大廠如南亞塑膠加碼銅箔廠、台光、台耀與聯茂紛紛加碼投資台灣，將再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

(2)未來發展之有利因素

A.5G 商機帶動 PCB 產業需求成長

5G 所衍生的商機與供應鏈相當龐大，從基地台天線設計、網通設備與伺服器，再到終端 5G 智慧型手機，所需要的印刷電路板規格與數量均較以往有大幅度的改變。數量方面，5G 基地台站所使用的印刷電路板面積將會是 4G 基地台所使用的 1.55 倍。除數量增加外，5G 對於 PCB 板材的規格要求更為嚴苛，為達到高頻高速傳輸之標準，不只需要較高的技術與設備投入，更需要技術人員和生產人員的經驗累積。該公司具備多年設備開發與雷射鑽孔加工之經驗，並且擁有數家大廠認證合格之設備，將成為競爭 5G 商機時的競爭利基。

B.全球政經局勢角力，台廠加速擴廠布局

面對美、中兩強角力，台廠積極分散全球生產風險，自 109 年起陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣，且近九成投資都在臺灣，如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎在台併購與新廠規劃等，帶動高階設備與周邊產業龐大商機。該公司深耕產業多年，具備設計、研發及整合能力，可配合客戶需求開發設備，亦能提供加工之技術支援，倘若把握住此波商

機，未來成長可期。

C.利基型產品興起，考驗廠商生產模式

印刷電路板產業競爭劇烈，多量少樣的標準品獲利難度大增，再加上因消費型態轉變而興起的少量多樣的利基型產品，將使廠商因生產模式的轉變而面臨考驗。而該公司因具備自主開發生產設備的能力，對於客戶提出之客製化需求能有效處理，且該公司相對大廠，更具機動性及配合度，能夠迅速且高度配合地協助客戶開發出所需設備。另，該公司多年累積之代工生產經驗，亦能幫助客戶針對各式加工條件，安排最佳解決方案。對於搶攻利基型產品市場，該公司之營運模式與能力，具備相當之優勢。

(3)未來發展之不利因素及其所採行相關因應措施

A.產品及服務集中於同一產業

該公司雖提供各式產品及服務項目，大部分均集中於印刷電路板產業，風險過度集中，倘若印刷電路板產業發生嚴重衰退，該公司營運將連帶受到影響。

因應措施

該公司為避免營運過度集中於同一產業，業務團隊努力開發新客群，尋找不同產業客戶與該公司產品合作可能性，而研發團隊透過雷射鑽孔技術及機械鑽孔技術的相互搭配，使公司產品與服務能應用於不同產業所需之電路板材料與加工方式。近兩年該公司積極往多角化的經營方向前進，將產品與服務之應用範圍拓展至半導體產業、通訊產業、車用電子業等。

B.設備製造業之景氣循環明顯且影響甚高

該公司營業項目之一為自主研發設備之產銷，其績效表現受景氣循環影響甚高，當景氣好時，市場供不應求，下游廠商生產力不足，添購設備的需求上升，而當景氣反轉時，產能過剩，下游廠商只能縮減資本支出，且此景氣循環通常是相當漫長的過程，雖有連續數年的榮景，但連續多年的景氣低迷將成為該公司的重大考驗。

因應措施

該公司採取穩健的財務政策，適度舉債經營，實現風險與報酬的最優組合，在景氣好時，能有適當的槓桿推動營運表現，當景氣反轉時，亦能具備足夠的償債能力。對於設備類應收帳款收款天期較長之議題，該公司除持續加強應收帳款管理及催收工作外，亦採取嚴格的備抵呆帳提列政策，以利管理團隊能隨時掌握公司之財務狀況。

另外，該公司之營運模式係傾向於推出高端機種，並採客製化需求接單模式生產，不但能提高毛利，亦能避免庫存呆滯之風險。另透過雷射鑽

孔加工服務，為客戶提供除添購設備外，能夠滿足擴增產能需求的其他選項，讓公司營運更具彈性。

C. 勞動力供給弱化

人口老化為未來世界無法逃避的問題，對勞動力供給的影響將逐漸浮現，且近年來因國內勞工短缺，使國內業者面臨招募不易、人員流動率高及勞動人力結構改變等窘境。

因應措施

該公司提供具競爭力的薪資與福利招募新血，並針對員工職涯規畫及專業職能提供完整培訓計畫，使員工更具向心力以為公司留住人才。除此之外，該公司為因應人口老化與勞動力人口不足等議題，朝著工業 4.0 的方向努力，發展自動化生產流程與設備，希望藉由智慧工廠及智慧製造，能夠解決勞動力供給弱化的問題。

另該公司股票上櫃掛牌後，可提升公司知名度，有利吸引優秀人才之加入，以奠定企業持續成長之基石。

(二) 技術能力、研發及專利權之營運風險

1. 技術專家之評估意見

本推薦證券商與該公司並未委請技術專家就該公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用。

2. 申請公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，瞭解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近三年度及申請年度截至最近期止研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險

(1) 研發部門之沿革及組織

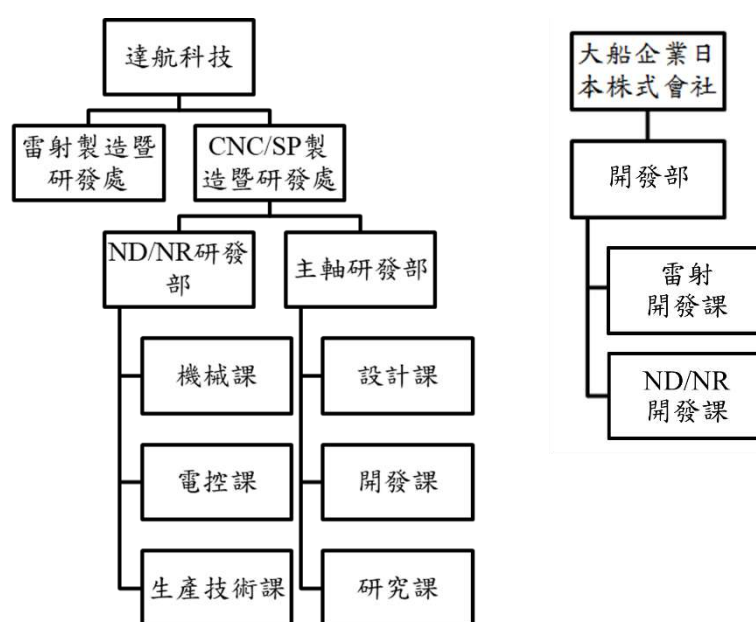
該公司成立於民國 80 年，成立初期以印刷電路板(PCB)鑽孔加工及相關機械設備之維修為主要營運項目。為提供客戶整體性的資訊化與自動化服務，於民國 82 年 4 月成立工程部 DNC 組，進行分散式數值控制(DNC)相關之軟體研發工作。85 年藉著與 Hitachi Via 技術合作，累積鑽孔機、成型機及機械鑽孔技術之經驗值，其後分別成立了 ND/NR 研發部及主軸研發部，具有研發製造高速主軸、鑽孔機及成型機的實力。

隨著終端產品愈趨輕薄短小，電路板線路密度愈來愈高，採用的材料也與過去不同，該公司於民國 105 年跨足雷射產業，成立雷射製造暨研發處，雷射鑽孔可依其特性應用於不同材料及製程，特別是傳統機械無法達到的方孔或微孔。該公司自主研發製造雷射鑽孔機，於民國 106 年及 107

年分別開發成功 CO2 雷射鑽孔機及 UV 雷射鑽孔機，並以自製設備為客戶提供專業的代工服務。該公司研發成果顯著，累積眾多專利及實作經驗，近年來更致力於自動化設備之研發、提升主軸性能以及精進雷射鑽孔技術應用。

該公司之研發單位分別設置於達航科技及子公司大船企業日本株式會社（簡稱日本大船），從事鑽孔機、成型機、主軸及雷射事業之研發工作。研發部門組織圖及其執掌如下：

A.研發部門組織圖



B.研發部門各單位職掌

所屬公司	部門單位		工作職掌	研發重心
達航科技	CNC/SP 製造暨研發處	主軸研發部	主軸產品之研發	針對製程需求研發差異化產能提升解決方案，並針對現有產品持續改善、降低成本，以及提供客製化的技術支援。
		ND/NR 研發部	鑽孔機及成型機之研發	提升設備之加工效率，並增加其自動化的程度。
	雷射製造暨研發處		雷射鑽孔技術之研發	負責處理客戶端之應用面問題，提供客戶技術支援，並彙整無法透過前端調整改善的問題，交由日本大船的研發單位進行解決。
日本大船	雷射開發課		雷射鑽孔設備之研發	依不同領域進行各種新型雷射鑽孔機研發。提升現有設備之加工效率。負責處理客戶端之應用面問題，提供技術客戶技術支援。
	ND/NR 開發課		鑽孔機及成型機	依日本客戶之需求提升改良設備之加

所屬公司	部門單位	工作職掌	研發重心
		之技術改良研發	工品質、效率，並增加其自動化的程度。將其成果回饋至母公司，推展應用於海外市場的開拓。

資料來源：該公司提供

(2)研發人員學歷分佈、平均年資及流動情形

單位：人

項目		107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至 9 月底
期初人數		28	34	33	30
新進人數		8	1	1	0
離職人數		5	0	3	2
轉入(出)人數		3	(2)	(1)	0
期末人數		34	33	30	28
離職率(註)		12.82%	0.00%	9.09%	6.67%
平均年資		8	9	10	10
學歷 分佈	博士	1	1	1	1
	碩士	2	2	2	2
	大學	20	19	16	14
	專科(含)以下	11	11	11	11
	合計	34	33	30	28

資料來源：該公司提供

註：離職率：離職人數/(期末人數+離職人數)

該公司最近三年度及 110 年前三季之研發人員分別為 34 人、33 人、30 人及 28 人，平均年資為 8 年、9 年、10 年及 10 年，其研發人員學歷具備大學以上學位之比率約占 6 成以上，且大多為相關系所畢業或具備產業背景，顯示該公司研發人員具備一定程度之專業素養與經驗。

在研發人員流動情形方面，最近三年度及 110 年前三季研發部門之離職率分別為 12.82%、0.00%、9.09%及 6.67%。107 年度離職 5 人，其中一人為未滿試用期之新進人員，一人為 ND/NR 研發課級主管，負責專案管理，其餘三人為主軸研發部之職員與課級主管，負責產品研發與專案管理；108 年度無人員離職情形；109 年度離職 3 人，其中一人為未滿試用期之新進人員，其餘二人均為主軸研發部之一般職員，負責產品研發；110 年前三季離職 2 人，分別為 ND/NR 研發課與雷射研發課之一般職員，負責協助產品研發。

雖離職人員中有課級主管，但未有經理級人員離職情事，整體而言並無管理階層大幅度異動或研發人員集體離職之情形，且該公司設有健全之技術文件管理制度，並妥善安排人員接手離職人員工作，部分研發人員離職對該公司之營運尚不致產生重大影響。

(3)最近三年度及申請年度截至最近期止之研發費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 前三季
研發費用	71,774	89,147	66,331	36,865
營業收入	1,542,739	1,175,825	1,001,731	884,477
研發費用占營業 收入比率	4.65%	7.58%	6.62%	4.17%

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近三年度及 110 年前三季研發費用分別為 71,774 千元、89,147 千元、66,331 千元及 36,865 千元，占各年度營業收入比重分別為 4.65%、7.58%、6.62%及 4.17%。研發費用主要為支付日本大船技術支援之勞務費、研發人員之薪資費用及相關設備之折舊費用等支出。108 年度研發費用與其占營業收入比率均較 107 年度提升，主係該公司 108 年度著重於改良雷射鑽孔機，研發目標為提升速度、優化品質及增加功能等，因而投入較高成本所致，另因 108 年營收較 107 年減少致研發費用佔營收比率提高。109 年度及 110 年前三季研發費用與其占營業收入比率較前期減少，係因目前研發目標主係提升現有產品效能及開發自動化相關設備與軟體等，所需之研發成本較改良雷射鑽孔機低所致。

整體而言，該公司每年持續投入一定金額作為研發支出，精進公司產品及服務之競爭力，並視實際研究需求而增減調整，其研發費用之變化尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

(4)重要研究成果

該公司致力於各項產品及技術之精進，茲將該公司重要研發成果及相關內容列示如下：

年度	重要研發成果(技術及產品)	主要用途/應用領域
104	大板 PCB 鑽孔機研發成功	車載板、伺服器、基地台基板
	D10 主軸研發(10 萬轉)	高光加工主軸
	高轉速 30 萬轉主軸	主軸
105	大板 PCB 成型機研發成功	車載板、伺服器、基地台基板
	高轉速 35 萬轉主軸	主軸
106	Vela CO2 雷射鑽孔機開發成功	CO2 雷射鑽孔機
107	新增 ABF 模式與改善 CCD 鏡頭	CO2 雷射鑽孔機
	Vela UV 雷射鑽孔機開發成功	UV 雷射鑽孔機

年度	重要研發成果(技術及產品)	主要用途/應用領域
	F20Q 主軸研發(20 萬轉)	鑽孔機主軸
108	改善 X-VIA 對穿加工、縮減 Over Hang 量、開發二維碼生成加工模式，優化整個加工品質及加工速度	CO2 雷射鑽孔機
	DM、DS 系列鑽孔機新機種研發成功	鑽孔機
	成型機新機種(RM 系列)研發成功	成型機
109	生產工單導入 QR Code，雷鑽機可讀取該 QR Code 進程式呼叫。	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	雷鑽機的影像辨識系統加入圓邊緣模式，提高當靶孔變形時的影像辨識度。	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	高景深 CCD 對焦模組	鑽孔機、成型機
	Z 軸輕量化鑽孔模組	鑽孔機、成型機
	薄板小孔徑加工技術之開發	CO2 雷射鑽孔機
	降低熱影響之加工技術開發	CO2 雷射鑽孔機
110	2H2P 加工設備原型機(ABF 專用)	CO2 雷射鑽孔機
	2 次元桌面高精度補正技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	UV 高轉速切割技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機

資料來源：該公司提供

3.主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司深耕產業多年，其主要技術來源係來自研發團隊長期設備開發累積之專業經驗，逐步建立起自有之核心技術，該公司最近三年度及 110 年截至評估報告出具日止，該公司尚無委託外部單位開發主要技術之情事，亦無與其他公司簽訂技術授權合約，或需支付權利金之情形。

4.研發工作未來發展方向

在印刷電路板產業中，產業的技術發展方向隨著市場主流終端產品的需求持續變化，研發工作之發展方向須配合客戶及市場需求隨時調整。該公司密切關注未來產業動向及發展，研發具有成長性、未來性之產品及技術，該公司研發工作之未來發展方向及預計開發之產品項目臚列如下：

(1)既有設備改良

提升既有設備之效能，提高加工速度與品質，並同時朝著降低成本的目標展開研發工作。

(2)智能車間

開發設備自動化方案，並結合軟體蒐集數據，加強管理調度及提升生產效率等。製程中的資訊亦能為研發團隊所用，成為研發工作之基礎。

(3)以自製零件取代外購零件

為降低仰賴外部供應商的程度，自行開發製造零組件以取代外購零件，除提高自主性外，更能製作出符合需求之零組件。

(4)擴展應用領域

隨著 5G、AI、車用、物聯網等領域的蓬勃發展，帶給印刷電路板產業許多機會與挑戰，因各領域所適用的材料基板不盡相同，需開發新材料基板的加工方法，甚至需開發新型機台。能夠拓展自身產品的應用領域，才能不在印刷電路板產業中被淘汰。

(5)環境保護與循環經濟

環保意識逐漸高漲，該公司亦投入開發節能環保的設備，延長設備使用壽命，並朝廢棄物回收再利用的方向進行研發工作。

(6)預計開發之產品項目：

產品類別	預計開發之產品項目	適用領域
鑽孔機	DM(20 萬轉)二代經濟型機種	IC 載板鑽孔
	DS(20 萬轉)二代高效率機種	IC 載板鑽孔
	自製零件取代外購零件	鑽孔機零件開發
	DS(30 萬、35 萬轉) 二代高效率機種	IC 載板鑽孔
	D6F(16、20 萬轉)線馬達經濟型機種	PCB 鑽孔機
	D6NF(16、20 萬轉)大板線馬達經濟型	PCB 鑽孔機
	鑽孔製程全面自動化方案	鑽孔自動化
成型機	成型自動化方案	PCB 成型加工
主軸	20 萬轉 SPINDLE 效率提升	鑽孔機主軸節能
	35 萬轉 SPINDLE 效率提升	鑽孔機主軸節能
	SPINDLE 零件製程能力提升	整合生產工序、降低生產成本
雷射鑽孔機	UV 高轉速切割技術之開發	UV 雷射鑽孔機
	2 次元桌面高精度補正技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	新畫像處理器開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	Vela Co2 雷射鑽孔機 2H2P 設備 (ABF 專用及泛用機型 2 種)	封裝 IC、虛擬貨幣、半導體、汽車技術 應用、高週波對應基板、AIP 等
	Vela Co2 雷射鑽孔機 2P4H 設備 (ABF 專用)開發	封裝 IC、虛擬貨幣、半導體、汽車技術 應用、高週波對應基板、AIP 等
	PICO/FEMTO 雷射加工機開發	5G、6G 通信用封裝 IC、汽車、液晶、半 導體、陶瓷、玻璃、光纖通信等新領域

資料來源：該公司提供

5.目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、

商標權及著作權之情事，暨因應措施是否合理有效

該公司最近三年度及 110 年起截至評估報告出具日止，並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，茲將該公司已登記或取得之專利權、商標權及著作權列示如下：

(1)專利權

A.已取得

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區	專利公告號碼	專利權有效期間
1	具冷卻.除塵及斷針偵測之壓力腳裝置	發明	中國	ZL200910204178.7	2009/10/19~2029/10/19
2	植銷設備	發明	台灣	I442989	2014/07/01~2031/06/30
3		發明	中國	ZL201110234868.4	2013/08/28~2031/08/16
4	基板清潔機的防發塵黏輪導移裝置	新型	台灣	M481074	2014/07/01~2024/01/26
5		新型	中國	ZL201420080819.9	2014/02/25~2024/02/24
6	基板清潔機的防捲清潔輪模組	新型	台灣	M483128	2014/08/01~2024/01/26
7		新型	中國	ZL201420081499.9	2014/02/25~2024/02/24
8	聯軸器	新型	台灣	M437757	2012/09/21~2022/04/24
9		新型	中國	ZL201220252557.0	2012/05/31~2022/05/31
10	用於多層印刷配線基板的背鑽加工方法及基板加工裝置	發明	台灣	I632007	2018/08/11~2037/05/08
11	電極接合方法	發明	台灣	I349500	2011/09/21~2027/11/01
12		發明	中國	ZL200710188394.8	2007/11/21~2027/11/21
13		發明	韓國	10-0952007	2010/04/01~2028/03/26
14	能改善冷卻及除塵效果的主軸裝置	發明	台灣	I376865	2012/11/11~2028/06/26
15		發明	中國	ZL200810133589.7	2008/07/17~2028/07/17
16	能改善動平衡的主軸裝置	發明	台灣	I379721	2012/12/21~2028/06/26
17	可降低電極圖案製程溫度之旋轉軸	發明	台灣	I362989	2012/05/01~2028/08/05
18	能提高冷卻效果的主軸裝置(F30)	發明	台灣	I386278	2013/02/21~2029/07/20
19		發明	中國	ZL200910204176.8	2009/10/19~2029/10/19
20		發明	日本	5055346	2009/12/17~2029/12/17

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區	專利公告號碼	專利權有效期間
21		發明	韓國	10-1071171	2009/12/14~2029/12/14
22	可換刀的小型化心軸單元及主軸裝置(F30)	發明	台灣	I397449	2013/06/01~2029/07/23
23		發明	中國	ZL200910204177.2	2009/10/19~2029/10/19
24		發明	日本	5017383	2010/01/26~2030/01/26
25		發明	韓國	10-1071388	2009/12/22~2029/12/22
26	襯套式空氣軸承及主軸裝置	發明	台灣	I447314	2014/08/01~2031/11/21
27		發明	中國	ZL201210024042.X	2012/02/03~2032/02/03
28	具有環向貯油溝的夾頭	新型	台灣	M505988	2015/08/01~2025/03/04
29		新型	中國	ZL201520177158.6	2015/08/19~2025/03/27
30	印刷電路版的雷射加工方法及其雷射加工機	發明	台灣	發明第 I705749 號	2020/09/21~2039/12/24
31	基板包裝箱(Vela VP Box)	新型	台灣	M598828	2020/07/21~2030/04/23
32		新型	中國	第 12108056 號	2020/05/13~2030/05/12
33	鑽孔機之共用型基座	新型	台灣	新型第 M617328 號	2021/09/21~2031/04/28
34	鑽孔機之夾板裝置	新型	台灣	新型第 M617326 號	2021/09/21~2031/04/28
35	板件鑽孔機及其輕量化加工主軸裝置與傳動機構	新型	台灣	新型第 M617327 號	2021/09/21~2031/04/28
36	X、Y 軸獨立驅動方式之雷射加工裝置	發明	日本	特願 2012-070468 特許第 5994168 號	2012/03/26~2032/03/26
37	主軸下降距離檢測模組及內建主軸下降距離檢測模組之機板加工裝置	發明	日本	特願 2013-110449 特許第 5807863 號 發明第 I522023 號	2013/05/25~2033/05/25
38	成型加工裝置中所應用之機板固定及更換方法	發明	日本	特願 2014-078268 特許第 6312027 號	2014/04/06~2034/04/06
39	雷射加工方法及雷射加工裝置	新型	日本	特願 2014-100934 特許第 6402895 號	2014/04/23~2034/04/23
40	主軸下降距離偵測模組及內建主軸下降距離偵測模組基板加工裝置	新型	日本	特願 2015-109188 特許第 6425138 號	2015/05/28~2035/05/28
41	應用於多層印刷電路板之背鑽工方法及其機板加工裝置	新型	日本	特願 2015-220845 特許第 6485774 號	2015/11/11~2035/11/11

資料來源：該公司提供

B.申請中

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區
1	轉軸下降距離訊息檢測機構和組裝有轉軸下降距離訊息檢測機構的基板加工裝置	發明	台灣
2		發明	中國
3	印刷電路版的雷射加工方法及其雷射加工機	發明	中國
4	基板搬送方法、具有該基板傳送方法的基板搬送裝置以及具有包括該基板搬送裝置和該基板處理裝置的基板傳送裝置的基板處理裝置。	新型	日本
5	基板之供給及回收方法與包括及個別之基板供給和回收方法、以及具備有加工前處理基板供給裝置和加工後處理基板回收裝置之基板搬送裝置	發明	日本
6	印刷電路板之雷射加工方法及印刷電路板之雷射加工機	發明	日本
7	印刷電路板之雷射加工方法及印刷電路板之雷射加工機	發明	日本
8	主軸下降距離檢測模組及內建主軸下降距離檢測模組之機板加工裝置	發明	日本

資料來源：該公司提供

(2)商標權

項次	商標名稱	註冊國別/地區	證書字號	權利期間
1		台灣	1278910	2006/09/11~2027/08/31
2		台灣	1273711	2006/09/11~2027/07/31
3		台灣	1080112	2003/06/06~2023/12/31
4		台灣	1080113	2003/06/06~2023/12/31
5		台灣	1080114	2003/06/06~2023/12/31
6		台灣	1332131	2007/09/13~2028/09/30
7		台灣	1995005	2018/12/05~2029/06/15
8		中國	35158767	2018/12/07~2029/10/06
9		中國	6274786	2007/09/13~2030/02/13
10		中國	6274785	2007/09/13~2030/03/27
11		中國	6274784	2007/09/13~2030/06/13

項次	商標名稱	註冊國別/地區	證書字號	權利期間
12		中國	6274783	2007/09/13~2030/03/27
13		中國	6274782	2007/09/13~2030/06/06
14		中國	6274781	2007/09/13~2030/03/27
15		中國	6274780	2007/09/13~2030/06/13
16		中國	5600275	2006/09/11~2029/07/06
17		中國	5600274	2006/09/11~2029/08/13
18		中國	5600273	2006/09/11~2029/11/20
19		中國	5600272	2006/09/11~2029/12/13
20		中國	5600271	2006/09/11~2029/12/13
21		中國	5600270	2006/09/11~2029/12/13
22		中國	5600269	2006/09/11~2029/11/20
23		中國	4078895	2004/05/24~2027/05/20
24	ofunagroup	中國	5600267	2006/09/11~2029/08/13
25	OFUNA	中國	4078896	2004/05/24~2027/05/20
26	大船	中國	4078897	2004/05/24~2027/06/20
27		日本	4830904	2004/05/17~2025/01/07
28		日本	5110154	2006/09/20~2028/02/08
29	OFUNATECH	日本	6208823	2018/10/15~2029/12/20
30		日本	5164828	2007/09/14~2028/09/05
31	OFUNA	香港	300215892	2004/05/17~2024/05/16

項次	商標名稱	註冊國別/地區	證書字號	權利期間
32		香港	300215900	2004/05/17~2024/05/16
33		香港	300215937	2004/05/17~2024/05/16
34		香港	300717444	2006/09/08~2026/09/07
35		香港	300954351AA	2007/09/14~2027/09/13
36		香港	300954351AB	2007/09/14~2027/09/13
37		香港	304736296	2018/11/15~2028/11/14
38		韓國	40-0924155	2010/11/24~2022/06/20

資料來源：該公司提供

(3)著作權：無。

6.取得申請公司目前重要技術合作契約，就其內容評估對申請公司營運之風險

該公司主要產品之技術係由其研發團隊自行研究開發，最近三年度及110年起截至評估報告出具日止，並未有與他人共同開發技術之技術合作並簽訂重要技術合作契約之情事。

7.以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫，以及生產開發技術之層次、來源等資料，以評估市場定位、需求及研究發展之內部控制暨保全措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上櫃，故不適用此項評估。

8.以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得參與經營決策之董事、持股超過股份總額百分之五之股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三年度及申請年度內股權移轉變化暨實際投入經營之時間與情形等，以評估該等人員未來若未能繼續參與經營對申請公司之營運風險，及其因應之措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上櫃，故不適用此項評估。

(三) 人力資源之營運風險

1.申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止依產品別區分之每人每年生產量值表，並就重大變動情形者，加以分析其原因

單位：新台幣千元；人；台

項目			年度		107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
					量	值	量	值	量	值	量	值
專業服務	生產量值		註		653,305		註	531,515	註	495,223	註	318,882
	直接人員	平均量值	註		2,276		註	2,783	註	3,038	註	2,140
		人數			287		191		163		149	
	直接及間接人員	平均量值	註		1,458		註	1,709	註	1,788	註	1,236
		人數			448		311		277		258	
設備產銷	生產量值			189	468,382		96	234,702	49	150,977	67	239,052
	直接人員	平均量值		0.66	1,632		0.50	1,229	0.30	926	0.45	1,604
		人數			287		191		163		149	
	直接及間接人員	平均量值		0.42	1,045		0.31	755	0.18	545	0.26	927
		人數			448		311		277		258	

資料來源：該公司提供

註：該公司產品別「專業服務」，主係鑽孔加工服務及維修保養服務等，其收入屬性偏向客製化、多樣化，非屬標準化製程，故無法針對產量進行統計。

該公司主係從事印刷電路板周邊設備之研發、製造、銷售，以及鑽孔加工與設備維修保養之專業服務，以下茲就設備產銷及專業服務之每人每年生產量值變動說明如下：

(1)專業服務

專業服務最近三年度之每人每年生產值呈現上升趨勢，主係下游廠商面對市場不佳時，減少資本支出之意願，如遇因需求回升而發生產能不足的情況，會選擇將訂單轉給與該公司相同之合格廠商，因此雖受到美中貿易戰與新冠疫情之衝擊，專業服務之產值下滑程度較設備產銷項目小，且該公司透過精實組織架構、廠辦合一等措施增進公司生產效率，使專業服務項目之每人每年生產值呈上升趨勢。110 年前三季每人每年生產值小幅下降，主係本期下游廠商增加資本支出擴充產能，委託該公司加工之需求下降所致。

(2)設備產銷

設備產銷項目最近三年度之每人每年生產量值呈現下降趨勢，主係美中貿易戰與新冠疫情對設備產銷項目之衝擊較大，產量與產值均大幅下滑，因市場氣氛充滿不確定性時，下游廠商對資本支出的態度趨於保守，設備訂單減少，公司減少生產安排所致。110 年前三季每人每年生產值上

升，主係本期下游廠商增加資本支出擴充產能，高精密設備訂單增加，生產量隨之增加所致。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季之每人每年平均生產量值主係隨市場供需變化而波動，其變動原因尚屬合理，尚無發現重大異常之情事。

2.申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料，以評估離職率之變化情形及其合理性以及對申請公司營運之風險

(1)員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料

單位：人

年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 9 月底止
項目					
期	初 人 數	464	448	311	277
新	進 人 數	56	46	59	24
離	職 人 數	59	65	54	25
退	休 人 數	1	0	0	3
資	遣 人 數	12	118	39	15
期	末 人 數	448	311	277	258
員工 分類	直 接 人 工	287	191	163	149
	間 接 人 工	161	120	114	109
平 均 年 齡 (歲)		38	41	42	43
平均服務年資 (年)		8	10	11	12

資料來源：該公司提供

該公司最近三年度及 110 年截至 9 月底止之員工人數分別為 448 人、311 人、277 人及 258 人，人員逐年減少，主係該公司於 108 年起為增進營運效率，透過處分子公司大船煙台股權、調整上海達航之集團定位與人員配置，以及將臺灣區資源整合為廠辦合一，精實組織架構所致。

108 年度資遣人數高達 118 人，主係處分子公司大船煙台股權與調整上海達航之人員配置所致。上海達航東莞分公司因位置及集團定位與東莞達程相似，且營運表現不佳而決定減少人員配置。該年度資遣人員中有 1 名經理級以上人員、40 名一般職員以及 77 名生產線員工，均已依法支付資遣費予以資遣，經評估對該公司營運尚無重大不利之影響。

平均年齡及平均服務年資方面，該公司員工平均年齡為 38 歲至

43 歲，平均服務年資為 8 年至 12 年，均逐年增加，顯示該公司人員穩定性尚佳，組成多為穩定發展中之青壯年，經評估該公司之人力組成尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司員工人數逐年減少，主係該公司為增進營運效率而精實組織架構所致，其期末員工變化原因、平均年齡及平均服務年資經評估尚屬合理。

(2)離職率之變化情形及其合理性以及對申請公司營運之風險

單位：人

年度	107 年度			108 年度			109 年度			110 年截至 9 月底止		
項目	期 末 人 數	離 職 人 數	離職率 (%)	期 末 人 數	離 職 人 數	離職率 (%)	期 末 人 數	離 職 人 數	離職率 (%)	期 末 人 數	離 職 人 數	離職率 (%)
經理級以上	10	0	0.00	9	1	10.00	9	0	0.00	8	1	11.11
一 般 職 員	195	28	12.56	137	59	30.10	126	34	21.25	128	11	7.91
生產線員工	243	44	15.33	165	123	42.71	142	59	29.35	122	31	20.26
合 計	448	72	13.85	311	183	37.04	277	93	25.14	258	43	14.29

資料來源：該公司提供

註 1：離職人數包含資遣及退休

註 2：離職率＝離職人數／（期末人數＋離職人數）

該公司最近三年度及 110 年截至 9 月底止之離職人數分別為 72 人、183 人、93 人及 43 人，其中經理級以上人員離職情形甚少，僅 108 年度及 110 年前三季各有 1 名離職。108 年度之離職人員係因無法配合該公司管理單位南遷至臺中之調動，故該公司依勞動基準法規定資遣該員，於法定時間內預先通報並支付資遣費用；110 年前三季之離職人員因符合退休資格而申請退休，上述人員工作均已由適當人員進行交接，而其他離職人員多為一般職員及生產線員工，該等人員可替代性較高，能視人力需求適時遞補，故上述員工之異動，尚不致對該公司營運產生重大影響。

該公司最近三年度及 110 年前三季之離職率分別為 13.85%、37.04%、25.14%以及 14.29%，其中 108 年度離職率偏高，主係處分子公司大船煙台股權與調整上海達航人員配置所致，該年度資遣人員達 118 人，若不考量因營運結構調整而資遣的人員，該年度離職率約為 17.72%，與其他期間相比尚無重大異常情形。

整體而言，該公司經理級以上人員離職情形甚少，顯示其營運階層尚屬穩定，且該公司已建立完整制度，人員離職前須確實完成交接工作，離職人員之工作均有安排適當人員承接，故對該公司營運尚不致產生重大不利影響。

(四) 各主要產品之成本

1.取得申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止主要產品之原料、人工及製造費用資料，核至相關帳冊，財務報表金額是否相符，並評估各成本要素之比率變化與同類別公司有無重大異常情事及對申請公司營運之風險

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	107 年		108 年		109 年		110 年前三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	原料	330,343	49%	261,461	47%	326,693	62%	233,921	58%
	直接人工	187,447	28%	162,541	29%	102,564	19%	87,615	22%
	製造費用	157,611	23%	132,637	24%	99,971	19%	80,795	20%
	小計	675,401	100%	556,639	100%	529,228	100%	402,331	100%
設備產銷	原料	356,686	82%	154,426	77%	119,492	88%	216,144	89%
	直接人工	51,492	12%	23,387	12%	10,446	8%	15,468	6%
	製造費用	27,576	6%	23,354	11%	5,725	4%	12,348	5%
	小計	435,754	100%	201,167	100%	135,663	100%	243,960	100%
其他	原料	-	-	-	-	-	-	-	-
	直接人工	-	-	-	-	-	-	-	-
	製造費用	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	原料	687,029	62%	415,887	55%	446,185	67%	450,065	70%
	直接人工	238,939	21%	185,928	24%	113,010	17%	103,083	16%
	製造費用	185,187	17%	155,991	21%	105,696	16%	93,143	14%
	總計	1,111,155	100%	757,806	100%	664,891	100%	646,291	100%

資料來源：該公司提供

該公司主係從事印刷電路板周邊設備之研發、製造、銷售，以及鑽孔加工與設備維修保養之專業服務等，其產品類別主要可區分為專業服務及設備產銷兩大類。於該公司整體成本結構中，原料所占比重最高，其次為直接人工及製造費用，以下茲就各年度主要產品之成本結構變動情形說明如下：

(1)專業服務

專業服務係指鑽孔加工服務及維修保養服務等，鑽孔加工服務係使用該公司自主研發生產之鑽孔機，配合客戶條件加工基板；維修保養服務係指設備機台之維修保養服務，除一般定期維修保養外，亦包含效率提升與設備改造等服務。最近三年度及 110 年前三季原料占成本比重分別為 49%、47%、62%及 58%，直接人工占成本比重分別為 28%、29%、19%及 22%，製造費用占成本比重分別為 23%、24%、19%及 20%。該公司製造費用占成本比重變化不大，而原料占成本比重於 109 年度及 110 年前三季上升，主係專業服務會依個案情形會使用不同規格的原料，隨

著加工精度與效率的要求提升，原料成本增加所致，經評估該公司專業服務之成本結構變動尚無重大異常之情事。

(2)設備產銷

設備產銷係指該公司機械鑽孔機與成型機之生產銷售。最近三年度及 110 年前三季原料占成本比重分別為 82%、77%、88%及 89%，直接人工占成本比重分別為 12%、12%、8%及 6%，製造費用占成本比重分別為 6%、11%、4%及 5%。108 年度製造費用占比增加，主係受美中貿易戰及新冠疫情影響，下游廠商資本支出意願保守，該公司設備產銷項目亦隨之衰退，整體產出下降，原料及直接人工均同步大幅減少，惟製造費用中的水電費、折舊費用等費用受整體產出數量影響不大，下降幅度較小，使製造費用占成本比重相對增加。109 年度及 110 年前三季之直接人工與製造費用占成本比重均下降，主係精實組織架構，人員減少，相關人力成本及製造費用降低所致，經評估該公司設備產銷之成本結構變動尚無重大異常之情事。

(3)其他

其他項目主係代理類收入，故無原料、直接人力及製造費用等相關成本。

整體而言，該公司最近三年度及 110 年前三季主要產品別之成本結構尚無發現重大異常之情事，對該公司營運亦未產生重大之營運風險。另因無法取得採樣同業之各產品別成本資訊，故無法針對各產品成本要素之比率變化與同業進行比較分析。

- 2.取得申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止主要產品之主要原料每年採購量及單價，核至相關帳冊，並評估價格變化情形，另與一般市場行情資料比較有無重大異常情事。

單位：新臺幣千元

原物料項目		107 年度	108 年度	109 年度	110 年 前三季
雷射頭	進貨金額	88,215	65,909	76,300	44,832
	進貨數量(個)	166	119	87	38
	平均單價	531	554	877	1,180
鑄物	進貨金額	93,161	24,851	20,812	52,908
	進貨數量(件)	1,067	280	300	1,644
	平均單價	87	89	69	32
電子掃描鏡	進貨金額	19,716	16,943	26,085	19,050
	進貨數量(個)	35	30	48	36

原物料項目		107 年度	108 年度	109 年度	110 年 前三季
	平均單價	563	565	543	529
控制器	進貨金額	61,867	28,269	18,508	34,127
	進貨數量(個)	602	264	111	250
	平均單價	103	107	167	137
螺桿與滑軌	進貨金額	63,494	41,942	14,077	22,883
	進貨數量(個)	10,963	5,961	3,147	4,819
	平均單價	6	7	4	5
鈹金	進貨金額	28,869	15,846	15,021	22,934
	進貨數量(件)	42,141	19,841	18,482	40,122
	平均單價	0.69	0.80	0.81	0.57
光學部品	進貨金額	19,051	19,447	29,980	24,600
	進貨數量(個)	721	457	894	663
	平均單價	26	43	34	37

資料來源：該公司提供

該公司主要產品之主要原物料為雷射頭、鑄物、電子掃描鏡、控制器、螺桿與滑軌、鈹金及光學部品，茲就主要原料之採購量及單價變化情形說明如下：

(1)雷射頭

雷射頭係用於雷射鑽孔加工服務所使用之雷射鑽孔機中，包含 CO2 雷射鑽孔機以及 UV 雷射鑽孔機，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 166 個、119 個、87 個及 38 個，此採購數量包含全新品與維修品，全新品係用於自行研發生產之雷射鑽孔機中，而維修品係指提供機台維修保養服務時所用之維修物料，而採購量呈現減少趨勢，主係客戶既有設備之加工條件與使用年限逐漸到達臨界值而維修需求減少，故採購維修品之數量逐年減少所致。

最近三年度及 110 年前三季之平均單價分別為 531 千元、554 千元、877 千元及 1,180 千元，平均單價變動主係採購品項包含全新品與維修品，其中維修品最近三年度及 110 年前三季採購金額占雷射頭採購金額比重分別為 83%、67%、41%及 24%，維修品採購比重因客戶維修需求減少而逐漸降低，然全新品之售價較維修品高，因此平均單價呈現上升趨勢。

(2)鑄物

鑄物係用於雷射鑽孔機、機械鑽孔機及成型機等設備之底座或床台，為設備之主要結構，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 1,067 件、280 件、300 件及 1,644 件，其採購量變化較大，主係鑄物因各式機型所需之形狀、重量及數量均不相同，採購量以件數計算具有較大差異。108 年

度較 107 年度採購量大幅減少，主係 107 年依據生產計劃預先備貨，而 108 年度受美中貿易戰影響，下游客戶減少設備訂單，該公司依實際需求量減少採購所致。109 年度及 110 年前三季採購數量呈現增加趨勢，主係 109 下半年度之主要生產機型設計改變，例如原本六軸鑽孔機中的六個主軸以同一件鑄物固定，可同步進行相同加工動作，而新機型則是將六個主軸以六件鑄物分別固定，可獨立運作執行加工，一台設備所需之鑄物件數上升，故採購數量呈增加趨勢。

最近三年度及 110 年前三季平均單價分別為 87 千元、89 千元、69 千元及 32 千元，107 年度及 108 年度之平均單價變化不大，109 年度起呈現下降趨勢，主係前述之機型設計改變，原先係採購一件大型鑄物，現改以採購六件小型鑄物，鑄物之重量減輕，每件鑄物之單價降低，再加上採購數量增加，使整體平均單價呈現下降趨勢。

(3)電子掃描鏡

電子掃描鏡係用於雷射鑽孔加工服務所使用之雷射鑽孔機中，用途為定位加工孔位點，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 35 個、30 個、48 個及 36 個，108 年度採購數量小幅減少主係前一年度已依生產計劃預先備料，而 108 年度僅需依實際生產情形調整採購量；109 年度採購數量上升係因該公司看好雷射加工技術之市場潛力，調增雷射鑽孔機之計畫生產量，故增加採購數量所致。

最近三年度及 110 年前三季平均單價分別為 563 千元、565 千元、543 千元及 529 千元，電子掃描鏡之單價穩定，係以美元採購，其平均單價變動主係美元匯率變動所致，經檢視美元兌新臺幣走勢，與平均單價變動趨勢相仿，尚無發現異常情事。

(4)控制器

控制器之於機械設備，有如大腦之於人類，搭載於鑽孔機、成型機等設備，以電腦數值控制設備，提高設備之加工精度與可靠性，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 602 個、264 個、111 個及 250 個，其採購量最近三年度呈現減少趨勢，主係該公司設備產銷之訂單減少，降低採購量所致，而 110 年前三季採購量相對上升，主係設備產銷之訂單增加，採購需求上升所致。

最近三年度及 110 年前三季平均單價分別為 103 千元、107 千元、167 千元及 137 千元，109 年度之平均單價較前兩年度增加約六成，主係該年度有設備改造案件，依客戶需求採用特殊規格之控制器，以及 109 下半年度開發生產高階鑽孔機，採用較高規格之控制器，使 109 年度之平均單價大幅上升。110 年前三季平均單價較 109 年度降低，係因該年度無設備改造委託，且 109 年下半年度生產之高階鑽孔機，於 110 年起進入量產，採

購價格較具優勢所致。

(5)螺桿與滑軌

螺桿與滑軌主係用於雷射鑽孔機、機械鑽孔機及成型機之 X、Y、Z 軸，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 10,963 個、5,961 個、3,147 個及 4,819 個，其採購量最近三年度呈現減少趨勢，主係該公司設備產銷之訂單減少，且 109 年起部分高階機種為增加設備加工效率，採用線性馬達替代螺桿，使整體採購需求降低所致，而 110 年前三季因設備產銷之訂單增加，導致整體採購需求上升所致。

最近三年度及 110 年前三季平均單價分別為 6 千元、7 千元、4 千元及 5 千元，平均單價下滑，主係螺桿單價較滑軌高，109 年度起螺桿採購比重降低，價格較低之滑軌採購比重上升，使平均單價呈現降低趨勢。

(6)鈹金

鈹金主係用於雷射鑽孔機、機械鑽孔機及成型機等設備之金屬鈹金外罩，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 42,141 件、19,841 件、18,482 件以及 40,122 件，其採購量最近三年度呈現減少趨勢，主係該公司設備產銷之訂單減少，採購需求降低所致，而 110 年前三季因設備產銷之訂單增加，導致採購需求上升所致。

最近三年度及 110 年前三季平均單價分別為 0.69 千元、0.80 千元、0.81 千元及 0.57 千元，108 年度及 109 年度之平均單價較 107 年度上升約 16%，主係 108 年度及 109 年度因設備產銷訂單下滑，採購數量減少，與供應商取得之單價較高所致；110 年前三季平均單價降低，主係隨景氣逐漸回溫，該公司採購量增加，與供應商取得較優惠之價格所致。

(7)光學部品

光學部品包含偏光鏡、透鏡等鏡面以及應用於雷射技術中的各式光學組件，最近三年度及 110 年前三季之採購量分別為 721 個、457 個、894 個及 663 個，其採購量變化較大，主係這類產品交期較長，須預先備料，107 年度及 109 年度依生產計劃預先備料，而 108 年度及 110 年度則依實際生產與市場供需情形調整當年度採購量。109 年度採購量較 107 年度高，係因該公司看好雷射加工技術之市場潛力，調增雷射鑽孔機之計畫生產量，採購需求上升所致。

最近三年度及 110 年前三季平均單價分別為 26 千元、43 千元、34 千元及 37 千元，其平均單價變化較大，108 年度平均單價較高，主係該年度有 UV 雷射鑽孔機之生產需求，該機種採用之光學部品單價較 CO2 雷射鑽孔機高，且該年度為配合加工精度提升，進行設備仕様升級，採用較高規格的光學部品，拉高平均單價所致；109 年度及 110 年前三季平均單價

穩定，但較 108 年度降低，係因 108 年度設備仕樣升級後的機型，於 109 年度起量產，採購價格較具優勢所致。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季主要原料之採購量及單價變化尚屬合理，尚無發現重大異常之情事。

- 3.取得申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止長期供貨契約，暨供貨短缺或中斷情形資料，以評估供貨契約有無重大限制條款及貨源過度集中之風險。

該公司並未與供應商簽定長期供貨合約，其所選擇之供應商除考量品質、價格及銷貨客戶之需求外，亦為確保各項原物料貨源之穩定性，分散向數家供應商採購，且與供應商間維持良好之合作關係。最近三年度及 110 年前三季單一廠商進貨金額占各期總進貨金額之比重均未達 30%，故尚無進貨過度集中之風險，另最近三年度及 110 年截至評估報告出具日止，尚無發現該公司有發生供貨短缺或中斷之情事。

- 4.建設公司申請股票上櫃者，取得當（鄰）地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例（如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等），以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，申請公司與地主之分配比率是否合理

該公司非屬建設公司申請股票上櫃，故不適用此項評估。

(五) 匯率變動情形

- 1.就申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止兌換損益占營業利益之比率及內外銷、內外購比率以評估匯率變動對申請公司營運之風險

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止兌換損益占營業利益之比率

單位：新臺幣千元

項目	年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 前三季
兌換(損)益		(3,189)	(1,970)	3,346	5,017
營業收入		1,542,739	1,175,825	1,001,731	884,477
營業利益		52,715	46,956	110,183	59,299
兌換(損)益占營業收入比率		(0.21)%	(0.17)%	0.33%	0.57%
兌換(損)益占營業利益比率		(6.05)%	(4.20)%	3.04%	8.46%

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近三年度及 110 年前三季兌換(損)益金額分別為(3,189)千元、(1,970)千元、3,346 千元及 5,017 千元，占各年度營業收入比率分別為(0.21)%、(0.17)%、0.33%及 0.57%；占各年度營業利益比率分別為(6.05)%、(4.20)%、3.04%及 8.46%。該公司之營運據點涵蓋臺灣、日本及中國，其銷貨與進貨係以臺幣、美元、人民幣、日圓及歐元做為交易計價之貨幣，於日常營運中即需面對多種不同外幣產生之匯率風險，其中受到美金、人民幣及日圓匯率影響較為顯著。

107 年度兌換損失 3,189 千元，該損失主係來自該公司之子公司 CHINA EXPO，其為境外投資公司，旗下轉投資公司於中國營運，如東莞達程、上海達航及大船煙台，使美金兌人民幣匯率對其兌換損益影響較大。107 年度美國聯準會升息、英國脫歐協議有變數，支撐美元指數上漲，且 107 年 3 月起美國放話對中國加徵關稅，使人民幣大幅走跌，致使 CHINA EXPO 產生兌換損失。

108 年度兌換損失 1,970 千元，主係來自達航科技持有之日圓外幣負債部位以及採日圓計價之進貨交易，108 年度日圓走勢起伏劇烈，年初美中貿易戰衝突緩和，避險情緒降溫，日圓走貶，5 月中美中貿易衝突升溫，避險需求推升日圓匯價，8 月日圓升值至全年最高點 0.2995 元，嗣後市場對美中貿易協商轉趨樂觀，加上 10 月底日本央行調整政策利率前瞻指引，導致日圓貶值，惟全年度日圓整體仍呈升值情形，因此產生兌換損失。

109 年度兌換利益 3,346 千元，主係來自該公司之子公司 CHINA EXPO，而影響其兌換損益最深的是美金兌人民幣之匯率。109 年度受到新冠肺炎疫情影響，市場擔憂未來經濟持續受到衝擊，聯準會宣布寬鬆貨幣政策並降息 4 碼，美元走弱人民幣強勢，全年人民幣兌美元升值幅度約 6.47%，CHINA EXPO 受惠於人民幣強勢升值，產生兌換利益。

110 年前三季兌換利益 5,017 千元，主係來自達航科技持有之日圓

外幣負債部位以及採日圓計價之進貨交易。日圓貶值的原因主係日本央行為因應新冠疫情，持續維持大規模貨幣寬鬆政策，使日圓 110 年迄今一路貶值，產生兌換利益。

整體而言，該公司兌換損益之變化情形與匯率趨勢相較尚屬合理，且兌換損益占營業收入與營業利益之比重非屬重大，經評估其兌換損益對該公司營運尚不致造成重大影響。

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止內外銷、內外購比率

A.內外銷情形

單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
內銷	623,321	40.40	761,600	64.77	725,093	72.38	699,317	79.07
外銷	919,418	59.60	414,225	35.23	276,638	27.62	185,160	20.93
合計	1,542,739	100.00	1,175,825	100.00	1,001,731	100.00	884,477	100.00

資料來源：該公司提供

該公司最近三年度及 110 年前三季外銷占營業收入比重分別為 59.60%、35.23%、27.62%及 20.93%，外銷地區以中國為主，外銷比重自 108 年起明顯下滑，主係受美中貿易戰之影響，該公司對中國外銷設備之數量明顯下滑，收款幣別採人民幣或美元計價，故外銷比重之多寡，將會改變人民幣與美元對該公司營收與獲利之影響程度。

B.內外購情形

單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
內購	763,764	78.59	362,301	73.11	357,099	71.74	448,027	76.96
外購	208,030	21.41	133,239	26.89	140,637	28.26	134,123	23.04
合計	971,794	100.00	495,540	100.00	497,736	100.00	582,149	100.00

資料來源：該公司提供

該公司最近三年度及 110 年前三季外購比重分別為 21.41%、26.89%、28.26%及 23.04%，主係向美國、歐洲及日本等國外廠商採購精密組件，多以美元、歐元或日圓計價，外購比重約占兩成，占比變化不大，美元、歐元與日圓之走勢對該公司營收與獲利將有一定程度之影響。109 年度外購比重上升主係內購金額下滑所致，外購品項多用於雷射鑽孔機，而雷射鑽孔機生產計劃穩定，故外購金額並無大幅變動，而內購品項多為同時用於機械鑽孔機與雷射鑽孔機，因設備產銷訂單減少，且前一年度之庫存尚未消化完畢，導致內購之進貨金額降低。

整體而言，該公司內銷與內購之比重較高，匯率走勢對其營收與獲利之影響尚不致造成重大影響。

2.申請公司因應匯率變動之避險措施

有鑑於匯率波動變化難以估算，為降低匯率變動對營收與獲利之影響，該公司採取之因應措施如下：

- (1)在業務訂價過程中，考量因匯率變動產生之影響，以確保利潤目標。
- (2)採用自然避險方式，將外銷所得之外幣貨款，用以支應外購產生之外幣應付款項。
- (3)於往來銀行開立外幣存款帳戶，因應外匯資金需求保留外幣部位。
- (4)財務部門隨時注意並掌握外匯市場之變化，以及公司對外幣資金之需求，慎選結匯時機，以期降低匯率變動之風險。

肆、業務狀況

一、營業概況

(一)最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象及供應商(年度前十名或佔年度營業收入淨額或進貨淨額五%以上者)之變化分析

1.最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及佔年度營業收入比例

單位：新台幣千元,%

排名	107 年度			108 年度			109 年度			110 年前三季		
	公司名稱	金額	%	公司名稱	金額	%	公司名稱	金額	%	公司名稱	金額	%
1	C 公司	164,381	10.66	C 公司	213,205	18.13	C 公司	252,825	25.24	A 公司	190,625	21.55
2	A-2 公司	110,595	7.17	A-2 公司	142,659	12.13	B 公司	92,269	9.21	B 公司	122,812	13.89
3	M-2	85,550	5.55	A 公司	75,009	6.38	A 公司	52,140	5.20	D 公司	73,143	8.27
4	凱歲電子	72,500	4.70	L 公司	72,577	6.17	D-1 公司	37,205	3.71	C 公司	69,170	7.82
5	A-1 公司	68,406	4.43	A-1 公司	49,379	4.20	A-1 公司	29,409	2.94	G 公司	52,997	5.99
6	A 公司	57,338	3.72	F 公司	26,300	2.24	G 公司	28,252	2.82	競國	28,484	3.22
7	E 公司	45,627	2.96	M-3 公司	24,406	2.08	I 公司	22,960	2.29	A-1 公司	21,876	2.47
8	L 公司	38,158	2.47	瀚宇博德(江陰)	23,926	2.03	瀚宇博德(江陰)	21,504	2.15	YS	18,531	2.10
9	M-1 公司	35,232	2.28	J 公司	23,709	2.02	C-1 公司	19,017	1.90	C-1 公司	18,227	2.06
10	K 公司	32,772	2.12	B 公司	17,655	1.50	J 公司	18,848	1.88	H 公司	16,564	1.87
	小計	710,559	46.06	小計	668,825	56.88	小計	574,429	57.34	小計	612,429	69.24
	其他	832,180	53.94	其他	507,000	43.12	其他	427,302	42.66	其他	272,048	30.76
	銷貨淨額	1,542,739	100.00	銷貨淨額	1,175,825	100.00	銷貨淨額	1,001,731	100.00	銷貨淨額	884,477	100.00

資料來源：該公司提供

註：以上銷貨客戶與發行人之關係：無。

(1)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司主要從事 PCB 或載板製程中所需的鑽孔技術，故該公司擁有鑽孔機台及成型機台設備的自製生產能力與自有品牌之販售，以及其設備關鍵零組件的維修與保養之服務，另，鑽孔機亦可區分為機械鑽孔機與雷射鑽孔機，於民國 80 年及 106 年間，該公司已分別自行開發成功機械鑽孔設備及雷射鑽孔設備，以供應客戶化鑽孔製程之需求，惟，雷射鑽孔設備之營運模式並非買賣方式，則採取雷射應用加工方式、設備駐廠或租賃的方式提供服務，因此，該公司客戶之銷售變化，分別受因下游印刷電路板廠製程優化改善、產能擴充及建置需求，以及消費性電子產品(智慧手機、NB、PC、穿戴式配件及車用市場等)中、長期發展，所需搭載的印刷電路板製程工藝需求而產生變化，以下茲就該公司最近三年度及 110 年度前三季主要合併銷售客戶對象變化情形，逐一進行說明：

A.C 集團

最近三年度及 110 年前三季對 C 集團之銷貨情形

單位：新台幣千元

公司名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
C 公司	164,381	10.66	213,205	18.13	252,825	25.24	69,170	7.82
C-1 公司	20,239	1.31	8,709	0.74	19,017	1.90	18,227	2.06
合計	184,620	11.97	221,914	18.87	271,842	27.14	87,397	9.88

資料來源:該公司提供。

該公司於 80 年與 C 集團開始交易，主要供應機鑽設備的售後維修保養及雷射應用服務為主。該公司最近三年度及 110 年前三季對 C 集團之銷售金額分別為 184,620 千元、221,914 千元、271,842 千元及 87,397 千元，占銷貨淨額比重分別為 11.97%、18.87%、27.14%及 9.88%，最近三年度對 C 集團之銷售金額逐年增長，係受惠於 5G 基礎建設啟動，推升高層數大尺寸網通載板之需求，使得 ABF 載板重新獲得青睞，廣泛被應用於 5G 基礎建設與高階 5G 智慧型手機，網通市場持續開發高階網通設備、人工智慧、雲端伺服器、天線模組及基地台收發器等高值化載板，致增加對該公司之雷射鑽孔應用加工服務採購，故最近三年 C 集團位居該公司前十大排行之第一，110 年前三季退居至第三大銷售客戶，係因 C 集團於 110 年前三季增添之產能設備交貨，故降低雷射應用採購所致。

B. A 集團

最近三年度及 110 年前三季對 A 集團之銷貨情形

單位：新台幣千元

公司名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
A 公司	57,338	3.72	75,009	6.38	52,140	5.20	190,625	21.55

A-2 公司	110,595	7.17	142,659	12.13	16,258	1.62	-	-
A-1 公司	68,406	4.43	49,379	4.20	29,409	2.94	21,876	2.47
合計	236,339	15.32	267,047	22.71	97,914	9.76	212,501	24.02

資料來源:該公司提供。

該公司於 80 年開始與 A 集團交易，主要供應高階印刷電路板的鑽孔及成型機設備、雷射應用鑽孔及各式機鑽設備的維修保養服務為主。該公司最近三年度及 110 年前三季對 A 集團銷售金額分別為 236,339 千元、267,047 千元、97,914 千元及 212,501 千元，占銷貨淨額比重分別為 15.32%、22.71%、9.76%及 24.02%，其中，108 年度較前一年度銷售金額增加 30,708 千元，成長幅度 12.99%，分別受惠 A 公司及 A-2 的產能擴充所致；109 年度較前一年度銷售額減少 169,133 千元，衰減幅度 63.33%，係因 108 年度 12 月底，中國大陸湖北省武漢市爆發新冠肺炎，中國大陸各省市府為降低新冠肺炎疫情蔓延，便展開封城管制禁令，迫使部分工廠停工，致 109 年度 A-2 公司及 A-1 公司的設備採購及維修採購訂單之需求銳減；110 年前三季，受惠於高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、雲端與新世代 GPU 需求帶動 ABF 產業需求大增，該公司對 A 集團之銷售金額大幅提高，致 110 年前三季度 A 公司位居第一大銷售客戶。隨著高階產品的產能需求上揚，以及因應 AI 與未來 5G 市場的布局，A 集團配合下游客戶中、長期產品開發，漸進式的進行產能擴充與製程優化，故 A 集團最近三年度及 110 年前三季銷售金額皆位居該公司前十大銷售客戶排行之列。

C.M-3 集團

最近三年度及 110 年前三季對 M-3 集團之銷貨情形

單位：新台幣千元

公司名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
M-3	20,878	1.35	24,406	2.08	10,261	1.02	7,126	0.82
M-2	85,550	5.55	1,673	0.14	1,906	0.19	2,888	0.33
M-1	35,232	2.28	9,598	0.82	3,536	0.35	3,149	0.34
合計	141,660	9.18	35,677	3.04	15,703	1.56	13,163	1.49

資料來源:該公司提供。

該公司於 81 年與 M-3 開始交易，主要供應印刷電路板鑽孔及成型設備機台、設備維修保養及雷射應用服務為主，最近三年度及 110 年前三季，該公司對 M-3 集團銷售金額分別為 141,660 千元、35,677 千元、15,703 千元及 13,163 千元，占銷貨淨額比重分別為 9.18%、3.04%、1.56%及 1.49%，107 年配合中國大陸因應 5G 通訊建置與電動車汽車雷達板的投產需求下，增加對該公司機鑽孔設備及成型設備之採購，但隨著 M-2 及 M-1 於 108 年初完工後，故逐漸降低對該公司的設備採購需求，

致 108 年度較前一年度銷售金額減少 105,983 千元，衰減幅度 74.82%；該公司 109 年對 M-3 集團銷售金額較前一年度減少 19,974 千元，衰減幅度 55.99%，係因雷射應用服務訂單衰減，110 年前三季較前一年度同期間增加 228 千元，變動幅度 1.76%，係因變動微小故不擬予深入分析。

D. 凱崙電子股份有限公司

凱崙電子股份有限公司(以下簡稱：凱崙)，成立於 86 年，為國內上櫃公司，其生產基地遍佈台灣及中國，主要生產印刷電路板使用的鑽頭、切削刀具及代銷銅箔基板及鑽孔加工服務專業廠商，由於，鑽頭產品屬耗材性質，係因配合高精密、輕薄化、可攜式的電腦、通訊及消費性電子產品的製程需求，應用於多層、高密度、小孔及薄型多層結構之印刷電路板的製程上。

該公司於 107 年與凱崙開始交易，主要供應印刷電路板機鑽及成型設備、設備維修保養為主。最近三年度及 110 年前三季該公司僅於 107 年與凱崙交易往來，銷售金額與比重分別為 72,500 千元及 4.70%，係因 107 年凱崙擴展機械鑽孔代工業務，故增加對該公司印刷電路板機鑽設備機台之採購，然隨著 108 年美中貿易關係緊張，隨著關稅壁壘政策的影響、中國大陸勞工成本及終端消費大廠訂單不確定性高，促使下游印刷電路板廠的資本投資意願降低，致 108 年起凱崙並未再與該公司進行交易。

E. E 公司

E 公司，於 72 年設立，總部位於日本長野縣，主要從事印刷電路板製造、基板材料應用及開發，其產品終端應用於汽車零件、空調設備和 O A 設備產業。

該公司於 106 年與 E 公司開始交易，主要供應印刷電路板機鑽機設備及產品維修保養服務為主。該公司最近三年度及 110 年前三季對 E 公司的銷售金額分別為 45,627 千元、4,757 千元、4,556 千元及 1,204 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.96%、0.40%、0.45%及 0.14%。107 年間，E 公司向該公司持股 100%子公司日本大船採購印刷電路鑽孔及成型設備機台，致 107 年進入該公司前十大銷售客戶之列，108 年起雙方維繫設備維修保養服務為主，故於 108 年起退出前十大銷售之客戶之列。

F. L 公司

該公司於 102 年起與 L 公司開始交易，主要供應印刷電路板機鑽及成型設備機台及設備維修保養。最近三年度及 110 年前三季對 L 公司銷售金額分別為 38,158 千元、72,577 千元、2,281 千元及 1,821 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.47%、6.17%、0.23%及 0.21%，108 年較前一年度銷售金額增加 34,419 千元，成長 90.20%，係因 L 公司分階段擴建產能，受惠於全球電動車的智能化，推升汽車電子多層板的供給量，致該公司

對 L 公司的印刷電路板鑽孔機設備的出貨量增加，隨著 L 公司的產能擴建案結束後，亦降低設備採購之需求，109 年度起，以提供一般設備維修保養服務為主，而退出前十大銷售客戶之列。

G. K公司

K 公司，主要從事印刷電路板製造及銷售業務，包含一般多層電路板、高密度電路板(HDI)、高層次板(HLC)、軟板(FPC)與軟硬板(Rigid-Flex PCB)等產品的生產製造及提供表面黏著技術 (SMT)之表面組裝服務，其產品搭載終端應用為 3C、伺服器及通訊產品。

該公司於 91 年與 K 公司開始交易，主要供應印刷電路板機鑽及成型設備、設備維修保養及雷射應用服務為主。該公司最近三年度及 110 年前三季對 K 公司銷售金額分別為 32,772 千元、14,501 千元、2,020 千元及 132 元，占銷貨淨額比重分別為 2.12%、1.23%、0.20%及 0.01%，該公司對 K 公司銷售業績持續下滑，係因 3C 產品已邁入成熟期且換機週期拉長，另，伺服器產品因受美中貿易戰影響、致企業投資趨於保守、代工產線移轉等因素，整體伺服器市場成長動能趨緩，降低 K 公司的資本支出，108 年起已退出該公司前十大銷售客戶之列。

H.F公司

該公司於 102 年與 F 公司開始交易，主要供應印刷電路板機鑽機及成型機台維修保養及雷射應用服務為主。最近三年度及 110 年前三季該公司對 F 公司銷售金額分別為 24,752 千元、26,300 千元、11,500 千元及 10,996 千元，占銷售淨額比重分別為 1.60%、2.24%、1.15%及 1.24%，108 年較前一年度銷售金額增加 1,097 千元，成長 4.43%，係因 F 公司對該公司雷射應用訂單增加所致，109 年度較前一年度銷售金額減少 14,211 千元，衰減 54.98%，係因 F 公司的雷射應用服務訂單需求減少所致，110 年前三季 F 公司向該公司增加少量雷射應用的採購訂單，整體而言，F 公司僅 108 年度列入該公司前十大主要銷售客戶之列。

I.瀚宇博德科技(江陰)有限公司

瀚宇博德科技(江陰)有限公司(以下簡稱：瀚宇博德(江陰))，為國內上市公司瀚宇博德股份有限公司(以下簡稱：瀚宇博)持股 100%之子公司，主要生產雙面至十六層的多層印刷電路板，產品應用於筆記型電腦、行動電話、平面電視、遊戲機、通訊設備、機上盒及伺服器等專用印刷電路板，其中，以筆記型電腦用板為大宗。

該公司於 93 年與瀚宇博德(江陰)開始交易，主要供應印刷電路板機鑽及成型設備的維修改造及保養為主。最近三年度及 110 年前三季該公司對瀚宇博德(江陰)銷售金額分別為 28,667 千元、23,926 千元、21,504 千元及 14,488 千元，占銷貨淨額比重分別為 1.86%、2.03%、2.15%及 1.64%，108 年度較前一年度銷售金額減少 4,741 千元，成長(16.54)%，

係 107 年度起瀚宇博位於中國華中及華南廠區生產基地，為優化產能需求而汰換部分老舊設備的零件，故持續對該公司下單，最近三年度銷貨金額皆維持在 20,000 千元以上，110 年前三季較前一年度同期間減少 2,805 千元，成長(16.22)%，係因產線擴增計畫已完工，整體而言，瀚宇博德(江陰)108 年度、109 年度仍位居該公司第八大銷售客戶之列，惟 110 年前三季退出前十大銷售客戶之列。

J.J公司

J 公司，成立於 94 年，主要提供硬質單(雙)面印刷電路板、硬質多層印刷電路板、軟質多層印刷電路板及其他印刷電路板之產銷業務，終端應用於 PC/NB、可攜式電子裝置等產品。

該公司於 95 年與 J 公司開始交易，主要供應印刷電路鑽孔機及成型設備維修保養服務為主。最近三年度及 110 年前三季銷貨金額分別為 28,698 千元、23,709 千元、18,848 千元及 11,250 千元，占銷貨淨額比重分別為 1.86%、2.02%、1.88%及 1.27%，於 107 及 108 年間，受因美中貿易戰的影響下，使得下游消費性電子大廠的出貨意願降低，且 109 年度因新冠肺炎(COVID-19)於全球肆虐的影響下，致該公司對 J 公司銷售金額逐年遞減，另該公司最近三年度及 110 年前三季的前十大銷售客戶的排行，J 公司僅於 107 年度及 110 年前三季未入列前十大銷售客戶之列，108 年度及 109 年度分別位居為第九大及第十大銷售客戶之列。

K.B公司

該公司於 90 年與 B 公司開始交易，主要供應印刷電路板機鑽及成型設備維修、零件組裝及雷射應用服務為主。最近三年度及 110 年前三季該公司對 B 公司銷售金額分別為 23,318 千元、17,655 千元、92,269 千元及 122,812 千元，占銷貨淨額比重分別為 1.51%、1.50%、9.21%及 13.89%，108 年度較前一年度銷售金額減少 5,663 千元，衰減 24.29%，係因 B 公司的鑽孔及成型設備維修服務需求減少所致，另，109 年度起銷售金額持續增加，係因 5G、高效能運算和人工智慧等應用帶動 ABF 載板及 BT 載板的供給需求，以致 B 公司對該公司增加雷射應用服務的訂單需求，整體而言，最近三年度及 110 年前三季，除 107 年未列入前十大銷貨客戶外，108~109 年度及 110 年前三季均位居該公司前十大銷貨客戶之列。

L.D集團

最近三年度及及110年前三季對D集團之銷售情形

單位：新台幣千元

公司名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
D-1 公司	-	-	100	0.01	37,205	3.71	10,870	1.23

D 公司	14,589	0.95	6,890	0.59	8,630	0.86	73,143	8.27
合計	14,589	0.95	6,990	0.60	45,835	4.57	84,013	9.50

資料來源:該公司提供。

該公司於 80 年與 D 公司開始交易，主要供應印刷電路機鑽機及成型設備銷售及維修保養服務為主。最近三年度及 110 年前三季銷售金額分別 14,589 千元、6,990 千元、45,835 千元及 84,013 千元，占合併銷售淨額比重分別為 0.95%、0.60%、4.57%及 9.50%，108 年度較前一年度減少 7,599 千元，變動幅度(52.09)%，109 年度較前一年度增加 38,845 千元，變動幅度 554.72%，係因 D-1 於新設廠房銜接原 D-1 的產能，故增加鑽孔機設備採購，110 年前三季 D 公司為因應高階 NB 及消費性電子商品及車用電子產品等軟、硬結合板之應用製程需求，故增加鑽孔設備採購訂單，而成為該公司前十大銷售客戶之列。

M.G公司

該公司於 88 年與 G 公司開始交易，主要供應 G 公司印刷電路機鑽機及成型設備銷售及維修保養服務為主。最近三年度及 110 年前三季銷售金額分別為 504 千元、461 千元、28,252 千元及 52,997 千元，占合併銷售淨額比重分別為 0.03%、0.04%、2.82%及 5.99%，109 年 G 公司為配合下游客戶的投產製程需求，向該公司增添機台設備，而擠入同年間第六大銷售客戶之列，其餘各年間，向該公司之採購需求以維修保養服務為主，然，110 年前三季 G 公司為因應下游印刷電路板廠的高階載板的製程需求，進而向該公司添增鑽孔機設備，致 110 年前三季位居該公司排行第五大。

N.I公司

I 公司，成立於 90 年，主要從事發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷。該公司於 102 年與 I 公司開始交易，最近三年度及 110 年前三季銷售金額分別為 14,042 千元、8,057 千元、22,960 千元及 4,510 千元，占銷售淨額比重分別為 0.89%、0.68%、2.29%及 0.46%，108 年度較前一年度減少 5,985 千元，衰減 42.62%，係因維修保養服務訂單減少所致，109 年度較前一年度增加 14,903 千元，成長 184.97%，係因出售鑽孔機設備所致，另，110 年前三季較前一年度同期，係因專業服務設備維修、保養訂單減少，致銷售業績表現減少。

O.競國實業股份有限公司

競國實業股份有限公司(以下簡稱：競國)，成立於 70 年，為國內上市公司，其生產基地遍佈台灣及中國，主要從事專業製造雙層、多層印刷電路板且採少量多樣方式生產，終端應用於網路、LED、DRAM 模組、電視、消費性電子、汽車等領域。

該公司於 86 年與競國開始交易，主要供應印刷電路鑽孔機及成型

設備銷售及維修保養服務為主。最近三年度及 110 年前三季銷售金額分別為 22,923 千元、10,897 千元、12,733 千元及 28,484 千元，占銷售淨額比重分別為 1.49%、0.93%、1.27%及 3.22%，108 年度較前一年度減少 12,026 千元，衰減 52.46%，係 108 年度設備採購訂單減少所致，109 年度較前一年度增加 1,836 千元，成長 16.85%，係因增添鑽孔設備的採購所致，110 年前三季較前一年度同期間銷售業績成長，係因鑽孔設備採購訂單。整體而言，競國僅於 110 年前三季列入該公司前十大銷售客戶之列，位居第六大，其餘各年未列入該公司前十大銷售客戶之列。

P.H 公司

H 公司，設立於 101 年，位於臺中市大甲區，主要從事五金批發業、電子材料批發業及電子零組件製造業。最近三年度及 110 年前三季銷售金額分別為 716 千元、2,423 千元、12,842 千元及 16,564 千元，占銷售淨額比重分別為 0.05%、0.21%、1.28%及 1.87%，該公司主要提供鑽孔設備的關鍵性零件產品為主，108 年度較前一年度增加 1,707 千元，變動幅度 238.41%，係因鑽孔機設備之關鍵性零件採購增加，109 年度較前一年度增加 10,419 千元，變動幅度 430.00%，主要係以雷射鑽孔關鍵性零件採購增加，110 年前三季，則因雷射光學零件屬高單價之採購增加，致 110 年前三季竄升為第十大銷售客戶之列。

Q、ヤハタ精工株式会社(英譯，YAHATA-SEIKO CO. LTD)

ヤハタ精工株式会社(以下簡稱：YS)，於 63 年設立，總部位於日本長野縣，係為日商八幡商事株式会社(英譯:YAHATA CO.)轉投資公司，主要從事印刷電路板製造鑽孔及雷射鑽孔專業加工公司。

該公司於 103 年與 YS 開始交易，主要提供雷射應用加工及設備租賃服務為主，最近三年度及 110 年前三季該公司對 YS 的銷售金額分別為 326 千元、7,347 千元、4,400 千元及 18,531 千元，占各年度之銷貨淨額比重分別為 0.02%、0.37%、0.44%及 2.10%，最近三年該公司主要提供少量的雷射應用代工服務，然自 110 年下半年起，因市場對載板需求日益增加，YS 公司採擴增產能方式因應，因此，向該公司承租雷射鑽孔設備，以穩定產能之供給與交期，使其於 110 年前三季竄升為該公司前十大銷售客戶列。

(2)是否有銷售集中之風險

該公司 107 至 109 年度及 110 年前三季前十大客戶占營收比重分別為 46.06%、56.88%、57.34%及 69.24%，其中，107 年度至 109 年度對第一大客戶 C 集團銷售金額分別為 184,620 千元、221,914 千元、271,842 千元及 87,397 千元，占各年度銷售收入占比分別為 11.97%、18.87%、27.14%及 9.88%，另，第二大客戶 A 集團銷售金額分別為 236,339 千元、267,047 千元、97,914 千元及 212,501 千元，占各年度銷售收入占比分別為 15.32%、22.71%、9.76%及 24.02%，該公司銷售增減變化，主要受終端市場中、長期產品發展需求，間接牽動下游印刷電路板廠之製程改善、

產能擴充及建置之需求影響所致，整體而言，該公司最近三年度及 110 年前三季前十大銷售客戶占各期間營收比重，並未有單一客戶達三成以上，故尚無顯著銷售集中風險。

(3)銷售政策

該公司長年專注於 PCB 鑽孔設備之自製、維修及保養等專業服務市場，且近年來，朝向提供整合性的資訊與自動化服務，以自製產能的專業雷射應用設備服務，使現有客戶生產效率及產品良率大幅提升，故該公司整體服務，源自於創新、專業、務實、誠信及品質主要訴求，從產品研發、改造及鑽孔材質的特性上與客戶產品高度依存，且適時協助客戶解決產線投產設備的問題，因此，該公司仍將持續強化技術支援及解決方案能力，以身為客戶值得信賴的夥伴為該公司主要銷售政策。

2.最近三年度及申請年度截至最近期止各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，分析最近三年度及申請年度截至最近期止主要供應商名稱、價格及條件之變化原因是否合理，是否有進貨集中之風險，並簡述申請公司之進貨政策

(1)主要供應商變化情形之原因並分析是否合理

單位：新臺幣千元；%

排 名	107 年度			108 年度			109 年度			110 年前三季		
	供應商名稱	金額	占進貨 淨額%	供應商名稱	金額	占進貨 淨額%	供應商名稱	金額	占進貨淨 額%	供應商名稱	金額	占進貨 淨額%
1	甲公司	88,215	9.08	甲公司	65,909	13.30	甲公司	76,300	15.33	甲公司	44,832	7.70
2	丙公司	70,999	7.31	日商清光社	25,907	5.23	戊公司	26,085	5.24	丁公司	29,119	5.00
3	丁公司	55,047	5.66	丁公司	25,487	5.14	日商住友電工	18,082	3.63	日商宝產業	24,600	4.23
4	日商清光社	30,764	3.17	日商住友電工	19,447	3.92	日商駿河	16,859	3.39	丙公司	19,852	3.41
5	庚公司	28,150	2.90	戊公司	16,943	3.42	丁公司	16,678	3.35	乙公司	19,513	3.35
6	台灣維亞	27,518	2.83	日商 KANTO	13,224	2.67	日商 S.E.C	13,820	2.78	戊公司	19,050	3.27
7	己公司	24,881	2.56	日商駿河	11,953	2.41	日商明治電機	13,430	2.70	己公司	17,244	2.96
8	戊公司	19,716	2.03	日商 S.E.C	10,520	2.12	日商宝產業	11,898	2.39	壬公司	15,829	2.72
9	日商 KANTO	19,388	2.00	丙公司	10,415	2.10	日商 KANTO	10,035	2.02	日商山洋電氣	14,761	2.54
10	日商住友電工	19,051	1.96	日商明治電機	10,352	2.09	辛公司	8,369	1.68	日商駿河	12,885	2.21
	小計	383,729	39.50	小計	210,157	42.41	小計	211,556	42.51	小計	217,685	37.39
	其他	588,065	60.50	其他	285,383	57.59	其他	286,180	57.49	其他	364,464	62.61
	進貨淨額	971,794	100.00	進貨淨額	495,540	100.00	進貨淨額	497,736	100.00	進貨淨額	582,149	100.00

資料來源：該公司提供

註：以上供應商與發行人之關係：無。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季之進貨淨額分別為 971,794 千元、495,540 千元、497,736 千元及 582,149 千元，主要進貨原物料為雷射頭、電子掃描鏡、鑄物、控制器及螺桿等，該公司之生產模式係依客戶訂單及計劃性生產，生產客製化設備，除各事業部產品皆採用之原物料外，對供應商之採購項目及金額常隨當年度承接設備規格不同而有變化，以下茲就各年度供應商變化情形概述如下：

A. 甲公司

甲公司成立於民國 95 年，實收資本額為美金 1 千元，主要銷售及製造雷射頭，為美國那斯達克掛牌 Coherent, Inc(交易代號 COHR)旗下之子公司，Coherent, Inc 為全球最大的雷射儀器產品及相關光電子產品製造商，主要應用於科學研究、醫療、工業等多項行業。

該公司自 103 年開始與甲公司交易往來，主要向甲公司進貨雷射機台使用之雷射頭，該公司 107~109 年度及 110 年前三季向甲公司進貨金額分別為 88,215 千元、65,909 千元、76,300 千元及 44,832 千元，占進貨淨額比率分別為 9.08%、13.30%、15.33%及 7.7%，108 年度進貨淨額較 107 年度減少 22,306 千元，主要係該公司 108 年度對雷射頭需求減少著重在汰換零件維修，故使 108 年度較 107 年度金額下降，109 年度進貨淨額較 108 年度增加 10,390 千元，主要係持續增加雷射機台組裝因而增購雷射頭，且維修件亦增加故金額較前期為高，110 年前三季則與去年同期持平，各年度及 110 年前三季均居於第一大供應商之列，尚無重大異常之情事。

B. 丙公司

丙公司成立於民國 83 年，實收資本額為新臺幣 469,500 千元，主要從事 CNC 工具機本體鑄件、各式鑄鐵及鑄鋼產品的製造及銷售，該公司自 102 年開始與丙公司交易往來，主要向其採購鑄物供應鑽孔機與成型機(ND/NR)生產，該公司 107~109 年度及 110 年前三季向丙公司進貨金額分別為 70,999 千元、10,415 千元、1,414 千元及 19,852 千元，占進貨淨額比率分別為 7.31%、2.10%、0.28%及 3.41%，最近三年度金額呈現下滑的趨勢，107 年度採購金額較大，係因應機台生產而增加備貨，108 及 109 年度進貨淨額較前一年度分別減少 60,584 千元及 9,001 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年前三季進貨增加，係因客戶銷貨需求增加，致使 110 年前三季占比達到 3.41%，尚無重大異常之情事。

C. 丁公司

丁公司成立於民國 51 年，位於德國，主要銷售及製造用於 CNC 控制器，產品範圍可用於機械結構和自動化技術的控制器，用於各種驅動器的伺服放大器，用於高速電動機和發電機的變頻器。該公司自 102 年開始與丁公司交易往來，主要向其採購控制器供鑽孔機與成型機(ND/NR)使用，該公司 107~109 年度及 110 年前三季向丁公司進貨金額分別為 55,047 千元、

25,487 千元、16,678 千元及 29,119 千元，占進貨淨額比率分別為 5.66%、5.14%、3.35%及 5.00%，最近三年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，107 年度採購金額較大，係因應機台生產而增加備貨，108 年度及 109 年度進貨淨額較前一年度分別減少 29,560 千元及 8,809 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年前三季進貨金額增加係因新規格的雷射鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

D. 株式会社清光社(簡稱：日商清光社)

日商清光社成立於民國 34 年，位於日本東京，主要銷售軸承、線性零件、電源、傳導電源及精密加工或組裝等產品。該公司自 103 年開始與日商清光社交易往來，主要向其採購螺桿零件，107~109 年度及 110 年前三季該公司向日商清光社進貨金額分別為 30,764 千元、25,907 千元、4,218 千元及 6,097 千元，占進貨淨額比率分別為 3.17%、5.23%、0.85%及 1.05%，最近三年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，主係該公司產品轉換使用線性馬達，致使需求逐年下滑，110 年前三季進貨金額增加原因係因新規格的鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

E. 庚公司

庚公司成立於民國 74 年，主要銷售鑄造零件、金屬零件、鋼材二次加工及製造。該公司自 98 年開始與庚公司交易往來，主要向其採購 ND 及 NR 小物鑄件及加工服務(SP 鞍座、外箱組合加工)，107~109 年度及 110 年前三季該公司向庚公司進貨金額分別為 28,150 千元、8,545 千元、5,879 千元及 10,162 千元，占進貨淨額比率分別為 2.90%、1.72%、1.18%及 1.75%，107 年度採購金額較大，係因應機台生產而增加備貨，最近三年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，108 年度及 109 年度進貨淨額較前一年度分別減少 19,605 千元及 2,666 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年前三季進貨金額增加係因新規格的鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

F. 台灣維亞機械股份有限公司(簡稱：台灣維亞)

台灣維亞成立於民國 101 年，主要營業項目為機械鑽孔機、雷射鑽孔機、機台零件販售及維修保養服務等，為日商 Via Mechanics, Ltd.在台子公司。該公司自 101 年開始與台灣維亞交易往來，主要向其採購雷射機零件、鑽孔機或成型機用零件及維修服務，107~109 年度及 110 年前三季該公司向台灣維亞進貨金額分別為 27,518 千元、908 千元、0 千元及 0 千元，占進貨淨額比率分別為 2.83%、0.18%、0.00%及 0.00%，最近三年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，主係該公司 106 年度與台灣維亞結束代理需求減少，因而減少進貨。

G. 己公司

己公司成立於民國 93 年，主要製造金屬製品、機械鈹金外罩、電控箱、車床外罩及精密機械鈹金等。該公司自 97 年開始與己公司交易往來，主要向其採購鈹金件，107~109 年度及 110 年前三季該公司向己公司進貨金額分別為 24,881 千元、5,748 千元、1,599 千元及 17,244 千元，占進貨淨額比率分別為 2.56%、1.16%、0.32%及 2.96%，最近三年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，主係該公司係依生產計劃進行進貨，108 年度及 109 年度進貨淨額較前一年度分別減少 19,133 千元及 4,149 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年前三季進貨金額增加，係因客戶銷貨需求增加，致使當期進貨金額占比達到 2.96%，尚無重大異常之情事。

H. 戊公司

戊公司成立於民國 92 年，主要銷售及製造雷射雕刻加工機設備相關零組件、雷射加工機特殊光源及雷射光學鏡組產品等。該公司自 99 年開始與戊公司交易往來，主要向其採購電子掃描鏡，107~109 年度及 110 年前三季該公司向戊公司進貨金額分別為 19,716 千元、16,943 千元、26,085 千元及 19,050 千元，占進貨淨額比率分別為 2.03%、3.42%、5.24%及 3.27%，108 年度進貨淨額較 107 年度減少 2,773 千元，主要係該公司代理的需求減少，故進貨隨之減少，109 年度及 110 年前三季進貨淨額分別較前期增加 9,142 千元及 2,118 千元，主要該公司增加雷射機台組裝及雷射加工服務，因而增購電子掃描鏡之採購，尚無重大異常之情事。

I. KANTO CO., LTD (簡稱：日商 KANTO)

日商 KANTO 成立於民國 44 年，位於日本，主要從事機械零件的銷售，如：自動省力設備，工業設備零件，汽車零件和密封裝置。該公司自 95 年開始與日商 KANTO 交易往來，主要向其採購滑軌，107~109 年度及 110 年前三季該公司向日商 KANTO 進貨金額分別為 19,388 千元、13,224 千元、10,035 千元及 12,639 千元，占進貨淨額比率分別為 2.00%、2.67%、2.02%及 2.17%，最近三年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，係該公司 107 年度售後服務代理零件需求較高，後續年度因需求減少，因而減少進貨，110 年前三季進貨占比與 109 年度相當，尚無重大異常之情事

J. 住友電氣工業株式会社(簡稱：日商住友電工)

日商住友電工成立於民國前 15 年，位於日本大阪市，主要銷售及製造汽車相關業務、信息與通信相關業務、電子相關業務、環境與能源相關業務及工業材料相關業務之光學零件，並在東京證券交易所、名古屋證券交易所及福岡證券交易所皆有掛牌上市(證券代號：5802)，日商住友電工係為日本住友集團旗下的一家電子零件製造商。該公司自 102 年開始與日商住友電工交易往來，主要向其採購光學零件鏡面，107~109 年度及 110 年前三季該公司向住友電氣進貨金額分別為 19,051 千元、19,447 千元、18,082 千元及 0 千元，占進貨淨額比率分別為 1.96%、3.92%、3.63%及 0.00%，該公

司各年度皆有採購日商住友電工之產品，屬廣泛使用之原物料供應商，107~109 年度進貨金額變化不大，109 年度因日商住友電工業務型態變更，故改向住友集團旗下之子公司日商宝產業採購。

K. 駿河マシンサービス株式会社(簡稱：日商駿河)

日商駿河成立於民國 51 年，位於日本靜岡縣，主要從事各種機械加工、機械零件、工業機械零件及電子設備製造相關，係為 Marusun Suruga 集團旗下之子公司，Marusun Suruga 集團主要從事設計和製造各種壓模、注塑模、熱模模、FRP 和 SPM 模等。該公司自 107 年開始與日商駿河交易往來，主要向其採購鑄物，107~109 年度及 110 年前三季該公司向日商駿河進貨金額分別為 12,863 千元、11,953 千元、16,859 千元及 12,885 千元，占進貨淨額比率分別為 1.32%、2.41%、3.39%及 2.21%，108 年度進貨淨額較 107 年減少幅度不大，不擬進一步分析，109 年度進貨淨額較 108 年度增加 4,906 千元，主要係因該公司增加雷射機台組裝，故進貨需求增加，110 年前三季進貨金額與去年同期差異不大。

L. 株式会社スリーエンジニアリング(簡稱：日商 S.E.C)

日商 S.E.C 成立於民國 75 年，位於日本群馬縣，主要從事設計、製造及加工精密機器。該公司自 104 年開始與日商 S.E.C 交易往來，主要向其採購底板及壓腳鉗，107~109 年度及 110 年前三季該公司向日商 S.E.C 進貨金額分別為 8,994 千元、10,520 千元、13,820 千元及 10,148 千元，占進貨淨額比率分別為 0.93%、2.12%、2.78%及 1.74%，最近三年度進貨淨額呈現上升的趨勢係因該公司增加雷射機台組裝，故進貨需求增加，110 年前三季進貨金額與去年同期差異不大。

M. 明治電機工業株式會社(簡稱：日商明治電機)

日商明治電機成立於民國 9 年，總部設在日本名古屋，主要營業項目為銷售電氣設備，其產品有逆變器、控制器、測量系統、儀表、斷路器、直流和交流電源等設備，並在東京證券交易所掛牌上市(證券代號：3388)。該公司自 95 年開始與日商明治電機交易往來，主要向其採購 CCD 圖像處理器及鏡頭用在雷射機台，107~109 年度及 110 年前三季該公司向日商明治電機進貨金額分別為 12,950 千元、10,352 千元、13,430 千元及 12,380 千元，占進貨淨額比率分別為 1.33%、2.09%、2.70%及 2.13%，108 年度進貨淨額較 107 年減少 2,598 千元係為確保雷射機台生產排程不因上述原因延遲，故部份 108 年度生產所需之料件提前於 107 年進貨，109 年度進貨淨額較 108 年度增加 3,078 千元，主要係因雷射機台生產數量較 108 年度多，故進貨需求增加，110 年前三季進貨金額增加原因係因新規格的雷射鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

N. 宝産業株式会社(簡稱：日商宝產業)

日商宝產業成立於民國 28 年，位於日本大阪市，主要光學零件鏡面等之代理銷售等。日商宝產業為日本住友集團之一，該公司主要向其採購光學鏡面等零件，109 年度及 110 年前三季該公司向日商宝產業進貨金額分別為 11,898 千元及 24,600 千元，占進貨淨額比率分別為 2.39%及 4.23%，日商宝產業為該公司 109 年度起新增之供應商，原向日商住友電工採購之光學鏡面等零件，因日商住友電工業務型態變更，故改向日商宝產業採購，合併 109 年度日商住友電工及日商宝產業進貨金額共計 29,980 千元，較 108 年度進貨增加係因該公司看好雷射加工技術之市場潛力，調增雷射鑽孔機之計畫生產量，採購需求上升所致，致使進貨增加，尚無重大異常之情事。

O. 辛公司

辛公司成立於民國 88 年，主要從事各式橡膠滾輪、矽膠滾輪、優力膠滾輪之開發製造及相關零組件加工。該公司自 106 年開始與辛公司交易往來，主要向其採購清潔滾輪，107~109 年度及 110 年前三季該公司向辛公司進貨金額分別為 10,124 千元、10,057 千元、8,369 千元及 6,668 千元，占進貨淨額比率分別為 1.04%、2.03%、1.68%及 1.15%，108 年度進貨淨額較 107 年減少幅度不大，不擬進一步分析，109 年度進貨淨額較 108 年度減少 1,688 千元，主要係客戶端需求減少，因而進貨需求降低，110 年前三季進貨金額與去年同期差異不大。

P. 乙公司

乙公司成立於民國 88 年，主要從事電子產業自動化設備與整廠物流規劃與智能自動化整合服務，該公司自 103 年開始與乙公司交易往來，主要向其採購投收板機，107~109 年度及 110 年前三季該公司向乙公司進貨金額分別為 9,547 千元、3,137 千元、3,029 千元及 19,513 千元，占進貨淨額比率分別為 0.98%、0.63%、0.61%及 3.35%，107~109 年度進貨淨額逐年遞減，係因配合雷射機台週邊使用，而有所變動，110 年前三季進貨金額占比增加至 3.35%，主係投產產品需求改變，導致投收板機的需求增加。

Q. 壬公司

壬公司成立於民國 86 年，為臺灣證券交易所掛牌公司，主要從事精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售，該公司主要向其採購線性馬達，107~109 年及 110 年前三季該公司向壬公司統進貨金額分別為 4,521 千元、4 千元、3,880 千元及 15,829 千元，占進貨淨額比率分別為 0.47%、0%、0.78%及 2.72%，110 年前三季進貨金額增加係因新規格的雷射鑽孔機銷售量及訂單增加，致使進貨需求增加。

R. 山洋電氣株式會社(簡稱：日商山洋電氣)

日商山洋電氣成立於 1936 年，總部位於日本東京，為東京證券交易所一部掛牌公司，產品包括散熱風扇、UPS、電源供應器、伺服器馬達、

馬達、發電設備，該公司主要向其採購線性馬達、伺服控制器，107~109 年及 110 年前三季該公司向日商山洋電氣進貨金額分別為 4,940 千元、2,301 千元、6,862 千元及 14,761 千元，占進貨淨額比率分別為 0.51%、0.46%、1.38%及 2.54%，110 年前三季進貨金額增加係因新規格的雷射鑽孔機銷售量及訂單增加，致使進貨需求增加。

(2)是否有進貨集中之風險

該公司最近三年度及 110 年前三季向前十大供應商進貨金額占該公司整體進貨淨額比率分別為 39.50%、42.41%、42.51%及 37.39%。前十大供應商個別進貨比率最高者之進貨金額占整體進貨比率為 15.33%，足見該公司並無進貨集中於特定供應商之情事。該公司原料之採購政策為分散供應商，部份常用料件皆有至少兩家以上的供應商提供採購，應無進貨集中之風險；且該公司與供應商長期維持良好之合作關係，以確保貨源之穩定性及自主性，因此供貨狀況良好，尚無因原料短缺而有生產中斷之虞。

(3)進貨政策

- A.該公司之生產方式為接單式及計劃性生產，以各年度預測客戶之需求訂定安全庫存量而備貨，大約會備1至3個月之庫存量。
- B.該公司每季定期召開產銷會議，依據營業單位之訂單情況、存貨庫存數量、市場供需情況、購料前置時間等因素作為備料依據再決定採購事宜。
- C.部份常用料件如鑄物、螺桿&滑軌及鈑金供應商至少維持兩家以上，以分散進料供應商物料短缺風險。
- D.一般原物料、商品及客製化之規格料件之採購，皆須進行詢、比、議價。
- E.該公司定期依據產品品質、交期、成本優勢、履行誠信、服務效率對供應商進行評比，亦不定期與現有之供應商進行議價以降低進貨成本。

(二)最近期及最近三個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.最近二年度及申請年度截至最近期止申請公司個體及合併之應收款項變動之合理性評估

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	個體財務報告			合併財務報告		
	108 年度	109 年度	110 年 前三季 (註)	108 年度	109 年度	110 年 前三季(註)
1.營業收入淨額	883,024	844,725	780,368	1,175,825	1,001,731	884,477
應收票據	3,915	2,550	4,131	21,909	13,283	13,482
應收帳款	190,976	154,707	125,959	327,868	256,388	209,606
應收帳款-關係人	22,104	21,174	20,566	-	-	-
2.應收款項總額	216,995	178,431	150,656	349,777	269,671	223,088
3.備抵呆帳提列數	(13,733)	(1,749)	(2,868)	(25,462)	(10,046)	(10,087)
4.應收款項淨額	203,262	176,682	147,788	324,315	259,625	213,001
5.應收款項週轉率(次)	4.31	4.27	6.32	3.41	3.23	4.79
6.應收款項收現日數(日)	85	85	57	107	113	77
7.授信條件	平均授信天數為 110 天					

資料來源：108 年度及 109 年經會計師查核簽證個體/合併財務報告；110 年前三季係經會計師核閱合併財務報告，110 年前三季個體財務報告由該公司提供。

註：110 年前三季應收帳款週轉率已推算全年。

(1)個體財務報告

該公司 108~109 年底及 110 年前三季之應收款項總額分別為 216,995 千元、178,431 千元及 150,656 千元，109 年度較前一年度減少 38,564 千元，變動幅度(17.77)%，係因 109 年度營業收入較前一年度減少 38,299 千元，變動幅度為(4.33)%，主因 109 年前三季新冠肺炎疫情籠罩全球，致全球經濟活動陷入遲緩性成長，降低下游印刷電路板廠設備資本支出之意願，進而使得該公司之設備銷售減少，110 年前三季底較 109 年底之應收款項總額減少 27,775 千元，變動幅度(15.57)%，係因 110 年前三季設備產銷銷售比重提高，該設備銷售採預收貨款方式交易所致。

應收款項週轉率方面，該公司 108~109 年度及 110 年前三季分別為 4.31 次、4.27 次及 6.32 次，收款日數分別 85 天、85 天及 57 天，109 年度應收款項週轉率較前一年度略微減少 0.93%，係因 109 年度的營業收入較前一年度之變動幅度為(4.33)%所致，而 109 年底應收款項週轉率較 110 年前三季底成長 48.01%，係因 110 年前三季之設備銷售業績成長且雷射應用專業服務之收款良好所致，另，109 年底及 108 年底收款天數，均為 85 天，係因 108 年度及 109 年度之應收週轉率，受因營業收入僅些微衰減所致，110 年前三季較 109 年底之收款天數縮減 28 天，係因設備產銷銷售比重提高，該設備銷售採預收貨款方式交易所致。

(2)合併財務報告

該公司 108~109 年底及 110 年前三季底之應收款項總額分別為 349,777 千元、269,671 千元及 223,088 千元，109 年度較前一年度減少 80,106 千元，變動幅度(22.90)%，109 年度營業收入較前一年度減少 174,094 千元，變動幅度(14.81)%，係因 109 年 01 月底中國大陸武漢市爆發新冠肺炎疫情，同年 02 月起，中國大陸政府為因應防疫政策需求，延後中國農曆春節的開工時間，各省(市)陸續施行人、物流的管制政策，且部分工廠停工生產，然，同年 3、4 月份新冠肺炎疫情大肆傳播蔓延至全球各地，致全球經濟陷入停滯狀態，間接縮減消費需求，使得下游印刷電路板廠，亦同步降低資本支出的需求，致該公司 109 年度營業收入及應收款項金額同步較 108 年度減少；110 年 09 月底應收帳款總額為 223,088 千元，相較 109 年底減少 46,583 千元，變動幅度(17.27)%，主係 110 年前三季設備產銷銷售比重提高，該設備銷售採預收貨款方式交易所致。

應收款項週轉率方面，該公司 108~109 年度及 110 年 09 月底應收款項週轉率分別為 3.41 次、3.23 次及 4.79 次；應收款項收現天數分別 107 天、113 天及 77 天，該公司 109 年度應收款項週轉率較 108 年度下降，而應收款項收現天數微幅超出平均授信天期 110 天，未如期支付所致；110 年 09 月底應收款項週轉率較 109 年度提升 47.99%且收款天數亦縮減 36 天，係因設備產銷銷售比重提高，該設備銷售採預收貨款方式交易所致。

整體而言，該公司最近二年度及 110 年 09 月底應收款項總額之變動係因營收增減變化之影響所致。

2.個體及合併備抵呆帳提列適足性之評估

(1)備抵呆帳提列政策合理性

該公司之備抵損失提列政策，依應收款項於授信期間天數所制定不同的備抵呆帳提列比率如下：

A、備抵呆帳提列政策(授信期間內，即未逾期)

帳齡	30 天內	31-60 天	61-90 天	91-180 天	181-365 天	一年以上
提列%	0%	1%	2%	5%	25%	50%

資料來源：該公司提供。

B、逾期部分，則採用「建構式機率」模型(統計模型)設算公式如下：

應收款項餘額-應收期望值(註1)=備抵呆帳提列損失

註1、逾期餘額 X 回收率(採累積常態分配)

由於，該公司存續期間之預期信用損失係考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況，但合併公司之信用損失歷史經驗，顯示不同客戶群之損失型態並無顯著差異，故未進一步區分客戶群，僅以應收款項(應收票據及帳款)天數，所訂定之預期信用損失率；另，逾期之應收票據及帳款，則按客戶依歷史經驗計算預期信用損失率，以下茲將該公司 109 年度 12 月 31 日及 110 年 09 月 30 日之合併財務報告之應收帳款及票據備抵呆帳提列，分別列示如下：

(A)個體應收帳款及票據之帳齡備抵損失提列情形

帳齡天期	未逾期						逾期 (註)	清算、合併 及財務困難
	1-30 天	31-60 天	61-90 天	91-180 天	181-365 天	一年以上		
提列比例 (108 年度)	-	2.56%	2.72%	8.04%	27.28%	50%	50.10%	100%
提列比例 (109 年度)	-	1.42%	15.45%	7.92%	-	-	51.39%	100%
提列比例(110 年前三季)	-	0.06%	0.46%	2%	25%	-	50%	100%

資料來源：該公司提供。

(B)合併應收帳款及票據之帳齡備抵損失提列情形

帳齡天期	未逾期						逾期 (註)	清算、合併 及財務困難
	1-30 天	31-60 天	61-90 天	91-180 天	181-365 天	一年以上		
提列比例 (108 年度)	-	1.72%	2.18%	5.30%	25%	50%	50.37%	100%
提列比例 (109 年度)	-	1.24%	4.42%	5.38%	25%	50%	51.39%	100%
提列比例(110 年前三季)	-	1.00%	2.00%	5.00%	25.00%	50.00%	47.58%	100%

資料來源：該公司提供。

依 IFRS 9 規定，評估逾期超過一年之帳款為確定不收回之款項為基準，該公司 108~109 年度預期信用損失分別為 101 元及 0 元，尚無需提列，而該公司 108~109 年度及 110 年前三季備抵呆帳總額分別為 25,462 千元、10,046 千元及 10,087 千元，故其備抵呆帳提列，尚稱適足。

綜上所述，該公司個體財務報告及合併財務報告之應收票據及應收帳款，係按存續期間之預期信用損失認列備抵損失，另，備抵呆帳之政策，係考量歷史收款經驗、期後收款情形及逾期帳款收回之可能性，透過個別檢視是否有逾期帳款，若有逾期帳款，每月亦會檢討應收款項收回狀況並定期追蹤，確認是否有信用風險及其因應措施，故該公司之備抵呆帳提列政策應尚屬合理。

(2)備抵呆帳提列之適足性

單位：新台幣千元；%

項目	年度	108年度		109 年度		110年前三季	
		個體	合併	個體	合併	個體	合併
備抵呆帳總額(A)		13,733	25,462	1,749	10,046	2,868	10,087
應收帳款總額(B)		216,995	349,777	178,431	269,671	150,656	223,088

項目	年度	108年度		109 年度		110年前三季	
		個體	合併	個體	合併	個體	合併
備抵呆帳占應收帳款總額比例(A/B；%)		6.33	7.28	0.98	3.73	1.90	4.52

資料來源：該公司提供。

該公司 108~109 年度及 110 年度前三季個體備抵損失餘額分別為 13,733 千元、1,749 千元及 2,868 千元，占各年度個體應收款項總額之比重分別為 6.33%、0.98%及 1.90%，備抵呆帳提列，逐年呈現下滑趨勢，109 年度較前一年度減少 11,984 千元，變動幅度(87.26)%，係因 L 公司及雄福 108 年底之應收帳款，尚未回收之提列數，109 年度初已全數回收，故回收狀況，尚屬良好；

另，該公司 108~109 年度及 110 年前三季備抵呆帳總額分別為 25,462 千元、10,046 千元及 10,087 千元，占應收帳款總額分別為 7.28%、3.73%及 4.52%，108 年度備抵呆帳金額較高，主要係因評估 L 公司及雄福應收帳款收回機率較低，分別認列備抵呆帳 10,355 千元及 1,327 千元所致，惟相關款項於 109 年已陸續收回。經評估該公司最近兩年度及 110 年 9 月底曾發生三筆實際壞帳之情事，一筆為 108 年度台灣達航之韓國客戶 Win Tech 倒閉，所產生呆帳金額為 282 千元，該公司業已執行債權請求並寄發存證信函辦理中，其餘二筆分別為 109 年度上海達航銷售客戶銅陵市超遠科技及煙臺希藹思電子，所產生實際呆帳金額分別為人民幣 68 千元(折合新臺幣 296 千元)及人民幣 9 千元(折合新臺幣 41 千元)，整體而言，該公司依據提列政策確實估列備抵金額，故其備抵呆帳提列，尚稱適足。

3.應收款項收回情形

(1)個體財務報告

單位：新臺幣千元

項目	110 年 09 月底 金額	截至 110.10.31 收回情形		截至 110.10.31 未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	4,131	1,494	36.17	2,637	63.83
應收帳款	146,525	24,930	17.01	121,595	82.99
合計	150,656	26,424	17.54	124,232	82.46

資料來源：該公司 110 年第三季經會計師核閱之財務報告；110.10.31 該公司提供。

該公司 110 年 09 月底之應收款項截至 110 年 10 月 31 日止已收回 26,424 千元，收回比率為 17.54%，未收回金額為 124,232 千元，比率為 82.46%；未收回帳款中尚未逾期之金額為 116,890 千元，占未回收金額比率 99.52%，均於授信範圍之內，逾期金額為 598 千元，占未回收金額比率為 0.48%，係為達航科技韓國分公司之客戶 New Ace Flex Co., Ltd 之未收回款項，目前該公司亦透過催收程序積極收回當中，並已全數提列為備抵損失，故該公司 110 年 9 月底應收款項之回收可能情形，尚未發現重大異常之情事。

(2)合併財務報告

單位：新臺幣千元

項目	110 年 09 月 底金額	截至 110.10.31 收回情形		截至 110.10.31 未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	13,482	1,252	9.29	12,230	90.71
應收帳款	209,606	32,044	15.29	177,562	84.71
合計	223,088	33,296	14.93	189,792	85.07

資料來源：該公司 110 年第三季經會計師核閱之財務報告；110.10.31 該公司提供。

該公司 110 年 09 月底之應收款項餘額截至 110 年 10 月 31 日止已收回金額與比率分別為 33,296 千元及 14.93%，未收回金額及比率分別為 189,792 千元及 85.07%；未收回應收款項 189,792 千元中，未逾期金額及比率分別為 185,106 千元及 97.53%，逾期金額及比率分別為 4,686 千元及 2.47%，逾期未收回主要有客戶 New Ace Flex Co., Ltd. 已倒閉進入催繳款項作業中，逾期金額為 198 千元，另部分客戶未如期付款因而協議採分期付款方式支付，而有逾期未收回之情事。

該公司就前述逾期且尚未收回之應收款項，已依其內部作業程序加強催收作業，並針對逾期未回收款，已依備抵呆帳提列政策辦理，經評估該公司應收帳款回收可能性應屬可期，故尚無重大異常之情事。

4.與同業比較評估

(1)個體財務報告

單位：新臺幣千元

年度		108 年度	109 年度	110 年前三季
項目				
營業收入淨額	達航科技	883,024	844,725	780,368
	大量	968,433	1,505,242	註2
	凱崙	449,622	520,721	註2
	尖點	1,020,624	1,148,344	註2
應收帳款總額(A)	達航科技	216,995	178,431	150,656
	大量	676,801	728,571	註2
	凱崙	178,928	213,794	註2
	尖點	243,787	175,396	註2
備抵呆帳總額(B)	達航科技	13,733	1,749	2,868
	大量	16,045	9,741	註2
	凱崙	2,244	394	註2
	尖點	-	-	註2
期末應收帳款淨額	達航科技	203,262	176,682	147,788
	大量	660,756	718,830	註2
	凱崙	176,684	213,400	註2

年度		108 年度	109 年度	110 年前三季
項目				
	尖點	243,787	175,396	註2
應收款項週轉率 (次)	達航科技	4.31	4.27	6.32
	大量	1.14	2.14	註2
	凱崑	5.01	4.30	註2
	尖點	3.98	5.48	註2
應收款項收現天數 (天)	達航科技	85	85	57
	大量	320	170	註2
	凱崑	73	85	註2
	尖點	92	67	註2
備抵呆帳提列比率 (B)/(A) (%)	達航科技	6.33	0.98	1.90
	大量	2.37	1.34	註2
	凱崑	1.25	0.18	註2
	尖點	-	-	註2

資料來源：該公司及採樣同業 107 年至 109 年為各股東會年報及經會計師查核簽證之財務報告，該公司 110 年前三季未出具個體財務報告為自結數。

註 1：110 年前三季應收帳款週轉率已推算全年。

註 2：110 年前三季採樣同業均無出具個別核閱財務報告。

該公司 108~109 年度及 110 年前三季之個體應收款項週轉率分別為 4.31 次、4.27 次及 6.32 次，個體應收帳款收現天數分別為 85 天、85 天及 57 天，尚介於個體財務報告之平均授信期間 110 天內，與採樣同業相較，尚介於同業水準間。

另，該公司 108~109 年度及 110 年前三季之個體備抵損失占應收款項總額比率分別為 6.33%、0.98%及 1.90 %，與採樣同業相較，僅 108 年備抵呆帳提列高於採樣同業，109 年度及 110 年前三季，尚介於同業水準區間，由於，採樣同業之客戶結構、過往之違約紀錄與現時財務狀況及授信政策不盡完全相同，且考量各區域之經濟情勢及產業情勢所產生之差異，經評估該公司之個體應收帳款週轉率、收現天期及備抵呆帳提列適足與採樣同業相較，尚未發現有重大異常之情事。

整體而言，該公司歷年來收款狀況良好，最近兩年度及 110 年 9 月底期間，除 108 年間，臺灣達航科技之韓國分公司的銷售客戶 Win Tech 發生倒閉，致產生呆帳金額為 282 千元，並經執行債權請求寄發存證信函外，尚未發現有重大異常之情形。

(2)合併財務報告

單位：新臺幣千元

年度		108 年度	109年度	110年前三季
項目				
營業收入淨額	達航科技	1,175,825	1,001,731	884,477
	大量	1,942,637	2,427,607	3,483,505
	凱歲	1,255,128	1,264,376	1,175,827
	尖點	3,006,253	2,973,426	2,765,814
應收帳款總額(A)	達航科技	349,777	269,671	223,088
	大量	1,485,737	1,644,245	2,338,559
	凱歲	696,553	704,007	832,038
	尖點	1,155,593	1,099,567	1,216,876
備抵呆帳總額(B)	達航科技	25,462	10,046	10,087
	大量	121,854	133,103	86,967
	凱歲	15,096	10,871	3,204
	尖點	9,510	5,069	221
期末應收帳款淨額	達航科技	324,315	259,625	213,001
	大量	1,363,883	1,511,142	2,251,592
	凱歲	681,457	693,136	828,834
	尖點	1,146,083	1,094,498	1,216,655
應收款項週轉率 (次)	達航科技	3.41	3.23	4.79
	大量	1.10	1.55	2.34
	凱歲	1.81	1.81	2.04
	尖點	2.35	2.64	2.95
應收款項收現天數 (天)	達航科技	107	113	77
	大量	332	236	156
	凱歲	202	203	179
	尖點	156	139	124
備抵呆帳提列比率 (B)/(A) (%)	達航科技	7.28	3.73	4.52
	大量	8.20	8.10	3.72
	凱歲	2.17	1.54	0.39
	尖點	0.82	0.46	0.02

資料來源：該公司及採樣同業 107 年至 109 年為各股東會年報及經會計師查核簽證之財務報告，110 年前三季該公司及採樣同業經會計師核閱財務報告，康和整理。

註：110 年前三季應收帳款週轉率已推算全年。

該公司 108~109 年度及 110 年前三季之合併應收款項週轉率分別為 3.41 次、3.23 次及 4.79 次，合併應收帳款收現天數分別為 107 天、113 天及 77 天，與採樣同業相較，該公司 108 年度、109 年度及 110 年前三季之應收款項週轉率及收款天期，優於同業水準間，另，該公司 108~109 年度及 110 年

前三季之合併備抵損失占應收款項總額比率分別為 7.28%、3.72%及 4.52%，與採樣同業相較，尚介於同業水準區間，經評估該公司之合併應收帳款週轉率、收現天期及備抵呆帳提列適足率與採樣同業相較，尚未發現有重大異常之情事。

整體而言，該公司歷年來收款狀況良好，惟，108 年度臺灣達航韓國客戶 Win Tech 發生倒閉，產生實際呆帳金額為 282 千元，另，109 年上海達航客戶銅陵市超遠科技及煙臺希邁思電子，產生實際呆帳金額分別為人民幣 68 千元(折合新臺幣 296 千元)及人民幣 9 千元(折合新臺幣 41 千元)外，經檢視評估期後帳款收回情形，尚未發現有重大異常之情形。

二、存貨概況

(一)最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告存貨淨額變動合理性及去化情形、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列適足性之評估，並與同業比較評估

1.最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告存貨淨額變動合理性

單位：新臺幣千元

項 目	個 體			合 併		
	108 年度	109 年度	110 年 9 月底	108 年度	109 年度	110 年 9 月底
1.營業收入淨額	883,024	844,725	780,368	1,175,825	1,001,731	884,477
2.營業成本	576,999	558,742	567,385	757,806	664,891	646,291
3.存貨總額	440,145	424,305	539,094	587,176	513,775	649,690
4.備抵跌價及呆滯損失	(65,321)	(46,021)	(58,230)	(81,936)	(62,987)	(76,954)
5.存貨淨額	374,824	378,284	480,864	505,240	450,788	572,736
6.存貨週轉率(次)	1.46	1.48	1.76	1.39	1.39	1.68
7.存貨週轉天數(天)	250	247	207	263	263	218

資料來源：該公司 108 及 109 年度經會計師查核簽證之合併及個體財務報告，110 年第三季經會計師核閱之合併財務報告及 110 年 9 月底個體金額為該公司提供。

註 1：存貨週轉率係採存貨淨額計算之。

註 2：110 年第三季存貨週轉率係以年化做計算。

該公司主要經營 PCB(印刷電路板) 鑽孔機及成型機設備研發、製造和銷售、設備售後維修，以及雷射鑽孔加工技術與服務。該公司產品主要係依銷貨客戶需求而自製客製化設備，存貨的增減狀況與銷貨客戶訂單量及交期息息相關，其存貨組成可分類為原物料、在製品、製成品及代理存貨四大類，以下茲就該公司個體及合併財務報表之存貨淨額變動合理性說明如下：

(1)個體存貨

108、109 年度及 110 年 9 月底之個體存貨總額分別為 440,145 千元、

424,305 千元及 539,094 千元，期末存貨淨額分別為 374,824 千元、378,284 千元及 480,864 千元，109 年度存貨總額較去年同期減少 3.60%，係因全球受到新冠肺炎(以下簡稱 COVID-19)疫情肆虐，影響銷貨客戶需求，因而減少進貨，致使存貨下降，110 年 9 月底較去年底存貨總額增加 27.05%，主要為在製品及製成品存貨上升，在製品增加係因本年度投產隨接單量上升，而製成品部份係因部份設備客戶尚未驗收，該設備尚未轉成本所致，並無重大異常。

在存貨週轉率方面，該公司個體財務報告 108、109 年度及 110 年 9 月底之存貨週轉率分別為 1.46 次、1.48 次及 1.76 次，週轉天數分別為 250 天、247 天及 207 天。108 及 109 年度差異不大，擬不進一步分析，110 年 9 月底較 109 年度存貨週轉率略微上升，主係該公司 110 年 9 月底營業成本推算全年度較 109 年度增加 35.95%，致使存貨週轉率略微上升應屬合理。

(2)合併存貨

該公司個體存貨占該公司合併存貨約占 8 成左右，其存貨增減變化仍以該公司個體財務報告為主，茲就該公司合併存貨變化原因說明如下：

108、109 年度及 110 年 9 月底合併存貨總額分別為 587,176 千元、513,775 千元及 649,690 千元，期末存貨淨額分別為 505,240 千元、450,788 千元及 572,736 千元，109 年度較去年同期存貨總額減少 12.50%，係因 109 年度持續受到全球新冠肺炎(以下簡稱 COVID-19)疫情肆虐，影響銷貨客戶需求，因而減少進貨，致使存貨金額下降；110 年 9 月底較去年底存貨總額增加 26.45%，主要為在製品及製成品存貨上升，在製品增加係因本年度投產隨接單量上升，而製成品部份係因部份設備客戶尚未驗收，該設備尚未轉成本所致，並無重大異常。

在存貨週轉率方面，該公司 108、109 年度及 110 年 9 月底之週轉率分別為 1.39 次、1.39 次及 1.68 次，存貨週轉天數分別為 263 天、263 天及 218 天。108 及 109 年度並無差異，擬不進一步分析；110 年 9 月底較 109 年度存貨週轉率略微上升，主係該公司 110 年 1~9 月因機台銷售金額增加，使得營業成本推算全年度較 109 年度增加 29.60%，致使存貨週轉率略微上升應屬合理。

2.截至最近期止存貨去化情形評估

(1)申請公司個體財務報表 110 年 9 月底存貨去化情形評估

單位：新臺幣千元

項 目	110 年 9 月底	截至 110 年 10 月 31 日存貨去化情形		110 年 10 月 31 日餘額
	存貨金額	金額	比率(%)	
原物料	66,182	18,137	27.40	48,045
在製品	84,697	42,674	50.38	42,023
製成品	376,565	73,105	19.41	303,460
維修材料	11,650	3,623	31.10	8,027
合計	539,094	137,539	25.51	401,555

資料來源：該公司提供

該公司個體財務報告 110 年 9 月底底之存貨總額為 539,094 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 137,539 千元，整體去化比率約為 25.51%。茲就各項目去化情形分述如下：

A.原物料

該公司個體財務報告原物料為雷射頭、電子掃描鏡、鑄物、控制器及螺桿等，110 年 9 月底底原物料總額為 66,182 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 18,137 千元，去化比率為 27.40%，主係該公司持續將原物料投入生產去化所致，尚未去化金額為 48,045 千元，未去化之原物料主係該公司為求對客戶之供貨不中斷，考量相關原物料使用期限較長，較無損之情事、交期時間性，及對原物料之採購有最低採購量取得較優惠之進貨價格，尚未去化之原物料待適當時機投入生產並銷售，經評估尚無重大異常之情事。

B.在製品

在製品係為尚未完工主軸、成型機、鑽孔機，該公司個體財務報告 110 年 9 月底在製品之總額為 84,697 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 42,674 千元，去化比率為 50.38%，其中未去化金額為 42,023 千元，未去化之在製品係依該公司個體財務報告依照客戶訂單安排生產排程及部分在製品為首次製作較為耗時，已依提列政策提列備抵存貨跌價及呆滯損失，整體去化狀況尚屬良好。

C.製成品

製成品係為已完工已檢驗之主軸、成型機及鑽孔機，其包括購入之非自製零件商品或已完工已檢驗之半成品，該公司個體財務報告 110 年 9 月底製成品之總額為 376,565 千元，截至 110 年 10 月底之去

化金額為 73,105 千元，去化比率為 19.41%，其中未去化金額為 303,460 千元，303,460 千元庫齡在一年以上約占 46%，主要為 ND、NR 機台及主軸成品、半成品，製成品係因 108 年度計劃性生產的存貨，受到疫情與美中貿易戰影響，使得庫存去化亦減緩，致使製成品去化比率為 19.41%，其去化速度稍緩，經評估尚無重大異常之情事。

D. 維修材料

維修材料係為該公司個體財務報告代理原廠在台的設備與零件備品，該公司 110 年 10 月底代理存貨之總額為 11,650 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 3,623 千元，去化比率為 31.10%，未去化金額為 8,027 千元，未去化之維修材料係為終端客戶尚未驗收架設完成，待客戶驗收完成後即可開發票將存貨去化，經評估尚無重大異常之情事。

(2)申請公司合併財務報表 110 年 9 月底存貨去化情形評估

單位：新臺幣千元

項 目	110 年 9 月底	截至 110 年 10 月 31 日存貨去化		110 年 10 月 31 日 餘額
	存貨金額	金額	比率(%)	
原物料	69,336	18,337	26.45	50,999
在製品	87,353	36,372	41.64	50,981
製成品	481,041	104,895	21.81	376,146
維修材料	11,960	3,934	32.89	8,026
合計	649,690	163,538	25.17	486,152

資料來源：該公司提供

該公司 110 年 9 月底之存貨總額為 649,690 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 163,538 千元，整體去化比率約為 25.17%。茲就各項目去化情形分述如下：

A.原物料

該公司原物料為雷射頭、電子掃描鏡、鑄物、控制器及螺桿等 110 年 9 月底原物料之總額為 69,336 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 18,337 千元，去化比率為 26.45%，主係該公司持續將原物料投入生產去化所致，尚未去化金額為 50,999 千元，未去化之原物料主係該公司為求對客戶之供貨不中斷，考量相關原物料使用期限較長，較無損之情事、交期時間性，及對原物料之採購有最低採購量取得較優惠之進貨價格，尚未去化之原物料待適當時機投入生產並銷售，經評估尚無重大異常之情事。

B.在製品

在製品係為尚未完工主軸、成型機、鑽孔機，該公司 110 年 9 月底在

製品之總額為 87,353 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 36,372 千元，去化比率為 41.64%，其中未去化金額為 50,981 千元，未去化之在製品係依該公司依照客戶訂單安排生產排程及部分在製品為首次製作較為耗時，已依提列政策提列備抵存貨跌價及呆滯損失，整體去化狀況尚屬良好。

C. 製成品

製成品係為已完工已檢驗之主軸、成型機、鑽孔機，其包括購入之非自製零件商品或已完工已檢驗之半成品，該公司 110 年 9 月底製成品之總額為 481,041 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 104,895 千元，去化比率為 21.81%，其中未去化金額為 376,146 千元，376,146 千元庫齡在一年以上約占 4 成，主要為 ND、NR 機台及買賣類零件，係因 108 年度計劃性生產的存貨，受到疫情與中美貿易戰影響，使得庫存去化亦減緩，致使製成品去化比率為 37.64%，其去化速度稍緩，ND、NR 機台若客戶有需求，將 ND、NR 機台標準機依客戶需求修改，另 108 年度計劃性生產的存貨，已逐步去化中，110 年 10 月已接獲訂單並出貨，惟尚待客戶驗收後將該存貨轉成本，故無法在去化比率顯現。

D. 維修材料

維修材料係為該公司代理原廠在台的設備與零件備品，該公司 110 年 9 月底代理存貨之總額為 11,960 千元，截至 110 年 10 月底之去化金額為 3,934 千元，去化比率為 31.11%，其中未去化金額為 8,026 千元，未去化之代理存貨係為終端客戶尚未驗收架設完成，待客戶驗收完成後即可開發票將存貨去化，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，截至 110 年 10 月底止，該公司 110 年 9 月底期末存貨已依其產品產製週期及訂單出貨排程，其去化情況尚屬合理，整體存貨之去化，尚無重大異常之情事。

3. 備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列之政策及適足性評估

(1) 備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列政策

A. 備抵存貨跌價損失提列政策

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

B. 備抵存貨呆滯損失提列呆滯政策

該公司根據以往之經驗，將所有存貨以穩健原則針對呆滯存貨提列呆滯損失，提列比率彙總如下：

(a) 庫齡提列呆滯比率

庫 齡(月)	庫 齡(月) 提列呆滯比率 (%) 第一類	庫 齡(月) 提列呆滯比率 (%) 第二類
12 個月以內	0	-
13~24個月	10	-
25~30個月	25	10
31~36個月	45	25
37~42個月	60	45
43~48個月	80	60
49 個月以上	100	80
61 個月以上	100	100

資料來源：該公司提供

註 1: 該公司存貨備抵跌價損失認列管理辦法係經會計功能主管核准；

註 2: 庫齡計算基礎採原始收料日開始計算；

註 3: 重大品項(鑄物與 BED(底座) 之長納期物料、NDNR 設備及整組主軸等)，採第二類比率法。所謂長納期物料係指鑄造後材質的穩定性需求，購入後需要曝露存放半年以上才能開始加工的原物料。

註 4: 不良品倉、跌損倉、待報廢倉，其內含存貨性質，為經辨識無價值之存貨，專案評估，提列全額跌價損失者。

註 5: 以下情形存貨不進行評價

(1) 已出貨至客戶端未驗存貨，因未達收入認列時點。

(2) 暫收存貨，尚未正式驗收入庫。

(2) 申請公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性評估

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	個體			合併		
	108 年度	109 年度	110 年 9 月底	108 年度	109 年度	110 年 9 月底
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	65,321	46,021	58,230	81,936	62,987	76,954
期末存貨總額(B)	440,145	424,305	539,094	587,176	513,775	649,690
提列比率(A)/(B)(%)	14.84	10.85	10.80	13.95	12.26	11.84

資料來源：該公司提供

A. 個體財務報表

該公司個體財務報告之備抵存貨跌價及呆滯損失均已依該公司個體財務報告「存貨備抵跌價損失認列管理辦法」按季提列，且針對滯料存貨(Slow moving)不定時做存貨專案評估。該公司個體財務報告 108、109 年度及 110 年第三季之備抵存貨跌價及呆滯損失分別為 65,322 千元、46,020 千元及 58,230 千元，提列比率分別為 14.84%、10.85%及 10.80%，108 年度該公司個體財務報告備抵存貨跌價及呆滯損失金額為 65,321 千元(詳表一)，主係為庫齡達 49 個月以上之存貨，按公司提列政策提列 36,255 千元，主要提列存貨項目為主軸成品、

半成品及買賣類零件；109 年度該公司個體財務報告備抵存貨跌價及呆滯損失金額較 108 年度下滑，係該公司個體財務報告自 109 年度針對庫齡達 4 年以上、消化速度慢等存貨部品進行報廢處理共計 28,790 千元，109 年度依政策提列庫齡 49 個月以上存貨提列金額已下降為 22,833 千元，該公司個體財務報告致力於改善存貨及庫齡品質，以避免潛在營運風險，110 年 9 月底與 109 年度差異不大，不擬進一步分析。經評估該公司個體財務報告已依所訂政策提列損失，並經證會計師查核簽證完竣，金額尚屬適足，該公司個體財務報告之存貨備抵提列應尚屬適足，故整體而言，該公司個體財務報告目前備抵存貨跌價及呆滯損失金額已依上述管理辦法提，尚無重大異常之情事。

表一：最近二年度及 110 年第三季個體財務報告備抵存貨跌價及呆滯損失金額

單位：新臺幣千元

庫齡(月)	期間(月)	提列呆滯 比率(%)	108 年度	109 年度	110 年前三季
			LCM 提列金額	LCM 提列金額	LCM 提列金額
13 個月以內	0~12.99	0%	2,805	1,022	2,917
13 個月以上~24 個月	13~24.99	10%	6,370	1,672	1,137
25 個月以上~30 個月	25~30.99	25%	3,221	4,256	6,799
31 個月以上~36 個月	31~36.99	45%	6,196	3,196	4,703
37 個月以上~42 個月	37~42.99	60%	5,009	4,305	4,038
43 個月以上~48 個月	43~48.99	80%	5,466	8,736	3,353
49 個月以上	49~	100%	36,255	22,833	35,283
合計(庫存+在製)			65,322	46,020	58,230

資料來源：該公司提供。

B.合併財務報表

該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失均已依該公司「存貨備抵跌價損失認列管理辦法」按季提列，且針對滯料存貨(Slow moving)不定時做存貨專案評估。該公司 108、109 年度及 110 年 9 月之合併備抵存貨跌價及呆滯損失分別為 81,936 千元、62,987 千元及 76,954 千元，提列比率分別為 13.95%、12.26%及 11.84%，108 年度合併備抵存貨跌價及呆滯損失金額為 81,936 千元(詳下表)，主係為庫齡達 49 個月以上之存貨，按公司提列政策提列 45,667 千元，主要提列存貨項目為主軸成品、半成品及買賣類零件；109 年度備抵存貨跌價及呆滯損失金額較 108 年度下滑，係該公司自 109 年度針對庫齡達 4 年以上、消化速度慢等存貨部品進行報廢處理共計 33,897 千元，109 年度依政策提列庫齡 49 個月以上存貨提列金額已下降為 29,718 千元，而截至 110 年 9 月底，庫齡在 4 年以上之金額較 109 年底增加 15,741 千元，係特殊規格部品，與雷射設備之維修用料隨時間經過拉長庫齡。經評估該公司已依所訂政策提列損失，存貨備抵提列應尚屬適足，並經會

計師查核簽證完竣，故整體而言，該公司目前備抵存貨跌價及呆滯損失金額已依上述管理辦法提，尚無重大異常之情事。

表二：108 年度及 109 年度合併備抵存貨跌價及呆滯損失金額

單位：新臺幣千元

庫齡(月)	期間(月)	提列呆滯 比率(%)	108 年度	109 年度	110 年前三季
			LCM 提列金額	LCM 提列金額	LCM 提列金額
13 個月以內	0~12.99	0%	3,316	1,313	2,997
13 個月以上~24 個月	13~24.99	10%	8,144	3,985	2,361
25 個月以上~30 個月	25~30.99	25%	4,421	5,486	7,824
31 個月以上~36 個月	31~36.99	45%	7,999	5,000	6,696
37 個月以上~42 個月	37~42.99	60%	6,330	6,195	6,538
43 個月以上~48 個月	43~48.99	80%	6,059	11,290	5,079
49 個月以上	49~	100%	45,667	29,718	45,459
合計(庫存+在製)			81,936	62,987	76,954

資料來源：該公司提供。

4.與同業比較

單位：新臺幣千元

項目		年度			合併		
		108 年度	109 年度	110 年 9 月底	108 年度	109 年度	110 年 9 月底
營業成本	達航	576,999	558,742	567,385	757,806	664,891	646,291
	大量	656,029	1,126,494	註 4	1,390,768	1,711,540	2,587,965
	凱崴	378,768	451,050	註 4	1,083,457	1,089,620	1,032,057
	尖點	670,158	741,691	註 4	2,147,058	2,003,273	1,855,277
期末存貨 總額	達航	440,145	424,305	539,094	587,176	513,775	649,690
	大量	380,617	506,498	註 4	註 3	註 3	註 3
	凱崴	157,083	160,036	註 4	473,611	442,409	473,488
	尖點	註 3	註 3	註 4	註 3	註 3	註 3
期末存貨 淨額(B)	達航	374,824	378,284	480,864	505,240	450,788	572,736
	大量	317,014	444,547	註 4	834,115	1,443,490	1,535,368
	凱崴	152,899	155,852	註 4	461,264	429,934	461,147
	尖點	141,852	152,809	註 4	434,286	482,352	648,378
存貨週轉 率(次) (註 1)	達航	1.46	1.48	1.76	1.39	1.39	1.68
	大量	2.02	2.96	註 4	1.62	1.50	2.32
	凱崴	2.53	2.92	註 4	2.35	2.45	3.09
	尖點	4.32	5.03	註 4	4.49	4.37	4.38
存貨週轉 天數(天)	達航	250	247	207	263	263	218
	大量	181	124	註 4	226	244	158
	凱崴	145	125	註 4	156	149	119
	尖點	85	73	註 4	82	84	83

項目		年度			個體			合併		
		108 年度	109 年度	110 年 9 月底	108 年度	109 年度	110 年 9 月底	108 年度	109 年度	110 年 9 月底
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	達航	65,321	46,021	58,230	81,936	62,987	76,954			
	大量	63,603	61,951	註 4	註 3	註 3	註 3			
	凱崑	4,184	4,184	註 4	12,347	12,475	12,341			
	尖點	註 3	註 3	註 4	註 3	註 3	註 3			
提列比率(A/B)	達航	14.84%	10.85%	10.80%	13.95%	12.26%	11.84%			
	大量	20.06%	13.94%	註 4	註 3	註 3	註 3			
	凱崑	2.74%	2.68%	註 4	2.68%	2.90%	2.61%			
	尖點	註 3	註 3	註 4	註 3	註 3	註 3			

資料來源：各公司 108 及 109 年度經會計師查核簽證之個體及合併財務報告，各公司經會計師核閱之 110 年第三季合併財務報告及達航 110 年 9 月底個體數字由該公司提供。

註 1：存貨週轉率係採存貨淨額計算之。

註 2：此資訊未有公開資料。

註 3：同業財報僅揭露存貨淨額，並未揭露備抵存貨跌價及呆滯損失、存貨總額資訊。

(1)個體財務報告

存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司個體財務報告 108、109 年度及 110 年前三季個體存貨週轉率分別為 1.46 次、1.48 次及 1.76 次，存貨週轉天數分別為 250 天、247 天及 207 天。與採樣同業水準相較，108、109 年度及 110 年前三季該公司個體財務報告皆低於採樣同業，係因該公司個體財務報告 107 年及 108 年度以計劃性生產為主，原計劃拓展中國區市場發展，但卻遭受到美中貿易戰及 COVID-19 疫情影響，致使中國區機台需求減緩，導致庫存去化亦減緩，造成部分存貨庫齡較長，致使期末存貨占資產總額約 20%，造成存貨週轉率較低，週轉天數較長。

備抵存貨跌價及呆滯損失占期末總額比率方面，該公司個體財務報告 108、109 年度及 110 年前三季個體備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率分別為 14.84%、10.85%及 10.80%，與採樣同業相較之下，該公司個體財務報告提列比率低於大量，高於凱崑，該公司個體財務報告已依政策提列適足，其提列政策尚屬允當。

綜上評估，該公司個體財務報告最近二年度及申請年度存貨及週轉率變化尚屬合理，備抵跌價及呆滯損失之提列應屬適足，與同業相較尚無重大異常情事。

(2)合併財務報告

合併存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 108、109 年度及 110 年前三季合併存貨週轉率分別為 1.39 次、1.39 次及 1.68 次，存貨週轉天數分別為 263 天、263 天及 218 天。與採樣同業水準相較，108、109 年度及 110 年前三季該公司皆低於採樣同業，係因該公司 107 年及 108 年度以計劃性生產為主，原計劃拓展中國區市場發展，但卻遭受到美中貿易戰及 COVID-19 疫情影響，致使中國區機台需求減緩，導致庫存去化亦減緩，造成部分存貨庫齡較長，致使期末存貨占資產

總額約 24.80%，造成存貨週轉率較低，週轉天數較長。

合併備抵存貨跌價及呆滯損失占期末總額比率方面，該公司 108、109 年度及 110 年前三季合併備抵存貨及呆滯損失提列比率分別為 13.95%、12.26%及 11.84%，與採樣同業相較，該公司合併提列比率皆高於凱崑，大量及尖點未揭露備抵存貨跌價及呆滯損失金額，故無法比較，該公司已依政策提列適足，其提列政策尚屬允當。

整體而言，該公司最近二年度及 110 年前三季存貨及週轉率及備抵跌價及呆滯損失之提列金額與採樣同業因產業特性、生產模式、產品結構及與客戶交易條件等互有許不同而略有差異，經評估尚無重大異常情事。

三、最近期及最近三個會計年度之業績概況

(一)列表並說明申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新台幣千元；%

比較項目	年度公司	107 年度	108 年度		109 年度		110 年前三季	
		金額	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
營業收入	達航	1,542,739	1,175,825	(23.78)	1,001,731	(14.81)	884,477	23.43
	大量	3,986,979	1,942,637	(51.28)	2,427,607	24.96	3,483,505	119.32
	凱崑	1,216,749	1,255,128	3.15	1,264,376	0.74	1,175,827	33.96
	尖點	3,282,444	3,006,253	(8.41)	2,973,426	(1.09)	2,765,814	29.69
營業毛利	達航	431,584	418,019	(0.97)	336,840	(20.71)	238,186	(1.84)
	大量	1,118,735	551,869	(50.67)	716,067	29.75	895,540	94.73
	凱崑	163,308	171,671	5.12	174,756	1.80	143,770	6.53
	尖點	909,845	859,195	(5.57)	970,153	12.91	910,537	39.09
營業利益	達航	52,715	46,956	(10.93)	110,183	134.65	59,299	(18.74)
	大量	526,318	209,650	(60.17)	202,822	(3.26)	463,480	273.95
	凱崑	32,167	48,343	50.29	36,787	(23.90)	39,264	20.46
	尖點	328,983	307,102	(6.65)	468,306	52.49	485,432	59.90

資料來源：各公司各年度及各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司設立於 80 年，主要從事印刷電路板製程中所需的鑽孔機台及成型機台設備的生產販售業務，以及其關鍵零組件的維修與保養等服務，另，自 106 年起，自行開發成功雷射鑽孔機台，作為供客製化雷射應用鑽孔代工之自製產能，主要銷售及服務對象為國內上市櫃印刷電路板大廠，所銷售地區涵蓋台灣、中國大陸及日韓市場。綜觀目前國內上市、櫃公司中，經參酌業務型態、營運規模及產業關聯性較為相近之業者，選取大量、凱崑及尖點三家為採樣同業。以下茲就該公司最近三年度及 110 年前三季之營業收入、營業毛利及營業利益情形，與採樣同業分別進行比較說明如下：

1.營業收入

該公司 107~109 年度及 110 年前三季之營業收入分別為 1,542,739 千元、1,175,825 千元、1,001,731 千元及 884,477 千元，最近三年度營收呈現衰退之趨勢，主要受到外在環境美中貿易大戰、COVID-19 疫情蔓延不確定因素升高及該公司經營策略調整影響所致。108 年起美中貿易戰及終端消費市場需求減緩，造成眾多印刷電路板製造廠的資本支出趨於保守，以致 108 年度該公司營業收入相較前一年度，減少 366,914 千元，變動幅度(23.78)%，然，同年 12 月，中國武漢市爆發新冠肺炎傳播，於 109 年間全球為因應防疫，各國陸續展開人流管制與國境封閉政策下，全球的物流、人流發展受限，使得該公司於中國華中區維修、保養及改造之專業服務業績減少，以及鑽孔機成型機銷售數量下滑，再加上該公司 108 年 10 月出售子公司大船科技煙台股權，縮減中國華北區業務之影響下，致該公司 109 年度營業收入又較前一年度減少 173,792 千元，變動幅度(14.78)%。110 年前三季受惠高精密機械鑽孔設備出貨增加，致該公司營業收入相較前一年度同期間增加 167,910 千元，變動幅度 23.43%。

107 年採樣比較同業大量及尖點的營業收入，分別係因全球智慧手機、消費性電子產品及車用電子的需求帶動下，拉升 HDI 板及類載板的供貨量，使得印刷電路板廠陸續增添設備，以因應產能供給需求，但 108 年採樣比較同業大量及尖點的營業收入，相較前一年度均呈現衰減趨勢，係因美中關稅壁壘的影響下，使得由中國大陸輸出的美國商品需加徵關稅，直接削弱消費市場的訂單需求，致印刷電路板廠的資本支出同步趨於保守態度，採樣同業凱歲的營業收入，相較前一年度微些成長 3.15%，係因受惠 108 年度鑽孔加工營收成長所致，109 年受因全球籠罩在新冠肺炎影響，故採樣比較同業尖點的營業收入表現，相較前一年度均產生衰減趨勢，惟，採樣同業大量的營業收入，相較前一年度呈現逆勢趨勢，係因受惠半導體業及印刷電路板製造廠擴充產能的資本支出，以因應 5G、車載及 AI 應用產品的投產需求，另，採樣同業凱歲的營業收入，相較前一年度僅些微成長 0.74%，未達 1%以上，故不擬予深入分析，110 年前三季後疫情時代，全球經濟逐漸復甦，故該公司營業收入，與採樣同業相較前一年度同期間之成長幅度，略顯低於採樣同業水準之間。

該公司與採樣同業相較，最近三年度及 110 年前三季之營業收入表現，107 年度介於同業水準間，108、109 年度、110 年度前三季低於採樣同業水準，係因該公司所提供之機台效能提升、維修、保養及雷射鑽孔應用專業服務比重逐年提高，而機器設備販售比重下降所致；但營收成長率變動方面，108 年度介於伯仲之間，109 年度低於採樣同業，110 年度前三季雖略低於採樣同業，但仍為正向成長。

綜上所述，該公司 107~109 年度及 110 年前三季營業收入之變化尚屬合理。

2.營業毛利

單位：新台幣千元；%

公司 \ 年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	毛利率	金額	毛利率	金額	毛利率	金額	毛利率
達航	431,584	27.98	418,019	35.55	336,840	33.63	238,186	26.93

大量	1,118,735	28.06	551,869	28.41	716,067	29.50	895,540	25.71
凱歲	163,308	13.42	171,671	13.68	174,756	13.82	143,770	12.23
尖點	909,845	27.72	859,195	28.58	970,153	32.63	910,537	32.92

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司 107~109 年度及 110 年度前三季之營業毛利分別為 431,584 千元、418,019 千元、336,840 千元及 238,186 千元，108 年度營業毛利金額較前一年度減少 13,565 千元，變動幅度(3.14)%，係因設備產銷業績減少；109 年度營業毛利金額較前一年度減少 81,179 千元，變動幅度(19.42)%，係因該公司調整中國區經營策略，於 108 年 10 月出售子公司大船煙台，將中國大陸的業務集中於華中及華南地區，以就近服務位於湖北黃石、江蘇昆山及廣東一帶的客戶，致 108、109 年間之營業收入減少，連動毛利金額同步下滑，110 年前三季較前一年度同期間減少 4,465 千元，變動幅度(1.84)%，另在毛利率方面，該公司 107~109 年度及 110 年前三季毛利率分別為 27.98%、35.55%、33.63%及 26.93%，108 年度毛利率較前一年度，變動幅度 27.06%，係因高毛利之雷射鑽孔加工及設備維修、改裝及保養的專案服務比重提高所致，109 年度毛利率較前一年度，變動幅度(5.40)%，係因該公司高毛率之設備之維修、保養及改造之專業服務營收下滑所致；110 年前三季因毛利率較低之機械鑽孔機銷售比重提高造成產品組合變動所致。

107 年度採樣比較同業大量、凱歲及尖點的營業毛利，係因營業收入帶動所致，108 年度隨著美中貿易戰劇烈影響下，終端消費電子產品的出貨逐步放緩，對組裝廠的採購需求亦同步減少，使得多數的印刷電路板廠在產能尚足以供給的情況下，降低資本支出的投資意願，以致採樣同業大量及尖點，108 年度的營業毛利相較前一年度均呈現衰減趨勢，凱歲 108 年度營業毛利較前一年度，僅些微成長 5.12%，然，109 年初，在中國大陸武漢市爆發 COVID-19 後，造成全球 109 年第一、二季的經濟活動陷入遲緩性的成長狀態，直到 109 年第三季末起，全球市場為因應新世代的 5G 網通、AI 及雲端運算產品的發展需求，推升高階精密設備的投產設備供給，致採樣同業大量、凱歲及尖點，109 年度及 110 年前三季之營業毛利，較 108 年度及 109 年前三季略微成長。

該公司與採樣同業相較，最近三年度及 110 年前三季營業毛利互有高低，係因營業規模及產品組合的差異所致；在毛利率表現上，107 年度優於凱歲及尖點，108 及 109 年度則優於採樣同業，110 年前三季僅次於尖點。

綜上評估，該公司 107~109 年度及 110 年前三季之營業毛利及毛利率變動尚屬合理。

3.營業利益

單位：新台幣千元；%

年度	營業費用及費用率(%)			
	107 年度	108 年度	109 年度	110 年前三季

公司	金額	費用率	金額	費用率	金額	費用率	金額	費用率
達航	378,869	24.56	371,063	31.56	226,657	23.63	178,887	20.23
大量	592,417	14.86	342,219	17.62	513,245	21.14	432,060	12.40
凱崑	131,141	10.78	123,328	9.83	137,969	10.91	104,506	8.89
尖點	585,442	17.84	579,421	19.27	497,159	16.72	443,648	16.04

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

單位：新台幣千元；%

公司	年度	營業利益及營業利益率(%)							
		107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
		金額	利益率	金額	利益率	金額	利益率	金額	利益率
達航		52,715	3.42	46,956	3.99	110,183	10.98	59,299	6.70
大量		526,318	13.20	209,650	10.79	202,822	8.35	463,480	13.30
凱崑		32,167	2.64	48,343	3.85	36,787	2.91	39,264	3.34
尖點		328,983	10.02	307,102	10.22	468,306	15.75	485,432	17.55

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司 107~109 年及 110 年前三季營業利益分別為 52,715 千元、46,956 千元、110,183 千元及 59,299 千元，另營業利益率分別為 3.42%、3.99%、10.98% 及 6.70%，108 年度營業利益較前一年度減少 5,759 千元，變動幅度(10.92)%，係因 108 年度營收的衰減影響所致；109 年度營業利益較前一年度增加 63,227 千元，變動幅度 134.65%，係因該公司於 108 年 10 月處分孫公司大船煙台股權縮小中國大陸之營運規模，同時，將林口辦公處與台中廠區進行廠辦合一摺節開支，致 109 年度營業費用較前一年度減少 144,406 千元，營業利益率由 3.99% 上升至 10.98%；110 年前三季營業利益較前一年度同期間，減少 13,675 千元，變動幅度(18.74)%，由於，110 年前三季該公司營業費用較前一年度同期增加 9,210 千元，變動幅度 5.43%，109 年前三季因期後回收之應收帳款產生預期信用減損利益 15,813 千元，其中，L 公司之呆帳費用 10,355 千元之迴轉，致比較基期營業費用偏低而營業利益較高；110 年前三季營業利益率相較前一年度同期變動(34.18)%，係因 110 年前三季較前一年度同期間產品組合之差異下，致營業毛利 110 年前三季較前一年度同期產生衰減。

採樣比較同業大量及尖點 108 年度的營業利益，相較前一年度衰減，係因 108 年度營收衰退所致，凱崑 108 年度營業利益較前一年度成長 50.29%，係因業績成長牽動及營業費用支付減少所致，另，109 年度採樣比較同業大量及凱崑的營業利益，相較前一年度分別減少 6,828 千元及 11,556 千元，變動幅度(3.26)%及(23.90)%，係因大量 109 年度的預期信用損失增加，凱崑則因 109 年度營業費用支付增加 14,641 千元，變動幅度達 11.87%所致，至於，尖點的營業利益，相較前一年度成長 52.49%，係因尖點於 109 年間陸續結束中國大陸區營業據點，致管理費用 109 年度較前一年度減少 63,875 千元，變動幅度(19.55)%，110 年前三季採樣同業受惠 5G、雲端、高階運算產品的先進製程的需求下，110 年前三季之業績表現較前一年度同期間成長。

該公司與採樣同業相較，最近三年度及 110 年前三季之營業利益，除 108 年度低於同業水準外，尚介於同業水準區間，另，營業利益率則介於同業水準之間。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季之營業收入、營業毛利及營業利益之變動原因及變動趨勢，與同業相較尚屬合理。

(二)列表並說明最近三年度及申請年度截至最近期止以「部門別」或「主要產品別」之銷貨收入、銷貨成本及銷貨毛利之變化情形是否合理

1.最近三年度及申請年度營業收入變動表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	995,663	64.54	912,184	77.58	825,709	82.43	513,976	58.11
設備產銷	520,623	33.75	253,091	21.52	154,963	15.47	344,160	38.91
其他	26,453	1.71	10,550	0.90	21,059	2.10	26,341	2.98
總 計	1,542,739	100.00	1,175,825	100.00	1,001,731	100.00	884,477	100.00

資料來源：該公司提供

2.最近三年度及申請年度營業成本變動表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	670,062	60.30	549,360	72.49	529,228	79.60	391,218	60.53
設備產銷	441,093	39.70	208,446	27.51	135,663	20.40	255,073	39.47
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	1,111,155	100.00	757,806	100.00	664,891	100.00	646,291	100.00

資料來源：該公司提供

3.最近三年度及申請年度營業毛利變動表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	325,601	75.44	362,824	86.79	296,481	88.02	122,758	51.54
設備產銷	79,530	18.43	44,645	10.68	19,300	5.73	89,087	37.40
其他	26,453	6.13	10,550	2.53	21,059	6.25	26,341	11.06
總 計	431,584	100.00	418,019	100.00	336,840	100.00	238,186	100.00

資料來源：該公司提供

4.最近三年度及 110 年前三季止依營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明：

該公司主要從事提供印刷電路板/載板製程所需雷射鑽孔加工服務、機械鑽孔、成型設備產銷服務及機械鑽孔設備之關鍵零組件維修、保養與改造等服務，以達印刷電路板廠產能提升並優化產品良率為目標。該公司主要產品別分為專業服務、設備產銷及其他三類。

以下茲就該公司最近三年度及 110 年前三季止各主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形分析如下：

(1)專業服務

該公司專業服務項目分別涵蓋雷射應用加工鑽孔的服務及機械鑽孔設備之維修、保養及改造服務兩大項目。在雷射應用加工鑽孔的服務方面，主要應用於消費性電子產品，例如：智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置及網通伺服等相關產品的製程上，雷射鑽孔之工藝技術，於印刷電路板的壓合板、盲埋孔板與增層多層板上已被廣泛使用，以增層、多層板為例，在製程上須將完成的雙面或四層板以雷射加工得到微盲孔後，再進行線路的高密度互連（即，簡稱：HDI，High Density Interconnect），而該公司自主開發生產的 CO2 及紫外線(即，UV)雷射鑽孔機設備，即是輔佐下游印刷電路板廠客戶，進行 IC 載板(含 ABF 載板)、類載板及 PC/NB 板等製程需求。另，該公司本身亦具備自製生產機械鑽孔設備之能力，有鑑於，設備經歷長期生產下，必然會存在耗損或效能不佳之情事，故該公司為協助客戶讓既存設備得以穩定運轉，確保投產之稼動率及產能效率，提供關鍵零組件維修、保養與改造之服務，以利於客戶既存之設備得以穩定運轉，確保投產之稼動率及產能效率。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季專業服務收入分別為 995,663 千元、912,184 千元、825,709 千元及 513,976 千元，占營業收入比重分別為 64.54%、77.58%、82.43%及 58.11%，最近三年度專業服務收入比重持續提高。108 年度專業服務收入較前一年度減少 83,479 千元，變動幅度(8.38)%，係因美中貿易戰影響下，致下游印刷電路板廠，在消費電子產品出貨遲緩，產能投產需求拉力減緩，鑽孔設備的關鍵零組件維修、保養與改造銷售業績減少；109 年度專業服務收入較前一年度減少 86,475 千元，變動幅度(9.48)%，係因 109 年 1 月初，中國大陸華中武漢地區爆發新冠肺炎肆虐，同年 3、4 月起，已傳播至歐、美等地，故全球為了有效控制疫情，採人、物流控管政策因應，在全球經濟活動產生遲緩性成長，致該公司於中國區維修、保養及改造服務收入衰減，且 108 年 10 月該公司出售大船煙台股權，縮減中國大陸華北地區業務之影響所致，110 年前三季該公司專業服務收入較前一年度同期減少 93,064 千元，變動幅度(15.32)%，係因下游印刷電路板廠擴充雷射鑽孔產能設備下，委託由該公司進行雷射鑽孔加工服務之需求降低所致。

該公司專業服務之營業成本及營業毛利變化方面，107~109 年度及 110 年前三季之營業成本分別為 670,062 千元、549,360 千元、529,228 千元及 319,218 千元，107~109 年度及 110 年前三季營業毛利分別為 325,601 千元、362,824 千元、296,481 千元及 122,758 千元，毛利率分別為 32.70%、39.78%、35.91%及 23.88%，108 年度受惠專業服務產品毛利上升，係因機鑽設備維修、保養產品的毛利貢獻成長幅度較高所致，108 年專業服務營業毛利較前一年度增加 37,223 千元，變動幅度 11.43%，毛利率由 32.70%上升至 39.78%，變動幅度達 21.65%；109 年度專業服務之營業成本，相較前一年度減少 20,132

千元，變動幅度(3.66)%，係因設備關鍵零組件維修、保養與改造訂單減少，109 年度專業服務營業毛利較前一年度減少 66,343 千元，變動幅度(18.29)%，係因鑽孔設備及關鍵零組件之維修、保養與改造訂單減少，毛利率由 39.78%下降至 35.91%，變動幅度(9.73)%；110 年前三季專業服務之營業成本較前一年度增加 4,996 千元，變動幅度 1.29%，係因雷射應用加工訂單減少，致 110 年前三季營業毛利較前一年度同期減少 97,999 千元，變動幅度(44.39)%，毛利率部分，110 年前三季為 23.88%較前一年度同期間 36.37%，下降 34.34%。

(2)設備產銷

該公司設備產銷產品以鑽孔機(ND)與成型機(NR)兩大類產品組合為主。該公司機械鑽孔工藝設備的技術支援功能，若以多層印刷電路板為例，其開孔之目的，係為做出連接所需要的導通路徑，除了橫向的（平面方向）的連接外，同時，亦進行垂直立體的連接，故在 PCB 或載板製程上，除了在基板上鑽孔或孔壁上電鍍的方法外，亦有將孔填埋的技術，至於，成型機之用途功能，係應用印刷電路板之成型(Profile)作業製程上，即將整片印刷電路板之各個排版(Pattern)進行裁切後，再轉交由封裝廠進行晶片與印刷電路板或載板封裝生產。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季設備產銷營業收入分別為 520,623 千元、253,091 千元、154,963 千元及 344,160 千元，占營業收入比重分別為 33.75%、21.52%、15.47%及 38.91%，最近三年度營業收入受到大環境不確定因素影響呈現衰退之趨勢。108 年度設備產銷營業收入較前一年度減少 267,532 千元，變動幅度(51.39)%，係因 107 年度 M-2 公司及 M-1 公司新廠擴建，致機械鑽孔機及成型機台採購增加，另，凱歲公司於同年間亦新增機械鑽孔代工業務，故增加對該公司之機械鑽孔機設備訂單，108 年度，美中貿易戰開打，關稅壁壘直接衝擊消費者及生產者的決策，致下游的印刷電路板廠，預期性的轉單或遷徙生產基地等因應關稅對策，促使資本支出趨近保守態度；109 年度設備產銷營業收入較前一年度減少 98,128 千元，變動幅度(38.77)%，係因 109 年第一、二季新冠肺炎影響下，致該公司 109 年度機械鑽孔機設備出售台數較前一年度衰退；在各國政府為了有效控管疫情需求，採行人流管制政策，再加上全球物流運送，在疫情的衝擊影響下，配送到貨時間均延遲，110 年前三季較前一年度同期間增加 247,797 千元，變動幅度 257.15%，係因受惠高階載板對高精密機械鑽孔設備數量之出售增加所致。

該公司設備產銷營業成本及營業毛利變化方面，107~109 年度及 110 年前三季營業成本分別為 441,093 千元、208,446 千元、135,663 千元及 255,073 千元，107~109 年度及 110 年前三季營業毛利分別為 79,530 千元、44,645 千元、19,300 千元及 89,087 千元，毛利率分別為 15.28%、17.64%、12.45%及 25.89%，最近三年度及 110 年前三季營業成本及毛利金額，大致隨著營業收入金額高低而同向變動。在毛利率部分，108 年度較前一年度成長 15.45%，係因該公司出售 A-2 公司及 L 公司的鑽孔機設備，屬高精密設備產品，109

年度較前一年度減少 29.42%，係因鑽孔機及成型機銷售數減少且未達規模經濟所致。110 年前三季較前一年度同期增加 187.67%，係因 110 年前三季隨著次世代電子產品符合高運算、高傳輸功能之訴求，在 PCB 或高階載板製程上，增加對高精密機鑽孔設備之出貨。

(3)其他

該公司歸屬其他類收入為代理商品收入，故營業收入與成本以淨額表達，故 107~109 年度及 110 年前三季其他產品營業收入及毛利金額均為 26,453 千元、10,550 千元、21,059 千元及 26,341 千元，最近三年度及 110 年前三季該公司代理類產品之營業收入及毛利變動，係因下游印刷電路板廠客製化之檢測模具訂購量多寡影響所致，由於，其他類產品營業收入占營業收入比重分別為 1.71%、0.90%、2.10%及 2.98%，其占比甚低，故不擬予以深入分析。

綜上所述，該公司最近三年度及申請年度截至最近期止主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化趨勢，經評估其變動情形尚屬合理。

(三) 最近三年度及申請年度截至最近期止營業收入或毛利率變動達20%以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

1.該公司最近三年度及 110 年前三季營業收入及毛利率變動情形

單位：新台幣千元；%

項目	年度	107 年度	108 年度	變動 比率	109 年度	變動 比率	109 年 前三季	110 年 前三季	變動 比率
營業收入		1,542,739	1,175,825	(23.78)	1,001,731	(14.81)	716,567	884,477	23.43
毛利率		27.98	35.55	27.06	33.63	(5.40)	33.86	26.93	(20.47)

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

由上表得知，該公司 107~108 年度、109 年前三季及 110 年前三季之營業收入或毛利率變動達 20%以上，故就上述期間，該公司主要產品別分別為專業服務、設備產銷及其他，由於，專業服務類產品，主要以雷射鑽孔應用及維修、保養及改造服務為主，屬客製化服務，因產品種類具多樣性，非屬自動化及標準化之製程，皆依據客戶需求進行服務，其中，雷射應用種類樣式眾多、因不同板材之孔徑、孔數量之差異而產生價量差異，另，維修、保養及改造服務，依實際訂單狀況、彈性配置人力投產提供勞務服務，故產能和產量，故無法用數值加總計算；而其他類產品，係屬代理類收入，不適宜進行價量分析，以下茲就該公司之產品別設備產銷之鑽孔機設備及成型機設備進行價量變動分析。

2.設備產銷之價量分析及說明

單位：新台幣千元

主要產品	分析項目	107年度~108年度	109年前三季~ 110年前三季

主要產品	分析項目	107年度~108年度	109年前三季~ 110年前三季
鑽孔機	(一)營業收入差異分析：		
	$P(Q'-Q)$	(140,888)	175,387
	$Q(P'-P)$	7,749	21,849
	$(P'-P)(Q'-Q)$	<u>(2,888)</u>	<u>70,228</u>
	$P'Q'-PQ$	(136,027)	267,464
	(二)營業成本差異分析：		
	$P(Q'-Q)$	(119,529)	154,331
	$Q(P'-P)$	(6,349)	8,042
	$(P'-P)(Q'-Q)$	2,366	25,848
	$P'Q'-PQ$	<u>(123,512)</u>	<u>188,221</u>
	(三)毛利變動金額：	(12,515)	79,243
成型機	(一)營業收入差異分析：		
	$P(Q'-Q)$	(132,258)	(23,884)
	$Q(P'-P)$	10,342	9,839
	$(P'-P)(Q'-Q)$	<u>(9,590)</u>	<u>(5,622)</u>
	$P'Q'-PQ$	(131,506)	(19,667)
	(二)營業成本差異分析：		
	$P(Q'-Q)$	(111,649)	(22,675)
	$Q(P'-P)$	34,557	4,276
	$(P'-P)(Q'-Q)$	<u>(32,044)</u>	<u>(2,443)</u>
	$P'Q'-PQ$	(109,136)	(20,842)
	(三)毛利變動金額：	(22,370)	1,175

資料來源：該公司提供

註：P' 及Q' 為最近年度單價及數量；P及Q為上一年度單價及數量

(1)107 年度~108 年度

鑽孔機及成型機設備產銷，於 108 年度受因美中貿易影響，使得下游印刷電路板廠降低資本支出的投資意願，分別產生 140,888 千元及 132,258 千元之不利銷售數量差，成本亦同等原因，分別產生 119,529 千元及 111,649 千元之不利數量差，另，108 年度部分客製化鑽孔設備屬高單價商品，成型機設備銷售數量少，致分別產生 7,749 千元及 10,342 千元有利價差，由於，客戶對美中貿易大戰採觀望態度，致設備訂單需求零星且未具經濟規模效益下，分別產生 6,349 千元及 34,557 千元不利價差，整體而言，108 年度鑽孔設備及成型設備之營業毛利較 107 年度分別減少 12,515 千元及 22,370 千元，致 108 年度設備產銷之營業毛利金額較 107 年度減少 34,885 千元。

(2)109 年前三季~110 年前三季

鑽孔機營業收入於 110 年前三季較前一年度同期成長，係因受惠 5G 產品及雲端運算傳輸產品的發展需求下，致下游印刷電路板設備廠，增添產能設備因應終端客戶，新一代產品規格投產需求，致 110 年前三季鑽孔機產品產生 175,387 千元有利的銷售數量差及 21,849 千元有利的價差，反觀，成型機設備，110 年前三季產生 23,884 千元不利的銷售數量差異及 9,839 千元不利價差，因受市場需求量縮減，進而降低產品出貨數，營業成本方面，鑽孔機設備受惠下游印刷電路板廠之採購具經濟規模效益，致產生 154,331 千元有利量差及 8,042 有利價差，反觀，成型設備市場已達飽和狀態，致產品市場價格競爭力較弱，而產生 22,675 千元不利量差及 4,276 千元不利價差，整體而言，110 年前三季鑽孔設備營業毛利較 109 年前三季增加 79,243 千元，至於，成型設備 110 年前三季營業毛利較 109 年前三季增加 1,175 千元，故 110 年度前三季設備產銷之營業毛利金額較 109 年前三季增加 80,418 千元。

四、併購他公司尚未屆滿一個完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素

經核閱該公司最近一年度及申請年度截至評估報告出具日止，董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，截至評估報告出具日止，該公司並無併購他公司尚未屆滿一個完整會計年度之情事，故不適用本項評估。

伍、財務狀況

- 一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力及現金流量

(一)選擇採樣公司之說明

該公司之主要業務內容為雷射鑽孔加工服務、自主研發生產之機械鑽孔機、成型機之設備銷售以及其效能提升與維修保養服務等。該公司在產業供應鏈中的定位係屬中游，負責基板之加工，其產品與服務主係應用於 IC 載板、HDI 載板的製程中。

綜觀國內 PCB 產業之上市櫃公司，經考量營業項目、產品結構及產業上下游關聯性等因素，選取上市公司大量科技股份有限公司(股票代號：3167，以下簡稱：大量)、上櫃公司凱崑電子股份有限公司(股票代號：5498，以下簡稱：凱崑)以及上市公司尖點科技股份有限公司(股票代號：8021，以下簡稱：尖點)，以茲比較：

大量為半導體產品檢測設備、PCB 設備及 CNC 彫銑機械製造商，主要產品 CNC 精密機器，應用於 PCB 鑽孔定位、成型切割、點膠、曲線滾塗等塗佈製程電漿之蝕刻、鍍膜等表面改質製程、晶片本體及外觀缺陷之檢查與測試等範圍，相關之營收比重約占八成。凱崑主要從事 PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工（機械鑽孔、機械成型與雷射鑽孔），其中 PCB 切削刀具及電路板製程代工兩項業務之營收比重約占七成。尖點主要產品為精密金屬鑽針與銑刀製品及鑽孔加工服務，兩項業務營收比重約占九成，其鑽針及銑刀主要用於 IC 載板、HDI、PCB 硬板、軟板內層線路鑽孔導通及成品切割，亦提供客戶機械鑽孔及雷射鑽孔服務。

另，同業平均之財務比率資料則是參考財團法人金融聯合徵信中心之「產業財務統計資訊」中之「C26 電子零組件製造業」之數據，作為同業平均之比較基礎。

(二)最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之變動分析與同業比較

分析項目		年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年 前三季
財務結構	負債占資產比率(%)	達航	47.78	45.88	47.20	54.59
		大量	55.54	55.06	62.10	63.73
		凱崑	44.91	42.86	42.44	54.20
		尖點	27.16	24.52	24.77	30.26
		同業	39.70	39.70	40.50	註 1
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	達航	170.92	161.88	129.58	132.05
		大量	650.52	529.57	177.67	219.96
		凱崑	208.94	239.11	252.70	219.83
		尖點	245.18	281.18	351.07	373.37

分析項目		年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年 前三季
		同業	43.00	48.20	44.10	註 1
償 債 能 力	流動比率(%)	達航	126.79	138.05	114.22	103.92
		大量	236.75	246.05	135.83	163.77
		凱崑	170.74	208.34	207.05	149.43
		尖點	365.14	452.97	455.53	388.48
		同業	280.80	315.00	280.10	註 1
	速動比率(%)	達航	61.71	69.01	54.68	45.18
		大量	180.12	181.44	82.33	103.31
		凱崑	119.74	147.47	162.42	114.90
		尖點	315.67	402.21	406.95	339.23
		同業	221.90	256.70	222.50	註 1
	利息保障倍數(倍)	達航	5.49	3.98	8.00	6.66
		大量	25.12	9.54	17.55	20.61
		凱崑	4.15	6.29	7.51	5.00
		尖點	20.10	22.91	49.22	58.12
		同業	2751.70	2154.10	3068.70	註 1
經 營 能 力	應收款項週轉率(次) (註 3)	達航	3.94	3.41	3.23	4.79
		大量	1.96	1.10	1.55	2.34
		凱崑	1.87	1.81	1.81	2.04
		尖點	2.40	2.35	2.64	2.95
		同業	4.80	4.70	5.00	註 1
	應收款項收現天數	達航	93	107	113	77
		大量	187	332	236	156
		凱崑	196	202	203	179
		尖點	153	156	139	124
		同業	77	78	73	註 1
	存貨週轉率(次) (註 3)	達航	2.05	1.39	1.39	1.68
		大量	2.70	1.62	1.50	2.32
		凱崑	2.29	2.35	2.45	3.09
		尖點	4.75	4.49	4.37	4.38
		同業	6.90	6.00	5.80	註 1
	平均售貨天數	達航	178	263	263	218
		大量	136	226	244	158
		凱崑	160	156	149	119
		尖點	77	82	84	84
		同業	53	61	63	註 1

分析項目		年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年 前三季
	不動產、廠房及設備週 轉率(次)	達航	2.75	1.75	1.21	1.23
		大量	9.29	4.14	2.41	3.06
		凱崑	1.34	1.31	1.29	1.43
		尖點	1.56	1.57	1.86	2.44
		同業	7.40	4.70	5.20	註 1
	總資產週轉率(次)	達航	0.80	0.60	0.51	0.54
		大量	0.84	0.46	0.51	0.81
		凱崑	0.41	0.42	0.38	0.42
		尖點	0.52	0.50	0.47	0.54
		同業	0.70	0.70	0.70	註 1
獲利能力	資產報酬率(%)	達航	2.18	3.33	5.16	3.32
		大量	9.96	4.64	9.19	8.81
		凱崑	1.85	2.95	3.14	2.20
		尖點	4.26	3.49	5.06	7.51
		同業	27.50	2.00	4.10	註 1
	權益報酬率(%)	達航	3.00	4.86	8.47	5.72
		大量	23.64	9.26	21.37	22.59
		凱崑	2.37	4.40	4.71	3.39
		尖點	5.49	4.44	6.54	10.19
		同業	3.40	1.00	3.60	註 1
	營業利益占實收資本 額比率(%)	達航	11.89	10.59	24.85	18.38
		大量	65.68	26.16	25.31	77.12
		凱崑	1.95	2.93	2.17	2.97
		尖點	22.92	21.60	32.94	45.52
		同業	註 2	註 2	註 2	註 2
	稅前純益占實收資本 額比率(%)	達航	13.07	12.26	24.81	18.89
		大量	76.48	28.34	56.80	77.98
		凱崑	3.45	5.81	6.92	4.96
		尖點	23.63	23.28	32.81	47.43
		同業	註 2	註 2	註 2	註 2
	純益率(%)	達航	2.08	4.29	8.91	5.14
		大量	11.23	9.08	17.11	10.35
		凱崑	3.34	5.94	7.04	4.18
		尖點	7.76	6.75	10.23	13.58
		同業	14.20	-3.70	29.00	註 1
	每股盈餘(元)	達航	0.74	1.18	2.09	1.06

分析項目		年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年 前三季
		大量	5.42	2.22	5.23	4.52
		凱崑	0.22	0.42	0.52	0.24
		尖點	1.69	1.34	1.98	2.42
		同業	註 2	註 2	註 2	註 2
現金 流量	現金流量比率(%)	達航	6.00	註 4	55.19	35.43
		大量	15.89	31.75	11.38	註 4
		凱崑	11.58	10.33	6.51	4.69
		尖點	50.92	107.63	87.55	55.73
		同業	13.10	16.20	19.10	註 1
	淨現金流量適當比率 (%)	達航	22.21	36.87	70.66	46.49
		大量	61.65	56.39	31.28	29.85
		凱崑	89.24	96.36	52.40	43.71
		尖點	147.46	170.91	197.57	162.98
		同業	註 2	註 2	註 2	註 2
	現金再投資比率(%)	達航	0.27	註 4	19.77	14.62
		大量	2.13	5.71	5.75	註 4
		凱崑	3.02	2.32	1.54	1.48
		尖點	4.69	7.49	6.59	4.36
		同業	1.90	4.00	4.60	註 1

資料來源：1.各公司經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、各公司股東會年報、公開資訊觀測站及康和證券整理。

2.同業平均資料係取自財團法人金融聯合徵信中心「產業財務統計資訊」之 IFRSs 合併財報財務比率，行業類別為「C26 電子零組件製造業」。

註 1：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版 110 年前三季同業平均資料。

註 2：財團法人金融聯合徵信中心之「產業財務統計資訊」未提供該項資訊。

註 3：應收款項週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

註 4：營業活動淨現金流量為淨流出，故不適用。

註 5：各採樣公司定義之變動營業成本與費用不同，故僅排除折舊費用及攤銷費用予以計算。

註 6：財務比率計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出

3.經營能力

- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現天數=365/應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
- (4)平均售貨天數=365/存貨週轉率。
- (5)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
- (6)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額

4.獲利能力

- (1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。
- (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
- (3)營業利益占實收資本額比率=營業利益/實收資本額。
- (4)稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/實收資本額。
- (5)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
- (6)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
- (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

1.財務結構

(1).負債占資產比率

該公司負債佔資產比率最近三年度及 110 年前三季分別為 47.78%、45.88%、47.20%及 54.59%。108 年度受到美中貿易戰的影響，全球經濟受到打擊，終端需求普遍下降，該公司營收亦受到衝擊，整體營運規模與對應之進貨規模同步減少，使期末應付帳款較去年同期減少，另因預收貨款與實際履約之時點有所差異，前一年度之合約負債於當年度完成履約，使期末合約負債較去年同期減少，故 108 年度負債占資產比率下降；109 年初面對新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，終端市場需求明顯下滑，衝擊全球 PCB 產業，但也使遠距工作、線上學習等需求趁勢崛起，帶動資料中心、個人電腦、平板電腦等應用需求提升，且 5G、AI 等應用帶動高效能運算晶片需求持續放大，驅動 ABF 載板需求持續成長，受惠相關需求成長的帶動，該公司年底的預收貨款及備料準備均較去年底提升，使期末合約負債及應付帳款均較去年同期增加，致 109 年度負債佔資產比率上升；110 年前三季因設備產銷訂單之增加，預收貨款及採購原料產生之應付帳款及銀行借款隨之增加，使負債占資產比率微幅上升。

該公司最近三年度及 110 年前三季負債占資產比率與採樣公司及同業平均互有高低，該公司負債占資產比率維持在五成左右，其變動幅度不高，

變動原因主係受營運面波動影響，尚無發現重大異常之情事。

(2).長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司長期資金占不動產、廠房及設備比率最近三年度及 110 年前三季分別為 170.92%、161.88%、129.58%及 132.05%，大致呈逐年下降趨勢，主係該公司 106 年起新增雷射鑽孔加工業務，有鑑於 5G 高頻高速的時代來臨，ABF 載板、IC 載板等高階材料之雷射鑽孔需求逐年攀升，該公司持續增加雷射機台設備，並於大甲精工廠增設雷射車間，因此不動產、廠房及設備淨額於 108 年度及 109 年度分別增加 94,819 千元及 220,480 千元，主係向銀行融資而使長期借款餘額分別增加 69,445 千元及 8,228 千元，但增加幅度不及不動產、廠房及設備增加幅度，致使 107 年至 109 年長期資金占不動產、廠房及設備比率逐年下降。而 110 年前三季因 109 年度獲利轉入保留盈餘，權益總額增加，使長期資金佔不動產、廠房及設備比率小幅上升。

由於該公司雷射鑽孔加工業務所需，持續增加購置機器設備，致該公司最近三年度及 110 年前三季長期資金占不動產、廠房及設備比率低於採樣公司，但比率仍均高於 100%，顯示該公司長期資金仍足以支應不動產、廠房及設備之投資需求，尚無以短支長之現象，財務結構尚屬穩定。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季財務結構變化趨勢及變動原因尚屬合理，且與採樣公司及同業平均相較互有高低，顯示該公司財務結構尚屬穩健。

2.償債能力

(1).流動比率

該公司流動比率最近三年度及 110 年前三季分別為 126.79%、138.05%、114.22%及 103.92%。108 年度受到美中貿易戰的影響，該公司整體營運規模縮小，且前一年度之預收貨款於該年度完成履約義務，使期末應付款項及合約負債較去年同期大幅減少，雖然營運規模縮小亦同樣影響期末存貨及現金及約當現金的餘額減少，但整體流動負債降低的比重大於流動資產降低的比重，致使 108 年度流動比率較去年同期上升。而 109 年度流動比率較 108 年度下降，主係流動負債增加、流動資產減少所致，流動負債增加主係疫情逐漸穩定帶動相關需求增加，該公司年底的預收貨款及備料準備較去年底增加，使期末合約負債及應付帳款均較去年同期增加；流動資產減少主係疫情雖逐漸穩定，但產業仍處復甦階段，客戶仍偏觀望態度，保守下單，在營運規模縮小的情況下，期末應收帳款及存貨均較去年同期減少。110 年前三季採購需求隨市場回溫而增加，存貨、應付帳款及銀行借款均較去年底增加，惟流動資產增加幅度小於流動負債增加幅度，致使 110 年前三季流動比率較 109 年度小幅降低。

該公司流動比率最近三年度及 110 年前三季均低於採樣公司及同業平

均，惟比率仍維持在 100%以上，顯示該公司之短期償債能力尚無疑慮。

(2).速動比率

該公司速動比率最近三年度及 110 年前三季分別為 61.71%、69.01%、54.68%及 45.18%，存貨淨額占資產比重約在 22%至 29%之間，並無大幅變動，速動比率變動原因與流動比率變動原因大致相同，與採樣公司及同業平均相較，該公司最近三年度及 110 年前三季速動比率低於採樣同業及同業平均。

該公司速動比率均小於 100%，為評估短期償債能力，須了解應收款項之變現週期，應收款項週轉率最近三年度及 110 年前三季分別為 3.94 次、3.41 次、3.23 次及 4.79 次，均優於採樣公司，雖該公司速動比率不足 100%，短期償債壓力相對較大，但考量應收款項週轉率表現較佳，收款天期較短，評估整體短期償債能力尚可。

(3).利息保障倍數

該公司利息保障倍數最近三年度及 110 年前三季分別為 5.49 倍、3.98 倍、8.00 倍及 6.66 倍。108 年度利息保障倍數較 107 年度降低，主係向銀行融資而使長期借款餘額增加 69,445 千元，使利息費用上升約 41.43%所致。109 年度利息保障倍數較 108 年度上升，主係該公司透過精實組織架構降低營業費用，使稅前息前利益較去年同期上升約 73.24%所致。110 年前三季償還部分銀行借款，年化利息費用較 109 年度降低約 8.75%，營業收入雖隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，惟設備產銷之毛利較低，產生之稅前利益有限，且 109 年度因處分子公司利益使營業外收入較 110 年前三季高，故使 110 年前三季之年化稅前息前利益較 109 年度下降約 23.97%，致使 110 年前三季利息保障倍數較 109 年度小幅下降。

該公司利息保障倍數最近三年度及 110 年前三季低於同業平均，但與採樣公司相比互有高低，經評估該公司利息保障倍數自 108 年度起呈上升趨勢，逐年改善，僅 110 年前三季小幅下滑，其短期償債能力尚可。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季償債能力低於採樣公司及同業平均，惟考量應收款項週轉率表現相對優異，短期償債能力尚可，尚無重大異常之情事。

3.經營能力

(1).應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司應收款項週轉率最近三年度及 110 年前三季分別為 3.94 次、3.41 次、3.23 次及 4.79 次，換算應收款項收現天數分別為 93 天、107 天、113 天及 77 天。最近三年度應收帳款週轉率呈下降趨勢，主係受到外在環境美中貿易大戰及 COVID-19 疫情蔓延不確定性因素提高及該公司營運策略調縮

減中國大陸營運規模所致。108 年度面對美中貿易戰，終端市場消費力道疲弱，衝擊印刷電路板市場需求，該公司營收表現亦受到衝擊而下滑，營收較去年同期減少 366,914 千元；109 年初面對新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，客戶偏觀望態度，保守下單，使 109 年度營收表現仍小幅衰退，營收較去年同期減少 174,094 千元。應收款項與營收皆呈現下滑趨勢，惟平均應收款項之計算係涵蓋最近兩年度的應收款項餘額，使平均應收款項的減少幅度較為趨緩，致使應收款項週轉率呈下降趨勢。110 年前三季隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，使年化銷貨淨額較 109 年度上升約 17.73%，且平均應收款項餘額較 109 年度下降，致使應收款項週轉率及應收款項收現天數較去年同期改善。

該公司應收款項週轉率及應收款項收現天數最近三年度及 110 年前三季均優於採樣公司，較同業平均差，主係該公司營運規模較同業平均小，對主要銷售客戶之交易條件可能較差所致，但該公司應收款項之控管良好，應收款項收款天數尚符合主要客戶之收款條件，應無重大異常之情事。

(2).存貨週轉率及平均售貨天數

該公司存貨週轉率最近三年度及 110 年前三季分別為 2.05 次、1.39 次、1.39 次及 1.68 次，換算平均售貨天數分別為 178 天、263 天、263 天及 218 天。108 年度面對美中貿易戰，公司營收下滑，銷貨成本也隨之下降，銷貨成本較去年同期減少 353,349 千元，約 31.80%；109 年初面對新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，公司營收小幅衰退，銷貨成本亦較去年同期減少 92,915 千元，約 12.26%。該公司存貨淨額最近三年度分別為 581,929 千元、505,240 千元以及 450,788 千元，亦呈現下降趨勢，主係因中美貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)的影響，市場需求萎縮，訂單減少的情況下，該公司降低存貨水位。109 年下半年 ABF 載板、IC 載板等高階材料之鑽孔需求大增，但客戶仍偏觀望態度，不願投入大筆資本支出購入設備，傾向於委託該公司進行雷射鑽孔代工，該公司存貨水位並未因此類需求增加而提高存貨量。該公司存貨淨額與銷貨成本皆呈下降趨勢，惟平均存貨淨額下降幅度不及銷貨成本下降比率，致使最近三年度存貨週轉率呈下降趨勢。110 年前三季隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，使年化銷貨成本較 109 年度上升約 29.60%，平均存貨淨額較 109 年度上升約 7.06%，致使 110 年前三季存貨週轉率及平均售貨天數較去年改善。

該公司存貨週轉率及平均售貨天數最近三年度均較採樣公司及同業平均差，主係該公司將營業重心從設備產銷轉移至鑽孔加工等專業服務，存貨週轉率下滑，但整體存貨水位亦持續降低，該公司應不致遭遇庫存過多而產生之潛在營運風險，且 110 年前三季隨市場回溫帶動設備產銷的業績，其存貨週轉率與平均售貨天數略為改善，經評估應無重大異常之情事。

(3).不動產、廠房及設備週轉率

該公司不動產、廠房及設備週轉率最近三年度及 110 年前三季分別為 2.75 次、1.75 次、1.21 次及 1.23 次。該公司 106 年起增加雷射鑽孔加工服務業務，最近三年陸續購入雷射鑽孔機台，且因 109 年下半年 ABF 載板、IC 載板等高階材料之雷射鑽孔需求增加，該公司除持續增加雷射機台設備外，亦於大甲精工廠中增設雷射車間以處理雷射鑽孔代工之訂單，因此不動產、廠房及設備淨額逐年增加，但營業收入受到美中貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)不確定因素影響，客戶持保守觀望態度，機械鑽孔機及成型機銷售持續下滑，致使最近三年度不動產、廠房及設備週轉率呈現下降趨勢。而 110 年前三季隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，使年化銷貨淨額較 109 年度上升約 17.73%，平均不動產、廠房及設備淨額較 109 年度增加約 15.62%，致使 110 年前三季不動產、廠房及設備週轉率上升。

該公司最近三年度及 110 年前三季不動產、廠房及設備週轉率與採樣公司互有高低，而低於同業平均，主係因營運策略的調整，逐年增加機台設備採購，不動產、廠房及設備金額逐年上升，且訂單量受到美中貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)之衝擊而下滑，皆影響著不動產、廠房及設備利用效率，且不動產、廠房及設備週轉率仍大於 1，上述變動原因尚屬合理。

(4).總資產週轉率

該公司總資產週轉率最近三年度及 110 年前三季分別為 0.80 次、0.60 次、0.51 次及 0.54 次。該公司最近三年度營業收入受到美中貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)不確定因素影響，客戶持保守觀望態度，機械鑽孔機及成型機銷售持續下滑，營業收入隨之下降，而 110 年前三季隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，年化銷貨淨額較 109 年度增加約 17.73%，使最近三年度總資產週轉率呈下降趨勢，而於 110 年前三季攀升。

該公司最近三年度及 110 年前三季總資產週轉率與採樣公司及同業平均互有高低，平均資產隨著獲利而逐年小幅增加，營業收入的變動成為總資產週轉率變動之主要原因，經評估其變動原因尚屬合理。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季經營能力各項指標表現尚可，應無重大異常之情事。

4.獲利能力

(1).資產報酬率及權益報酬率

該公司最近三年度及 110 年前三季資產報酬率分別為 2.18%、3.33%、5.16%及 3.32%，權益報酬率則分別為 3.00%、4.86%、8.47%及 5.72%，受到最近三年度稅後淨利逐年增加而呈上升趨勢。108 年度營業收入受美中貿易戰不確定因素影響而下滑，但稅後淨利仍較 107 年度增加，主係所得稅費用較去年同期大幅減少 21,978 千元，約 84.78%，而其減少主因係 108 年度未認列之可減除暫時性差異以及 107 年度認列以前年度之當期所得稅費用於本期之調整金額差異所致。109 年度營業收入因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響亦小幅衰退，但在適度調整人力及辦公處所下，營業費用控管得

宜較 108 年度減少 141,114 千元，使得稅後淨利仍較去年同期增加。110 年前三季年化營業收入雖隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，惟設備產銷之毛利較低，年化稅後損益仍較 109 年度下降。而最近三年度及 110 年前三季平均資產總額變動幅度不大，稅後淨利變動方向與資產報酬率及權益報酬率變動方向相同，均呈現最近三年度上升，110 年前三季下降的變化。

該公司最近三年度及 110 年前三季資產報酬率及權益報酬率與採樣公司及同業平均互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好，尚無重大異常之情事。

(2).營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近三年度及 110 年前三季營業利益占實收資本額比率分別為 11.89%、10.59%、24.85%及 18.38%；稅前純益占實收資本額比率則分別為 13.07%、12.26%、24.81%及 18.89%。108 年營業利益及稅前純益下滑，主係營業收入受美中貿易戰之影響而下滑所致，致使營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較去年同期下降。109 年營業收入因 COVID-19 疫情影響而下滑，但透過精實組織架構降低營業費用，致使營業利益及稅前純益上升，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較去年同期上升。110 年前三季年化營業收入雖隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，惟設備產銷之毛利較低，使年化營業利益及年化稅前純益較 109 年度下降，使該兩項比率均較 109 年度下降。

該公司最近三年度及 110 年前三季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率與採樣公司互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好。

(3).純益率及每股盈餘

最近三年度及 110 年前三季純益率分別為 2.08%、4.29%、8.91%及 5.14%，每股盈餘分別為 0.74 元、1.18 元、2.09 元及 1.06 元。銷貨淨額方面，108 年及 109 年因受到美中貿易戰及新冠疫情之影響，營業收入表現下滑，110 年前三季因設備產銷收入增加，營業收入表現上升。稅後損益方面，雖 108 年及 109 年營業收入表現下滑，但 108 年度因所得稅費用較 107 年度減少，109 年度因精實組織，營業費用較 108 年度減少，兩年度稅後損益表現均較前一年度上升，而 110 年前三季因營業收入上升的產品別為毛利較不佳之設備產銷，使稅後損益較 109 年度下滑。因此，該公司最近三年度純益率呈上升趨勢，而 110 年前三季較 109 年度下降，每股盈餘亦呈同向變化。

該公司最近三年度及 110 年前三季純益率及每股盈餘與採樣公司及同業平均互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季獲利能力各項指標雖受美中貿易戰及新冠疫情之影響，仍大致呈成長趨勢，顯示該公司獲利能力尚屬良好。

5.現金流量

(1).現金流量比率

該公司現金流量比率最近三年度及 110 年前三季分別為 6%、負值、55.19%及 35.43%。108 年度因營運規模縮小，營運產生之現金減少，支付利息及所得稅後，使營業活動之淨現金量為負值，故不予計算。109 年度現金流量比率較 107 年度增加，與 107 年度相比，備料積極性降低，存貨及應付款項均減少，使營業活動之淨現金流入金額增加，致使現金流量比率上升。110 年前三季現金流量比率較 109 年度下降，係因本期存貨增加額較 109 年度增加，使年化營業活動淨現金流量下降，流動負債增加所致。

107 年度現金流量比率低於採樣公司及同業平均，惟 109 年度及 110 年前三季現金流量比率大幅上升，109 年度及 110 年前三季僅低於尖點，指標大幅改善，雖該比率小於 100%，但綜合考量流動比率及銀行融資額度，該公司之短期償債能力及營運資金尚屬足夠。

(2).淨現金流量適當比率

該公司淨現金流量適當比率最近三年度及 110 年前三季分別為 22.21%、36.87%、70.66%及 46.49%，淨現金流量適當比率係指營業活動淨現金流量與資本支出、存貨增加及發放現金股利之比率，係反映公司營業活動現金滿足主要現金需求之程度。該公司 108 年及 109 年最近五年度營業活動淨現金流量總和增加、存貨增加量減少，使淨現金流量適當比率上升，存貨增加量減少係因 108 年及 109 年面臨美中貿易戰及新冠疫情之影響，該公司調整存貨水位所致。110 年前三季最近五年度營業活動淨現金流量減少，而資本支出、存貨增加額及現金股利發放額總和為增加，致使 110 年前三季淨現金流量適當比率降低。

107 年度及 108 年度淨現金流量適當比率低於採樣公司，惟 109 年度比率大幅改善，僅次於尖點，110 年前三季比率下滑，仍優於大量及凱歲，顯示該公司營業現金負擔主要現金支出之能力尚屬中等。

(3).現金再投資比率

該公司現金再投資比率最近三年度及 110 年前三季分別為 0.27%、負值、19.77%及 14.62%。108 年度因營運規模縮小，營運產生之現金減少，支付利息及所得稅後，使營業活動之淨現金量為負值，故不予計算。109 年度現金再投資比率較 107 年度增加，與 107 年度相比，營業活動之淨現金流入金額增加，致使現金再投資比率上升。110 年前三季現金再投資比率較 109 年度下降，主係本期存貨增加額較 109 年度增加，使年化營業活動淨現金流量下降所致。

107 年度現金再投資比率低於採樣公司及同業平均，惟 109 年度及 110 年前三季現金再投資比率大幅改善，表現優於所有採樣公司，顯示該公司營運資金負擔投資公司所需資產之能力尚可。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季現金流量各項指標與採樣公司及同業平均互有高低，其變化原因尚屬合理。

二、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之最近期及最近三個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響

該公司業已訂定「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「負債承諾及或有事項管理辦法」，另分別於109年7月24日及109年8月10日董事會及109年8月31日臨時股東會通過修定「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」；另又於110年7月5日董事會及110年8月30日股東臨時會通過修訂「取得或處分資產處理程序」。該公司之子公司亦以訂定相關作業程序，作為其辦理背書保證、重大承諾、資金貸與及取得或處分資產之依據，茲將該公司及其子公司107至110年最近期背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易情形分別列述如下：

(一)背書保證

該公司及其子公司業已訂定「背書保證管理辦法」，並經董事會及股東會決議通過，以作為該公司及其子公司背書保證作業之依據。經查閱該公司及其子公司之董事會、股東會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，並至公開資訊觀測站查詢，該公司及其子公司107~109年度及110年前三季背書保證情形列示如下：

單位：新臺幣千元

年度	背書保證者 公司名稱	背書保證對象		對單一企業背書 保證限額(註 1)	本期最高背 書保證餘額	期末背書 保證餘額	實際動 支金額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證最 高限額(註 1)
		公司名稱	關係							
107 年	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	415,724	275,880	275,880	107,849	-	26.54%	519,655
		日本大船	子公司	415,724	200,530	200,530	83,460	-	19.29%	519,655
108 年	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	414,732	278,834	191,030	90,279	-	18.42%	518,415
		日本大船	子公司	414,732	202,870	167,600	77,280	-	16.16%	518,415
109 年	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	428,679	193,455	187,220	26,668	-	17.47%	535,847
		日本大船	子公司	428,679	169,739	164,717	55,260	-	15.37%	535,847
110 年前三季	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	419,447	317,395	269,675	-	-	25.72%	524,309
		日本大船	子公司	419,447	162,704	152,810	62,250	-	14.57%	524,309

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

- 註：1.該公司及子公司對外背書保證之總額以不超過該公司及子公司最近期會計師簽證之財務報表淨值50%為限，對單一企業之背書保證限額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值40%為限，該公司及子公司整體得為背書保證之總額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值50%為限。
- 2.原為達航電子(深圳)有限公司於107年度更名為廣東達航電子有限公司，後又於110年2月配合營運佈局需要，由廣東省深圳區遷址到上海市青浦區，並將公司更名為上海達航實業有限公司。

上述為該公司為子公司上海達航及日本大船之營運周轉需要向銀行融通資金而須提供背書保證所產生，均為該公司直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司間產生，而背書保證限額之計算，係以該公司訂定「背書保證管理辦法」中，對外背書保證之總額不得超過最近期會計師簽證之財務報表淨值百分之五十為限，其中對單一企業之背書保證限額不得超過最近期會計師簽證之財務報表淨值百分之四十為限。以該公司 107~110年前三季淨值分別為1,039,311千元、1,036,829千元、1,071,695千元及1,048,619千元進行設算，該公司對單一企業背書保證之限額分別為415,724千元、414,732千元、428,679千元及419,447千元，背書保證總額度分別為519,655千元、518,415千元、535,847千元及524,309千元，尚無超限之情事。

經評估各相關交易均已符合該公司及子公司背書保證作業程序，對該公司及各子公司之財務業務應無不利影響。

(二)重大承諾事項

該公司及其子公司訂有「負債承諾及或有事項管理辦法」，並經該公司及其子公司分別於106年1月10日之董事會通過訂定，作為該公司及其子公司從事相關交易之依據。經查閱該公司及其子公司107~109年度及110前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司及其子公司107~109年度及110年前三季之重大承諾事項有因購買原料及機器設備已開立未使用之信用狀及委託銀行出具履約保證函。經評估，該公司及其子公司107~109年度及110年前三季之重大承諾事項係正常營業活動所產生，並無重大異常之情事，故應不致對該公司及其子公司之財務狀況產生重大不利之影響。

(三)資金貸與他人

該公司已訂定「資金貸與他人管理辦法」，並經董事會及股東會決議通過，作為該公司辦理資金貸與他人之依據，此外，該公司之子公司亦已訂定相關作業程序，作為其辦理資金貸與他人之依據。經參閱該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告，最近三年度及110年前三季資金貸與他人情形如下：

單位：新臺幣千元

年度	資出資金 公司名稱	貸與對象	往來科目	本期最 高金額	期末餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質	業務往 來金額	有短期融通資 金必要之原因	提列備抵 呆帳金額	對個別對象資金 貸與限額(註1,2)	資金貸與總 限額(註1,2)
107 年	CHINA EXPO	達航科技	註3	146,796	146,796	146,796	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	579,720	579,720
	CHINA EXPO	ALPHA	註3	2,457	2,457	2,457	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	579,720	579,720
	東莞達程	上海達航	註3	7,155	7,155	7,155	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	44,180	44,180
	大船煙台	上海達航	註3	25,491	25,491	25,491	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	188,899	188,899
108 年	CHINA EXPO	達航科技	註3	151,025	140,906	140,906	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	587,003	587,003
	CHINA EXPO	ALPHA	註3	2,528	2,398	2,398	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	587,003	587,003
	ALPHA	達航科技	註3	153,708	153,708	153,708	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	207,343	207,343
	東莞達程	上海達航	註3	10,127	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	50,029	50,029
	大船煙台(註2)	上海達航	註3	54,850	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	-(註2)	-(註2)
	上海達航	東莞達程	註3	17,113	15,068	15,068	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	82,544	82,544
109 年	CHINA EXPO	達航科技	註3	154,008	75,472	75,472	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	360,201	360,201
	CHINA EXPO	ALPHA	註3	2,536	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	360,201	360,201
	CHINA EXPO	東莞達程	註3	44,020	43,370	43,370	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	360,201	360,201
	ALPHA	達航科技	註3	155,571	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	8,240	8,240
	東莞達程	上海達航	註3	10,023	10,023	10,023	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	42,565	42,565
	上海達航	東莞達程	註3	29,754	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	184,330	184,330
110 年 前三 季	CHINA EXPO	達航科技	註3	75,618	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	259,757	259,757
	CHINA EXPO	東莞達程	註3	43,840	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	259,757	259,757
	東莞達程	上海達航	註3	10,039	7,749	7,749	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	41,492	41,492

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註1：資金貸與之限額說明如下：

1.短期資金融通限額：

- (1)該公司資金貸與總額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值之 40%為限。
- (2)該公司對個別對象之貸與限額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值之 20%為限。
- (3)該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，其總額及對單一企業貸與之金額以貸與公司最近期會計師簽證之財務報表淨值之 100%為限，期限以兩年為限。
- (4)有短期融通資金之必要者，得貸與資金之情況如下：
 - A.作為營運週轉使用：將資金使用於支付廠商貨款及費用者。
 - B.作為償還金融借款及借款利息。
 - C.作為償還關係企業借款及借款利息。

2.業務往來限額：

與該公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限，所謂業務往來金額係指雙方間最近一年度進貨或銷貨孰高者。因業務往來之資金貸與總額不得超過新台幣一億伍千萬元(或等值其他外幣)。

3.上述所稱之淨值，係指依證券發行人財務報告編製準則規定之最近期財務報告資產負債表歸屬於母公司業主之權益。

註 2：該公司之子公司 ALPHA 於 108 年 11 月 30 日出售大船煙台 100%股份。

註 3：往來科目為其他應收款-關係人

該公司與子公司於104年4月20日訂定資金貸與他人管理辦法，經檢視該公司與子公司最近三年度及110年前三季資金貸與情形，皆屬合併主體間之資金貸與，已於合併報表中消除，且皆經過董事會審核通過。經檢視該公司「資金貸與他人管理辦法」皆已依證交法第36條之1及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關規定訂定。然該公司由於法令解讀有差異，而以有實際動支金額之對象作為登載於備查簿的基礎，故造成備查簿有不完整之情形。惟考量該公司董事會通過資金貸與或背書保證其對象均為持股100%之子公司或孫公司，且雖備查簿有不完整之情形，但未登載至備查簿之對象僅為額度開立，並未有實際動用，對財務業務並不造成影響，故下列僅就有實際動用之對象加以說明。

該公司107年度至109年度及110年前三季並未有將資金貸與他人之情形。而其直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，107年度至109年度及110年前三季有因融通資金之必要性而從事資金貸與他人之交易，係依照各公司相關作業程序進行。

CHINA EXPO 107 年度至 109 年度及 110 年前三季資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與之情事，依照該公司相關作業程序，CHINA EXPO 107 年度至 109 年度及 110 年前三季淨值分別為 579,720 千元、587,003 千元、360,201 千元及 259,757 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 579,720 千元、587,003 千元、360,201 千元及 259,757 千元，CHINA EXPO 最近三年度及 110 年前三季對達航科技資金貸與期末餘額分別為 146,796 千元、140,906 千元、75,472 千元及 0 元，CHINA EXPO 107 年及 108 年對 ALPHA 資金貸與期末餘額分別為 2,457 千元及 2,398 千元，另因該公司於 109 年 12 月 21 日董事會通過 ALPHA 清算案，故截至 109 年底已無對 ALPHA 資金貸與之情事。CHINA EXPO 109 年及 110 年第三季對東莞達程資金貸與期末餘額分別為 43,370 千元及 0 元，資金貸與尚無超限之情事。

另 CHINA EXPO 106 年 10 月 24 日董事會分別通過短期融通資金貸與該公司及 ALPHA，貸放日期分別為 107 年 5 月 16 日及 107 年 12 月 16 日，截至 109 年 6 月尚未收回其貸與資金，違反子公司 CHINA EXPO LTD 所訂資金貸與他人管理辦法第 4.3 條『短期融通之規定，金管會來函要求改善，該公司已於 109 年 7 月 24 日董事會報告資金貸與他人缺失及改善計畫，該公司及 ALPHA 已分別於 110 年 6 月底及 109 年 12 月底償還資金，對該公司之財務狀況尚無重大之影響。

東莞達程 107 年度至 109 年度及 110 年前三季資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與上海達航，依照該公司相關作業程序，東莞達程 107 年度至 109 年度及 110 年前三季淨值分別為 44,180 千元、50,029 千元、42,565 千元及 41,492 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 44,180 千元、50,029 千元、42,565 千元及

41,492 千元，東莞達程最近三年度及 110 年前三季對上海達航資金貸與期末餘額分別為 7,155 千元、0 千元、10,023 千元及 7,749 千元，尚無超限之情事。

大船煙台 107 年度至 108 年底資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與上海達航，依照該公司相關作業程序，大船煙台 107 年度淨值為 188,899 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 188,899 千元，大船煙台 107 年度對上海達航資金貸與期末餘額為 25,491 千元，尚無超限之情事。該公司之子公司 ALPHA 於 108 年 11 月 30 日出售大船煙台有限公司 100% 股份，截至 108 年底大船煙台已無資金貸與上海達航之情事。

ALPHA 108 年度及 109 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與達航科技，依照該公司相關作業程序，ALPHA 108 年度及 109 年度淨值分別為 207,343 千元及 8,240 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 207,343 千元及 8,240 千元，ALPHA 對該公司 108 年度及 109 年度資金貸與期末餘額分別為 153,708 千元及 0 元，尚無超限之情事。

上海達航 108 年度至 109 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與東莞達程，依照該公司相關作業程序，上海達航 108 年度至 109 年度淨值分別為 82,544 千元及 184,330 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 82,544 千元及 184,330 千元，上海達航 108 年度至 109 年度對東莞達程資金貸與期末餘額分別為 15,068 千元及 0 元，尚無超限之情事。

另檢視該公司及子公司最近三年度及 110 年截至最近期之資金貸與備查簿、決議通過之董事會議事錄及抽核各子公司間資金貸與情形，尚無重大異常情事。

(四) 衍生性商品交易

該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，並經該公司 110 年 7 月 5 日之董事會決議通過主管機關公告之條文修訂，並經 110 年 8 月 30 日之股東臨時會通過，以作為該公司及其子公司從事衍生性商品交易之依據。經查閱該公司及其子公司之董事會、股東會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，並至公開資訊觀測站查詢申報資料，該公司及其子公司最近三年度及 110 年前三季截至最近期並無從事衍生性商品交易之情事。

(五) 重大資產交易

該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，並經該公司 110 年 7 月 5 日之董事會及 110 年 8 月 30 日之股東臨時會通過修正，以作為該公司及其子公司重大資產交易之依據。經查閱該公司及其子公司之董事會、股東會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，並至公開資訊觀測站查詢申報資料，該公司最近三年度及最近期取得或處分資產金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20% 以上之重大資產交易為機器設備之取得說明如下：

單位：新臺幣千元

標 的 物 名 稱	取得日期				取得 總價款	實際付 款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者， 其原取得資料				取得目的	價格決定之 參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會 決議日					日期	對象	與公司 之關係	價格		
107 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	N/A	106.12.18 107.06.26	134,729 (註 2)	依交易條款付款	依交易條款付款	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策
108 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	110.2.26	108.01.22	193,437 (註 2)	依交易條款付款	依交易條款付款	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策
109 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	110.2.26	108.12.24 109.03.24	238,885 (註 2)	依交易條款付款	依交易條款付款	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策
110 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	110.2.26 110.8.09	109.12.21 110.03.15	343,535 (註 2)	依交易條款付款	依交易條款付款	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之個體財務報告及該公司提供。

註 1：該公司於董事會通過機器設備購買預算後，按實際需求下單訂購。

註 2：107 至 109 年度為個體財務報告揭露之交易金額，110 年為董事會通過固定資產預算金額，經檢視 110 年 8 月 9 日董事會，截至 110 年 6 月 30 日止已採購雷射加工機器設備金額為新臺幣 180,907 千元。另因應中國大陸雷射應用市場需求，調整集團間自製設備產能配置，達航科技機器設備預算下修為 285,535 千元，上海達航新增為 60,000 千元，合計 343,535 千元。

隨著電子零件高運算及微小化之發展，而帶動電路板產業朝向高密度、多層與微型化等方向進化，而雷射鑽孔機為發展趨勢中主要生產設備之一。該公司因應產業發展之趨勢，持續擴充雷射鑽孔加工事業產能，加深與客戶合作關係，以期成為客戶無可取待的合作伙伴。因應此發展需求該公司於各年度視實際營運需求，於董事會通過向子公司日本大船採購雷射加工機器設備，用以擴增雷射事業部產能，並於 110 年 3 月 15 日經董事會追認通過。經檢視董事會議記錄、簽訂合約及抽核相關憑證等資料，尚無發現重大異常之情事，對該公司之財務業務尚不致產生重大不利之影響。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及 110 年截至最近期之背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易及重大資產交易情形，皆為正常營運發展所需，經評估尚無發現重大異常之情事，故對該公司及其子公司財務狀況尚無重大影響。

三、申請公司申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

該公司及其子公司上海達航實業有限公司（以下簡稱上海達航）預計於110年度持續向子公司大船企業日本株式會社（以下簡稱日本大船）購置供營業用資產（24台雷射鑽孔機）為新台幣343,535千元，用以投入雷射鑽孔加工業務，以滿足未來市場訂單需求及強化公司競爭力。茲就雷射鑽孔加工事業產能擴充計畫之可行性及合理性評估如下：

（一）計畫內容

因消費性電子產品日趨輕、薄、短小及可攜帶為主流，以及製程裝置搭載的功能更加多元化，故產品製程的孔徑與孔數日趨精密。因此，下游PCB板廠為因應高階產品的產能需求，則需建置新型設備因應之，但礙於消費性電子產品日新月異且全球經貿關係詭譎多變，致下游PCB板廠的資本設備支出，趨於保守態度下，該公司具備自製設備能力，得適時切入下游PCB板廠的製程中，提供雷射應用的鑽孔工藝製程的支援，並間接透過客製化雷射光源及參數設定，使自製雷射鑽孔設備累積多元應用的經驗值，進而提升自製設備的市場競爭能力，進而在近期持續擴充雷射鑽孔加工事業，除汰換老舊設備外，於109年12月21日、110年3月15日、110年5月10日以及110年8月9日董事會通過，預計110年向日本大船購置24台雷射鑽孔機設備成本為新台幣343,535千元，以及配合該公司雷射廠房之修繕、配電等支出計畫，廠房修繕成本為新台幣133,000千元，用以擴充雷射鑽孔機設備產能以提升公司競爭力。

（二）資金來源

本次擴充雷射鑽孔機設備產能及相關廠房修繕，所需總資金預計為476,535千元，將全數以該公司自有資金及銀行借款支應。

（三）工作進度

本次擴充雷射鑽孔機設備產能，相關廠區規劃經110年5月10日董事會通過增加修繕該公司大甲精工廠雷射廠房預算，預計於110年12月中完成雷射廠房修繕規劃，並陸續安置雷射鑽孔機設備，截至110年11月底止，該公司已向日本大船採購15台雷射鑽孔機，其中有14台雷射鑽孔機已送達大甲廠區，上海達航已向日本大船採購4台雷射鑽孔機，其中有3台已送達上海廠區。大甲廠區14台預計110年底陸續安裝完畢；上海廠區2台已完成裝機並進行測試，尚有1台預計於110年底完成裝機作業，上述機台預計於111年起開始產生效益。

（四）預計效益

本次擴增雷射鑽孔機設備產能計畫，主要是擴增雷射鑽孔機設備產能以因應客戶需求，此項目符合市場未來的發展趨勢，預期效益係以新設備帶動銷售業績估計，111年開始逐步貢獻營收，計資金回收年限約為7年。

單位：新台幣千元

年度	營業收入	營業毛利	營業利益	折舊費用	現金流入	累計現金流入
111 年度	125,089	37,969	31,057	36,980	68,037	68,037
112 年度	126,797	38,960	32,048	35,609	67,657	135,694
113 年度	131,110	42,521	35,609	34,074	69,683	205,377
114 年度	134,241	44,861	37,949	32,530	70,479	275,856
115 年度	134,241	44,861	37,949	31,148	69,097	344,953
116 年度	134,241	44,861	37,949	29,793	67,742	412,695
117 年度	134,241	44,861	37,949	28,469	66,414	479,109

資料來源：該公司提供

(五)可行性評估

1.計畫可行性

(1) 擴增雷射鑽孔機設備產能地點

該公司計劃於大甲廠區擴充擬擴增雷射鑽孔機設備產能，將現有大甲廠區整體重新規劃用以擴充雷射鑽孔機設備，另上海廠區目前既有廠房空間即可放置五台雷射鑽孔機，相關廠區空間規劃應屬可行。

(2)設備取得

本次擴充雷射鑽孔機設備產能，主要係向子公司日本大船採購雷射鑽孔機設備，日本大船於 104 年開始投入雷射鑽孔機之生產及製造，其在發展初期為提供機械鑽孔機及成型機、主軸維修零件的銷售與技術的支援服務，憑藉著持續專研的能力成功開發雷射鑽孔機。目前主要任務係生產滿足該公司對雷射鑽孔機之需求。而該公司近期已有陸續採購，以及安裝多台雷射鑽孔機，已累積相當經驗，故相關之取得應屬可行。

2.財務可行性

本次擴增雷射鑽孔機設備所需要之資金為 343,535 千元將全數以自有資金支應，依據該公司及其子公司 109 年 12 月 31 日之財務報告顯示帳上現金金額為 134,529 千元，且營業活動之淨現金流入為 449,315 千元，再加上該公司及其子公司預估 110 年度營運仍可穩定獲利，營運獲利之資金亦可支應擴增雷射鑽孔機設備所需及日常營運週轉，故擴增雷射鑽孔機設備所需資金來源以自有資金及銀行借款支應尚屬合理。

3.營運可行性

全球印刷電路板的生產基地，以亞洲為主，包含台灣、日本、韓國及中國，其中雷射鑽孔機亦為主要生產設備之一。在 5G 帶動多項產品成長與升級下，如基礎建設、消費性電子、電動車及物聯網等。帶動印刷電路板產業從板廠、上游原材料、延伸至設備廠，都能感到強勁的需求。再加上近年來先進載板朝向高密度、多層與微型化發展，隨著電子零件功能的發展，電路板的孔徑需要微小化，微孔深淺穩定、微孔位置精度、鑽孔數量以及生產速度等，大大的加深了對雷射鑽孔

產能之需求。又因各產品生產週期不一，故若出現同一時間需要大量鑽孔工序的情形，接單工廠（係該公司之客戶）會出現有產能不足而需委外代工之情況，以及接單工廠因擴充產能受制於場地、鑽孔設備取得成本及取得之時效性，再加上產品預估生產數量變動等風險，在相關擴產計劃決策時會保留一定程度之彈性，造成需要有委外加工代鑽孔之情形。隨著後疫情時代，電子產品功能不斷的加強電子線路設計愈來愈複雜，電子板上加工孔數呈倍數成長，造成相關鑽孔需求爆增，雷射鑽孔加工事業預估市場銷售應屬可行。

4. 效益合理性

該公司擴增雷射鑽孔機設備以提升雷射事業營業收入預估年營業收入方面，參考 110 年截至 11 月底之銷售額及評估未來市場需求情況，預估 111 年起每年營業收入可增加營業收入約 1.25 億至 1.34 億；雷射事業營業毛利率以 30%至 33%作為毛利估算基準，經參閱 109 年度及 110 年前三季雷射事業之毛利率分別為 44.85%及 21.93%，故所預估之毛利尚屬合理。在預估年營業利潤率方面，因雷射事業於設備投入後，在提供加工服務過程會產生的營業費用較小，大部份僅為零星費用，故所預估之營業利益率尚屬合理。

該公司如依計畫完成擴增雷射鑽孔機設備，除有利於該公司有效提升營業額創造更高利潤外，從長期效益上而言，該公司滿足客戶加工產能需求，同時持續性的提供雷射事業加工服務同時可以穩固該公司競爭優勢外，亦可藉由代工生產之經驗回饋至日本大船，以期能再精進雷射加工機台之性能，透過該公司持續採購機台，日本大船也有相當程度的生產經驗，以期未來雷射加工機台能在市場上有一席之地。

整體而言，該公司擴增雷射鑽孔機計畫應屬可行，且未來效益預估尚屬合理。

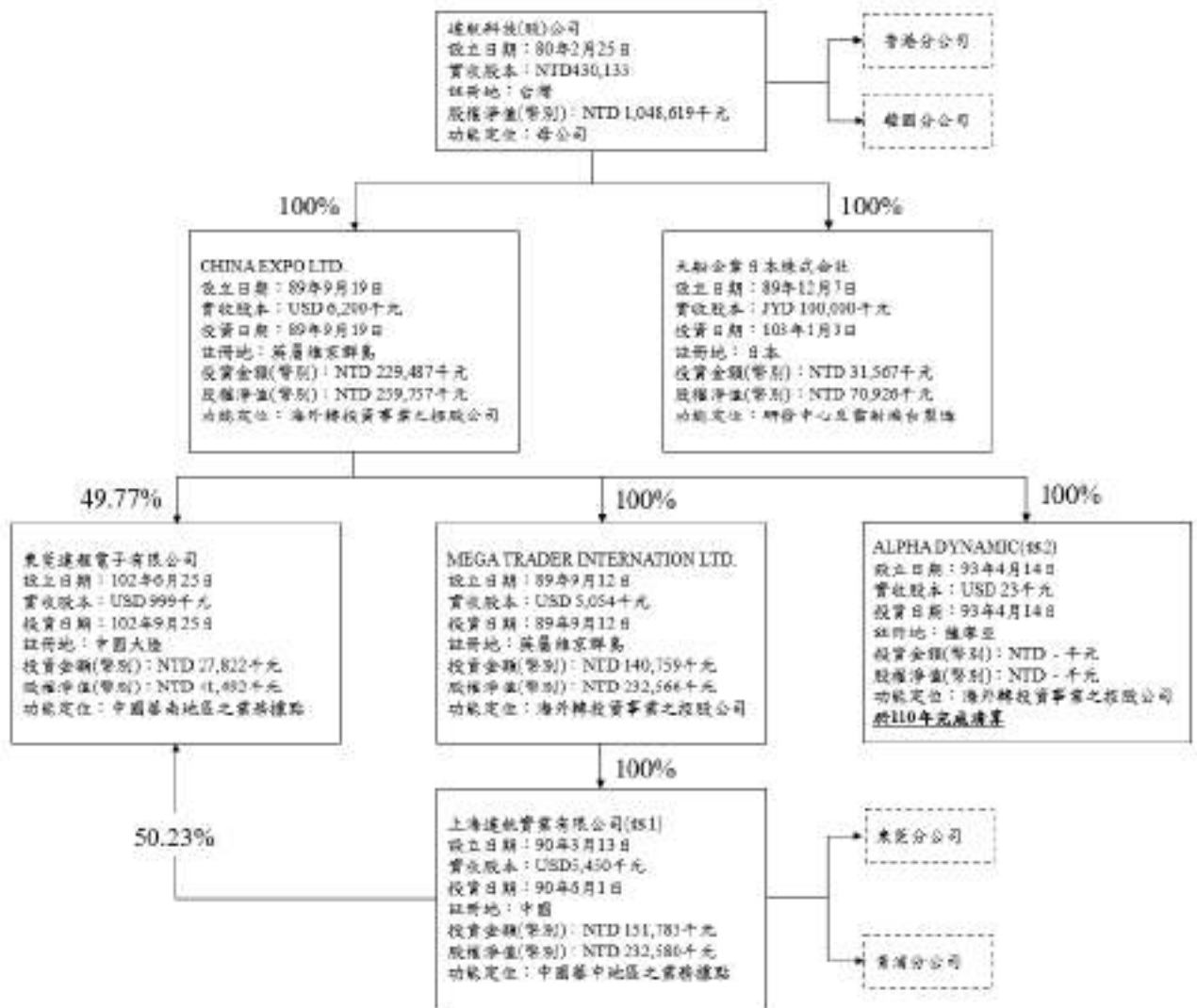
四、個體及合併財務報告之轉投資事業

(一)申請公司申請年度截至最近期止轉投資事業概況，並評估重要轉投資事業(持股比例達 20%以上或帳面金額或原始投資金額達新台幣 5 千萬元以上) 最近年度及申請年度截至最近期止之營運情形及獲利能力

1.個體財務報告之轉投資事業概況

(1)轉投資事業架構圖

110年9月30日/單位：千元



註1：原名為廣東達航電子有限公司。

註2：已於110年4月19日完成清算。

(2)轉投資事業概況

達航科技截至 110 年 9 月底轉投資事業之投資金額總計為 259,754 千元，占實收資本額 430,133 千元之 60.39%，另該公司公司章程第二條之一載明「轉投資總額得超過該公司實收資本額 40%」，故該公司尚無違反公司法第十三條規定之情事。該公司截至 110 年 9 月 30 日止，投資大陸地區之金額為 109,924 千元，未超過投審會規定之投資限額 629,171 千元。以下茲就該公司之轉投資事業概況說明如下：

A.直接轉投資事業

單位：新台幣千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	投資目的	評價方法	投資狀況				110 年 9 月 30 日			
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值或市價
CHINA EXPO LTD.	境外投資公司	英屬維京群島	89	境外投資	權益法	229,487	6,200	100%	259,754	6,200	100%	41.9	259,757
大船企業日本株式會社	設備、零件買賣及維修之業務	日本	89	設備製造及銷售、零件買賣及維修	權益法	31,567	2	100%	(25,912)	2	100%	35.463	70,926

資料來源：該公司 110 年第三季經會計師核閱之財務報告

B.間接轉投資事業

單位：新台幣千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	投資目的	評價方法	投資金額				110 年 9 月 30 日			
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值或市價
MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED	投資業務	英屬維京群島	89	境外投資	權益法	140,759	5,054	100%	232,566	5,054	100%	46.01	232,566
ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(註 1)	投資業務	薩摩亞	93	境外投資	權益法	-	-	100%	-	-	100%	-	-
上海達航實業有限公司(註 2)	成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣及維修保養	中國上海市	90	設備製造及銷售	權益法	151,783	-	100%	232,580	-	100%	-	232,580
東莞達程電子有限公司	PCB 機械設備製造加工買賣	中國廣東省	102	設備、零件買賣及維修	權益法	27,822	-	100%	41,492	-	100%	-	41,492

資料來源：該公司 110 年第三季經會計師核閱之財務報告

註 1：已於 110 年 4 月 19 日完成清算。

註 2：原名廣東達航電子有限公司，已於 110 年 2 月更名為上海達航實業有限公司。

2.合併財務報告之轉投資事業概況

該公司之轉投資公司之持股比率均為 100%，均已於編製合併財務報表時，全數納入合併財務報表主體內。

3.重要轉投資事業投資過程及股權變動情形

該公司截至 110 年 9 月 30 日之轉投資事業共計 6 家，其中直接投資包括 CHINA EXPO LTD(以下簡稱 CHINA EXPO)及大船企業日本株式會社(以下簡稱日本大船)等 2 家，間接投資之轉投資公司包括 MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED(以下簡稱 MEGA)、上海達航實業有限公司(以下簡稱上海達航)、ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(以下簡稱 ALPHA)及東莞達程電子有限公司(以下簡稱東莞達程)等 4 家，茲就該公司各轉投資事業之投資目的、決策過程及取得價格合理性分述如下：

(1)CHINA EXPO LTD.

單位：美金千元

投資 年月	投資金額 變動情形	投資目的及 變動原因	取得持 股比例 (%)	交 易 對 象	股 權 價 格 評 估 依 據	款項匯出/匯入日期		經濟部投資審議委員會 (以下簡稱投審會)核備及備查情形	
						日期	金額		
90/05~ 91/12	USD 450	設備間接投資 上海達航	100%	-	-	90/05/31	USD 320	90.03.22 經(90)投審二字第 90007857 號核准 90.06.19 經(90)投審二字第 90023354 號備查 90.12.21 經(90)投審二字第 90040036 號備查 91.05.15 經審二字第 091013855 號備查	
	USD 720	間接投資 上海達航				90/06/01	USD 200		
91/08~ 91/10	USD 450	間接投資 上海達航	100%	-	-	90/12/14	USD 200		
						91/8/27	USD 200		90.03.22 經(90)投審二字第 90007857 號核准
						91/10/8	USD 247	91.01.28 經審二字第 91002375 號核准	
92/07~ 92/08	USD 450	間接投資 上海達航	100%	-	-	91/10/8	USD 3	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准	
								91.10.30 經審二字第 091034243 號備查	
						92/7/8	USD 246.17722	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准 92.11.04 經審二字第 092035989 號備查	
92/7/8	USD 53.82278								
92/8/14	USD 150								
92/10~ 93/02	USD 400	間接投資 上海達航	100%	-	-	92/10/29	USD 200	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准	
						93/2/9	USD 200	93.03.18 經審二字第 093007267 號備查	
93/06~ 93/08	USD 263.9	間接投資 上海達航	100%	-	-	93/6/4	USD 120	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准	
						93/8/6	USD 143.9	93.06.21 經審二字第 093016792 號核准 93.08.27 經審二字第 093023763 號備查	
93/9	USD 312	設備間接投資 上海達航	100%	-	-	-	-	93.03.11 經審二字第 93006456 號核准 93.06.21 經審二字第 093016792 號核准 93.10.07 經審二字第 093028554 號備查	
109/09/17	USD 404.1	設備間接投資 上海達航	100%	-	-	-	-	經審二字第 10900262470 號 截至 93 年止以設備作價投資，大陸海關核 定金額不同造成美金 404.1 千元差異。	

資料來源：該公司提供

(2)日本大船

日本大船成立於民國 89 年 12 月，原為該公司前十大之一大船企業股份有限公司(以下簡稱大船企業)持股 100%之公司，因業務需要，達航科技於 102 年 12 月 23 日及 103 年 1 月 3 日董事會決議通過現金增資發行新股 1,739 千股，受讓日本大船 100%股權(2 千股)及台灣田中貴金屬股份有限公司(以下簡

稱台灣田中)10%(18 千股)股權之對價，每股面額 10 元，並以每股約新台幣 37.26 元溢價發行，增資股款(含溢價)計 64,808 千元，價格合理性係參酌 102 年 12 月 31 日日本大船之自結財務報表所載每股淨值所評估之價值，以每股約 15,783 元，計 31,567 千元及參酌台灣田中 102 年 11 月 30 日之自結財務報表所載每股淨值所評估之價值，以每股約 1,805 元，計 33,242 千元，合計 64,808 千元。日本大船於 103 年 1 月 3 日成為達航科技 100%持股之子公司，持股迄今尚未變動。

(3)MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED

單位：美金千元

投資 年月	投資金額 變動情形	投資目的及 變動原因	取得持股 比例(%)	交易 對象	股權價 格評估 依據	款項匯出/匯入日期		投審會核備及備查情形
						日期	金額	
90/05~ 91/12	USD 450	設備間接投資上海達航	100%	-	-	90/05/31	USD 320	90.03.22 經(90)投審二字第 90007857 號核准 90.06.19 經(90)投審二字第 90023354 號備查 90.12.21 經(90)投審二字第 90040036 號備查 91.05.15 經審二字第 091013855 號備查
	USD 720	間接投資上海達航				90/06/01	USD 200	
						90/12/14	USD 200	
91/08~ 91/10	USD 450	間接投資上海達航	100%	-	-	91/8/27	USD 200	
						91/10/8	USD 247	
						91/10/8	USD 3	
92/07~ 92/08	USD 450	間接投資上海達航	100%	-	-	92/7/8	USD 246.17722	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准 92.11.04 經審二字第 092035989 號備查
						92/7/8	USD 53.82278	
						92/8/14	USD 150	
92/10~ 93/02	USD 400	間接投資上海達航	100%	-	-	92/10/29	USD 200	
						93/2/9	USD 200	
93/06~ 93/08	USD 263.9	間接投資上海達航	100%	-	-	93/6/4	USD 120	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准 93.06.21 經審二字第 093016792 號核准 93.08.27 經審二字第 093023763 號備查
						93/8/6	USD 143.9	
93/9	USD 312	設備間接投資上海達航	100%	-	-	-	-	93.03.11 經審二字第 93006456 號核准 93.06.21 經審二字第 093016792 號核准 93.10.07 經審二字第 093028554 號備查
109/09/17	USD 404.1	設備間接投資上海達航	100%	-	-	-	-	經審二字第 10900262470 號 截至 93 年止以設備作價投資，大陸海關核定金額不同造成美金 404.1 千元差異。
109/10/30	USD 200	間接投資上海達航	100%	-	-	110/8/25	USD 200	109.10.30 經審二字第 10900301450 號核准 110.11.09 經審二字第 11000280670 號備查

資料來源：該公司提供

(4)ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED

該公司 93 年 4 月透過 CHINA EXPO 100%持股設立 ALPHA 公司，ALPHA 設立於薩摩亞，主要從事海外投資控股業務。ALPHA 這兩年未進行海外投資，該公司已於 109 年 12 月 21 日董事會決議通過 ALPHA 辦理清算案，並於 110 年 4 月清算完成。

(5)上海達航實業有限公司

該公司為擴展中國大陸業務於 90 年 3 月透過 MEGA100%轉投資深圳達航有限公司(以下簡稱，深圳達航)，然，107 年 8 月 27 日為遷址至中國大陸東莞，進行更名為廣東達航電子有限公司(以下簡稱，廣東達航)，因廣東達航已連二年虧損，且中國華中地區為 PCB 產業聚落，110 年 02 月再次進行遷址至中國華中一帶，更名為上海達航實業有限公司(以下簡稱上海達航)。

單位：美金千元

投資 年月	投資金額 變動情形	投資目的及 變動原因	取得持股 比例(%)	交易 對象	股權價 格評估 依據	款項匯出/匯入日期		稱投審會核備及備查情形
						日期	金額	
90/05~ 91/12	USD 450	設備作價至 中國生產	100%	-	-	90/05/31	USD 320	90.03.22 經(90)投審二字第 90007857 號核准
	USD 720	現金投資至 中國生產				90/06/01	USD 200	90.06.19 經(90)投審二字第 90023354 號備查
						90/12/14	USD 200	90.12.21 經(90)投審二字第 90040036 號備查 91.05.15 經審二字第 091013855 號備查
91/08~ 91/10	USD 450	現金投資至 中國生產	100%	-	-	91/8/27	USD 200	90.03.22 經(90)投審二字第 90007857 號核准
						91/10/8	USD 247	91.01.28 經審二字第 91002375 號核准
						91/10/8	USD 3	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准 91.10.30 經審二字第 091034243 號備查
92/07~ 92/08	USD 450	現金投資至 中國生產	100%	-	-	92/7/8	USD 246.17722	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准 92.11.04 經審二字第 092035989 號備查
						92/7/8	USD 53.82278	
						92/8/14	USD 150	
92/10~ 93/02	USD 400	現金投資至 中國生產	100%	-	-	92/10/29	USD 200	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准
						93/2/9	USD 200	93.03.18 經審二字第 093007267 號備查
93/06~ 93/08	USD 263.9	現金投資至 中國生產	100%	-	-	93/6/4	USD 120	91.08.01 經審二字第 91023222 號核准
						93/8/6	USD 143.9	93.06.21 經審二字第 093016792 號核准 93.08.27 經審二字第 093023763 號備查
93/9	USD 312	設備作價至 中國生產	100%	-	-	-	-	93.03.11 經審二字第 93006456 號核准 93.06.21 經審二字第 093016792 號核准 93.10.07 經審二字第 093028554 號備查
109/09/17	USD 404.1	設備作價 核定差額	100%	-	-	-	-	經審二字第 10900262470 號 截至 93 年止以設備作價投資，大陸海關核 定金額不同造成美金 404.1 千元差異。
109/10/30	USD 200	間接投資 上海達航	100%	-	-	110/8/25	USD 200	109.10.30 經審二字第 10900301450 號核准 110.11.09 經審二字第 11000280670 號備查

資料來源：該公司提供

(6)東莞達程電子有限公司

該公司 102 年 6 月分別透過 CHINA EXPO 與上海達航投資 49.77%及 50.23%股權，共同持有東莞達程電子有限公司(以下簡稱，東莞達程)，主要從事印刷電路板設備維修保養及零件販售業務。

投資 年月	投資金額 變動情形	投資目的及 變動原因	取得持股 比例(%)	交易 對象	股權價 格評估 依據	款項匯出/匯入		投審會核備及備查情形
						日期	金額	
102/12/27	USD 500	對外股本 投資	49.77%	-	-	102/9/18	USD 500	102.12.27 經審二字第 10200485820 號備查

資料來源：該公司提供

4.對轉投資事業之管理政策

該公司稽核部門依照內部控制處理準則第十三條，將「子公司之監督與管理」及子公司重要營運循環(如銷售循環、採購循環)排入年度稽核計畫中，並依照年度稽核計畫，執行子公司相關稽核作業，以下茲就子公司監理情形說明如下：

(1)經營階層

該公司子公司之最高主管係經母公司董事會指派，其他職務人員聘任視營運及業務需求聘任。組織架構及人員異動，於系統呈核並依核決權限經相關人員核定之，另，對子公司之預算執行及營運計畫，係參照每年 12 月經該公司董事會核備通過之計畫，考核預算追蹤及分析，並按月檢討分析按月之各項管理報表。

(2)銷售業務管理與採購管理

銷售、採購管理政策上，子公司的客戶的訂單處理作業、收款沖帳與供應商請採購處理作業、付款及沖帳係透過與該公司同套 Oracle ERP 系統執行。對於向該公司採購之產品，其價格訂定及交易條件，則依內部控制制度之「關係人交易循環」之規定辦理。並定期與該公司就雙方之應收、應付帳款明細進行對帳，確認帳務處理是否正確。

(3)存貨管理

存貨管理政策上，該公司按時檢視子公司每月存貨庫齡分析表，評估存貨週轉率及產銷月報是否有存貨過高之情形，定期於每年 6 月底及 12 月底執行存貨盤點，確認有無異常之盤盈、虧及呆滯存貨。受到新冠肺炎疫情影響，109 年期末盤點存貨及固定資產盤點採用移動視訊 Zoom 視訊會議系統進行連線方式進行抽盤，盤點報告上傳至系統並依核決權限呈核至該公司。

(4)財務及會計管理

A.各子公司處理當地帳務及稅務作業外，需每月提供財會相關報表(如資金貸與他人及背書保證月報表、資產負債月報表、損益月報表、現金流量月報表、應收帳款帳齡分析表、逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、重大財產取得或處分月報表等)資料上傳至系統並依核決權限呈核至該公司財務、會計主管、

總經理、董事長，以供定期監督各地區財會相關工作事項是否落實。

B.稽核人員按月核實上海達航各項管理報表是否按照內控程序落實執行，且按時呈核及歸檔備查。

C.各子公司應配合母公司依相關法令規定之應公告或申報事項及其時限，提供必要之財務、業務資訊，或委託會計師進行查核或核閱財務報告。

(5)稽核報告

A.該公司稽核計畫針對各子公司重要循環排定稽核作業，以及按季執行「子公司之監督與管理」稽核作業，包含年度預算執行、存貨管理、檢視管理報表及資金貸與背書保證，

B.依循環作業之查核項目，抽核各項作業是否依內控辦法執行，並比對 ERP 系統資料與內、外部憑證核對稽查，並分別執行銷售收款循環(包含客戶徵信及授信、基本資料、買賣契約及收款帳務作業等)與採購付款(包含供應商徵信、基本資料、詢報價及付款帳務作業等)，相關稽核報告之發現及建議於陳核後，通知子公司進行改善，查核範圍並無發現重大異常情事發生，稽核結果定期於該公司董事會上報告。

C.原預定 109 年第四季至子公司實地查核，受到新冠肺炎疫情未趨緩之影響無法前往，因子公司交易及帳務作業皆使用該公司 Oracle ERP 系統，伺服器、資料庫均存放於台灣，因此查核方式主要是透過各子公司所提供抽核的掃描檔與 Oracle ERP 系統上資料核對，並以視訊方式確認所提供檢核之掃描檔是否與原始檔案相符，以降低查核風險。

(二)申請公司最近三年度及申請年度截至最近期認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形及海外轉投資事業獲利匯回金額。

1.重要轉投資事業最近年度及申請年度截至最近期營運情形及獲利能力

單位：新台幣千元

公司名稱	營業收入淨額		營業毛利		營業利益		稅後純益(損)	
	109 年度	110年 前三季	109 年度	110年 前三季	109 年度	110年 前三季	109 年度	110年 前三季
CHINA EXPO	-	-	-	-	(804)	(1,728)	(8,435)	(6,930)
日本大船	381,752	271,194	54,689	31,515	23,446	8,268	17,261	5,227
MEGA	-	-	-	-	(13)	-	(15,612)	(4,501)
ALPHA (註 1)	-	-	-	-	(273)	-	7,870	-
上海達航	246,755	143,284	44,924	27,520	(7,246)	(8,450)	(15,598)	(4,501)
東莞達程	141,307	59,606	(1,600)	3,928	(7,804)	(1,284)	(8,122)	(378)

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司提供。

註 1：已於 110 年 4 月 19 完成清算。

(1)CHINA EXPO及ALPHA

CHINA EXPO 及 ALPHA 係該公司 100%持有之控股公司，尚無任何營

業收入。CHINA EXPO 109 年度及 110 年前三季稅後損益分別為(8,435)千元、(6,930)千元；ALPHA 已於 110 年 4 月完成清算，109 年度認列稅後損益 7,870 千元。

(2)MEGA

MEGA 為該公司透過 CHINA EXPO 100%持有之轉投資公司，尚無任何營業收入。MEGA 109 年度及 110 年前三季稅後損益分別為(15,612)千元及(4,501)千元。

(3)上海達航

上海達航係為該公司透過 MEGA 持有 100%轉投資之孫公司，主要負責該集團 PCB 鑽孔機於中國大陸之產銷業務。上海達航 109 年度營業收入、營業毛利及稅後損益分別為 246,755 千元、44,924 千元及(15,598)千元。110 年前三季之營業收入、營業毛利及稅後損益分別為 143,284 千元、27,520 千元及(4,501)千元，109 年虧損主係受到 COVID-19 疫情影響，展開人流管制與國境封閉政策下，全球的物流、人流發展受限，使得該公司於中國華中區維修、保養及改造之專業服務業績減少，以及鑽孔機成型機銷售數量下滑所致。

(4)東莞達程電子有限公司

東莞達程係為該公司透過 China Expo 持有 49.77%以及透過上海達航持有 50.23%轉投資之孫公司，主要負責該集團 PCB 鑽孔機於中國大陸華南地區之產銷業務。受到 COVID-19 疫情影響，展開人流管制與國境封閉政策下，全球的物流、人流發展受限，使得該公司於中國華中區維修、保養及改造之專業服務業績減少，以及鑽孔機成型機銷售數量下滑，致東莞達程 109 年度及 110 年前三季產生稅後純損分別為(8,122)千元及(378)千元，惟其營運正常尚無重大異常之情事。

(5)日本大船

日本大船為該公司持股 100%之轉投資公司，主要負責該集團的研發及雷射機台製造業務。隨著達航科技持續增加雷射應用業務，對於雷射機台之需求持續增加，使得日本大船 109 年度及 110 年前三季稅後損益分別為 17,261 千元及 5,227 千元，整體營運尚屬穩定。

2.最近三年度及申請年度截至最近期止轉投資事業股利分配情形

單位：新台幣千元

公司名稱	投資(損)益認列金額				股利分配情形				獲利匯回金額			
	107 年度	108 年度	109 年度	110年 前三季	107 年度	108 年度	109 年度	110年 前三季	107 年度	108 年度	109 年度	110年 前三季
CHINA EXPO	(13,171)	24,533	(7,201)	(6,930)	-	-	-	-	-	-	209,943	-
日本大船	(7,531)	(9,063)	(9,878)	(14,760)	-	-	-	-	-	-	-	-

公司名稱	投資(損)益認列金額				股利分配情形				獲利匯回金額			
	107年度	108年度	109年度	110年前三季	107年度	108年度	109年度	110年前三季	107年度	108年度	109年度	110年前三季
MEGA	(20,307)	(15,176)	(15,612)	(4,501)	-	-	-	-	-	-	-	-
ALPHA (註 1)	12,918	268	7,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海達航	(20,307)	(15,715)	(15,598)	(4,501)	-	-	-	-	-	-	-	-
東莞達程	(9,348)	4,083	(7,879)	(595)	-	-	-	-	-	-	-	-
大船(煙台)(註 2)	12,992	(15,256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司提供。

註 1：已於 110 年 4 月 19 完成清算。

註 2：已於 108 年 11 月出售 100%股份。

各轉投資事業於最近三年度及 110 年前三季均依其持股比例認列損益，其中 ALPHA 於 109 年 12 月經董事會通過辦理清算並於 110 年 4 月完成清算；而大船(煙台)於 108 年 11 月出售 100%股份；此外，除 CHINA EXPO 於 109 年度有獲利匯回 209,943 千元外，各轉投資事業於最近三年度及 110 年前三季均無股利分配及獲利匯回之情事，經評估尚無重大異常之情事。

(三)申請公司申請年度截至最近期止尚未完成之投資案，其預估總投資金額佔最近一年度財務報告所列示股本 20%以上，或逾新台幣五億元者，應詳加評估說明

該公司截至申請上櫃日止，並無未完成之投資案，其預估總投資金額佔最近一年度實收資本額達 20%以上或逾新台幣五億元者，故不適用。

五、申請公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響

該公司為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，依據該公司之公司章程第五條訂定保留一定股數供員工認股，並經該公司 106 年 12 月 18 日董事會通過員工認股權憑證發行與認股辦法，107 年 1 月 30 日董事會通過第一次執行員工認股權作業。該公司已於 107 年 7 月 31 日發行第一次員工認股權憑證 1,000 千單位，存續期間六年，認股權人包含該公司及子公司符合特定條件之員工。該公司 107 年 9 月 12 日取得首次公開發行普通股暨員工認股權證，該公司員工認股權憑證係依國際財務報導準則第二號(IFRS2)「股份基礎給付」規定，取具專業鑑價機構(加得顧問股份有限公司)針對其公平價值進行衡量及計算酬勞成本，並非採內含價值法衡量，故不適用內含價值法於股上櫃後產生之費用對財務報表之影響評估。

六、公營事業申請股票上櫃時，其檢送之財務報告以經審計機關審定之審定報告書替代者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見

該公司非屬公營事業，故不適用此項評估。

七、推薦證券商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響

該公司非屬外國申請公司，故不適用此項評估。

陸、關係人交易之評估

推薦證券商應就申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告之關係人交易，評估以下事項：

- 一、應針對申請公司交易金額重大或性質特殊之關係人交易執行相關評估程序（包括與同業及非關係人交易之比較），以瞭解其交易之必要性，決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性

(一)關係人之名稱及關係

關 係 人 名 稱	與 該 公 司 之 關 係
CHINA EXPO LTD.(CHINA EXPO)	該公司之子公司
大船企業日本株式會社(日本大船)	該公司之子公司
東莞達程電子有限公司(東莞達程)	該公司之子公司
MEGA TRADER INTERNATIONAL LTD.(MEGA)	該公司之子公司
上海達航實業有限公司(上海達航)	該公司之子公司
ALPHA DYNAMIC INVERTMENT LTD.(ALPHA)(註 1)	該公司之子公司
大船科技(煙台)有限公司(註 2)(大船煙台)	該公司之子公司
永然聯合法律事務所(註 3)(永然)	實質關係人
韶瑞開發股份有限公司(註 4)(韶瑞開發)	實質關係人
大船電子(上海)有限公司(上海大船)	實質關係人
大船科技(東莞)有限公司(東莞大船)(註 5)	實質關係人
大船科技股份有限公司(大船科技)(註 6)	實質關係人
大船科技股份有限公司(東京支店)(東京大船)	實質關係人

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體財務報告及合併財務報告。

註：1.已於 110 年 4 月 19 日清算完成。

2.該公司之子公司 ALPHA 已出售大船煙台 100%股份，故自 108 年 11 月 30 日起大船煙台已非該公司之關係人。

3.該公司已全面改選董事及監察人，故於 108 年 5 月 28 日起永然聯合法律事務所非為該公司之關係人。

4.該公司董事長與韶瑞開發董事長為同一人。

5.大船企業已出售東莞大船，故自 109 年 9 月 30 日起非為該公司之關係人。

6.該公司董事長與大船科技董事長為同一人。

(二)個體報告與關係人間重大交易事項

1.銷貨收入及應收帳款

銷貨收入

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金 額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	103,156	8.63	56,375	6.38	82,957	9.82	62,919	8.06
東莞達程	65,623	5.49	32,632	3.70	21,432	2.54	8,955	1.15

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
上海達航	861	0.07	-	-	-	-	-	-
大船煙台	40,942	3.42	7,389	0.84	-	-	-	-
合計	210,582	17.61	96,396	10.92	104,389	12.36	71,874	9.21

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

應收帳款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	15,403	9.11	11,417	5.36	17,735	10.08	14,317	11.01
東莞達程	16,411	9.71	3,280	1.54	3,439	1.96	3,960	3.04
上海達航	19,044	11.27	7,407	3.48	-	-	2,289	1.76
大船煙台	1,446	0.86	-	-	-	-	-	-
合計	52,304	30.95	22,104	10.37	21,174	12.04	20,566	15.81

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司銷貨至集團內子公司除因當地客戶有擴充設備之需求而有透過子公司銷售設備造成當年度金額較大外，因該公司為達採購效益極大化，集團所需大部分零組件係由臺灣母公司統一採購，由於該公司之子公司東莞達程、上海達航及大船煙台主要係提供各地區客戶機械鑽孔機維修服務，該公司主要銷貨以各地區執行維修需要之設備零件如SPINDLE（主軸）、滾珠螺桿及滑軌等維修零組件為主。而子公司日本大船主要係該集團雷射鑽孔設備研發中心，而該公司主要銷售雷射鑽孔設備所需要之雷射頭（LASER HEAD）、感應器及控制器等零組件，隨著該公司逐年擴充專業服務雷射加工產能，故銷貨致子公司日本大船金額居高不下。經抽核銷貨於各子公司零組件主要係依該公司移轉定價政策，主要係以成本加成10%，經評估尚無發現顯著異常。另經核閱相關帳冊及交易憑證，其收款條件為月結60天~月結90天，而該公司前十大銷售客戶多為介於月結30天~月結120天期之間，收款條件與其他客戶有別主要係依外幣曝險部位風險，以及考量集團內各子公司資金週轉需求訂定，經評估尚屬合理，並無重大異常之情事。

2.進貨及應付帳款

進貨

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	43,881	5.02	30,864	5.38	21,539	3.85	29,689	5.23

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金 額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東莞達程	10,406	1.19	12,965	2.26	9,759	1.75	5,725	1.01
上海達航	-	-	2,328	0.41	-	-	-	-
大船煙台	13,453	1.54	10,060	1.76	-	-	-	-
合計	67,740	7.74	56,217	9.81	31,298	5.60	35,414	6.24

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

應付帳款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金 額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	3,314	2.11	15,070	18.19	32,498	29.29	21,580	11.53
東莞達程	1,561	0.99	2,292	2.77	1,761	1.59	674	0.36
上海達航	1,877	1.19	955	1.15	-	-	-	-
大船煙台	783	0.50	-	-	-	-	-	-
合計	7,535	4.79	18,317	22.11	34,259	30.88	22,254	11.89

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司因維修或生產加工設備（如機械鑽孔機）之需要，部份零件需透過子公司日本大船採購日本當地生產之零組件如Z軸線性馬達、滾珠螺桿、光學尺及DSFI基板等，進而向子公司日本大船進貨。而部份零組件因成本考量則透過子公司東莞達程、上海達航及大船煙台至中國採購，主要以氣缸、夾頭、及SPINDLE（主軸）等。經抽核向各子公司進貨之零組件主要亦依該公司移轉定價政策定價，主要係以成本加成10%，經評估尚無發現顯著異常。另經檢視相關帳冊及交易憑證，其付款條件為月結30天，而該公司前十大進貨供應商付款條件主要為月結30天左右，故與其他供應商相較並無明顯不同，經評估尚屬合理，並無重大異常之情事。

3. 勞務收入

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金 額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	851	0.07	-	-	2,192	0.26	595	0.08
東莞達程	3,191	0.27	1,272	0.14	3,870	0.46	1,435	0.18
上海達航	40,636	3.40	20,782	2.35	10,437	1.24	6,894	0.88
大船煙台	5,598	0.47	2,404	0.27	-	-	-	-
合計	50,276	4.20	24,458	2.77	16,499	1.95	8,924	1.14

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司107~109年度及110年前三季勞務收入主要係該公司協助各子司諮詢、顧問、技術及協助規劃等服務，所收取的管理諮詢服務費，以及分攤台灣總部EPR系統等軟體維護費。經抽核上述交易之會計傳票及相關憑證，並核對經會計師簽證之財務報告，尚未發現有重大異常之情事。

4.其他營業收入

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
日本大船	33	0.01	303	0.03	245	0.03	10	-
東莞達程	29	-	240	0.03	101	0.01	191	0.02
大船煙台	9	-	27	-	-	-	-	-
合計	71	0.01	570	0.06	346	0.04	201	0.02

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

其他營業收入係出售非主要之零星設備(如：鼓風機、冰水機及清潔滾輪等)。經核對帳冊尚無重大異常之情形。

5.其他應收款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
日本大船	26	0.28	158	3.34	2	50.00	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

其他應收款係代購WIFI設備及代墊進口及營業稅等，經核對帳冊尚無重大異常之情形。

6.其他應付款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
日本大船	29,792	11.29	19,646	4.94	26,392	13.66	1,449	1.48
大船煙台	4,832	1.83	-	-	-	-	-	-
上海達航	2,074	0.79	-	-	-	-	-	-
大船科技	951	0.36	984	0.25	-	-	-	-
合計	37,649	14.26	20,630	5.19	26,392	13.66	1,449	1.48

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司107~109年度及110年前三季其他應付款主要係應付設備款、應付勞務費及其他費用所產生，經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

7.預付款項

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	64,092	69.79	46,684	53.81	72,158	81.01	150,239	69.96
大船煙台	4,846	3.08	-	-	-	-	-	-
合計	68,938	43.81	46,684	53.81	72,158	81.01	150,239	69.96

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司107~109年度及110年前三季預付款項主要係依約預付設備採購之訂金。經核閱相關帳冊，尚無重大異常之情形。

8.取得不動產、廠房及設備

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	134,729	83.62	193,437	84.63	237,957	90.68	12,222	11.37
大船煙台	-	-	8,865	3.88	-	-	-	-
上海達航	14,916	9.26	-	-	-	-	-	-
合計	149,645	92.88	202,302	88.51	237,957	90.68	12,222	11.37

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司107~109年度及110年前三季對日本大船採購金額主要係採購雷射鑽孔機，隨著該公司持續擴充雷射加工業務，雷射鑽孔機需求逐年提升。107年度及108年度分別向上海達航及大船煙台購進設備主要係配合該集團整體營運規劃，縮減子公司營運規模而將其設備（如複合加工機等）購進。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

9.承租協議-租賃費用

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
大船科技	18,848	7.55	13,700	5.48	7,743	5.06	4,539	3.69
韶瑞開發	60	0.03	60	0.02	60	0.04	45	0.04
合計	18,908	7.58	13,760	5.50	7,803	5.10	4,584	3.73

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司107~109年度承租林口廠所支付的租賃費用，隨著整體營運規劃縮減規模，租賃費用隨著租賃面積縮小而減少，於109年下半年該公司考量營運效益決定結束林口廠，將相關設備及人員全數搬回大甲廠，租賃費用隨著租賃合約的終止而減少。韶瑞開發租賃費用主要係承租內湖辦公室之費用。經檢視相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

10.向關係人借款

其他應付款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
CHINA EXPO	155,479	58.90	151,526	38.12	83,228	43.09	-	-
ALPHA	-	-	153,733	38.67	-	-	-	-
合計	155,479	58.90	305,259	76.79	83,228	43.09	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

利息費用

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
CHINA EXPO	2,111	28.73	2,150	16.24	1,846	15.18	573	7.02
ALPHA	-	-	26	0.20	719	5.91	-	-
合計	2,111	28.73	2,176	16.44	2,565	21.09	573	7.02

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司107~109年度及110年前三季因與子公司因短期資金融通之需求而有資金調度之情形，相關資金調度係經臺灣母公司董事會通過取得額度後，視集團內各公司實際資金需求調借，其主要以利息費用以1.5%計。經評估尚屬合理，並無重大異常之情事。

11.勞務費

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
日本大船	43,291	17.35	56,978	22.79	36,452	23.84	14,042	11.43
上海達航	7,090	2.84	2,113	0.85	392	0.26	-	-
東莞達程	-	-	-	-	95	0.06	-	-

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
永然	205	0.08	73	0.03	-	-	-	-
合計	50,586	20.27	59,164	23.66	36,939	24.16	14,042	11.43

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季對子公司之勞務費主要是支付日本大船技術支援委託之勞務費，主要有雷射鑽孔機主要零配件之研究及開發，以及 PCB 製造設備之設計、功能升級、製程改善或特殊規格等技術服務等。支付子公司上海達航及東莞達程勞務費主要係委託維護該公司出售至大陸客戶機械鑽孔設備之費用。107~108 年度支付永然主要係支付常年法律顧問聘任費等，因該公司全面改選董事及監察人，自 108 年 5 月 28 日起永然聯合法律事務所已非為該公司之關係人，故揭露關係人交易之勞務費隨之減少。經檢視相關明細，並抽核相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

12.其他費用

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	-	-	338	0.14	45	0.03	39	0.03
上海達航	-	-	93	0.04	1,113	0.73	-	-
大船科技	2,823	1.13	1,839	0.74	913	0.60	531	0.43
合計	2,823	1.13	2,270	0.92	2,071	1.36	570	0.46

資料來源：該公司 107~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季其他費用主要係支付大船科技因租賃林口廠所支付的大樓管理費用，隨著該公司持續管控費用，對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的管理費用亦隨之減少。而支付上海達航及日本大船其他費用主要係委託裝設機械鑽孔機台之服務成本等，經核閱相關租賃合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(三)合併報告關係人之名稱及關係

關係人名稱	與該公司之關係
大船科技股份有限公司(大船科技)	實質關係人
大船科技股份有限公司(東京支店)(東京大船)	實質關係人
永然聯合法律事務所(永然)	實質關係人(註 1)
韶瑞開發股份有限公司(韶瑞開發)	實質關係人
大船電子(上海)有限公司(上海大船)	實質關係人
大船科技(東莞)有限公司(東莞大船)	實質關係人(註 2)

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

註：1.該公司已全面改選董事及監察人，故於 108 年 5 月 28 日起永然聯合法律事務所非為該公司之關係人。

2.大船企業已出售東莞大船，故自 109 年 9 月 30 日起非為合併公司之關係人。

(四)合併報告與關係人間重大交易事項

1.勞務收入及應收帳款

勞務收入

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
東京大船	819	0.05	851	0.07	831	0.08	583	16.27(註 1)

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

註 1：110 年起重分類至業外收入項下，故計算該科目比重基礎變動。

107~109 年度及 110 年前三季受東京大船委任管理東京大船日本房地產物業管理所收取的管理收入。

應收帳款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
東京大船	-	-	152	0.05	76	0.03	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

2.其他應付款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
大船科技	951	0.90	984	0.84	-	-	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

該公司 107~108 年度其他應付款主要係應付林口廠水電費之支出。經核閱相關帳冊，尚無重大異常之情形。

3.預付租賃款

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	636	2.97	643	4.05	-	-	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

預付租賃款主要係依合約預付東京大船一個月之租金支出，經核相關合約，尚無重大差異之情形。

4.承租協議

取得使用權資產

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
上海大船	-	-	-	-	11,119	21.81	-	-
東京大船	-	-	-	-	35,413	69.46	-	-
東莞大船	-	-	9,030	29.16	-	-	-	-
合計	-	-	9,030	29.16	46,532	91.27	-	-

資料來源：107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

該集團參考鄰近地區辦公室租金行情分別於 109 年度 1 月份、109 年度 4 月份及 108 年 4 月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約。其租賃交易已依國際財務報導準則第 16 號時分別認列使用權資產、租賃負債及認列利息支出，其交易之必要性尚屬合理。日本大船租約係參考 TMAX Valuation 出具之不動產鑑價調查報告書。經核閱合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

租賃負債

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
上海大船	-	-	-	-	9,150	18.15	6,106	7.38
東京大船	-	-	-	-	27,861	55.27	20,408	24.65
東莞大船	-	-	6,686	28.83	-	-	-	-
合計	-	-	6,686	28.83	37,011	73.42	26,514	32.03

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務

報告及該公司提供。

該集團分別於 109 年 1 月份、109 年 4 月份及 108 年 4 月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約依國際財務報導準則第 16 號所認列之租賃負債。

利息費用

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
東京大船	-	-	-	-	454	2.89	257	2.39
上海大船	-	-	-	-	281	1.79	276	2.56
東莞大船	-	-	426	2.34	273	1.74	-	-
合計	-	-	426	2.34	1,008	6.42	533	4.95

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

該集團分別於 109 年 1 月份、109 年 4 月份及 108 年 4 月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約依國際財務報導準則第 16 號所認列之利息費用。

租賃費用

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)	金額	占該科目比重(%)
大船科技	18,848	5.08	13,700	3.69	7,743	3.42	4,539	2.53
東京大船	6,937	1.87	7,208	1.94	-	-	-	-
上海大船	3,425	0.92	4,008	1.08	3,250	1.43	84	0.05
東莞大船	950	0.74	735	0.20	-	-	-	-
韶瑞開發	60	0.02	60	0.02	60	0.03	45	0.03
合計	30,220	8.63	25,711	6.93	11,053	4.88	4,668	2.61

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

大船科技 107~109 年度及 110 年前三季因租賃林口廠所支付之租金，隨著該公司持續管控費用，對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的租賃費用亦隨之減少。東京大船及上海大船租賃費用減少主要是採用 IFRS 16 新公報，致相關費用轉為折舊之影響。東莞大船租賃費用減少主要係租賃予東莞達程為期三年之廠房合約，因東莞大船於 109 年 9 月出售予他人而提前解約所致。經檢視相關租賃合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

5.存出保證金

單位：新台幣千元

年度 名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	875	11.15	868	10.09	1,220	13.86	1,099	9.50
東莞大船	1,509	19.22	1,173	13.64	-	-	-	-
上海大船	388	4.94	374	4.35	380	4.32	374	3.23
大船科技	-	-	-	-	-	-	3,112	26.91
合計	2,772	35.31	2,415	28.08	1,600	18.18	4,585	39.64

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季承租廠房或辦公室依合約所支付之保證金，經抽核相關合約，尚無重大異常；另，該公司於 110 年 3 月 15 日支付大船科技存出保證金 3,112 千元係因按照原簽訂之合約第二條第三項之規定，需支付兩個月租金為押租保證金，惟 110 年 9 月 30 日止該公司未再續租，故大船科技於 110 年 10 月 5 日返還該筆存出保證金，經檢視相關匯款憑證，尚無重大異常之情形。

6.勞務費

單位：新台幣千元

年度 名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
永然	205	0.06	73	0.02	-	-	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

107~108 年度主要係支付常年法律顧問聘任費，該公司於 108 年 5 月 28 日全面改選董事及監察人，即日起永然聯合法律事務所已非為該公司之關係人，故揭露關係人交易之勞務費隨之減少。經檢視相關明細，尚無重大異常之情形。

7.其他費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
大船科技	2,803	0.76	1,839	0.50	913	0.40	531	0.30

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年前三季因租賃林口廠所支付的大樓管理費用，

隨著該公司持續管控費用，對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的管理費用亦隨之減少。經檢視相關租賃合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

8.其他收入

單位：新台幣千元

年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年前三季	
名稱	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東莞大船	-	-	-	-	967	38.03	-	-

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及該公司提供。

東莞大船租賃予東莞達程為期三年之廠房合約，因東莞大船於 109 年 9 月出售予他人而提前解約支付予東莞達程之違約金。

綜上所述，該公司最近三年度及 110 年前三季與其關係人間之業務往來，主要係基於業務上需求而產生之交易，實有其必要性，且與關係人之交易價格及收付款條件經評估尚屬合理，整體而言，該公司與關係人間尚未發現有重大非常規交易之情事。

二、瞭解申請公司金額重大之關係企業應收款項是否逾期，針對逾期者，應查明其原因及有無重大異常情事

經參閱該公司107~109年度及110年前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及檢視董事會議事錄及資金貸與備查簿等，該公司合併財務報告中與關係企業間應收帳款金額微小，檢視其交易尚無發現重大異常之情事。

三、申請公司與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來者，應查明其原因，及利率、收付息情形有無重大異常之情事

經參閱該公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止董事會及股東會議紀錄、年報、資金貸與他人備查簿、107~109年度及110年前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司及其子公司間主要因營運資金調度而有資金往來之情形，未發現該公司及其子公司有與合併公司以外之關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來之情事。

柒、重要子公司營運情形

- 一、推薦證券商派員實地瞭解申請公司之重要子公司營運情形者，應具體列示其是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

該公司轉投資公司中符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心推薦證券商辦理股票申請上櫃案之評估查核程序」第7條及「會計師查核簽證財務報表規則」第2條之1第2項規定之重要子公司為MEGA、CHINA EXPO及上海達航，其中MEGA及CHINA EXPO主要為投資控股功能，有實際營運生產銷售者為上海達航。

該公司為拓展大陸地區業務與就近服務客戶，在90年透過MEGA 間接持有上海達航100%股權，主要業務為PCB成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣及維修保養，同時也提供產品售後服務。本推薦證券商已於107年10月派員至上海達航進行實地查核，透過與上海達航經營階層主管訪談，了解其組織架構、生產及營運狀況，進行進、銷貨、薪工等循環之表單抽核，了解上海達航進貨模式及運作情形，並實地觀察並抽盤固定資產及設備以瞭解其管理情形，並未發現上海達航有重大營運風險或重大異常之情事；考量實地查核時間迄今已逾兩年，為掌握上海達航近兩年營運情形，已於110年6月委託天健會計師事務所，進行上海達航生產、進銷貨循環、薪工循環、採購循環內控表單確認及實地進行不動產、廠房、設備抽盤等作業進行瞭解，並未發現有重大異常之情事。茲就該公司重要子公司上海達航之營運風險說明如下：

(一)進、銷貨風險

上海達航主要銷貨對象為台灣上市櫃 PCB 業者於中國之子公司，主要係負責集團 PCB 成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣、維修保養及售後服務等事宜，其訂單處理作業、收款沖帳與供應商請採購處理作業、付款及沖帳均透過與該公司同套 Oracle ERP 系統執行。而銷售接單報價係透過評估當地市場行情、管銷費用及合理利潤下向客戶報價，並經當地主管核准。上海達航亦會評估客戶財務狀況後給予適當授信條件，得以有效控管客戶收款。在進貨部分，上海達航進貨主要以當地自行採購為主，採購前進行詢比議價，並經當地主管核准。如遇有特殊設備無法於當地採購之情形，則會向達航科技購買。

經與經營階層主管訪談，並抽核上海達航進銷貨相關表單後，其進銷貨交易均依內控制度實際執行，收付款項未發現重大異常之情事，經評估進銷貨交易尚無重大營運風險。

(二)財務及管理風險

上海達航目前配置財會主管 1 名、會計人員 2 名、財務人員 1 名，除處理當地帳務及稅務作業外，需每月提供財會相關報表(如資金貸與他人及背書保證月報表、資產負債月報表、損益月報表、現金流量月報表、應收帳款帳齡分析表、逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、重大財產取得或處分月報表等)資料上傳至系統並依核決權限呈核至該公司財務、會計主管、總經理、董事長，以供定期監督各地區財會相關工作事項是否落實。稽核人員亦按季執行「子公司之監督與管理」稽核作業，包含年度預算執行、存貨管理、檢視管理報表及資金

貸與背書保證等作業。整體而言，上海達航財務作業尚屬穩健，如有資金調度或重大資本支出須經由母公司進行審核，且母公司定期取得上海達航各項管理報表，經評估尚無重大之財務風險。

(三)政經風險

上海達航設立於中國，主要從事中國地區業務發展，故未來營運狀況及前景受中國政治經濟及兩岸情勢之影響。中國內需市場仍具潛力，達航科技將持續觀察中國政經情勢之發展，並對任何之變化進行快速之應對，以適時因應可能的變化。

(四)匯兌風險

上海達航位於中國，其銷貨及採購原物料係以人民幣為主要計價幣別，故人民幣匯率變動對其獲利影響有限。上海達航財務人員亦與往來銀行保持密切聯繫，隨時注意國際匯率變化，以掌握匯率走勢，降低匯率帶來之風險。

綜上所述，經本推薦券商派員並委託專業機構進行實地瞭解重要子公司之內部控制執行情況及營運狀況，經評估該重要子公司尚無重大營運風險或重大異常之情事。

二、本國申請公司生產據點或獲利主要來自海外重要子公司者，應具體列示申請公司對其海外重要子公司在財務操作與資金調度、帳務處理、內控內稽執行及盈餘決策等事項之監管措施及實際執行情形之評估意見

達航科技生產據點及獲利主要來自台灣，上海達航係負責集團 PCB 鑽孔機於中國大陸之產銷業務等事宜，並無生產之情事。且 108~109 年度及 110 年前三季上海達航之稅後純益分別為(15,175)千元、(15,598)千元及(4,501)千元，佔各年度合併稅後純益比率分別為(30.11)%、(17.47)%及(9.90)%，亦無獲利主要來自該海外子公司之情事，故不適用本項評估。

捌、法令之遵循及對公司營運影響

經參酌本推薦證券商委任之翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，針對該公司及申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人，就最近三年內下列相關事項出具意見，茲將其律師所出具之意見書及本推薦證券商評估對該公司營運影響評估彙總如下：

一、申請公司是否違反相關法令規章

(一)該行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章

經參酌律師出具之法律意見書，該公司截至評估報告出具日止，曾有違反相關法令規章說明如下：

- 1.前員工陳員於 108 年有詐欺行為，該公司予以資遣，暨違反勞動基準法勞工退休金條例、全民健康保險法

該公司與勞動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署之行政訴訟案請詳「附件一依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見 第一款 遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。」之說明。

- 2.該公司於臺中市大甲區南里工一路 00 號房屋屋前、屋後及屋側有增建情事」。

請詳「附件一依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見 第一款 遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。」之說明。

- 3.該公司所訂資金貸與他人管理辦法核有未符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』情事

請詳「附件一依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見 第一款 遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。」之說明。

- 4.該公司 108 年度未依董事會通過之稽核計畫，執行『資通安全檢查』乙項年度必要稽核項目，另申報 109 年度稽核計畫未按月編列年度應稽核項目，核有違反公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 13 條第 1 項及第 2 項第 6 款規定。

請詳「附件一依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處

所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見第一款遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。」之說明。

5.107年11月6日東莞市工商行政管理局以因東莞達航(109年已更名為上海達航)於106年工商年檢需要06月30日前完成公示，公司未於期限內完成公示，對東莞達航罰款人民幣1萬元，東莞達航已繳納罰鍰並依據主管機關指示完成公示，故應可認為上述情事已改善完畢。

6.110年6月21日該公司董事黃立達先生辭任，該公司未依公司法第387條第1項授權訂定之公司登記辦法第4條第1項前段規定：「公司及外國公司登記事項如有變更者，應於變更後15日內，向主管機關申請為變更之登記」，因該公司至110年9月7日始檢具應備書件向臺北市政府申請董事解任變更登記，未依上開規定期限辦理變更登記，依公司法第387條第4項之規定，處代表公司之負責人罰鍰新臺幣2萬元整。該公司已繳納罰鍰，並於教育訓練加強法令宣導，應可認為上述情事已改善完畢。

綜上，該公司於最近三年度及110年截至評估報告出具日止，除有上述違反法令遭主管機關裁罰，惟該公司已繳納罰款，並完成改善，對該公司之財務、業務不致於產生重大不利影響。

(二)依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊，評估是否依其法令辦理

經參酌律師出具之法律意見書及主管機關往來函文，並上網查詢公開資訊觀測站有關該公司所公告申報事項，除下述情事，該公司自107年9月12日經金融監督管理委員會證券期貨局核准公開發行後，截至評估報告出具日除以下公告疏失外，尚依公開發行公司資訊公開相關法令辦理資訊公開應行公告及申報事項，定期或不定期向主管機關辦理應公告申報事項。

- 1.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於110年3月29日來函表示，該公司於109年12月21日董事會通過向關係人(日本大船)購買雷射加工用機器設備343,535千元，符合公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項第1款規定之應辦理公告申報事項，而該公司遲至110年2月26日17時始將該訊息內容輸入中心指定之網際網路資訊申報系統，核有疏失。
- 2.另查該公司於110年3月15日董事會決議發放109年度股利分派情形、110年度股東常會召開日期及召集事由，以及通過109年度財務報告，惟該公司未依興櫃審查準則第34條第2項規定於事實發生日(110年3月15日)之次一營業日交易時間開始二小時前，而遲至110年3月16日12至18時始分次將該等訊息內容輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統，核有疏失。
- 3.依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年7月14日來函表示，該公司未依於110年7月5日董事會決議110年現金股利配息基準日，係屬興櫃審查準則第34條第1項31款所稱重大訊息，惟該公司未依興櫃審查準則第34條第2項

規定於事實發生日(110年7月5日)之次一營業日交易時間開始二小時前，而遲至110年7月7日17時始將該訊息內容申報，核有疏失，故擬處以新臺幣一萬元之違約金並注意改善。

4.110年6月4日金融監督管理委員會以金管證審字第1100362331號函略以：「達航公司之重要子公司CHINA EXPO LTD.分別於108年11月26日及109年8月10日資金貸與該公司及東莞達程電子有限公司各新臺幣50,000千元、另子公司東莞達程電子有限公司於109年11月16日資金貸與上海達航實業有限公司10,000千元，前開資金貸與皆達1千萬元且達該公司最近期財務報表淨值百分之二以上，已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定，應於事實發生日之即日起算2日內公告申報之標準，該公司未依規定於事實發生日之即日起算2日內代子公司公告申報，而遲至110年5月28日始公告申報，涉有違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第2項規定，通知達航公司陳述意見。」等語，該公司已依主管機關指示回覆，並加強內部員工之教育訓練，避免相同類似案件再發生，截至目前為止，尚未收到主管機關進一步來函。

5.該集團(大船企業日本株式會社、廣東達航電子有限公司上海分公司、東莞達程電子有限公司)分別於109年度1月份、109年度4月份及108年度4月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約。其租賃交易已依國際財務報導準則第16號時分別認列使用權資產、租賃負債及認列利息支出，因該公司申報人員疏失，而未即時依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第17款發佈重大訊息，惟該公司發現後已於110年6月21日補行公告完成。

前述有關公開發行公司資訊公開申報作業相關缺失，該公司已據主管機關指示完成改善，並加強內部員工訓練，避免類似案件再發生。

(三)其他法令規章

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京市天元律師事務所出具之法律意見書，並查閱主管機關往來函文、檢視簽訂之重大契約及相關明細帳冊，該公司最近三年度及申請年度截至評估報告出具日止，尚無重大違反其他法令規章之情事。

二、申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使

經參酌律師出具之法律意見書及取得上述相關人員之聲明書，該公司申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人最近三年度內並無違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務行使之情事。

三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事

經參酌律師出具之法律意見書及取得上述相關人員之聲明書，該公司申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人最近三年度內並無涉及違反著作權、專利權及商標權等情事。

四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌律師出具之法律意見書，核閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、110 年前三季經會計師核閱之財務報告、董事會及股東會會議記錄、該公司與主管機關往來函文，並取得該公司上述相關人員之聲明書，截至評估報告出具日止，該公司及董事繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件如下：

(一)台灣達航：

該公司與動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署之行政訴訟案詳「請詳附件一依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見第一款 遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。

(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。」之說明。

(二)重要子公司-上海達航

上海達航最近三年度及 110 年截至評估報告出具日止，尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件主要為客戶未如期支付貨款而產生之起訴案說明如下：

- 1.銅陵市超遠科技有限公司(以下簡稱超遠科技)委託上海達航進行主軸維修並向上海達航採購零配件，因被告超遠科技遲延付款，上海達航起訴要求超遠科技支付欠款人民幣 67,700 元及利息，經法院判超遠科技於判決生效後十日內支付上海達航人民幣 67,700 元及利息，惟因超遠科技 108 年 12 月 12 日已進入破產程序，故該款項於 109 年 6 月已作壞帳處理。
- 2.108 年 02 月上海達航與江蘇聯坤電子科技有限公司(以下簡稱江蘇聯坤)簽訂《設備維修保養與 SPINDLE 維修合約》，後因江蘇聯坤未支付貨款，上海達航起訴至法院要求江蘇聯坤支付款項人民幣 573,712.23 元及預期利息，經法院一審判決江蘇聯坤於判決生效後十日內向上海達航支付款項人民幣 472,187.15 元及預期利息損失。經查該款項已於 108 年 12 月收回。
- 3.109 年 03 月 06 日，上海達航因悅虎電路（蘇州）有限公司(以下簡稱蘇州悅虎)未支付貨款向法院提起訴訟，要求蘇州悅虎支付上海達航合同款項總計人民幣 535,836.97 元及利息，蘇州悅虎款項已支付，上海達航撤訴。

五、申請公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經參酌律師出具之法律意見書，並經發函勞動部、環保局及檢視收發文資料及取得該公司出具之聲明書，該公司及其重要子公司之勞資糾紛或污染環境事件情形如下：

(一)該公司

- 1.有關該公司違反動基準法之說明詳「附件一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見 第一款 遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。」之評估說明。
- 2.該公司有違反危險性機械未檢查合格，共計 1 案；固定式起重機(代碼：12F36A0350005)，逾期未檢(合格證有效期限 110/5/6)」，後經覆檢合格，檢查後之有效期限至 112 年度。

該公司雖有 1 件違反勞動基準法、違反危險性機械未檢查合格，上開 2 案件已繳納罰鍰並依據主管機關指示完成改善，上述事件違反法規之情節尚屬輕微，並無發現有重大污染環境事件，故對於該公司之財務及業務尚不致產生重大不利之影響。

(二)重要子公司-上海達航與員工之訴訟案

說明請詳「附件一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見 第一款 遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。就具體認定標準逐一評估情形之該公司及重要子公司上海達航訴訟及非訟案件說明 3.因上海達航東莞分公司(以下簡稱東莞分公司)的經營方針與和業務發生重大的調整和變化(曾用名:廣東達航電子有限公司東莞分公司)，故與東莞分公司原有員工解除勞動關係，部份員工向廣東省東莞市人民法院提出訴訟請求。」

另上海達航有發生 4 件工傷案件，但均已終結，且未與員工發生勞資爭議。有關重要子公司之述勞資爭議，該公司已依法院判決結果賠償員工，另除上述勞資糾紛案外，並無發現有污染環境事件，故對於該公司之財務及業務尚不致產生重大不利之影響。

綜上所述，該公司及其申請時董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人在法令遵循方面對該公司之營運尚無重大不利影響之情事。

玖、列明依櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見

本推薦證券商依櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項所列各款逐條評估結果，並未發現該公司有違反上述條文所列不宜上櫃之情事(請詳附件一)。

拾、列明發行公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見

該公司於 109 年 8 月 10 日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並於 109 年 8 月 31 日經董事會決議通過成立薪資報酬委員會，選任第一屆薪資報酬委員共三人，分別為梁江蔚委員、游張松委員以及陳文炯委員，其任期與該屆董事相同，成員之專業資格、職權行使及相關事項評估如下：

一、成員之專業資格

經檢視該公司薪資報酬委員會委員之學經歷資料，其委員會成員之組成尚屬健全，並符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條對於薪資報酬委員會成員專業資格及第六條獨立性資格規範之情事。

二、職權行使及相關事項

經檢視截至評估報告出具日止之薪資報酬委員會議事錄，會議中針對獎金分配、董事酬勞、經理人薪酬以及年度薪資報酬等議案進行討論並決議，經評估該公司薪資報酬委員會之職權行使及相關事項，尚符合證券交易法第 14 條之 6 及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。

綜上評估，該公司薪資報酬委員會之設置，其成員之專業資格、職權行使及相關事項尚符合我國證券法令之規定，尚無重大異常。

拾壹、評估發行公司公司治理自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

經檢視該公司出具之公司治理評鑑自評報告，該公司業已依公司治理評鑑指標進行逐項評估，包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」及「額外加、減分項目」，茲就公司治理評鑑自評報告中之項目說明如下：

一、維護股東權益及平等對待股東

該公司重視股東權益，每年定期依相關法令召集股東會，並於股東會開會日前上傳股東會議事手冊、會議補充資料及股東會年報，以確保每位股東能平等、及時且低成本地獲取攸關的訊息。股東會召開時係依「股東會議事規則」進行，其全體董事(含獨立董事)皆親自出席，對於報告及討論事項，均給予股東適當發言及充分參與討論之機會，並將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄，於會後將結果輸入公開資訊觀測站。另，該公司董事與大股東持股設定質押比率未逾 50%且未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情形，尚無影響公司股

東權益或產生利害衝突之慮。

二、強化董事會結構與運作

該公司參照「上市上櫃公司治理實務守則」相關規定，已訂定其公司治理實務守則並經董事會通過，以建立有效的公司治理架構，該公司目前設有七席董事，其中三席為獨立董事，並由三名獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，該公司遴選之獨立董事除符合獨立性資格外，並充分考量其學經歷背景，以期能發揮應有之功能，強化該公司之公司治理。

該公司之董事長與總經理非為同一人或互為配偶或一親等親屬，且該公司之董事間並無超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無具該公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數高於董事席次三分之一情事，顯示該公司董事長及總經理之職責能明確劃分，其董事會結構有助於董事會做出客觀獨立之判斷。

該公司董事會之成員結構多元化，具有會計師、稽核主管、大學教授及業界先進等不同專業背景，本年度全體董事之董事會實際出席率為 100%，且每次董事會獨立董事均親自出席。另，為使董事會成員有效發揮職能，該公司之獨立董事業已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成相關專業知識之進修，該公司董事會之運作尚屬健全。

三、提升資訊透明度

該公司重視資訊透明公開之責任，已依證券主管機關及櫃檯買賣中心之規定，指定專人負責於公開資訊網路申報作業系統揭露相關重要財務業務資訊，並建立發言人制度，使股東及利害關係人能及時並充分了解公司之財務業務狀況及實施公司治理之情形，此外，該公司已於公司網站建置投資人專區，列示公司年報及財務資訊等內容，以利投資人能夠容易取得相關資訊。另該公司於受評年度並無重編財務報告之情事，亦無因違反資訊揭露相關法規而受違約金處分。

四、落實企業社會責任

該公司參照「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定其誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過，以落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為；參照「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定其企業社會責任實務守則，以管理公司對經濟、環境及社會及公司治理議題之風險與影響。此外，該公司重視員工權益並落實企業社會責任，訂定及實施員工福利措施，並將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標，並於股東會年報中揭露相關內容。

五、額外加、減分項目

該公司於公司治理領域雖尚未有優良表現或具體效益，惟該公司截至評估報告出具日止，並無重大違反誠信經營原則、企業社會責任、內部控制制度或其他不符公司治理原則之情事。

經檢視該公司各項評鑑指標之評估說明，該公司之公司治理評鑑自評報告尚能允當表達其公司治理運作情形。

拾貳、評估本國申請公司是否符合集團企業、建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定

一、評估是否符合集團企業申請股票上櫃之規定

(一)集團企業之具體認定

依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」第一條之規定，所稱「集團企業」係指於申請上櫃會計年度及其最近一個會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體。其具體認定標準如下：

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	查核說明
1.屬於母公司及其所有子公司關係者。	(1) CHINA EXPO LTD. (2) ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED (3) MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED (4) 上海達航實業有限公司 (5) 東莞達程電子有限公司 (6) 大船企業日本株式會社	1.經檢視達航公司之股東名冊，並無持股逾 50%以上之股東，故該公司並非其他公司之子公司。 2.經檢視該公司 109 年度及 110 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司持股達 50%以上之子公司計有左列 6 家公司。
2.申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。其判斷標準如下：		
(1)取得對方過半數之董事席位者。	(1) CHINA EXPO LTD. (2) ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED (3) MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED (4) 上海達航實業有限公司 (5) 東莞達程電子有限公司 (6) 大船企業日本株式會社	1.經檢視該公司之董事名單，並無他公司取得該公司過半數董事席次之情形。 2.經檢視該公司 109 年度及 110 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告轉投資明細及年報，該公司取得對方過半數董事席位之情事計有左列 6 家公司。
(2)指派人員獲聘為對方總經理者。	(1) CHINA EXPO LTD. (2) ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED (3) MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED (4) 上海達航實業有限公司 (5) 東莞達程電子有限公司 (6) 大船企業日本株式會社	經詢問該公司管理當局及核閱其董事會議紀錄，左列 6 家子公司總經理分別為該公司所指派。

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	查核說明																								
(3)依合資經營契約規定擁有對方經營權者。	無	經檢視該公司董事會議事錄及重要契約之主要內容，並詢問該公司之管理階層，並無發現該公司有與他公司簽訂合資經營契約之情形，故無符合本款認定標準之集團企業。																								
(4)為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者。	無	經查閱該公司之109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、資金貸與他人備查簿及相關帳冊，並未發現有為他公司或他公司為其資金融通金額達對方總資產三分之一以上之情事。																								
(5)為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者	(1) 上海達航實業有限公司 (2) 大船企業日本株式會社	經查閱該公司109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、背書保證備查簿及董事會議事錄，該公司對外背書保證情形如下： <u>109 年度</u> 單位：新台幣千元；% <table><tr><th>對象</th><th>背書保證金額</th><th>總資產</th><th>占比</th></tr><tr><td>上海達航</td><td>193,455</td><td>377,582</td><td>51.24</td></tr><tr><td>日本大船</td><td>169,739</td><td>208,161</td><td>81.54</td></tr></table> 資料來源:經會計師查核簽證之財務報告 <u>110 年第三季</u> 單位：新台幣千元；% <table><tr><th>對象</th><th>背書保證金額</th><th>總資產</th><th>占比</th></tr><tr><td>上海達航</td><td>317,395</td><td>289,522</td><td>109.63</td></tr><tr><td>日本大船</td><td>162,704</td><td>248,052</td><td>65.59</td></tr></table> 資料來源:經會計師核閱之財務報告 該公司為上海達航與大船日本背書保證金額已達對方總資產之三分之一以上。	對象	背書保證金額	總資產	占比	上海達航	193,455	377,582	51.24	日本大船	169,739	208,161	81.54	對象	背書保證金額	總資產	占比	上海達航	317,395	289,522	109.63	日本大船	162,704	248,052	65.59
對象	背書保證金額	總資產	占比																							
上海達航	193,455	377,582	51.24																							
日本大船	169,739	208,161	81.54																							
對象	背書保證金額	總資產	占比																							
上海達航	317,395	289,522	109.63																							
日本大船	162,704	248,052	65.59																							
3.申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者。	無	經檢視該公司之109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東名冊，並未發現有該公司與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營之情事。																								

具下列各款情事之一者，即認為申請公司與他公司間具有控制或從屬關係。但經檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	查核說明
1.申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二等親以內之親屬關係者在內。	無	經檢視達航科技及其關係人擔任他公司董事、監察人及總經理情形，並取具法人股東之董監事及總經理名單，該公司並無與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同之情事。
2.申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。	1.鴻圻國際股份有限公司(以下簡稱：鴻圻) 2.鴻洋投資股份有限公司(以下簡稱：鴻洋) 3.大船企業股份有限公司(以下簡稱：大企) 4.大船開發股份有限公司(以下簡稱：大開) 5.大船科技股份有限公司(以下簡稱：大科) 6.大船國際實業有限公司(以下簡稱：大船國際) 7.OFUNA HOLDING COMPANY LIMITED(以下簡稱：OFUNA HOLDING) 8.ARIA WORLDWIDE LTD.(以下簡稱：ARIA) 9.ARRIS CORP.(以下簡稱：ARRIS) 10.達航工業(香港)有限公司(以下簡稱：達航工業(香港)) 11.大船電子(上海)有限公司(以下簡稱：大船電子(上海)) 12.達航電子設備(上海)有限公司(以下簡稱：達航電子設備(上海))	經檢視該公司 109 年度及 110 年截至最近期之股東名冊及董事之轉投資聲明書，並未發現該公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者之情事。 另考量黃立達家族截至 110 年 12 月 10 日持有該公司股權達 61.90%，大企、鴻圻、鴻洋之負責人亦為黃立達先生，而大企公司直接或間接持股達 50%以上之子公司計有如下： (1)直接持有：持有大開 56.49%股權。 (2)間接持有：透過大開持有大科、大船國際及 OFUNA HOLDING 100%股權；另透過大船國際持有 ARIA、ARRIS 及達航工業(香港)100%股權；透過 ARRIS 持有大船電子(上海)100%股權；透過達航工業(香港)持有達航電子設備(上海)100%股權。 爰實質認定上述 12 家公司為該公司之集團企業。
3.對申請公司採權益法評價之他投資公司，與該他投資公司之關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採	1.China Expo 2.ALPHA 3.MEGA 4.上海達航 5.東莞達程 6.日本大船	1.經檢視該公司最近期之股東名冊及 109 年度及 110 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並無他公司對該公司採權益法評價者。 2.經參閱該公司 109 年度及 110 年前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司採權益法評價之他公司計有 China Expo、

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	查核說明
權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。		ALPHA、MEGA、上海達航、東莞達程及日本大船等 6 家公司，且前述 6 家公司皆為該公司直接或間接持有 100% 股權。

綜上評估，符合該公司集團企業認定標準之公司計有 China Expo、ALPHA、MEGA、上海達航、東莞達程、日本大船、鴻圻、鴻洋、大企、大開、大科、大船國際、OFUNA HOLDING、ARIA、ARRIS、達航工業(香港)、大船電子(上海)、達航電子設備(上海)等 18 家公司。

(二)集團企業中之公開發行公司申請股票上櫃者，雖合於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則（以下簡稱審查準則）有關規定，但不能符合下列各款情事，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心認為不宜上櫃者，應不同意其股票上櫃：

1.申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，無相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發潛力者，所稱「相互競爭」，應以企業型態、商品可否替代及對象客戶等一般性要素綜合判斷之

該公司主要從事印刷電路板/載板製程所需雷射鑽孔加工服務、機械鑽孔、成型設備產銷服務及設備之關鍵零組件維修、保養與改造等服務，經查閱該公司 109 年度及 110 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，以及鴻圻、大企、大開 109 年度經會計師核簽證之財務報告，並訪談該公司營運管理中心副總經理，茲就該公司同屬集團企業公司之主要業務或產品列示如下，並說明有無相互競爭之情事：

集團企業名稱	主要營業或主要產品	集團定位及功能	有無相互競爭
China Expo	投資控股公司	海外轉投資事業之控股公司	無
ALPHA(註)	投資控股公司	海外轉投資事業之控股公司	無
MEGA	投資控股公司	海外轉投資事業之控股公司	無
上海達航	PCB 成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣及維修保養	業務據點	無
東莞達程	印刷電路板設備維修保養及零件販售	業務據點	無
日本大船	設備、零件買賣及維修之業務	研發中心及雷射機台製造	無

集團企業名稱	主要營業或主要產品	集團定位及功能	有無相互競爭
鴻圻	一般投資業、不動產租賃業	一般投資業、不動產租賃業	無
鴻洋	一般投資業。	一般投資業。	無
大企	投資控股公司。		無
大開	不動產租賃業。		無
大科	投資業務及不動產租賃業。		無
大船國際	投資控股公司。		無
OFUNA HOLDING(註 2)	投資控股公司。		無
ARIA(註 3)	投資控股公司。		無
ARRIS	投資控股公司。		無
達航工業(香港)	投資控股公司。		無
大船電子(上海)	不動產租賃業。		無
達航電子設備(上海)	不動產租賃業。		無

資料來源：該公司提供

註 1：ALPHA 已於 110 年 4 月 19 日完成清算。

註 2：OFUNA HOLDING 已於 110 年 3 月 29 日註銷。

註 3：ARIA 已於 110 年 5 月 3 日註銷。

(1)China Expo及ALPHA

China Expo 及 ALPHA 分別為該公司 100%轉投資公司，主要營業項目為國際投資，僅為投資控股功能，與該公司業務無相互競爭之情形。

(2)MEGA

為該公司透過 China Expo100%持有之轉投資公司，主要營業項目為國際投資，僅為投資控股功能，與該公司業務無相互競爭之情形。

(3)上海達航

上海達航係為該公司透過 MEGA 持有 100%轉投資之孫公司，主要營業項目為 PCB 成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣及維修保養，主要負責該集團 PCB 鑽孔機於中國大陸之產銷業務，上海達航由該公司主導其經營決策方向，彼此並非業務競爭關係，為業務營運範圍之延伸，與該公司業務無相互競爭之情形。

(4)東莞達程

東莞達程係為該公司透過 China Expo 持有 49.77%以及透過上海達航持有 50.23%轉投資之孫公司，主要營業項目為印刷電路板整廠機械設備製造加工買

賣，主要負責該集團 PCB 鑽孔機於中國大陸華南地區之產銷業務，東莞達程由該公司主導其經營決策方向，彼此並非業務競爭關係，為業務營運範圍之延伸，與該公司業務無相互競爭之情形。

(5)日本大船

日本大船為該公司持股 100%之轉投資公司，主要營業項目為設備、零件買賣、維修及研發之業務，主要負責該集團的研發及雷射機台製造業務，日本大船由該公司主導其經營決策方向，彼此並非業務競爭關係，與該公司業務無相互競爭之情形。

(6)鴻洋

主要營業項目為一般投資業，鴻圻主要營業項目為一般投資業及不動產租賃業，前述兩家公司皆與該公司業務無相互競爭之情形。

(7)大企

最近兩年度並無營業收入，目前為投資控股功能，與該公司業務無相互競爭之情形。

(8)大開及其子公司大船電子(上海)、達航電子設備(上海)

主要營業項目為不動產租賃業務；大科為投資業務及不動產租賃；子公司大船國際、OFUNA HOLDING、ARIA、ARRIS 及達航工業(香港)則為投資控股公司，大開及其子公司皆與該公司業務無相互競爭之情形。

綜上所述，該公司與同屬集團企業公司之主要業務，尚無相互競爭之情事，且具獨立行銷之能力。

2.申請公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過

該公司針對集團企業、特定公司及關係人之業務及財務往來已訂定「與關係企業及關係人間財務業務往來相關作業程序」之具體書面制度，並經 106 年 1 月 17 日董事會通過。另外增訂「關係人交易管理辦法」、「內部管理循環-關係人交易管理」及「關係人交易帳務管理辦法」等內控制度辦法，以規範集團企業公司間之財務及業務間往來相關作業程序。另該公司與同屬集團企業公司已出具與集團企業間不論有無財務業務往來均無非常規交易之聲明書。

3.其財務業務狀況及前述之作業辦法與其他同業比較應無重大異常現象

經查閱該公司之帳冊與會計師出具之審查報告，各項交易已依內控制度作業執行，且比較上述書面作業辦法與其他同業公司所訂之相關辦法，尚無重大異常之情形。

4. 申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自集團企業公司之進貨金額不超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，不在此限。

經查閱該公司 109 年度及 110 年第三季度經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司 109 年度及 110 年前三季度進貨金額來自集團企業公司分別為 8.87% 及 6.08%，故該公司申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自集團企業公司之進貨金額不超過百分之七十。

5. 申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自集團企業公司之營業收入或營業利益金額不超過百分之五十；或利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額不超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策、或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，不在此限。：

經查閱該公司 109 年度及 110 年第三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，該公司來自子公司之營業收入已於編製合併財務報表時全數沖銷，此外來自非屬子公司集團企業公司之營業收入為子公司日本大船受大科之東京支店委託管理日本房地產業務所收取之勞務收入，108 年度、109 年度及 110 年前三季管理收入僅有 851 千元、831 千元及 583 千元，占該公司 108 年度及 109 年度合併營業收入分別為 0.07% 及 0.08%，後自 110 年起重分類至營業外收支-其他收入，另該公司並無利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入之情事，故該公司符合此款之標準。

綜上所述，該公司與其集團企業尚符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」。

(三)申請時屬於母子公司關係，母公司申請其股票上櫃者，依據櫃買中心審查準則有關規定辦理；子公司申請其股票上櫃，雖合於同準則有關規定，但不能符合規定情事，櫃買中心認為不宜上櫃者，應不同意其股票上櫃：

該公司非屬母子公司關係之子公司申請股票上櫃，故不適用本項規定。

二、評估本國申請公司是否符合建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定

達航科技非屬建設業、資訊軟體業、投資控股公司、金融控股公司或參與公共建設之民間機構，故不適用。

三、評估外國申請公司是否符合「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第十六條至第十九條有關集團企業及第二十條至第二十三條有關投資控股公司之規定

達航科技非屬外國申請公司申請股票上櫃，故不適用本項評估規定。

四、評估外國申請公司是否符合本中心「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第四條第五項有關建設公司申請股票上櫃之規定

達航科技非屬外國申請公司申請股票上櫃，故不適用本項評估規定。

拾參、以投資控股公司申請股票上櫃者，推薦承銷商亦應就其被控股公司依應行記載事項要點第五條、第七條第四項、第十條及第十一條規定逐項評估

該公司非以投資控股公司身份申請股票上櫃買賣，故不適用本項評估。

拾肆、本國上櫃(市)公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣者，推薦承銷商應評估本國上櫃(市)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施

該公司非以上櫃（市）公司之海外子公司身份申請其股票為櫃檯買賣者，故不適用此項評估。

拾伍、自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，推薦證券商對上列各項目應加以更新說明與評估

該公司自本推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，尚無重大期後事項，故不適用本項評估。

拾陸、其他揭露事項

該公司自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，尚無發生重大期後事項。

附件一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」
第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之推薦證券商審查意見

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
一、遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。 (一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。	最近三年度及 110 年截至目前為止，該公司轉投資公司符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心推薦證券商辦理股票申請上櫃案之評估查核程序」第 7 條及「會計師查核簽證財務報表規則」第 2 條之 1 第 2 項規定之重要子公司為上海達航實業有限公司(原名為：廣東達航電子有限公司，下稱上海達航)、CHINA EXPO LTD. (下稱 CHINA EXPO)及 MEGA TRADER INTERNATIONAL LIMITED(下稱 MEGA)。其中 CHINA EXPO 及 MEGA 之功能定位為投資控股，該等公司並未在其註冊地召開董事會或於當地雇用員工，其帳務處理皆由該公司執行，故 CHINA EXPO 及 MEGA 皆未有在註冊地國從事實際營運活動之情事；上海達航則係負責中國地區之產銷基地，故該公司有實質營運活動之重要子公司為上海達航，以下依規定對其進行相關評估。 (一)經查閱該公司最近三年度及 110 年截至目前為止之董事會、股東會會議紀錄、經會計師查核簽證及核閱之財務報告、勞務費用與營業外支出明細分類帳、查詢法學檢索系統及公司之收發文紀錄，並取得翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及該公司所出具之聲明書，該公司最近三年度及 110 年截至目前為止有下述 1.之訴訟事件或非訟事件，惟經評估其結果尚不足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。 經查閱重要子公司上海達航最近三年度及 110 年截至目前為止之現行有效重要契約內容、經會計師查核簽證之財務報告、查閱勞務費用與營業外支出等明細帳資料及上海達航出具之聲明書，並參酌北京天元律師事務所曾嘉律師所出具之法律意見書，上海達航最近三年度及 110 年截至目前為止有下述 2.及 3.之訴訟事件或非訟事件，惟經評估其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。 茲將該公司及重要子公司上海達航之訴訟及非訟案件說明如下：	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	1.前員工陳君於 108 年有詐欺行為，該公司予以資遣，暨違反勞動基準法勞工退休金條例、全民健康保險法 (1)該公司與前員工陳君之訴訟案 該公司前員工陳君於任職期間有未實際使用機票卻進行申報核銷之情況，考量該員未來發展，該公司不依法逕自解雇該員，而是依勞動基準法第 11 條第 4 款資遣，給付資遣費及預告工資，並取得該員承諾書，承諾勞動關係已一次性終結，不得提出勞資關係爭議、調節、申訴，或其他任何途徑進行索賠。惟陳君於離職後違反其承諾內容，陸續向臺中市政府勞工局(以下簡稱勞工局)、勞動部勞工保險局(以下簡稱勞保局)及衛生福利部中央健康保險署(以下簡稱健保署)等主管機關提出勞動檢舉，該公司因而委由律師提出告訴，依法追究其所涉不法行為之責任，該員因詐欺案件被臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴。最終該公司與前員工陳君於 110 年 3 月 22 日於臺灣臺中地方法院臺中簡易庭調解成立，調解結果為陳君給付該公司新臺幣 20 萬元，雙方並承諾自調解成立之日起，不再向他造為任何請求或主張(包括但不限於民、刑事追訴)，如有違反，陳君願支付 50 萬元之違約金，該公司願支付 70 萬元之違約金。而陳君之詐欺案件，經檢察官提起公訴，被告自白犯罪，臺灣臺中地方法院合議庭已裁定簡易判決：陳君詐欺得利罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑二年。綜上所述，此案應屬已結案。經查核相關憑證，陳君已如實支付 20 萬元，經評估該案對該公司財務業務並無重大不利影響。 (2)未依資遣費給與標準給付勞工資遣費 勞工局於 109 年 2 月進行勞動檢查，認為陳君派駐在韓國分公司期間所給付工資，屬於調派期間工資，故陳君在韓國所領取的薪資應要納入平均薪資計算資遣費，惟該名員工離職時，該公司漏未將其派駐在韓國期間所領的薪資納入資遣費計算，該公司於 109 年 5 月 28 日接獲臺中市政府來函，說明該公				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	司未依資遣費給與標準給付勞工資遣費，違反勞工退休金條例第 12 條第 1 項規定，經勞工局實施勞動條件檢查屬實，爰依同例第 45 條之 1 規定，對該公司處以新臺幣 300 千元罰鍰，該公司已於 109 年 6 月 19 日繳納罰鍰並且加強內部員工訓練，避免相類似案件再發生，應可認為已改善完畢。 (3)違反勞動基準法勞工退休金條例、全民健康保險法 勞保局認為陳君於 107 年 5 月至 7 月、107 年 11 月至 108 年 1 月薪資已有變動、該公司未按規定申報調整陳君勞工退休金月提繳工資，勞保局於 109 年 8 月依審查結果認定該公司違反勞工退休金條例，依據該條例第 15 條第 2 項對該公司處以罰鍰新臺幣 5 千元，另因該公司未依規定調整，勞保局逕予更正及調整，短計之勞工退休金已於 108 年 12 月份勞工退休金內補收，該公司因不服勞保局所認定未按規定申報調整陳君勞工退休金月提繳工資，而逕予調整陳君上開期間之勞工退休金月提繳工資，補收短計之勞工退休金及所發生之罰鍰，該公司於 109 年 9 月對勞保局提起訴願，110 年 5 月提起行政訴訟，臺灣臺北地方法院於 110 年 12 月 21 日以 110 年度簡字第 137 號行政訴訟判決，裁定陳君於韓國分公司工作期間，係同時受僱於該公司及韓國分公司，工資分按各自勞動契約給付，且韓國分公司於該期間為陳君投保國民年金、健康保險、健康(護理)保險、僱用保險等 4 種保險，陳君亦享有韓國分公司各項福利，應認陳君於前揭期間每月自韓國分公司領取之系爭薪資，非屬於勞基法第 2 條第 3 款所稱之工資，故判決該公司之訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由勞保局負擔。 另健保署依據查得之勞工退休金月提繳工資資料，逕予調整陳君投保金額，該公司因未依規定於期限內調整，違反全民健康保險法，依據該法第 21 條第 2 項、第 89 條處以罰鍰新臺幣 138 千元，該公司已於 109 年 10 月 7 日先繳納上開罰鍰並對該行政處分提出覆議，且衛生福利部已於 110 年 1 月 14 日				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	來函表示，撤銷上開罰鍰新臺幣 138 千元，並將該罰鍰返還予該公司，該公司並於 110 年 2 月 9 日收到罰鍰核退支票。該公司不服健保署就陳君 107 年 5 月至 8 月、107 年 9 月至 108 年 7 月健保投保金額逕予調整，認為該公司未依勞工退休金月提繳工資調整健保投保金額，於 110 年 2 月對健保署提起訴願，110 年 6 月提起行政訴訟，業經行政法院裁示後，健保署已於 111 年 02 月 11 日撤銷調整陳君投保金額之處分案。 2. 客戶未如期支付貨款之訴訟案 (1) 銅陵市超遠科技有限公司(以下簡稱超遠科技)自 107 年 3 月至 108 年 3 月委託上海達航進行主軸維修並向上海達航採購零配件，因超遠科技遲延付款，上海達航起訴要求超遠科技支付欠款人民幣 67,700 元及利息，經法院判超遠科技於判決生效後十日內支付上海達航人民幣 67,700 元及利息，惟超遠科技 108 年 12 月已進入破產程序，故該款項於 109 年 6 月認列壞帳損失。 (2) 107 年 02 月上海達航與江蘇聯坤電子科技有限公司(以下簡稱江蘇聯坤)簽訂《設備維修保養與 SPINDLE 維修合約》，後因江蘇聯坤未支付貨款，上海達航起訴至法院要求江蘇聯坤支付款項人民幣 573,712.23 元及逾期利息，經法院一審判決江蘇聯坤於判決生效後十日內向上海達航支付款項人民幣 472,187.15 元及逾期利息損失。經查該筆款項已於 108 年 12 月收回。 (3) 109 年 3 月 6 日，上海達航因悅虎電路（蘇州）有限公司(以下簡稱蘇州悅虎)未支付貨款，上海達航向法院提起訴訟，要求蘇州悅虎支付合同款項總計人民幣 535,836.97 元及利息，蘇州悅虎款項已支付，上海達航已於 109 年 3 月 12 日提出撤訴。 3. 因上海達航東莞分公司(以下簡稱東莞分公司)的經營方針與和業務發生重大的調整和變化(曾用名:廣東達航電子有限公司東莞分公司)，故與東莞分公司原有員工解除勞動關				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	係，共計 15 名員工向廣東省東莞市人民法院提出訴訟請求，請求支付二倍或不足之經濟補償金，賠償金額共計人民幣 790 千元，該公司業已全數支付。 上述該公司及重要子公司上海達航之訴訟案件已完結，其結果並無足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。				
(二)發行該有價證券之公司遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容，或退票，其結果足使公司財務狀況有顯著重大改變而影響市場秩序或損害公益之虞者。	(二) 經查閱該公司 107~109 年度及 110 年截至目前為止之董事會、股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、營利事業所得稅結算申報書及核定通知書、營業外收支明細帳、收發文紀錄、簽訂之存續有效重要契約、台灣票據交換所出具之第一類票據信用資料查覆單及查詢聯合徵信中心信用報告等，並取得由翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之法律意見書及該公司出具之聲明書，該公司並無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容，或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。 經檢視重要子公司上海達航 107~109 年度及 110 年截至目前為止經會計師查核簽證之財務報告、目前存續之重要合約、取具上海達航出具之聲明書，並參酌北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，並未發現上海達航遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容，或退票，其結果足使該公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。				
(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。	經查閱該公司 107~109 年度及 110 年截至目前為止之董事會、股東會會議紀錄、查詢網際網路或法學檢索系統，並取得翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及該公司出具之聲明書，該公司曾有下述違反法令規章之情事，惟尚不足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。 經檢視重要子公司上海達航出具之聲明書，並參閱北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，並未發現上海達航有虛偽不實或違法情事，足以影響該公司證券價格，而及於市場秩序或損害公				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	益之虞者。 茲將該公司曾有違反相關法令規章說明如下： 1.臺中市政府稅務局沙鹿分局 108 年 7 月 10 日來函表示，該公司位於臺中市大甲區南里工一路 00 號房屋屋前、屋後及屋側有增建情事，要求該公司依據房屋稅條例第 7 條規定向臺中市政府地方稅務局申報房屋增建稅籍及使用情形。經參閱該公司委請之建築師出具之意見，渠等表示：「上開違建，截至目前暫無收到立即拆除之通知，若未來被縣市主管機關要求拆除，預計拆除需耗費 10 天，拆除費用預估新臺幣 500 千元，惟該既存違建區域並未放置生財器具，若進行拆除，對達航科技之財務業務亦不至於造成重大不利之影響。」等語，故上開違建尚不致對該公司之財務、業務產生重大影響。 2.金融監督管理委員會 109 年 6 月 18 日來函表示，查該公司所訂資金貸與他人管理辦法核有未符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』（下稱處理準則）情事如下： (1)第 5 條雖已訂資金貸與總額及個別對象之限額，惟未分就業務往來、短期融通資金訂定總額及個別對象之限額，違反處理準則第 9 條第 1 項第 3 款規定。 (2)第 6 條資金貸與條件規定：『一、每筆資金貸款與期間 以合約為準，原則上以一年為限，借款到期得經董事會核定予以展期。』，違反處理準則第 3 條第 2 款規定。 (3)該公司之子公司 CHINA EXPO 於 106 年 10 月 24 日經董事會通過短期融通資金貸與該公司，貸放日期為 107 年 5 月 16 日，截至發函日止尚未收回其貸與資金，違反子公司 CHINA EXPO 所訂資金貸與他人管理辦法第 4.3 條『短期融通：所稱短期，係指一年，但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。』之規定情事，該公司核有未依處理準則第 13 條規定辦理之情事。 (4)另查該公司之子公司 CHINA EXPO 於 106 年 10 月 24 日經董事會通過短期融通資金貸與 ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LTD.(下稱				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	ALPHA)，並授權董事會分次撥補或循環動用，惟貸放日期 107 年 12 月 16 日，已逾董事會授權董事長於一年之期間分次撥貸或循環動用，違反子公司 CHINA EXPO 所訂資金貸與他人管理辦法第 5.3.3 條規定，該公司核有未符合處理準則第 13 條規定。 經檢視該公司董事會議事錄，該公司已於 109 年 7 月 24 日董事會決議通過修訂資金貸與他人管理辦法，並經 109 年 8 月 31 日股東臨時會通過，且於 109 年 7 月 24 日董事會報告事項中報告此案之缺失及改善計畫。另分別檢視截至 109 年底、截至 110 年 6 月底資金貸與備查簿，CHINA EXPO 對 ALPHA 及對該公司之資金貸與餘額已為零，後續並無收到此案之裁罰或其他建議事項，應已改善完成。 3.金融監督管理委員會 109 年 7 月 10 日來函表示，該公司 108 年度未依董事會通過之稽核計畫，執行『資通安全檢查』乙項年度必要稽核項目，核有違反公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 13 條第 2 項第 6 款規定；另查該公司申報之 109 年度稽核計畫未按月編列年度應稽核項目，核有違反公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 13 條第 1 項規定。該公司業於 109 年 7 月 20 日回覆金管會證期局，提交改善計畫。 經檢視該公司董事會議紀錄，該公司已於 109 年 8 月 10 日董事會中報告稽核計畫修訂事宜，並取得 108 年度「資通安全檢查」稽核報告，確認已於 109 年 8 月 6 日執行完畢，後續並無收到此案之裁罰或其他建議事項，應已改善完成。 4.違反勞動基準法勞工退休金條例、全民健康保險法說明請詳一、(一) 前員工陳君於 108 年有詐欺行為，該公司予以資遣，暨違反勞動基準法勞工退休金條例、全民健康保險法之說明。 該公司已就前述裁罰事件，已如數繳納罰鍰完竣，並加強員工教育訓練已改善完成，上述事件對該公司之財務業務尚無重大影響。 綜上所述，該公司及重要子公司上海達航應無違反證券交易法第 156 條第 1 項第 1 款至第 3 款所				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	列之情事。				
二、財務或業務未能與他人獨立劃分者。 (一)資金來源過度集中於非金融機構者。 (二)申請公司與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。 (三)與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分者。但母子公司間共用貸款額度，不在此限。 (四)申請上櫃會計年度或最近一會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策、或其他合理原因所造成者，不在此限。 (五)申請上櫃會計年度或最近一會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十；或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政	(一)經參閱該公司109年度及110年經會計師查核簽證之財務報告及其重要子公司上海達航相關會計科目明細帳及借款合同，尚未發現該公司及其重要子公司上海達航資金來源過度集中於非金融機構之情事。 (二)經檢視該公司及其重要子公司上海達航之重要契約彙總表及抽核重大契約，並參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，尚無發現該公司及其重要子公司上海達航有與他人簽訂重要契約而對該公司及其重要子公司上海達航營運有重大限制或顯不合理之情事，致有不利影響之虞者。 (三)經參閱該公司109年度及110年經會計師查核簽證之財務報告及檢視該公司及重要子公司上海達航之董事會議紀錄及借款契約，並詢問該公司會計主管並取得該公司出具之聲明書，該公司及重要子公司上海達航之借款並無與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。 (四)經查閱該公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及重要子公司上海達航109年度及110年度進貨金額均無來自非屬集團企業公司之關係人。故無申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十之規定。 (五)經查閱該公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及重要子公司上海達航109年度及110年度並無來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益。故無違反申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十；或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十之規定。 綜上所述，該公司及重要子公司上海達航應無財務或業務未能與他人獨立劃分者之情事。	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
府政策、或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，不在此限。					
三、發生重大勞資糾紛或重大環境污染之情事，尚未改善者。 (一)所稱重大勞資糾紛，係指有下列情事之一，且足以影響公司財務業務正常營運： 1.發生重大勞資爭議者。 2.未依法提撥職工福利金組織職工福利委員會或未依勞動基準法提撥勞工退休準備金及勞工退休金條例提繳勞工退休金者。 3.最近三年內曾因安全衛生設施不良而發生重大職業災害者；或違反勞工安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未	(一)重大勞資糾紛： 1.經檢視 107~109 年度及 110 截至目前為止該公司與主管機關往來函文、經會計師查核簽證之財務報告、稅簽報告、其他營業外支出明細、勞資會議紀錄及訪談該公司管理當局，且函詢勞動部、桃園市政府勞動局及臺中市政府勞工局，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，該公司及其重要子公司上海達航 107~109 年度及 110 年截至目前為止，除不宜上櫃條款第一款所列該公司及重要子公司上海達航訴訟、非訟事件所列 1.及 3.勞資爭議事件外，該公司尚無發生重大勞資爭議。 2.經檢視該公司職工福利委員會之職工福利機構證、組織章程及臺北市政府勞動局函文，並抽核職工福利金提撥情形，該公司已依法組織職工福利委員會，並依章程規定比率提撥職工福利金。該公司已依勞動基準法於 82 年 2 月成立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥並儲存於臺灣銀行退休準備金專戶；另適用勞工退休金條例之員工，該公司已依法每月按員工薪資之 6%，提繳勞工退休金，經抽核相關憑證，尚無發現重大異常之情形。 經抽核重要子公司上海達航繳納五險一金相關憑證及取具合規證明，並參酌天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，上海達航並無未依法提撥養老保險之情事。 3.經檢視 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文及其他營業外支出明細、訪談管理當局，且函詢勞動部、桃園市政府勞動局及臺中市政府勞工局，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，該公司及其重要子公司上海達航最近三年內並未發生因安全衛生設施	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
檢查合格者。但經申請由檢查機構複查合格者，不在此限。	不良而發生重大職業災害，或違反職業安全衛生法被處以部分或全部停工之情事；另有關設置危險性機械、設備未檢查合格之部分，經檢視該公司收發文明細，該公司曾於 110 年 5 月 6 日收到社團法人中華產業機械設備協會來函指出該公司之固定式起重機經該會派員定期檢查結果以「未備妥」判定，須整備妥另案申請複檢，惟該公司已於 110 年 7 月 2 日複檢合格，截至目前為止，已無此情形。				
4.積欠勞工保險保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納者。	4.經抽核該公司勞保費及健保費繳納情形，並函詢勞動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署，且參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司尚無積欠勞保費、健保費及滯納金，而受主管機關依法追訴仍未繳納之情事。 經抽核重要子公司上海達航繳納社會保險及住房公積金相關表單，及取具當地五險一金合規證明，並參酌會計師核算五險一金工作底稿以及北京市天元律師事務所曾嘉律師之中國法律意見書，除兩位台籍員工未繳納社會保險金外，尚未發現有違反相關勞動或住房公積金方面之法律、法規及勞動政策。另上海達航之兩位台籍員工未繳納社會保險金一事，經會計師 109 年度設算應估列金額人民幣 152 千元，因金額微小故未入帳，上海達航亦對該兩名台籍員工於當地進行團險投保，以保障員工於當地之工作及生活之照顧，經檢視北京市天元律師事務所曾嘉律師之中國法律意見書表示，尚無重大影響。				
(二)重大環境污染：係指公司或其事業活動相關場廠有下列情事之一 1.依法令應取得污染相關設置、操作或排放許可證而未取得者。	(二) 重大環境污染 1.經詢問該公司管理當局，並參閱該公司 107~109 年度及 110 年截至目前為止之與主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，該公司產品製程中並無有關空氣污染之製造程序，製程中產生之廢水係由經濟部工業局大甲幼獅工業區協助處理排放，而製程中產生之廢棄物為廢油混合物、廢潤滑油及含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑等，該公司已委託合格廠商代為處理，因此該公司製程無須設置污染防治設備，故該公司並無依法令應取得污染相關設施、操作或排放				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	許可證而未取得之情事。另該公司之重要子公司上海達航分別於上海及東莞設有分公司，東莞分公司係負責維修業務，僅設有一間辦公室，並無產生空氣或廢水等污染之製程；上海分公司係提供雷射鑽孔代工服務，亦無產生空氣或廢水等污染之製程，製程中產生之廢棄物為雷射機粉塵，工廠內設有粉塵收集器，收集後委由合格廠商代為處理。因此上海達航並無依法令應取得污染相關設施、操作或排放許可證而未取得之情事。				
2.曾因環境污染，於申請上櫃會計年度或最近二會計年度，各該年度經環保機關按日連續處罰或經限期改善，而未完成改善者。	2.經檢視 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文、經會計師查核簽證之財務報告、稅簽報告、其他營業外支出明細及詢問該公司管理當局，且函詢該公司所屬環保機關，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，並未發現該公司及其重要子公司上海達航曾因環境污染而經環保機關按日連續處罰或經限期改善，而未完成改善之情事。				
3.有公害糾紛事件而無有效污染防治設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄者	3.經詢問該公司管理當局，並參閱 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，並未發現該公司及其重要子公司上海達航有公害糾紛事件而無有效污染防治設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修技術之情事。				
4.有環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證者。	4.經詢問該公司管理當局，並參閱 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，並未發現該公司及其重要子公司上海達航有環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證之情事。				
5.廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病	5.經詢問該公司管理當局，並參閱 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書以及北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，並未發現該公司及其重要子公司上海達航有廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
者。	處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病之情事。				
6.經中央主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址者。	6.經詢問該公司管理當局，並參閱 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書與北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，以及查詢行政院環境保護署土壤及地下水汙染整治網，並未發現該公司及其重要子公司上海達航有經中央主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。				
7.有製造、加工、或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定者。	7.經詢問該公司管理當局，並參閱 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司之與主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書與北京市天元律師事務所曾嘉律師出具之中國法律意見書，以及查詢司法院法學資料檢索系統，並未發現該公司及其重要子公司上海達航有製造、加工、或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定之情事。				
(三)所謂「尚未改善者」：係指在本中心受理其股票上櫃申請案之日以後仍有上開情事者。	綜上所述，該公司及其重要子公司上海達航尚無發生有足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或重大環境污染之情事。				
(四)但前（二）之 2. 之重大環境污染情事，以其已委託經環保機關認可之檢測機構，進行檢測及提出檢測結果報告書，並據以向環保機關申報污染改善完成報告書，於申報後三個月內未再續遭處罰者，作為是否改善之認定標準。					

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
四、有重大非常規交易迄申請時尚未改善者。		✓			
(一)進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。	(一)經取得該公司 107~109 年度及 110 年截至目前為止經會計師查核簽證之財務報告及明細帳，並抽核該公司及其重要子公司上海達航與關係人、前十大進銷貨廠商客戶之進銷貨交易及收付情形，尚未發現該公司有進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理之情事。				
(二)依證券主管機關訂頒之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，未能合理證明其內部決定過程之合法性，或其交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形之合理性者。	(二)該公司及其重要子公司上海達航已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」(下稱取處準則)訂定「取得或處分資產處理程序」(下稱取處程序)，業經 106 年 1 月 17 日董事會決議通過，並提請 107 年 3 月 27 日股東常會同意。經檢視 107 年度迄今之相關交易資料，該公司及其重要子公司上海達航，以及該公司之子公司日本大船及 ALPHA 之重大取得或處分資產之交易行為說明如下： 1.出售股權 該公司於 108 年 9 月 27 日董事會決議通過以人民幣 48,500 千元(折合新臺幣 210,349 千元)價格，將轉投資事業大船煙台公司之股權出售予非關係人-煙台宏源建設工程有限公司，相關價格係參酌富博聯合會計師事務所鄭文榮會計師辦理出售股權交易價格合理性評估意見書(評估合理價格區間為人民幣 46,075 千元至 50,925 千元，折合新臺幣 199,832 千元至 220,867 千元)。經評估其內部決策過程之合法性、交易之必要性，或有關報表揭露之充分性，暨價格與款項之收付，尚無重大異常或不合理之情事。 該公司業已於期限內辦理資訊公告或申報事宜，尚符合取處準則及該公司之取處程序之規定辦理，且其內部決策過程、交易之必要性或其報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形，尚無重大異常之情事。				
	2.取得供營業用固定資產 該公司於 108 年 1 月 22 日、108 年 12 月 24 日及 109 年 3 月 24 日、109 年 12 月 21 日之董事會通過向子公司日本大船購置供營業使用設備之預算案，惟前述議案未依取處準則之時限內辦理資訊公告，而係於 110 年 2 月 29 日一併辦理相關公告，並於 110 年 3 月 15 日向董事會提出向關係人取得或處分資產之目的、必要性及預計效益，以及選定關係				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	人為交易對象之原因與關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項，並就預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表評估交易之必要性及資金運用之合理性之追認案，另，該公司於 110 年 12 月 20 日通過固定資產預算案，預計向子公司日本大船購入供營業使用之資產，業依取處準則辦理並如期公告之。 3.取得使用權資產 該公司於 109 年與關係人大船科技(股)公司之東京分公司、大船企業(上海)有限公司及大船企業(東莞)有限公司簽訂承租供營業使用之廠房，租賃期間約 3-5 年，已符合取得或處分資產作業程序之規定，惟該公司未如期辦理代子公司公告事宜，故於 110 年 6 月 21 日業經該公司審議委員會通過並經董事會追認並完成公告作業程序，經檢視相關文件，尚無發重大異常之情事。 綜上所述，經檢視該公司 107 年度迄今之相關交易資料，其取得或處分資產之交易行為，尚符合上述作業辦法之執行，且經評估內部決策過程之合法性、交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性暨價格與款項之收付情事，尚無發現重大異常或不合理之情事，惟該公司向關係人取得供營業用使用資產、向關係人取得使用權資產交易，已達應辦理公告事宜，該公司雖未於公告期限內辦理公告，惟業已分別於 110 年 2 月 26 日及 110 年 6 月 21 日完成補辦理公告事宜，另該公司針對資訊公告作業已設置專人負責辦理因應。				
(三)以簽約日為計算基準，其最近五年內買賣不動產有左列情形之一者： 1.向關係人購買不動產，有違反證券主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之涉有非常規交易之認定標準者。 2.出售不動產予關係人，其按證券主管機關所訂頒「公開發行公司取得或	(三)經查閱該公司最近五年度及 110 年截至最近期止之董事會議事錄、經會計師查核簽證及核閱之財務報告，並經查閱該公司固定資產明細帳等相關資料，該公司及其重要子公司上海達航最近五年內並無向關係人買賣不動產之情事，且該公司及其重要子公司上海達航最近五個會計年度末一季並無銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年營業收入百分之二十之情事。 經核閱該公司最近五年度及 110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告、公開說明書及財產目錄，尚無其他資料顯示該公司向非關係人買賣不動產有明顯異於一般交易而無適當理由之情事。				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
處分資產處理準則」之買賣不動產涉有非常規交易之認定標準所列方法，設算或評估不動產成本結果，均較實際交易價格為高者。 3.向關係人買賣不動產，收付款條件明顯異於一般交易，而未有適當理由者。 4.申請公司所買賣土地與關係人於相近時期買賣鄰近土地，價格有明顯差異而未有適當理由者。 5.最近五個會計年度末一季銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年度營業收入百分之二十，而未有適當理由者。 6.向關係人買賣不動產，有其他資料顯示買賣不動產交易明顯異於一般交易而無適當理由者。 對於最近五年內其交易對象之前手或前前手具有關係人身份時，亦應比照關係人買賣不動產之規定適用之。但買賣不動產之交易，其交易對象簽約取得時間，至本次交易簽約日止超過五年者，可免適用證券主管機關訂頒之涉有非常規交易認定標準。 (四)最近一年內非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，而仍有	(四)經查閱該公司 109 年度及 110 年度截至目前為止經會計師查核簽證之財務報告及相關帳冊資料，109 年度及 110 年度截至目前子公司 CHINA EXPO 及東莞達程有分別實際資金貸予該公司及重要子公司上海達				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
大量資金貸與他人者。前段所稱「大量」係指貸放年度之貸放資金最高金額達貸放時資本額之百分之十或一千萬元以上者。 (五)所稱「尚未改善」，其改善之認定係指符合左列情事之一者： 1.因非常規交易而致申請公司以外之人獲得利益者，該獲得利益之人已將所得利益歸還應得之人者。 2.因非常規交易而致申請公司獲得利益者，將所獲利益予以扣除設算後，其獲利能力仍符合上櫃規定條件者。 3.該非常規交易行為經檢調或司法單位確定無犯罪情事。 4.該非常規交易已恢復原狀者。 (六)但公營事業因配合政府政策或已依「政府採購法」辦理者，不適用本款之規定。	航之情形，前述資金貸與係營運所需之融通資金，已依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及相關作業程序規定辦理，除此之外，該公司及其上海達航最近一年內並無非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，而仍有大量資金貸與他人之情事。 (五)該公司及其重要子公司上海達航，尚無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。。 (六)不適用。				
五、申請上櫃會計年度已辦理及辦理中之增資發行新股併入最近一年度財務報告所列示股本計算，其獲利能力不符合上櫃規定條件者。 (一)「申請上櫃會計年度」：係指該股票申請上櫃業經本中心收文受理以迄董事會決	經參閱該公司 109 年度及申請上櫃年度截至目前止之董事會議事錄、股東會議事錄、變更登記表及與主管機關往來函文，該公司目前實收資本額為 430,133 千元，另於辦理公開承銷前尚有最大得執行之員工認股權憑證	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
議通過之審查期間所屬之會計年度而言。 (二)「已辦理與辦理中」：所謂「已辦理」，係指已取得經濟部核准變更登記之核准函，並以核准函所載日期為準。所謂「辦理中」，係指已向證券管理機關申請且經受理，而尚未取得變更後之核准函而言。且為辦理上櫃前之公開銷售，而辦理之現金增資案亦屬之。 (三)「增資發行新股」：係泛指所有現金增資、合併增資、盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股而言。 (四)「其獲利能力不符合上櫃規定條件」：係指其獲利能力經逆算後不符合股票之上櫃規定條件。	531 單位(得執行取得股數 531 千股)，預計將全數執行完畢，故該公司辦理公開承銷前實收資本額合計為 435,443 千元。另為配合上櫃前公開承銷，該公司預計辦理現金增資 58,059 千元，增資後實收資本額為 493,502 千元，該公司 109 年度稅前淨利 110,038 千元，占設算後實收資本額之比率為 22.29%，達 4%以上，且 109 年無累積虧損，故該公司設算後之獲利能力仍符合上櫃規定條件。				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
六、未依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，或內部控制、內部稽核及書面會計制度未經健全建立且有效執行，其情節重大者。審查認定標準： (一)所稱「未依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告」係指有下列情事之一者： 1.財務報告未依有關法令及一般公認會計原則編製，經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書者，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達者。 2.財務報告經主管機關函示應改進而未改進者。 3.簽證會計師查核工作底稿，經本中心調閱後，發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達者。 (二)所稱「內部控制、內部稽核及書面會計制度未經健全建立且有效執行」係指有左列情事之一者： 1.在申請上櫃年度未依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則規定，建立健全書面會計制度。	(一)是否依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告之評估如下： 1.經檢視該公司 107~109 年度及 110 年截至最近期經會計師查核簽證之財務報告，均依照有關法令及一般公認會計原則編製，且未有經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告允當表達之情事。 經檢視該公司 107~109 年度及 110 年截至最近期經會計師查核簽證之財務報告、參閱該公司與主管機關往來函文，並詢問該公司管理當局，尚無發現該公司財務報告有經主管機關函示應改進而未改進之情事。 經檢視 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文、借閱該公司簽證會計師之工作底稿及詢問該公司簽證會計師事務所，並無發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達之情事。 (二)內部控制、內部稽核及書面會計制度是否未經健全建立且有效執行之評估如下： 經參閱該公司之內部控制制度、內部稽核制度及書面會計制度，該公司已依「證券發行人財務報告編製準則」建立健全書面會計制度，並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，建立內部控制制度及內部稽核制度，並經董事會決議通過。 經檢視 107~109 年度及 110 年截至目前為止該公司與主管機關往來函文，該公司針對主管機關有關內部控制缺失建議事項來函，均已改善完成。另該公司業依規定委請會計師就其內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，並經勤業眾信聯合會計師	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
2.經本中心實地查核，發現未依內部控制、內部稽核及書面會計制度合理運作者。	事務所楊清鎮會計師及龔則立會計師於 110 年 12 月 2 日出具無保留意見之內部控制制度專案審查報告書(審查期間:109 年 10 月 1 日至 110 年 9 月 30 日)，故該公司內部控制及內部稽核制度之建立與執行應尚屬有效。 綜上所述，該公司業已依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，並建立健全之內部控制、內部稽核及書面會計制度，且應已合理運作及有效執行。				
七、公司或申請時之董事、監察人、總經理或實質負責人於最近三年內，有違反誠信原則之行為者。 (一)所謂「最近三年內」：係指該股票申請上櫃案經本中心收文受理之日起算之前三年內。 1.公司部份 (1)所開立所公告為拒絕往來戶，或之	1.公司部分 (1)經向財團法人金融聯合徵信中心查詢、經台灣票據交換所出具之第一類票據信用資料查覆單，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該公司及重要子公司上海達航最近三年內並無所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票之情事。	✓			
據交換因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄，未經達成本中心「證券商營業處所買賣價證券業務規則」第十二條第四					

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
項所列之補正程序並檢附相關書件證明者。					
(2)向金融機構貸款有逾期還款之情形者。	(2)經取具財團法人金融聯合徵信中心之綜合信用報告及該公司出具之聲明書，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該公司及重要子公司上海達航並無向金融機構貸款有逾期還款之情形。。				
(3)曾違反勞動基準法經判決有罪確定者。但最近一年內未受勞工主管機關罰鍰以上處分或法院刑事有罪判決者，不在此限。	(3)經取得該公司出具之聲明書及發函勞動主管機關，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該公司及重要子公司上海達航最近三年內尚無因違反勞動基準法經判決有罪確定之情事。				
(4)違反稅捐稽徵法經判決有罪確定者。	(4)經查閱該公司最近三年內與主管機關往來函文及翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，並取具無違章欠稅證明，該公司及重要子公司上海達航最近三年內並無欠稅或違反稅捐稽徵法經判決有罪確定之情事。				
(5)違反申請上櫃時所出具聲明書之聲明事項者。	(5)經取得該公司出具之聲明書，該公司及重要子公司上海達航已聲明最近三年內未有違反申請上櫃時所出具聲明書之聲明事項。				
(6)有其他重大虛偽不實或喪失公司債信情事，而有損害公司利益或股東權益或公眾利益。	(6)經取得該公司出具之聲明書及參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該公司及重要子公司上海達航最近三年內並無其他重大虛偽不實或喪失公司債信之行為，而致損害公司利益或股東權益或公眾利益之情事。				
2.董事、總經理或實質負責人部分	2.董事、總經理或實質負責人部分 該公司業依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會替代監察人職能。該公司之代表負責人(法定代理人)為董事長翁榮隨、總經理陳柏棋，另該公司並無公司法第8條第3項所列之非董事而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，故無實質負責人。重要子公司上海達航設有1席執行董事劉智鴻及1席監察人陳俊程，亦準用此款之評估				
(1)同前1.之(1)至(5)部分。但屬向金融機構貸款逾期還款者，倘逾期還款情節非屬重大或有合理事由者，不在此限。	(1)經取得該公司董事、總經理及重要子公司上海達航				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	董事、監察人出具之聲明書、向財團法人金融聯合徵信中心信用報告回覆書及臺灣票據交換所出具之第一類票據信用資料查覆單，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該等人員並無被列入拒絕往來戶或發生存款不足退票之情事。 經取得該公司董事、總經理及重要子公司上海達航董事、監察人出具之聲明書、向財團法人金融聯合徵信中心信用報告回覆書及台灣票據交換所出具之第一類票據信用資料查覆單，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該等人員並無逾期還款之情形。 經取得該公司董事、總經理及重要子公司上海達航董事、監察人出具之聲明書並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該等人員並無違反勞動基準法被判決有罪確定且最近一年內未受勞工主管機關罰鍰以上處分或法院刑事有罪判決之情事。 經取得國稅局及稅捐稽徵處出具之納稅義務人違章欠稅查復表，暨該公司董事、總經理及重要子公司上海達航董事、監察人出具之聲明書並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見，該等人員並無違反稅捐稽徵法經判決有罪確定之情事。 經取得該公司董事、總經理及重要子公司上海達航董事、監察人出具之聲明書並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見書，該等人員已聲明未有違反申請上櫃時所出具聲明書之聲明事項。				
(2)觸犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法所定之罪，或貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以	(2)經取得該公司董事、總經理及重要子公司上海達航董事、監察人出具之聲明書並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見，該等人員最近三年內並無觸犯公司法、銀行法、金融控股公司法、證券交易法、商業會計法等商事法所定之罪，或貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之情事。				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
上之刑者。 (3)有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為者。	(3)經取得該公司董事、總經理及重要子公司上海達航董事、監察人出具之聲明書並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師及北京天元律師事務所曾嘉律師出具之法律意見，該等人員最近三年內尚無經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理等不良經營行為之情事。 該公司創辦人暨前董事黃立達及其二親等與可控公司持有該公司股份共計 61.90%，經評估該公司於人事、財務及業務面均依相關內控辦法程序執行，且黃立達自 110 年 6 月 21 日辭任該公司董事乙職後，均無實質上執行董事業務或實質控制該公司之人事、財務或業務經營而實質董事執行業務之情事，故黃立達非為該公司之實質負責人。縱使黃立達被認定為該公司實質負責人，經查閱財團法人金融聯合徵信中心之徵信報告並無被列為拒絕往來戶、發生存款不足退票列入記錄未經註銷及向金融機構貸款有逾期還款之情事、財政部所屬各地區國稅局、各縣市稅捐稽徵處所出具之無欠繳應納稅捐資料並查詢司法院網站中裁判書查詢系統、法源法律網裁判查詢系統後，黃立達先生於最近三年度及本年度截至申請時並無違反相關法令，致使有違誠信原則之行為。 綜上所述，該公司及其重要子公司上海達航及於申請時之董事、監察人及總經理於最近三年內並無違反誠信原則之行為。				
八、申請公司之董事會或監察人，有無法獨立執行其職務者。 (一)申請公司之董事會成員應至少五席，其中獨立董事席次不得低於三席且不得少於董事席次五分之一。	(一)該公司章程係經 109 年 8 月 31 日股東會決議通過，其章程第 18 條載明：「本公司設董事五至九名，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，任期三年，連選得連任。全體董事所持有本公司股份總數，不得少於主管機關依法規定之成數。上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一」。該公司之一般董事 4 席，分別為翁榮隨先生、金谷保彥先生、稻見和明先生(所代表之法人為鴻圻國際股份有限公司)及蕭長榮先生，獨立董事 3 席為陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生，已符合董事會成員應至少 5 席，其中獨立董事席次不得低於	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
(二)申請公司之董事彼此間應有超過半數之席次，未具有下列關係之一；但經目的事業主管機關核准者，不適用 3. 之規定： 1.配偶。 2.二親等以內之親屬。 3.同一法人之代表人。 所稱同一法人之代表人，包括政府、法人股東或與其有控制或從屬關係者（含財團法人及社團法人等）指派之代表人。	3 席且不得少於董事席次五分之一之規定。 (二) 經取得該公司一般董事及獨立董事所出具基本資料、親屬表、持股 10%以上股東之轉投資及經歷證明，執行交叉比對後，尚未發現董事彼此間具有配偶、二親等以內之親屬或同一法人之代表人之關係，故該公司之董事彼此間已有超過半數之席次未具有配偶、二親等以內之親屬或為同一法人之代表人之關係。				
(三)獨立董事之任職條件： 1.應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之程序及要件。 2.需有一人以上為會計或財務專業人士。 3.自其推薦證券商與公司簽訂輔導約日起，每年應就法律、財務或會計專業知識進修三小時以上，並取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」參、四(一)、(二)、(四)訂定之進修體系所出具之證明文件。	(三)獨立董事之任職條件 1.獨立董事之任職條件評估 (1)經取得該公司變更登記表及股東會議事錄，該公司獨立董事陳文炯、游張松及梁江蔚係以自然人身分擔任董事，非為公司法第 27 條所定之法人或其代表人；另取得上述人員出具之獨立性聲明書，均已聲明其並無公司法第 30 條各款所列之情事。 (2)經取得該公司最近期之公司章程、相關董事會及股東議事錄，以及參閱公開資訊觀測站重大訊息公告，申請公司獨立董事選舉業依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度，並載明於章程。另該公司已於規定期限內受理持股 1%以上之股東提名獨立董事候選人，惟並無股東提出，申請公司之獨立董事候選人係由董事會自行提名通過，提請 109 年 8 月 31 日股東臨時會選任，其獨立董事選任作業皆依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之程序及要件辦理，並無重大異常情事。 (3)經評估申請公司獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之資格條件，茲說明如下： A、獨立董事陳文炯之學歷及經歷： A-1、學歷或專業證照： 陽明大學醫學院醫務管理碩士 臺灣大學商學系學士				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	專業證照：高考會計師及格 A-2、經歷 勤業眾信聯合會計師事務所資深執業合夥會計師(84 年間~92 年間) 臺北市會計師公會理事(105. 8~108.8)。 銘傳大學會計研究所兼任助理教授(107.9~迄今) 現職： 杏和聯合會計師事務所/所長 (96 年~迄今) 祥德陶瓷(股)公司董事長(103.4~迄今) B、獨立董事梁江蔚之學歷及經歷： B-1、學歷或專業證照： 臺灣大學推廣教育中心企業管理研究碩士 淡江大學航太工程學系學士 B-2、經歷 中租迪和(股)公司經理(72 年~87 年) 菱光科(股)公司總經理(87 年~92 年) 亞泰影像科技(股)公司總經理(94 年~102 年) 現職：虹光精密工業股份有限公司獨立董事(110 年~迄今) 怡豐創業投資(股)公司董事(104.5~迄今) C、獨立董事游張松之學歷及經歷： C-1、學歷或專業證照： 美國卡內基美隆大學管理博士 美國卡內基美隆大學工業管理碩士 交通大學運輸工程研究所碩士 臺灣大學數學系學士 C-2、經歷： 臺灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授(76 年~107 年) 現職：國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(兼任) (107 年~迄今) 雄獅旅遊(股)公司獨立董事(107 年~迄今) 寶陞國際(股)公司獨立董事(109 年~迄今) 綜上評估，申請公司獨立董事均具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗，其中獨立董事陳文炯為會計或財務之專業人士，尚符合相關規定。 2.獨立董事獨立性身分評估				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	以下茲就獨立董事陳文炯、梁江蔚及游張松於選任前二年及任職期間是否符合獨立性評估如下： (1)經檢視三名獨立董事所出具基本資料及相關經歷證明及截至最近期之聲明書，並未發現獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人於選任前二年及任職期間，有擔任該公司或其關係企業之受僱人。 (2)經檢視三名獨立董事所出具基本資料及相關經歷證明，以及被選任前與最近期間之聲明書，並查詢經濟部商業司之工商登記資料，尚未發現獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，有擔任該公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、最近期之聲明書及親屬表資料、公司之股東名冊，交叉比對後，尚未發現獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，其本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、被選任前及任職期間之聲明書、親屬表資料及該公司之股東名冊內容，交叉比對後，尚未發現獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，為前述第 1 項之經理人或前述 2、3 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、被選任前及最近期之聲明書、親屬表資料及該公司之股東名冊內容，交叉比對後，尚未發現獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前 5 名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、被選任前及最近期之聲明書、持股 10% 以上股東之轉投資，顯示獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，均無任職於該公司與他公司之董事席次或有表決權之				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 (7)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、被選任前之聲明書、持股 10%以上股東之轉投資，顯示獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，尚無任職該公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、被選任前之聲明書、持股 10%以上股東之轉投資及經歷證明，顯示獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，並無擔任下列①~④項(註)與公司有財務業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 註： ①持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十：經檢視申請公司股東名冊，並未發現持有 20%以上，未超過 50%之特定公司。 ②他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內：經檢視申請公司股東名冊及獨立董事經歷證明文件並未發現他公司及其董事、監察人及持有股份總數 10%之股東總計持有公司已發行股份總數 30%以上，且雙方曾有財務或業務之往來之特定公司。 ③公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上：經檢視申請公司之 107~109 年度及截至 110 年 9 月底主要前十大銷售客戶收入來自他公司及其集團者，占合併營收達 30%之特定公司為 C 集團。 ④公司之主要產品原料（指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料）或主要商品（指占總營業收入 30%以上者），其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達 50%以上：經檢視申請公司之 107~109 年度及截至 110 年度 9 月止之主要前十大之供應商交易金				

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	額，該公司並無主要產品原料或主要商品，故無當期採購達 50%以上之供應商。 (9)經檢視三名獨立董事所出具基本資料、被選任前及最近期之聲明書、持股 10%以上股東之轉投資及經歷證明，另，檢視該公司及其子公司之 107~109 年度及 110 年截至目前為止之勞務費用明細，顯示獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生三人，於選任前二年及任職期間，並無為該公司或關係企業提供審計或最近 2 年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 綜上評估，該公司獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生於選任前二年及任職期間符合具備獨立性身分。 3.經檢視申請公司之獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生所出具基本資料，並查詢公開資訊觀測站，除梁江蔚先生兼任虹光精密(股)公司、游張松先生兼任寶陞國際(股)公司及雄獅旅行社(股)公司之獨立董事外，陳文炯先生尚無兼任其他公開發行公司獨立董事之情事，故該公司三位獨立董事尚無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家以上之情事。 4.申請公司之獨立董事陳文炯先生、梁江蔚先生及游張松先生，均已於該公司申請上櫃前一年度間進修法律、財務或會計專業知識達三小時以上且取得核發之上課證明。 綜上評估，申請公司之董事會並未有無法獨立執行其職務之情事。				
九、申請公司於申請上櫃會計年度及其最近一個會計年度已登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，於掛牌日起，其現任董事、監察人及持股超過其發行股份總額百分之十之股東，有未於興櫃股票市場，而買賣申請公司	該公司於 109 年 10 月 27 日登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，經查閱該公司之內部人持股異動申報資料，該公司之現任董事及持股超過其發行股份總額百分之十之股東，於興櫃股票掛牌日起並未有未於興櫃股票市場買賣申請公司發行之股票情事。	✓			

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
發行之股票情事者。但因辦理第四條之承銷事宜或其他正當事由者，不在此限。					
十、申請公司之股份為上櫃（市）公司持有且合於下列條件之一者，於申請上櫃前三年內，上櫃（市）公司為降低對申請公司之持股比例所進行之股權分散行為，未採上櫃（市）公司原有股東優先認購或未採其他不損及上櫃（市）公司股東權益之方式者： (一)申請公司係屬上櫃（市）公司進行分割之分割受讓公司。 (二)申請公司係屬上櫃（市）公司之子公司，於申請上櫃前三年內，該上櫃（市）公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上。	該公司非屬上櫃(市)公司進行分割之分割受讓公司，或屬上櫃(市)公司之子公司，亦無於申請上櫃前三年內，上櫃(市)公司降低對該公司直接或間接持股比例累積達 20%以上之情事，故本款評估不適用。	✓			
十一、所營事業嚴重衰退者。		✓			
單位：新台幣千元；%					
年度		108 年度	109 年度		110 年度
公司名稱		金額	金額	成長率	金額 成長率
營業收入	達航	1,175,825	1,000,900	(14.87)	1,245,511 24.34
	大量	1,942,637	2,427,607	24.96	4,443,506 83.04
	凱崴	1,255,128	1,264,376	0.74	1,579,047 24.89
	尖點	3,006,253	2,973,426	(1.09)	3,773,746 26.92
營業利益	達航	46,956	109,352	137.95	128,439 16.57
	大量	209,650	202,822	(3.26)	550,878 171.61
	凱崴	48,343	36,787	(23.90)	28,323 (23.01)
	尖點	307,102	468,306	52.49	643,002 37.03
稅前淨利	達航	54,349	110,038	102.47	121,076 10.03

項目		就具體認定標準逐一評估情形						是否適宜上櫃			說明
								是	否	不適用	
		大量	227,117	455,211	100.43	567,193	24.6				
		凱崴	95,712	117,166	22.42	55,948	(52.25)				
		尖點	330,961	466,449	40.94	665,345	42.64				
資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證之財務報告 該公司主要從事雷射鑽孔加工服務、機械鑽孔機、成型機之設備銷售及其效能提升與維修保養服務等。綜觀國內 PCB 產業之上市櫃公司，經考量營業項目、產品結構及產業上下游關聯性等因素，選取上市公司大量（股票代號 3167）、上櫃公司凱崴（股票代號 5498）以及上市公司尖點（股票代號：8021）為採樣公司，大量為半導體產品檢測設備、PCB 設備及 CNC 彫銑機械製造商；凱崴之主要營業項目有 PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工（機械鑽孔、機械成型與雷射鑽孔）；尖點主要從事精密金屬製品（精密鑽針與精密銑刀）及加工服務（鑽孔服務）。											
申請公司如有下列情形之一者，本中心得認其所營事業嚴重衰退，但申請公司最近一會計年度財務報告之稅前淨利不包含非控制權益之淨利（損）占股本之比率達百分之六以上者，不適用之： (一)最近一會計年度或申請上櫃會計年度之營業收入及營業利益與同業比較，顯有重大衰退者。 (二)最近一會計年度或申請上櫃會計年度之稅前淨利與同業比較，顯		該公司 110 年度之稅前淨利為 121,076 千元，占股本 443,435 千元之比率為 27.30%，已達 6%以上，故不適用所營事業有重大衰退之評估。 (一)該公司 109 年度及 110 年營業收入分別較前期衰退 14.87%及成長 24.34%；營業利益分別較前期成長 132.88%及 16.57%，與同業相較，109 年度及 110 年度營收成長幅度低於同業水準，主係該公司於 108 年 10 月出售大船煙台股權等因素，致中國大陸地區 108 年度維修、保養及改造之專業服務業績減少所致。而 109 年度營業利益受到高毛利率雷射加工服務收入比重拉高及樽節費用有成，成長率則優於採樣同業，110 年因毛利率高階機械鑽孔機銷售比重提高造成產品組合變動，使毛利率上升，以及因該公司於 109 年初陸續收回 108 年底認列預期信用減損之敬鵬(常熟)及雄福逾期應收帳款，而認列預期信用減損利益 12,063 千元，而 110 年無此情形，與採樣同業相較該公司 110 年度較 109 年度之營業利益成長率介於採樣同業間。 綜上，該公司 109 年度或 110 年度之營業收入及營業利益與同業比較，並未有重大衰退之情事。 (二)該公司 109 年度稅前淨利較 108 年度成長 102.47%優於所有採樣同業，而 110 年之稅前淨利較 109 年同期成長 10.03%，介於採樣同業之間，故該公司並									

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
有重大衰退者。 (三)最近三會計年度之營業收入及營業利益，連續呈現負成長情形者。 (四)最近三會計年度之稅前淨利，連續呈現負成長情形者。 (五)產品或技術已過時，而未有改善計畫者。	109 年度及 110 年度之稅前淨利與同業比較，並無重大衰退之情事。 (三)該公司 108~110 年度營業收入分別為 1,175,825 千元、1,000,900 千元及 1,542,739 千元，成長率分別為(14.87)%及 24.34%。另該公司 108~110 年度營業利益分別為 109,352 千元及 128,439 千元，成長率分別為 137.95%及 16.57%，故該公司營業收入及營業利益並無均連續三年度呈現負成長之情事。 (四)該公司 108~110 年度稅前淨利分別為 54,349 千元、110,038 千元及 121,076 千元，成長率分別為 102.47%及 10.03%，並未有最近三個會計年度之稅前淨利連續呈現負成長之情形。 (五)該公司主要從事印刷電路板製造商，於印刷電路板製程中所需的鑽孔機台及成型機台的設備販售業務，以及其關鍵零組件的維修與保養的專業服務，同時，該公司在雷射鑽孔技術的應用上，提供客製化雷射加工的專業服務，故經評估該公司並未有產品技術過時之虞。 綜上所述，該公司尚無所營事業嚴重衰退之情事。				
十二、其他因事業範圍、性質或特殊情況，本中心認為不宜上櫃者。	經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司有既存違建之情事，惟對該公司之營運應不致造成重大不利之影響，茲說明如下： 該公司位於臺中市大甲區工廠之屋前、屋後及屋側增建專烤漆板造、鐵架烤漆板等，違建分類為既存違章建築，臺中市都發局於 108 年 7 月 3 日來函通知該增建目前遭該單位列管，截至目前暫無收到立即拆除之通知，若未來被縣市主管機關要求拆除，預計拆除需耗費 10 天，拆除費用預估新臺幣 500 千元，惟該既存違建區域該公司並未放置生財器具，若進行拆除，亦不致對該公司財務業務造成重大不利之影響。	✓			

主辦推薦證券商：康和綜合證券股份有限公司



評估人簽章：李育儒



紀秀鳳



郭雅君



黃婉玲



黃珮禎



陳萬信



黃聖儒



單位主管簽章：呂素玲



代表人簽章：鄭大宇



中華民國一一〇年十二月九日編撰

(中華民國一一一年五月三十日修訂)

(僅限於達航科技股份有限公司股票初次申請上櫃推薦證券商評估報告使用)

協辦推薦證券商：台新綜合證券股份有限公司



評估人簽章：黃淑惠



單位主管簽章：陳立國



代表人簽章：郭嘉宏



中華民國一一〇年十二月九日編撰

(中華民國一一一年五月三十日修訂)

(僅限於達航科技股份有限公司股票初次申請上櫃推薦證券商評估報告使用)

協辦推薦證券商：兆豐證券股份有限公司



評估人簽章：黃明華



單位主管簽章：陳志強



代表人簽章：陳佩君



中華民國一一〇年十二月九日編撰

(中華民國一一一年五月三十日修訂)

(僅限於達航科技股份有限公司股票初次申請上櫃推薦證券商評估報告使用)

附件十八、111 年度現金增資發行新股證券商評估報告

達航科技股份有限公司

一一一年度現金增資發行新股
(辦理初次上櫃前公開承銷)

證券承銷商評估報告

主辦承銷商：康和綜合證券股份有限公司

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三 十 日

目錄

壹、承銷商總結意見.....	1
貳、評估報告內容摘要.....	2
一、產業概況.....	2
二、發行人之競爭地位.....	12
三、營運風險.....	14
四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益.....	31
參、就發行人下列業務財務狀況蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	33
一、業務狀況.....	33
二、財務狀況.....	79
肆、發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	105
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫.....	105
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益.....	105
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響.....	105
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務周轉困難情事.....	105
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開.....	105
伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	106
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行.....	106
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事.....	106
三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定.....	114
四、法令之遵循及對公司營運影響.....	124
五、說明是否已取具發行人委請填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商具有下列關係之聲明書.....	130
陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	131
一、本次募集與發行有價證券資金運用計劃、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性.....	131
二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估.....	133
三、本次籌資計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工	

程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性.....	133
四、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性.....	140
五、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應就減資計畫等內容評估其可行性與合理性.....	140
六、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格之訂定方式及對股東權益之影響.....	140
七、發行人向金融監督管理委員會申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定辦理採彈性訂定方式者，應評估下列事項.....	140
八、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償還資金來源計畫之可行性、必要性及合理性(至少應包括到期償還之來源及如何取得人民幣等).....	142
柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	142
捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	142
玖、評估本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	142
拾、就本次發行公司債債權確保情形蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果.....	142
拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	142
拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	142
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	142

壹、承銷商總結意見

達航科技股份有限公司(以下簡稱達航或該公司)本次為辦理現金增資發行新股普通股 5,806,000 股，每股面額新台幣 10 元，合計總金額新台幣 58,060,000 元整，依法向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與該公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，該公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

康和綜合證券股份有限公司



負責人：邱榮澄



承銷部門主管：呂素玲



中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三 十 日

貳、評估報告內容摘要

本承銷商經依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券評估報告之評估查核程序」規定辦理查核完畢，所獲致結論如下：

一、產業概況

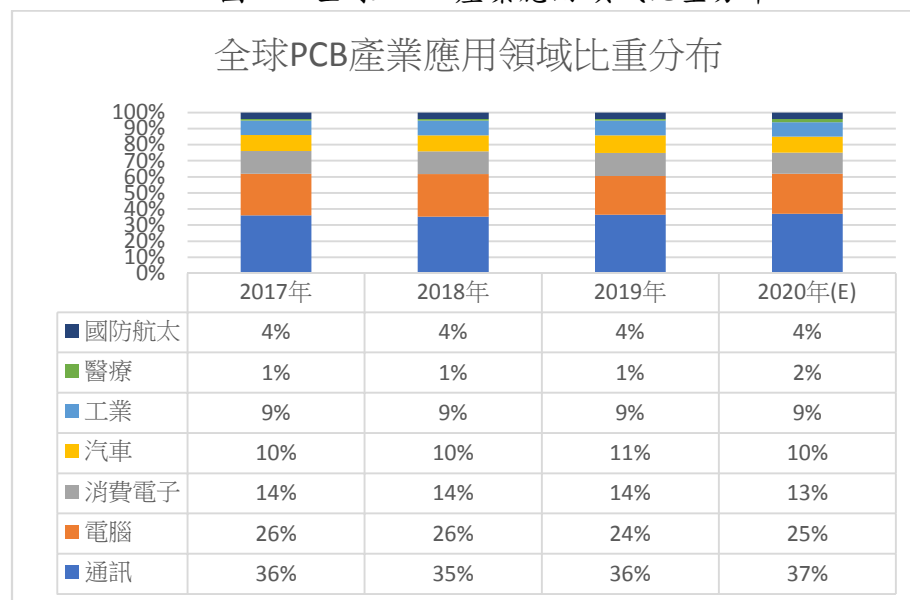
(一)產業現況與發展

該公司所生產及銷售之 PCB 鑽孔機/PCB 成型機等設備，係屬 PCB 產業中游之鑽孔設備，另提供雷射加工應用服務，如：CO2 雷射鑽孔機台維護保養、協助提升雷射機台之效率以及雷射加工服務等，其應用係包含 PCB、光電及半導體產業之生產加工設備，因此就印刷電路板產業概況進行說明。

1. PCB 產業概況

印刷電路板（Printed circuit board；PCB）為電子產品之母，所有電子產品皆需使用 PCB，PCB 是將電子零件之間複雜的電路，蝕刻在一塊板子上，提供電子零組件在安裝與互聯的支撐，主要功用在固定電子零件、提供零件電流，因此也有 3C 產業之母的稱號。目前國內印刷電路板類型約可分類成單面板、雙面板、多層板、軟板、軟硬結合板、IC 載板等種類型，印刷電路板為各項電子產品之關鍵零組件，主要用於承載各電子元件及元件間訊息傳遞之媒介，產品廣泛應用於電子產品包括穿戴式裝置、個人電腦、平板電腦、網通、伺服器/儲存器、車用電子、5G、各類消費性電子產品等（詳圖一）。

圖一、全球 PCB 產業應用領域比重分布



資料來源：台灣電路板協會(TPCA)、N.T.Information、台灣經濟研究院

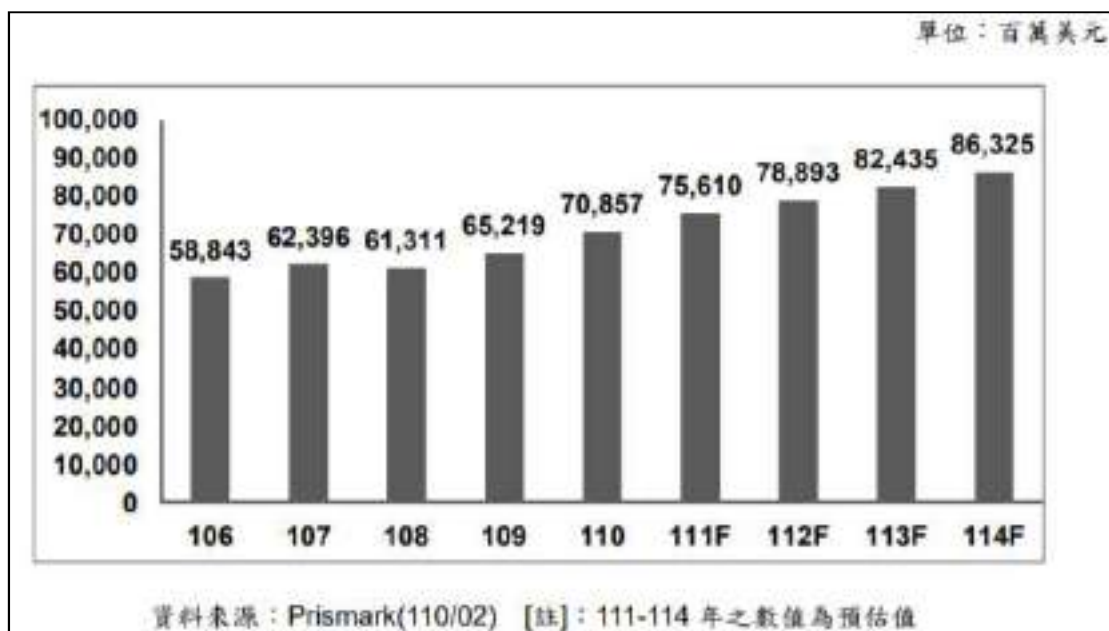
(1) 全球 PCB 產業概況

109 年全球電子產業週期受到新冠肺炎(Covid-19)影響，多數工廠在第一季停工，使得週期延長，以及因隨著疫情持續升溫，終端消費需求減少，影響全球印刷電路板產業，所幸下半年全球 5G 通訊基礎建設陸續進入建設及 5G 智慧型手機印刷電路板商機逐步發酵，將提升各式印刷電路板在電子產業的高度應用與重要性，以及防疫下的遠距辦公、宅娛樂應用方面開發的電子設備及系統需求，也將帶動包括伺

服器及穿戴裝置等各式印刷電路板需求持續增長。

根據 Prismark 預測，全球印刷電路板產值由 98 年的 412 億美元增長到 108 年的 613 億美元，成長幅度 49.0%，預估 110 年 PCB 行業預計成長率為 8.6%，109 年至 114 年之間以 5.8% 年複合增長率成長，至 114 年全球 PCB 行業產值將達到 863.3 億美元（詳圖二）。

圖二、106-114 年全球印刷電路板市場規模



從圖三可以看到全球 PCB 主要產品產值表現，在 109 年主要產品產值表現以 IC 載板、HDI 板表現相對較佳。IC 載板的主要成長動能主要來自 NB、伺服器、網通設備等應用需求明顯成長，加上雲端運算、AI 及 5G 基礎建設等應用持續增溫，帶動 ABF 載板市場需求持續增溫；而 HDI 板則主要來自手機主板規格升級及 NB、電動汽車等應用擴大導入；軟板、單雙層板受智慧手機、汽車市場需求下滑，表現相對疲弱。

圖三、全球主要 PCB 產品產值概況

(單位：百萬美元)	2019年	2020年(e)		
	金額	金額	比重	年增率
IC載板	8,139	10,031	15.7%	23.2%
單雙面板	8,092	7,661	12.0%	-5.3%
多層板	23,877	24,476	38.3%	2.5%
HDI板	9,008	9,575	15.0%	6.3%
軟板	12,195	12,238	19.1%	0.4%

資料來源：台灣電路板協會(TPCA)、台經院產經資料庫

109 年初受新冠肺炎疫情(Covid-19)蔓延，導致廠商延後開工，衝擊供應鏈運作，全球經濟停滯也影響第一季產值表現，上班族在家辦公，學校使用遠距教學，反而帶動了伺服器及雲端儲存的需求，有望成為 PCB 產業的成長主軸。由於建置雲端網路系統所需資料中心、網路工作站，須配置大量網通設備、光通訊設備、電源設備、伺服器、散熱設備，其中，伺服器、網路交換器所搭載 IC，即需使用大量 IC 載板。

雲端網路應用之外，AI 應用已成為推動 IC 載板市場需求成長另一要角；機器視覺、語音辨識、大數據分析等科技，持續拓展不同生活應用層面，不只因此加速 AI 伺服器系統布建速度，更全面性擴大刺激雲端、終端 AI 高速運算晶片搭載需求。

以全球 AI 晶片市場規模而言，有機會自 108 年的 113 億美元，明顯大幅成長至 112 年 418 億美元，期間年複合成長率達 38.70%。如以公有雲市場而言，市場規模則有望自 108 年的 830 億美元，成長至 112 年時 1,791 億美元，期間年複合成長率亦達 21.20%；二大應用板塊的中長期成長向上趨勢，將為 IC 載板市場造就剛性需求。

(2) 臺灣 PCB 產業之概況與發展

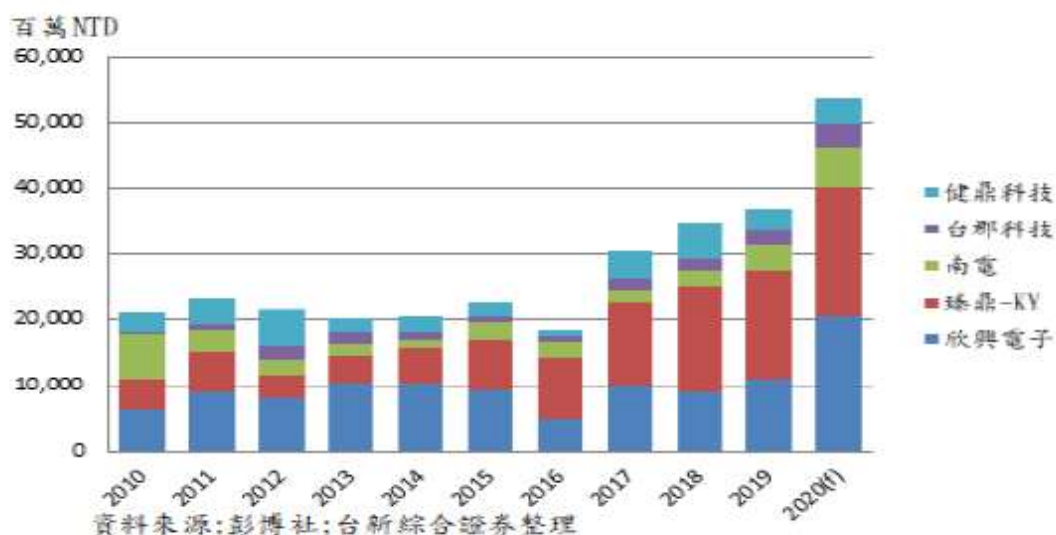
台灣在全球各式印刷電路板產業佔有舉足輕重的地位，據 Prismark 資料顯示，以生產地為基準，109 年大陸、日本、美國、歐洲之生產規模分別佔全球之 53.7%、8.8%、4.4%及 2.5%，全球超過 1/2 的各式印刷電路板在大陸生產，為全球最大之印刷電路板生產基地，亞洲其他以台系、韓系 PCB 廠商為主。而 109 年全球電路板產值年成長率 9.4%，台灣電路板成長率則優於全球，創下 10.2%(以原始訂單美金計算)，保守預估 110 年全球電路板產值可成長約 6%(詳圖四)。

圖四、台灣電路板產值規模趨勢



自 106 年以來，受惠於智慧手機規格持續提升，資料中心建置潮驅動伺服器升級需求，加上手機大廠的真無線藍芽耳機(TWS)的推出，使得 HDI 板、軟板、軟硬結合板等出貨持續增溫。除此之外，在物聯網(IOT)、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)等應用需求持續提升下，帶動微處理器(MCU)、繪圖晶片(GPU)、基地台晶片、伺服器晶片等封裝需求持續增溫，且由於晶片設計日趨複雜，在新增產能相對有限下，IC 載板市場供需轉趨吃緊，報價不斷走揚，帶動 IC 載板產值表現亦呈現穩定成長。著眼於各國持續投入 5G 基礎建設的建置、5G 手機市場規模將逐步擴大，國際主要品牌車廠加速投入電動車市場的布局，且 5G、AI 應用蓬勃發展將帶動高效能運算晶片市場需求持續增溫。為有效滿足市場需求，台廠 109 年加速投入高階軟板、HDI 板及 IC 載板產能的擴充，新產能預計於 110 年起逐步開出。如圖五，台灣主要 IC 載板供應商也擴大在臺投資，如欣興在桃園楊梅設置新廠，擴增高階 IC 載板產能，臻鼎、南電、台郡也因應 5G 轉型，擴大 PCB 的資本支出。

圖五、臺灣主要印刷電路板大廠資本支出規模



在 PCB 的產品裡面，IC 載板因受惠於 5G、高效能運算等應用需求帶動 ABF 載板需求增溫，且產能大多位於台灣，帶動 ABF 載板出貨大幅提升，加上 5G 手機、機上盒、記憶體等應用有效支撐 BT 載板出貨表現，驅使我國 IC 載板製造業 109 年上半年產值表現亮眼。根據經濟部工業生產統計磁帶資料顯示(詳見圖六)，109 年上半年我國 IC 載板製造業產值達 458 億元，年增率高達 25%，呈現強勁的成長力道。

圖六、我國 IC 載板產值及年增率走勢



資料來源：經濟部工業生產統計磁帶資料、台灣經濟研究院

雖然受到疫情影響，導致全球經濟停滯，但產業的發展只會延後不會消失，5G、高效能運算和人工智慧等應用依舊帶動 PCB 產品強勁需求。

(3) PCB 產業之發展趨勢

A. 新能源車發展趨勢

近年，汽車產業呈現逐年衰退，但在受到各國政府補貼政策的激勵，包含純電動車 (BEV) 與插電混合式電動車 (PHEV) 在內的新能源車，在整體車市衰退下仍保持銷售正成長。

燃油車跟電動車(新能源車)動力、傳動不同，傳統車較多的是機械相關，電動車則是透過電池，要應付內部各種直流電、交流電的變化，會採用更重的銅、和更高層數的設計，加上視聽娛樂、導航、雷達，到 ADAS、自動駕駛等其他不同功能的控制系統，每一個功能就要一塊 PCB，這也使得未來電動車的 PCB 需求量增大，單量電動車的 PCB 產值預估為 100 美元以上，優於燃油車的 60~70 美元，再加上現有的燃油車也有不少搭載自駕跟車系統，汽車內含的電路板越來越多，汽車電子化的趨勢下，仍是非常具有成長潛力的領域。

根據 TrendForce 旗下拓璞產業研究院統計數據指出，預估 109 年銷售量為 240 萬輛，到了 111 年，預期全球的新能源車規模將達到近 500 萬輛。



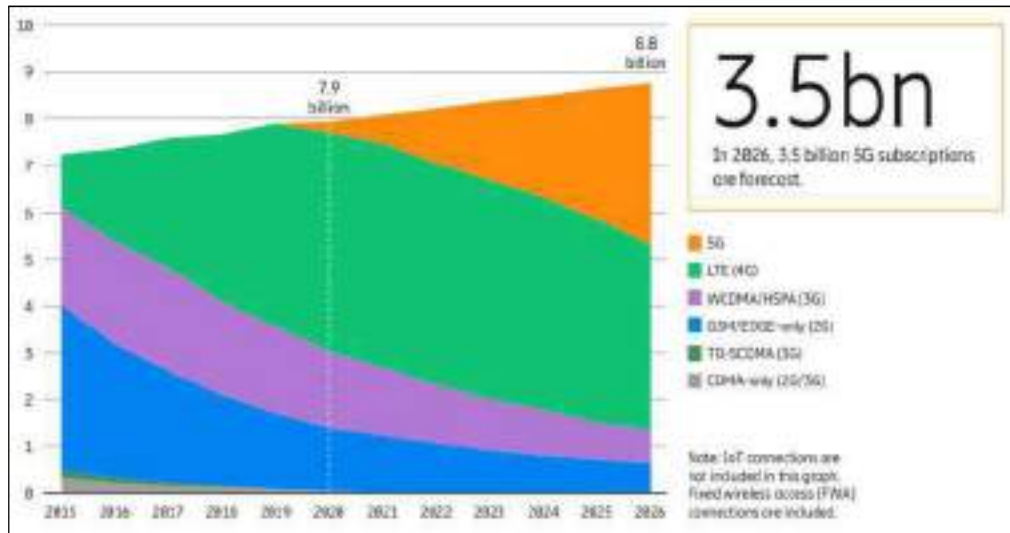
資料來源：拓璞產業研究院，NOV.109

而電動車未來勢必會朝向更輕量化、乘載更多電池、更高續航的方向邁進，而 HDI 具備輕薄短小的優勢，因此相關製程逐漸走入汽車板當中，未來電動車需求持續成長的話，預期將有更多 HDI 製程的 PCB 廠可望受益。

B. 5G 新浪潮帶動相關產業

第四代行動通訊(4G)自 102 年開始發展並普及以來已邁入了第 8 個年頭，隨著民眾對於傳輸網速要求以及物聯網對於高速聯網的需求不斷的提升，第五代行動通訊(5G)技術也開始孕育而生。自 108 年開始，各國 5G 服務陸續上路，5G 用戶數逐步放大，根據 EricssonMobilityReport 的統計，109 年時全球約有 2.2 億 5G 用戶數，到了 115 年時，全球 5G 用戶數預估將成長到 35 億戶。而目前則有產 412 家電信商針對 131 國家/地區進行 5G 領域投資，135 家電信商即將在 50 個國家/地區啟動 5G 服務。

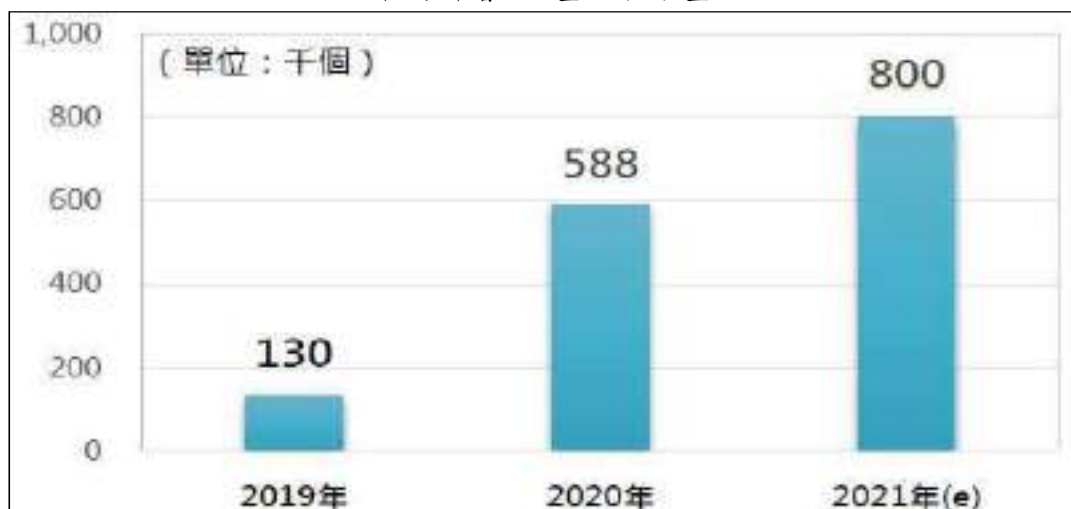
全球 5G 用戶數



資料來源：Ericsson Mobility Report November 109

中國自 108 年開始也積極推動 5G 建設，預計投資 2.5 兆人民幣建設 5G 新基建。中國工信部統計，預計到 110 年將會建設逾 80 萬座 5G 基地台。而歐美 5G 基礎建設在 109 年受疫情及美中科技戰影響 5G 基地台的布建速度。為了加速 5G 服務普及，110 年歐美電信商將加快 5G 基地台等基礎建設的建置，以擴大 5G 服務的覆蓋率。因此當全球加速佈建 5G 基地台，開始 5G 世代的元年。而新世代通訊基地台需求急升，帶旺相關零組件產業鏈，PCB 產業鏈便是其中之一。

中國新增 5G 基地台數量



資料來源：中國工信部

根據研究機構 Prismark 指出，5G 行動通訊時代將帶動智慧手機規格、物聯網及汽車電子複雜度的提升等一系列終端應用產品升級，而軟板、HDI 板及多層板業者將是主要受惠者。由於通信設備對 PCB 需求主要以多層板為主(8-16 層板比重約 35.2%)，隨著 5G 開始商轉，通信設備的高頻高速將是必然趨勢，且基地台站所使用的 PCB 面積將會是 4G 基地台所使用的 1.55 倍，因此高頻高速 PCB 板需求將會顯著增加，相關 PCB 廠商也積極在高階 HDI 板上著墨。各項 5G 通訊設備 PCB 需求如下表一：

表一、各項 5G 通訊設備 PCB 需求一覽表

PCB 需求	基礎建設		行動 終端設備	用戶 終端設備	5G 應用
	戶外 大型基地台	小型基地台	智慧手機	路由器 交換器	各式 連網設備
	多層板 高頻高速板 ABF 載板	高頻多層板 高頻微波板	天線軟板 AiP 載板 SiP 載板	多層板 高頻高速板	多層板 高頻高速板 金屬基板

資料來源：工研院產科國際所、台灣經濟研究院產經資料庫

近年隨著全球智慧型手機需求飽和，相關供應鏈業者已開始將未來成長動能寄望於 5G 上路後所帶來的新興商機，各國電信業者也正積極展現布建 5G 網路的企圖心，冀望能取得優勢、搶攻市場占有率，也提供包括半導體、印刷電路板、電子零組件等上游供應鏈業者新的藍海商機。市場原預期 109 年為 5G 基地台建置的高峰期，但受到新冠肺炎疫情在中國迅速蔓延，除導致台商中國廠區面臨延後開工，終端市場銷售亦出現急凍。邁入下半年，全球經濟市場逐步復甦，各國 5G 建設也重新啟動，而美系手機大廠推出新款 5G 手機，預估 5G 手機市場規模將逐步擴大，台廠在多元應用布局完整以及新產能陸續量產，在基期相對偏低之下，預計 110 年 PCB 業景氣可望持續呈現成長態勢，後續營運表現仍值得期待。

2. 雷射加工產業概況

雷射加工技術在工業上的應用，從金屬切削、鋼板切割、焊接及熱處理等機械加工，到電子產業中的印刷電路板鑽孔、TFT LCD 切割、晶圓切割及 MEMS 加工技術等，都已有十分廣泛的應用。

根據調研機構 Maximize Market Research 資料顯示，全球雷射材料加工市場規模將從 105 年的 64 億美金成長至 113 年的 97 億美金，複合成長率約達 6%，呈現穩健成長的態勢。雷射材料加工市場可大致分為雷射標籤、雷射精密加工(金屬切割/焊接等)和雷射清潔等領域。未來材料加工之需求將隨經濟發展和終端應用如消費性電子(手機、平板/筆電、穿戴式裝置、面板)、車用、工業等領域發展而持續增加，雷射技術將成為相關應用之關鍵技術，有助推動各項產業向上成長。



在 1981 年時，萊世曼 (Leishman) 將雷射加工微小盲孔的方法應用在 Finstrate 基板上，又到了 1990 年，IBM 公司發表了所謂表面配線板製程技術 (Surface Laminar Circuit, 簡稱 SLC Technology) 的增層印刷電路板，其後，由於微細圖案和間距技術的持續發展與進步，使得增層印刷電路在 1998 開始實用化，而這時的增

層法，係在傳統壓合之多層板外面，再以背膠銅箔(Resin Coated Copper，簡稱 RCC)或銅箔加膠片增層(Build up)，其與內在(core)板的連係採微孔(microvia)或雷射加工及光成孔(Photovia or laser via)之途徑，它是一種用非機械鑽孔方式，以及壓合後再增層的製造方式。

近年來，在 5G 通訊、IA 等此產業可攜性輕薄短小，多功能及價格低廉的要求，印刷電路板遂走向高密度佈線、細線及小孔化、複合多層化、薄板化發展，另雷射精微加工領域部分，受到光電半導體產業近年吸睛產品 OLED、Micro-LED 影響，與其相關之製程技術用雷射源亦跟著發展，例如 Coherent Inc.之 CO2 雷射，因其波長特性，200W 之 CO2 雷射可用於玻璃切割、PCB 通孔鑽孔；切割 OLED 面板之紫外光皮秒脈衝雷射源，加入感測器與精準光束控制模組，可提供光電半導體產業高速發展之解決方案。

(二)所屬行業之營運風險

茲就該公司產品所屬之行業，分別說明景氣循環及產品可替代性等對其之營運風險如下：

1. 景氣循環之營運風險

該公司主要生產及銷售 PCB 鑽孔機/PCB 成型機及雷射鑽孔加工服務等，係屬 PCB 產業中游。而 PCB 搭載於所有的電子產業，因此也有 3C 產業之母的稱號，應用範圍涵蓋各式通訊產品、工業用品及消費性電子產品等，因此電子業的景氣循環將影響 PCB 機械設備之需求多寡。未來隨著 5G 商轉、防疫之下 PC 及週邊設備消費性電子產品的強勁需求，汽車、軍事等領域之創新與升級，以及新興應用不斷開出之新需求，整體終端應用市場穩定成長，進而帶動印刷電路板之需求。臺灣在全球 PCB 產業的超前部署使需求湧向臺灣，預期臺灣 PCB 大廠資本支出將持續成長。

機械設備業本身即對整體經濟環境有著極高的敏感度，達航科技為降低產品集中的風險，一直積極拓展其他領域產品線，提前佈局投入自動車、半導體、光通訊及 6G 相關應用，以分散銷售市場、提升公司競爭力，並降低單一下游產業景氣循環對該公司的影響及風險。且面對印刷電路板高階製程之多樣化及複雜化，該公司持續研發更好之鑽孔技術，提供最佳客戶服務，並持續為該公司營收注入動能，亦提升同業競爭能力。

2. 產品可替代性

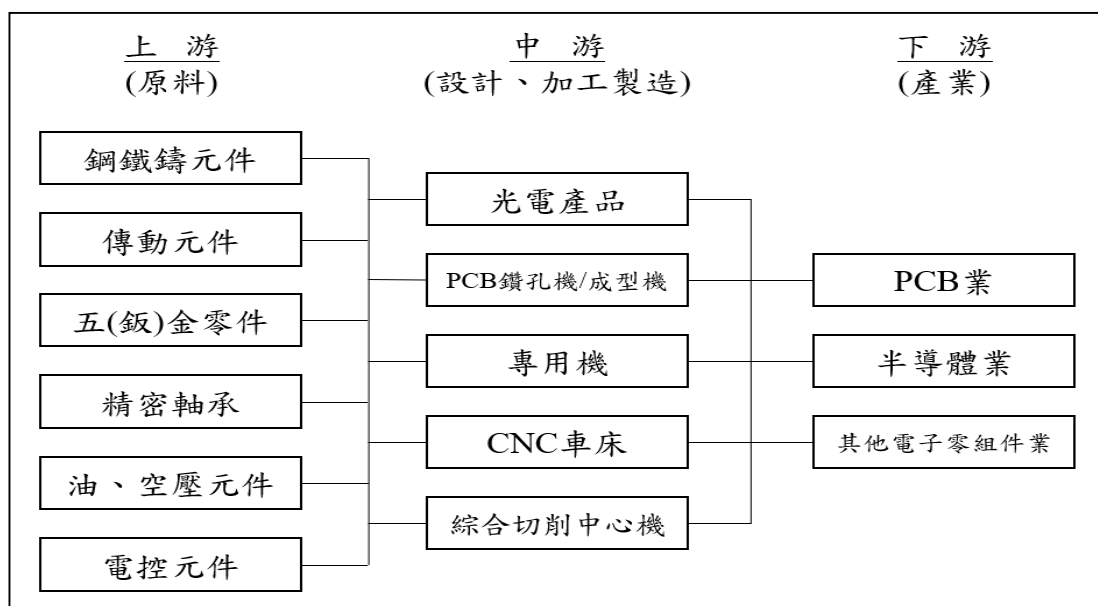
達航科技主要從事生產及銷售之 PCB 鑽孔機/PCB 成型機等設備，另提供雷射加工應用服務如雷射金屬切割機、全自動雷射鑽孔/劃線機及雷射晶圓標印機等，與客戶製程設備連結，提供客戶最佳自動化解決方案，提升各式印刷電路板在電子產業的高度應用與重要性，並與客戶共同開發成長。

隨著高科技產品在追求重量輕、體積小之前提下，PCB 越做越小，該公司鑽孔設備具有高穩定、高工藝、高技術等優勢，面對不同載板所需之孔數、深度等都能維持良好之品質與良率，目前國內鑽孔設備之廠商尚不能與該公司相比擬；且 5G、電動車等產業持續發展，使得 PCB 之需求爆發，就長遠製造產業需求而言，對於 PCB 機械設備之需求將隨之提高，該公司產品尚無被立即取代之風險。

(三)行業上、中、下游變化

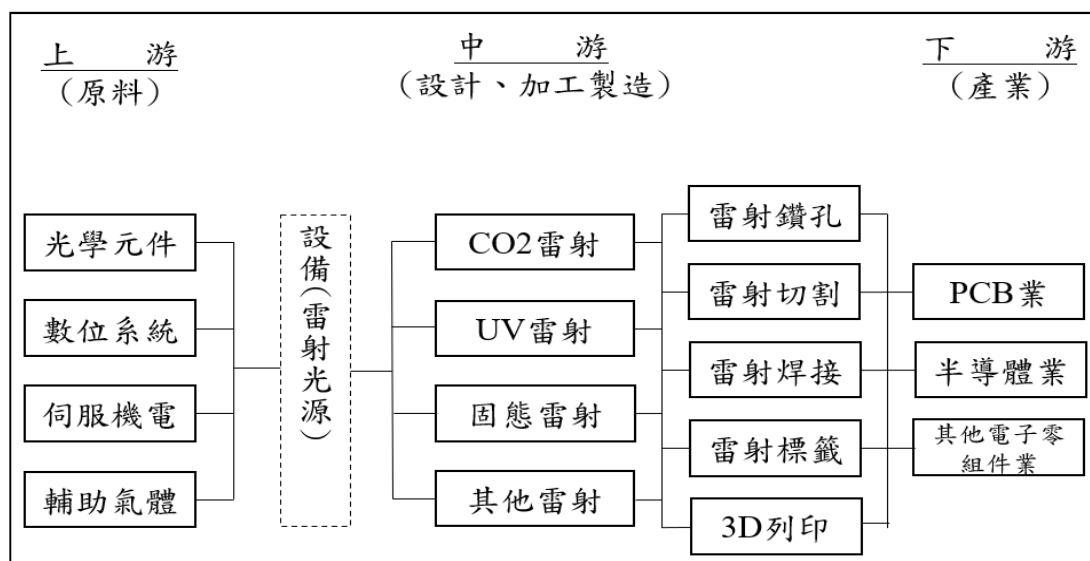
達航科技為印刷電路板之鑽孔機台製造商，係屬機械設備造業之中游，通常藉由協力廠商配合零件之加工製造等生產過程，以專業分工方式整合機械之製造，其整合上游之相關鑄件、五金零件、控制器、馬達及軸承等，研發製造 PCB 產業鑽孔機械設備，再銷售給下游 PCB 產業、半導體業及其他電子零組件業等廠商。茲將達航科技所屬產業之上、中、下關聯性圖示說明如下：

1. PCB 設備產業



2. 雷射加工產業

雷射加工產業上游主要包括雷射材料及配套元件，中游為雷射器及其配套元件，下游包括雷射應用產業如 PCB 產業、半導體業及其他電子零組件業等。

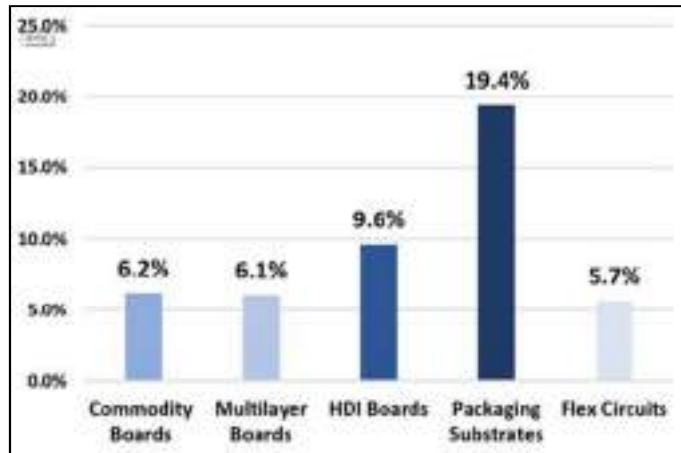


(四)行業未來發展趨勢

在 2020 年全球電路板各式產品中，載板產值佔所有產品之比重達 16%，全球年成長率高達 25%，因 5G 手機晶片需求及 SiP、AiP 等新的應用規模快速的成長帶動先進製程需求，呈現高度成長主要原因為：(1)全球 IC 出貨量持續成長；(2)高單價 ABF 載板需求旺盛，由於 5G 基地台、高效能電腦的需求高度成長；(3)5G 手機衍生出 AiP 之載板需求。

根據研究機構 Prismark 資料，晶圓製造產能與載板的供不應求下，110 年全球載板成長率預估維持 19% 高成長，如圖所示，居各式電路板產品之冠。

圖 2021 年全球電路板產品預估成長率



資料來源:Prismark (2021/02) 製表:TPCA

近年 5G 技術快速發展，為達成高速傳輸之目標，載板朝高密度、多層與微型化發展，盲孔與埋孔需求大增，傳統機械鑽孔機無法有效解決盲孔、埋孔製程及孔徑微小化問題；而雷射鑽孔機在小孔徑及盲孔具優勢，適用高階 PCB 板製程，迎接下世代的 PCB 將跨入類載板(Substrate-Like Process, SLP)等製程。

展望 110 年，隨著 5G 網路正式普及，PCB 各終端需求包括車用、消費、通訊電子、工控醫療及航太等也將逐步成長；而 5G 基地台、物聯網、雲端智能及 AI 應用等軟硬體規格提升，其需求增加也將受惠 PCB 產業鏈。依據 Prismark 預估，未來 IC 載板成長幅度將為 PCB 各產品類別中最大，113 年產值將達到美金 126 億元，較 109 年之複合成長率達 9.1%，Multilayer Board(多層板)與 HDI 複合成長率亦分別具 4.4%與 6.5%成長規模，各類印刷電路板總產值將在 108 年至 113 年以平均 5.1%年複合增長率成長，將於 113 年達到美金 787 億元規模，顯示未來五年 PCB 市場產業及其衍生出之雷射應用代工成長可期。

二、發行人之競爭地位及營運風險

(一)發行人之競爭地位

單位：新臺幣千元；%

公司 名稱	主要產品	110 年度			
		實收 資本額	營業收入	毛利率 (%)	每股 盈餘
達航	雷射鑽孔代工服務、自有品牌鑽孔機及成型機產銷、保養、維修及改造服務	430,133	1,245,511	31.00	2.12
大量	半導體產品檢測設備、PCB 設備及 CNC 彫銑機械	801,341	4,443,506	25.88	5.51
凱崙 (註)	PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工	註	1,579,047	10.90	0.18
尖點	精密鑽針、精密銑刀以及鑽孔加工服務	1,421,805	3,773,746	32.70	3.14

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告

註：凱崙截至評估報告出具日止尚未上傳110年度合併財務報告，上表揭露凱崙之營業收入、毛利率及每股盈餘來源係凱崙於111/2/25發布之重大訊息，公告其董事會通過合併財報數字。

該公司與採樣公司相較，實收資本額及營收規模不及採樣公司，惟毛利率僅略遜於尖點，且 110 年度每股盈餘表現優於凱崙，顯示該公司以目前之規模，其營運表現及獲利能力尚具市場競爭力，在同業地位中尚屬穩健。

(二)市場佔有率

該公司產品及服務項目主要劃分為專業服務及設備產銷兩大類分別說明如下：

1.專業服務

(1)雷射鑽孔加工之相關服務：

使用自主研發生產之雷射鑽孔機，協助客戶進行加工 IC 載板(ABF 載板、BT 載板)、低耗損高頻基板材料(Low Loss)及次毫米發光二極體(Mini LED)等材料，滿足其各種高精密度、不同孔型的板材加工。該公司亦提供專業駐廠工程師協助進行加工條件之設定，以提升客戶生產效率。並可配合客戶研發階段、產品保密等因素，將設備搬入客戶廠區，並提供人員駐廠，進行雷射鑽孔加工服務。

(2)鑽孔機與成型機之維護保養服務以及效能提升方案：

配合客戶既有機台，提供維護保養服務，或運用該公司生產製造之主軸產品，協助客戶設備改造升級等效率提升服務專案。該公司提供之主軸產品，係屬工具機之關鍵零組件，主軸系統與切削力之傳遞最直接相關，其旋轉精度與動態特性影響最終的加工品質。透過使用該公司提供之主軸產品，能夠將客戶既有機台之效能有效提升。

2.設備產銷

該公司以自主研發製造之鑽孔機及成型機進行銷售，並以「VELA」為其設備之自創品牌，搭載自主研發高速主軸、自動檢測、相關刀具等機構組件，主要應用

於 PCB 基板、IC 載板等材料之鑽孔及成型製程。

該公司提供之產品及服務，參考行政院主計總處之行業統計分類能大致歸類為 C2630 印刷電路板製造業，該公司 107 年至 110 年度營業收入占我國印刷電路板製造業年產值之總金額約 0.32%至 0.53%，隨著 5G 通訊、汽車電子等應用需求持續成長，且各類電子產品愈趨強調輕薄短小，對雷射鑽孔服務之需求愈趨增加，該公司未來仍有成長空間可期。

單位：新臺幣千元

年度	營業收入(A)	印刷電路板 製造業年產值(B)	約略市場占有率 (A)/(B)
107 年度	1,542,739	289,995,627	0.53%
108 年度	1,175,825	291,631,029	0.40%
109 年度	1,000,900	313,517,311	0.32%
110 年度	1,245,511	366,122,931	0.34%

資料來源：經濟部統計處及該公司經會計師查核簽證之財務報告

(三)公司競爭利基

1.研發團隊之經驗與技術

隨著科技之快速變遷，PCB 產業可能隨時會迎接材料的變化與製程的變化，如 5G、AI 及車用電子等領域，所使用的材料基板與製程要求不盡相同。因此，研發團隊能否適時開發出符合市場需求之產品將是公司成就與否之關鍵因素之一。該公司研發團隊資歷豐富，具備持續研發專利之能力，並自行研發產品之核心技術，能隨時調整研發方向，推出符合市場需求之新設備及新技術，為該公司之競爭立基之一。

2.市場發展趨勢之掌握度

市場上終端產品的發展趨勢，即為 PCB 產業的未來方向，縱使公司研發團隊能開發出符合當下市場需求的產品及技術，因產業中的競爭者眾多，推出新產品及服務的時點也成為關鍵。因此，對市場發展趨勢的掌握度將是公司成就與否的關鍵因素之一，市場中能越早掌握到未來發展趨勢的廠商，所獲得的優勢越大。該公司透過銷售設備及提供鑽孔代工服務，業務人員及研發人員與客戶進行交流，從需求端得到第一手的市場資訊，並憑藉著經營團隊對產業脈動的敏感度，可高度掌握未來產品技術的發展發項，有助於該公司及早啟動研發計畫，開發符合市場需求之技術及產品，提升競爭優勢。

3.產品及服務之靈活程度

PCB 產業已發展超過數十年，生產方式從人工、半自動化、全自動化乃至今的智動化，各式機械設備對生產流程至關重要，然鑽孔機、成型機等設備售價動輒百萬起跳，對於大額之資本支出，客戶並不會倉促做決定，若能提供替代之產品與服務，將能提升公司之競爭利基，因此產品及服務之靈活程度將是公司成就與否的關鍵因素之一。該公司透過提供完整的產品及服務鏈，從自行研發之設備銷售、客戶現有設備之改造，到提供鑽孔代工之服務等，並提供技術支援團隊做為後盾，提供客戶在生產流程中最佳的解決方案。

三、營運風險

(一)該行業之營運風險

請詳一、產業概況(二)所屬行業之營運風險。

(二)發行人之營運風險

茲就該公司之業務、技術能力、研發、專利權、人力資源、財務（包括成本、匯率變動等）等之營運風險列示說明如下：

1.業務之營運風險

(1) 市場可能之供應變化情形

109 年度的新冠肺炎疫情重創了全球經濟市場，然而隨著疫情的發展，帶動居家上班與宅經濟持續發燒，推升筆電、平板與遊戲機等相關產品需求，也為 PCB 產業帶來意外的收穫。若說新冠肺炎是 109 年度的一大災難，那 5G 絕對可說是災難中的一道曙光，IC 載板在 5G 相關應用需求暢旺的持續加持，基於產能受限供不應求下，成為帶動 PCB 產業成長主要的火車頭，著眼於 5G 商機已經發酵，根據台灣電路板協會（TPCA）統計，109 年起台資 PCB 製造與原物料廠商將陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣，如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎在台併購與新廠規劃、台郡、景碩、耀新電子等板廠外，也帶動材料大廠如南亞塑膠加碼銅箔廠、台光、台耀與聯茂紛紛加碼投資台灣，將再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

(2)未來發展之有利、不利因素及因應對策

A. 未來發展之有利因素

a. 5G 商機帶動 PCB 產業需求成長

5G 所衍生的商機與供應鏈相當龐大，從基地台天線設計、網通設備與伺服器，再到終端 5G 智慧型手機，所需要的印刷電路板規格與數量均較以往有大幅度的改變。數量方面，5G 基地台站所使用的印刷電路板面積將會是 4G 基地台所使用的 1.55 倍。除數量增加外，5G 對於 PCB 板材的規格要求更為嚴苛，為達到高頻高速傳輸之標準，不只需要較高的技術與設備投入，更需要技術人員和生產人員的經驗累積。該公司具備多年設備開發與雷射鑽孔加工之經驗，並且擁有數家大廠認證合格之設備，將成為競爭 5G 商機時的競爭利基。

b. 全球政經局勢角力，台廠加速擴廠布局

面對美、中兩強角力，台廠積極分散全球生產風險，自 109 年起陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣，且近九成投資都在臺灣，如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎在台併購與新廠規劃等，帶動高階設備與周邊產業龐大商機。該公司深耕產業多年，具備設計、研發及整合能力，可配合客戶需求開發設備，亦能提供加工之技術支援，倘若把握住此波商機，未來成長可期。

c. 利基型產品興起，考驗廠商生產模式

印刷電路板產業競爭劇烈，多量少樣的標準品獲利難度大增，再加上因消費

型態轉變而興起的少量多樣的利基型產品，將使廠商因生產模式的轉變而面臨考驗。而該公司因具備自主開發生產設備的能力，對於客戶提出之客製化需求能有效處理，且該公司相對大廠，更具機動性及配合度，能夠迅速且高度配合地協助客戶開發出所需設備。另，該公司多年累積之代工生產經驗，亦能幫助客戶針對各式加工條件，安排最佳解決方案。對於搶攻利基型產品市場，該公司之營運模式與能力，具備相當之優勢。

B. 未來發展之不利因素及其所採行相關因應措施

a. 產品及服務集中於同一產業

該公司雖提供各式產品及服務項目，大部分均集中於印刷電路板產業，風險過度集中，倘若印刷電路板產業發生嚴重衰退，該公司營運將連帶受到影響。

因應措施

該公司為避免營運過度集中於同一產業，業務團隊努力開發新客群，尋找不同產業客戶與該公司產品合作可能性，而研發團隊透過雷射鑽孔技術及機械鑽孔技術的相互搭配，使公司產品與服務能應用於不同產業所需之電路板材料與加工方式。近兩年該公司積極往多角化的經營方向前進，將產品與服務之應用範圍拓展至半導體產業、通訊產業、車用電子業等。

b. 設備製造業之景氣循環明顯且影響甚高

該公司營業項目之一為自主研發設備之產銷，其績效表現受景氣循環影響甚高，當景氣好時，市場供不應求，下游廠商生產力不足，添購設備的需求上升，而當景氣反轉時，產能過剩，下游廠商只能縮減資本支出，且此景氣循環通常是相當漫長的過程，雖有連續數年的榮景，但連續多年的景氣低迷將成為該公司的重大考驗。

因應措施

該公司採取穩健財務政策，適度舉債經營，實現風險與報酬的最優組合，在景氣好時，適當的槓桿推動營運表現，當景氣反轉時，亦能具備足夠的償債能力。對於設備類應收帳款收款天期較長者，該公司除持續加強應收帳款管理及催收工作外，亦採取嚴格的備抵呆帳提列政策，以利管理團隊能隨時掌握財務狀況。

該公司之營運模式係傾向於推出高端機種，並採客製化需求接單模式生產，不但能提高毛利，亦能避免庫存呆滯之風險。另透過雷射鑽孔加工服務，為客戶提供除添購設備外，能夠滿足擴增產能需求的其他選項，讓公司營運更具彈性。

c. 勞動力供給弱化

人口老化為未來世界無法逃避的問題，對勞動力供給的影響將逐漸浮現，且近年來因國內勞工短缺，使國內業者面臨招募不易、人員流動率高及勞動人力結構改變等窘境。

因應措施

該公司提供具競爭力的薪資與福利招募新血，針對員工職涯規畫及專業職能提供完整培訓計畫，使員工更具向心力以為公司留住人才。該公司為因應人口老化與勞動力人口不足等議題，朝著工業 4.0 的方向努力，發展自動化生產流程與設備，希望藉由智慧工廠及智慧製造，能夠解決勞動力供給弱化的問題。

另該公司股票上櫃掛牌後，可提升公司知名度，有利吸引優秀人才之加入，以奠定企業持續成長之基石。

2.技術研發及專利權

(1)取得技術專家之評估意見

本推薦證券商與該公司並未委請技術專家就該公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用。

(2)申請公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，瞭解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近三年度及申請年度截至最近期止研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險

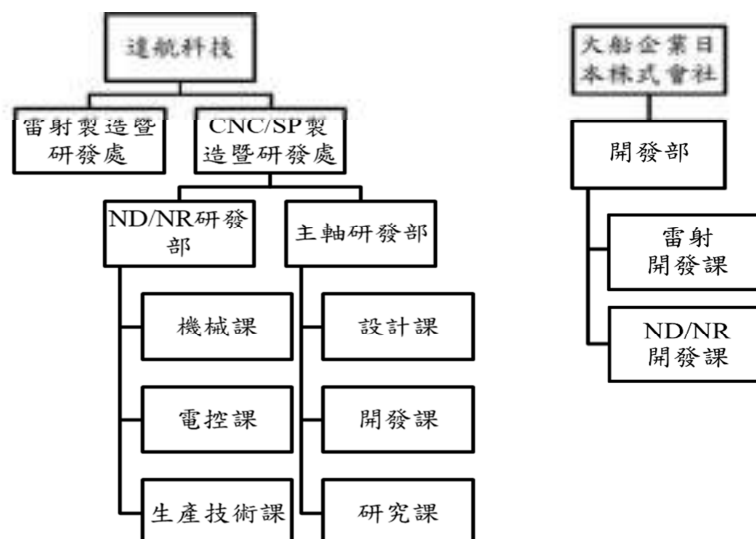
A.研發部門之沿革及組織

該公司成立於民國 80 年，成立初期以印刷電路板(PCB)鑽孔加工及相關機械設備之維修為主要營運項目。為提供客戶整體性的資訊化與自動化服務，於民國 82 年 4 月成立工程部 DNC 組，進行分散式數值控制(DNC)相關之軟體研發工作。85 年藉著與 Hitachi Via 技術合作，累積鑽孔機、成型機及機械鑽孔技術之經驗值，其後分別成立了 ND/NR 研發部及主軸研發部，具有研發製造高速主軸、鑽孔機及成型機的實力。

隨著終端產品愈趨輕薄短小，電路板線路密度愈來愈高，採用的材料也與過去不同，該公司於民國 105 年跨足雷射產業，成立雷射製造暨研發處，雷射鑽孔可依其特性應用於不同材料及製程，特別是傳統機械無法達到的方孔或微孔。該公司自主研發製造雷射鑽孔機，於民國 106 年及 107 年分別開發成功 CO2 雷射鑽孔機及 UV 雷射鑽孔機，並以自製設備為客戶提供專業的代工服務。該公司研發成果顯著，累積眾多專利及實作經驗，近年來更致力於自動化設備之研發、提升主軸性能以及精進雷射鑽孔技術應用。

該公司之研發單位分別設置於達航科技及子公司大船企業日本株式會社（簡稱日本大船），從事鑽孔機、成型機、主軸及雷射事業之研發工作。研發部門組織圖及其執掌如下：

a.研發部門組織圖



b.研發部門各單位職掌

所屬公司	部門單位		工作職掌	研發重心
達航科技	CNC/SP 製造暨研 發處	主軸研發部	主軸產品之研發	針對製程需求研發差異化產能提升解決方案，並針對現有產品持續改善、降低成本，以及提供客製化的技術支援。
		ND/NR 研發部	鑽孔機及成型機之研發	提升設備之加工效率，並增加其自動化的程度。
	雷射製造暨研發處		雷射鑽孔技術之研發	負責處理客戶端之應用面問題，提供客戶技術支援，並彙整無法透過前端調整改善的問題，交由日本大船的研發單位進行解決。
日本大船	雷射開發課		雷射鑽孔設備之研發	依不同領域進行各種新型雷射鑽孔機研發。提升現有設備之加工效率。負責處理客戶端之應用面問題，提供技術客戶技術支援。
	ND/NR 開發課		鑽孔機及成型機之技術改良研發	依日本客戶之需求提升改良設備之加工品質、效率，並增加其自動化的程度。將其成果回饋至母公司，推展應用於海外市場的開拓。

資料來源：該公司提供

B.研發人員學歷分佈、平均年資及流動情形

單位：人

項目		108 年度	109 年度	110 年度
期初人數		34	33	30
新進人數		1	1	0
離職人數		0	3	2
轉入(出)人數		(2)	(1)	0
期末人數		33	30	28
離職率(註)		0.00%	9.09%	6.67%
平均年資		9	10	11
學歷分佈	博士	1	1	1
	碩士	2	2	2
	大學	19	16	14
	專科(含)以下	11	11	11
	合計	33	30	28

資料來源：該公司提供

註：離職率：離職人數/(期末人數+離職人數)

該公司最近三年度研發人員分別為 33 人、30 人及 28 人，平均年資為 9 年、10 年及 11 年，其研發人員學歷具備大學以上學位之比率約占 6 成，且大多為相關系所畢業或具備產業背景，顯示該公司研發人員具備一定程度之專業素養與經

驗。

在研發人員流動情形方面，最近三年度研發部門之離職率分別為 0.00%、9.09%及 6.67%。108 年度無人員離職情形；109 年度離職 3 人，其中一人為未滿試用期之新進人員，其餘二人均為主軸研發部之一般職員，負責產品研發；110 年度離職 2 人，分別為 ND/NR 研發課與雷射研發課之一般職員，負責協助產品研發。

整體而言並無管理階層大幅度異動或研發人員集體離職之情形，且該公司設有健全之技術文件管理制度，並妥善安排人員接手離職人員工作，部分研發人員離職對該公司之營運尚不致產生重大影響。

C.最近三年度及申請年度截至最近期止之研發費用

單位：新臺幣千元

年度	108 年度	109 年度	110 年度
項目			
研發費用	89,147	66,331	65,918
營業收入	1,175,825	1,000,900	1,245,511
研發費用占營業收入比率	7.58%	6.63%	5.29%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

該公司最近三年度研發費用分別為 89,147 千元、66,331 千元及 65,918 千元，占各年度營業收入比重分別為 7.58%、6.63%及 5.29%。研發費用主要為支付日本大船技術支援之勞務費、研發人員之薪資費用及相關設備之折舊費用等支出。109 年度及 110 年度研發費用與其占營業收入比率均較前期減少，係因目前研發目標主係提升現有產品效能及開發自動化相關設備與軟體等，而 108 年度係著重改良雷射鑽孔機，提升速度、優化品質及增加功能等，108 年度所投入之研發成本較高所致。

整體而言，該公司每年持續投入一定金額作為研發支出，精進公司產品及服務之競爭力，並視實際研究需求而增減調整，其研發費用之變化尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

D.重要研究成果

該公司致力於各項產品及技術之精進，茲將該公司重要研發成果及相關內容列示如下：

年度	重要研發成果(技術及產品)	主要用途/應用領域
104	大板 PCB 鑽孔機研發成功	車載板、伺服器、基地台基板
	D10 主軸研發(10 萬轉)	高光加工主軸
	高轉速 30 萬轉主軸	主軸
105	大板 PCB 成型機研發成功	車載板、伺服器、基地台基板
	高轉速 35 萬轉主軸	主軸
106	Vela CO2 雷射鑽孔機開發成功	CO2 雷射鑽孔機

年度	重要研發成果(技術及產品)	主要用途/應用領域
107	新增 ABF 模式與改善 CCD 鏡頭	CO2 雷射鑽孔機
	Vela UV 雷射鑽孔機開發成功	UV 雷射鑽孔機
	F20Q 主軸研發(20 萬轉)	鑽孔機主軸
108	改善 X-VIA 對穿加工、縮減 Over Hang 量、開發二維碼生成加工模式，優化整個加工品質及加工速度	CO2 雷射鑽孔機
	DM、DS 系列鑽孔機新機種研發成功	鑽孔機
	成型機新機種(RM 系列)研發成功	成型機
109	生產工單導入 QR Code，雷鑽機可讀取該 QR Code 進行程式呼叫。	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	雷鑽機的影像辨識系統加入圓邊緣模式，提高當靶孔變形時的影像辨識度。	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	高景深 CCD 對焦模組	鑽孔機、成型機
	Z 軸輕量化鑽孔模組	鑽孔機、成型機
	薄板小孔徑加工技術之開發	CO2 雷射鑽孔機
	降低熱影響之加工技術開發	CO2 雷射鑽孔機
110	2H2P 加工設備原型機(ABF 專用)	CO2 雷射鑽孔機
	2 次元桌面高精度補正技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	UV 高轉速切割技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機

資料來源：該公司提供

(3)主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司深耕產業多年，其主要技術來源係來自研發團隊長期設備開發累積之專業經驗，逐步建立起自有之核心技術，該公司最近三年度及 111 年截至評估報告出具日止，該公司尚無委託外部單位開發主要技術之情事，亦無與其他公司簽訂技術授權合約，或需支付權利金之情形。

(4)研發工作未來發展方向

在印刷電路板產業中，產業的技術發展方向隨著市場主流終端產品的需求持續變化，研發工作之發展方向須配合客戶及市場需求隨時調整。該公司密切關注未來產業動向及發展，研發具有成長性、未來性之產品及技術，該公司研發工作之未來發展方向及預計開發之產品項目臚列如下：

(A)既有設備改良

提升既有設備之效能，提高加工速度與品質，並同時朝著降低成本的目標展開研發工作。

(B)智能車間

開發設備自動化方案，並結合軟體蒐集數據，加強管理調度及提升生產效率等。製程中的資訊亦能為研發團隊所用，成為研發工作之基礎。

(C)以自製零件取代外購零件

為降低仰賴外部供應商的程度，自行開發製造零組件以取代外購零件，除提高自主性外，更能製作出符合需求之零組件。

(D)擴展應用領域

隨著 5G、AI、車用、物聯網等領域的蓬勃發展，帶給印刷電路板產業許多機會與挑戰，因各領域所適用的材料基板不盡相同，需開發新材料基板的加工方法，甚至需開發新型機台。能夠拓展自身產品的應用領域，才能不在印刷電路板產業中被淘汰。

(E)環境保護與循環經濟

環保意識逐漸高漲，該公司亦投入開發節能環保的設備，延長設備使用壽命，並朝廢棄物回收再利用的方向進行研發工作。

(F)預計開發之產品項目：

產品類別	預計開發之產品項目	適用領域
鑽孔機	DM(20 萬轉)二代經濟型機種	IC 載板鑽孔
	DS(20 萬轉)二代高效率機種	IC 載板鑽孔
	自製零件取代外購零件	鑽孔機零件開發
	DS(30 萬、35 萬轉) 二代高效率機種	IC 載板鑽孔
	D6F(16、20 萬轉)線馬達經濟型機種	PCB 鑽孔機
	D6NF(16、20 萬轉)大板線馬達經濟型	PCB 鑽孔機
	鑽孔製程全面自動化方案	鑽孔自動化
成型機	成型自動化方案	PCB 成型加工
主軸	20 萬轉 SPINDLE 效率提升	鑽孔機主軸節能
	35 萬轉 SPINDLE 效率提升	鑽孔機主軸節能
	SPINDLE 零件製程能力提升	整合生產工序、降低生產成本
雷射鑽孔機	UV 高轉速切割技術之開發	UV 雷射鑽孔機
	2 次元桌面高精度補正技術之開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	新畫像處理器開發	CO2 與 UV 雷射鑽孔機
	Vela Co2 雷射鑽孔機 2H2P 設備 (ABF 專用及泛用機型 2 種)	封裝 IC、虛擬貨幣、半導體、汽車技術 應用、高週波對應基板、AIP 等
	Vela Co2 雷射鑽孔機 2P4H 設備 (ABF 專用)開發	封裝 IC、虛擬貨幣、半導體、汽車技術 應用、高週波對應基板、AIP 等
	PICO/FEMTO 雷射加工機開發	5G、6G 通信用封裝 IC、汽車、液晶、半 導體、陶瓷、玻璃、光纖通信等新領域

資料來源：該公司提供

(5)目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，暨因應措施是否合理有效

該公司最近三年度及 111 年起截至評估報告出具日止，並無涉及違反專利權、

商標權及著作權之情事，茲將該公司已登記或取得之專利權、商標權及著作權列示如下：

A.專利權

a.已取得

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區	專利公告號碼	專利權有效期間
1	具冷卻.除塵及斷針偵測之壓力腳裝置	發明	中國	ZL200910204178.7	2009/10/19~2029/10/19
2	植銷設備	發明	台灣	I442989	2014/07/01~2031/06/30
3		發明	中國	ZL201110234868.4	2013/08/28~2031/08/16
4	基板清潔機的防發塵黏輪導移裝置	新型	台灣	M481074	2014/07/01~2024/01/26
5	基板清潔機的防捲清潔輪模組	新型	台灣	M483128	2014/08/01~2024/01/26
6	聯軸器	新型	台灣	M437757	2012/09/21~2022/04/24
7		新型	中國	ZL201220252557.0	2012/05/31~2022/05/31
8	用於多層印刷配線基板的背鑽加工方法及基板加工裝置	發明	台灣	I632007	2018/08/11~2037/05/08
9	電極接合方法	發明	台灣	I349500	2011/09/21~2027/11/01
10		發明	中國	ZL200710188394.8	2007/11/21~2027/11/21
11		發明	韓國	10-0952007	2010/04/01~2028/03/26
12	能改善冷卻及除塵效果的主軸裝置	發明	台灣	I376865	2012/11/11~2028/06/26
13		發明	中國	ZL200810133589.7	2008/07/17~2028/07/17
14	能改善動平衡的主軸裝置	發明	台灣	I379721	2012/12/21~2028/06/26
15	可降低電極圖案製程溫度之旋轉軸	發明	台灣	I362989	2012/05/01~2028/08/05
16	能提高冷卻效果的主軸裝置(F30)	發明	台灣	I386278	2013/02/21~2029/07/20
17		發明	中國	ZL200910204176.8	2009/10/19~2029/10/19
18		發明	日本	5055346	2009/12/17~2029/12/17
19		發明	韓國	10-1071171	2009/12/14~2029/12/14
20	可換刀的小型化心軸單元及主軸裝置(F30)	發明	台灣	I397449	2013/06/01~2029/07/23
21		發明	中國	ZL200910204177.2	2009/10/19~2029/10/19
22		發明	日本	5017383	2010/01/26~2030/01/26
23		發明	韓國	10-1071388	2009/12/22~2029/12/22

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區	專利公告號碼	專利權有效期間
24	襯套式空氣軸承及主軸裝置	發明	台灣	I447314	2014/08/01~2031/11/21
25		發明	中國	ZL201210024042.X	2012/02/03~2032/02/03
26	具有環向貯油溝的夾頭	新型	台灣	M505988	2015/08/01~2025/03/04
27		新型	中國	ZL201520177158.6	2015/08/19~2025/03/27
28	印刷電路版的雷射加工方法及其雷射加工機	發明	台灣	發明第 I705749 號	2020/09/21~2039/12/24
29	基板包裝箱(Vela VP Box)	新型	台灣	M598828	2020/07/21~2030/04/23
30		新型	中國	第 12108056 號	2020/05/13~2030/05/12
31	鑽孔機之共用型基座	新型	台灣	新型第 M617328 號	2021/09/21~2031/04/28
32	鑽孔機之夾板裝置	新型	台灣	新型第 M617326 號	2021/09/21~2031/04/28
33	板件鑽孔機及其輕量化加工主軸裝置與傳動機構	新型	台灣	新型第 M617327 號	2021/09/21~2031/04/28
34	X、Y 軸獨立驅動方式之雷射加工裝置	發明	日本	特願 2012-070468 特許第 5994168 號	2012/03/26~2032/03/26
35	主軸下降距離檢測模組及內建主軸下降距離檢測模組之機板加工裝置	發明	日本	特願 2013-110449 特許第 5807863 號 發明第 I522023 號	2013/05/25~2033/05/25
36	成型加工裝置中所應用之機板固定及更換方法	發明	日本	特願 2014-078268 特許第 6312027 號	2014/04/06~2034/04/06
37	雷射加工方法及雷射加工裝置	新型	日本	特願 2014-100934 特許第 6402895 號	2014/04/23~2034/04/23
38	主軸下降距離偵測模組及內建主軸下降距離偵測模組基板加工裝置	新型	日本	特願 2015-109188 特許第 6425138 號	2015/05/28~2035/05/28
39	應用於多層印刷電路板之背鑽工方法及其機板加工裝置	新型	日本	特願 2015-220845 特許第 6485774 號	2015/11/11~2035/11/11

資料來源：該公司提供

b.申請中

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區
1	PAT 印刷電路版的雷射加工方法及其雷射加工機	發明	中國
2	PAT 印刷電路版的雷射加工方法及其雷射加工機	發明	韓國
3	轉軸下降距離訊息檢測機構和組裝有轉軸下降距離訊息檢測機構的基板加工裝置	發明	台灣
4	轉軸下降距離訊息檢測機構和組裝有轉軸下降距離訊息檢測機構的基板加工裝置	發明	中國

序號	專利權名稱	專利類別	申請國別/地區
5	安裝在印製電路板鐳射加工設備上的光圈中的加工點功率調整方法，以及用以實施該安裝在印製電路板鐳射加工設備上的光圈中的加工點功率調整方法的印製電路板鐳射加工設備	發明	台灣
6	安裝在印製電路板鐳射加工設備上的光圈中的加工點功率調整方法，以及用以實施該安裝在印製電路板鐳射加工設備上的光圈中的加工點功率調整方法的印製電路板鐳射加工設備	發明	中國
7	安裝在印製電路板鐳射加工設備上的光圈中的加工點功率調整方法，以及用以實施該安裝在印製電路板鐳射加工設備上的光圈中的加工點功率調整方法的印製電路板鐳射加工設備	發明	韓國
8	印製電路板的鐳射加工方法及印製電路板的鐳射加工機	發明	台灣
9	印製電路板的鐳射加工方法及印製電路板的鐳射加工機	發明	中國
10	印製電路板的鐳射加工方法及印製電路板的鐳射加工機	發明	韓國
11	工機(印刷基板的雷射加工方法及印刷基板的雷射加工機)	發明	台灣
12	工機(印刷基板的雷射加工方法及印刷基板的雷射加工機)	發明	中國
13	透過鐳射加工在印製電路板上形成切口或凹槽的方法	發明	台灣
14	透過鐳射加工在印製電路板上形成切口或凹槽的方法	發明	中國
15	透過鐳射加工在印製電路板上形成切口或凹槽的方法	發明	韓國
16	印刷基板上利用 CO2 雷射開設孔洞的加工方法	發明	台灣
17	印刷基板上利用 CO2 雷射開設孔洞的加工方法	發明	中國
18	起槽加工裝置的印刷基板的固定方法及起槽加工裝置	發明	台灣
19	起槽加工裝置的印刷基板的固定方法及起槽加工裝置	發明	中國
20	起槽加工裝置的印刷基板的固定方法及起槽加工裝置	發明	韓國
21	鑽孔機之夾板裝置及夾持方法	發明	台灣
22	板件鑽孔機及其輕量化加工主軸裝置與傳動機構	發明	台灣
23	基板搬送方法、具有該基板傳送方法的基板搬送裝置以及具有包括該基板搬送裝置和該基板處理裝置的基板傳送裝置的基板處理裝置。	新型	日本
24	基板之供給及回收方法與包括及個別之基板供給和回收方法、以及具備有加工前處理基板供給裝置和加工後處理基板回收裝置之基板搬送裝置	發明	日本
25	印刷電路板之雷射加工方法及印刷電路板之雷射加工機	發明	日本
26	印刷電路板之雷射加工方法及印刷電路板之雷射加工機	發明	日本
27	主軸下降距離檢測模組及內建主軸下降距離檢測模組之機板加工裝置	發明	日本

資料來源：該公司提供

B.商標權

項次	商標名稱	註冊國別/地區	證書字號	權利期間

項次	商標名稱	註冊國別/地區	證書字號	權利期間
1		台灣	1278910	2006/09/11~2027/08/31
2		台灣	1273711	2006/09/11~2027/07/31
3		台灣	1080112	2003/06/06~2023/12/31
4		台灣	1080113	2003/06/06~2023/12/31
5		台灣	1080114	2003/06/06~2023/12/31
6		台灣	1332131	2007/09/13~2028/09/30
7		台灣	1995005	2018/12/05~2029/06/15
8		中國	35158767	2018/12/07~2029/10/06
9		中國	6274786	2007/09/13~2030/02/13
10		中國	6274785	2007/09/13~2030/03/27
11		中國	6274784	2007/09/13~2030/06/13
12		中國	6274783	2007/09/13~2030/03/27
13		中國	6274782	2007/09/13~2030/06/06
14		中國	6274781	2007/09/13~2030/03/27
15		中國	6274780	2007/09/13~2030/06/13
16		中國	5600275	2006/09/11~2029/07/06
17		中國	5600274	2006/09/11~2029/08/13
18		中國	5600273	2006/09/11~2029/11/20
19		中國	5600272	2006/09/11~2029/12/13
20		中國	5600271	2006/09/11~2029/12/13

項次	商標名稱	註冊國別/地區	證書字號	權利期間
21		中國	5600270	2006/09/11~2029/12/13
22		中國	5600269	2006/09/11~2029/11/20
23		中國	4078895	2004/05/24~2027/05/20
24	ofunagroup	中國	5600267	2006/09/11~2029/08/13
25	OFUNA	中國	4078896	2004/05/24~2027/05/20
26	大船	中國	4078897	2004/05/24~2027/06/20
27		日本	4830904	2004/05/17~2025/01/07
28		日本	5110154	2006/09/20~2028/02/08
29	OFUNATECH	日本	6208823	2018/10/15~2029/12/20
30		日本	5164828	2007/09/14~2028/09/05
31	OFUNA	香港	300215892	2004/05/17~2024/05/16
32	大船	香港	300215900	2004/05/17~2024/05/16
33		香港	300215937	2004/05/17~2024/05/16
34		香港	300717444	2006/09/08~2026/09/07
35		香港	300954351AA	2007/09/14~2027/09/13
36		香港	300954351AB	2007/09/14~2027/09/13
37	OFUNATECH	香港	304736296	2018/11/15~2028/11/14
38		韓國	40-0924155	2010/11/24~2022/06/20

資料來源：該公司提供

(C)著作權：無。

(6)取得申請公司目前重要技術合作契約，就其內容評估對申請公司營運之風險

該公司主要產品之技術係由其研發團隊自行研究開發，最近三年度及 111 年起截至評估報告出具日止，並未有與他人共同開發技術之技術合作並簽訂重要技術合作契約之情事。

3.人力資源之營運風險

(1)申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止依產品別區分之每人每年生產量值表，並就重大變動情形者，加以分析其原因

項目			年度		108 年度		109 年度		110 年度	
					量	值	量	值	量	值
專業服務	生產量值		註		531,515		註	495,223	註	432,021
	直接人員	平均量值	註		2,783		註	3,038	註	2,880
		人數			191		163		150	
	直接及間接人員	平均量值	註		1,709		註	1,788	註	1,662
		人數			311		277		260	
設備產銷	生產量值				96	234,702	52	157,996	100	385,916
	直接人員	平均量值			0.50	1,229	0.32	969	0.67	2,573
		人數			191		163		150	
	直接及間接人員	平均量值			0.31	755	0.19	570	0.38	1,484
		人數			311		277		260	

資料來源：該公司提供

註：該公司產品別「專業服務」，主係鑽孔加工服務及維修保養服務等，其收入屬性偏向客製化、多樣化，非屬標準化製程，故無法針對產量進行統計。

該公司主係從事印刷電路板周邊設備之研發、製造、銷售，以及鑽孔加工與設備維修保養之專業服務，以下茲就設備產銷及專業服務之每人每年生產量值變動說明如下：

A.專業服務

專業服務每人每年生產值 109 年度較 108 年度上升，主係下游廠商面對市場不佳時，減少資本支出之意願，如遇因需求回升而發生產能不足的情況，會選擇將訂單轉給與該公司相同之合格廠商，因此雖受到美中貿易戰與新冠疫情之衝擊，專業服務之產值下滑程度較設備產銷項目小，且該公司透過精實組織架構、廠辦合一等措施增進公司生產效率，使專業服務項目之每人每年生產值上升。110 年度每人每年生產值小幅下降，主係本期下游廠商增加資本支出擴充產能，委託該公司加工之需求下降所致。

B.設備產銷

設備產銷每人每年生產量值 109 年度較 108 年度下降，主係美中貿易戰與新冠疫情對設備產銷項目之衝擊較大，產量與產值均大幅下滑，因市場氣氛充滿不確定性時，下游廠商對資本支出的態度趨於保守，設備訂單減少，公司減少生產

安排所致。110 年度每人每年生產值上升，主係本期下游廠商增加資本支出擴充產能，高精密設備訂單增加，生產量隨之增加所致。

綜上所述，該公司最近三年度之每人每年平均生產量值主係隨市場供需變化而波動，其變動原因尚屬合理，尚無發現重大異常之情事。

(2)申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料，以評估離職率之變化情形及其合理性以及對申請公司營運之風險

A.員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料

單位：人

項目		年度	108 年度	109 年度	110 年度
期	初	人 數	448	311	277
新	進	人 數	46	59	33
離	職	人 數	65	54	33
退	休	人 數	0	0	3
資	遣	人 數	118	39	14
期	末	人 數	311	277	260
員 工 分 類	直 接	人 工	191	163	150
	間 接	人 工	120	114	110
平 均 年 齡 (歲)			41	42	43
平 均 服 務 年 資 (年)			10	11	12

資料來源：該公司提供

該公司最近三年度之員工人數分別為 311 人、277 人及 260 人，人員逐年減少，主係該公司於 108 年起為增進營運效率，透過處分子公司大船煙台股權、調整上海達航之集團定位與人員配置，以及將臺灣區資源整合為廠辦合一，精實組織架構所致。

108 年度資遣人數高達 118 人，主係處分子公司大船煙台股權與調整上海達航之人員配置所致。上海達航東莞分公司因位置及集團定位與東莞達程相似，且營運表現不佳而決定減少人員配置。該年度資遣人員中有 1 名經理級以上人員、40 名一般職員以及 77 名生產線員工，均已依法支付資遣費予以資遣，經評估對該公司營運尚無重大不利之影響。

平均年齡及平均服務年資方面，該公司員工平均年齡為 41 歲至 43 歲，平均服務年資為 10 年至 12 年，均逐年增加，顯示該公司人員穩定性尚佳，組成多為穩定發展中之青壯年，經評估該公司之人力組成尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司員工人數逐年減少，主係該公司為增進營運效率而精實組織架構所致，其期末員工變化原因、平均年齡及平均服務年資經評估尚屬合理。

B.離職率之變化情形及其合理性以及對申請公司營運之風險

單位：人

項目	108 年度			109 年度			110 年度		
	期	末	離職率	期	末	離職率	期	末	離職率
年度	人	數	(%)	人	數	(%)	人	數	(%)
經理級以上	9	1	10.00	9	0	0.00	8	1	11.11
一般職員	137	59	30.10	126	34	21.25	130	14	9.72
生產線員工	165	123	42.71	142	59	29.35	122	35	22.29
合計	311	183	37.04	277	93	25.14	260	50	16.13

資料來源：該公司提供

註 1：離職人數包含資遣及退休

註 2：離職率＝離職人數／（期末人數＋離職人數）

該公司最近三年度之離職人數分別為 183 人、93 人及 50 人，其中經理級以上人員離職情形甚少，僅 108 年度及 110 年度各有 1 名離職。108 年度之離職人員係因無法配合該公司管理單位南遷至臺中之調動，故該公司依勞動基準法規定資遣該員，於法定時間內預先通報並支付資遣費用；110 年度之離職人員因符合退休資格而申請退休，上述人員工作均已由適當人員進行交接，而其他離職人員多為一般職員及生產線員工，該等人員可替代性較高，能視人力需求適時遞補，故上述員工之異動，尚不致對該公司營運產生重大影響。

該公司最近三年度之離職率分別為 37.04%、25.14%以及 16.13%，其中 108 年度離職率偏高，主係處分子公司大船煙台股權與調整上海達航人員配置所致，該年度資遣人員達 118 人，若不考量因營運結構調整而資遣的人員，該年度離職率約為 17.72%，與其他期間相比尚無重大異常情形。

整體而言，該公司經理級以上人員離職情形甚少，顯示其營運階層尚屬穩定，且該公司已建立完整制度，人員離職前須確實完成交接工作，離職人員之工作均有安排適當人員承接，故對該公司營運尚不致產生重大不利影響。

4.各主要產品之成本分析

- (1)取得申請公司最近期及最近三個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素之比率變化對申請公司營運之風險

單位：新臺幣千元；%

項目		108 年		109 年		110 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
專 業 服 務	原料	261,461	47%	326,693	62%	281,956	56%
	直接人工	162,541	29%	102,564	19%	116,572	23%
	製造費用	132,637	24%	99,971	19%	104,926	21%
	小計	556,639	100%	529,228	100%	503,454	100%
設 備 產 銷	原料	154,426	77%	119,492	88%	323,757	91%
	直接人工	23,387	12%	10,446	8%	16,527	5%
	製造費用	23,354	11%	5,725	4%	15,622	4%
	小計	201,167	100%	135,663	100%	355,906	100%

年度		108 年		109 年		110 年度	
項目		金額	%	金額	%	金額	%
其他	原料	-	-	-	-	-	-
	直接人工	-	-	-	-	-	-
	製造費用	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	-
合計	原料	415,887	55%	446,185	67%	605,713	70%
	直接人工	185,928	24%	113,010	17%	133,099	16%
	製造費用	155,991	21%	105,696	16%	120,548	14%
	總計	757,806	100%	664,891	100%	859,360	100%

資料來源：該公司提供

該公司主係從事印刷電路板周邊設備之研發、製造、銷售，以及鑽孔加工與設備維修保養之專業服務等，其產品類別主要可區分為專業服務及設備產銷兩大類。於該公司整體成本結構中，原料所占比重最高，其次為直接人工及製造費用，以下茲就各年度主要產品之成本結構變動情形說明如下：

A.專業服務

專業服務係指鑽孔加工服務及維修保養服務等，鑽孔加工服務係使用該公司自主研發生產之鑽孔機，配合客戶條件加工基板；維修保養服務係指設備機台之維修保養服務，除一般定期維修保養外，亦包含效率提升與設備改造等服務。最近三年度原料占成本比重分別為 47%、62%及 56%，直接人工占成本比重分別為 29%、19%及 23%，製造費用占成本比重分別為 24%、19%及 21%。該公司製造費用占成本比重變化不大，而原料占成本比重於 109 年度及 110 年度上升，主係專業服務會依個案情形會使用不同規格的原料，隨著加工精度與效率的要求提升，原料成本增加所致，經評估該公司專業服務之成本結構變動尚無重大異常之情事。

B.設備產銷

設備產銷係指該公司機械鑽孔機與成型機之生產銷售。最近三年度原料占成本比重分別為 77%、88%及 91%，直接人工占成本比重分別為 12%、8%及 5%，製造費用占成本比重分別為 11%、4%及 4%。109 年度及 110 年度之直接人工與製造費用占成本比重均下降，主係精實組織架構，人員減少，相關人力成本及製造費用降低所致，經評估該公司設備產銷之成本結構變動尚無重大異常之情事。

C.其他

其他項目主係代理類收入，故無原料、直接人力及製造費用等相關成本。

整體而言，該公司最近三年度主要產品別之成本結構尚無發現重大異常之情事，對該公司營運亦未產生重大之營運風險。

(2)建設公司申報募集與發行案件者，取得當（鄰）地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例（如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等），以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，公司與地主之分配比率是否合理

該公司非為建設公司，故不適用此項評估。

5. 匯率變動情形

(1) 最近期及最近三個會計年度兌換損益占營業利益之比率

單位：新臺幣千元

項目	年度	108 年度	109 年度	110 年度
兌換(損)益		(1,970)	3,346	6,282
營業收入		1,175,825	1,000,900	1,245,511
營業利益		46,956	109,352	128,439
兌換(損)益占營業收入比率		(0.17)%	0.33%	0.50%
兌換(損)益占營業利益比率		(4.20)%	3.06%	4.89%

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近三年度兌換(損)益金額分別為(1,970)千元、3,346千元及6,282千元，占各年度營業收入比率分別為(0.17)%、0.33%及0.50%；占各年度營業利益比率分別為(4.20)%、3.06%及4.89%。該公司之營運據點涵蓋臺灣、日本及中國，其銷貨與進貨係以臺幣、美元、人民幣、日圓及歐元做為交易計價之貨幣，於日常營運中需面對多種不同外幣產生之匯率風險，其中受到美金、人民幣及日圓匯率影響較為顯著。

108 年度兌換損失 1,970 千元，主係來自達航科技持有之日圓外幣負債部位以及採日圓計價之進貨交易，108 年度日圓走勢起伏劇烈，年初美中貿易戰衝突緩和，避險情緒降溫，日圓走貶，5 月中美中貿易衝突升溫，避險需求推升日圓匯價，8 月日圓升值至全年最高點 0.2995 元，嗣後市場對美中貿易協商轉趨樂觀，加上 10 月底日本央行調整政策利率前瞻指引，導致日圓貶值，惟全年度日圓整體仍呈升值情形，因此產生兌換損失。

109 年度兌換利益 3,346 千元，主係來自該公司之子公司 CHINA EXPO，而影響其兌換損益最深的是美金兌人民幣之匯率。109 年度受到新冠肺炎疫情影響，市場擔憂未來經濟持續受到衝擊，聯準會宣布寬鬆貨幣政策並降息 4 碼，美元走弱人民幣強勢，全年人民幣兌美元升值幅度約 6.47%，CHINA EXPO 受惠於人民幣強勢升值，產生兌換利益。

110 年度兌換利益 6,282 千元，主係來自達航科技持有之日圓外幣負債部位以及採日圓計價之進貨交易。日圓貶值的原因主係日本央行行為因應新冠疫情，持續維持大規模貨幣寬鬆政策，使日圓 110 年迄今一路貶值，產生兌換利益。

整體而言，該公司兌換損益之變化情形與匯率趨勢相較尚屬合理，且兌換損益占營業收入與營業利益之比重非屬重大，經評估其兌換損益對該公司營運尚不致造成重大影響。

(2) 最近期及最近三個會計年度內外銷、內外購比率

A. 內外銷情形

單位：新臺幣千元

項目	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%

年度 項目	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
內銷	761,600	64.77	725,093	72.44	1,009,214	81.03
外銷	414,225	35.23	275,807	27.56	236,297	18.97
合計	1,175,825	100.00	1,000,900	100.00	1,245,511	100.00

資料來源：該公司提供

該公司最近三年度外銷占營業收入比重分別為 35.23%、27.56%及 18.97%，外銷地區以中國為主，外銷比重逐年下降，主係受美中貿易戰之影響，該公司對中國外銷設備之數量明顯下滑所致。收款幣別採人民幣或美元計價，故外銷比重之多寡，將會改變人民幣與美元對該公司營收與獲利之影響程度。

B.內外購情形

單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
內購	362,301	73.11	357,099	71.74	627,252	77.60
外購	133,239	26.89	140,637	28.26	181,103	22.40
合計	495,540	100.00	497,736	100.00	808,355	100.00

資料來源：該公司提供

該公司最近三年度外購比重分別為 26.89%、28.26%及 22.40%，主係向美國、歐洲及日本等國外廠商採購精密組件，多以美元、歐元或日圓計價，外購比重約占兩成，占比變化不大，美元、歐元與日圓之走勢對該公司營收與獲利將有一定程度之影響。109 年度外購比重上升主係內購金額下滑所致，外購品項多用於雷射鑽孔機，而雷射鑽孔機生產計劃穩定，故外購金額並無大幅變動，而內購品項多為同時用於機械鑽孔機與雷射鑽孔機，因設備產銷訂單減少，且前一年度之庫存尚未消化完畢，導致內購之進貨金額降低。

整體而言，該公司內銷與內購之比重較高，匯率走勢對其營收與獲利之影響尚不致造成重大影響。

(3)申請公司因應匯率變動之避險措施

有鑑於匯率波動變化難以估算，為降低匯率變動對營收與獲利之影響，該公司採取之因應措施如下：

- 在業務訂價過程中，考量因匯率變動產生之影響，以確保利潤目標。
- 採自然避險方式，將外銷所得之外幣貨款，用以支應外購產生之外幣應付款項。
- 於往來銀行開立外幣存款帳戶，因應外匯資金需求保留外幣部位。
- 財務部門隨時注意並掌握外匯市場之變化，以及公司對外幣資金之需求，慎選結匯時機，以期降低匯率變動之風險。

四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

該公司最近期及最近三個會計年度之募集有價證券之籌資效益，請參閱本評估報告「肆、發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有

價證券計畫之執行情形」。

參、就發行人下列業務財務狀況蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、業務狀況

(一)最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象及供應商之變化分析

1.最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象之變化情形並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述該集團之銷售政策

(1)最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象之名稱、金額及占年度合併營業收入比例

單位：新台幣千元

	108 年度			109 年度			110 年度		
	名稱	金額	%	名稱	金額	%	名稱	金額	%
1	C 公司	213,205	18.13	C 公司	252,825	25.26	A 公司	314,010	25.21
2	A-2 公司	142,659	12.13	B 公司	92,269	9.22	B 公司	171,470	13.77
3	A 公司	75,009	6.38	A 公司	52,140	5.21	G 公司	92,078	7.39
4	L 公司	72,577	6.17	D-1 公司	37,205	3.72	D 公司	91,719	7.36
5	A-1 公司	49,379	4.20	A-1 公司	29,409	2.94	C 公司	83,321	6.69
6	F 公司	26,300	2.24	G 公司	28,252	2.82	競國	42,786	3.44
7	M-3	24,406	2.08	I 公司	22,960	2.29	C-1 公司	29,724	2.39
8	瀚宇博德(江陰)	23,926	2.03	瀚宇博德(江陰)	21,504	2.15	A-1 司	26,479	2.13
9	J 公司	23,709	2.02	C-1 公司	19,017	1.90	H 公司	23,002	1.85
10	B 公司	17,655	1.50	J 公司	18,848	1.88	N 公司	18,548	1.49
	小計	668,825	56.88	小計	574,429	57.39	小計	893,137	71.71
	其他	507,000	43.12	其他	426,471	42.61	其他	352,374	28.29
	合計	1,175,825	100.00	合計	1,000,900	100.00	合計	1,245,511	100.00

資料來源：該公司提供

註：以上銷貨客戶與發行人之關係：無。

(2)主要銷售對象之變化原因並分析是否合理

茲就 108 年度、109 年度及 110 年度前十大銷售對象變化情形及原因依照其集團分析如下：

A.C 集團

108 年度、109 年度及 110 年度對 C 集團之銷貨情形

單位：新臺幣千元

公司名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
C 公司	213,205	18.13	252,825	25.26	83,321	6.69
C-1 公司	8,709	0.74	19,017	1.90	29,724	2.39
合計	221,914	18.87	271,842	27.16	113,045	9.08

資料來源：該公司提供。

該公司 108 年度、109 年度及 110 年度對 C 集團之銷售金額分別為 221,914 千元、271,842 千元及 113,045 千元，占銷貨淨額比重分別為 18.87%、27.16%及 9.08%，該公司 108 年度及 109 年度對 C 集團之銷售金額較高，係因受惠於 5G 基礎建設啟動，推升高層數大尺寸之網通載板需求，使得 ABF 載板重新獲得青睞，廣泛被應用於 5G 基礎建設與高階智慧型手機，網通市場仍持續開發高階網通設備、人工智慧、雲端伺服器、天線模組及基地台收發器等高值化產品，使推升 C 公司對該公司之雷射鑽孔應用加工服務訂單成長，致 108 年度、109 年度均位居該公司之第一大銷售客戶，惟 110 年度因 C 公司進行設備汰換計畫，向國外進口之設備陸續交貨，減少對該公司雷射應用加工訂單，致退居至該公司之第五大銷售客戶。另 C-1 因持續提供雷射應用加工服務，於 109 年及 110 年度分別位居該公司九、七大銷售客戶。

B. A 集團

108 年度、109 年度及 110 年度對 A 集團之銷貨情形

單位：新臺幣千元

公司名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
A 公司	75,009	6.38	52,140	5.21	314,010	25.21
A-1 公司	142,659	12.13	16,258	1.62	-	-
A-2 公司	49,379	4.20	29,409	2.94	26,479	2.13
合計	267,047	22.71	97,807	9.77	340,489	27.34

資料來源：該公司提供。

該公司 108 年度、109 年度及 110 年對 A 集團銷售金額分別為 267,047 千元、97,807 千元及 340,489 千元，占銷貨淨額比重分別為 22.71%、9.77%及 27.34%，近年來，A 集團為配合下游客戶中、長期新產品之開發，漸進式地進行產能擴充與製程優化，惟 108 年度 12 月底，因中國大陸湖北省武漢市爆發新冠肺炎，中國大陸各省(市)政府為降低新冠肺炎疫情之蔓延，便展開封城管制禁令，迫使部分工廠停工，且 A-2 於 109 年間，逐漸將設備維修、保養及改造業務委託予單一特定廠商受理，致該公司 109 年度對 A-2 及 A-1 的設備出售及維修訂單減少；110 年度受惠於高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、雲端與新世代 GPU 需求帶動 ABF 產業需求大增，A 集團對該公司高轉速鑽孔機設備需求增加，致 110 年度 A

公司躍居至第一大銷售客戶之列。

整體而言，A 公司及 A-1 公司 108 年度、109 年度及 110 年皆位居該公司前十大銷售客戶排行之列，惟 A-2 公司因 108 年度擴廠完成，且將維修業務委託他廠，109 年度及 110 年度對該公司需求減少，致退出前十大銷售客戶之列。

C. M-3 公司

M-3 公司主要從事各種印刷電路板之製造、銷售，以及 TFT LCD 等產品之 PCB 基板加工組裝業務。該公司對 M-3 公司之銷貨主係提供鑽孔及成型設備販售，以及設備維修保養與雷射應用服務。108 年度、109 年度及 110 年前三季，該公司對 M-3 公司銷售金額分別為 24,406 千元、10,261 千元及 7,276 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.08%、1.02%及 0.58%，該公司 109 年起對 M-3 公司銷售業績逐年遞減，係因雷射應用服務訂單減少。

D.L 公司

L 公司，主要產品包含單面板、雙面板、四層板、多層板、HDI 板等，產品終端應用領域分別為汽車、消費性、工業用及網通，並以汽車板為大宗並為全球第一大汽車板製造商。該公司對 L 公司之銷貨主係提供印刷電路板機械鑽孔及成型設備販售，以及鑽孔設備的維修保養服務。108 年度、109 年度及 110 年度對 L 公司銷售金額分別為 72,577 千元、2,281 千元及 2,395 千元，占銷貨淨額比重分別為 6.17%、0.23%及 0.19%，108 年受惠全球投入電動車的節能及智能化，推升汽車電子多層板的供給量，L 公司分階段擴建產能，致該公司對 L 公司鑽孔機設備的出貨量增加，隨著 L 公司之產能擴建案結束，亦降低設備採購之需求，109 年度起，雙方僅維持設備維修保養服務，L 公司並退出該公司前十大銷售客戶之列。

E. F 公司

F 公司主要經營印刷電路板製造、電子元件及組件製造等業務，包括類載板、高密度互聯板、積體電路封裝基板及相關電子裝聯、微電子及光電產品，其終端應用於通訊、消費性電子產品，如智慧型手機、NB 及數位照相機。該公司對 F 公司之銷貨主係提供機械鑽孔設備及成型設備之維修與保養以及雷射應用服務。108 年度、109 年度及 110 年度該公司對 F 公司銷售金額分別為 26,300 千元、11,500 千元及 11,009 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.24%、1.15%及 0.88%，108 年該公司對 F 公司銷售以雷射應用服務為主，109 年度及 110 年度銷售變化係因雷射應用服務訂單減少，致 F 公司自 109 年起退出該公司前十大主要銷售客戶之列。

F. 瀚宇博德科技(江陰)有限公司(以下簡稱：瀚宇博德(江陰))

瀚宇博德(江陰)，為國內上市公司瀚宇博德股份有限公司(股票代碼：5469)持股 100%之子公司，主要生產雙面至十六層的多層印刷電路板，產品應用於筆記型電腦、行動電話、平面電視、遊戲機、通訊設備、機上盒及伺服器等專用印刷

電路板，其中，以筆記型電腦用板為大宗。該公司對瀚宇博德(江陰)之銷貨主係提供機械鑽孔與成型設備之維修保養服務。108 年度、109 年度及 110 年度該公司對瀚宇博德(江陰)銷售金額分別為 23,926 千元、21,504 千元及 17,347 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.03%、2.15%及 1.39%，瀚宇博德(江陰)工廠位於中國華中及華南廠區生產基地，為優化產能需求而汰換部分老舊設備的零件，故持續對該公司下單，110 年度隨著產線擴增計畫已完工，對該公司減少採購訂單，並退出前十大銷售客戶之列。

G.J 公司

J 公司主要提供硬質單(雙)面印刷電路板、硬質多層印刷電路板、軟質多層印刷電路板及其他印刷電路板之產銷業務，終端應用於 PC/NB、可攜式電子裝置等產品。該公司對 J 公司之銷貨主係提供鑽孔與成型設備產品及維修保養服務。108 年度、109 年度及 110 年度銷貨金額分別為 23,709 千元、18,848 千元及 15,123 千元，占銷貨淨額比重分別為 2.02%、1.88%及 1.21%，於 108 年間，受因美中貿易戰的影響下，使得下游消費性電子大廠的出貨意願降低，且 109 年度因新冠肺炎(COVID-19)於全球肆虐的影響下，致該公司對 J 公司銷售金額逐年遞減，並於 110 年退出前十大銷售客戶之列。

H.B 公司

B 公司，主要從事 IC 封裝用之覆晶晶片尺寸級封裝載板(FCCSP ,Flip Chip-Chip Scale Package)、射頻模組封裝載板(RF modules)、SiP、記憶體應用(Substrate for Memory)、類載板(SLP, Substrate-Like PCB)的研發製造與銷售，終端應用於 5G 通訊、電腦、消費性電子產品。該公司對 B 公司之銷貨主係提供鑽孔及成型設備之維修保養及雷射應用服務。108 年度、109 年度及 110 年該公司對 B 公司銷售金額分別為 17,655 千元、92,269 千元及 171,470 千元，占銷貨淨額比重分別為 1.50%、9.22%及 13.77%，109 年度起對 B 公司之銷售金額持續增加，係因 5G、高效能運算和人工智慧等應用帶動 ABF 載板及 BT 載板的供給需求，以致 B 公司對該公司增加雷射應用服務的訂單需求，整體而言，B 公司 108 年度、109 年度及 110 年度均位居該公司前十大銷售客戶之列。

I. D 集團

108 年度、109 年度及 110 年度對 D 集團之銷售情形

單位：新臺幣千元

公司名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
D 公司	6,890	0.59	8,630	0.86	91,719	7.36
D-1 公司	100	0.01	37,205	3.72	15,020	1.21
合計	6,990	0.60	45,835	4.58	106,739	8.57

資料來源：該公司提供。

D 公司生產基地遍佈臺灣及中國，從早期 PC 使用的多層板 (Multilayer PCB)，升級至智慧裝置使用的 HDI 板與軟硬板 (Rigid-Flex PCB)，並延伸到智慧汽車使用的汽車板，終端應用於智慧手持裝置(手機及無線耳機等)、車用、IT(平板/NB)，另，D-1，係因原 D-1 廠區獲中國大陸政府通知進行遷廠乙案，故於中國大陸江蘇南通設立之新廠，作為因應上海展華廠產能之銜接。該公司對 D 集團之銷貨主係提供機鑽機及成型設備販售，以及鑽孔設備之維修保養服務。

108 年度、109 年度及 110 年對 D 集團之銷售金額分別 6,990 千元、45,835 千元及 106,739 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.60%、4.58%及 8.57%，109 年度因 D-1 於新設廠房銜接原 D-1 的產能，而增加鑽孔機設備採購，D-1 於 109 年成為該公司第四大銷售客戶；另 110 年 D 公司為因應高階 NB 及消費性電子商品及車用電子產品等軟、硬結合板之應用製程需求，增加鑽孔設備採購訂單，故於 110 年成為該公司第四大銷售客戶。

J.G 公司

G 公司主要業務內容為提供機械鑽孔加工服務，該公司對 G 公司之銷貨主係供應機鑽機及成型設備販售，以及鑽孔設備之維修與保養服務。該公司 108 年度、109 年度及 110 年度對 G 公司之銷售金額分別為 461 千元、28,252 千元及 92,078 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.04%、2.82%及 7.39%。109 年度及 110 年度 G 公司為配合下游客戶的高階載板投產製程需求，陸續向該公司增添機台設備，致 G 公司於 109 年度及 110 年均位居該公司前十大銷售客戶之列。

K.I 公司

I 公司為國內上市公司旗下轉投資之子公司，成立於 90 年，主要從事發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷。該公司對 I 公司之銷貨主係提供機鑽機及成型設備販售，以及鑽孔設備之維修與保養服務。該公司 108 年度、109 年度及 110 年度之銷售金額分別為 8,057 千元、22,960 千元及 6,082 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.68%、2.29%及 0.49%，108 年度該公司以維修保養服務訂單服務為主，109 年度係因鑽孔機設備銷售業績成長，另，110 年較 109 年減少 16,876 千元，係因專業服務設備維修、保養訂單減少，退出前十大銷售客戶之列。

L.競國實業股份有限公司 (以下簡稱：競國)

競國生產基地遍佈臺灣及中國，主要從事專業製造雙層、多層印刷電路板且採少量多樣方式生產，終端應用於網路、LED、DRAM 模組、電視、消費性電子、汽車等領域，該公司對競國主係提供機械鑽孔設備販售。該公司 108 年度、109 年度及 110 年度之銷售金額分別為 10,897 千元、12,733 千元及 42,786 千元，占銷貨淨額比重分別為 0.93%、1.27%及 3.44%，該公司於 108 年度、109 年度及 110 年銷貨逐年增加，主係競國汰換部分老舊設備，致該公司鑽孔機訂單增加。

M.H 公司

H 公司主要從事 PCB 鑽孔成型設備及主軸之維修業務，該公司對 H 公司之銷售主係銷售雷射鑽孔設備相關關鍵性零件。最近三年度對 H 公司之銷售金額分別為 2,423 千元、12,842 千元及 23,002 千元，占銷售淨額比重分別為 0.21%、1.28% 及 1.85%。109 年度因雷射鑽孔設備之關鍵性零件出售增加，另 110 年度則因雷射光學零件屬高單價之出售增加，致 110 年度竄升為第十大銷售客戶之列。

N.N 公司

N 公司主要從事印刷電路板的設計及製造，為深圳交易所掛牌公司，該公司主要銷售機械鑽孔設備及維修保養業務，108 年度、109 年度及 110 年對 N 公司之銷售金額 1,018 千元、7,311 千元及 18,548 千元，占銷售淨額比重分別為 0.09%、0.73% 及 1.49%，110 年度 N 公司為配合下游客戶的高階載板投產製程需求，向該公司增添機台設備，故於 110 年度竄升為第十大銷售客戶之列。

(3) 是否有銷售集中之風險

該公司最近三年度前十大銷售客戶占營收比重分別為 56.88%、57.39% 及 71.71%，其中，該公司最近三年度對 C 集團銷售金額分別為 221,914 千元、271,842 千元及 113,045 千元，占各年度銷售收入占比分別為 18.17%、27.16% 及 9.08%，另，對 A 集團銷售金額分別為 267,047 千元、97,914 千元及 340,489 千元，占各年度銷售收入占比分別為 22.71%、9.76% 及 27.34%，該公司銷售金額變化主要受銷售客戶之業績增減變動影響，整體而言，該公司最近三年度前十大銷售客戶占各期間營收比重，並未有單一客戶達三成以上，故該公司最近三年度尚無顯著銷售集中之風險。

(4) 該公司之銷售政策

該公司長年專注於 PCB 鑽孔設備之自製、維修及保養等專業服務市場，且近年來，朝向提供整合性的資訊與自動化服務，以自製產能的專業雷射應用設備服務，使現有客戶生產效率及產品良率大幅提升，故該公司整體服務，源自於創新、專業、務實、誠信及品質主要訴求，從產品研發、改造及鑽孔材質的特性上與客戶產品高度依存，且適時協助客戶解決產線投產設備的問題，因此，該公司仍將持續強化技術支援及解決方案能力，以身為客戶值得信賴的夥伴為該公司主要銷售政策。

2. 最近期及最近三個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額佔當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析主要供應商之變化情形

(1) 主要供應商名稱、進貨淨額及占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新臺幣千元；%

排名	108 年度			109 年度			110 年度		
	供應商名稱	金額	占進貨淨額%	供應商名稱	金額	占進貨淨額%	供應商名稱	金額	占進貨淨額%

1	甲公司	65,909	13.30	甲公司	76,300	15.33	甲公司	59,093	7.31
2	日商清光社	25,907	5.23	戊公司	26,085	5.24	丁公司	49,570	6.13
3	丁公司	25,487	5.14	日商住友電工	18,082	3.63	壬公司	31,029	3.84
4	日商住友電工	19,447	3.92	日商駿河	16,859	3.39	子公司	26,961	3.34
5	戊公司	16,943	3.42	丁公司	16,678	3.35	丙公司	25,874	3.20
6	日商 KANTO	13,224	2.67	日商 S.E.C	13,820	2.78	己公司	25,389	3.14
7	日商駿河	11,953	2.41	日商明治電機	13,430	2.70	日商宝產業	24,519	3.03
8	日商 S.E.C	10,520	2.12	日商宝產業	11,898	2.39	乙公司	22,443	2.78
9	丙公司	10,415	2.10	日商 KANTO	10,035	2.02	丑公司	20,624	2.55
10	日商明治電機	10,352	2.09	辛公司	8,369	1.68	山洋電氣	20,427	2.53
	小計	210,157	42.41	小計	211,556	42.51	小計	305,929	37.85
	其他	285,383	57.59	其他	286,180	57.49	其他	502,426	62.15
	進貨淨額	495,540	100.00	進貨淨額	497,736	100.00	進貨淨額	808,355	100.00

資料來源：該公司提供

註：以上供應商與發行人之關係：無。

(2) 最近期及最近三個會計年度主要供應商變化情形之原因及分析是否合理

該公司 108~ 110 年度之進貨淨額分別為 495,540 千元、497,736 千元及 808,355 千元，主要進貨原物料為雷射頭、電子掃描鏡、鑄物、控制器及螺桿等，該公司之生產模式係依客戶訂單及計劃性生產，生產客製化設備，除各事業部產品皆採用之原物料外，對供應商之採購項目及金額隨當年度承接設備規格不同而有變化，以下茲就各年度供應商變化情形概述如下：

A. 甲公司

甲公司成立於民國 95 年，實收資本額為美金 1 千元，主要銷售及製造雷射頭，為美國那斯達克掛牌 Coherent, Inc(交易代號 COHR)旗下之子公司，Coherent, Inc 為全球最大的雷射儀器產品及相關光電子產品製造商，主要應用於科學研究、醫療、工業等多項行業。

該公司自 103 年開始與甲公司交易往來，主要向甲公司進貨雷射機台使用之雷射頭，該公司 108~ 110 年度向甲公司進貨金額分別為 65,909 千元、76,300 千元及 59,093 千元，占進貨淨額比率分別為 13.30%、15.33%及 7.31%，109 年度進貨淨額較 108 年度增加 10,390 千元，主要係持續增加雷射機台組裝因而增購雷射頭，且維修件亦增加故金額較前期為高，110 年則較 109 年度減少係雷射機生產計劃調整，各年度均居於第一大供應商之列，尚無重大異常之情事。

B. 丙公司

丙公司成立於民國 83 年，實收資本額為新臺幣 469,500 千元，主要從事 CNC 工具機本體鑄件、各式鑄鐵及鑄鋼產品的製造及銷售，該公司自 102 年開始與丙公司交易往來，主要向其採購鑄物供應鑽孔機與成型機(ND/NR)生產，該公司 108~110 年度向丙公司進貨金額分別為 10,415 千元、1,414 千元及 25,874 千元，占進貨淨額比率分別為 2.10%、0.28%及 3.20%，109 年度年度進貨淨額較 108 年度減少 9,001 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年進貨較 109 年度增加，係因客戶銷貨需求增加，致使 110 年度占比達到 3.20%，尚無重大異常之情事。

C. 丁公司

丁公司成立於民國 51 年，位於德國，主要銷售及製造用於 CNC 控制器，產品範圍可用於機械結構和自動化技術的控制器，用於各種驅動器的伺服放大器，用於高速電動機和發電機的變頻器。該公司自 102 年開始與丁公司交易往來，主要向其採購控制器供鑽孔機與成型機(ND/NR)使用，該公司 108~110 年度向丁公司進貨金額分別為 25,487 千元、16,678 千元及 49,570 千元，占進貨淨額比率分別為 5.14%、3.35%及 6.13%，109 年度進貨淨額較 108 年度減少 8,809 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年度進貨金額增加係因新規格的鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

D. 株式会社清光社(簡稱：日商清光社)

日商清光社成立於民國 34 年，位於日本東京，主要銷售軸承、線性零件、電源、傳導電源及精密加工或組裝等產品。該公司自 103 年開始與日商清光社交易往來，主要向其採購螺桿零件，108~110 年度該公司向日商清光社進貨金額分別為 25,907 千元、4,218 千元及 7,442 千元，占進貨淨額比率分別為 5.23%、0.85%及 0.92%，109 年度進貨淨額呈現下滑的趨勢，主係該公司產品轉換使用線性馬達，致使需求下滑，110 年度進貨金額增加原因係因新規格的鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

E. 丑公司

丑公司成立於民國 77 年，主要從事各種工業用溫度控制設備，如：油冷卻機、水冷卻機、熱交換器、空調冷卻機及油霧回收機等。該公司 98 年度開始與該集團有往來，109 年以前係要向其關係企業超聖精密工業有限公司(以下簡稱超聖精密)採購油冷卻機作為鑽孔機週邊設備，108 年及 109 年該公司向超聖精密採購金額分別為 3,460 千元及 1,008 千元，109 年起度超聖精密進行內部整合，該公司轉而向丑公司採購，109 年及 110 年採購金額分別為 4,917 千元及 20,624 千元，故該公司 108 年~110 年向該集團進貨金額分別為 3,460 千元、5,925 千元、及 20,624 千元，占進貨淨額比率分別為 0.70%、1.19%及 2.55%，110 年對丑公司採購金額大幅增加係鑽孔機生產計劃需求增加所致。

F. 己公司

己公司成立於民國 93 年，主要製造金屬製品、機械鈹金外罩、電控箱、車床外罩及精密機械鈹金等。該公司自 97 年開始與己公司交易往來，主要向其採購鈹金件，108~ 110 年度該公司向己公司進貨金額分別為 5,748 千元、1,599 千元及 25,389 千元，占進貨淨額比率分別為 1.16%、0.32%及 3.14%，109 年度進貨淨額較 108 年度減少 4,149 千元，主係該公司為消耗 107 年度庫存，因而減少進貨，110 年進貨金額增加，係因鑽孔機生產計劃增加，致使當期進貨金額占比達到 3.14%，尚無重大異常之情事。

G. 戊公司

戊公司成立於民國 92 年，主要銷售及製造雷射雕刻加工機設備相關零組件、雷射加工機特殊光源及雷射光學鏡組產品等。該公司自 99 年開始與戊公司交易往來，主要向其採購電子掃描鏡，108~110 年度該公司向戊公司進貨金額分別為 16,943 千元、26,085 千元及 20,097 千元，占進貨淨額比率分別為 3.42%、5.24%及 2.49%，109 年度進貨淨額分別較前期增加 9,142 千元，主要該公司增加雷射機台組裝及雷射加工服務，因而增購電子掃描鏡之採購，110 年雷射機生產計劃調整進貨金額較 109 年度減少，尚無重大異常之情事。

H. KANTO CO., LTD (簡稱：日商 KANTO)

日商 KANTO 成立於民國 44 年，位於日本，主要從事機械零件的銷售，如：自動省力設備，工業設備零件，汽車零件和密封裝置。該公司自 95 年開始與日商 KANTO 交易往來，主要向其採購滑軌，108~ 110 年度該公司向日商 KANTO 進貨金額分別為 13,224 千元、10,035 千元及 15,900 千元，占進貨淨額比率分別為 2.67%、2.02%及 1.97%，該公司 107 年度售後服務代理零件需求較高，108~年起需求減少，因而減少進貨，110 年度進貨較 109 年度增加 5,865 千元，係售服維修需求增加，尚無重大異常之情事

I. 住友電氣工業株式会社(簡稱：日商住友電工)

日商住友電工成立於民國前 15 年，位於日本大阪市，主要銷售及製造汽車相關業務、信息與通信相關業務、電子相關業務、環境與能源相關業務及工業材料相關業務之光學零件，並在東京證券交易所、名古屋證券交易所及福岡證券交易所皆有掛牌上市(證券代號：5802)，日商住友電工係為日本住友集團旗下的一家電子零件製造商。該公司自 102 年開始與日商住友電工交易往來，主要向其採購光學零件鏡面，108~ 110 年度該公司向住友電氣進貨金額分別為 19,447 千元、18,082 千元及 0 千元，占進貨淨額比率分別為 3.92%、3.63%及 0.00%，該公司各年度皆有採購日商住友電工之產品，屬廣泛使用之原物料供應商，108~109 年度進貨金額變化不大，109 年度因日商住友電工業務型態變更，故改向住友集團旗下之子公司日商宝產業採購。

J. 駿河マシンサービス株式会社(簡稱：日商駿河)

日商駿河成立於民國 51 年，位於日本靜岡縣，主要從事各種機械加工、機械零件、工業機械零件及電子設備製造相關，係為 Marusun Suruga 集團旗下之子公司，Marusun Suruga 集團主要從事設計和製造各種壓模、注塑模、熱模模、FRP 和 SPM 模等。該公司自 107 年開始與日商駿河交易往來，主要向其採購鑄物，108~110 年度該公司向日商駿河進貨金額分別為 11,953 千元、16,859 千元及 14,718 千元，占進貨淨額比率分別為 2.41%、3.39%及 1.82%，109 年度進貨淨額較 108 年度增加 4,906 千元，主要係因該公司增加雷射機台組裝，故進貨需求增加，110 年度因雷射機生產計劃調整，故進貨金額較 109 年度減少。

K. 株式会社スリーエンジニアリング(簡稱：日商 S.E.C)

日商 S.E.C 成立於民國 75 年，位於日本群馬縣，主要從事設計、製造及加工精密機器。該公司自 104 年開始與日商 S.E.C 交易往來，主要向其採購底板及壓腳鉗，108~110 年度該公司向日商 S.E.C 進貨金額分別為 10,520 千元、13,820 千元及 11,896 千元，占進貨淨額比率分別為 2.12%、2.78%及 1.47%，109 年度較 108 年度進貨金額增加係因該公司增加雷射機台組裝，故進貨需求增加，110 年度雷射機生產計劃調整故進貨金額較 109 年度減少。

L. 明治電機工業株式會社(簡稱：日商明治電機)

日商明治電機成立於民國 9 年，總部設在日本名古屋，主要營業項目為銷售電氣設備，其產品有逆變器、控制器、測量系統、儀表、斷路器、直流和交流電源等設備，並在東京證券交易所掛牌上市(證券代號：3388)。該公司自 95 年開始與日商明治電機交易往來，主要向其採購 CCD 圖像處理器及鏡頭用在雷射機台，108~110 年度該公司向日商明治電機進貨金額分別為 10,352 千元、13,430 千元及 15,978 千元，占進貨淨額比率分別為 2.09%、2.70%及 1.98%，109 年度進貨淨額較 108 年度增加 3,078 千元，主要係因雷射機台生產數量較 108 年度多，故進貨需求增加，110 年度係新規格鑽孔機銷售量及訂單增加，故增加採購，尚無重大異常之情事。

M. 宝産業株式会社(簡稱：日商宝産業)

日商宝産業成立於民國 28 年，位於日本大阪市，主要光學零件鏡面等之代理銷售等。日商宝産業為日本住友集團之一，該公司主要向其採購光學鏡面等零件，109 年度及 110 年度該公司向日商宝産業進貨金額分別為 11,898 千元及 24,519 千元，占進貨淨額比率分別為 2.39%及 3.03%，日商宝産業為該公司 109 年度起新增之供應商，原向日商住友電工採購之光學鏡面等零件，因日商住友電工業務型態變更，故改向日商宝産業採購，合併 109 年度日商住友電工及日商宝産業進貨金額共計 29,980 千元，較 108 年度進貨增加係因該公司看好雷射加工技術之市場潛力，調增雷射鑽孔機之計畫生產量，採購需求上升所致，致使進貨增加，110

年度因雷射機生產計劃調整，故進貨金額較 109 年(日商住友電工加計日商宝產業)減少，尚無重大異常之情事。

N.辛公司

辛公司成立於民國 88 年，主要從事各式橡膠滾輪、矽膠滾輪、優力膠滾輪之開發製造及相關零組件加工。該公司自 106 年開始與辛公司交易往來，主要向其採購清潔滾輪，108~ 110 年度該公司向辛公司進貨金額分別為 10,057 千元、8,369 千元及 9,179 千元，占進貨淨額比率分別為 2.03%、1.68%及 1.14%，109 年度進貨淨額較 108 年度減少 1,688 千元，主要係客戶端需求減少，因而進貨需求降低，110 年度與 109 年度差異不大。

O.乙公司

乙公司成立於民國 88 年，主要從事電子產業自動化設備與整廠物流規劃與智能自動化整合服務，該公司自 103 年開始與乙公司交易往來，主要向其採購投收板機，108~ 110 年度該公司向乙公司進貨金額分別為 3,137 千元、3,029 千元及 22,443 千元，占進貨淨額比率分別為 0.63%、0.61%及 2.78%，108~109 年度進貨淨額較少，係因配合雷射機台週邊使用，而有所變動，110 年度進貨金額占比增加至 2.78%，主係投產產品需求改變，導致投收板機的需求增加。

P.壬公司

大壬公司成立於民國 86 年，為臺灣證券交易所掛牌公司，主要從事精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售，該公司主要向其採購線性馬達，108~ 110 年度該公司向壬公司進貨金額分別為 4 千元、3,880 千元及 31,029 千元，占進貨淨額比率分別為 0%、0.78%及 3.84%，110 年度係因新規格鑽孔機銷售量及訂單增加，致使進貨需求增加。

Q.山洋電氣株式會社(簡稱：日商山洋電氣)

日商山洋電氣成立於 1936 年，總部位於日本東京，為東京證券交易所一部掛牌公司，產品包括散熱風扇、UPS、電源供應器、伺服器馬達、馬達、發電設備，該公司主要向其採購線性馬達、伺服控制器，1108~110 年度該公司向日商山洋電氣進貨金額分別為 2,301 千元、6,862 千元及 20,427 千元，占進貨淨額比率分別為 0.46%、1.38%及 2.53%，110 年度係因新規格鑽孔機銷售量及訂單增加，致使進貨需求增加。

R.子公司

子公司成立於民國 77 年，主要從事工作母機鑄件、電子機械鑄件、產業機械鑄件，該公司主要向其採購鑄物作為機台與工作台底座，108~ 110 年度該公司向子公司進貨金額分別為 2,482 千元、2,540 千元及 26,961 千元，占進貨淨額比率分別為 0.50%、0.51%及 3.34%，109 年度與 108 年度進貨金額差異不大，110 年度進貨金額增加主係鑽孔機生產計劃增加。

(3)是否有進貨集中之風險

該公司 108~110 年度向前十大供應商進貨金額占該公司整體進貨淨額比率分別為 42.41%、42.51%及 37.85%。前十大供應商個別進貨比率最高者之進貨金額占整體進貨比率為 15.33%，足見該公司並無進貨集中於特定供應商之情事。該公司原料之採購政策為分散供應商，部份常用料件皆有至少兩家以上的供應商提供採購，應無進貨集中之風險；且該公司與供應商長期維持良好之合作關係，以確保貨源之穩定性及自主性，因此供貨狀況良好，尚無因原料短缺而有生產中斷之虞。

(4)進貨政策

- A.該公司之生產方式為接單式及計劃性生產，以各年度預測客戶之需求訂定安全庫存量而備貨，大約會備 1 至 3 個月之庫存量。
- B.該公司每季定期召開產銷會議，依據營業單位之訂單情況、存貨庫存數量、市場供需情況、購料前置時間等因素作為備料依據再決定採購事宜。
- C.部份常用料件如鑄物、螺桿、滑軌及鈑金供應商至少維持兩家以上，以分散進料供應商物料短缺風險。
- D.一般原物料、商品及客製化之規格料件之採購，皆須進行詢、比、議價。
- E.該公司定期依據產品品質、交期、成本優勢、履行誠信、服務效率對供應商進行評比，亦不定期與現有之供應商進行議價以降低進貨成本。

(二)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告應收款項變動合理性、母子公司備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	109 年度		110 年度	
	個體	合併	個體	合併
營業收入淨額	844,725	1,000,900	1,110,429	1,245,511
應收票據	2,550	13,283	6,672	18,613
應收帳款	154,707	256,388	123,432	182,185
應收帳款-關係人	21,174	-	8,759	-
應收款項總額	178,431	269,671	138,863	200,798
備抵呆帳提列數	(1,749)	(10,046)	(6,228)	(9,607)
應收款項淨額	176,682	259,625	132,635	191,191
應收款項週轉率(次)	4.27	3.23	7.00	5.30
應收款項收現日數(日)	85	113	52	69

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告及個體財務報告

(1) 個體應收款項及應收款項週轉率變動原因

該公司 110 年度營業收入較 109 年度增加 265,704 千元，變動幅度為 31.45%，係因下游印刷電路板廠為因應 5G 產品製程設備之需求，致增加對該公司之設備產銷訂單，然該公司 110 年度應收帳款總額卻較 109 年度減少 39,568 千元，變動幅度 (22.18)%，係因該公司之設備產銷交易採預收部分貨款後再出貨所致，而

應收款項週轉率方面，該公司 109 年度及 110 年分別為 4.27 次及 7.00 次，收款日數分別 85 天及 52 天，110 年度應收款項週轉率較 109 年度成長 63.93%，係因 110 年度設備產銷產品採預收部分貨款，致 110 年底較 109 年底之收款天數縮減 33 天。

(2) 合併應收款項及應收款項週轉率變動原因

該公司 110 年度營業收入較 109 年度成長 24.44%，然 110 年度應收帳款總額 200,798 千元較 109 年度 269,671 千元減少 68,873 千元，變動幅度 (25.54)%，係因 110 年度之設備產銷比重拉高，然該公司設備銷貨款採預收部分貨款方式所致。

應收款項週轉率方面，該公司 109 年度及 110 年度之應收款項週轉率分別為 3.23 次及 5.30 次；應收款項收現天數分別 113 天及 69 天，110 年度應收款項週轉率較 109 年度提升 38.94% 且收款天數亦縮減 44 天，係因設備產銷貨款採部分預收方式所致。

整體而言，該公司 109 年度及 110 年度之應收款項總額及應收款項週轉率之變動係因設備產銷採部分預收貨款方式之影響所致。

2. 個體/合併公司備抵呆帳提列之適足性之評估

(1) 備抵呆帳提列政策

該公司之備抵損失提列政策，依應收款項於授信期間天數所制定不同的備抵呆帳提列比率如下：

A、備抵呆帳提列政策(授信期間內，即未逾期)

帳齡	30 天內	31-60 天	61-90 天	91-180 天	181-365 天	一年以上
提列%	0%	1%	2%	5%	25%	50%

資料來源：該公司提供。

B、逾期部分，則採用「建構式機率」模型(統計模型)設算公式如下：

應收款項餘額-應收期望值(註1)=備抵呆帳提列損失

註1、逾期餘額 X 回收率(採累積常態分配)

由於，該公司存續期間之預期信用損失係考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況，但合併公司之信用損失歷史經驗，顯示不同客戶群之損失型態並無顯著差異，故未進一步區分客戶群，僅以應收款項(應收票據及帳款)天數，所訂定之預期信用損失率；另，逾期之應收票據及帳款，則按客戶依歷史經驗計算預期信用

損失率，以下茲將該公司 109 年度 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日之個體與合併財務報告之應收帳款及票據備抵呆帳提列，分別列示如下：

(A)個體應收帳款及票據之帳齡備抵損失提列情形

帳齡天期	未逾期						逾期	清算、合併及財務困難
	1-30 天	31-60 天	61-90 天	91-180 天	181-365 天	一年以上		
提列比例-109 年度	-	1.418%	15.454%	7.918%	-	-	93.654%	100%
提列比例-110 年度	-	1%	2%	5%	25%	-	50%	100%

資料來源：該公司提供。

(B)合併應收帳款及票據之帳齡備抵損失提列情形

帳齡天期	未逾期						逾期	清算、合併及財務困難
	1-30 天	31-60 天	61-90 天	91-180 天	181-365 天	一年以上		
提列比例 (109 年度)	-	1.241%	4.417%	5.379%	24.994%	-	51.386%	100%
提列比例 (110 年度)	-	1%	2%	5%	25%	-	50.80%	100%

資料來源：該公司提供。

依 IFRS 9 規定，評估逾期超過一年之帳款為確定不收回之款項為基準，該公司 109 年度及 110 年度預期信用損失均為 0 元，尚無需提列，該公司 109 年度及 110 年度之個體備抵呆帳總額分別為 1,749 千元及 6,228 千元，另該公司 109 年度及 110 年度之合併備抵呆帳總額分別為 10,046 千元及 9,607 千元，故其備抵呆帳提列，尚稱適足。

綜上所述，該公司個體財務報告及合併財務報告之應收票據及應收帳款，係按存續期間之預期信用損失認列備抵損失，另，備抵呆帳之政策，係考量歷史收款經驗、期後收款情形及逾期帳款收回之可能性，透過個別檢視是否有逾期帳款，若有逾期帳款，每月亦會檢討應收款項收回狀況並定期追蹤，確認是否有信用風險及其因應措施，故該公司之備抵呆帳提列政策應尚屬合理。

(2)備抵呆帳提列之適足性

單位：新台幣千元；%

項目	109 年度		110年度	
	個體	合併	個體	合併
備抵呆帳總額(A)	1,749	10,046	6,228	9,607
應收帳款總額(B)	178,431	269,671	138,863	200,798
備抵呆帳占應收帳款總額比例(A/B；%)	0.98	3.73	4.48	4.78

資料來源：該公司提供。

該公司 109 年度及 110 年度個體備抵損失餘額分別為 1,749 千元及 6,228 千元，占各年度個體應收款項總額之比重分別為 0.98%及 4.48%，備抵呆帳提列，逐年呈現下滑趨勢，故回收狀況，尚屬良好；

另，該公司 109 年度及 110 年度合併備抵呆帳總額分別為 10,046 千元及 9,607 千元，占應收帳款總額分別為 3.73%及 4.78%，經評估該公司 109 年度及 110 年度曾發生二筆實際壞帳之情事，分別為 109 年度上海達航銷售客戶銅陵市超遠科技及煙臺希邁思電子，所產生實際呆帳金額分別為人民幣 68 千元(折合新臺幣 296 千元)及人民幣 9 千元(折合新臺幣 41 千元)，整體而言，該公司依據提列政策確實估列備抵金額，故其備抵呆帳提列，尚稱適足。

3.應收款項收回可能性

應收款項期後收回情形

單位：新台幣元

項目		110.12.31 金額	截至 111.02.28 之收回情形		截至 111.02.28 之未收回情形	
			金額	%	金額	%
個體	應收票據總額	6,672	3,225	48.34	3,447	51.66
	應收帳款總額	132,191	59,234	44.81	72,957	55.19
	合計	138,863	62,459	44.98	76,404	55.02
合併	應收票據總額	18,613	4,235	22.76	14,378	77.24
	應收帳款總額	182,185	80,114	43.97	102,071	56.03
	合計	200,798	84,349	42.01	116,449	57.99

資料來源：該公司 110 年度經會計師查核財務報告;該公司提供。

該公司 110 年 12 月底之個體應收款項截至 111 年 02 月 28 日止已收回 62,459 千元，收回比率為 44.98%，未收回金額為 76,404 千元，比率為 55.02%;未收回帳款中尚未逾期之金額為 75,970 千元，占未回收金額比率 99.43 %，均於授信範圍之內，逾期金額為 434 千元，占未回收金額比率為 0.57%，係為達航科技韓國分公司之客戶 New Ace Flex Co., Ltd 之未收回款項，目前該公司亦透過催收程序積極收回當中，並已全數提列為備抵損失，故該公司 110 年 12 月底應收款項之回收可能情形，尚未發現重大異常之情事。

該公司 110 年 12 月底之合併應收款項餘額截至 111 年 2 月 28 日止已收回金額與比率分別為 84,349 千元及 42.01%，未收回金額及比率分別為 116,449 千元及 57.99%；未收回應收款項 116,449 千元中，未逾期金額及比率分別為 112,524 千元及 96.63%，逾期金額及比率分別為 3,925 千元及 3.37%，逾期未收回主要有客戶 New Ace Flex Co., Ltd.已倒閉進入催繳款項作業中，逾期金額為 198 千元，另部分客戶未如期付款因而協議採分期付款支付方式支付，而有逾期未收回之情事。

該公司就前述逾期且尚未收回之應收款項，已依其內部作業程序加強催收作業，並針對逾期未回收款，已依備抵呆帳提列政策辦理，經評估該公司應收帳款回收可能

性應屬可期，故尚無重大異常之情事。

4.與同業之比較

項目	公司名稱 \ 年度	109 年度		110 年度	
		個體	合併	個體	合併
應收款項週轉率(次)	達航	4.27	3.23	7.00	5.30
	大量	2.14	1.55	2.38	2.32
	凱崑	4.30	1.81	註 1	註 1
	尖點	5.48	2.64	4.62	3.06
應收款項週轉天數(天)	達航	85	133	52	69
	大量	170	236	153	157
	凱崑	85	203	註 1	註 1
	尖點	67	139	79	119
應收款項總額	達航	178,431	269,671	138,863	200,798
	大量	728,571	1,644,245	979,053	2,182,324
	凱崑	213,794	704,007	註 1	註 1
	尖點	175,396	1,099,567	338,250	1,374,512
備抵呆帳	達航	1,749	10,046	6,228	9,607
	大量	9,741	133,103	11,568	69,237
	凱崑	394	10,871	註 1	註 1
	尖點	-	5,069	-	-
備抵呆帳佔應收款項總額比率(%)	達航	0.98	3.73	4.48	4.78
	大量	1.34	8.10	1.18	3.17
	凱崑	0.18	1.54	註 1	註 1
	尖點	-	0.46	-	-

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之財務報告合併及個體財務報告。

註 1：截至評估報告出具日止，尚未出具 110 年度經會計師查核簽證之財務報告。

(1)個體財報

該公司 109 年度及 110 年度之個體應收款項週轉率分別為 4.27 次及 7.00 次，個體應收帳款收現天數分別為 85 天及 52 天，尚介於個體財務報告之平均授信期間 110 天內，與採樣同業相較，優於同業水準間。

另，該公司 109 年度及 110 年度之個體備抵損失占應收款項總額比率分別為 0.98%及 4.48 %，與採樣同業相較，109 年度及 110 年度，尚介於同業水準區間，由於，採樣同業之客戶結構、過往之違約紀錄與現時財務狀況及授信政策不盡完全相同，且考量各區域之經濟情勢及產業情勢所產生之差異，經評估該公司之個體應收帳款週轉率、收現天期及備抵呆帳提列適足與採樣同業相較，尚未發現有重大異常之情事。

整體而言，該公司歷年來收款狀況良好，109 年度及 110 年度，除臺灣達航科技之韓國分公司的銷售客戶 Win Tech 發生倒閉，致產生呆帳金額為 282 千元，並經執行債權請求寄發存證信函外，尚未發現有重大異常之情形。

(2)合併財報

該公司 109 年度及 110 年度之合併應收款項週轉率分別為 3.23 次及 5.30 次，合併應收帳款收現天數分別為 113 天及 69 天，與採樣同業相較，該公司 109 年度及 110 年度之應收款項週轉率及收款天期，優於同業水準間，另，該公司 109 年度及 110 年度合併備抵損失占應收款項總額比率分別為 3.73%及 4.78%，與採樣同業相較，尚介於同業水準區間，經評估該公司之合併應收帳款週轉率、收現天期及備抵呆帳提列適足率與採樣同業相較，尚未發現有重大異常之情形。

整體而言，該公司歷年來收款狀況良好，惟 109 年上海達航客戶銅陵市超遠科技及煙臺希藹思電子，產生實際呆帳金額分別為人民幣 68 千元(折合新臺幣 296 千元)及人民幣 9 千元(折合新臺幣 41 千元)外，經檢視評估期後帳款收回情形，尚未發現有重大異常之情形。

(三)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、母子公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

1.最近期及最近二個會計年度個體及合併財務報告存貨淨額變動合理性

單位：新台幣千元

項 目	個 體		合 併	
	109 年度	110 年度	109 年度	110 年度
1.營業收入淨額	844,725	1,110,429	1,000,900	1,245,511
2.營業成本	556,474	764,498	664,891	859,360
3.存貨總額	424,305	598,903	513,775	689,391
4.備抵跌價及呆滯損失	(46,021)	(56,163)	(62,987)	(76,540)
5.存貨淨額	378,284	542,740	450,788	612,851
6.存貨週轉率(次)	1.48	1.66	1.39	1.62
7.存貨週轉天數(天)	247	220	263	226

資料來源：該公司110年度經會計師查核簽證之合併及個體財務報告。

註1：存貨週轉率係採存貨淨額計算之。

該公司主要經營 PCB(印刷電路板) 鑽孔機及成型機設備研發、製造和銷售、設備售後維修，以及雷射鑽孔加工技術與服務。該公司產品主要係依銷貨客戶需求而自製客製化設備，存貨的增減狀況與銷貨客戶訂單量及交期息息相關，其存貨組成可分類為原物料、在製品、製成品及代理存貨四大類，以下茲就該公司個體及合併財務報表之存貨淨額變動合理性說明如下：

(1)個體存貨

109 年度及 110 年底之個體存貨總額分別為 424,305 千元及 598,903 千元，期末存貨淨額分別為 378,284 千元及 542,740 千元，110 年底較 109 年底存貨總額增加 41.15%，主要為在製品及製成品存貨上升，在製品增加係因本年度投產隨接單量上升，而製成品部份係因部份設備客戶尚未驗收，該設備尚未轉成本所致，並無重大異常。

在存貨週轉率方面，該公司個體財務報告 109 年度及 110 年底之存貨週轉率分別為 1.48 次及 1.66 次，週轉天數分別為 247 天及 220 天，110 年底較 109 年度存貨週轉率略微上升，主係該公司 110 年度營業成本較 109 年度增加 37.38%，致使存貨週轉率略微上升應屬合理。

(2)合併存貨

該公司個體存貨占該公司合併存貨約占 8 成左右，其存貨增減變化仍以該公司個體財務報告為主，茲就該公司合併存貨變化原因說明如下：

109 年度及 110 年底合併存貨總額分別為 513,775 千元及 689,391 千元，期末存貨淨額分別為 450,788 千元及 612,851 千元，110 年底較 109 年底存貨總額增加 34.18%，主要為在製品及製成品存貨上升，在製品增加係因本年度投產隨接單量上升，而製成品部份係因部份設備客戶尚未驗收，該設備尚未轉成本所致，並無重大異常。

在存貨週轉率方面，該公司 109 年度及 110 年度之週轉率分別為 1.39 次及 1.62 次，存貨週轉天數分別為 263 天及 226 天，110 年度較 109 年度存貨週轉率略微上升，主係該公司 110 年機台銷售金額增加，使得營業成本推算全年度較 109 年度增加 29.25%，致使存貨週轉率略微上升應屬合理。

2.截至最近期止存貨去化情形評估

(1)申請公司個體財務報表 110 年底存貨去化情形評估

單位：新臺幣千元

項 目	110 年 12 月底	截至 111 年 2 月 28 日存貨去化情形		111 年 2 月 28 日餘額
	存貨金額	金額	比率(%)	
原物料	70,131	27,811	39.66	42,320
在製品	91,523	57,024	62.31	34,499
製成品	420,278	129,356	30.78	290,922
維修材料	16,971	12,406	73.10	4,565
合計	598,903	226,597	37.84	372,306

資料來源：該公司提供

該公司個體財務報告 110 年 12 月底之存貨總額為 598,903 千元，截至 111 年 2

月底之去化金額為 226,597 千元，整體去化比率約為 37.84%。茲就各項目去化情形分述如下：

A. 原物料

該公司個體財務報告原物料為雷射頭、電子掃描鏡、鑄物、控制器及螺桿等，110 年 12 月底底原物料總額為 70,131 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 27,811 千元，去化比率為 39.66%，主係該公司持續將原物料投入生產去化所致，尚未去化金額為 42,320 千元，未去化之原物料主係該公司為求對客戶之供貨不中斷，考量相關原物料使用期限較長，較無損之情事、交期時間性，及對原物料之採購有最低採購量取得較優惠之進貨價格，尚未去化之原物料待適當時機投入生產並銷售，經評估尚無重大異常之情事。

B. 在製品

在製品係為尚未完工主軸、成型機、鑽孔機，該公司個體財務報告 110 年 12 月底在製品之總額為 91,523 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 57,024 千元，去化比率為 62.31%，其中未去化金額為 34,499 千元，未去化之在製品係依該公司個體財務報告依照客戶訂單安排生產排程及部分在製品為首次製作較為耗時，已依提列政策提列備抵存貨跌價及呆滯損失，整體去化狀況尚屬良好。

C. 製成品

製成品係為已完工已檢驗之主軸、成型機及鑽孔機，其包括購入之非自製零件商品或已完工已檢驗之半成品，該公司個體財務報告 110 年 12 月底製成品之總額為 420,278 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 129,356 千元，去化比率為 30.78%，其中未去化金額為 290,922 千元，290,922 千元庫齡在一年以上約占 28%，主要為 ND、NR 機台及主軸成品、半成品，製成品係因 108 年度計劃性生產的存貨，受到疫情與美中貿易戰影響，使得庫存去化亦減緩，其去化速度稍緩，經評估尚無重大異常之情事。

D. 維修材料

維修材料係為該公司個體財務報告代理原廠在台的設備與零件備品，該公司 110 年 12 月底代理存貨之總額為 16,971 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 12,406 千元，去化比率為 73.10%，未去化金額為 4,565 千元，未去化之維修材料係為終端客戶尚未驗收架設完成，待客戶驗收完成後即可開發票將存貨去化，經評估尚無重大異常之情事。

(2) 申請公司合併財務報表 110 年 12 月底存貨去化情形評估

單位：新臺幣千元

項 目	110 年 12 月底	截至 111 年 2 月 28 日存貨去化		111 年 2 月 28 日 餘額
	存貨金額	金額	比率(%)	
原物料	73,236	28,401	38.78	44,835
在製品	99,440	56,272	56.59	43,168
製成品	499,740	137,319	27.48	362,421
維修材料	16,975	12,405	73.08	4,570
合計	689,391	234,397	34.00	454,994

資料來源：該公司提供

該公司 110 年 12 月底之存貨總額為 689,391 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 234,397 千元，整體去化比率約為 34.00%。茲就各項目去化情形分述如下：

A.原物料

該公司原物料為雷射頭、電子掃描鏡、鑄物、控制器及螺桿等 110 年 12 月底原物料之總額為 73,236 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 28,401 千元，去化比率為 38.78%，主係該公司持續將原物料投入生產去化所致，尚未去化金額為 44,835 千元，未去化之原物料主係該公司為求對客戶之供貨不中斷，考量相關原物料使用期限較長，較無損之情事、交期時間性，及對原物料之採購有最低採購量取得較優惠之進貨價格，尚未去化之原物料待適當時機投入生產並銷售，經評估尚無重大異常之情事。

B.在製品

在製品係為尚未完工主軸、成型機、鑽孔機，該公司 110 年 12 月底在製品之總額為 99,440 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 56,272 千元，去化比率為 56.59%，其中未去化金額為 43,168 千元，未去化之在製品係依該公司依照客戶訂單安排生產排程及部分在製品為首次製作較為耗時，已依提列政策提列備抵存貨跌價及呆滯損失，整體去化狀況尚屬良好。

C.製成品

製成品係為已完工已檢驗之主軸、成型機、鑽孔機，其包括購入之非自製零件商品或已完工已檢驗之半成品，該公司 110 年 12 月底製成品之總額為 499,740 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 137,319 千元，去化比率為 27.48%，其中未去化金額為 362,421 千元，362,421 千元庫齡在一年以上約占 25%，主要為 ND、NR 機台及買賣類零件，係因 108 年度計劃性生產的存貨，受到疫情與中美貿易戰影響，使得庫存去化亦減緩，致使製成品去化比率為 27.48%，其去化速度稍緩，經評估尚無重大異常之情事。

D.維修材料

維修材料係為該公司代理原廠在台的設備與零件備品，該公司 110 年 12 月底代理存貨之總額為 16,975 千元，截至 111 年 2 月底之去化金額為 12,405 千元，去化比率為 73.08%，其中未去化金額為 4,570 千元，未去化之代理存貨係為終端客戶尚未驗收架設完成，待客戶驗收完成後即可開發票將存貨去化，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，截至 111 年 2 月底止，該公司 110 年 12 月底期末存貨已依其產品產製週期及訂單出貨排程，其去化情況尚屬合理，整體存貨之去化，尚無重大異常之情事。

3.備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列之政策及適足性評估

(1)備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列政策

A.備抵存貨跌價損失提列政策

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

B.備抵存貨呆滯損失提列呆滯政策

該公司根據以往之經驗，將所有存貨以穩健原則針對呆滯存貨提列呆滯損失，提列比率彙總如下：

(a) 庫齡提列呆滯比率

庫 齡(月)	庫 齡(月) 提列呆滯比率 (%) 第一類	庫 齡(月) 提列呆滯比率 (%) 第二類
12 個月以內	0	-
13~24個月	10	-
25~30個月	25	10
31~36個月	45	25
37~42個月	60	45
43~48個月	80	60
49 個月以上	100	80
61 個月以上	100	100

資料來源：該公司提供

註 1: 該公司存貨備抵跌價損失認列管理辦法係經會計功能主管核准；

註 2:庫齡計算基礎採原始收料日開始計算；

註 3:重大品項(鑄物與 BED(底座) 之長納期物料、NDNR 設備及整組主軸等)，採第二類比率法。所謂長納期物料係指鑄造後材質的穩定性需求，購入後需要曝露存放半年以上才能開始加工的原物料。

註 4:不良品倉、跌損倉、待報廢倉，其內含存貨性質，為經辨識無價值之存貨，專案評估，提列全額跌價損失者。

註 5:以下情形存貨不進行評價

(1)已出貨至客戶端未驗存貨，因未達收入認列時點。

(2)暫收存貨，尚未正式驗收入庫。

(2)申請公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性評估

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	個體		合併	
	109 年度	110 年度	109 年度	110 年度
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	46,021	56,163	62,987	76,540
期末存貨總額(B)	424,305	598,903	513,775	689,391
提列比率(A)/(B)(%)	10.85	9.38	12.26	11.10

資料來源：該公司提供

A.個體財務報表

該公司個體財務報告之備抵存貨跌價及呆滯損失均已依該公司個體財務報告「存貨備抵跌價損失認列管理辦法」按季提列，且針對滯料存貨(Slow moving)不定時做存貨專案評估。該公司個體財務報告 109 年度及 110 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失分別為 46,021 千元及 56,163 千元，提列比率分別為 10.85%及 9.38%，109 年度該公司個體財務報告備抵存貨跌價及呆滯損失金額為 46,020 千元(詳表一)，主係為庫齡達 49 個月以上之存貨，按公司提列政策提列 22,833 千元，主要提列存貨項目為主軸成品、半成品及買賣類零件;110 年度該公司個體財務報告備抵存貨跌價及呆滯損失金額為 56,163 千元，較 109 年度增加 10,143 千元，係 49 個月以上之存貨，屬特殊規格部品，與雷射設備之維修用料，隨時間經過拉長庫齡，而依政策增加呆滯提列比率，而增加提列金額。經評估該公司個體財務報告已依所訂政策提列損失，並經簽證會計師查核簽證完竣，存貨備抵提列應尚屬適足，整體而言，該公司個體財務報告之備抵存貨跌價及呆滯損失尚無重大異常之情事。

表一：最近二年度個體財務報告備抵存貨跌價及呆滯損失金額

單位：新臺幣千元

庫齡(月)	期間(月)	提列呆滯比率(%)	109 年度	110 年度
			LCM 提列金額	LCM 提列金額
13 個月以內	0~12.99	0%	1,022	3,944
13 個月以上~24 個月	13~24.99	10%	1,672	1,170
25 個月以上~30 個月	25~30.99	25%	4,256	889
31 個月以上~36 個月	31~36.99	45%	3,196	3,484
37 個月以上~42 個月	37~42.99	60%	4,305	6,952

庫齡(月)	期間(月)	提列呆滯 比率(%)	109 年度	110 年度
			LCM 提列金額	LCM 提列金額
43 個月以上~48 個月	43~48.99	80%	8,736	4,004
49 個月以上	49~	100%	22,833	35,721
合計(庫存+在製)			46,020	56,164

資料來源：該公司提供。

B.合併財務報表

該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失均已依該公司「存貨備抵跌價損失認列管理辦法」按季提列，且針對滯料存貨(Slow moving)不定時做存貨專案評估。該公司 109 年度及 110 年度合併備抵存貨跌價及呆滯損失分別為 62,987 千元及 76,540 千元，提列比率分別為 12.26%及 11.10%，109 年度合併備抵存貨跌價及呆滯損失主要提列為庫齡達 49 個月以上之存貨，按公司提列政策提列 45,667 千元(詳下表)，存貨項目包括主軸成品、半成品及買賣類零件；110 年度備抵存貨跌價及呆滯損失金額較 109 年度增加 13,553 千元，係依政策提列庫齡 49 個月以上存貨提列金額為 46,881 千元，較 109 年度增加 17,163 千元，屬特殊規格部品，與雷射設備之維修用料隨時間經過拉長庫齡，而依政策增加呆滯提列比率。經評估該公司已依所訂政策提列損失，存貨備抵提列應尚屬適足，並經會計師查核簽證完竣，故整體而言，該公司目前備抵存貨跌價及呆滯損失金額已依上述管理辦法提，尚無重大異常之情事。

表二：109 年度及 110 年度合併備抵存貨跌價及呆滯損失金額

單位：新臺幣千元

庫齡(月)	期間(月)	提列呆滯 比率(%)	109 年度	110 年度
			LCM 提列金額	LCM 提列金額
13 個月以內	0~12.99	0%	1,313	4,141
13 個月以上~24 個月	13~24.99	10%	3,985	1,346
25 個月以上~30 個月	25~30.99	25%	5,486	3,332
31 個月以上~36 個月	31~36.99	45%	5,000	5,062
37 個月以上~42 個月	37~42.99	60%	6,195	9,176
43 個月以上~48 個月	43~48.99	80%	11,290	6,602
49 個月以上	49~	100%	29,718	46,881
合計(庫存+在製)			62,987	76,540

資料來源：該公司提供。

4.與同業比較

單位：新臺幣千元

年度		個體		合併	
		109 年度	110 年度	109 年度	110 年度
營業成本	達航	556,474	764,498	664,891	859,360

項目	年度	個體		合併	
		109 年度	110 年度	109 年度	110 年度
	大量	1,027,918	1,416,028	1,711,540	3,293,553
	凱崑	451,050	註 4	1,089,620	註 4
	尖點	725,932	778,546	2,003,273	2,539,688
	達航	424,305	598,903	513,775	689,391
期末存貨總額	大量	506,498	512,429	註 3	註 3
	凱崑	160,036	註 4	442,409	註 4
	尖點	註 3	註 3	註 3	註 3
	達航	378,284	542,740	450,788	612,851
期末存貨淨額(B)	大量	444,547	487,495	1,443,490	1,421,729
	凱崑	155,852	註 4	429,934	註 4
	尖點	152,809	160,535	482,352	687,653
	達航	1.48	1.66	1.39	1.62
存貨週轉率 (次) (註 1)	大量	2.70	3.04	1.50	2.30
	凱崑	2.92	註 4	2.45	註 4
	尖點	4.93	4.97	4.37	4.34
	達航	247	220	263	226
存貨週轉天數(天)	大量	135	120	244	159
	凱崑	125	註 4	149	註 4
	尖點	74	73	84	84
	達航	46,021	56,163	62,987	76,540
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	大量	61,951	24,934	註 3	註 3
	凱崑	4,184	註 4	12,475	註 4
	尖點	註 3	註 3	註 3	註 3
	達航	10.85%	9.38%	12.26%	11.10%
提列比率 (A/B)	大量	13.94%	4.87%	註 3	註 3
	凱崑	2.68%	註 4	2.90%	註 4
	尖點	註 3	註 3	註 3	註 3
	達航				

資料來源：各公司 110 年度經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。

註 1：存貨週轉率係採存貨淨額計算之。

註 2：此資訊未有公開資料。

註 3：同業財報僅揭露存貨淨額，並未揭露備抵存貨跌價及呆滯損失、存貨總額資訊。

註 4：截至評估報告日止尚未出具 110 年度經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。

(1)個體財務報告

存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司個體財務報告 109 年度及 110 年度個體存貨週轉率分別為 1.48 次及 1.66 次，存貨週轉天數分別為 247 天及 220 天。與採樣同業水準相較，109 年度及 110 年度該公司個體財務報告皆低於採樣同業，係因該公司 107 年及 108 年度以計劃性生產為主，原計劃拓展中國區市場發展，但卻遭

受到美中貿易戰及 COVID-19 疫情影響，致使中國區機台需求減緩，導致庫存去化亦減緩，造成部分存貨庫齡較長，致使期末存貨占資產總額為 24.96%，造成存貨週轉率較低，週轉天數較長。

備抵存貨跌價及呆滯損失占期末總額比率方面，該公司個體財務報告 109 年度及 110 年度個體備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率分別為 10.85%及 9.38%，與採樣同業相較之下，該公司個體財務報告提列比率 109 年度低於大量，高於凱崑，110 年度高於大量，凱崑則因尚未公佈無法比較，該公司個體財務報告已依政策提列適足，其提列政策尚屬允當。

綜上評估，該公司個體財務報告最近二年度存貨及週轉率變化尚屬合理，備抵跌價及呆滯損失之提列應屬適足，與同業相較尚無重大異常情事。

(2)合併財務報告

合併存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 109 年度及 110 年度合併存貨週轉率分別為 1.39 次及 1.62 次，存貨週轉天數分別為 263 天及 226 天。與採樣同業水準相較，109 年度及 110 年度該公司皆低於採樣同業，係因該公司 108 年度以計劃性生產為主，原計劃拓展中國區市場發展，但卻遭受到美中貿易戰及 COVID-19 疫情影響，致使中國區機台需求減緩，導致庫存去化亦減緩，造成部分存貨庫齡較長，致使期末存貨占資產總額為 26.83%，造成存貨週轉率較低，週轉天數較長。

合併備抵存貨跌價及呆滯損失占期末總額比率方面，該公司 109 年度及 110 年度合併備抵存貨及呆滯損失提列比率分別為 12.26%及 11.10%，與採樣同業相較，該公司 109 年度合併提列比率皆高於凱崑，大量及尖點未揭露備抵存貨跌價及呆滯損失金額，故無法比較，110 年度同業未揭露或未公佈相關資料可茲比較，該公司已依政策提列適足，其提列政策尚屬允當。

整體而言，該公司最近二年度存貨及週轉率及備抵跌價及呆滯損失之提列金額與採樣同業因產業特性、生產模式、產品結構及與客戶交易條件等互有許不同而略有差異，經評估尚無重大異常情事。

(四)發行人最近期及最近三個會計年度財務報告之業績概況

1.列表並說明最近期及最近三個會計年度財務報告營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較

單位：新台幣仟元；%

公司名稱 \ 年度		108 年度		109 年度		110 年度	
		金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
營業收入	達航	1,175,825	(23.78)	1,000,900	(14.87)	1,245,511	24.44
	大量	1,942,637	(51.28)	2,427,607	24.96	4,443,506	83.04
	凱崑	1,255,128	3.15	1,264,376	0.74	註 1	-

	尖點	3,006,253	(8.41)	2,973,426	(1.09)	3,773,746	26.92
營業 毛利	達航	418,019	(0.97)	336,009	(19.62)	386,151	14.92
	大量	551,869	(50.67)	716,067	29.75	1,149,953	60.59
	凱崑	171,671	5.12	174,756	1.80	註 1	-
	尖點	859,195	(5.57)	969,264	12.81	1,234,058	27.32
營業 利益	達航	46,956	(10.93)	109,352	57.06	128,439	17.45
	大量	209,650	(60.17)	202,822	(3.26)	550,878	171.61
	凱崑	48,343	50.29	36,787	(23.90)	註 1	-
	尖點	307,102	(6.65)	467,417	52.20	643,002	37.56

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：截至評估報告出具日止，尚未出具 110 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司設立於 80 年，主要從事印刷電路板製程中所需的鑽孔機台及成型機台設備的生產販售業務，以及其關鍵零組件的維修與保養等服務，另，自 106 年起，自行開發成功雷射鑽孔機台，作為供客製化雷射應用鑽孔代工之自製產能，主要銷售及服務對象為國內上市櫃印刷電路板大廠，所銷售地區涵蓋台灣、中國大陸及日韓市場。綜觀目前國內上市、櫃公司中，經參酌業務型態、營運規模及產業關聯性較為相近之業者，選取大量、凱崑及尖點三家為採樣同業。以下茲就該公司最近三年度之營業收入、營業毛利及營業利益情形，與採樣同業分別進行比較說明如下：

(1)營業收入

該公司 108~110 年度之營業收入分別為 1,175,825 千元、1,000,900 千元及 1,245,511 千元，該公司 108 年度及 109 年度營收呈現衰退之趨勢，主要受到外在環境美中貿易大戰、COVID-19 疫情蔓延不確定因素升高及該公司經營策略調整影響所致。108 年起美中貿易戰及終端消費市場需求減緩，造成眾多印刷電路板製造廠的資本支出趨於保守，另，109 年間全球為因應防疫，各國陸續展開人流管制與國境封閉政策下，全球的物流、人流發展受限，使得該公司於中國華中區維修、保養及改造之專業服務業績減少，以及鑽孔機成型機銷售數量下滑，再加上該公司 108 年 10 月出售子公司大船科技煙台股權，縮減中國華北區業務之影響下，致該公司 109 年度營業收入較 108 年度減少 174,925 千元，變動幅度(14.87)%。110 年度受惠高精密機械鑽孔設備出貨增加，致該公司營業收入相較 109 年度增加 244,611 千元，變動幅度 24.44%。

109 年受因全球籠罩在新冠肺炎影響，故採樣同業尖點的營業收入表現，相較 108 年度均產生衰減趨勢，惟，採樣同業大量的營業收入，相較 108 年度呈現逆勢趨勢，係因受惠半導體業及印刷電路板製造廠擴充產能的資本支出，以因應 5G、車載及 AI 應用產品的投產需求，另，採樣同業凱崑的營業收入，相較 108 年度僅些微成長 0.74%，未達 1%以上，故不擬予深入分析，110 年度後疫情時代，全球經濟逐漸復甦，故該公司營業收入，與採樣同業相較 110 年度之成長幅度，略顯低於採樣同業水準之間。

該公司與採樣同業相較，108~110 年度之營業收入表現，108、109 年度、110 年度低於採樣同業水準，係因該公司所提供之機台效能提升、維修、保養及雷射鑽孔應用專業服務比重逐年提高，而機器設備販售比重下降所致；但營收成長率變動方面，108 年度~110 年度略低於採樣同業，係因產品組成及營運規模差異所致。

綜上所述，該公司 108~110 年度營業收入之變化尚屬合理。

(2)營業毛利

單位：新台幣千元；%

公司 \ 年度	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	毛利率	金額	毛利率	金額	毛利率
達航	418,019	35.55	336,009	33.57	386,151	31.00
大量	551,869	28.41	716,067	29.50	1,149,953	25.88
凱崴	171,671	13.68	174,756	13.82	註 1	-
尖點	859,195	28.58	970,153	32.63	1,234,058	32.70

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

註1：截至評估報告出具日止，尚未出具110年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 108~110 年度之營業毛利分別為 418,019 千元、336,009 千元及 386,151 千元，109 年度營業毛利金額較 108 年度減少 82,010 千元，變動幅度(19.62)%，係因該公司調整中國區經營策略，並於 108 年 10 月出售子公司大船煙台，將中國大陸的業務集中於華中及華南地區，以就近服務位於湖北黃石、江蘇昆山及廣東一帶的客戶，致 108、109 年間之營業收入減少，連動毛利金額同步下滑，110 年較 109 年度增加 50,142 千元，變動幅度 14.92%，另在毛利率方面，該公司 108~110 年度毛利率分別為 35.55%、33.57%及 31.00%，109 年度毛利率較 108 年度，變動幅度(5.57)%，係因該公司高毛率之設備維修、保養及改造之專業服務營收下滑所致；110 年度因毛利率較低之機械鑽孔機銷售比重提高造成產品組合變動所致。

108 年度隨著美中貿易戰劇烈影響下，終端消費電子產品的出貨逐步放緩，對組裝廠的採購需求亦同步減少，使得多數的印刷電路板廠在產能尚足以供給的情況下，降低資本支出的投資意願，以致採樣同業大量及尖點，然，109 年初，在中國大陸武漢市爆發 COVID-19 後，造成全球 109 年第一、二季的經濟活動陷入遲緩性的成長狀態，直到 109 年第三季末起，全球市場為因應新世代的 5G 網通、AI 及雲端運算產品的發展需求，推升高階精密設備的投產設備供給，致採樣同業大量、凱崴及尖點，109 年度及 110 年度之營業毛利，較 108 年度及 109 年度略微成長。

該公司與採樣同業相較，108 年~110 年度之營業毛利互有高低，係因營業規模及產品組合的差異所致；在毛利率表現上，108 及 109 年度則優於採樣同業，110 年度僅次於尖點。

綜上評估，該公司 108 年~110 年度之營業毛利及毛利率變動尚屬合理。

(3)營業利益

單位：新台幣千元；%

公司 \ 年度	營業費用及費用率(%)					
	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	費用率	金額	費用率	金額	費用率
達航	371,063	31.56	226,657	23.63	257,712	20.69
大量	342,219	17.62	513,245	21.14	599,075	13.48
凱崑	123,328	9.83	137,969	10.91	註 1	-
尖點	579,421	19.27	497,159	16.72	608,831	16.13

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

註1：截至評估報告出具日止，尚未出具110年度經會計師查核簽證之財務報告。

單位：新台幣千元；%

公司 \ 年度	營業利益及營業利益率(%)					
	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	利益率	金額	利益率	金額	利益率
達航	46,956	3.99	109,352	10.93	128,439	10.31
大量	209,650	10.79	202,822	8.35	550,878	12.40
凱崑	48,343	3.85	36,787	2.91	註 1	-
尖點	307,102	10.22	467,417	15.72	643,002	17.04

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

註1：截至評估報告出具日止，尚未出具110年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 108 年度~110 年度營業利益分別為 46,956 千元、109,352 千元及 128,439 千元，另營業利益率分別為 3.99%、10.93%及 10.31%，109 年度營業利益較 108 年度增加 62,396 千元，變動幅度 132.88%，係因該公司於 108 年 10 月處分孫公司大船煙台股權縮小中國大陸之營運規模，同時，將林口辦公處與台中廠區進行搏節開支計劃，致 109 年度營業費用較 108 年度減少 144,406 千元，營業利益率由 3.99%上升至 10.93%；110 年度之營業利益較 109 年度增加 19,087 千元，變動幅度 17.45%，由於，110 年度該公司營業費用較 109 年度增加 31,055 千元，變動幅度 13.70%，係因 109 年度因期後回收之應收帳款產生預期信用減損利益 15,194 千元，其中，L 公司之呆帳費用 10,355 千元之迴轉，致比較基期營業費用偏低而營業利益較高；110 年度之營業利益率相較 109 年度變動(5.67)%，係因 110 年度較 109 年度產品組合之差異下，致營業毛利 110 年度較 109 年度產生衰減。

109 年度採樣比較同業大量及凱崑的營業利益，相較 108 年度分別減少 6,828 千元及 11,556 千元，變動幅度(3.26)%及(23.90)%，係因大量 109 年度的預期信用損失增加，凱崑則因 109 年度營業費用支付增加 14,641 千元，變動幅度達 11.87%所致，至於，尖點的營業利益，相較 108 年度成長 52.49%，係因尖點於 109 年間陸續結束中國大陸區營業據點，致管理費用 109 年度較 108 年度減少 63,875 千元，變動幅度(19.55)%，110 年度採樣同業受惠 5G、雲端、高階運算產品的先進製程的需求下，

110 年度之業績表現較 109 年度成長。

該公司與採樣同業相較，108 年度~110 年度之營業利益及營業利益率，108 年度及 110 年度均低於同業水準。

綜上所述，該公司 108 年度~110 年度之營業收入、營業毛利及營業利益之變動原因及變動趨勢，與同業相較尚屬合理。

2.列表並說明最近期及最近三個會計年度財務報告以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

(1)最近期及最近三個會計年度主要產品別營業收入變動表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	912,184	77.58	824,878	82.41	688,763	55.30
設備產銷	253,091	21.52	154,963	15.48	524,659	42.12
其他	10,550	0.90	21,059	2.11	32,089	2.58
總 計	1,175,825	100.00	1,000,900	100.00	1,245,511	100.00

資料來源：該公司提供

(2)最近期及最近三個會計年度主要產品別營業成本變動表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	549,360	72.49	529,228	79.60	503,454	58.58
設備產銷	208,446	27.51	135,663	20.40	355,906	41.42
其他	-	-	-	-	-	-
總 計	757,806	100.00	664,891	100.00	859,360	100.00

資料來源：該公司提供

(3)最近期及最近三個會計年度主要產品別營業毛利變動表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
專業服務	362,824	86.79	295,650	87.99	185,309	47.99
設備產銷	44,645	10.68	19,300	5.74	168,753	43.70
其他	10,550	2.53	21,059	6.27	32,089	8.31
總 計	418,019	100.00	336,009	100.00	386,151	100.00

資料來源：該公司提供

(4)最近期及最近三年度依營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明：

A. 專業服務

該公司之專業服務之維修、保養及改造服務，源自於該公司長期以來協助日商日立維亞於臺灣、中國大陸地區進行設備組裝、保養及維修業務之經驗，以及該公司所具備自製生產機械鑽孔設備之能力。由於機械設備之使用壽命在經歷長期生產下，易產生耗損或效能不佳之情況，若生產者欲延續設備耐用年限及穩定產線之品質，須確保既存設備得以穩定運轉、產線投產之稼動率及產能效率處於最佳狀態，故鑽孔設備中之關鍵性零組件必須定期進行維修、保養及改良。

另，該公司之專業服務之雷射應用鑽孔代工服務，主係透過自主開發之二氧化碳雷射器(CO₂)及紫外線(UV)雷射鑽孔機設備，以及自主雷射光源整合技術，協助下游印刷電路板廠客戶，進行 IC 載板(含 ABF 載板)、類載板及 PC/NB 板等加工鑽孔製程之需求，主要應用於消費性電子產品中所需搭載之晶片等電子元件，舉凡：智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置及網通伺服等相關產品的製程上。綜觀國內其他印刷電路板廠在雷射鑽孔設備製程上，大多依賴國外進口設備，以日商三菱電機及日商維亞機械為大宗，而該公司則為目前國內少數具備獨立開發產能設備的雷射鑽孔加工廠商，長期以來，扮演著衛星協力工廠的角色支援著國內外印刷電路板廠的雷射鑽孔製程。

該公司 108 年度、109 年度及 110 年度之專業服務的營業收入分別為 912,184 千元、824,878 千元及 688,763 千元，占各年度之營業收入比重分別為 77.58%、82.41%及 55.30%，該公司 108、109 年度業績成長，主要受惠次世代電子產品須具備高傳輸、高速度的能力，以及 5G 世代網路伺服相關設備之升級需求，對 IC 載板（如：ABF 載板）需求大增，而載板製程中，雷射鑽孔為關鍵製程，正當下游印刷電路板廠自身產能不足，或陸續著手規劃擴建載板的產能，提升自身製程技術與能力的同時，則可由該公司先行透過自製雷射鑽孔機設備，提供下游印刷電路板廠加工鑽孔服務及解決問題之技術支援。110 年度該公司專業服務收入較 109 年度減少 136,115 千元，變動幅度(16.50)%，係因下游印刷電路板廠擴充雷射鑽孔產能設備下，委託由該公司進行雷射鑽孔加工服務之需求降低所致，另 109 年初中國大陸華中武漢地區爆發新冠肺炎疫情，使原先於中國大陸華中湖北一帶之 PCB 產業聚落經濟活動產生嚴重性之遲緩性成長，致該公司專業維修及保養之服務收入減少。

營業成本、營業毛利方面，該公司專業服務之營業成本、營業毛利之變化方面，108 年度、109 年度及 110 年度之營業成本分別為 549,360 千元、529,228 千元及 503,454 千元，108 年度~110 年度之營業毛利分別為 362,824 千元、295,650 千元及 185,309 千元；109 年度專業服務之營業成本，相較 108 年度減少 20,132 千元，變動幅度(3.66)%，係因設備關鍵零組件維修、保養與改造訂單減少，109 年度專業服務營業毛利較 108 年度減少 67,174 千元，變動幅度(18.29)%，係因鑽孔設備及關鍵零組件之維修、保養與改造訂單減少；110 年度之專業服務之營業成本較 109 年度減少 25,774 千元，變動幅度(4.87)%，主要銷售客戶 C、B 之雷射鑽孔設備仍以國外進口設備為採購主流，故隨著 C 採購之日商三菱電機設備於 110

年第一、二季已陸續交貨，致縮減對該公司之雷射應用代工訂單，營收下滑，固定成本卻增加所致係因雷射應用加工訂單減少，致 110 年度之營業毛利較 109 年度減少 110,341 千元，變動幅度(37.32)%。

B.設備產銷

該公司設備產銷產品以鑽孔機(ND)與成型機(NR)兩大類產品組合為主。該公司機械鑽孔工藝設備的技術支援功能，若以多層印刷電路板為例，其開孔之目的，係為做出連接所需要的導通路徑，除了橫向的（平面方向）的連接外，同時，亦進行垂直立體的連接，故在 PCB 或載板製程上，除了在基板上鑽孔或孔壁上電鍍的方法外，亦有將孔填埋的技術，至於，成型機之用途功能，係應用印刷電路板之成型(Profile)作業製程上，即將整片印刷電路板之各個排版(Pattern)進行裁切後，再轉交由封裝廠進行晶片與印刷電路板或載板封裝生產。

該公司 108 年度、109 年度及 110 年度之設備產銷營業收入分別為 253,091 千元、154,963 千元及 524,659 千元，占營業收入比重分別為 21.52%、15.48%及 42.12%，109 年度設備產銷營業收入較 108 年度減少 98,128 千元，減少幅度 38.77%，主係因中國大陸 PCB 廠商用低階鑽孔機製造商大幅擴產，並以低價搶奪市場，致台灣 PCB 鑽孔機製造商營收逐年下滑，該公司低階產品因於中國大陸地區競爭力不足，相關設備產銷營業收入減少，且 109 年初起受新冠肺炎疫情影響，中國大陸各地因受封城、復工緩慢等複雜因素之影響，印刷電路板廠原訂擴廠計畫延緩，暫緩對該公司之設備採購，致該公司 109 年度機械鑽孔機設備較 108 年度銷售減少；惟該公司於 108 年研發成功高階精密鑽孔機可搭載 20 萬、30 萬或 35 萬轉主軸，109 年間經客戶認證，並自 109 年下半年起陸續出貨予 A 集團等客戶，110 年度因受惠雲端、5G、AI 產品對 ABF 載板需求增加，致 A 公司、C 公司及競國等對高精密機械鑽孔設備數量之訂單增加，使設備產銷收入較 109 年度增加 369,696 千元，增加幅度 238.57%。

營業成本、營業毛利方面，該公司 108 年度、109 年度及 110 年度之設備產銷營業成本分別為 208,446 千元、135,663 千元及 355,906 千元，營業毛利分別為 44,645 千元、19,300 千元及 168,753 千元。109 年度設備產銷營業成本較 108 年度減少 72,783 千元，減少幅度 34.92%，係因中國大陸 PCB 設備紅海市場及受 109 年初起新冠肺炎疫情影響下，該公司 109 年度設備產銷之營業毛利較 108 年度減少 25,345 千元，減少幅度 56.77%；110 年度設備產銷營業成本較 109 年度增加 220,243 千元，增加幅度 162.35%，係因後疫情時代下，因應 5G 產品在 PCB 或高階載板製程上，對高精密機鑽孔設備需求上揚，致該公司設備產銷之營業毛利亦增加 149,453 千元，增加幅 774.37%。

C.其他

該公司其他類收入主係代理癸公司之電測治具所收取之收入，因該公司僅提供代理零件銷售等服務，故營業收入與成本係以淨額表達。該公司提供此類服務

之主要客戶包含 C 公司、B 公司等。108 年度、109 年度及 110 年度其他產品營業收入分別為 10,550 千元、21,059 千元及 32,089 千元，營業收入變動主係受下游印刷電路板廠客製化之檢測模具訂購量多寡影響所致，由於其他類營業收入於 108 年度、109 年度及 110 年度僅分別占營業收入 0.90%、2.11%及 2.58%，比重甚低，故不擬予以深入分析。

3.最近期及最近三個會計年度財務報告營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

該公司最近三年度營業收入及毛利率變動率如下表所示：

項目	108 年度	109 年度	變動 比率	109 年度	110 年度	變動 比率
營業收入	1,175,825	1,000,900	(14.81)	1,000,900	1,245,511	24.44
毛利率	35.55	33.57	(5.40)	33.57	31.00	(7.65)

由上表得知，該公司 108 年~110 年度之營業收入或毛利率變動達 20%以上，故就上述期間，該公司主要產品別分別為專業服務、設備產銷及其他，由於，專業服務類產品，主要以雷射鑽孔應用及維修、保養及改造服務為主，屬客製化服務，因產品種類具多樣性，非屬自動化及標準化之製程，皆依據客戶需求進行服務，其中，雷射應用種類樣式眾多、因不同板材之孔徑、孔數量之差異而產生價量差異，另，維修、保養及改造服務，依實際訂單狀況、彈性配置人力投產提供勞務服務，故產能和產量，故無法用數值加總計算；而其他類產品，係屬代理類收入，不適宜進行價量分析，以下茲就該公司之產品別設備產銷之鑽孔機設備及成型機設備進行價量變動分析。

(1)設備產銷之價量分析及說明

單位：新台幣千元

主要產品	分析項目	109年度~110年度
鑽孔機	(一)營業收入差異分析：	
	$P(Q'-Q)$	303,070
	$Q(P'-P)$	23,179
	$(P'-P)(Q'-Q)$	<u>77,649</u>
	$P'Q'-PQ$	403,899
	(二)營業成本差異分析：	
	$P(Q'-Q)$	255,911
	$Q(P'-P)$	(12)
	$(P'-P)(Q'-Q)$	(41)
	$P'Q'-PQ$	<u>255,858</u>
	(三)毛利變動金額：	148,041

主要產品	分析項目	109年度~110年度
成型機	(一)營業收入差異分析：	
	$P(Q'-Q)$	(42,995)
	$Q(P'-P)$	26,380
	$(P'-P)(Q'-Q)$	(17,587)
	$P'Q'-PQ$	(34,202)
	(二)營業成本差異分析：	
	$P(Q'-Q)$	(39,514)
	$Q(P'-P)$	11,698
	$(P'-P)(Q'-Q)$	(7,798)
	$P'Q'-PQ$	(35,614)
	(三)毛利變動金額：	1,412

資料來源：該公司提供

註：P'及Q'為最近年度單價及數量；P及Q為上一年度單價及數量

鑽孔機營業收入於 110 年度較 109 年度同期成長，係因受惠 5G 產品及雲端運算傳輸產品的發展需求下，致下游印刷電路板設備廠，增添產能設備因應終端客戶，新一代產品規格投產需求，致 110 年度鑽孔機產品產生 303,070 千元有利的銷售數量差及 23,179 千元有利的價差，反觀，成型機設備，110 年度產生 42,995 千元不利的銷售數量差異及 26,380 千元不利價差，因受市場需求量縮減，進而降低產品出貨數，營業成本方面，鑽孔機設備受惠下游印刷電路板廠之採購具經濟規模效益，致產生 255,911 千元有利量差及 12 有利價差，反觀，成型設備市場已達飽和狀態，致產品市場價格競爭力較弱，而產生 39,514 千元不利量差及 11,698 千元不利價差，整體而言，110 年度鑽孔設備營業毛利較 109 年增加 148,041 千元，至於，成型設備 110 年營業毛利較 109 年增加 1,412 千元，故 110 年度設備產銷之營業毛利金額較 109 年增加 149,453 千元。

(五)最近三個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其子公司(包括子公司間交易事項)與關係人交易之評估

- 1.發行人與關係人公司間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬發行人銷貨予關係人者，則再評估發行人之授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性

(1)個體關係人名稱及關係

關係人名稱	與該公司之關係
CHINA EXPO LTD.(CHINA EXPO)	該公司之子公司
大船企業日本株式會社(日本大船)	該公司之子公司

關係人名稱	與該公司之關係
東莞達程電子有限公司(東莞達程)	該公司之子公司
MEGA TRADER INTERNATIONAL LTD.(MEGA)	該公司之子公司
上海達航實業有限公司 (上海達航)	該公司之子公司
ALPHA DYNAMIC INVERTMENT LTD.(ALPHA)(註 1)	該公司之子公司
大船科技(煙台)有限公司(註 2)(大船煙台)	該公司之子公司
永然聯合法律事務所(註 3)(永然)	實質關係人
韶瑞開發股份有限公司(註 4)(韶瑞開發)	實質關係人
大船電子(上海)有限公司(上海大船)	實質關係人
大船科技(東莞)有限公司(東莞大船)(註 5)	實質關係人
大船科技股份有限公司(大船科技)(註 6)	實質關係人
大船科技股份有限公司(東京支店)(東京大船)	實質關係人

資料來源：該公司各年度或各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

註：1.已於 110 年 4 月 19 日清算完成。

2.該公司之子公司 ALPHA 已出售大船煙台 100%股份，故自 108 年 11 月 30 日起大船煙台已非該公司之關係人。

3.該公司已全面改選董事及監察人，故於 108 年 5 月 28 日起永然聯合法律事務所非為該公司之關係人。

4.該公司董事長與韶瑞開發董事長為同一人。

5.大船企業已出售東莞大船，故自 109 年 9 月 30 日起非為該公司之關係人。

6.該公司董事長與大船科技董事長為同一人。

(2)個體財務報告之關係人交易

A.銷貨收入及應收帳款

銷貨收入

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	56,375	6.38	82,957	9.82	74,356	6.70
東莞達程	32,632	3.70	21,432	2.54	14,501	1.31
上海達航	-	-	-	-	-	-
大船煙台	7,389	0.84	-	-	-	-
合計	96,396	10.92	104,389	12.36	88,857	8.01

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

應收帳款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	11,417	5.36	17,735	10.08	7,865	6.22
東莞達程	3,280	1.54	3,439	1.96	894	0.71
上海達航	7,407	3.48	-	-		
合計	22,104	10.37	21,174	12.04	8,759	6.93

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司銷貨至集團內子公司除因當地客戶有擴充設備之需求而有透過子公司銷售設備造成當年度金額較大外，因該公司為達採購效益極大化，集團所需大部分零組件係由臺灣母公司統一採購，由於該公司之子公司東莞達程、上海達航主要係提供各地區客戶機械鑽孔機維修服務，該公司主要銷貨以各地區執行維修需要之設備零件如 SPINDLE（主軸）、滾珠螺桿及滑軌等維修零組件為主。而子公司日本大船主要係該集團雷射鑽孔設備研發中心，而該公司主要銷售雷射鑽孔設備所需要之雷射頭（LASER HEAD）、感應器及控制器等零組件，隨著該公司逐年擴充專業服務雷射加工產能，故銷貨至子公司日本大船金額居高不下。經抽核銷貨於各子公司零組件主要係依該公司移轉定價政策，主要係以成本加成 10%，經評估尚無發現顯著異常。另經核閱相關帳冊及交易憑證，其收款條件為月結 60 天~月結 90 天，而該公司前十大銷售客戶多為介於月結 30 天~月結 120 天期之間，收款條件與其他客戶有別主要係依外幣曝險部位風險，以及考量集團內各子公司資金週轉需求訂定，經評估尚屬合理，並無重大異常之情事。

B.進貨及應付帳款

進貨

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	30,864	5.38	21,539	3.85	45,967	6.06
東莞達程	12,965	2.26	9,759	1.75	8,550	1.13
上海達航	2,328	0.41	-	-		
大船煙台	10,060	1.76	-	-		
合計	56,217	9.81	31,298	5.60	54,517	7.19

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

應付帳款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	15,070	18.19	32,498	29.29	8,631	4.13
東莞達程	2,292	2.77	1,761	1.59	457	0.22
上海達航	955	1.15	-	-	716	0.34
合計	18,317	22.11	34,259	30.88	9,804	4.69

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司因維修或生產加工設備（如機械鑽孔機）之需要，部份零件需透過子公司日本大船採購日本當地生產之零組件如 Z 軸線性馬達、滾珠螺桿、光學尺及 DSFI 基板等，進而向子公司日本大船進貨。而部份零組件因成本考量則透過子公司東莞達程、上海達航及大船煙台至中國採購，主要以氣缸、夾頭、及 SPINDLE（主軸）等。經抽核向各子公司進貨之零組件主要亦依該公司移轉定價政策定價，主要係以成本加成 10%，經評估尚無發現顯著異常。另經核閱相關帳冊及交易憑證，其付款條件為月結 30 天，而該公司前十大進貨供應商付款條件主要為月結 30 天左右，故與其他供應商相較並無明顯不同，經評估尚屬合理，並無重大異常之情事。

C. 勞務收入

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	-	-	2,192	0.26	786	0.07
東莞達程	1,272	0.14	3,870	0.46	1,984	0.18
上海達航	20,782	2.35	10,437	1.24	9,182	0.83
大船煙台	2,404	0.27	-	-	-	-
合計	24,458	2.77	16,499	1.95	11,952	1.08

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度勞務收入主要係該公司協助各子司諮詢、顧問、技術及協助規劃等服務，所收取的管理諮詢服務費，以及分攤台灣總部 EPR 系統等軟體維護費。經抽核上述交易之會計傳票及相關憑證，並核對經會計師簽證之財務報告，尚未發現有重大異常之情事。

D. 其他營業收入

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	303	0.03	245	0.03	13	0.00
東莞達程	240	0.03	101	0.01	393	0.04
大船煙台	27	0.00	-	-	-	-
合計	570	0.06	346	0.04	406	0.04

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

其他營業收入係出售非主要之零星設備(如：鼓風機、冰水機及清潔滾輪等)。
經核對帳冊尚無重大異常之情形。

E.其他應收款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	158	3.34	2	50.00	8,162	91.34

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

110 年度係出售雷射鑽孔機，其餘係為代購 WIFI 設備及代墊進口及營業稅等，
經核對帳冊尚無重大異常之情形。

F.其他應付款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	19,646	4.94	26,392	13.66	10,195	8.51
大船科技	984	0.25	-	-	-	-
合計	20,630	5.19	26,392	13.66	10,195	8.51

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度其他應付款主要係應付設備款、應付勞務費及其他費用
所產生，經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

G.預付款項

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	46,684	53.81	72,158	81.01	144,764	60.60
合計	46,684	53.81	72,158	81.01	144,764	60.60

資料來源：該公司 108~1110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度預付款項主要係依約預付設備採購之訂金。經核閱相關帳冊，尚無重大異常之情形。

H.取得不動產、廠房及設備

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	193,437	84.63	194,429	74.09	34,938	32.67
大船煙台	8,865	3.88	-	-	-	-
合計	202,302	88.51	194,429	74.09	34,938	32.67

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度對日本大船採購金額主要係採購雷射鑽孔機，隨著該公司持續擴充雷射加工業務，雷射鑽孔機需求逐年提升。108 年度分別向日本大船及大船煙台購進設備主要係配合該集團整體營運規劃，縮減子公司營運規模而將其設備（如複合加工機等）購進。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

I.承租協議-租賃費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
大船科技	13,700	5.48	7,743	5.06	4,539	2.40
韶瑞開發	60	0.02	60	0.04	60	0.03
合計	13,760	5.50	7,803	5.10	4,599	2.43

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度年度承租林口廠所支付的租賃費用，隨著整體營運規劃縮減規模，租賃費用隨著租賃面積縮小而減少，於 109 年下半年該公司考量營運效益決定結束林口廠，將相關設備及人員全數搬回大甲廠，租賃費用隨著租賃合約的終止而減少。韶瑞開發租賃費用主要係承租內湖辦公室之費用。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

J.向關係人借款

其他應付款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
CHINA EXPO	151,526	38.12	83,228	43.09	-	-
ALPHA	153,733	38.67	-	-	-	-
合計	305,259	76.79	83,228	43.09	-	-

資料來源：該公司 108~109 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

利息費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
CHINA EXPO	2,150	16.24	1,846	15.18	573	5.02
ALPHA	26	0.20	719	5.91	-	-
合計	2,176	16.44	2,565	21.09	573	5.02

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度與子公司因短期資金融通之需求而有資金調度之情形，相關資金調度係經臺灣母公司董事會通過取得額度後，視集團內各公司實際資金需求調借，利息費用以 1.5%計算。經評估尚屬合理，並無重大異常之情事。

K.勞務費

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	56,978	22.79	36,452	23.84	18,466	9.75
上海達航	2,113	0.85	392	0.26	-	-
東莞達程	-	-	95	0.06	-	-
永然	73	0.03	-	-	-	-
合計	59,164	23.67	36,939	24.16	18,466	9.75

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度對子公司之勞務費主要是支付日本大船技術支援委託之勞務費，主要有雷射鑽孔機主要零配件之研究及開發，以及 PCB 製造設備之設計、功能升級、製程改善或特殊規格等技術服務等。支付子公司上海達航及東莞達程

勞務費主要係委託維護該公司出售至大陸客戶機械鑽孔設備之費用。1108 年度支付永然主要係支付常年法律顧問聘任費等，因該公司全面改選董事及監察人，自 108 年 5 月 28 日起永然聯合法律事務所已非為該公司之關係人，故揭露關係人交易之勞務費隨之減少。經檢視相關明細，並抽核相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

L.其他費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
日本大船	338	0.14	45	0.03	38	0.02
上海達航	93	0.04	1,113	0.73	686	0.36
大船科技	1,839	0.74	913	0.60	531	0.28
東莞達程	-	-	-	-	494	0.26
合計	2,270	0.92	2,071	1.36	1,749	0.92

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度其他費用主要係支付大船科技因租賃林口廠所支付的大樓管理費用，隨著該公司持續管控費用，對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的管理費用亦隨之減少。而支付上海達航、日本大船急東莞達程其他費用主要係委託裝設機械鑽孔機台之服務成本等，經核閱相關租賃合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(3)合併報告關係人之名稱及關係

關係人名稱	與該公司之關係
大船科技股份有限公司(大船科技)	實質關係人
大船科技股份有限公司(東京支店)(東京大船)	實質關係人
永然聯合法律事務所(永然)	實質關係人(註一)
韶瑞開發股份有限公司(韶瑞開發)	實質關係人
大船電子(上海)有限公司(上海大船)	實質關係人
大船電子(東莞)有限公司(東莞大船)	實質關係人(註二)

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

註：1.該公司已全面改選董事及監察人，故於 108 年 5 月 28 日起永然聯合法律事務所非為該公司之關係人。

2.大船企業已出售東莞大船，故自 109 年 9 月 30 日起非為合併公司之關係人。

(4)合併報告與關係人間重大交易事項

A.勞務收入及應收帳款

勞務收入

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	851	0.07	831	0.08	766	12.94. (註 1)

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

註 1：110 年起重分類至業外收入項下，故計算該科目比重基礎變動。

108~110 年度受東京大船委任管理東京大船日本房地產物業管理所收取的管理收入。

應收帳款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	152	0.05	76	0.03	-	-

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

B.其他應付款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
大船科技	984	0.84	-	-	-	-

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

該公司 108 其他應付款主要係應付林口廠水電費之支出，自 109 年起因會計師認定代墊水電之款項非屬關係人交易，故未揭露於財報上，經核閱相關帳冊，尚無重大異常之情形。

C.預付租賃款

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	643	4.05	-	-	-	-

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

預付租賃款主要係依合約預付東京大船一個月之租金支出，經核相關合約，尚無重大差異之情形。

D.承租協議

取得使用權資產

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
上海大船	-	-	11,119	21.81	-	-
東京大船	-	-	35,413	69.46	-	-
東莞大船	9,030	29.16	-	-	-	-
合計	9,030	29.16	46,532	91.27	-	-

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

該集團參考鄰近地區辦公室租金行情分別於 109 年度 1 月份、109 年度 4 月份及 108 年 4 月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約。其租賃交易已依國際財務報導準則第 16 號時分別認列使用權資產、租賃負債及認列利息支出，其交易之必要性尚屬合理。其中日本大船租約係參考 TMAX Valuation 出具之不動產鑑價調查報告書。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

租賃負債

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
上海大船	-	-	9,150	18.15	5,162	6.74
東京大船	-	-	27,861	55.27	18,188	23.76
東莞大船	6,686	28.83	-	-	-	-
合計	6,686	28.83	37,011	73.42	23,350	30.50

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

該集團分別於 109 年 1 月份、109 年 4 月份及 108 年 4 月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約依國際財務報導準則第 16 號所認列之租賃負債。

利息費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	-	-	454	2.89	327	2.25
上海大船	-	-	281	1.79	345	2.38
東莞大船	426	2.34	273	1.74		

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
合計	426	2.34	1,008	6.42	672	4.63

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

該集團分別於 109 年 1 月份、109 年 4 月份及 108 年 4 月份與東京大船、上海大船及東莞大船簽訂為期五年、三年及三年之廠房或辦公室租賃合約依國際財務報導準則第 16 號所認列之利息費用。

租賃費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
大船科技	13,700	3.69	7,743	3.42	4,539	1.76
東京大船	7,208	1.94	-	-	-	-
上海大船	4,008	1.08	3,250	1.43	112	0.04
東莞大船	735	0.20	-	-	-	-
韶瑞開發	60	0.02	60	0.03	60	0.02
合計	25,711	6.93	11,053	4.88	4,771	1.82

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

大船科技 108~110 年度因租賃林口廠所支付之租金，隨著該公司持續管控費用，對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的租賃費用亦隨之減少。東京大船及上海大船租賃費用減少主要是採用 IFRS 16 新公報，致相關費用轉為折舊之影響。東莞大船租賃費用減少主要係租賃予東莞達程為期三年之廠房合約，因東莞大船於 109 年 9 月出售予他人而提前解約所致。經核閱相關租賃合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

E. 存出保證金

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東京大船	868	10.09	1,220	13.86	1,062	12.04
東莞大船	1,173	13.64	-	-	-	-
上海大船	374	4.35	380	4.32	377	4.27
合計	2,415	28.07	1,600	18.18	1,439	16.31

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度承租廠房或辦公室依合約所支付之保證金，經抽核相關

合約，尚無重大異常；另，該公司於 110 年 3 月 15 日支付大船科技存出保證金係因按照原簽訂之合約第二條第三項之規定，需支付兩個月租金為押租保證金，惟 110 年 9 月 30 日止該公司未再續租，故大船科技於 110 年 10 月 5 日返還該筆存出保證金，經檢視相關匯款憑證，尚無重大異常之情形。

F.勞務費

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
永然	73	0.02	-	-	-	-

資料來源：該公司 108~1110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

108 年度主要係支付常年法律顧問聘任費，該公司於 108 年 5 月 28 日全面改選董事及監察人，即日起永然聯合法律事務所已非為該公司之關係人，故揭露關係人交易之勞務費隨之減少。經檢視相關明細，尚無重大異常之情形。

G.其他費用

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
大船科技	1,839	0.50	913	0.40	531	0.21

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

該公司 108~110 年度因租賃林口廠所支付的大樓管理費用，隨著該公司持續管控費用，對辦公室及廠房空間加以調整，租賃面積逐年減少，相對的管理費用亦隨之減少。經核閱相關租賃合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

H.其他收入

單位：新台幣千元

年度 名稱	108 年度		109 年度		110 年度	
	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)	金額	占該科目 比重(%)
東莞大船	-	-	967	38.03	-	-

資料來源：該公司 108~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告及該公司提供。

東莞大船租賃予東莞達程為期三年之廠房合約，因東莞大船於 109 年 9 月出售予他人而提前解約支付予東莞達程之違約金。

2.發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品（指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者），有無相互競爭之情形

達航公司主要從事印刷電路板/載板製程所需雷射鑽孔加工服務、機械鑽孔設備與成型設備之生產銷售服務及設備之關鍵零組件維修、保養與改造等服務。經查閱該公司 109 年度及 110 年度經會計師查核簽證之財務報告，以及鴻圻、大企、大開 109 年度經會計師核簽證之財務報告，並訪談該公司營運管理中心副總經理，茲就該公司同屬集團企業公司之主要業務或產品列示如下，並說明有無相互競爭之情事：

(1)集團企業主要之營業項目：

A.屬該公司直、間接持股之轉投資公司

集團企業名稱	主要營業或主要產品	集團定位及功能
China Expo Limited (以下簡稱：China Expo)	投資控股公司	海外轉投資事業之控股公司
ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED (以下簡稱：ALPHA)(註 1)	投資控股公司	海外轉投資事業之控股公司
ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED (以下簡稱：ALPHA)(註 1)	投資控股公司	海外轉投資事業之控股公司
上海達航實業有限公司 (以下簡稱：上海達航)	PCB 成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣及維修保養	業務據點
東莞達程電子有限公司 (以下簡稱：東莞達程)	印刷電路板設備維修保養及零件販售	業務據點
大船企業日本株式會社 (以下簡稱：日本大船)	設備、零件買賣及維修之業務	研發中心及雷射機台製造

資料來源：該公司提供

註 1：該公司已於 110 年 4 月 19 日完成清算。

B.非屬該公司之轉投資公司

集團企業名稱	主要營運項目或主要產品	集團定位及功能
鴻圻國際股份有限公司 (以下簡稱：鴻圻)	一般投資業、不動產租賃業	為該公司大股東黃立達先生直接或間接持有之公司，實質認定左列 12 家公司為該公司之集團企業
鴻洋投資股份有限公司 (以下簡稱：鴻洋)	一般投資業	
大船企業股份有限公司 (以下簡稱：大企)	投資控股公司	
大船開發股份有限公司 (以下簡稱：大開)	不動產租賃業	
大船科技股份有限公司 (以下簡稱：大科)	投資業務及不動產租賃業	

集團企業名稱	主要營運項目或主要產品	集團定位及功能
大船國際實業有限公司 (以下簡稱：大船國際)	投資控股公司	
OFUNA HOLDING COMPANY LIMITED(以下簡稱：OFUNA HOLDING) (註 2)	投資控股公司	
ARIA WORLDWIDE LTD. (以下簡稱：ARIA)(註 3)	投資控股公司	
ARRIS CORP. (以下簡稱：ARRIS)	投資控股公司	
達航工業(香港)有限公司 (以下簡稱：達航工業(香港))	投資控股公司	
大船電子(上海)有限公司 (以下簡稱：大船電子(上海))	不動產租賃業	
達航電子設備(上海)有限公司 (以下簡稱：達航電子設備(上海))	不動產租賃業	

資料來源：該公司提供

註 2：OFUNA HOLDING 已於 110 年 3 月 29 日註銷。

註 3：ARIA 已於 110 年 5 月 3 日註銷。

(2)該公司與集團企業間有無競業情形之評估

A.屬該公司直、間接持股轉投資公司

- (A).China Expo及ALPHA分別為該公司100%轉投資公司，MEGA為該公司透過China Expo100%持有之轉投資公司，主要營業項目皆為國際投資，僅為投資控股功能，與該公司業務無相互競爭之情形。
- (B).上海達航係為該公司透過MEGA持有100%轉投資之子公司，主要營業項目為PCB成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣、維修保養及雷射加工服務，主要負責該公司PCB鑽孔機於中國大陸之銷售業務及雷射加工服務，由該公司主導上海達航之經營決策方向，彼此並非業務競爭關係，為業務營運範圍之延伸，與該公司業務無相互競爭之情形。
- (C).東莞達程為該公司透過子公司China Expo持有49.77%以及透過孫公司上海達航持有50.23%轉投資之子公司，主要營業項目為PCB成型機、鑽孔機設備及零件進口買賣及維修保養，主要負責該公司PCB鑽孔機於中國大陸華南地區之銷售業務，由該公司主導東莞達程之經營決策方向，彼此並非業務競爭關係，為業務營運範圍之延伸，與該公司業務無相互競爭之情形。
- (D).日本大船為該公司持股100%之轉投資公司，主要營業項目為設備、零件買賣、維修及研發之業務，主要負責該公司的雷射機台研發及機台製造業務，由該公司主導日本大船之經營決策方向，彼此並非業務競爭關係，

與該公司業務無相互競爭之情形。

B.非屬該公司之轉投資公司

(A).鴻洋主要營業項目為一般投資業，鴻圻主要營業項目為一般投資業及不動產租賃業，前述兩家公司皆與該公司業務無相互競爭之情形。

(B).大企最近兩年度並無營業收入，目前為投資控股功能，與該公司業務無相互競爭之情形。

(C).大開及其子公司大船電子(上海)、達航電子設備(上海)主要營業項目為不動產租賃業務；大科為投資業務及不動產租賃；子公司大船國際、OFUNA HOLDING、ARIA、ARRIS及達航工業(香港)則為投資控股公司，大開及其子公司皆與該公司業務無相互競爭之情形。

綜上所述，該公司與同屬集團企業公司之主要業務，尚無相互競爭之情事，且具獨立行銷之能力。

二、財務狀況

(一)應列明發行人最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證財務報告之損益狀況及財務比率，並作變動分析與同業比較

1.選擇採樣公司之理由

該公司之主要業務內容為雷射鑽孔加工服務、自主研發生產之機械鑽孔機、成型機之設備銷售以及其效能提升與維修保養服務等。該公司在產業供應鏈中的定位係屬中游，負責基板之加工，其產品與服務主係應用於 IC 載板、HDI 載板的製程中。

綜觀國內 PCB 產業之上市櫃公司，經考量營業項目、產品結構及產業上下游關聯性等因素，選取上市公司大量科技股份有限公司(股票代號：3167，以下簡稱：大量)、上櫃公司凱崑電子股份有限公司(股票代號：5498，以下簡稱：凱崑)以及上市公司尖點科技股份有限公司(股票代號：8021，以下簡稱：尖點)，以茲比較：

大量為半導體產品檢測設備、PCB 設備及 CNC 彫銑機械製造商，主要產品 CNC 精密機器，應用於 PCB 鑽孔定位、成型切割、點膠、曲線滾塗等塗佈製程電漿之蝕刻、鍍膜等表面改質製程、晶片本體及外觀缺陷之檢查與測試等範圍，相關之營收比重約占八成。凱崑主要從事 PCB 切削刀具製造及銷售、銅箔基板代理銷售以及電路板製程代工（機械鑽孔、機械成型與雷射鑽孔），其中 PCB 切削刀具及電路板製程代工兩項業務之營收比重約占七成。尖點主要產品為精密金屬鑽針與銑刀製品及鑽孔加工服務，兩項業務營收比重約占九成，其鑽針及銑刀主要用於 IC 載板、HDI、PCB 硬板、軟板內層線路鑽孔導通及成品切割，亦提供客戶機械鑽孔及雷射鑽孔服務。

另，同業平均之財務比率資料則是參考財團法人金融聯合徵信中心之「產業財務

統計資訊」中之「C26 電子零組件製造業」之數據，作為同業平均之比較基礎。

2. 最近期及最近三個會計年度財務報告之損益狀況、變動分析及與同業之比較

單位：新台幣千元;%

項目	公司 \ 年度	108年度	109年度			110年度		
		金額	金額	註1	註2	金額	註1	註2
營業收入	達航	1,175,825	1,000,900	(174,925)	(14.88)	1,245,511	244,611	24.44
	大量	1,942,637	2,427,607	484,970	24.96	4,443,506	2,015,899	83.04
	凱崴	1,255,128	1,264,376	9,248	0.74	註 3	-	-
	尖點	3,006,253	2,973,426	(32,827)	(1.09)	3,773,746	800,320	26.92
營業成本	達航	757,806	664,891	(92,915)	(12.26)	859,360	194,469	29.25
	大量	1,390,768	1,711,540	320,772	23.06	3,293,553	1,582,013	92.43
	凱崴	1,083,457	1,089,620	6,163	0.57	註 3	-	-
	尖點	2,147,058	2,004,162	(142,896)	(6.66)	2,539,688	535,526	26.72
營業毛利	達航	418,019	336,009	(82,010)	(19.62)	386,151	50,142	14.92
	大量	551,869	716,067	164,198	29.75	1,149,953	433,886	60.59
	凱崴	171,671	174,756	3,085	1.80	註 3	-	-
	尖點	859,195	969,264	110,069	12.81	1,234,058	264,794	27.32
營業費用	達航	371,063	226,657	(144,406)	(38.92)	257,712	31,055	13.70
	大量	342,219	513,245	171,026	49.98	599,075	85,830	16.72
	凱崴	123,328	137,969	14,641	11.87	註 3	-	-
	尖點	579,421	497,159	(82,262)	(14.20)	608,831	111,672	22.46
營業淨利(損)	達航	46,956	109,352	62,396	132.88	128,439	19,087	17.45
	大量	209,650	202,822	(6,828)	(3.26)	550,878	348,056	171.61
	凱崴	48,343	36,787	(11,556)	(23.90)	註 3	-	-
	尖點	307,102	467,417	160,315	52.20	643,002	175,585	37.56
營業外收支	達航	7,393	686	(6,707)	(90.72)	(7,363)	8,049	1173.32
	大量	17,467	252,389	234,922	1344.95	16,315	(236,074)	(93.54)
	凱崴	47,369	80,379	33,010	69.69	註 3	-	-
	尖點	357	(1,857)	(2,214)	620.17	22,343	24,200	(1303.18)
本期淨利(損)	達航	50,403	89,295	38,892	77.16	91,064	1,769	1.98
	大量	176,434	415,518	239,084	135.51	438,849	23,331	5.61
	凱崴	74,531	89,057	14,526	19.49	註 3	-	-
	尖點	203,007	303,546	100,539	49.52	491,194	187,648	61.82
本期其他綜合 損益(稅後淨額)	達航	(22,885)	(11,872)	11,013	(48.12)	(18,431)	6,559	55.25
	大量	(56,619)	22,027	78,646	(138.90)	(13,072)	(35,099)	(159.35)
	凱崴	24,367	215,089	190,722	782.71	註 3	-	-
	尖點	(149,283)	57,850	207,133	(138.75)	(22,418)	(80,268)	(138.75)
本期綜合損益 總額	達航	27,518	77,423	49,905	181.35	72,633	(4,790)	(6.19)
	大量	119,815	437,545	317,730	265.18	425,777	(11,768)	(2.69)
	凱崴	98,898	304,146	205,248	207.54	註 3	-	-

項目	年度	108年度	109年度			110年度		
	公司	金額	金額	註1	註2	金額	註1	註2
	尖點	(126,585)	361,396	487,981	385.50	468,776	107,380	29.71

資料來源：各公司各年度及各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

註 1：較前一年度相同期間之增減金額

註 2：較前一年度相同期間之增減比率

(1)營業收入、成本與毛利變動原因說明

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度財務報告之營業收入、營業成本及營業毛利變動原因，請詳見本評估報告「參、一、(四)、1、發行人最近期及最近三個會計年度財務報告之業績概況」之說明。

(2)營業費用及營業利益

最近期及最近三個會計年度營業費用明細表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	108年度	109年度	110 年度
推銷費用	115,065	77,495	81,935
管理費用	150,267	98,025	109,863
研發費用	89,147	66,331	65,918
預期信用風險損失(利益)	16,584	(15,194)	(4)
營業費用合計	371,063	226,657	257,712
費用率(%)	31.56	23.63	20.69

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

最近期及最近三個會計年度營業費用率及營業利益率同業比較表

項目	年度	108年度	109年度	110 年度
營業費用率(%)	公司			
	達航	31.56	23.63	20.69
	大量	17.62	21.14	13.48
	凱崴	9.83	10.91	註 1
營業利益率(%)	尖點	19.27	16.72	16.13
	達航	3.99	10.93	10.31
	大量	10.79	8.35	12.40
	凱崴	3.85	2.91	
	尖點	10.22	15.72	17.04

資料來源：各公司各年度經會計師查核簽證之財務報告，康和證券計算

註 1：截至評估報告出具日止，尚未出具 110 年度經會計師查核簽證之財務報告。

A、營業費用

該公司 108 年度~110 年度之營業費用分別為 371,063 千元、226,657 千元及 257,712 千元，109 年度營業費用較 108 年度減少 144,406 千元，主係因 108 年間對於中國大陸華東、華南地區的營運據點進行整合，致營業費用減少 36,207 千元，以及處分子公司大船煙台股權，致營業費用減少 23,940 千元，復因 109 年度新冠肺炎疫情影響交際費用及旅費支出減少 14,665 千元，且 109 年度雷射應用加工服務以少樣多量，致雷射應用設備精進改良開發投入減少 21,087 千元，此外，該公司另於 109 年度收回 108 年度已提列備抵呆帳之應收帳款，於 109 年度迴轉減損損失，致 109 年度預期信用風險損失較 108 年度減少 31,778 千元；另 110 年營業費用較 109 年度增加 9,210 千元，主要係因 110 年申請股票初次上櫃費支付中介機構包含會計師、律師及推薦券商等勞務費用增加 9,318 千元所致。該公司 108~110 年度之營業費用率分別為 31.56%、23.63%及 20.69%，經前述組織調整後，該公司之營業費用率於 109 年度及 110 年度下降至 22.63%及 20.67%。茲就營業費用組成之變動原因說明如下：

① 推銷費用

該公司推銷費用主要包含業務人員薪資及獎金支出、保險費用、交際費用、旅費、廣告費用等項目，108 至 110 年度之推銷費用分別為 115,065 千元、77,495 千元及 81,935 千元，占各期營業收入比重分別為 9.79%、7.74%及 6.58%。109 年度較 108 年度減少 37,570 千元，減少幅度 32.65%，係因 108 年度該公司調整中國區營運策略布局對於中國大陸華東、華南地區的營運據點進行整合，並處分子公司大船煙台股權，華北地區員工人數裁減 51 人，使 109 年度薪資費用較 108 年度減少 11,750 千元，另 109 年度因新冠肺炎影響下，全球各地政府限縮人流的經濟活動範圍，致該公司的交際費用及旅費支出較 108 年度分別減少 10,043 千元及 4,622 千元，110 年度較 109 年度增加約 1,041 千元，因增加幅度僅 1.76%，故不擬深入分析。

② 管理費用

該公司管理費用主要包含薪資支付、保險費用、租金支出、折舊、保險費用等項目，108 至 110 年度之管理費用分別為 150,267 千元、98,025 千元及 109,863 千元，占各期營業收入比重分別為 12.78%、9.79%及 8.82%，109 年度較 108 年度減少 52,242 千元，減少幅度 34.77%，係因該公司集團政策之營運策略調整，於 108 年 8 月為樽節管理費用支出，將原先向關係人大船開發公司承租林口廠之辦公管理中心，遷移至台中大甲幼獅工業區之自有廠區，落實廠辦合一，致該公司員工人數大幅縮減 18 人，且同年 10 月除了處分子公司大船煙台公司股權外，亦縮減大陸地區華東、華南營運地區之員工人力，由 47 人減至 12 人，致薪資費用減少 23,943 千元、租金費用減少 4,042 千元、保險費用減少 5,121 千元、折舊費用減少 4,222 千元及其他費用減少 5,581 千元。110 年管理費用較 109 年度增加 11,838 千元，增加幅度 12.08%，主要係因 110 年度申請股票初次上櫃費支付中介機構包含會計師、律師及推薦券商等勞務費用增加 9,318 千元、翻修裝潢臺中精工廠的修繕費用增加 635 千元、新購辦公桌椅之雜項購置增加 371 千元所致。

③ 研究發展費用

該公司研究發展費用主要包含研發部門薪資支付、保險費、資訊軟體使用費、勞務費用、檢測費用等項目，108 至 110 年度之研發費用分別為 89,147 千元、66,331 千元及 65,918 千元，占各期營業收入比重分別為 7.58%、6.62%及 5.29%。109 年度較 108 年度減少 22,816 千元，減少幅度為 25.59%，係因 109 年度雷射應用加工服務以少樣多量，致雷射應用設備精進改良開發投入減少 21,087 千元，隨著該公司雷射應用設備已逐漸成熟且已貼近市場需求下，致 110 年度較 109 年度減少 413 千元，減少幅度 0.63%。

④ 預期信用風險損失(利益)

該公司 108 至 110 年度之預期信用風險損失(利益)分別為 16,584 千元、(15,194)千元及(4)千元，占各期營收比重分別為 1.41%、(1.52)%及 0.00%，109 年度較 108 年度減少 31,778 千元，變動幅度(191.62)%，係因 108 年度 L 公司及雄福之逾期應收帳款，於 109 年度已陸續回收所致，110 年度因金額微小，故不擬予深入分析。

B、營業利益

該公司 108 至 110 年度之營業利益分別為 46,956 千元、109,352 千元及 128,439 千元，另營業利益率分別為 3.99%、10.93%及 10.31%，109 年度營業利益較 108 年度增加 63,227 千元，增加幅度 134.65%，係因該公司於 108 年度調整中國區營運策略布局，同時將林口辦公處南遷至臺中精工廠區，致 109 年度營業費用較 108 年度減少 141,113 千元，營業利益率由 3.99%上升至 10.93%，110 年營業利益較 109 年度增加 19,087 千元，增加幅度 17.45%，分別係因 110 年度因雷射應用需求訂單減少，受產品銷售組合調整影響，營業毛利增加 50,142 千元，又 109 年營業費用因迴轉原提列 L 公司的呆帳費用 10,355 千元所致。

(3)營業外收入及支出

單位：新台幣仟元；%

年度		108 年度	109 年度	110 年度
利息收入	利息收入	919	634	513
其他收入	其他	3,290	3,374	5,921
其他利益及損失	處分子公司利益	28,850	6,885	—
	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	(1,829)	4,885	(1,300)
	淨外幣兌換利益(損失)	(1,970)	3,346	6,282
	租賃修改利益	59	194	2
	不動產、廠房及設備減損回升利益	356	—	—
	手續費支出	(1,875)	(1,720)	(2,001)
	其他	(2,164)	(1,188)	(2,266)
財務成本		(18,243)	(15,724)	(14,514)

合計	7,393	686	(7,363)

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

A、利息收入

該公司 108~109 年度及 110 年度利息收入分別為 919 千元、634 千元及 513 千元，主係該公司帳上資金存放銀行存款及押金設算之利息收入，109 年度較 108 年度減少 285 千元，係因該公司美金存款部位，受因新臺幣匯率升值影響所致，110 年較 109 年度減少 121 千元，係存款利息減少所致。

B、其他收入

該公司 108~109 年度及 110 年度其他收入分別為 3,290 千元、3,374 千元及 5,921 千元，109 年度較 108 年度增加 84 千元，增加幅度 2.55%，係因變動幅度微小，故不擬深入分析，110 年度較 109 年度增加 2,547 千元，主係因勞資和解金 200 千元及出售中國大陸區使用車牌約 2,064 千元。

C、處分子公司利益

該公司 108~109 年度及 110 年度之處分子公司利益分別為 28,850 千元、6,885 千元及 0 千元，係因 108 年 10 月出售子公司大船煙台股權所產生之利益，出售合約內容述明價款之 5%係於大船煙台之應收帳款實際收回後，始有向買方收取之權利，故於 108 年度計算處分投資利益時，未將其 5%納入計算，而於 109 年度確認已達成履約義務時，始認列此變動價款之處分利益。

C、處分不動產、廠房及設備利益(損失)

該公司 108~109 年度及 110 年度處分不動產、廠房及設備利益(損失)分別為 (1,829)千元、4,885 千元及(1,300)千元，該公司於 108 年度第二季逐步調整集團營運策略，108 年度因出售子公司大船煙台之股權後，將部分老舊設備處分致產生損失 1,829 千元，109 年度係因出售日系它牌老舊雷射鑽孔設備所產生利益，另 110 年度則係該公司將臺灣區部分什項設備處分所產生之損失。

D、淨外幣兌換利益(損失)

該公司 108~109 年度及 110 年之淨外幣兌換利益(損失)分別為(1,970)千元、3,346 千元及 6,282 千元，109 年度由 108 年度之兌換損失轉為外幣兌換利益，係因該公司於中國大陸區銷貨收款，採美元交易，然 108 年度美中貿易關係漸緩，美國 Fed 降息及英國脫歐等國際政經變動，造成美元走弱，而致有匯兌損失，109 年度及 110 年度因該公司向子公司日大船購置設備付款，採日幣交易，因受日圓走弱、新臺幣走強影響，產生外幣兌換利益。為避免匯率波動之風險，該公司與

往來銀行隨時保持密切聯繫，並請銀行提供專業諮詢，以因應國際間匯率的走勢，且該公司財務部門在外匯資金保留外幣部位，並視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動之影響。

E、租賃修改利益

該公司 108~109 年度及 110 年度之租賃修改利益分別為 59 千元、194 千元及 2 千元，109 年度較 108 年增加 135 千元，係因東莞達程與大船科技(東莞)有限公司提前終止租賃契約所致，110 年度租賃修改利益，係因該公司之子公司員工住宿提前終止租賃所致。

F、不動產、廠房及設備減損回升利益

該公司 108 年度之不動產、廠房及設備減損回升利益 356 千元，係 108 年第三季大船煙台出售設備所產生之資產評價利益回升。

G、手續費支出

該公司 108~109 年度及 110 年度之手續費支出分別為 1,875 千元、1,720 千元及 2,001 千元，主係銀行匯款手續費支出，109 年度較 108 年度減少 155 千元，110 年度較 109 年度增加 281 千元其變動均因外幣匯款之業務頻率增減之影響。

H、其他

該公司 108~109 年度及 110 年之其他分別為(2,164)千元、(1,188)千元及(2,266)千元，108 年度及 109 年度主係分期支付 M-2 賠償款(共賠償美金 100 千元)，分別支付 1,928 千元及 688 千元，110 年度較 109 年度增加損失 1,078 千元，主係因上海達航遷址，經當地稅局核定補繳 105 年度中國大陸內銷稅 2,193 千元所致。

I、財務成本

該公司 108~109 年度及 110 年度之財務成本分別為 18,243 千元、15,724 千元及 14,514 千元，主要包含銀行借款利息、租賃負債之利息、應收帳款讓售利息、應付公司債利息及其他財務成本，109 年度較 108 年度財務成本減少 2,519 千元，減少幅度 13.81%，係因 109 年間陸續償還銀行借款，致銀行借款利息減少 3,440 千元，110 年度較 109 年度減少 1,210 千元，減少幅度 7.70%，係因銀行借款減少所致。

(4)本期淨利、本期其他綜合損益及本期綜合損益總額

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年度	109年度	110 年度

項目 \ 年度	108年度	109年度	110 年度
本期淨利(損)	50,403	89,295	91,064
本期其他綜合損益	(22,885)	(11,872)	(18,431)
本期綜合損益總額	27,518	77,423	72,633

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

該公司 108~109 年度及 110 年度之本期淨利分別為 50,403 千元、89,295 千元及 91,064 千元；本期其他綜合損益分別為(22,885)千元、(11,872)千元及(18,431)千元；本期綜合損益總額 27,518 千元、49,905 千元及 72,633 千元，108~109 年度及 110 年度之本期淨利、本期其他綜合損益及本期綜合損益總額逐年成長，係因應 5G 產品的載板製程，受 ABF 材質限制下，致下游印刷電路板廠對雷射鑽孔設備或高階機械鑽孔設備需求上升，致該公司之營業毛利率維持約 31.00%~35.55%，另營業費用率部分，該公司由 108~109 年度及 110 年度分別為 31.56%、23.63%及 20.69%逐年下滑，致該公司之本期淨利、本期其他綜合損益及本期綜合損益總額逐年成長。

整體而言，該公司最近三年度本期淨利之變化及與同業比較情形，尚無重大異常之情形。

3.最近三個會計年度經會計師查核簽證財務報告之財務比率，並做變動分析與同業比較

分析項目			年度 公司別	108年度	109年度	110年度
財務結構	占資產比率 (%)	權 益	達航	54.12	52.80	47.76
			大量	44.94	37.90	39.09
			凱崴	57.14	57.56	註 6
			尖點	75.48	75.23	69.31
			同業	60.30	59.50	註 1
		負 債	達航	45.88	47.20	52.24
			大量	55.06	62.10	60.91
			凱崴	42.86	42.44	註 6
			尖點	24.52	24.77	30.69
			同業	39.70	40.50	註 1
	長期資金占不動產、廠房及設 備比率(%)		達航	161.88	129.58	132.52
			大量	529.57	177.67	264.99
			凱崴	239.11	252.70	註 6
			尖點	281.18	351.07	367.61
			同業	48.20	44.10	註 1
償債能力	流動比率(%)		達航	138.05	114.22	107.25
			大量	246.05	135.83	204.23
			凱崴	208.34	207.05	註 6
			尖點	452.97	455.53	387.39
			同業	315.00	280.10	註 1
	速動比率(%)		達航	69.01	54.68	39.55
			大量	181.44	82.33	132.83
			凱崴	147.47	162.42	註 6
			尖點	402.21	406.95	336.49
			同業	256.70	222.50	註 1
經營能力	應收款項週轉率(次) (註 3)		達航	3.41	3.23	5.29
			大量	1.10	1.55	2.32
			凱崴	1.81	1.81	註 6
			尖點	2.35	2.64	3.06
			同業	4.70	5.00	註 1
	應收款項收現天數		達航	107	113	69
			大量	332	236	157
			凱崴	202	203	註 6
			尖點	156	139	119
			同業	78	73	註 1

分析項目			年度 公司別	108年度	109年度	110年度
	存貨週轉率(次) (註 3)		達航	1.39	1.39	1.62
			大量	1.62	1.50	2.30
			凱崑	2.35	2.45	註 6
			尖點	4.49	4.37	4.34
			同業	6.00	5.80	註 1
	平均售貨天數		達航	263	263	226
			大量	226	244	159
			凱崑	156	149	註 6
			尖點	82	84	84
			同業	61	63	註 1
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)		達航	1.75	1.21	1.27
			大量	4.14	2.41	3.04
			凱崑	1.31	1.29	註 6
			尖點	1.57	1.86	2.42
			同業	4.70	5.20	註 1
獲利能力	資產報酬率(%)		達航	3.33	5.16	4.76
			大量	4.64	9.19	8.22
			凱崑	2.95	3.14	註 6
			尖點	3.49	5.06	7.22
			同業	2.00	4.10	註 1
	權益報酬率(%)		達航	4.86	8.47	8.42
			大量	9.26	21.37	20.10
			凱崑	4.40	4.71	註 6
			尖點	4.44	6.54	9.82
			同業	1.00	3.60	註 1
	占實收資本額 比率(%)	營業利益	達航	10.59	24.66	29.86
			大量	26.16	25.31	68.74
			凱崑	2.93	2.17	註 6
			尖點	21.60	32.94	45.22
			同業	註 2	註 2	註 2
		稅前純益	達航	12.26	24.81	28.15
			大量	28.34	56.80	70.78
			凱崑	5.81	6.92	註 6
			尖點	23.28	32.81	46.80
			同業	註 2	註 2	註 2
	純益率(%)		達航	4.29	8.92	7.31
			大量	9.08	17.11	9.88
			凱崑	5.94	7.04	註 6

分析項目		年度 公司別	108年度	109年度	110年度
		尖點	6.75	10.23	13.02
		同業	-3.70	29.00	註 1
	每股盈餘(元)	達航	1.18	2.09	2.12
		大量	2.22	5.23	5.51
		凱崑	0.42	0.52	註 6
		尖點	1.34	1.98	3.14
		同業	註 2	註 2	註 2
現金 流量	現金流量比率(%)	達航	註 4	55.19	46.31
		大量	31.75	11.38	註 4
		凱崑	10.33	6.51	註 6
		尖點	107.63	87.55	57.19
		同業	16.20	19.10	註 1
	淨現金流量適當比率(%)	達航	36.87	70.66	51.99
		大量	56.39	31.28	24.62
		凱崑	96.36	52.40	註 6
		尖點	170.91	197.57	158.10
		同業	註 2	註 2	註 2
	現金再投資比率(%)	達航	註 4	19.77	17.51
		大量	5.71	5.75	註 4
		凱崑	2.32	1.54	註 6
		尖點	7.49	6.59	4.62
		同業	4.00	4.60	註 1
槓 桿 度	營運槓桿度	達航	3.81	2.36	2.26
		大量	0.86	1.37	1.08
		凱崑	3.25	4.26	註 6
		尖點	4.84	3.30	1.48
		同業	註 2	註 2	註 2
	財務槓桿度	達航	1.64	1.17	1.13
		大量	1.15	1.15	1.07
		凱崑	1.59	1.96	註 6
		尖點	1.06	1.02	1.02
		同業	註 2	註 2	註 2

資料來源：1.各公司經會計師查核簽證合併財務報告、各公司股東會年報、公開資訊觀測站及康和證券整理。

2.同業平均資料係取自財團法人金融聯合徵信中心「產業財務統計資訊」之 IFRSs 合併財報財務比率，行業類別為「C26 電子零組件製造業」。

註 1：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版 110 年度同業平均資料。

註 2：財團法人金融聯合徵信中心之「產業財務統計資訊」未提供該項資訊。

註 3：應收款項週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

註4：營業活動淨現金流量為淨流出，故不適用。

註5：各採樣公司定義之變動營業成本與費用不同，故僅排除折舊費用及攤銷費用予以計算。

註6：凱歲截至評估報告出具日止，尚未公告110年度合併財務報告。

註7：財務比率計算公式如下：

1.財務結構

(1) 權益占資產比率=權益總額/資產總額。

(2) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(3) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1) 流動比率=流動資產/流動負債。

(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

3.經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現天數=365/應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4) 平均售貨天數=365/存貨週轉率。

(5) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

4.獲利能力

(1) 資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3) 營業利益占實收資本額比率=營業利益/實收資本額。

(4) 稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/實收資本額。

(5) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(6) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6.槓桿度

營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

7.財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

(1)財務結構

A.權益占資產比率及負債占資產比率

該公司權益占資產比率最近三年度分別為 54.12%、52.80%及 47.76%；負債占資產比率最近三年度分別為 45.88%、47.20%及 52.24%。109 年初面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，終端市場需求明顯下滑，衝擊全球 PCB 產業，但也使遠距工作、線上學習等需求趁勢崛起，帶動資料中心、個人電腦、平板電腦等應用需求提升，且 5G、AI 等應用帶動高效能運算晶片需求持續放大，驅動 ABF 載板需求持續成長，受惠相關需求成長的帶動，該公司年底的預收貨款及備料準備均較去年底提升，使期末合約負債及應付帳款均較去年同期增加，致使 109 年度權益占資產比率下降，負債占資產比率上升；110 年度因設備產銷訂單之增加，預收貨款及採購原料產生之應付帳款隨之增加，使權益占資產比率下降，負債占資產比率上升。

該公司最近三年度負債占資產比率與採樣公司及同業平均互有高低，該公司負債占資產比率維持在五成左右，其變動幅度不高，變動原因主係受營運面波動影響，尚無發現重大異常之情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司長期資金占不動產、廠房及設備比率最近三年度分別為 161.88%、129.58%及 132.52%。109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 108 年度下滑，主係該公司 106 年起新增雷射鑽孔加工業務，有鑑於 5G 高頻高速的時代來臨，ABF 載板、IC 載板等高階材料之雷射鑽孔需求逐年攀升，該公司持續增加雷射機台設備，並於大甲精工廠增設雷射車間，因此不動產、廠房及設備淨額於 109 年度增加 220,480 千元所致。而 110 年度因 109 年度獲利轉入保留盈餘，權益總額增加，使長期資金占不動產、廠房及設備比率小幅上升。

由於該公司雷射鑽孔加工業務所需，持續增加購置機器設備，致該公司最近三年度長期資金占不動產、廠房及設備比率低於採樣公司，但比率仍均高於 100%，顯示該公司長期資金仍足以支應不動產、廠房及設備之投資需求，尚無以短支長之現象，財務結構尚屬穩定。

綜上所述，該公司最近三年度財務結構變化趨勢及變動原因尚屬合理，且與採樣公司及同業平均相較互有高低，顯示該公司財務結構尚屬穩健。

(2)償債能力

A.流動比率

該公司流動比率最近三年度分別為 138.05%、114.22%及 107.25%。109 年度流動比率較 108 年度下降，主係流動負債增加、流動資產減少所致，流動負債增

加主係疫情逐漸穩定帶動相關需求增加，該公司年底的預收貨款及備料準備較去年底增加，使期末合約負債及應付帳款均較去年同期增加；流動資產減少主係疫情雖逐漸穩定，但產業仍處復甦階段，客戶仍偏觀望態度，保守下單，在營運規模縮小的情況下，期末應收帳款及存貨均較去年同期減少。110 年度採購需求隨市場回溫而增加，存貨及應付帳款均較去年底增加，惟流動資產增加幅度小於流動負債增加幅度，致使 110 年度流動比率較 109 年度小幅降低。

該公司流動比率最近三年度均低於採樣公司及同業平均，惟比率仍維持在 100%以上，顯示該公司之短期償債能力尚無疑慮。

B.速動比率

該公司速動比率最近三年度分別為 69.01%、54.68%及 39.55%，存貨淨額占資產比重約在 22%至 27%之間，並無大幅變動，速動比率變動原因與流動比率變動原因大致相同，與採樣公司及同業平均相較，該公司最近三年度速動比率低於採樣同業及同業平均。

該公司速動比率均小於 100%，為評估短期償債能力，須了解應收款項之變現週期，應收款項週轉率最近三年度分別為 3.41 次、3.23 次及 5.29 次，均優於採樣公司，雖該公司速動比率不足 100%，短期償債壓力相對較大，但考量應收款項週轉率表現較佳，收款天期較短，評估整體短期償債能力尚可。

綜上所述，該公司最近三年度償債能力低於採樣公司及同業平均，惟考量應收款項週轉率表現相對優異，短期償債能力尚可，尚無重大異常之情事。

(3)經營能力

A.應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司應收款項週轉率最近三年度分別為 3.41 次、3.23 次及 5.29 次，換算應收款項收現天數分別為 107 天、113 天及 69 天。109 年度應收帳款週轉率較 108 年度下降，主係受到外在環境美中貿易大戰及 COVID-19 疫情蔓延不確定性因素提高及該公司營運策略調縮減中國大陸營運規模所致。109 年初面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，客戶偏觀望態度，保守下單，使 109 年度營收表現小幅衰退，營收較去年同期減少 174,925 千元。應收款項與營收皆呈現下滑趨勢，惟平均應收款項之計算係涵蓋最近兩年度的應收款項餘額，使平均應收款項的減少幅度較為趨緩，致使應收款項週轉率下降。110 年度隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，使營收較 109 年度上升約 24.44%，且平均應收款項餘額較 109 年度下降，致使應收款項週轉率及應收款項收現天數較去年同期改善。

該公司應收款項週轉率及應收款項收現天數最近三年度均優於採樣公司，較同業平均差，主係該公司營運規模較同業平均小，對主要銷售客戶之交易條件可能較差所致，但該公司應收款項之控管良好，應收款項收款天數尚符合主要客戶

之收款條件，應無重大異常之情事。

B.存貨週轉率及平均售貨天數

該公司存貨週轉率最近三年度分別為 1.39 次、1.39 次及 1.62 次，換算平均售貨天數分別為 263 天、263 天及 226 天。108 年度及 109 年度存貨週轉率差異不大，故不擬深入分析。108 年度及 109 年度在美中貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)衝擊下，市場需求萎縮，訂單減少，但 110 年度隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，營業成本較 109 年度上升約 29.25%，平均存貨淨額較 109 年度上升約 11.26%，致使 110 年度存貨週轉率及平均售貨天數較去年改善。

該公司存貨週轉率及平均售貨天數最近三年度均較採樣公司及同業平均差，主係該公司將營業重心從設備產銷轉移至鑽孔加工等專業服務，惟該公司整體存貨水位約占總資產兩成，應不致遭遇庫存過多而產生之潛在營運風險，且 110 年度隨市場回溫帶動設備產銷的業績，其存貨週轉率與平均售貨天數略為改善，經評估應無重大異常之情事。

C.不動產、廠房及設備週轉率

該公司不動產、廠房及設備週轉率最近三年度分別為 1.75 次、1.21 次及 1.27 次。該公司 106 年起增加雷射鑽孔加工服務業務，最近三年陸續購入雷射鑽孔機台，且因 109 年下半年 ABF 載板、IC 載板等高階材料之雷射鑽孔需求增加，該公司除持續增加雷射機台設備外，亦於大甲精工廠中增設雷射車間以處理雷射鑽孔代工之訂單，因此不動產、廠房及設備淨額逐年增加，但 109 年度營業收入受到美中貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)不確定因素影響，客戶持保守觀望態度，機械鑽孔機及成型機銷售下滑，致使 109 年度不動產、廠房及設備週轉率較 108 年度下降。而 110 年度隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加，使營收較 109 年度上升約 24.44%，平均不動產、廠房及設備淨額較 109 年度增加約 18.05%，致使 110 年度不動產、廠房及設備週轉率上升。

該公司最近三年度不動產、廠房及設備週轉率與採樣公司互有高低，而低於同業平均，主係因營運策略的調整，逐年增加機台設備採購，不動產、廠房及設備金額逐年上升，且訂單量受到美中貿易戰及新冠肺炎(COVID-19)之衝擊而下滑，皆影響著不動產、廠房及設備利用效率，上述變動原因尚屬合理，且不動產、廠房及設備週轉率仍大於 1，顯示其利用效率尚可，經評估應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近三年度經營能力各項指標表現尚可，應無重大異常之情事。

(4)獲利能力

A.資產報酬率及權益報酬率

該公司最近三年度資產報酬率分別為 3.33%、5.16%及 4.76%，權益報酬率則分別為 4.86%、8.47%及 8.42%。109 年度營業收入因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響而小幅衰退，但在適度調整人力及辦公處所下，營業費用控管得宜較 108 年度減少 141,114 千元，使得稅後淨利仍較去年同期增加，使 109 年度資產報酬率及權益報酬率較去年同期上升。110 年度營業收入雖隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，惟設備產銷之毛利較低，稅後損益僅較 109 年度上升約 1.98%，而平均資產總額及平均權益總額分別增加約 9.35%及 2.57%，致使 110 年度資產報酬率及權益報酬率小幅下滑。

該公司最近三年度資產報酬率及權益報酬率與採樣公司及同業平均互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好，尚無重大異常之情事。

B.營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近三年度營業利益占實收資本額比率分別為 10.59%、24.66%及 29.86%；稅前純益占實收資本額比率則分別為 12.26%、24.81%及 28.15%。109 年營業收入因 COVID-19 疫情影響而下滑，但透過精實組織架構降低營業費用，致使營業利益及稅前純益上升，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較去年同期上升。110 年度營業收入隨著市場逐漸回溫，設備產銷收入增加而上升，使營業利益及稅前純益較 109 年度上升，使該兩項比率均較 109 年度上升。

該公司最近三年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率與採樣公司互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好。

C.純益率及每股盈餘

最近三年度純益率分別為 4.29%、8.92%及 7.31%，每股盈餘分別為 1.18 元、2.09 元及 2.12 元。109 年度因受到美中貿易戰及新冠疫情之影響，營業收入表現下滑，雖營業收入表現下滑，但透過精實組織，營業費用較前一年度減少，稅後損益表現較前一年度上升，致使 109 年度純益率較前一年度上升。110 年度營業收入因設備產銷收入增加而上升，較去年同期增加約 24.44%，然設備產銷之毛利較不佳，使稅後損益僅較 109 年度上升約 1.98%，其幅度小於營業收入之增加幅度，致使 110 年度純益率較去年同期小幅下滑。每股盈餘則是因加權平均已發行股數變動不大，其變動方向與稅後損益之變動方向相同，呈逐年增加趨勢。

該公司最近三年度純益率及每股盈餘與採樣公司及同業平均互有高低，顯示該公司獲利能力尚屬良好，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近三年度獲利能力各項指標雖受美中貿易戰及新冠疫情之影響，仍大致呈成長趨勢，顯示該公司獲利能力尚屬良好。

(5)現金流量比率

A.現金流量比率

該公司現金流量比率最近三年度分別為負值、55.19%及 46.31%。108 年度因營運規模縮小，營運產生之現金減少，支付利息及所得稅後，使營業活動之淨現金量為負值，故不予計算。110 年度現金流量比率較 109 年度下降，係因本期存貨增加額較 109 年度增加，使營業活動淨現金流量下降，流動負債增加所致。

109 年度及 110 年度僅低於尖點，雖該比率小於 100%，但綜合考量流動比率及銀行融資額度，該公司之短期償債能力及營運資金尚屬足夠。

B.淨現金流量適當比率

該公司淨現金流量適當比率最近三年度分別為 36.87%、70.66%及 51.99%，淨現金流量適當比率係指營業活動淨現金流量與資本支出、存貨增加及發放現金股利之比率，係反映公司營業活動現金滿足主要現金需求之程度。該公司 109 年最近五年度營業活動淨現金流量總和增加、存貨增加量減少，使淨現金流量適當比率上升，存貨增加量減少係因 109 年面臨美中貿易戰及新冠疫情之影響，該公司調整存貨水位所致。110 年度最近五年度營業活動淨現金流量減少，而資本支出、存貨增加額及現金股利發放額總和為增加，致使 110 年度淨現金流量適當比率降低。

108 年度淨現金流量適當比率低於採樣公司，而 109 年度比率大幅改善，僅次於尖點，110 年度比率雖小幅下滑，仍優於大量，顯示該公司營業現金負擔主要現金支出之能力尚屬中等。

C.現金再投資比率

該公司現金再投資比率最近三年度分別為負值、19.77%及 17.51%。108 年度因營運規模縮小，營運產生之現金減少，支付利息及所得稅後，使營業活動之淨現金量為負值，故不予計算。110 年度現金再投資比率較 109 年度下降，主係本期存貨增加額較 109 年度增加，使營業活動淨現金流量下降所致。

109 年度及 110 年度現金再投資比率優於所有採樣公司，顯示該公司營運資金負擔投資公司所需資產之能力尚可。

綜上所述，該公司最近三年度現金流量各項指標與採樣公司及同業平均互有高低，其變化原因尚屬合理。

(6)槓桿度

A.營運槓桿度

營運槓桿度係指公司營運中固定成本及費用之使用度，固定成本及費用占比越高，營運風險相對較高。該公司營運槓桿度最近三年度分別為 3.81、2.36 及 2.26，

雖因不動產、廠房及設備逐年增加，使固定成本及費用逐年上升，但因 109 年度及 110 年度營業利益均較去年同期增長，使營運槓桿度下降。

該公司最近三年度營運槓桿度與採樣公司互有高低，且該公司主要業務項目之設備需求相對較高，營運槓桿度之變動尚屬合理，營運風險尚無重大異常之跡象。

B.財務槓桿度

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，指標越高代表公司承擔之財務風險相對較高。該公司財務槓桿度最近三年度分別為 1.64、1.17 及 1.13，該公司因營運規模較小，其自有資金較採樣公司少，舉債程度相對較高，負擔之利息費用亦相對較高，隨著營業利益之增加，財務槓桿度下降。

該公司最近三年度財務槓桿度與採樣公司互有高低，財務槓桿度尚屬中等，其變化情形尚屬合理，顯示該公司財務風險之控管尚屬穩健，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司槓桿度各項指標之變化與經營狀況及舉債程度有關，最近三年度與採樣公司相較互有高低，顯示該公司營運風險及財務風險尚屬合理，應無重大異常之情事。

(二)發行人及其各子公司(包括母子公司間交易事項)最近期及最近三個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

該公司業已訂定「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「負債承諾及或有事項管理辦法」，另分別於 109 年 7 月 24 日及 109 年 8 月 10 日董事會及 109 年 8 月 31 日臨時股東會通過修定「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」；另又於 110 年 7 月 5 日董事會及 110 年 8 月 30 日股東臨時會通過修訂「取得或處分資產處理程序」。該公司之子公司亦以訂定相關作業程序，作為其辦理背書保證、重大承諾、資金貸與及取得或處分資產之依據，茲將該公司及其子公司 108~110 年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易情形分別列述如下：

1.背書保證

該公司及其子公司業已訂定「背書保證管理辦法」，並經於 109 年 7 月 24 日及 109 年 8 月 10 日董事會及 109 年 8 月 31 日臨時股東會通過修定，以作為該公司及其子公司背書保證作業之依據。經查閱該公司及其子公司之董事會、股東會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，並至公開資訊觀測站查詢，該公司及其子公司 108~110 年度背書保證情形列示如下：

單位：新臺幣千元

年度	背書保證者 公司名稱	背書保證對象		對單一企業背書 保證限額(註 1)	本期最高背 書保證餘額	期末背書 保證餘額	實際動 支金額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證最 高限額(註 1)
		公司名稱	關係							
108 年	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	414,732	278,834	191,030	90,279	-	18.42%	518,415
		日本大船	子公司	414,732	202,870	167,600	77,280	-	16.16%	518,415
109 年	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	428,679	193,455	187,220	26,668	-	17.47%	535,847
		日本大船	子公司	428,679	169,739	164,717	55,260	-	15.37%	535,847
110 年度	達航科技股 份有限公司	上海達航(註 2)	子公司	436,445	317,295	270,640	-	-	24.80%	545,556
		日本大船	子公司	436,445	162,704	149,155	24,050	-	13.67%	545,556

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：1.該公司及子公司對外背書保證之總額以不超過該公司及子公司最近期會計師簽證之財務報表淨值50%為限，對單一企業之背書保證限額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值40%為限，該公司及子公司整體得為背書保證之總額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值50%為限。

2.原為達航電子(深圳)有限公司於107年度更名為廣東達航電子有限公司，後又於110年2月配合營運佈局需要，由廣東省深圳區遷址到上海市青浦區，並將公司更名為上海達航實業有限公司。

上述為該公司為子公司上海達航及日本大船之營運周轉需要向銀行融通資金而須提供背書保證所產生，均為該公司直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司間產生，而背書保證限額之計算，係以該公司訂定「背書保證管理辦法」中，對外背書保證之總額不得超過最近期會計師簽證之財務報表淨值百分之五十為限，其中對單一企業之背書保證限額不得超過最近期會計師簽證之財務報表淨值百分之四十為限。以該公司 108~110 年度淨值分別為 1,036,829 千元、1,071,695 千元及 1,091,113 千元進行設算，該公司對單一企業背書保證之限額分別為 414,732 千元、428,678 千元及 436,445 千元，背書保證總額度分別為 519,655 千元、518,415 千元、535,847 千元及 545,556 千元，尚無超限之情事。

經評估各相關交易均已符合該公司及子公司背書保證作業程序，對該公司及各子公司之財務業務應無不利影響。

2. 重大承諾事項

該公司及其子公司訂有「負債承諾及或有事項管理辦法」，並經該公司及其子公司分別於 106 年 1 月 10 日之董事會通過訂定，作為該公司及其子公司從事相關交易之依據。經查閱該公司及其子公司 108~110 年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司及其子公司 108~110 年度之重大承諾事項有因購買原料及機器設備已開立未使用之信用狀及委託銀行出具履約保證函。經評估，該公司及其子公司 108~110 年度之重大承諾事項係正常營業活動所產生，並無重大異常之情事，故應不致對該公司及其子公司之財務狀況產生重大不利之影響。

3. 資金貸與他人

該公司已訂定「資金貸與他人管理辦法」，並經董事會及股東會決議通過，作為該公司辦理資金貸與他人之依據，此外，該公司之子公司亦已訂定相關作業程序，作為其辦理資金貸與他人之依據。經參閱該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告，108~110 年度資金貸與他人情形如下：

單位：新臺幣千元

年度	資出資金 公司名稱	貸與對象	往來科目	本期最 高金額	期末餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質	業務往 來金額	有短期融通資 金必要之原因	提列備抵 呆帳金額	對個別對象資金 貸與限額(註1,2)	資金貸與總 限額(註1,2)
108 年	CHINA EXPO	達航科技	其他應收款 -關係人	151,025	140,906	140,906	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	587,003	587,003
	CHINA EXPO	ALPHA	其他應收款 -關係人	2,528	2,398	2,398	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	587,003	587,003
	ALPHA	達航科技	其他應收款 -關係人	153,708	153,708	153,708	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	207,343	207,343
	東莞達程	上海達航	其他應收款 -關係人	10,127	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	50,029	50,029
	大船煙台(註2)	上海達航	其他應收款 -關係人	54,850	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	-(註 2)	-(註 2)
	上海達航	東莞達程	其他應收款 -關係人	17,113	15,068	15,068	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	82,544	82,544
109 年	CHINA EXPO	達航科技	其他應收款 -關係人	154,008	75,472	75,472	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	360,201	360,201
	CHINA EXPO	ALPHA	其他應收款 -關係人	2,536	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	360,201	360,201
	CHINA EXPO	東莞達程	其他應收款 -關係人	44,020	43,370	43,370	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	360,201	360,201
	ALPHA	達航科技	其他應收款 -關係人	155,571	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	8,240	8,240
	東莞達程	上海達航	其他應收款 -關係人	10,023	10,023	10,023	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	42,565	42,565
	上海達航	東莞達程	其他應收款 -關係人	29,754	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	184,330	184,330

年度	資出資金 公司名稱	貸與對象	往來科目	本期最 高金額	期末餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質	業務往 來金額	有短期融通資 金必要之原因	提列備抵 呆帳金額	對個別對象資金 貸與限額(註1,2)	資金貸與總 限額(註1,2)
110 年	CHINA EXPO	達航科技	其他應收款 -關係人	75,618	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	264,661	264,661
	CHINA EXPO	東莞達程	其他應收款 -關係人	43,840	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	264,661	264,661
	東莞達程	上海達航	其他應收款 -關係人	10,039	-	-	1.50%	短期融通資金	-	營運週轉	-	44,612	44,612

資料來源：各年度經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：資金貸與之限額說明如下：

1.短期資金融通限額：

(1)該公司資金貸與總額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值之 40%為限。

(2)該公司對個別對象之貸與限額以不超過該公司最近期會計師簽證之財務報表淨值之 20%為限。

(3)該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，其總額及對單一企業貸與之金額以貸與公司最近期會計師簽證之財務報表淨值之 100%為限，期限以兩年為限。

(4)有短期融通資金之必要者，得貸與資金之情況如下：

A.作為營運週轉使用：將資金使用於支付廠商貨款及費用者。

B.作為償還金融借款及借款利息。

C.作為償還關係企業借款及借款利息。

2.業務往來限額：

與該公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限，所謂業務往來金額係指雙方間最近一年度進貨或銷貨孰高者。

因業務往來之資金貸與總額不得超過新台幣一億伍千萬元(或等值其他外幣)。

3.上述所稱之淨值，係指依證券發行人財務報告編製準則規定之最近期財務報告資產負債表歸屬於母公司業主之權益。

註 2：該公司之子公司 ALPHA 於 108 年 11 月 30 日出售大船煙台 100%股份。

該公司與子公司於 104 年 4 月 20 日訂定資金貸與他人管理辦法，經檢視該公司與子公司 108~110 年度資金貸與情形，皆屬合併主體間之資金貸與，已於合併報表中消除，且皆經過董事會審核通過。

該公司 108~110 年度並未有將資金貸與他人之情形。而其直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，108~110 年度有因融通資金之必要性而從事資金貸與他人之交易，係依照各公司相關作業程序進行。

CHINA EXPO 108~110 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與之情事，依照該公司相關作業程序，CHINA EXPO 108~110 年度淨值分別為 587,003 千元、360,201 千元及 264,661 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 587,003 千元、360,201 千元及 264,661 千元，CHINA EXPO 108~110 年度對達航科技資金貸與期末餘額分別為 140,906 千元、75,472 千元及 0 元，CHINA EXPO 108 年對 ALPHA 資金貸與期末餘額分別為 2,457 千元，另因該公司於 109 年 12 月 21 日董事會通過 ALPHA 清算案，故截至 109 年底已無對 ALPHA 資金貸與之情事。CHINA EXPO 109 及 110 年度對東莞達程資金貸與期末餘額分別為 43,370 千元及 0 元，資金貸與尚無超限之情事。

東莞達程 108~110 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與上海達航，依照該公司相關作業程序，東莞達程 108~110 年度淨值分別為 50,029 千元、42,565 千元及 44,612 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 50,029 千元、42,565 千元及 44,612 千元，東莞達程 108~110 年度對上海達航資金貸與期末餘額分別為 0 元、10,023 千元及 0 元，尚無超限之情事。

大船煙台 108 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與上海達航，依照該公司相關作業程序，該公司之子公司 ALPHA 於 108 年 11 月 30 日出售大船煙台有限公司 100% 股份，截至 108 年底大船煙台已無資金貸與上海達航之情事。

ALPHA 108 年度及 109 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與達航科技，依照該公司相關作業程序，ALPHA 108 年度及 109 年度淨值分別為 207,343 千元及 8,240 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 207,343 千元及 8,240 千元，ALPHA 對該公司 108 年度及 109 年度資金貸與期末餘額分別為 153,708 千元及 0 元，尚無超限之情事。

上海達航 108 年度至 109 年度資金貸與該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，因融通資金之必要性而有資金貸與東莞達程，依照該公司相關作業程序，上海達航 108 年度至 109 年度淨值分別為 82,544 千元及 184,330 千元，貸與總額及個別金額限額分別為 82,544 千元及 184,330 千元，上海達航 108 年度至 109 年度對東莞達程資金貸與期末餘額分別為 15,068 千元及 0 元，尚無超限之情事。

另檢視該公司及子公司 108~110 年度之資金貸與備查簿、決議通過之董事會議事錄及抽核各子公司間資金貸與情形，尚無重大異常情事。

4.衍生性商品交易

該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，並經該公司 110 年 7 月 5 日之董事會決議通過主管機關公告之條文修訂，並經 110 年 8 月 30 日之股東臨時會通過，以作為該公司及其子公司從事衍生性商品交易之依據。經查閱該公司及其子公司之董事會、股東會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，並至公開資訊觀測站查詢申報資料，該公司及其子公司 108~110 年度並無從事衍生性商品交易之情事。

5.重大資產交易

該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，並經該公司 110 年 7 月 5 日之董事會及 110 年 8 月 30 日之股東臨時會通過修正，以作為該公司及其子公司重大資產交易之依據。經查閱該公司及其子公司之董事會、股東會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，並至公開資訊觀測站查詢申報資料，該公司 108~110 年度取得或處分資產金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上之重大資產交易為機器設備之取得說明如下：

單位：新臺幣千元

標 的 物 名 稱	取得日期				取得 總價款	實際付 款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者， 其原取得資料				取得目的	價格決定之 參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會 決議日					日期	對象	與公司 之關係	價格		
108 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	110.2.26	108.01.22	193,437 (註 2)	依交易條款付款	日本大船	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策
109 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	110.2.26	108.12.24 109.03.24	194,429 (註 2)	依交易條款付款	日本大船	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策
110 年度雷射加工 用機器設備	(註 1)	不適用	110.2.26 110.8.09 110.12.20	109.12.21 110.03.15 110.12.20	34,938 (註 2)	依交易條款付款	日本大船	持股 100%子公司	(註 1)	自產	N/A	自產	提升產能	依該公司移 轉訂價政策

資料來源：該公司經會計師查核簽證之個體財務報告及該公司提供。

註 1：該公司於董事會通過機器設備購買預算後，按實際需求下單訂購。

註 2：108 至 110 年度為個體財務報告揭露之交易金額。

隨著電子零件高運算及微小化之發展，而帶動電路板產業朝向高密度、多層與微型化等方向進化，而雷射鑽孔機為發展趨勢中主要生產設備之一。該公司因應產業發展之趨勢，持續擴充雷射鑽孔加工事業產能，加深與客戶合作關係，以期成為客戶無可取代的合作伙伴。因應此發展需求該公司於各年度視實際營運需求，於董事會通過向子公司日本大船採購雷射加工機器設備，用以擴增雷射事業部產能，並於 110 年 3 月 15 日經董事會追認通過。經檢視董事會議記錄、簽訂合約及抽核相關憑證等資料，尚無發現重大異常之情事，對該公司之財務業務尚不致產生重大不利之影響。

綜上所述，該公司及其子公司 108~110 年度之背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易及重大資產交易情形，皆為正常營運發展所需，經評估尚無發現重大異常之情事，故對該公司及其子公司財務狀況尚無重大影響。

(三)發行人最近期及最近三個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

1.資金募集情形及每股盈餘變化情形

單位：新台幣千元

年度 項目	108年度	109年度	110年度
期初股本	443,435	443,435	443,435
員工認股權證行使	-	-	1,690
期末股本	443,435	443,435	430,133 (註)
營業收入	1,175,825	1,000,900	1,245,511
每股盈餘(元)	1.18	2.09	2.12

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

註：110 年3月15日經董事會決議註銷庫藏股 1,499 千股，另110年6月份員工認股增資 169千股，故增資後實收資本額為430,133千元。

2.整體分析評估所募集資金是否允當運用並產生合理效益及對每股盈餘稀釋之影響

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

(四)本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計畫實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

1.現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明期查核程序所獲致結論」之說明。

2.前各次募集與發行有價證券計畫實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

截至評估報告出具日止，該公司前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計畫實際完成日距本次申報已逾三年，故不適用本項評估。

(五)發行人其他特殊財務狀況

經查閱該公司 108 年度~110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告，並無其他特殊財務狀況情事。

肆、發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

本承銷商已依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」第參之四條規定查核完畢，所獲致結論如下：

- 一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫

該公司截至評估報告出具日止，並無辦理現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者，故不適用。

- 二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

該公司截至評估報告出具日止，並無辦理現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫經重大變更且尚未完成者，故不適用本項評估。

- 三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

該公司截至評估報告出具日止，並無辦理現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券，計畫實際完成日距申報時未逾三年之情事，故不適用本項評估。

- 四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務周轉困難情事

經參閱該公司最近三個會計年度經會計師查核簽證之財務報告，截至評估報告出具日止，並無發行公司債之情事；另該公司之長期借款均能如期還本付息，故公司債或長期借款合約對該公司目前財務、業務或其他事項並無重大影響，該公司最近三個會計年度亦無財務週轉困難之情事。

- 五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開

該公司截至評估報告出具日止，並無辦理私募有價證券之情事，故不適用本項評估。

伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

- 一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，辦理現金增資發行新股以供上櫃前公開承銷之用，非依同準則第六條第二項第一款或第四款募集與發行有價證券，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。

- 二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事		評估依據
	有	無	
一、簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。		V	經查閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，簽證會計師並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列之情事。
二、簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者。		V	經查閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，簽證會計師並無出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者，故無左列之情事。
三、發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。		V	該公司本次辦理現金增資發行新股係供初次上櫃前公開承銷之案件，依法令規定無需檢附發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，故不適用。
四、律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		V	經查閱普華商務法律事務所鍾元珖律師對本次現金增資發行新股出具之法律意見書及法律事項檢查表，該公司並無違反法令，致影響有價證券募集與發行之情事。
五、證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		V	該公司本次係辦理現金增資發行新股以供初次上櫃前公開承銷之案件，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款所列之案件，依「中華民國證券商同業公會發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」規定，得不適用關於募集資金計畫必要性之評估。本證券承銷商業已對該公司本次募集與發行有價證券之計畫，明確表

審查情事	有無左列情事		評估依據
	有	無	
			示其可行性及合理性，請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」之說明。
六、經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報（請）案件，發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理前條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。		V	經查閱該公司董事會議事錄、金管會證期局受理案件申請情形及與金管會往來函文，並無左列情事。
七、申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。		V	經檢視該公司本次現金增資之董事會議事錄、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，並取得 111 年度及 112 年度現金收支預測表，本次現金增資計畫之資金用途為充實營運資金，並無直接或間接赴大陸地區投資之情事，且截至 110 年 12 月 31 日止，實際赴大陸地區累計投資金額為 109,257 千元，並未超過經濟部投資審議委員會規定之限額 654,667 千元，故並無左列情事。
八、上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依證券交易法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。		V	經查閱該公司最近三年度及申報年度截至評估報告出具日之董事會議紀錄及薪酬委員會議紀錄，該公司已於 109 年 08 月 31 日依法設置薪酬委員會，並遵循相關法令規定辦理，故無左列之情事。
九、未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。		V	經查閱該公司之公司章程及股東會議事錄，該公司已於章程中載明將電子方式列為股東行使表決權行使管道之一，故無左列之情事。
十、違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。		V	經查閱該公司與主管機關往來函文、董事會及股東會議事錄、該公司申請股票上櫃時之聲明書及公開資訊觀測站相關資訊，截至評估報告出具日止，尚無發現該公司有左列之情事。
十一、經金管會發現有違反法令，情節重大者。		V	經查閱該公司主管機關往來函文、金管會證期局公告裁罰案件資訊、董事

審查情事	有無左列情事		評估依據
	有	無	
			會議事錄及普華商務法律事務所鍾元珖律師出具之法律意見書，尚無發現有左列之情事。

綜上評估，該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條各款所列之情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
一、申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反證券交易法第四十三條之一規定。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		V		1. 經查閱該公司申報年度及前二年度之董事會及股東會議事錄、公司變更登記表，該公司設有董事七席(包含獨立董事三席)，申報年度及前二年度公司董事變動未有達二分之一之情事。 2. 經檢視該公司申報年度及前二年度之內部人持股異動申報、主管機關往來函文及該公司及董事聲明書，並無發現該公司之股東取得股份有違反證交法第四十三條之一之情事，故無違反左列規定。
二、上市或上櫃公司有證券交易法第一百五十六條各款情事之一者。但依證券交易法第一百三十九條第二項規定限制其上市買賣，不在此限。				
(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。		V		經查閱該公司最近三年度及截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、普華商務法律事務所鍾元珖律師所出具之法律意見書，尚無左列之情事。
(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		V		經查閱該公司最近三年度及截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄、該公司最近三年度及截至評估報告出具日止之帳簿明細、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、現行有效契約、普華商務法律事務所鍾元珖律師所出具之法律意見書等，尚無左列之情事。
(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格。		V		經查閱該公司最近三年度及申報年度截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄、該公司及董事聲明書、主管機關往來函文、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告及普華商務法律事務所鍾元

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
				珽律師所出具之法律意見書，尚無左列之情事。
(四)該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。		V		經查詢櫃檯買賣中心網站所公告之興櫃股票股價異常達通知公告，尚無發生左列之情形。
(五)發行該有價證券之公司發生重大公害或食品藥物安全事件。		V		經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會與股東會議事錄及與主管機關往來函文，以及該公司出具之聲明書，截至評估報告出具日止，無左列情事。
(六)其他重大情事。		V		經查閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄、與主管機關往來之函文及律師所出具之法律意見書，尚無發現有影響市場秩序或損害公益之其他重大情事。
三、本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。		V		該公司本次募集與發行有價證券計畫具可行性及合理性，相關評估內容詳評估報告參「陸、就本次募集及發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性」之評估說明。另該公司本次募資係辦理現金增資發行新股以供初次上櫃前公開承銷案件，依規定得不適用必要性之評估。
四、前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善者：				
(一)無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。		V		經查閱該公司前各次現金增資計畫均已執行完畢；該公司並無私募有價證券，相關評估內容請參閱評估報告參「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明，經評估並無左列之情事。
(二)無正當理由計畫經重大變更。但計畫實際完成日距申		V		該公司並無辦理私募有價證券，另經查閱該公司董事會議事錄及股東會議事錄，該

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
報時已逾三年，不在此限。				公司前各次募集與發行有價證券計畫並無重大計畫變更之情事
(三)募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。		V		經查閱該公司董事會議事錄及股東會議事錄，該公司前各次募資計畫並無重大計畫變更之情事。
(四)最近一年內未確實依第九條第一項第四款至第九款及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十一條規定辦理。			V	經查閱該公司董事會議記錄、主管機關往來函文及金管會證期局受理案件申請情形，並查詢公開資訊觀測站公告資料，該公司最近一年內並無應依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第四款至第九款及「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第十一條規定辦理之事項，故不適用左列之規定。
(五)未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理，情節重大。			V	經參閱該公司於公開資訊觀測站公告資訊、截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄及與主管機關往來之函文，該公司並無辦理私募有價證券，故不適用左列之規定。
(六)未能產生合理效益且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		V		經檢視該公司前各次募集與發行有價證券並無未能產生合理效益且無正當理由之情事，相關評估內容詳評估報告參「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。
五、本次募集與發行有價證券計畫之重要內容（如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等）未經列成議案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。		V		經查閱該公司本次現金增資之提請原股東放棄優先認購權案業經 110 年 3 月 15 日董事會及 110 年 7 月 5 日股東常會決議通過；且本次募集與發行有價證券計畫之重要內容已列成議案，並經 111 年 3 月 15 日董事會討論且決議通過，尚無左列之情事。
六、非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。		V		經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄、資金貸與及背書保證備查簿，並查詢公開資訊觀測站之公告資訊，該公司並無左列情形。
七、有重大非常規交易，迄未改善者。		V		經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄，並未發現該公司有重大非常規交易之情事。
八、持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達			V	該公司本次辦理現金增資發行新股係供辦理初次上櫃前公開承銷用，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司債者。但所募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備或用於合併非以買賣有價證券為主要業務之公司且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。				項第二款之規定，依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條第四項之規定，故不適用左列之規定。
九、本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。		V		經查閱該公司 111 年 3 月 15 日董事會議事錄，本次募資計畫之資金用途為充實營運資金，非為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者，故無左列情事。
十、不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。		V		經查閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，均依相關法令及國際財務報導準則編制財務報告，並無左列情事。
十一、違反發行人募集與發行有價證券處理準則第五條第二項規定情事者。		V		該公司已出具聲明書，聲明將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定，自申報日起至申報生效前，除依法令發布之資訊外，不得對特定人或不特定人說明或發布財務業務之預測性資訊。
十二、內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。		V		該公司業已依規定委請會計師就該公司內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，並取得簽證會計師出具之內部控制制度審查報告，尚未發現其內部控制制度之設計或執行有重大缺失。
十三、申報日前一個月，其股價變化異常者。		V		經查詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站所公告之興櫃股票股價異常達通知公告，該公司申報日前一個月並無股價變化異常之情事。
十四、公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(一)違反證券交易法第二十六條規定，經通知補足持股尚未補足。		V		該公司業已設置審計委員會取代監察人，故不適用左列監察人持股規定；截至評估報告出具日止，該公司全體董事持股總數為 8,983,000 股，占發行股數 43,013,285 股之 20.88%，符合證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(二)加計本次申報發行股份後，未符證券交易法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，不在此限。		V		該公司業已設置審計委員會取代監察人，故不適用左列監察人持股規定；截至評估報告出具日止，該公司已發行股份總數為43,013,285股，加計本次辦理現金增資發行新股5,806,000股後，股份總數為48,819,285股，增資後全體董事持股成數為18.40%，仍符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。
(三)申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。		V		經查閱該公司最近一年度及申報年度截至評估報告出具日止與主管機關之往來函文，並無接獲主管機關通知董事或監察人應補足持股之情事，尚無有左列之情事。
十五、發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		V		經參閱普華商務法律事務所鍾元珽律師所出具之法律意見書與法律事項檢查表、108年度迄今之董事會議事錄及股東會議事錄、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，並取具該公司、現任董事長及總經理聲明書，該公司及其現任董事長、總經理於最近三年內並無左列事項。
十六、因違反證券交易法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		V		經參閱普華商務法律事務所鍾元珽律師所出具之法律意見書與法律事項檢查表、該公司與主管機關往來函文、最近三年度之董事會議事錄及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告，並取具該公司聲明書，該公司並無左列之事項。
十七、為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		V		經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄、股東會議事錄、資金貸與及背書保證備查簿，並查詢公開資訊觀測站之公告資訊，截至評估報告出具日止，該公司並無違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
十八、合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一： (一)違反金管會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節規定，情節重大。 (二)受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。 (三)受讓之股份或收購之營業或財產有限制買賣等權利受損或受限制之情事。 (四)違反公司法第一百六十七條第三項及第四項之規定。 (五)被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。			V	該公司辦理本次募集及發行有價證券計畫非屬合併發行新股、受讓他公司股份發行新股或依法律規定進行收購或分割發行新股者，故不適用左列之規定。
十九、有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一： (一)申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。 (二)申報發行轉換公司債或附認股權公司債，未於發行辦法明定應募人應自前揭公司債發行日起將公司債及嗣後所轉換或認購之股份送交證券			V	該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款第六目所列之情事，故不適用左列之評估。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
集中保管事業保管一年。				
二十、證券承銷商於發行人申報時最近一年內經金管會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上，且自被處記缺點累計達十點之日起未逾三個月。但發行人辦理現金發行新股為初次上市、上櫃公開銷售者，不在此限。			V	該公司本次係辦理現金增資發行新股以供辦理上櫃前公開承銷，故不適用。
二十一、其他金管會為保護公益認為有必要者。		V		經查閱該公司與主管機關之往來函文，截至評估報告日止，尚無左列之情事。

綜上評估，該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條各款所列之情事。

三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

該公司募集與發行有價證券係屬現金增資發行普通股，故針對「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第壹章總則及第貳章現金增資普通股之規定逐條評估如下：

自律規則		說明
第一條	為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商辦理該公司本次募集與發行有價證券，謹遵守本自律規則。
第二條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數	經取得該公司與本承銷商並無違反左列各款所出具之聲明書，本承銷商與該公司間並無左列各款規定之關係，故得擔任該公司本次募集與發行有價證券之主辦承銷商。

	自律規則	說明
	以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。 六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人席次分別未逾三分之一者，不在此限。 七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。 八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者，致有失其獨立性之情事者。 發行公司或外國發行人發行普通公司債及未涉及股權之金融債券，如銷售對象僅限於證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。 本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。	
第二條之一	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書： 一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。 二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。 依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。	本承銷商已取得該公司所洽請本次填報法律事項檢查表並出具法律意見書之普華商務法律事務所鍾元珖律師所出具之聲明書，聲明其最近一年內未受法務部懲戒委員會懲戒且與該公司、該公司之簽證會計師及本承銷商並未具有左列之關係。
第三條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會或其委託之機構申報案件至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；總括申報追補發行新股案件，前開聲明書之聲明期間為自承銷商出具評估總結意見之日起至繳款截止日止，承銷商並應複核發行	本推薦證券商已出具之聲明書，本推薦證券商輔導該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件，將依左列規定辦理。

自律規則		說明
	公司或外國發行人有無違反前開規定。 前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。 經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者，第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日。	
第四條	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券(員工認股權憑證除外)，加計其前各次(含其所私募者)上述有價證券流通在外餘額依各別轉換(認購)價格設算轉換(認購)後所增加之股數，不得逾已發行股數之百分之五十。 發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換(認購)之用者，其做為轉換(認購)用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，非屬申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之一	承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，以新發行之股份履行轉換義務或履約者，承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度，惟自九十五年七月一日起，上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付，除外國發行人註冊地國另有規定外，應以帳簿劃撥方式為之。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之二	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司之發行與轉換(認購)辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換(認購)」規定；另應注意避免現金增資認股停止過戶日前十五個營業日、股票變更面額之停止轉換(認購)起始日起暫停轉換(認購)期間與前各次具轉換(認股、交換)有價證券到期日前之停止轉換(認股、交換)期間接續，及已發行流通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者，如遇普通股除息、除權或現金增資認股時，應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

自律規則		說明
	券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。 前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。	
第四條之三	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購、交換）權之各種有價證券，自發行日後屆滿一定期間起，除依法暫停過戶期間外，持有人得依發行人所定之發行及轉換（認股、交換）辦法請求轉換（認股、交換）；但發行公司或外國發行人為未上市（櫃）、未登錄興櫃之公開發行公司者，轉換（認股、交換）期間自發行日後屆滿一定期間至到期日前十日止為限。 前項所稱一定期間不得少於三個月，並應由發行人或外國發行人於轉換（認購、交換）辦法中訂定之。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之四	（刪除）	
第四條之五	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。 對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之六	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二千萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有特殊需求，且發行條件合理者，不受此限。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，並非發行海外有價證券，故不適用左列規定。
第四條之七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

	自律規則	說明
	或外國發行人依發行與轉換（認購）辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。 承銷商輔導發行公司或外國發行人申報（請）發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換（認購）辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格（向下調整，向上則不予調整）並函請證交所或櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。 依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。	
第四條之八	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行條件對股權稀釋、股東權益之影響。	該公司本次非申報發行具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，故不適用左列規定
第四條之九	除上市（櫃）公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。 承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說電子檔傳送至金管會指定之網站。 第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。	該公司本次辦理以現金增資發行普通股申請初次上櫃案，將採競價拍賣及公開申購配售方式辦理公開承銷，本推薦證券商謹遵守左列規定辦理。
第四條之十	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換（認購、交換）性質之各種有價證券，應注意發行與	該公司本次非申報發行具股權轉換(交

自律規則		說明
	轉換（認購、交換）辦法中應訂明債券到期還本付息之款項支付日。若發行條件中包含債券持有人之賣回權利，並應訂明債券持有人行使賣回權之款項支付日。	換、認購)性質之各種有價證券，故不適用左列規。
第四條之十一	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第 34 及 36 號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第 249 條第 2 款及第 250 條第 2 款之規定。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，並非發行具股權性質之各種公司債，故不適用左列規定。
第四條之十二	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後三個月內不得買回本公司股份。 現金增資發行新股案件，前項承諾書應承諾自申報日起至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。 總括申報發行新股案件，第一項承諾書應承諾首次發行自申報日起及各次追補發行自承銷商出具評估總結意見之日起，至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，已出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回該公司股份，故符合左列規定。
第四條之十三	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不以任何方式匯回臺灣。	該公司本次係辦理現金增資發行普通股，非屬申報募集人民幣計價海外公司債，故不適用左列規定。
第四條之十四	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。	該公司已於公開說明書記載該公司、該公司之董事、總經理、財務長以及與該公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書。另檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。
第四條之十五	承銷商輔導外國發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募	該公司非為外國人發行人，故不適用左

自律規則		說明
	資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。 承銷商輔導有重要子公司位於中國大陸之外國發行人辦理申報募資案，應輔導外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾應將在臺所募資金存放於台資銀行或其海外子(分)行並依計劃支用。承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估 承銷商依前項輔導外國發行人申報在臺募集與發行公司債案件，擔保銀行及受託銀行限於在我國設有營業據點之銀行。	列之規定。
第四條之十六	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應就發行公司或外國發行人之財務業務狀況製作檢查表，並於發行公司或外國發行人向金管會申報案件前五個營業日，向證交所或櫃買中心申報。	該公司本次係辦理現金增資發行新股供辦理初次上櫃前公開承銷，故不適用左列之規定。
第四條之十七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購、交換）權之各種有價證券，若發行條件中訂有收回條款者，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認股、交換）辦法中應訂明債券持有人請求轉換（認股、交換）之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。	該公司本次非申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，故不適用左列規定。
第貳章 現金增資普通股		
第五條	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股，應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾書，如屬總括申報發行新股案件，並應承諾不得參與首次發行及各次追補發行之新股認購。	截至評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司而非上市櫃公司，故不適用左列規定。
第五條之一	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司、興櫃公司、戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如申請延長募集期間且其財務預測無重大變動者，應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明。	該公司本次申報辦理現金增資發行普通股申請初次上櫃案件，並未公布財務預測，故不適用左列規定
第五條之二	承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市（櫃）案件，除另有規定外，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成，股票申請創新板初次上市案件不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃（或戰略新板興櫃公司）有成交之十個營業日其成交均價（或戰略新板興櫃公司收盤價）簡單算術平均數之九成；	本推薦證券商本次輔導該公司辦理現金增資發行普通股係供申請初次上櫃公開承銷之用，謹遵左列規定辦理，相關評估內容請參閱評估報告參「陸、就本次募集及發行有價證券計畫之可行

	自律規則	說明
	如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。。 除股票申請創新板上市案件外，以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃前之承銷案件、創新板上市公司轉列上市、上櫃公司案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開銷售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。	性、必要性及合理性」之評估說明。
第六條	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。 承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。 戰略新三板興櫃公司現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格準用前項規定，惟用以計算之價格採戰略新三板興櫃公司股票之收盤價。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非屬上(櫃)公司、創新板上市公司，且本次現金增資發行普通股係供申請初次上櫃公開承銷用，故不適用左列規定。

自律規則		說明
第六條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司、興櫃公司及戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定，決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷，其發行價格訂定方式應提報公司股東會。	本次現金增資發行普通股係供申請初次上櫃公開承銷用，故不適用左列規定。
第七條	承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導創新板上市公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格準用第六條第三項規定，惟用以計算之價格採戰略新板興櫃公司股票之收盤價。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司尚屬興櫃公司而非上市(櫃)公司、創新板上市公司或戰略新板興櫃公司，且本次現金增資發行普通股係供申請初次上櫃公開承銷用，故不適用左列規定。
第七條之一	承銷商輔導上櫃（市）公司申請轉上市（櫃）為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公	該公司尚屬興櫃公司而非上市或上櫃公司，且本次現金增資發行普通股係供

自律規則		說明
	會申報辦理公開申購公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	申請初次上櫃公開承銷用，故不適用左列規定。
第 八 條	採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。 承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料： 一、詢價圈購之相關資料(含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之成數等資料)。 二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人等之股數及配售比率。 承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。	該公司本次辦理現金增資發行新股係採競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷，故不適用左列規定。
第八條之一	承銷商輔導上市(櫃)公司辦理總括申報發行新股案件，準用第六條、第六條之一、第七條及第八條規定。	該公司本次辦理現金增資發行新股非屬總括申報發行，故不適用左列規定。
第 九 條	承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。 承銷商輔導上市(櫃)公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資	該公司尚屬興櫃公司而非上市或上櫃公司或創新板上市公司，且本次辦理現金增資發行普通股並非參與發行海外存託憑證，故不適用左列條款之規定。

自律規則		說明
	除權) 及除息後平均股價之八成。 實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權) 及除息後平均股價之八成。 前項實際發行價格低於九成者，海外存託憑證持有人不得於發行後三個月內請求兌回，承銷商並應輔導上市(櫃)公司於發行計畫及存託契約中載明。 創新板上市公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案件，前各項規定準用之。	

綜上所述，經查該公司本次籌資相關申報書件、董事會會議記錄及公司章程等相關資料，該公司本次申報辦理現金增資發行新股尚能符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定。

四、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百二十九條、第一百三十條、第一百五十六條第五項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第二百七十條規定之情事

法 律 條 文	是否符合規定			說 明
	是	否	不適用	
公司法第一百二十九條 發起人應以全體之同意訂立章程，載明下列各款事項，並簽名或蓋章： 一、公司名稱。 二、所營事業。 三、採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。 四、本公司所在地。 五、董事及監察人之人數及任期。 六、訂立章程之年、月、日。	V			該公司已於章程載明公司法第 129 條事項，故無違反左列規定。
公司法第一百三十條 下列各款事項，非經載明於章程者，不生效力： 一、分公司之設立。 二、解散之事由。 三、特別股之種類及其權利義務。 四、發起人所得受之特別利益及受益者	V			該公司已於章程載明公司法第 130 條第一項第一款事項，且自該公司設立後，尚無解散、發行特別股與發起人所得受之特別利益，故無違反左列規定。

法 律 條 文	是否符合規定			說 明
	是	否	不適用	
之姓名。 前項第四款發起人所得受之特別利益，股東會得修改或撤銷之。但不得侵及發起人既得之利益。				
公司法第一百五十六條第五項 股東之出資，除現金外，得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之；其抵充之數額需經董事會決議。			V	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，未以現金以外之出資抵充情形，故無違反左列規定。
公司法第一百六十七條第三項及第四項 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。 前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。	V			經查閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司之從屬公司及該公司與其從屬公司直接或間接持有已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，並未將該公司及其從屬公司之股份收買或收為質物，故無違反左列規定。
公司法第二百四十六條 公司經董事會決議後，得募集公司債。但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。 前項決議，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。			V	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
公司法第二百四十七條 公開發行股票公司之公司債總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額。 無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。 證券交易法第二十八條之四 已依本法發行股票之公司，募集與發行公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，依下列規定辦理，不受公司法第二百四十七條規定之限制： 一、有擔保公司債、轉換公司債或附認			V	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

法 律 條 文	是否符合規定			說 明
	是	否	不適用	
股權公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百。 二、前款以外之無擔保公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一。				
公司法第二百四十九條 公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結，自了結之日起三年內。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債，應負擔年息總額之百分之一百五十。			V	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
公司法第二百五十條 公司有左列情形之一者，不得發行公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。			V	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
公司法第二百六十九條 公司有左列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股： 一、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特別股股息者。 二、對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。			V	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
公司法第二百七十條 公司有左列情形之一者，不得公開發	V			經查閱該公司 110 年及 109 年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司 110 年、109 年之稅後淨利分別

法 律 條 文	是否符合規定			說 明
	是	否	不適用	
行新股： 一、最近連續二年有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。 二、資產不足抵償債務者。				為 91,064 千元、89,295 千元，未有連續二年虧損之情事；另 110 年底資產總額為 2,284,556 千元，負債總額為 1,193,443 千元，尚無資產不足抵償債務之情事。

綜上評估，該公司對上述各項應遵循之法令未有違反之情事，故對該公司及本次有價證券之募集與發行尚不致產生不利影響。

(二)發行人是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

經查閱該公司最近三年度及申報年度與主管機關往來之函文、董事會及股東會議事錄、公告之重大訊息、會計師查核簽證之財務報告、重要契約及最近一個月普通股股價資訊；另參酌普華商務法律事務所鍾元珖律師出具之法律意見書以及法律事項檢查表及取具該公司所出具之聲明書，未發現該公司有發生證券交易法第一百五十六條第一項各款之情事，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近三個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經查閱該公司截至評估報告出具日止之公告重大訊息、董事會及股東會議事錄、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告並取得該公司及其現任董事、持股百分之十以上股東、負責人及總經理所出具之聲明書；另參酌普華商務法律事務所鍾元珖律師出具之法律意見書以及法律事項檢查表，該公司及其現任董事、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近三個會計年度至刊印日止，並無尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經查閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、截至評估報告出具日止之董事會議事錄及股東會議事錄、現行有效契約、與主管機關往來之函文、並取得該公司及其現任董事、負責人及總經理之聲明書，與金融聯合徵信中心之徵信資料及台灣票據交換所之票信資料；另參酌普華商務法律事務所鍾元珖律師出具之法律意見書以及法律事項檢查表，該公司及其現任董事、負責人及總經理最近三個會計年度至刊印日止，並無經法院判決有期徒刑以上之罪者。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

經檢視該公司目前仍有效存續及最近一個會計年度到期之重要契約，皆係為公司正常營運所需要而簽訂，並未發現該公司所簽訂之契約內容有任何對公司經營及未來發展與投資人權益有重大不利影響之情事。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110年12月16日至 111年12月15日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110年12月16日至 111年12月15日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110年12月16日至 111年12月15日	應收帳款讓售	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110年8月13日至 115年8月13日	中長期借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110年9月27日至 111年9月26日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	110年11月15日至 111年11月14日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	中國信託商業銀行	110年10月19日至 111年9月30日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	中國信託商業銀行	110年10月19日至 111年9月30日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	台北富邦商業銀行	110年12月7日至 111年12月6日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	富邦華一銀行	108年9月19日至 111年9月30日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	玉山銀行	110年8月26日至 111年12月16日(短期) 114年6月16日(中期)	短、中期借款	無
銀行授信	元大銀行	110年3月4日至 111年3月4日	短期綜合授信借款	無
銀行授信	王道銀行	108年2月26日至 113年2月25日	中長期借款	無
銀行授信	台新商業銀行	108年4月8日至 112年3月23日(自動展期)	短期綜合授信借款	無
銀行授信	瑞穗銀行	108年2月19日至 115年2月27日	日本大船發行無擔保 公司債	無
銀行授信	三井住友銀行	110年11月29日至 115年11月29日	中長期借款	無
廠房租賃	英隆針織股份有限公司	110年6月1日至 111年12月16日	本公司之廠房租約	無
廠房租賃	鈞宏精密工業(股)公司	110年6月1日至 120年5月31日	本公司之青年廠房租 約	無
廠房租賃	大船電子(上海)有限公司	109年6月1日至 112年5月29日	子公司(上海達航實 業)之租約	無
廠房租賃	大船科技(股)公司	109年1月1日至 113年12月31日	子公司-大船企業(日 本)株式會社之租約	無

資料來源：該公司提供

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經查閱該公司與主管機關往來之函文、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，並取得該公司出具之聲明書；另參酌普華商務法律事務所鍾元珖律師出具之法律意見書以及法律事項檢查表，最近三個會計年度及申報年度截至評估報告出具日止、該公司及各子公司並無重大污染環境事，惟有關重大勞資紛事件如下說明如下：

1.重大勞資糾紛：

該公司就前員工陳彥文，有發生下列勞資糾紛：

- (1)根據臺中市政府勞工局 109 年 5 月 28 日府受勞動字第 1090125930 號函，臺中市政府勞工局以該公司於 109 年 2 月 28 日資遣員工陳彥文時，未將其於駐韓期間在韓國分公司領取之薪資納入資遣費計算，違反勞工退休金條例第 12 條第 1 項規定，依同法第 45 條之一規定處以罰鍰新台幣 30 萬元整，經查該公司已於 109 年 6 月 19 日繳納罰鍰。
- (2)根據勞動部勞工保險局 109 年 8 月 7 日保退三字第 10913151922 號函，該公司未按規定申報調整前員工陳彥文勞工退休金月提繳工資，違反勞工退休金條例第 15 條第 2 項規定，依法處以罰鍰新台幣 5 千元整，經查該公司已於 109 年 9 月 2 日繳納該罰鍰。另後因該公司不服上開行政處分，提起訴願遭駁回，該公司再提起行政訴訟，經臺灣臺北地方法院行政訴訟庭 110 年簡字第 137 號判決該公司勝訴，勞動部勞工保險局已於 111 年 1 月 26 日撤回原處分並退還罰鍰新台幣 5 千元。
- (3) 根據衛生福利部中央健康保險署 109 年 9 月 28 日健保中字第 1094081198 號函，該公司未依規定申報調整前員工陳彥文之投保金額，違反全民健康保險法第 21 條第 2 項、同法第 89 條，依法處以罰鍰新台幣 13 萬 7608 元整。經查該公司已於 109 年 10 月 7 日繳納罰鍰。後因該公司不服上開行政處分，經申請爭議審議，獲撤銷罰鍰新台幣 13 萬 7,608 元整，經查該公司已於 110 年 2 月 9 日收到罰鍰核退支票，但就調整前員工陳彥文之投保金額部分則經訴願審議委員會維持原處分，該公司不服遂提起行政訴訟，現由臺灣臺中地方法院行政訴訟庭審理中，業經行政法院裁示後，健保署已於 111 年 02 月 11 日撤銷調整陳君投保金額之處分案。

前開事件，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準第 3 點第 1 款規定，應非屬重大勞資糾紛，故該等情事並非財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項第三款所指重大勞資糾紛，且該等情事應不致對該公司之營運產生重大影響，對其股東權益或證券價格亦應無重大影響。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次所募資金係用於充實營運資金，依規定無須事先取得目的事業主管機關同意，故無所核准之附帶事項有影響本次募集與發行有價證券之情事。

(八)承銷商因前項之評估需要，若有洽請律師出具意見者，應說明事項

本次並無洽請律師對前項評估出具意見，故不適用本項之說明。

五、說明是否已取具發行人委請填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商具有下列關係之聲明書。

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒

(二)與發行人、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

1.依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。

2.其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。

經取具普華商務法律事務所鍾元珽律師出具之聲明書，其於最近一年內未曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且未與該公司、最近期財務報告簽證會計師及本承銷商間具有主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係，或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者之關係。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性

(一)本次計畫內容

1.本次計畫所需資金總金額：新台幣 185,792 千元。

2.本次計畫資金來源：

(1)本次現金增資發行新股 5,806 千股，每股發行價格 32 元，募集總金額 185,792 千元

(2)該公司本次現金增資發行普通股，如每股實際發行價格因市場變動而與暫訂發行價格不同，致募集資金不足時，將減少充實營運資金之金額；惟若募集資金增加時，則將全數用以充實營運資金。

3.目的事業主管機關核准日期及文號：無。

4.計畫項目及預定資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度
			111 年第三季
充實營運資金	111 年第三季	185,792	185,792
合計		185,792	185,792

5.預計可能產生效益

該公司預計本次現金增資所募得之資金，預計全數用於充實營運資金，係考量公司長期發展與未來成長性，以因應該公司營運規模擴大及配合未來發展策略之執行，故藉由現金增資充實營運資金，將可使該公司之自有資金更形充裕，對該公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

(二)本次募集與發行有價證券之可行性評估

1.法定程序上之可行性分析

該公司本次辦理上櫃前現金增資發行普通股計畫，業經 110 年 3 月 15 日董事會及 110 年 7 月 5 日股東常會決議通過辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷案，並於 111 年 3 月 15 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，並授權董事長全權處理相關增資事宜。經查本次增資內容及程序與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定並無不符，並經律師對本次募集現金增資計畫之內容出具法律意見書，顯示本次現金增資發行普通股計畫確已符合相關法令之規定，故該公司本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

2.募集完成之可行性

該公司本次現金增資計畫發行普通股 5,806 千股，每股面額新臺幣 10 元，以每股 32 元溢價發行，預計募集總金額為 185,792 千元，其中依公司法第 267 條規定保留 15%，計 870 千股由員工認購，其餘 4,936 千股則依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」按證券交易法第 28 條之 1 規定，於 110 年 7 月 5 日股東常會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購。

本次辦理現金增資發行新股係採部份競價拍賣，部份公開申購方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，經該公司 111 年 3 月 15 日董事會決議授權董事長洽特定人認購之；而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故該公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

3.本次資金預計運用計畫之可行性

本次辦理現金增資發行新股所募得之資金，考量主管機關審查與承銷作業時程，預計於 111 年 6 月募集完成，並於 111 年第三季支用，資金運用計畫為充實營運資金，以因應該公司營運週轉及業務成長所產生之資金需求，除可強化該公司財務結構之外，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業之經營及健全財務結構具有正面助益，故本次籌資用於充實營運資金應屬合理可行。

綜上所述，該公司本次現金增資發行新股計畫內容，就其適法性、資本市場募得資金及資金運用項目及進度等各方面評估應具有可行性，故整體而言其籌資計畫應屬可行。

(三)本次資金募集計畫之必要性

本次現金增資發行新股係依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」規定，以現金增資發行新股方式，委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，故依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 6 條第 2 項第 2 款之規定，不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

(四)本次籌資之資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性

1.資金運用計畫及預定進度合理性評估

該公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理初次上櫃前公開銷售之用，預計募集資金共計新臺幣 185,792 千元，資金運用計畫為充實營運資金，以提高自有資本比率及強化財務結構，並可提升資金靈活調度之彈性，更可有效提升該公司之競爭力，降低營運及財務風險，故資金運用計畫應具合理性。另資金運用之進度，將視主管機關之審查時間、公開承銷期間及繳款作業時程而定，預計於 111 年 6 月完成資金募集作業後，並於 111 年第三季用於充實營運資金，故該公司之資金運用計畫及預定進度應屬合理。

2. 預計可能產生效益之合理性

項目		年度	籌資前	籌資後(註)
			110 年度	111 年第一季(預估)
財務結構	負債佔資產比率(%)		49.83	45.91
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)		164.56	187.53
償債能力	流動比率(%)		92.86	114.89
	速動比率(%)		27.25	49.27

資料來源：該公司提供。

註：係以 110 年度經會計師查核之個體財務數字為基礎設算。

該公司本次辦理現金增資發行新股 185,792 千元，預計於 111 年 6 月募集完成，並於 111 年第三季投入充實營運資金。若以該計畫募集完成後之財務結構及償債能力觀之，其負債比率可降至 45.91%，長期資金占不動產、廠房及設備比率、流動比率及速動比率將分別上升至 187.53%、114.89%及 49.27%，將可達成強化財務結構之效益，且考量公司長期發展與未來成長性，將可使該公司之自有資金更形充裕，對該公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益，故本次現金增資計畫之效益應屬合理。

- 二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上櫃前之公開銷售作業，該公司本次辦理現金增資發行普通股 5,806 千股，另於辦理公開承銷前有員工認股權憑證 173,713 股已執行完畢，故已發行股數為 43,187 千股，每股盈餘將因現金增資後股權稀釋比率為 11.85% (5,806 千股/(43,013 千股+173,713 股+5,806 千股)，考量該公司整體營運及獲利均能維持一定水準，且本次辦理現金增資用於充實營運資金，將可強化財務結構及償債能力、支應營運規模成長所需資金且維持公司之競爭力，整體而言對該公司營運發展係有正面之助益，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋影響應屬有限，對現有股東權益亦尚無重大影響。

- 三、本次籌資計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

(一) 本次募集與發行有價證券資金計畫用於轉投資者之評估

該公司本次辦理現金增資所募資金預計用於充實營運資金，故不適用本項評估。

(二) 本次募集與發行有價證券資金計畫用於償債或用於充實營運資金者之評估

- 就發行人之營業特性、應收帳款收款與應付帳款付款政策及資本支出計畫，逐項分析發行人所編製之申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性，並具體評估發行人資金需求狀況、資金不足之時點與原因及本次現金增資用以償債或充實營運資金之必要性及合理性。前述現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分

之六十者，其資金來源、用途及預計效益。

(1)營業特性

依臺灣電路板協會出版之 PCB 高階技術所調查的製程、材料、設備缺口與發展藍圖中，臺灣於載板項目之自主化程度為最低，約 7 成的關鍵材料與設備需要依賴外商，在高階材料自主化程度不足的有 Ajinomoto Build-up Film(以下簡稱:ABF)、樹脂(以下簡稱:BT)、乾膜、電鍍藥水；在機台方面，有 DI 的曝光機、雷射鑽孔機、機械鑽孔機、電測機等，其中，絕大部分來自於日本，顯見臺灣 PCB 在關鍵材料與設備的自主能力上還未達到相對應的表現，然該公司之主要產品，係供應印刷電路板產業之製程上，其終端可應用領域涵蓋 5G 智慧型手機、網通伺服設備、自動車、WI-FI(如 SpaceX 的衛星網路計畫)、輕、薄、短小及攜帶式之消費性電子產品，本公司憑藉所專精之鑽孔工藝，並透過自製開發的機械鑽孔設備，提供新式電子產品製程的解決方案並陪同客戶共同摸索新製程，或維修升級服務使下游製造商的可優化產線、提高生產效能與品質之目標，甚至可以本公司自製雷射鑽孔機提供加工服務，以解決客戶產能不足之情形，故依研究機構 Prismark 之預測，各式印刷電路板產業將在 107 至 112 年之間以 3.7%的年均複合增長率成長，另依調查研究機構 Maximize Market Research 的資料亦顯示，全球雷射材料加工市場規模將從 105 年度至 113 年度複合成長率約達 6%，該公司自主開發之雷射鑽孔設備，可作為雷射應用加工服務生產設備，並可搭載不同的雷射源(CO₂、UV)應用於各式載板、Mini LED PCB、半導體檢測製程等專業加工鑽孔上的需求，再加上我國政府亦致力扶植高階印刷電路板產業發展暨半導體設備在地化生產之計畫，該公司所處之產業景氣維持成長的樂觀趨勢。

該公司所編製之 111 及 112 年度各月份之現金收支預測表，係依據 110 年度及 111 年 1~2 月之實際營運情況，並綜合評估其歷史營運情形、產業特性、產品結構、預計接單狀況、未來營運計畫及公司收付款政策等，且考量產業未來發展趨勢、產業特性及銷售及採購政策等因素予以推估各月份收入及支出情形，故該公司現金收支預測表之編製基礎尚屬合理。其中，現金流入主要係銷貨所產生之應收款項收現，現金支出主要為進貨所產生之應付款項付現，日常營運產生之銷售管理費用及人事費用等，其編製之假設基礎尚屬合理。

(2)應收帳款收款與應付帳款付款政策

A.應收帳款收款政策

該公司應收帳款政策係評估考量客戶屬性、擔保品及歷史收款情形等因素給予不同的授信條件，其主要授信條件為直接銷售客戶月結平均 110 天。該公司預計 111 及 112 年度對銷售客戶之收款政策變化不大，故該公司以此推估未來年度各月份應收款項之收款情形，用以編製未來年度之現金收支預測表，其應收款項收現之編製之假設基礎尚屬合理。

B.應付帳款付款政策

在應付帳款付款政策方面，該公司對供應商之選定及付款條件則視採購產品之數量、單價、品質、雙方合作期間及廠商供貨穩定性與及時性等因素而有不同，對主要供應商付款條件及付款天期係為月結 30~115 天，預估 111 及 112 年度之付款政策無顯著變動，故以此作為現金收支預測表之編製基礎，其應付款項付現之編製假設基礎尚屬合理。

(3)資本支出計畫

經檢視該公司編製之現金收支預測表，該公司 111 及 112 年度之資本支出金額分別為 406,404 千元及 179,037 千元，主要分別考量 ABF 載板需求暢旺將帶動雷射鑽孔需求大增及擴大雷射加工機台自主性，且適度改善中國大陸區子公司產線精進需求而執行汰舊換新，此外，為因應鑽孔加工產能調度彈性、5G 電子產品製程工序之複雜與半導體、光電領域製程所需雷射加工製程，進而適度擴增自製雷射鑽孔設備之供給，經評估期編製假設基礎尚屬合理。

(4)申報(請)年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測編製基礎與其合理性及與財務預測關聯性

該公司 111 年度現金收支表中，1~2 月份各項金額係實際數，111 年 3~12 月及 112 年度則為預估數，其預估基礎係參酌產業發展趨勢、該公司預計接單情形、與各供應商及一般客戶之收付款條件及資本支出計畫等因素編製。經核對 111 年期初現金及約當現金、銀行定期存款之餘額數 71,909 千元與 110 年度經會計師查核簽證之個別財務報告相符，且其所編製之現金收支預測表中，本次發行普通股之資金流入與本次資金運用計畫進度一致。整體而言，該公司申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編製基礎尚屬合理。

另，該公司並無對外公佈財務預測，故不適用現金收支預測表與財務預測之關聯性評估。

(5)公司最近年度及預計未來一年現金流量情形，說明其資金需求狀況與資金不足之時點及原因相關影響之必要性及合理性

就該公司編製 111 及 112 年度各月之現金收支預測表觀之，該公司自有資金尚稱充足，並無明顯資金缺口，然為配合承銷制度之規定，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯股票買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第 2 條，以現金增資發行新股之方式委託推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，故本次增資計畫確有必要性及合理性。

另該公司本次現金增資募集資金用於充實營運資金，將可強化財務結構、提升資金靈活調度之彈性，增加競爭力及降低企業財務風險，故本次增資計畫實有其必要性及合理性。

(6)前述現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

該公司於 111 年度及 112 年度現金收支預測表中，預計重大資本支出金額分別為新台幣 406,404 千元及 179,037 千元，主係因臺中精工廠區承接原位於林口廠區之雷射應用代工，故修繕改建既有廠區之無塵作業環境、增購雷射鑽孔設備因應非 PCB 產業之客戶訂單及預留部分產能外包服務之需求，合計為新台幣 585,441 千元，已逾本次募集金額之百分之六十(新台幣 111,475 千元)，茲就其必要性、預計資金來源及效益說明如下：

A.必要性：

該公司原雷射應用廠區為林口廠承租面積為 559 坪，可供容納設備台數 31，且建置達 16 年以上，故作業環境設施老舊且空間上狹小不具規模效益，該公司於

108 年度著手規劃於台中精工廠區增設可供容納 100 台設備之雷射服務區域，分別於 109 年度及 110 年度陸續完工下，該公司為精實費用及管理便利，故於 110 年度 9 月，已將林口廠區設備南遷至台中精工廠區，以滿足客戶加工環境需求，降低生產成本，此外，該公司雷射應用之設備，初期由該公司之技術人員調整改良他牌之雷射鑽孔機台約 60 臺，從事雷射鑽孔代工業務，惟該公司子公司大船企業日本株式會社(以下簡稱日本大船)，於 105 年度已成功開發自製之 CO2 雷射鑽孔設備(原型機)，於 106 年度陸續經過臺灣 PCB 板廠認證後，開始投入雷射代鑽孔服務，並將他牌設備汰換，故截至目前為止該公司設備自給率臺灣地區已達 100%，中國大陸地區尚有 9 台牌設備，預計於未來二年內汰換之。

綜上所述，該公司購置資本支出除考量原既有廠房空間不足、無塵室設備老舊外暨考量 ABF 載板需求暢旺將帶動雷射鑽孔需求大增及擴大雷射加工機台自主性，以及半導體、光電產業雷射鑽孔之製程所需，所應預留加工產能彈性，本次該公司雷射應用代工部門之精實計畫，所產生無塵室作業環境建置、因應非 PCB 產業客戶之租賃訂單及預留廠區部分產能可供外包服務之需求，故資本支出實有其必要性。

B.預計資金來源：

該公司營運產生之現金流入及金融機構借款支應，以該公司 111 年 2 月底銀行借款額度尚有 641,933 千元，另以 109 年及 110 年營運活動之現金流量分別為 346,398 千元及 371,219 千元觀之，其資金來源應屬可行。

C.效益說明：

該公司如依計畫完成擴增雷射鑽孔機設備，除有利於該公司有效提升營業額創造更高利潤外，就長期無形效益而言，滿足客戶加工產能需求、同時持續性的提供雷射事業加工服務可以穩固競爭優勢外，亦可藉由代工生產因應各種加工板材而調整機台參數之經驗回饋至子公司日本大船，可再精進雷射加工機台之性能，期待未來雷射鑽孔機及其加工服務成為客戶的首選品牌。

111年度

單位：新臺幣千元

項目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合計
期初現金餘額 1	71,909	102,382	152,440	80,902	73,984	78,017	83,471	85,934	86,575	89,248	88,354	87,148	71,909
加：非融資性收入 2													
應收款項收現	42,547	114,734	68,705	120,371	82,449	101,305	72,241	154,283	153,820	118,423	122,445	168,591	1,319,914
其他收現	3	2,251	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,301
合計	42,550	116,985	68,752	120,371	82,449	101,305	72,241	154,283	153,820	118,423	122,445	168,591	1,322,215
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	85,948	83,912	88,536	45,761	47,134	46,673	48,028	48,028	48,028	48,028	48,028	48,028	686,132
薪資	45,297	2,662	13,865	14,258	14,220	14,420	14,220	14,220	14,420	14,220	14,220	14,220	190,242
費用及其他付現	16,311	17,736	7,751	5,530	9,325	8,543	9,367	9,790	10,812	10,497	11,881	11,366	128,909
購置固定資產	14,184	48,622	25,231	38,195	82,037	50,624	35,731	13,936	27,234	22,875	35,210	12,525	406,404
利息費用及其他付現	698	829	3,418	805	14,070	1,091	6,347	805	14,233	805	4,908	954	48,963
員工紅利、董事酬勞	691	-	346	346	346	346	346	346	346	346	9,946	346	13,751
合計	163,129	153,761	139,147	104,895	167,132	121,697	114,039	87,125	115,073	96,771	124,193	87,439	1,474,401
要求最低現金餘額 4	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
所需資金總額 5=3+4	193,129	183,761	169,147	134,895	197,132	151,697	144,039	117,125	145,073	126,771	154,193	117,439	1,504,401
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	(78,670)	35,606	52,045	66,378	(40,699)	27,625	61	111,480	83,710	69,288	44,994	126,688	(110,277)
融資淨額 7													
發行新股	-	-	-	-	-	185,792	-	-	-	-	-	-	185,792
借款	151,052	86,834	(1,143)	(22,394)	88,716	(84,946)	44,261	(66,517)	(36,074)	(22,546)	542	(86,115)	51,670
現金股利						(75,000)							(75,000)
合計	151,052	86,834	(1,143)	(22,394)	88,716	25,846	44,261	(66,517)	(36,074)	(22,546)	542	(86,115)	150,850
期末現金餘額 8=1+2-3+7	102,382	152,440	80,902	73,984	78,017	83,471	85,934	86,575	89,248	88,354	87,148	82,185	82,185

資料來源：該公司提供。

112年度

單位：新臺幣千元

項目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合計
期初現金餘額 1	82,185	83,364	84,765	84,052	87,549	85,949	88,077	88,588	90,463	87,426	82,031	85,089	82,185
加：非融資性收入 2													
應收款項收現	138,378	98,542	139,276	121,226	118,351	122,712	131,036	104,055	116,660	132,963	137,837	140,062	1,501,098
其他收現	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	138,378	98,542	139,276	121,226	118,351	122,712	131,036	104,055	116,660	132,963	137,837	140,062	1,501,098
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	91,840	67,252	52,618	53,859	57,540	60,359	61,635	57,985	51,936	53,442	64,011	72,873	745,350
薪資付現	35,453	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	191,873
費用及其他付現	15,591	12,705	12,612	12,219	9,909	10,522	9,319	9,756	10,791	10,477	11,861	11,345	137,107
購置固定資產	5,132	14,813	10,264	15,396	20,528	25,660	20,528	15,396	10,264	15,396	10,264	15,396	179,037
利息費用及其他	1,000	1,000	1,000	1,000	24,103	1,000	1,000	1,000	17,552	1,000	1,000	1,000	51,655
員工紅利、董事酬勞	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	9,946	346	13,752
合計	149,362	110,336	91,060	97,040	126,646	112,107	107,048	98,703	105,109	94,881	111,302	115,180	1,318,774
要求最低現金餘額 4	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
所需資金總額 5=3+4	189,362	150,336	131,060	137,040	166,646	152,107	147,048	138,703	145,109	134,881	151,302	155,180	1,358,774
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	19,589	19,958	81,369	56,626	27,642	44,942	60,453	42,328	50,402	73,896	56,954	58,359	212,897
融資淨額 7													
發行新股													
借款	12,163	13,195	(48,929)	(20,689)	6,695	66,523	(23,477)	(3,477)	(14,588)	(43,477)	(23,477)	(23,477)	(103,015)
現金股利	-	-	-	-	-	(75,000)	-	-	-	-	-	-	(75,000)
合計	12,163	13,195	(48,929)	(20,689)	6,695	(8,477)	(23,477)	(3,477)	(14,588)	(43,477)	(23,477)	(23,477)	(178,015)
期末現金餘額 8=1+2-3+7	83,364	84,765	84,052	87,549	85,949	88,077	88,588	90,463	87,426	82,031	85,089	86,494	86,494

資料來源：該公司提供。

2.就對發行人申報年度財務槓桿、負債比率(或自有資產與風險性資產比率)、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，了解本次增資計畫之必要性及合理性

(1)就發行人申報年度財務槓桿及負債比率等相關影響，了解本次計畫之必要性及合理性

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	109年度	110年度
營業利益	135,323	156,629
利息費用	13,238	11,425
財務槓桿度(倍)	1.11	1.08
負債比率(%)	45.11	49.83

資料來源：該公司 109 年度 110 年經會計師查核簽證之個別財務報告

註：財務槓桿度=營業利益/(營業利益－利息費用)。

A.財務槓桿

財務槓桿指數係為衡量公司舉債經營之財務風險，用以評估利息費用之變動對於營業利益之影響程度。若公司未舉債經營，則財務槓桿度為 1，而該數值若為正數，顯示舉債經營仍屬有利，惟若財務結構不良，則易發生資金週轉困難而陷入財務危機，該項指標數值愈高表示公司所承擔之財務風險越大。該公司 109 年度及 110 年即便向金融機構舉借長短期借款，但其財務槓桿度均維持在 1 倍，尚稱穩定，未有信用過度擴張之情形。預計此次辦理現金增資以充實營運資金將降低公司財務負擔及資金調度壓力，避免未來因業績成長導致對營運資金需求增加而向銀行借款所產生之利息費用，並提升償債能力及公司競爭力，故該公司以現金增資發行新股應有其必要性及合理性。

B.負債比率

該公司 109 年度及 110 年度之負債比率分別為 45.11%及 49.83%，預計此次辦理現金增資以充實營運資金，將可降低負債比率，並強化財務結構以增加資金靈活調度彈性，故本次以現金增資發行新股用以充實營運資金，提高資金靈活運用空間並提升償債能力，確有其必要性及合理性。

(2)就公司營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，評估償債或充實營運資金之必要性及合理性

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	109年度	110年度
營業收入	844,725	1,110,429
營業淨利	135,323	156,629
本期淨利	89,295	91,064
每股盈餘(元)(註)	2.09	2.12

資料來源：該公司 109 年度及 110 年經會計師查核簽證之個別財務報告

註：係以當年度加權平均流通在外股數計算之每股稅後純益。

由上表得知，該公司近年營業收入及獲利能力表現尚稱穩健。該公司本次辦理現金增資發行普通股 5,806 千股，另於辦理公開承銷前有員工認股權憑證 173,713 股已執行完畢，故已發行股數為 43,187 千股，每股盈餘將因現金增資後股權稀釋比率為 11.85% (5,806 千股/(43,013 千股+173,713 股+5,806 千股)。考量該公司整體營運獲利均能維持一定水準，且本次辦理現金增資係用於充實營運資金，其將可強化財務結構、支應營運規模成長所需資金且維持公司之競爭力，整體而言對該公司營運發展係有正面之助益，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋影響應屬有限。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資發行新股對該公司財務槓桿、負債比率、營業收入及獲利能力皆有正面效益，且對每股盈餘稀釋效果尚無重大影響，故就降低其營運及財務風險、強化償債能力與提升市場競爭力而言，此次籌資具有其合理性。

3.增資計畫如用於償債者，取得該公司償債之相關明細，以了解原借款用途之必要性、合理性及顯現之效益

該公司本次募集資金計畫係用以充實營運資金，故不適用本項評估。

(三)本次增資計畫如用於償債者，取得該公司償債之相關明細，以了解原借款用途之必要性、合理性及顯現之效益。如原借款用以購買營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置該營建用地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度等項目，了解原借款用途之必要性及合理性。另就認列損益之時點與金額，了解預計可能產生效益之合理性及其效益是否顯現。原借款用途之必要性、合理性及顯現之效益

該公司本次辦理現金增資發行新股計畫並無用於償債之情事，故不適用本項評估。

(四)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於購置營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點與金額，評估可能產生效益是否具有合理性

該公司本次募集資金並非用於購買營建用地或支付營建工程款，故不適用本項評估。

四、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次辦理增資發行新股係採現金出資方式，故不適用本項評估。

五、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應就減資計畫等內容評估其可行性與合理性

該公司本次辦理增資發行新股係採現金出資方式，故不適用本項評估。

六、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格之訂定方式及對股東權益之影響

該公司非以低於票面金額辦理現金發行新股，故不適用本項評估。

七、發行人向金融監督管理委員會申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定辦理採彈性

訂定方式者，應評估下列事項：

- (一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性

該公司為申請初次上櫃公司，故不適用本項之評估。

- (二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認股，採全數詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第7條第1項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性，與暫定發行股數區間是否符合公司法第278條之規定

該公司為申請初次上櫃公司，故不適用本項之評估。

- (三)以現金增資發行普通股申請股票初次上市(櫃)案件向金融監督管理委員會申報(請)案件時應以合理之方式暫定發行價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

1.暫定價格之訂定

該公司於111年3月15日經董事會決議辦理現金增資發行新股5,806千股，每股面額10元，暫定每股之發行價格為新臺幣30元，係依一般市場承銷價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量法等股價評價方法及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，推算合理之承銷價格，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據。再參酌該公司所處產業、經營績效、競爭利基、產業未來發展前景及未來投資人認購意願等因素後，由本承銷商與該公司共同議定之。而實際每股發行價格待主管機關核准後，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，並依該公司實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，由推薦證券商與該公司共同議定最後實際發行價格。

2.募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

該公司於本案件生效後，若實際發行價格低於暫定發行價格，致募集資金不足時，將減少充實營運資金之金額，以自有資金支應，若本次現金增資實際發行時，如因競價拍賣結果之最後訂價變動，使得每股實際發行價格高於暫定承銷價格時，將維持原預定募集股數，並將高於原預定募集總金額全數用於充實營運資金，以進一步提高該公司流動比率及速動比率，降低負債比率及改善財務結構，進而強化公司長期競爭能力，其適法性及合理性於本評估報告「伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」皆已適法及合理。

- (四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明

該公司本次係辦理現金增資發行新股，非人民幣債券，故不適用本項評估。

八、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償還資金來源計畫之可行性、必要性及合理性(至少應包括到期償還之來源及如何取得人民幣等)

該公司本次係辦理現金增資發行新股，非人民幣債券，故不適用本項評估。

柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論。

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用此項評估。

捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用此項評估。

玖、評估本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用此項評估。

拾、就本次發行公司債債權確保情形蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用此項評估。

拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用此項評估。

拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用此項評估。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

無。

證券承銷商：康和綜合證券股份有限公司



負責人簽章：邱榮澄



中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 三 十 日

(僅限於達航科技股份有限公司辦理 111 年度現金增資發行新股證券承銷商評估報告使用)

公司印鑑：達航科技股份有限公司



負責人：翁榮隨

